



股票代碼：6953

家碩科技股份有限公司

(原名:家登自動化股份有限公司)

Gudeng Equipment Co., LTD.

公開說明書

(現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用)

一、公司名稱：家碩科技股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用

(一)發行新股來源：現金增資發行新股。

(二)新股種類：記名式普通股，每股面額新臺幣壹拾元整。

(三)股數：現金增資發行新股2,717,000股。

(四)金額：新臺幣27,170,000元整。

(五)發行條件：全額發行。

1. 本次現金增資發行普通股2,717,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣27,170,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣188.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格275.01元為之，並以均價高於最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股發行價格以新臺幣216.80元溢價發行。

2. 依公司法第267條規定，保留發行新股15%，計407,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%計2,310,000股全數委託證券承銷商對外辦理公開承銷。

3. 本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

(六)公開承銷比例：本次現金增資發行新股總數之85%，共計2,310,000股。

(七)承銷及配售方式：同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第53頁。

四、本次發行之相關費用：

(一)承銷費用：包括輔導費用及承銷手續等費用，約新臺幣500萬元整。

(二)審查費用：新臺幣50萬元。

(三)其他費用：包括會計師、律師及印刷等其他費用，合計約新臺幣240萬元整。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。另應註明參閱本文之頁次。請參閱本公開說明書第3~8頁。

八、本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，並計劃以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理上櫃前之公開銷售。

九、本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，掛牌後首五個交易日無漲跌幅之限制，投資人應注意交易之風險。

十、本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行安定操作。

十一、查詢本公開說明書之網址：

(一)請至公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

(二)公司揭露公開說明書相關資料之網址：<https://www.gdauto.com.tw>

家碩科技股份有限公司 編製

中華民國 113 年 4 月 26 日刊印



本公司申請已公開發行普通股股票上櫃乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心營業處所買賣有價證券審查準則」審查後，並以 113 年 3 月 28 日證櫃審字第 11301005321 號函同意俟本次現金增資發行新股公開銷售完畢後，列為上櫃股票。

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新臺幣元；%

實收資本額來源	金額	占實收資本額比例(%)
設立股本	17,500,000	6.41
現金增資	77,000,000	28.21
盈餘轉增資	178,476,000	65.38
合計	272,976,000	100.00

二、公開發行說明書之分送計畫：

(一)陳列處所：依規定檢送有關單位外，另陳列於本公司以供查閱。

(二)分送方式：依金融監督管理委員會證券期貨局規定辦理。

(三)索取方式：上述陳列處所或至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢及下載。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司	網址： https://www.yuanta.com.tw/
地址：臺北市中山區南京東路3段219號11樓	電話：(02)2718-1234
名稱：合作金庫證券股份有限公司	網址： https://www.tcfhc-sec.com.tw/
地址：臺北市大安區忠孝東路4段285號1樓	電話：(02)2752-8000
名稱：永豐金證券股份有限公司	網址： https://securities.sinopac.com/
地址：臺北市中正區重慶南路1段2號7、18及20樓	電話：(02)2311-4345
名稱：凱基證券股份有限公司	網址： https://www.kgi.com.tw/zh-tw/
地址：臺北市中山區明水路698號3樓、700號3樓	電話：(02)2181-8888

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部	網址： https://www.yuanta.com.tw
地址：臺北市大同區承德路三段210號地下一樓	電話：(02)2586-5859

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：曾建銘、王攀發	網址： https://www2.deloitte.com/tw
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所	電話：(02)2725-9988
地址：臺北市信義區松仁路100號20樓	

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

律師名稱：邱雅文律師	
事務所名稱：翰辰法律事務所	網址： http://www.fsi-law.com
地址：臺北市信義區松德路6號12樓	電話：(02)2345-0016

十二、公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：石惠文	電子信箱： IR@gdauto.com.tw
職稱：財務行政處經理	電話：(03)550-6279
代理發言人姓名：陳毓正	電子信箱： IR@gdauto.com.tw
職稱：業務處副總經理	電話：(03)550-6279

十三、公司網址：<https://www.gdauto.com.tw>

發行人之產業、營運及其他重要風險

一、產業風險(請參閱第 41~42 頁)

(一)景氣循環之營運風險

本公司產品應用於微影製程之光罩相關半導體設備及相關零組件，主要銷售予晶圓代工廠及記憶體廠，因此本公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運受半導體產業資本支出需求狀況所影響。半導體市場受景氣循環影響、且產品需求變化快速，故晶圓製造商若面臨不景氣或是產能過剩的狀況，不僅調降資本支出也將會削減對本公司之下單致影響營收及獲利。

因應對策

- (1)本公司具備多年設備開發設計及製造經驗，已累積豐富的實績，並擁有多項專利，本公司除了加強生產製程管理，提高產品品質與效率，以降低生產成本，促進有效經營管理方式，另外，持續投入優化產品設計開發，加強產品技術與終端客戶技術需求開發，以擴大新產品開發領域，滿足新客戶產品需求。
- (2)本公司產品應用領域廣泛，目前除應用在如晶圓代工廠、DRAM 製造廠，也陸續拓展半導體後段製造及工廠自動化智能製造等，另以既有產品提升功能規格，積極開發新產品，藉由適當調整經營策略並拓展新業務，期在經濟環境及產業變化下，公司營運能持續成長。

二、營運風險(請參閱第 42~43 頁)

(一)專業人才取得與留任面臨挑戰

臺灣地緣風險提高，各國期盼半導體產業在地化，使全球爭奪半導體技術人才情形加劇，且面臨國內理工科畢業生逐年下滑，本公司之規模及品牌能見度不及國內大型科技企業與國際大廠，此外由於本公司生產據點位於南部，距離如竹科等半導體產業聚落較遠，人才招募上較為不易。

因應對策

本公司申請股票上櫃以提高企業知名度，吸引優秀人才；推行人性化管理制度，建立以績效導向之激勵機制並順暢升遷管道，同時，持續優化各項福利制度，致力創造愉快又有競爭力的工作環境，凝聚員工對公司的向心力，並增加員工留任率。

(二)銷貨集中

隨著 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，各產業為提升自身競爭力，致力生產技術升級與深化自動化製造技術，故近年來半導體代工業者擴大先進製程與產能規模，帶動資本支出預算陸續增加。然半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡佔的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致本公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象

仍然有限，且本公司考量整體營運規模，選擇優先滿足領導大廠資本支出需求，而出現銷貨集中之情事。

因應對策

(1)技術延伸至新產品或新市場開發

本公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用本公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境管理設備需求與日俱增趨勢，本公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

(2)鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，本公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，本公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外本公司與其長期合作的關係，且本公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場具領導地位，本公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為本公司帶來廣大的客戶效益，有助於本公司銷售策略之運用。

(3)積極開發其他客戶

本公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。本公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展本公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

三、其他重要風險(請參閱第 3~8 頁)

本公司其他重要風險請詳本公開說明書「壹、二、風險事項」之說明。

綜上所述，本公司已就產業、營運及其他重要風險三方面，分別予以評估其各項可能風險之因應措施，本公司已具備降低風險之能力，各項因應措施尚屬允當。

四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項：

(一)貴公司銷貨集中於主要客戶 A 集團(含透過 B 集團及 M 集團間接銷售)，最近二年度及 112 年前三季對該等客戶之銷售比重分別達 78.25%、73.36%及 54.28%，有關貴公司銷貨集中之原因、風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

公司說明：

1.銷貨集中之原因

(1)半導體產業特性

根據集邦科技(TrendForce)旗下拓璞產業研究院進行的調查，111 年第四季全球晶圓代工的市占率排名前三名分別為台積電、三星及聯電，此前三名業者市占

率合計占 80.6%，顯示半導體製造屬高度寡占市場，半導體設備廠商之銷售對象有限，晶圓代工產能集中於少數晶圓大廠，其中 A 集團持續推進先進製程並保持業界技術領先地位，近年來資本支出金額為業界最高，本公司銷貨集中於 A 集團，乃產業特性所致。

由於半導體為技術與資本密集行業，晶圓代工產業集中於少數晶圓大廠，經檢視半導體設備供應商之京鼎及華景電 111 年度對其第一大銷售客戶之銷售比重分別為 82.98%及 69.92%，顯示本公司銷貨集中現象，與同業相較係符合產業特性。

(2) 半導體設備進入門檻高，且供應鏈更換不易

A 集團對晶圓製造環境的污染控制要求甚高，廠商一旦成為其合格供應商後，除非所提供之服務或品質發生嚴重瑕疵，否則 A 集團更換供應商之可能性甚低，且 A 集團要採用其他供應商，必須先通過認證且機台各式規格不同也需逐一認證，所需耗費時間及成本可觀。近年來，A 集團對於光罩潔淨度要求越趨嚴格，本公司自 105 年起與 A 集團合作開發，針對 A 集團需求開發光罩相關之微環境機器設備，產品通過 SEMI 相關驗證，經長年合作，品質與交期深獲客戶肯定。本公司於半導體機台所需之光罩相關微污染防治設備客製化設計能力強，以提供客製化服務來穩固產品與 A 集團之密切合作關係，在技術、品質、成本及交期均能滿足 A 集團需求，故得以維持長期穩定之供應鏈關係，且 A 集團亦滿意本公司提供之服務，進而使本公司銷貨集中於 A 集團。

綜上所述，隨著客戶需求攀升，致本公司對 A 集團之銷貨金額(包含透過 B 集團及 M 集團銷售)逐年成長，此乃該客戶在市場具有領先之地位，對相關產品亦有一定的需求，本公司在半導體領域耕耘多年，秉持提供客戶客製化服務，強化競爭利基並獲致客戶的肯定，也陸續反映在公司近年的營收規模增長。因此除 A 集團外，本公司亦積極開發新客戶及新型全自動機台，隨著新客戶、認證產品之增加，期以提高本公司營業收入金額以逐步降低對單一客戶銷售之比重。

2. 銷貨集中之風險

(1) 更換供應商的風險或倒帳的風險

半導體前端製程產業擁有技術不斷創新及市場參與者寡占的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，致本公司主要銷貨對象雖為半導體產業國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，而出現銷貨集中之情事，若主要客戶出現更換供應商或倒帳情形，將對公司營運產生重大影響。本公司產品推出前，會依 A 集團製程所需規格進行客製化設計，產品驗證期間 A 集團亦需投入相關人力、廠務成本及提供光罩進行設備之驗證測試，故經重點客戶採用後，以客戶觀點考量其已投入的時間成本，除非有重大產品品質問題否則不會輕易更換供應商，影響其產線之運作。

另檢視本公司對 A 集團、B 集團及 M 集團之收款條件、應收帳款帳齡及收回情形，本公司於出貨後即收取銷貨金額 80%之出機款，設備驗收後收取尾款銷貨金額之 20%，應收帳款未曾發生逾期而無法收回之情形，加上前開客戶均為財務健全且營運良好之國際大廠，故其對本公司應收帳款倒帳風險尚低。

(2)因品質而被抽單的風險

考量半導體設備進入門檻高及產業特性，廠商一旦成為其合格供應商後，除非所提供之服務或品質發生嚴重瑕疵，否則客戶更換供應商之可能性甚低；一座 Fab 廠約上千機台設備且幾乎是歐美日十數家國際設備廠所囊括，尤其是晶圓廠內一台動輒數億的機台，搭配的相關客製化機台零組件雖然造價相對較低，但附屬機台若無法與主製程設備良好搭配，亦會影響晶圓廠的生產良率，因此供應商若因產品品質問題將可能面臨抽單風險。

因不同設備有不同驗收規格，產品通過客戶嚴峻之品質考驗，並配合開發客製化產品，同時具備售後維護的能力且價格具競爭力。因此，透過公司內部之人員訓練維持產品品質及提升客製化服務，增加本公司與 A 集團的緊密度，藉此降低供應商更換或因品質而被抽單之風險。

3.銷貨集中之因應措施

(1)技術延伸新產品開發

本公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展業務市場，除深耕半導體晶圓代工廠外，亦擴展至半導體封裝及記憶體廠等，以期將觸角延伸至不同領域。本公司擁有設備業經驗豐富的專業人才且長期與客戶配合，客戶遇到問題時會優先與本公司討論，本公司透過持續掌握客戶需求，發現潛在光罩相關之半導體功能設備之開發方向，有助於開拓未來商機，目前已針對客戶需求開發光罩清洗機、光罩交換機及 EIP 檢查機等，亦積極開發 AOI 光罩檢測機器設備，以期解決客戶需求並為公司帶來新的營收動能。

(2)鞏固與客戶之密切合作關係

本公司產品經客戶技術認證，打入多家國際半導體供應鏈，與客戶建立長期合作關係，客戶有任何需求皆會尋求本公司之協助。本公司主要業務係針對客戶需求開發光罩相關之各式功能性機器設備，於新竹及台南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，故獲得客戶肯定持續下單採購，因主要客戶在半導體市場之領導地位，本公司也因此參與前瞻技術之機會，藉由客戶需求之解決提升本身技術能力，增加與客戶之黏著度。

(3)積極開發其他客戶

本公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展 A 集團以外之半導體代工廠及記憶體廠，另亦持續推廣產品應用於不同產業，包括半導體封裝、面板產業及光罩廠等，以期將觸角延伸至不同領域。本公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。本公司逐步推廣光罩潔淨相關之半導體機器設備，以提升及拓展本公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

推薦證券商說明：

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季對 A 集團(含透過 B 集團及 M 集團銷售)之銷售比重分別為 78.25%、73.36%及 54.28%，有銷貨集中之情形。該公司自 105 年起與 A 集團合作開發，針對客戶需求開發光罩相關之微環境機器設備，經長年合作，不論品質深獲肯定及準時達交率高，且產品皆已通過安全性認證，加

上該公司於半導體機台所需之光罩相關微污染防治設備客製化設計能力強，以提供客製化服務來穩固產品與客戶之密切合作關係，在技術、品質、成本及交期均能滿足客戶需求且較同業具有優勢下，故得以維持長期穩定之供應鏈關係，且客戶亦滿意其提供之服務，進而使得該公司有銷貨集中於 A 集團之情形。經本推薦證券商檢視該公司之股東名冊及轉投資組織圖，並訪談該公司財務行政處經理，該公司與 A 集團並無任何投資關係，亦非屬該公司關聯企業，且該公司積極開發新型機台及拓展客戶，以降低銷貨集中風險，經評估尚無重大異常之情事。

(二)貴公司主要產品係半導體微影製程所衍生之周邊設備，非屬主製程設備，需求主要來自客戶新建廠房或擬提升現有廠房之光罩潔淨度所產生，有關貴公司營收受主要客戶資本支出波動影響之風險、所採具體因應措施及如何維持競爭優勢之說明，暨推薦證券商之評估意見。

公司說明：

1.面臨營收受主要客戶資本支出波動影響之風險

本公司主要產品光罩儲存櫃，及光罩清洗、交換及檢查等設備，係屬半導體微影製程中所衍生之周邊設備，目的為協助維持光罩之潔淨程度，非直接應用於微影製程之主製程設備，故本公司相關設備非屬客戶需周期性採購更替之設備，需求主要來自於客戶新建廠房或擬提升現有廠房之光罩潔淨程度所產生，其中儲存櫃可能視客戶廠房空間規劃有不同數量及規格之需求，光罩清洗、交換及檢查等設備則依各廠區晶圓產量而不同配置相關設備。

本公司產品之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運受半導體產業資本支出需求狀況所影響，半導體市場受景氣循環影響且產品需求變化快速，故晶圓代工廠或記憶體廠若面臨不景氣或產能過剩之狀況，可能會調降資本支出並削減對本公司之訂單，致影響本公司營收及獲利。

2.本公司所採具體因應措施

(1)隨著網路、資料中心、5G 智慧手機，以及其他高度成長市場如自駕車、駕駛輔助系統、人工智慧、機器學習及影像識別等應用對於先進製程的強勁需求，在晶圓代工製程不斷演化進步下，使單片晶圓 EUV 曝光光罩層數快速提升，光罩需求日益提高，其中先進邏輯製程晶圓 110 年 EUV 曝光層數平均已逾 10 層，至 112 年增加到逾 20 層，且光罩造價越來越高，光罩保存的需求將持續成長，即使本公司可能面臨受景氣循環影響的風險，惟半導體晶圓製程進步的腳步是不停歇，若固守原有的技術，將失去產業競爭力，故可預期整體半導體晶圓製造的技術將持續精進，本公司光罩儲存櫃之需求亦將持續存在。

(2)本公司具備多年設備開發設計及製造經驗，已累積豐富實績並擁有多項專利，除加強生產製程管理，提高產品品質與效率，以降低生產成本外，並持續投入優化產品設計開發，亦積極拓展新產品領域及新客戶，以期減低景氣波動帶來之相關影響。

3.如何持續維持競爭優勢之說明

(1)自行研發並掌握核心技術

A.獨立儲位並複合充氣穩壓技術及溫溼度控制

本公司依不同製程光罩之特性與其載具個別設計其儲存裝置所需之機構及料件，另獨立儲位之設計亦可確保儲存設備之潔淨度及避免微塵粒子有交叉污染之情形，此外，透過精密的溫濕度控制確保光罩儲存環境之穩定性，避免光罩於儲存期間有汙染或損壞情形。

B.針式風刀、微潤水洗及真空抽吸設計

光罩之正反面分別為薄膜面及玻璃面，本公司針對薄膜面及玻璃面個別開發出不同清潔模式，光罩薄膜面極其脆弱，故開發針式風刀設計，光罩玻璃面則採微潤水洗方式，除光罩玻璃面外亦可同時清潔光罩兩側區域。另外搭配真空抽吸設計，對光罩表面微塵進行清潔，經由不同方式之交互清潔大大提升光罩之潔淨度。

C.整合設備功能性需求，增加設備附加價值及提升自動化

本公司除光罩儲存及光罩清潔設備外，亦同時開發有光罩交換設備，透過與客戶之緊密溝通瞭解其需求，將不同功能之設備進行整合，增加設備之附加價值，以提升客戶廠區設備空間效率及工廠自動化升級。此外，針對光罩交換開發專利夾頭，以確保光罩傳輸之防護及安全，另增加機器手臂在夾取交換功能外之目檢操作之多功能性，使設備於有限空間之效益最大化。

(2)透過專利佈局規劃避免同業競爭風險

本公司之技術主要來自於解決客戶問題研發出之各項解決方案，並透過專利佈局規劃進一步保障在市場銷售之自由度，免於被訴訟，以及設法阻卻競爭者。目前本公司已取得之專利(含領證中)共計 48 項，其中包含發明專利 32 項及新型專利 16 項，地區涵括臺灣 29 項、美國 13 項、新加坡 2 項、韓國 1 項、中國大陸 3 項。另外，申請中發明專利 17 項，申請地區包括臺灣 7 項、美國 9 項及中國大陸 1 項，申請中之專利主係與本公司重點研發方向相關。

本公司專利佈局規劃將持續以保護核心產品之核心技術為主要方向，專利佈局策略以綿密的申請案，有系統性地在產品或製程的每一態樣或步驟中佈滿專利來提高競爭門檻，保護市場及提升企業競爭力與企業價值。

(3)持續擴展公司的技術能量

本公司擁有多項透過解決客戶問題研發出之各項核心技術，透過持續與客戶溝通及在半導體製程中技術應用的多元化及產學合作等方式，可持續確保公司產品之競爭力，另透過多角化之產品應用整合提升自身產品價值，並進一步培育公司核心技術人才。

(4)產品取得客戶認證

半導體設備具有高技術門檻且認證不易之特性，使得欲切入半導體廠之合格供應商體系，需經相當時間之溝通配合及技術驗證，建立與客戶間之信任關係，故一旦獲得客戶採用，對其他供應商之進入造成一定之門檻，而透過前期產品開

發及售後服務增進與客戶之黏著度，加上本公司之技術能力，自 105 年起已打入全球晶圓製造領導廠商 A 集團之供應鏈，並持續交易且為本公司主要客戶之一。

(5)與客戶建立夥伴關係且透過合作開發產品增進黏著度

本公司已與客戶建立長期合作的關係，客戶有任何需求皆會尋求本公司之協助，本公司產品及技術係透過與國內外半導體大廠充分溝通討論，提供其完善技術方案，並針對客戶需求開發功能性機器設備，除在開發設計過程中與客戶建立互信之合作夥伴關係外，本公司於新竹及台南地區設置營運據點，在設備售後提供完善且即時之技術支援，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，能第一手獲得客戶生產需求之相關問題，進而改善後續出貨設備良率並為未來產品開發提供不同想法取得開發新產品之先機，故獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場具領導地位，本公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，強化對客戶之黏著度。

(6)發揮集團資源綜效

本公司透過內部人員訓練維持產品品質及提升客製化服務，並與母公司家登精密策略合作開發光罩載具相關之解決方案，一同至客戶端廠內進行驗證測試，以發揮集團資源之綜效。本公司亦為家登精密聯手 9 家半導體在地供應鏈聯盟之一員，未來除了服務台灣之外，也將前進美國市場，預計要再擴展到歐洲、日本，期透過聯盟合作關係擴大海外銷售及維修等業務。

推薦證券商說明

推薦證券商經參閱產業研究報告、採樣同業之公開說明書及股東會年報，並與該公司經營團隊訪談以瞭解該公司及其所屬產業特性，及受主要客戶資本支出波動影響之風險，惟隨終端應用對於先進製程的強勁需求，使單片晶圓使用的光罩層數量持續增加，亦持續配合客戶需求積極優化其產品技術，並開發新產業的應用或是推廣至新客戶，應尚可降低主要客戶資本支出波動影響之風險。另該公司透過自行研發的光罩儲存櫃及清洗機設計專利，及整合設備功能性需求提升附加價值，並透過專利佈局規劃提高競爭門檻，對既有技術持續改良與優化，該公司未來將持續透過與客戶保持密切合作及與學術界和研究機構之產學合作，開發符合市場需求之產品，亦藉由合作過程推進技術研發且可節省陌生開發之時間，並結合自有研發量能，擴大新產品開發領域，持續開發具競爭力之產品，應尚可維持其競爭力，尚無重大異常之情事。

家碩科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：272,976,000 元		公司地址：新北市土城區中央路 4 段 2 號 8 樓之 5		電話：(03)550-6279	
設立日期：民國 105 年 07 月 18 日			網址：https://www.gdauto.com.tw		
上市日期：不適用		上櫃日期：不適用		公開發行日期：112 年 3 月 30 日	
管理股票日期：不適用		負責人：		董事長：邱銘乾	
		總經理：詹印豐		發言人姓名：石惠文	
				代理發言人：陳毓正	
				職稱：財務行政處經理	
				職稱：業務處副總經理	
股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部			電話：(02)2586-5859		
地址：臺北市大同區承德路三段 210 號地下一樓			網址：https://www.yuanta.com.tw		
股票承銷機構：元大證券股份有限公司		電話：(02)2718-1234		網址：https://www.yuanta.com.tw/	
合作金庫證券股份有限公司		地址：臺北市中山區南京東路 3 段 219 號 11 樓		電話：(02)2752-8000	
永豐金證券股份有限公司		地址：臺北市大安區忠孝東路 4 段 285 號 1 樓		網址：https://www.tcfhc-sec.com.tw/	
凱基證券股份有限公司		電話：(02)2311-4345		網址：https://securities.sinopac.com/	
		地址：臺北市中正區重慶南路 1 段 2 號 7、18 及 20 樓		電話：(02)2181-8888	
		地址：臺北市中山區明水路 698 號 3 樓、700 號 3 樓		網址：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/	
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所			電話：(02)2725-9988		
曾建銘、王攀發會計師			地址：臺北市信義區松仁路 100 號 20 樓		
複核律師：翰辰法律事務所			電話：(02)2345-0016		
邱雅文律師			地址：臺北市信義區松德路 6 號 12 樓		
信用評等機構：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
評等標的		發行公司：不適用		評等日期：不適用	
		本次發行公司債：不適用		評等日期：不適用	
				評等等級：不適用	
				評等等級：不適用	
董事選任日期：112 年 5 月 31 日，任期：三年			監察人選任日期：成立審計委員會，故不適用。		
全體董事持股比例：58.30%(113 年 3 月 24 日)			全體監察人持比率：成立審計委員會，故不適用。		
董事、持股超過 10%股東及其持股比例：58.30%(113 年 3 月 24 日)					
職稱	姓名	持股比例	職稱	姓名	持股比例
董事長	家登精密工業(股)公司	47.19%	獨立董事	李文中	0.00%
	代表人：邱銘乾	2.80%			
董事	家登精密工業(股)公司	47.19%	獨立董事	林秀怡	0.00%
	代表人：林添瑞	2.80%			
董事	詹印豐	5.51%	獨立董事	陳瑞杏	0.00%
董事	胡瑞卿	0.00%	10%以上大股東	家登精密工業(股)公司	47.19%
工廠地址：臺南市新市區紫棟路 17 號 4 樓之 2				電話：(06)589-2558	
主要產品：半導體設備及相關零組件		市場結構：(112 年度)		參閱本文之頁次	
		內銷 72.84%、外銷 27.16%		第 39 頁	
風 險 事 項		詳本公開發行說明書風險事項之說明		參閱本文之頁次	
				第 3 頁~第 8 頁	
去 (1 1 2) 年 度		合併營業收入：1,207,145 千元		第 63 頁	
		合併稅前純益：277,315 千元			
		稅後基本每股盈餘：8.36 元			
本次募集發行有價證券種類及金額		請參閱本公開說明書封面			
發行條件		請參閱本公開說明書封面			
募集資金用途及預計產生效益概述		請參閱本公開說明書第 53 頁			
推薦證券商執行過額配售及穩定價格之相關訊息		本公司已與主辦證券承銷商簽訂過額配售協議書，並已協調特定股東，就其所持有本公司之股票，於掛牌日起六個月內，送存臺灣集中保管結算所股份有限公司集保並不得賣出，以維持承銷價格穩定。			
本次公開發行說明書刊印日期：113 年 4 月 26 日			刊印目的：現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用		
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄					

家碩科技股份有限公司

公開說明書目錄

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項.....	1
貳、公司概况.....	2
一、公司簡介.....	2
(一)設立日期.....	2
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話.....	2
(三)公司沿革.....	2
二、風險事項.....	3
(一)風險因素.....	3
(二)訴訟或非訟事件.....	6
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響.....	8
(四)發行人於最近一會計年度或申請上櫃會計年度內，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，或推薦證券商認為對發行人財務報告有重大影響者，應增列其風險事項說明.....	8
(五)外國發行人申請股票登錄興櫃或第一上櫃者，應增列敘明外國發行人註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施.....	8
(六)其他重要事項.....	8
三、公司組織.....	9
(一)組織系統.....	9
(二)關係企業圖.....	10
(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管.....	11
(四)董事資料.....	12
(五)發起人資料.....	17
(六)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	18
(七)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司之職務、與發行人董事之關係及對發行人實質控制情形，另外國發行人並應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任..	23
四、資本及股份.....	23
(一)股份種類.....	23

(二)股本形成經過	23
(三)最近股權分散情形	24
(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	28
(五)公司股利政策及執行狀況	29
(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	29
(七)員工、董事及監察人酬勞	29
(八)最近三年度及截至公開發行說明書刊印日止公司買回本公司股份情形	30
五、公司債(含海外公司債)辦理情形	30
六、特別股辦理情形	30
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形	30
八、員工認股權憑證辦理情形	30
九、限制員工權利新股辦理情形	30
十、併購辦理情形	30
十一、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者辦理情形	30
參、營運概況.....	31
一、公司之經營	31
(一)業務內容	31
(二)市場及產銷概況	39
(三)最近二年度從業員工人數	45
(四)環保支出資訊	46
(五)勞資關係	46
(六)資通安全管理	47
(七)公司及其子公司於申請上櫃年度及其前二年度如有委託單一加工工廠於年度內 加工金額達五千萬元以上者，應增露該加工工廠之名稱、地址、電話、董事成 員、持股百分之十大股東及最近期財務報表	48
(八)有無爭訟事件，及勞資間關係有無尚須協調之處	48
(九)有無因應景氣變動之能力	48
(十)關係人間交易事項是否合理	48
(十一)如其事業係屬生物技術工業、製藥工業或醫療儀器工業者，應增列其依法令 取得主管機關許可進行人體臨床試驗或田間實驗者或在國內從事生物技術工 業或醫療儀器工業研究發展，且已有生物技術或醫療儀器相關產品製造及銷 售或提供技術服務之實績暨最近一年度產品及相關技術服務之營業額、研究 發展費用所占該公司總營業額之比例情形	48
(十二)公司如於提出上櫃申請前一年度因調整事業經營，終止其部分事業，或已將 其部分之事業獨立另設公司、移轉他公司或與他公司合併者，應分別予以記 載說明其終止、移出或合併之事業暨目前存續之營業項目，並提出目前存續 營業項目前一年度之營業額、研究發展費用占公司該年度總營業額之比例情 形	49

二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產	49
(一)自有資產	49
(二)使用權資產	49
(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率	49
三、轉投資事業	50
(一)轉投資事業概況	50
(二)綜合持股比例	50
(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響.....	50
(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數.....	50
(五)於已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者，應增列該投資事業之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表.....	50
四、重要契約	50
肆、發行計畫及執行情形.....	52
一、前次現金增資、併購或受讓其他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析 ...	52
二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫分析 ...	53
三、本次受讓其他公司股份發行新股情形	61
四、本次併購發行新股情形	61
伍、財務概況.....	62
一、最近五年度簡明財務資料	62
(一)簡明資產負債表及綜合損益表	62
(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響.....	66
(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見	66
(四)本國發行人自公開發行後最近連續七年或外國發行人最近連續七年由相同會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施.....	66
(五)外國發行人申請股票登錄興櫃者，得僅列示最近二年度之財務資料;外國發行人申請股票第一上櫃者，得僅列示最近三年度之財務資料.....	66
(六)財務分析	67
(七)會計項目重大變動說明	71
二、財務報告應記載事項	73
(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告.....	73

(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告	73
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露.....	73
三、財務概況及其他重要事項應記載事項	73
(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響.....	73
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露下列資訊.....	73
(三)期後事項	73
(四)其他	73
四、財務狀況及經營結果之檢討與分析	74
(一)財務狀況分析	74
(二)財務績效分析	75
(三)現金流量	76
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響	76
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	76
(六)其他重要事項	77
陸、特別記載事項.....	78
一、內部控制制度執行狀況	78
(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議	78
(二)最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形	78
(三)內部控制聲明書	78
(四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形.....	78
二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告.....	78
三、證券承銷商評估總結意見	78
四、律師法律意見書	78
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	78
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形.....	78
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會證券期貨局通知應補充揭露之事項.....	78
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形.....	78
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容.....	78

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形.....	78
十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書.....	78
十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書....	78
十三、本國發行人自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書.....	78
十四、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常規交易情事之書面承諾，及其重要業務之政策.....	78
十五、發行人是否有與其他公司共同使用申請貸款額度.....	78
十六、發行人有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人.....	78
十七、發行人申請公司債上櫃者，應說明公司債本金及利息償還之資金來源，暨發行標的或保證金融機構之信用評等等級、評等理由及評等展望等信用評等結果.....	78
十八、發行人有財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查準則第十條第一項第四款或外國審查準則第九條第一項第三款情事者，應將該重大未改善之非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會.....	79
十九、充分揭露發行人與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式.....	79
二十、發行人分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響.....	79
二一、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明.....	79
二二、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見.....	79
二三、其他必要補充說明事項.....	79
(一)有關貴公司對業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見.....	79
(二)貴公司近期研發人員離職率高且平均服務年資短，有關貴公司如何提升研發能量，以因應未來產品布局之說明，暨推薦證券商之評估意見.....	98
二四、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項.....	100
(一)董事會運作情形.....	100
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形.....	103
(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因.....	105
(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形...109	
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原	

因；符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊.....	110
(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	112
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式	114
(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財 務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總....	114
(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露	114
柒、重要決議、公司章程及相關法規.....	115
一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)..	115
(一)與本次發行有關之決議文	115
(二)公司章程(含章程修正條文對照表).....	115
(三)盈餘分配表	115
二、未來股利發放政策	115
三、截至公開說明書刊印日止之背書保證相關資訊.....	115
附件一、111 年度合併財務報告暨會計師查核報告	
附件二、112 年度合併財務報告暨會計師查核報告	
附件三、111 年度個體財務報告暨會計師查核報告	
附件四、112 年度個體財務報告暨會計師查核報告	
附件五、內部控制制度聲明書	
附件六、內部控制制度審查報告	
附件七、證券承銷商評估總結意見	
附件八、律師法律意見書	
附件九、不得退還或收取承銷相關費用聲明書	
附件十、無非常規交易情事之聲明書	
附件十一、不受理特定對象投標聲明書	
附件十二、誠信聲明書	
附件十三、與本次發行有關之決議文	
附件十四、盈餘分配表	
附件十五、公司章程及新舊條文對照表	
附件十六、股票初次上櫃證券承銷商評估報告	
附件十七、股票上櫃前現金增資發行新股之證券承銷商評估報告	
附件十八、承銷價格計算書	

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項

一、風險事項乙節：

(一)貴公司銷貨集中於主要客戶 A 集團(含透過 B 集團及 M 集團間接銷售)，最近二年度及 112 年前三季對該等客戶之銷售比重分別達 78.25%、73.36%及 54.28%，有關貴公司銷貨集中之原因、風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

(二)貴公司主要產品係半導體微影製程所衍生之周邊設備，非屬主製程設備，需求主要來自客戶新建廠房或擬提升現有廠房之光罩潔淨度所產生，有關貴公司營收受主要客戶資本支出波動影響之風險、所採具體因應措施及如何維持競爭優勢之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱公開說明書「產業、營運及其他重要風險」之說明。

二、特別記載事項乙節：

(一)有關貴公司對業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見。

(二)貴公司近期研發人員離職率高且平均服務年資短，有關貴公司如何提升研發能量，以因應未來產品布局之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱公開說明書「陸、二十三、其他必要補充說明事項」之說明。

貳、公司概況

一、公司簡介

(一)設立日期：民國 105 年 7 月 18 日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

名稱	地址	電話
總公司	新北市土城區中央路 4 段 2 號 8 樓之 5	(03)550-6279
新竹辦公室	新竹縣竹北市嘉豐 11 路一段 117 號	(03)550-6279
工廠(樹谷園區)	臺南市新市區紫棟路 17 號 4 樓之 2	(06)589-2558

(三)公司沿革

年 度	重要紀事
105	<ul style="list-style-type: none">➢ 公司設立，實收資本額 17,500 千元。➢ EUV 微環境充氣製程技術研發，並成功導入到 EUV 製程市場。
106	<ul style="list-style-type: none">➢ 現金增資 17,000 千元，累計實收資本額 34,500 千元。
107	<ul style="list-style-type: none">➢ 開發光罩儲存管理設備，成功導入國際大廠應用。
108	<ul style="list-style-type: none">➢ 成功開發高階光罩潔淨設備，取得 SEMI S2 認證並導入市場應用。➢ 開發光罩交換設備，成功導入國際大廠應用。
109	<ul style="list-style-type: none">➢ 盈餘轉增資 20,700 千元，累計實收資本額 55,200 千元。➢ 成功開發 EUV 微環境充氣倉儲，技術延伸整合廠區管路系統。➢ 擴廠搬遷至臺南樹谷園區。➢ 收購昇和精技(股)公司，業務觸角延伸至 PVD 真空鍍膜及相關設備技術。
110	<ul style="list-style-type: none">➢ 登記資本額變更為 5 億元，盈餘轉增資 55,200 千元，累計實收資本額 110,400 千元。➢ 推出 EUV 光罩智慧檢測設備，取得 SEMI S2 認證並導入市場應用。➢ 成功開發 EUV 光罩高潔淨技術，取得國際客戶認證，導入應用。➢ 領先業界開發光罩傳送驛站，導入美系半導體大廠之製造整合應用。
111	<ul style="list-style-type: none">➢ 成功開發 EUV 光罩交換與長期儲存方案，取得 SEMI S2 認證並導入市場應用。➢ 成功以 EUV 光罩交換設備導入美系記憶體大廠應用。➢ 推出 EUV 倉儲整合自動化系統，導入國際大廠應用。➢ 產品及技術服務拓展至國際大廠之美洲及東亞廠區。➢ 產品及技術服務拓展至美系大廠之東南亞廠區。➢ 盈餘轉增資 55,200 千元，累計實收資本額 165,600 千元。➢ 現金增資 60,000 千元，累計實收資本額 225,600 千元。
112	<ul style="list-style-type: none">➢ 公司更名為家碩科技股份有限公司。➢ 產品及技術服務拓展至美系大廠之歐洲及西亞廠區。➢ 盈餘轉增資 47,376 千元，累計實收資本額 272,976 千元。

二、風險事項

(一)風險因素

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動影響對公司損益之影響及未來因應措施

本公司111~112年度利息收入與支出淨額占年度營業收入淨額分別為0.09%及0.81%，所佔比例微小，故利率變動對本公司損益尚無重大影響。本公司定期評估貨幣市場利率及金融資訊，以適時採取適當之因應措施，並視其資金成本之高低及可能之報酬與風險，選擇最有利之資金運用方式，以降低利率變動之風險。

(2)匯率變動影響對公司損益之影響及未來因應措施

本公司111~112年度淨外幣兌換(損)益淨額占年度營業收入淨額分別為1.12%及0.48%，本公司進銷貨計價以新臺幣為主，匯率變動對本公司損益影響尚屬有限。

本公司因應匯率變動的風險，財務部門定期收集匯率資訊，隨時與銀行保持密切聯繫，以期充分掌握匯率走勢，並視匯率變動情形適時調整外匯持有部位，以降低匯率變動所造成之影響。

(3)通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司產品並非民生基本消費品，因此通貨膨脹情形對本公司損益尚無重大影響。未來將持續密切觀察物價指數變化，視通貨膨脹對本公司的影響，機動調整產銷策略，以降低因通貨膨脹對本公司之影響。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

(1)從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司專注本業經營，最近年度及截至公開說明書刊印日止並無從事高風險或高槓桿投資之情事，且本公司已訂有「取得或處分資產處理程序」，規範各類投資之風險管理制度，故對本公司並無產生不利之影響。

(2)從事資金貸與他人之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無從事資金貸與他人之情事。未來若欲從事資金貸與他人，將依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」規定辦理。

(3)從事背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無背書保證之情事。未來若欲從事背書保證，將依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司訂定之「背書保證作業程序」規定辦理。

(4)從事衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司專注本業經營，最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無從事衍生性商品交易之情事，且本公司已訂有「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性商品之風險管理制度，未來亦將審慎評估從事衍生性商品交易及風險，故對本公司並無產生不利之影響。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司研發計畫朝極紫外光微影製程(Extreme Ultraviolet lithography，以下簡稱 EUV)光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，以及半導體物理氣相沉積(Physical vapor deposition，以下簡稱 PVD)相關之設備開發，研發計畫與進度皆按公司專案計畫進行，未來將持續隨半導體技術演進及市場需求投入研發資源，掌握人才、資金、技術等關鍵因素，追求研發能力之領先地位。本公司預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況逐年提升。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時關注任何可能影響公司財務業務之國內外重要政策及法律變動，並蒐集相關變動資訊提供經營階層做為決策參考。最近年度及截至公開說明書刊印日止國內外重要政策及法律變動對本公司財務與業務並無重大不利影響。

5.科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展，以迅速掌握產業動態，持續加強提升本身之研發能力積極拓展未來市場應用領域，已設立資訊室確保本公司資訊資產之機密性、完整性及可用性符合相關法規之要求並嚴格控管執行本公司資訊安全管理以因應科技改變(包括資通安全風險)及產業變化。最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司未有因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務重大影響之情事。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，秉持著誠信經營、技術創新、品質提升及客戶滿意之經營政策，重視企業形象，遵守法令規定，積極強化營運管理品質及績效。截至公開說明書刊印日止，本公司未有企業形象改變致使公司面臨企業危機管理之情形。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未有併購計畫。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司廠房之擴充皆經過完整、審慎與專責單位之評估過程，已充份考量投資回收效益與防範可能面臨風險事項。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1)進貨集中面臨之風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止無單一供應商超過 25%，並無進貨集中之情形。目前除持續與既有供應商建立良好關係並積極開發新供應商，透過分散供應商採購，以降低缺料風險。

(2)銷貨集中面臨之風險及因應措施

本公司 111 年度及 112 年度第一大客戶銷貨金額分別占總銷貨淨額之 44% 及 33%，雖有銷貨集中之情況，惟該客戶係國際自動化設備大廠，本公司產品及技術獲得其認同使銷貨金額提高而致，其應收帳款收款情形良好。另本公司亦積極開發客戶並擴展現有客戶的產品類別，以改善銷貨集中之情況。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司主要董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉之情事。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無經營權改變之情事。

12.其他重要風險及因應措施：

(1)面臨地緣政治風險，如何因應美國與中國之貿易戰爭中之市場分割與技術專利保護之策略

半導體產業是世界經濟的重點產業，臺灣則為全球晶片重要生產基地，面對俄烏戰爭、美中科技戰、兩岸政經情勢緊俏等地緣政治之風險，不斷對臺灣半導體業產生嚴重影響與劇烈衝擊，茲就本公司受地緣政治風險之影響及因應措施說明如下：

A.銷售區域全球化

中美間貿易戰爭，美國聯合日本、韓國、荷蘭以及臺灣強化對中國出口先進半導體技術、設備和產品的限制，惟本公司銷售比重以內銷為主，占整體營收約八成，現對中國市場銷售比重不高，且外銷至中國市場之產品係屬成熟製程用之光罩清洗及儲存管理相關設備，並無涉及晶片產品製程等相關技術，故截至目前為止，本公司未有出口至中國之設備遭限制之情事，未來將隨時關注國際相關管制措施，恪遵國內及國際出口管制規範。

本公司深耕於半導體設備多年，與全球半導體客戶建立深厚之合作基礎，銷售區域隨客戶全球拓展，未來因應地緣政治風險與趨勢，除持續與國際客戶保持密切之合作關係，並關注客戶在國際各區域擴廠計畫。同時，評估各地區半導體政策的優勢、政治環境之穩定性、區域需求與價值鏈發展，以與本公司業務方向整合推展，以因應地緣政治風險。

另，基於技術壁壘之佈建以確保產品市場優勢，本公司核心產品所開發之核心技術，將採全球化市場策略布局專利申請區域。而如為改良性或短效牽制市場之設計，相較對公司之營運影響有限之技術，則考量成本效益，策略性於銷售區域國家申請專利。由於中國並非本公司目前重點銷售區域，且本公司近年技術隨重點客戶朝先進製程領域開發，故而該區域之專利較少，然考量地緣政治風險，中國市場或有其發展走向，因此本公司計畫回防專利於中國之布局，期以因應。

B. 產品多角化

隨 EUV 製程推進與擴展，產品開發除先進製程需要新設備研發，成熟製程也需要機台研發來改進製程良率與生產效能，故本公司將技術延伸至成熟製程相關機台。另，本公司積極佈局半導體晶圓製造大廠、記憶體廠及面板製造大廠等等多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用本公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，拓展新市場業務。

C. 供應鏈與製造基地分散

本公司為分散風險，各料件建立多家供應商，並藉由採購團隊對各供應商對原物料交期之積極掌握，降低存貨管控成本，建立穩定之原物料供應鏈。此外，母公司家登聯手 9 家半導體晶圓傳載解決方案廠商，組成半導體在地供應鏈聯盟，除了服務台灣之外，也將前進美國市場，預計要再擴展到歐洲、日本。本公司也是該供應鏈聯盟一員，未來將透過聯盟合作關係擴大海外銷售及維修等業務，並視發展情形評估海外產線佈局之可能，以減少對特定地域供應鏈的依賴。

綜上，隨著國際地緣政治諸多結構性因素影響，地緣政治風險越形艱難，本公司將對於供應鏈和客戶的影響，納入決策考量，並隨時關注任何可能影響公司財務業務之國內外重要政策及法律變動，做為決策參考。

(二) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情形。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴

訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：

除本公司之法人董事兼持股比例超過百分之十之股東家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)有下述訴訟案尚於進行中外，其餘人員均未有繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件之情事，相關評估分析如下：

- (1)家登公司主張，其為中華民國發明第 I238804 號「傳送盒之填充裝置改良」專利(以下簡稱系爭專利)之專利權人，因美國 Entegris, Inc. 在其網站公開展示之型號 A300 晶圓傳送盒(以下簡稱系爭產品)，經家登公司比對發現系爭產品已落入系爭專利請求項 1、4、5、8、9 之文義及均等範圍。因此，Entegris, Inc.、其子公司、負責臺灣地區銷售業務之人及實質負責人等七人生產、製造、販賣系爭產品即屬侵害原告專利權之行為。故家登公司遂向智慧財產及商業法院起訴請求 Entegris, Inc.等七人不得自行或委託、授權他人製造、販賣、使用、進口系爭產品及其他侵害系爭專利權之產品，並應銷毀侵害系爭專利權之物及連帶賠償家登公司 1 億元。查本案經智慧財產及商業法院審理後，因認系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義或均等範圍，故判決駁回家登公司之全部請求。家登公司不服已提出上訴，故本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院第二審審理中，迄未終結。
- (2)Entegris, Inc.基於與前款相同之原因事實，主張系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義及均等範圍，且系爭專利有得撤銷事由，亦向智慧財產及商業法院起訴請求確認家登公司基於系爭專利，對於 Entegris, Inc.系爭產品之防止侵害請求權、排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。查本案經智慧財產及商業法院審理後，因認系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義及均等範圍，故判決確認家登公司之前述請求權均不存在。家登公司不服已提出上訴，故本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院第二審審理中，迄未終結。
- (3)美國 Entegris, Inc.主張，家登公司未經授權製造「300 Diffuser FOUN」前開式晶圓傳送盒，侵害其中華民國發明第 I606534 號或 I515159 號發明專利，故向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求家登公司賠償 3,000 萬元等。查家登公司於 112 年 9 月 12 日收受本案起訴狀繕本後，已委託律師處理後續訴訟程序，本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院審理中，迄未終結。
- (4)家登公司前羅姓勞工主張，其於上班期間發生車禍，發生職業災害，故起訴請求家登公司應補足職災期間(即 109 年 9 月至 111 年 9 月，共二年)原領工資差額及未足額提繳之勞工退休金共 463 千元。又因羅姓勞工前述職災事件經勞工局核定職災期間為 7 個月，非二年，故家登公司亦於 112 年 7 月依民法 179 條不當得利規定，就家登公司先前多給付之 1 年 5 個月工資補償計 902 千元提起反訴。經查，本案目前尚在法院審理中，迄未終結。

綜上評估，上述訴訟案件為法人董事兼持股比例超過百分之十之股東因企業經營所衍生之民事糾紛，經評估應不影響本公司財務業務運作，亦無對本公司之股東權益或證券價格有重大影響。

- 3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情

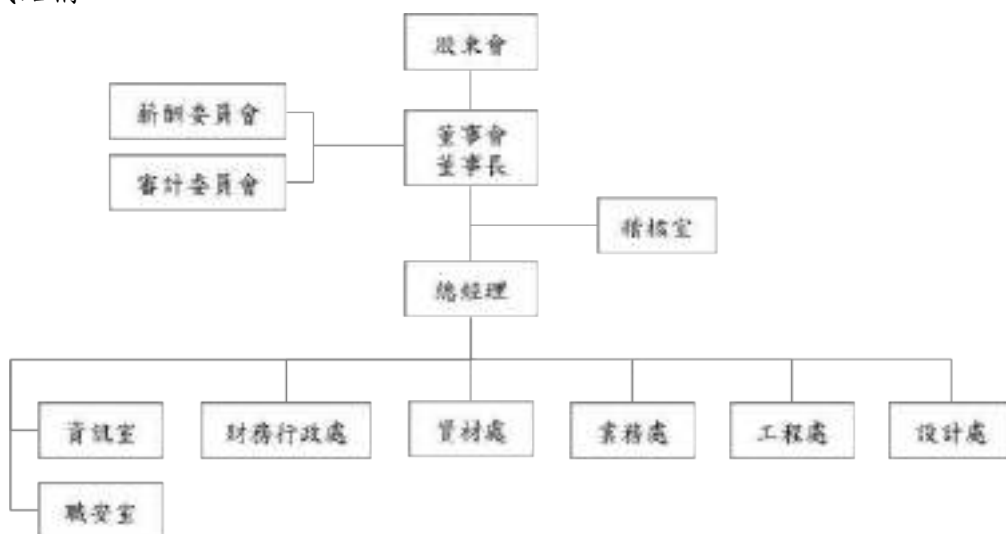
形：無此情形。

- (三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無此情形。
- (四)發行人於最近一會計年度或申請上櫃會計年度內，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項及會計師受託查核簽證金融機構財務報表相關規定第五條規定之重要子公司標準之一者，或推薦證券商認為對發行人財務報告有重大影響者，應增列其風險事項說明：無。
- (五)外國發行人申請股票登錄興櫃或第一上櫃者，應增列敘明外國發行人註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施：不適用。
- (六)其他重要事項：無。

三、公司組織

(一)組織系統

1.組織結構



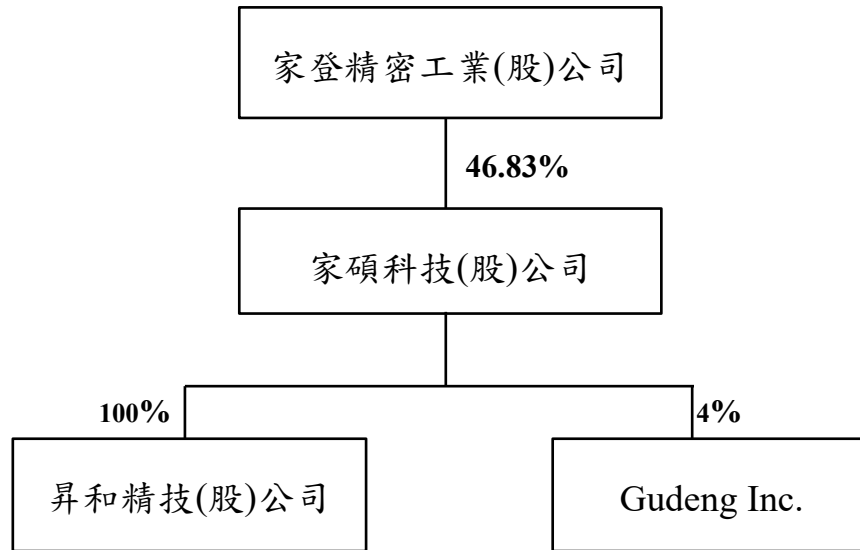
2.各主要部門所營業務

主要部門	職掌業務
稽核室	負責評估及稽核內部控制制度設計與執行之有效性，並提出改善建議，促進內部控制目標之達成。
資訊室	負責規劃、建置、發展及管理公司之各式資訊作業系統與設備。
職安室	負責職業安全衛生管理之規劃、推動及督導。
業務處	負責市場及客戶開發、報價、訂單及交期管理，以及客戶服務事宜。
資材處	負責產銷協調、生管物控及採購執行與管理，以及供應商管理。
工程處	負責產品製造生產、製程及品質管控與改善等事項。
設計處	負責新技術研究、新產品設計、開發及驗證，以及產品技術支援。
財務行政處	綜理財務、會計、股務、投資人關係、人事行政及法務智權等事項。

(二)關係企業圖

1.關係企業架構圖

112年12月31日



2.公司與關係企業間之關係、相互持股比例、股份及實際投資金額

112年12月31日；單位：千股；新臺幣千元；%

關係企業名稱	與本公司關係	本公司直接或間接持有			持有本公司		
		股數	比率	實際投資金額	股數	比率	實際投資金額
家登精密工業(股)公司	母公司	-	-	-	12,782	46.83	84,431
昇和精技(股)公司	子公司	3,451	100	70,000	-	-	-
Gudeng Inc.	兄弟公司	208	4	USD208	-	-	-

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

113年3月24日；單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
總經理	詹印豐	男	中華民國	105.08.01	1,503,771	5.51	-	-	-	-	陽明交通大學EMBA University of Missouri-Columbia 電機碩士 - 阿爾卡特真空科技董事 弘塑科技(股)公司董事兼總經理 Micronic Laser System Inc. Site Manager	本公司董事 昇和精技(股)公司法人代表 董事長 台林電通(股)公司獨立董事 瑞峰半導體(股)公司監察人	無	無	無	無	-
業務處副總經理	陳毓正	男	中華民國	105.08.01	451,855	1.66	263,000	0.96	-	-	勤益科技大學研發與科技管理碩士 - 弘塑科技(股)公司資深業務處長 新農油空壓工業(股)公司副廠長	昇和精技(股)公司總經理	無	無	無	無	-
資材處副總經理	莊少杰	男	中華民國	105.09.01	578,905	2.12	-	-	-	-	文化大學電機系學士 名超企業(股)公司獨立董事 - 司熱高科技(股)公司採購主管 弘塑科技(股)公司資深資材處長 元太科技工業(股)公司採購課長	無	無	無	無	-	
工程處經理	王安邦	男	中華民國	105.08.01	400,355	1.47	163,500	0.60	-	-	屏東科技大學資訊管理所碩士 - 家登精密工業(股)公司資深副理	無	無	無	無	-	
設計處經理	杜林炘	男	中華民國	109.12.07	11,500	0.04	-	-	-	-	陽明交通大學應用化學所碩士 生捷科技(股)公司處長 - 旭德科技(股)公司總經理特助 中華凸版電子(股)公司經理 聯華電子(股)公司光罩部門經理	生生科技(股)公司董事	無	無	無	無	-
財務行政處經理兼公司治理主管	石惠文	女	中華民國	111.12.19	-	-	-	-	-	-	University of North Alabama MBA - 宇智網通(股)公司稽核經理	無	無	無	無	-	
稽核主管	羅儀珊	女	中華民國	112.11.07	-	-	-	-	-	-	淡江大學會計系學士 - 慧榮科技(股)公司資深稽核 建騰創達科技(股)公司稽核主管	無	無	無	無	-	

註：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司無此情事。

(四)董事資料

1.董事之姓名、經(學)歷、持有股份及性質

113年3月24日；單位：股；%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	初次 選任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公 司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	家登精密 工業(股) 公司	-	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	11,302,701	50.10	12,882,268	47.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法人董事 代表人： 邱銘乾	男 51-60	中華民國	105.06.22	112.05.31	三年	632,000	2.80	764,720	2.80	-	-	-	-	政治大學資管所博士 北京大學光華管理學院EMBA 碩士 臺北大學EMBA 碩士	註2	-	-	-	-
董事	家登精密 工業(股) 公司	-	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	11,302,701	50.10	12,882,268	47.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法人董事 代表人： 林添瑞	男 51-60	中華民國	105.06.22	112.05.31	三年	632,000	2.80	764,720	2.80	-	-	-	-	中歐國際工商學院EMBA 政治大學EMBA 碩士 政治大學全球企業家班碩士 華夏技術學院機械科	註3	-	-	-	-
董事	詹印豐	男 51-60	中華民國	105.06.22	112.05.31	三年	1,242,786	5.51	1,503,771	5.51	-	-	-	-	陽明交通大學EMBA University of Missouri-Columbia 電機碩士 阿爾卡特真空科技董事 弘塑科技(股)公司董事兼總經理 Micronic Laser System Inc. Site Manager	註4	-	-	-	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	初次 選任日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公 司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	胡瑞卿	女 51-60	中華民國	112.01.31	112.05.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	陽明交通大學 EMBA Stanford University 碩士 漢民微測科技(股)公司副總經理 全磊微機電(股)公司副總經理 美商英特爾亞太有限公司策略投資部總監	註 5	-	-	-	-
獨立 董事	李文中	男 61-70	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	英國國立萊思特大學企管研究所 MBA 輔仁大學法律系兼任助理教授	註 6	-	-	-	-
獨立 董事	陳瑞杏	女 51-60	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣大學管理學院碩士 三商美邦人壽保險(股)公司副總經理 第一創業投資(股)公司協理	註 7	-	-	-	-
獨立 董事	林秀怡	女 41-50	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	陽明交通大學 EMBA 碩士 美國伊利諾大學法學碩士 常在國際法律事務所律師/Integrated Partner 理律法律事務所資深律師、律師顧問	註 8	-	-	-	-

註 1：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司無此情事。

註 2：家登精密工業(股)公司董事長、家崎科技(股)公司董事長、家碩建設(股)公司法人代表董事長、恆陽綠能(股)公司法人代表董事長、家登創業投資(股)公司法人代表董事、富瑞昇實業(股)公司法人代表董事長、柏升工業(股)公司法人代表董事長、碩頂精密工業(股)公司法人代表董事、愛思分析儀器(股)公司董事、迅得機械(股)公司法人代表董事、上海家登貿易有限公司代表人、蘇州堃鉅貿易有限公司執行董事、Gudeng INC 代表人、Gudeng Investment Co., Ltd.代表人、Partner one Limited 董事長。

註 3：家登精密工業(股)公司副董事長兼總經理、家崎科技(股)公司董事、家登創業投資(股)公司法人代表董事長、富瑞昇實業(股)公司法人代表董事、柏升工業(股)公司法人代表董事、碩頂精密工業(股)公司法人代表董事、愛思分析儀器(股)公司監察人、家宇航太(股)公司法人代表董事長、蘇州堃鉅貿易有限公司監事、Gudeng Investment Limited 董事長、Sun Park Development Limited 代表人。

註 4：本公司總經理、昇和精技(股)公司法人代表董事長、台林電通(股)公司獨立董事、瑞峰半導體(股)公司監察人。

註 5：潘杰(股)公司法人代表董事長、祥誠科技(股)公司法人代表董事長、公信電子(股)公司獨立董事、漢民科技(股)公司副總經理、聯勝光電(股)公司法人代表董事、漢民原醫(股)公司法人代表董事、禾榮科技(股)公司監察人。

註 6：中華國際聯合法律事務所主持律師/所長、桃園汽車客運(股)公司法人常務董事代表人、豐運通開發有限公司負責人、中玲投資有限公司負責人。

註 7：三商投資控股(股)公司董事長特助、三商行(股)公司董事長特助、三友藥妝(股)公司法人代表董事、心樸市集(股)公司法人代表監察人。

註 8：怡睿國際法律事務所主持律師、實億投資(股)公司監察人。

2.法人股東之主要股東

112年6月24日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
家登精密工業股份有限公司	莊明郎 (9.26%) 邱銘乾 (7.57%) 林添瑞 (5.18%) 羅采芳 (3.81%) 晟捷投資股份有限公司 (3.47%) 昀陞投資股份有限公司 (3.26%) 匯豐銀行託管美林國際公司投資專戶 (2.00%) 台北富邦商業銀行受林添瑞信託財產專戶 (1.82%) 潘素春 (1.80%) 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 (1.71%)

3.主要股東為法人者其主要股東

112年6月24日

法人名稱	法人之主要股東
晟捷投資股份有限公司	林添瑞(49.90%)、潘素春(45.69%)
昀陞投資股份有限公司	邱銘乾(52.20%)、羅采芳(47.80%)

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
家登精密工業(股)公司 法人董事代表人：邱銘乾		<ul style="list-style-type: none"> 畢業於政治大學資管所博士，現任家登精密工業(股)公司董事長。 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 曾擔任商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上。 致力於半導體產業相關領域多年，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。 未有公司法第30條各款情事之一。 	非獨立董事，不適用。	-

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
家登精密工業 (股)公司 法人董事代表 人：林添瑞	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於中歐國際工商學院EMBA，現任家登精密工業(股)公司副董事長。 • 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 專精產業相關營運規劃、經營及與管理實務能力。 • 未有公司法第30條各款情事之一。 	非獨立董事，不適用。	-
詹印豐	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於陽明交通大學EMBA碩士，現任家碩科技(股)公司總經理、台林電通(股)公司獨立董事。 • 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 擁有國際觀，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。在董事會以經理人之角色，向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動，並提出相關經營管理意見。 • 未有公司法第30條各款情事之一。 	非獨立董事，不適用。	1
胡瑞卿	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於陽明交通大學EMBA，現任漢民科技(股)公司副總經理、公信電子(股)公司獨立董事等多家上市櫃公司董事。 • 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 專精於企業財務金融及營運管理，對產業具有領導決策經驗。 • 未有公司法第30條各款情事之一。 	非獨立董事，不適用。	1

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
李文中	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於英國國立萊思特大學企管研究所MBA，現任中華國際聯合法律事務所主持律師/所長、輔仁大學法律系兼任助理教授。 • 擁有律師執照，具商務、法務與公司業務相關科系之大專院校講師經驗。 • 熟稔商業法律並兼具學界與產業界專業與實務經驗。 • 未有公司法第30條各款情事之一。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2.選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。 	-
陳瑞杏	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於臺灣大學管理學院碩士，現任三商投資控股(股)公司董事長特助。 • 擁有會計師執業證書。 • 專長於法律、財務會計及稅務風險管理能力及實務經驗。 • 未有公司法第30條各款情事之一。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2.選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。 	-
林秀怡	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業於美國伊利諾大學法學碩士及陽明交通大學EMBA碩士，現任怡睿國際法律事務所主持律師。 • 擁有律師執照。 • 熟稔商業法律、公司治理、財務會計、商務投資及產業科技等領域之分析及管理能力。 • 未有公司法第30條各款情事之一。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2.選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。 	-

5.董事會多元化及獨立性

(1)董事會成員多元化政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B.專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

C.本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心項目 姓名/職稱		基本組成					專業能力								
		國籍	性別	年齡			兼任本公司員工	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				41至50歲	51至60歲	61至70歲									
邱銘乾	董事長：家登精密工業(股)公司代表人	中華民國	男		√			√		√	√	√	√	√	√
林添瑞	董事：家登精密工業(股)公司代表人	中華民國	男		√			√		√	√	√	√	√	√
詹印豐	董事	中華民國	男		√		√	√		√	√	√	√	√	√
胡瑞卿	董事	中華民國	女		√			√	√	√	√	√	√	√	√
李文中	獨立董事	中華民國	男			√		√	√	√	√	√	√	√	√
陳瑞杏	獨立董事	中華民國	女		√			√	√	√	√	√	√	√	√
林秀怡	獨立董事	中華民國	女	√				√	√	√	√	√	√	√	√

(2)董事會成員多元化政策目標及達成情形、董事會獨立性

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位非獨立董事(57%)及3位獨立董事(43%)，其中1席(14%)非獨立董事兼任公司經理人身分。獨立董事皆符合獨立性資格條件，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事有3席，比率達43%。

(五)發起人資料：不適用。

(六)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

1.最近年度(112 年度)給付董事之酬金

(1)最近年度(112 年度)給付董事之酬金

112 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之 比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總 額及占稅後純益 之比例		領取來 自子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金 (H)			
		報酬 (A)		退職退休 金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)									
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司				
董事長(註 1)	家登精密工業 (股)公司代表 人：邱銘乾																								
	邱銘乾																								
董事(註 2)	家登精密工業 (股)公司代表 人：林添瑞	-	-	-	-	4,998	4,998	312	312	5,310 2.32%	5,310 2.32%	7,941	10,771	-	-	920	-	920	-	14,171 6.21%	17,001 7.45%	68,454			
	林添瑞																								
董事	詹印豐																								
董事(註 3)	胡瑞卿																								
董事(註 4)	林雅文																								
獨立 董事 (註 5)	李文中																								
	陳瑞杏	-	-	-	-	1,995	1,995	282	282	2,277 1.00%	2,277 1.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,277 1.00%	2,277 1.00%	-			
	林秀怡																								

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所負擔之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：不適用。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

註 1：邱銘乾董事長於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任法人董事長：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾。

註 2：林添瑞董事於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任法人董事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞。

註 3：胡瑞卿董事於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任董事。

註 4：林雅文董事於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任董事，後於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任董事。

註 5：李文中董事、陳瑞杏董事、林秀怡董事於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任獨立董事。

(2)董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前八項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G+H)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	家登精密工業(股)公司代表人：邱銘乾、家登精密工業(股)公司代表人：林添瑞、邱銘乾、林添瑞、林雅文、李文中、陳瑞杏、林秀怡	同左	家登精密工業(股)公司代表人：邱銘乾、家登精密工業(股)公司代表人：林添瑞、邱銘乾、林添瑞、林雅文、李文中、陳瑞杏、林秀怡	家登精密工業(股)公司代表人：邱銘乾、家登精密工業(股)公司代表人：林添瑞、李文中、陳瑞杏、林秀怡
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	詹印豐、胡瑞卿	同左	胡瑞卿	同左
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	林雅文
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	詹印豐	同左
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	邱銘乾、林添瑞
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	10 人	10 人	10 人	10 人

2.最近年度(112 年度)給付監察人之酬金

(1)最近年度(112 年度)給付監察人之酬金

112 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		本公司	財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
監察人(註 1)	王彩樺	-	-	904	904	44	44	948	948	2,635
監察人(註 2)	沈恩年	-	-	-	-	-	-	0.42%	0.42%	

註 1：王彩樺監察人於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

註 2：沈恩年監察人於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任監察人，後於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

(2)監察人酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	王彩樺、沈恩年	王彩樺
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	沈恩年
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2 人	2 人

3.最近年度(112 年度)給付總經理及副總經理之酬金

(1)最近年度(112 年度)給付總經理及副總經理之酬金

112 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

職稱	姓名	報酬 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外 轉投資或 母 公司 酬 金
		本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公 司	財務報告內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	詹印豐	7,555	11,214	216	292	10,055	10,842	3,020	-	3,020	-	20,846 9.13%	25,368 11.11%	-
副總經理	陳毓正													
副總經理	莊少杰													

(2)總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及 副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	陳毓正、莊少杰	陳毓正、莊少杰
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	詹印豐	詹印豐
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3 人	3 人

4.最近年度上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

5.最近年度(112 年度)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

112 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
	總經理	詹印豐	-	6,320	6,320	2.77%
	副總經理	陳毓正				
	副總經理	莊少杰				
	經理	王安邦				
	經理	杜林炘				
	經理	石惠文				

6.分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1)本公司及合併報告所有公司給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新臺幣千元；%

職稱	111 年度				112 年度			
	酬金總額		酬金總額占稅後純益比例(%)		酬金總額		酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司
董事	5,451	5,451	2.68	2.68	7,587	7,587	3.32	3.32
監察人	1,817	1,817	0.89	0.89	948	948	0.42	0.42
總經理及副總經理	21,541	22,356	10.59	10.99	20,846	25,368	9.13	11.11

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

本公司給付董監酬勞係依據公司章程第二十四條規定，以公司當年度有獲利的前提，提撥不高於 3% 為董監酬勞。董監酬金之訂定程序，授權董事會依董監對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參照同業水準議定之。本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工紅利，係依據所擔任之職位、承擔之責任及貢獻度，並參酌同業水準議定之。本公司支付董監事、總經理及副總經理之薪酬皆已併同考量公司未來的營運發展與經營風險，同時評估與其經營績效呈正相關，以謀永續經營與風險控管之平衡。

(七)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司之職務、與發行人董事之關係及對發行人實質控制情形，另外國發行人並應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任：無此情事。

四、資本及股份

(一)股份種類

113年3月24日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	27,297,600	22,702,400	50,000,000	非上市(櫃)股票

(二)股本形成經過

1.股本形成

單位：千股；新臺幣千元

年月 (註1)	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本 來源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	其他
105.07	10	10,000	100,000	1,750	17,500	公司創立(現金)	無	註2
106.07	11	10,000	100,000	3,450	34,500	現金增資 17,000千元	無	註3
109.07	10	10,000	100,000	5,520	55,200	盈餘轉增資 20,700千元	無	註4
110.08	10	50,000	500,000	11,040	110,040	盈餘轉增資 55,200千元	無	註5
111.06	10	50,000	500,000	16,560	165,600	盈餘轉增資 55,200千元	無	註6
111.12	22	50,000	500,000	22,560	225,600	現金增資 60,000千元	無	註7
112.05	10	50,000	500,000	27,297	272,976	盈餘轉增資 47,376千元	無	註8

註1：係以變更登記生效日期為準。

註2：105年07月18日新北府經司字第1055214947號。

註3：106年07月19日新北府經司字第1068044801號。

註4：109年07月17日新北府經司字第1098050153號。

註5：110年08月24日新北府經司字第1108059452號。

註6：111年06月01日新北府經司字第1118037549號。

註7：111年12月07日新北府經司字第1118086929號。

註8：112年05月12日新北府經司字第1128032560號。

2.最近三年度及截至公開發行說明書刊印日止，私募普通股之辦理情形：無。

(三)最近股權分散情形

1.股東結構

113年3月24日；單位：股；%

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外國人	合計
人數	-	-	27	1,210	2	1,239
持有股數	-	-	15,588,464	11,696,678	12,458	27,297,600
持股比例	-	-	57.10	42.85	0.05	100.00

2.股權分散情形

113年3月24日；單位：股；%

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至999	447	82,590	0.30
1,000至5,000	599	1,118,296	4.10
5,001至10,000	67	525,351	1.92
10,001至15,000	32	413,575	1.52
15,001至20,000	23	435,720	1.60
20,001至30,000	18	451,138	1.65
30,001至40,000	9	308,426	1.13
40,001至50,000	5	223,835	0.82
50,001至100,000	16	1,110,979	4.07
100,001至200,000	8	1,130,117	4.14
200,001至400,000	6	1,756,188	6.43
400,001至600,000	3	1,431,115	5.24
600,001至800,000	3	2,210,809	8.10
800,001至1,000,000	-	-	-
1,000,001以上	3	16,099,461	58.98
合計	1,239	27,297,600	100.00

3.主要股東名單

113年3月24日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
家登精密工業股份有限公司		12,882,268	47.19
士大投資有限公司		1,713,422	6.28
詹印豐		1,503,771	5.51
邱銘乾		764,720	2.80
林添瑞		764,720	2.80
詹佳蓉		681,369	2.50
莊少杰		578,905	2.12
陳毓正		451,855	1.66
王安邦		400,355	1.47
詹文豪		360,455	1.32

4.最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

(1)董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

單位：股

職稱	姓名	111 年度		112 年度		113 年截至 公開說明書刊印日	
		可認股數	實認股數	可認股數	實認股數	可認股數	實認股數
董事長 (註 1)	家登精密工業(股)公司	2,750,101	2,750,101	-	-	-	-
	法人董事代表人：邱銘乾	-	-	-	-	-	-
董事 (註 2)	家登精密工業(股)公司	2,750,101	2,750,101	-	-	-	-
	法人董事代表人：林添瑞	-	-	-	-	-	-
董事	詹印豐	661,586	661,586	-	-	-	-
董事 (註 3)	胡瑞卿	-	-	-	-	-	-
董事 (註 4)	林雅文	-	-	-	-	-	-
監察人 (註 5)	王彩樺	-	-	-	-	-	-
監察人 (註 6)	沈恩年	-	-	-	-	-	-
獨立 董事 (註 7)	李文中	-	-	-	-	-	-
	陳瑞杏	-	-	-	-	-	-
	林秀怡	-	-	-	-	-	-
大股東	家登精密工業(股)公司	2,750,101	2,750,101	-	-	-	-

註 1：邱銘乾董事長於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任法人董事長：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾。

註 2：林添瑞董事於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任法人董事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞。

註 3：胡瑞卿董事於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任董事。

註 4：林雅文董事於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任董事，後於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

註 5：王彩樺監察人於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

註 6：沈恩年監察人於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任監察人，後於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

註 7：李文中董事、陳瑞杏董事、林秀怡董事於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任獨立董事。

(2)放棄現金增資認股洽關係人認購情形：無。

5.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(1)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	111 年度		112 年度		113 年截至 公開說明書刊印日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 (註 1)	家登精密工業(股)公司	5,680,301	-	1,459,567	-	100,000	-
	法人董事代表人：邱銘乾	632,000	-	132,720	-	-	-
董事 (註 2)	家登精密工業(股)公司	5,680,301	-	1,459,567	-	100,000	-
	法人董事代表人：林添瑞	632,000	-	132,720	-	-	-
董事兼 總經理	詹印豐	558,986	-	(286,015)	-	-	-
董事(註 3)	胡瑞卿	-	-	-	-	-	-

職稱	姓名	111 年度		112 年度		113 年截至 公開說明書刊印日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事 (註 4)	林雅文	-	-	31,460	-	-	-
監察人 (註 5)	王彩樺	-	-	24,200	-	-	-
監察人 (註 6)	沈恩年	-	-	66,760	-	-	-
獨立董事 (註 7)	李文中	-	-	-	-	-	-
	陳瑞杏	-	-	-	-	-	-
	林秀怡	-	-	-	-	-	-
大股東	家登精密工業(股)公司	5,680,301	-	1,459,567	-	100,000	-
副總經理	陳毓正	626,434	-	(686,579)	-	-	-
副總經理	莊少杰	161,434	-	(94,529)	-	-	-
經理	王安邦	376,434	-	(404,079)	-	(84,000)	-
經理	杜林炘	50,000	-	10,500	-	(49,000)	-
經理	石惠文	-	-	-	-	-	-

註 1：邱銘乾董事長於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任法人董事長：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾。

註 2：林添瑞董事於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任法人董事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞。

註 3：胡瑞卿董事於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任董事。

註 4：林雅文董事於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任董事，後於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

註 5：王彩樺監察人於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

註 6：沈恩年監察人於 112 年 1 月 31 日股東臨時會補選新任監察人，後於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選卸任。

註 7：李文中董事、陳瑞杏董事、林秀怡董事於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選新任獨立董事。

(2) 股權移轉之相對人為關係人者資訊

A.111 年度

單位：股；新臺幣元

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
邱銘乾	取得	111.12.28	莊少杰	本公司副總經理	365,000	27.00
			士大投資有限公司	負責人為本公司總經理配偶	267,000	27.00
林添瑞	取得	111.12.28	士大投資有限公司	負責人為本公司總經理配偶	314,000	27.00
			詹印豐	本公司董事兼總經理	318,000	27.00
詹印豐	處分	111.07.18	詹佳蓉	二親等以內之親屬	300,000	17.00
			詹文豪	二親等以內之親屬	100,000	17.00
		111.12.28	林添瑞	本公司董事	318,000	27.00
家登精密工業(股)公司	取得	111.12.28	士大投資有限公司	負責人為本公司總經理配偶	119,000	27.00

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
莊少杰	處分	111.12.28	邱銘乾	本公司董事長	365,000	27.00
王安邦	贈與	111.11.24	王晨宇	二親等以內之親屬	100,000	不適用
			余彥葶	配偶	150,000	

B.112 年度

單位：股；新臺幣元

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
詹印豐	處分	112.01.13	賴柏安	法人董事及大股東家登精密工業(股)公司之經理人	55,000	27.00
			王彩樺	本公司前監察人	20,000	27.00
林雅文	取得	112.01.13	陳毓正	本公司副總經理	26,000	27.00
王彩樺	取得	112.01.13	詹印豐	本公司董事兼總經理	20,000	27.00
沈恩年	取得	112.01.13	陳毓正	本公司副總經理	56,000	27.00
陳毓正	處分	112.01.13	沈恩年	本公司前監察人	56,000	27.00
			林雅文	本公司前董事	26,000	27.00
	贈與	112.04.26	林冠汝	配偶	300,000	不適用
			陳麒合	二親等以內之親屬	100,000	
王安邦	處分	112.01.13	林韋程	本公司董事 二親等以內之親屬	100,000	27.00
			林靖雅	本公司董事 二親等以內之親屬	100,000	27.00
			晟捷投資(股)公司	董事長為本公司董事	76,000	27.00
			黃崇鵬	法人董事及大股東家登精密工業(股)公司之董事	36,000	27.00
			莊家和	法人董事及大股東家登精密工業(股)公司之經理人	35,000	27.00

C.113 年截至公開說明書刊印日：無。

(3)股權質押之相對人為關係人者資訊：無此情形。

6. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

113年3月24日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
家登精密工業(股)公司	12,882,268	47.19	-	-	-	-	邱銘乾	董事長	-
家登精密工業(股)公司 負責人：邱銘乾	764,720	2.80	-	-	-	-			
士大投資有限公司	1,713,422	6.28	-	-	-	-	詹印豐	士大投資有限公司 負責人為其配偶	-
士大投資有限公司 負責人：陳梅君	-	-	-	-	-	-			
詹印豐	1,503,771	5.51	-	-	-	-	士大投資有限公司	負責人為本公司 總經理配偶	-
邱銘乾	764,720	2.80	-	-	-	-	家登精密工業(股)公司	董事長	-
林添瑞	764,720	2.80	-	-	-	-	家登精密工業(股)公司	副董事長 兼總經理	-
詹佳蓉	681,369	2.50	-	-	-	-	士大投資有限公司	負責人為二親等 以內親屬	-
							詹印豐	二親等以內親屬	-
莊少杰	578,905	2.12	-	-	-	-	-	-	-
陳毓正	451,855	1.66	263,000	0.96	-	-	-	-	-
王安邦	400,355	1.47	163,500	0.60	-	-	-	-	-
詹文豪	360,455	1.32	-	-	-	-	士大投資有限公司	負責人為二親等 以內親屬	-
							詹印豐	二親等以內親屬	-

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：千股；新臺幣元

項目	年度		111年度	112年度
	最高	最低	未上市(櫃)	未上市(櫃)
每股市價	最高	最低	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	最低	平均	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	平均		未上市(櫃)	未上市(櫃)
每股淨值	分配前		24.40	32.50
	分配後		18.52	尚未分配
每股盈餘	加權平均股數		17,086	27,298
	每股盈餘	追溯調整前	11.91	8.36
		追溯調整後	9.84	8.36
每股股利	現金股利		2.0	尚未分配
	無償配股	盈餘配股	2.1	尚未分配
		資本公積配股	-	尚未分配
	累積未付股利		-	尚未分配

項目		年度	111 年度	112 年度
		投資報酬 分析	本益比	未上市(櫃)
本利比	未上市(櫃)		未上市(櫃)	
現金股利殖利率	未上市(櫃)		未上市(櫃)	

(五)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

本公司股利之政策，應配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，作為股利發放之依據。股利發放提撥之數額不低於當年度可供分配盈餘之百分之十，得以股票股利或現金股利之方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。

2.本年度擬(已)議股利分配之情形

(1)本公司 113 年 3 月 4 日董事會通過 112 年度盈餘分派案及每股股利如下

單位：新臺幣元

項目	金額
民國 111 年期末分配盈餘	100,920,428
加：本期稅後淨利	228,243,080
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(22,824,308)
減：依法提列特別盈餘公積	(384,907)
截至民國 112 年底可分配保留盈餘	305,954,293
分配項目	
普通股現金股利(每股新臺幣 4.5 元)	(122,839,200)
期末未分配保留盈餘	183,115,093

(2)上述股利分配情形與本公司公司章程規定尚無不符之情事。

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司 112 年度盈餘分配係分配現金股利，對公司每股盈餘並無影響。

(七)員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥 3%以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提

股東會報告，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司估列 112 年度員工酬勞及董監事酬勞，係依公司章程所載分派條件作為估列之基礎，本年度董事會通過之員工酬勞及董監事酬勞與 112 年度估列數相同，若嗣後董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為下年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 112 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案，業經 113 年 3 月 4 日董事會決議通過，分派員工酬勞 31,586,615 元及董監酬勞 7,896,654 元，並均以現金方式發放，董事會通過之員工酬勞及董事、監察人酬勞與 112 年財務報告估列金額無差異之情事。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本年度並未擬議配發員工股票酬勞，故不適用。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：

擬於 113 年 5 月 22 日股東常會報告分派 112 年員工酬勞 31,586,615 元及董監酬勞 7,896,654 元，與董事會擬議分配金額無差異之情事。

5. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 111 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案，業經 112 年 2 月 20 日董事會決議分派之員工酬勞 28,691,000 元及董監酬勞 7,172,000 元，實際分派金額與估列數並無差異之情事。

(八)最近三年度及截至公開發行說明書刊印日止公司買回本公司股份情形：無此情形。

五、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股辦理情形：無。

十、併購辦理情形：無

十一、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者辦理情形：無。

參、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)所營業務之主要內容

- CQ01010 模具製造業
- C805050 工業用塑膠製品製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- F106030 模具批發業
- F119010 電子材料批發業
- F206030 模具零售業
- F219010 電子材料零售業
- H701010 住宅及大樓開發租售業
- H701020 工業廠房開發租售業
- E604010 機械安裝業
- E603050 自動控制設備工程業
- CB01010 機械設備製造業
- CB01990 其他機械製造業
- E599010 配管工程業
- F401010 國際貿易業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)所營業務之營業比重

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	111 年度		112 年度	
	金額	比率	金額	比率
機器設備	914,800	87.29	1,060,560	87.86
其他	133,153	12.71	146,585	12.14
合計	1,047,953	100.00	1,207,145	100.00

資料來源：本公司提供

(3)目前之商品(服務)項目

本公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，其中主要包括應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。

(4)計劃開發之新商品(服務)項目

- A.EUV 製程相關：攜手母公司家登集團，整合以專業技術服務鏈，持續協助客戶挑戰半導體極限，開發與精進 EUV 製程相關之解決方案。
- B.高階光罩相關：持續深耕高階光罩製程相關之設備，並跨足非標準六寸光罩，提供客製化服務。
- C.PVD 相關設備：隨著 5G、節能及電動車等產品需求增加，高功率電子元件產品的需求隨之增加，本公司投入開發 PVD 相關設備，以期拓展新業務市場。

2.產業概況

(1)產業之現況與發展

A.全球半導體產業

半導體產業是一種採用半導體材料(III-V 族化學元素)去製造電子元件的產業，主要用於控制、計算、處理、記憶、傳輸。因為半導體是電子產品的基礎元件，常見的終端應用，例如：電腦、手機、相機、計算機、伺服器、顯示器、汽車、航空、軍武等。目前半導體產業已是一個高度全球化、高技術競爭、高資本門檻的產業。全球知名的半導體廠商，包含台積電、聯電、環球晶圓、日月光、三星、SK 海力士、英特爾、德州儀器、輝達、超微、應材、美光、高通、博通、艾司摩爾、恩智浦、英飛凌、意法半導體、東京威力科創、瑞薩、中芯國際、長江存儲等。半導體產業隨著摩爾定律持續發展和進步，積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，促使科技創新、社會改革、生產效率提升、產品應用擴展，對全球經濟發展有重大的貢獻，隨著科技的進步和需求的增加，半導體產業仍然具有很大的潛力和前景。

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)統計，112 年全球半導體市場全年總銷售值達 5,268 億美元，較 111 年衰退 8.2%。這是自 108 年以來首次陷入萎縮。WSTS 指出，由於生成式 AI 的普及，全球半導體市場 112 年下半年已開始轉趨復甦，第二季至第三季營收表現強勁，部分終端市場改善，因此微幅調高 112 年半導體營收預估，預期將約 5,201.26 億美元，年減 9.4%。

展望 113 年，全球半導體市場將強勁成長，預計成長 13.1%，估值達到 5,880 億美元。包括分離式半導體、光電子、感測器營收將全面成長個位數百分比，記憶體營收激增 44.8%，是推升半導體營收成長主要動能。WSTS 預期，所有市場都將在 113 年持續擴張。歐洲及日本市場將分別成長 4.3%及 4.4%，美洲市場將成長 22.3%居最高，亞太地區成長 12%。

全球半導體產業產值

Fall 2023	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Americas	141,136	132,536	162,154	16.2	-6.1	22.3
Europe	53,853	57,048	59,480	12.8	5.9	4.3
Japan	48,158	47,209	49,275	10.2	-2.0	4.4
Asia Pacific	330,937	283,333	317,455	-3.5	-14.4	12.0
Total World - \$M	574,084	520,126	588,364	3.3	-9.4	13.1
Discrete Semiconductors	33,993	35,951	37,459	12.0	5.8	4.2
Optoelectronics	43,908	42,583	43,324	1.2	-3.0	1.7
Sensors	21,782	19,417	20,127	13.7	-10.9	3.7
Integrated Circuits	474,402	422,174	487,454	2.5	-11.0	15.5
Analog	88,983	81,051	84,056	20.1	-8.9	3.7
Micro	79,073	76,579	81,937	-1.4	-3.2	7.0
Logic	176,578	174,944	191,693	14.0	-0.9	9.6
Memory	129,767	89,601	129,768	-15.6	-31.0	44.8
Total Products - \$M	574,084	520,126	588,364	3.3	-9.4	13.1

資料來源：WSTS(112/11)

B. 臺灣半導體產業

臺灣是全球主要的半導體生產基地之一，在全球半導體產業中占有重要地位，處於全球半導體產業的領先地位，亦是臺灣經濟的重要支柱之一，產業發展受到政府的大力支持，通過設立科技基金、開發技術、政策補助等措施，促進臺灣半導體產業快速發展。時至今日，臺灣半導體產業的主要優勢，具有強大的晶圓製造能力，為全球半導體廠商或終端應用品牌客戶提供最佳的製造選擇，產值位居全球半導體領先地位。同時具有領先技術研發能力，不斷推陳出新，配合國際知名企業和研究機構建立密切的合作關係，共同研發和生產創新產品，設計開發出全球領先的半導體產品。此外，臺灣擁有領域廣泛的半導體供應鏈，涵蓋設備製造、IC 設計、材料生產、封裝檢測等多個製造關鍵節點。臺灣半導體產業長期建立出產業良好形象及巨大的品牌影響力，在全球市場上享有聲譽，將在未來繼續發揮重要作用，成為全球半導體產業中不可忽視的成員。

台灣半導體產業協會(TSIA)公布最新統計並指出，112 年台灣 IC 產業產值約 4.34 兆元、年減 10.2%，衰退幅度高於全球半導體市場的 8.2%；而展望 113 年，預估台灣 IC 產業產值將增至約 5.01 兆元，年增達 15.4%，將高於全球半導體市場的 13.1%；其中，產業鏈以台積電(2330)為首的晶圓代工業，預估 113 年產值將達 2 兆 9,060 億元，年增率 16.6% 居最高。

113 年國內晶圓代工業景氣將可擺脫 112 年的衰退轉為成長態勢，除了庫存調整將告一段落外，主要是 3C 等產品出貨量將呈現溫和成長，況且 AI 需求將仍顯強勁，此皆可進一步帶動對於晶圓代工的需求；其中台積電先進製程的景氣能見度相對較高，包括 Apple、AMD、Intel、Nvidia、Qualcomm、聯發科、Xilinx、Tesla 均將成為公司 3 奈米強化版或變種製程的客戶，預計 3 奈米製程所占比重將由 112 年第三季 6% 提升

至 113 年超過一成的水準，且 3 奈米家族(如之後 N3P 和 N3X 製程)，將成為台積電另一個大規模且有長期需求的製程技術。

2020 ~ 2024 年台灣 IC 產業產值

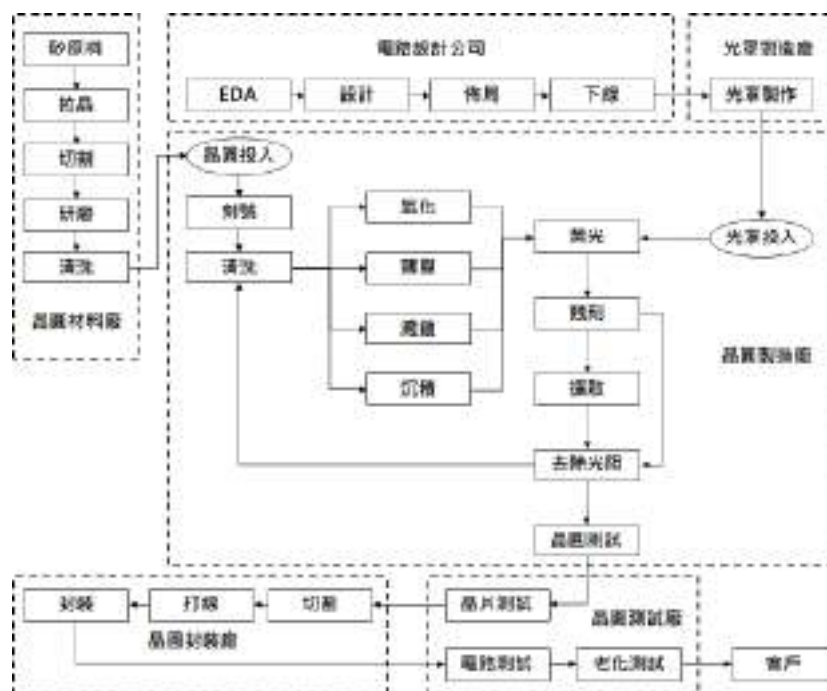
億新臺幣	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024(e)	2024(e) 成長率
IC 產業產值	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	50,116	15.4%
IC 設計業	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,570	14.6%
IC 製造業	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	31,038	16.6%
晶圓代工	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	29,060	16.6%
記憶體與其他製造	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,978	16.3%
IC 封裝業	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,362	11.0%
IC 測試業	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,146	12.6%
IC 產品產值	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-10.2%	14,548	14.9%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,404	6.8%	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,268	-8.2%	5,958	13.1%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所(2023/11)

C. 半導體設備產業

半導體設備是半導體產業的核心，設備的品質和性能對半導體元件的良率和性能有很大的影響，是製造半導體元件所不可或缺的部分。全球知名的半導體設備商，包含應材、阿斯摩爾、東京威力科創、柯林研發、科磊等。其中，半導體製造過程包含：晶圓投入製造前所需的拉晶、切割、研磨、清洗，黃光製程所需的光罩製作，晶圓投入製造後所需的薄膜、濺鍍、黃光、蝕刻、擴散、清洗等製程，以後晶圓出廠後所需的測試、切割、打線、封裝。每個製造環節都需要半導體設備廠參與其中，例如：長晶爐、晶圓切割機、光罩交換機、極紫外光刻機、晶圓清洗機、檢測設備等，由半導體設備廠商提供先進設備及技術支援，以確保半導體元件生產具備穩定度和可靠度。因此，半導體設備廠商屬於整個半導體產業的重要合作夥伴，由於半導體產業的快速發展，相關設備的市場需求持續成長，例如：增設生產線、擴建擴廠，因此半導體設備廠商亦伴隨產業同步成長。

半導體設備相關製程站點



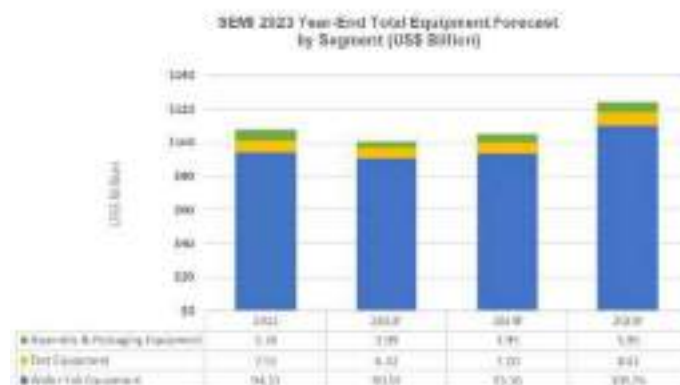
資料來源：<http://www.semiinsights.com>

根據國際半導體產業協會(SEMI)統計資料指出，112 年全球半導體製造設備銷售總額全年預估將達 1,000 億美元水平，與 111 年總額 1,074 億美元相比減少 6.1%；在前段及後段製程推動下，半導體製造設備銷售預期於 113 年回升，並在 114 年創下 1,240 億美元新高。

半導體前段設備銷售額(含晶圓製程、晶圓廠設施和光罩設備)繼 111 年達成 940 億美元新高後，112 全年銷售預估將達 906 億美元，年減 3.7%，113 年市場可望回溫，預估 114 年隨著新晶圓廠建成運轉、產能擴張和技術升級的帶動，需求成長加速，全年對於半導體前段設備的投資金額預估將近 1,100 億美元，成長 18%。

半導體後段製程設備，包括測試設備和組裝及封裝設備，於 113 年可望迎來新局面，預估將分別成長 13.9%和 24.3%。2025 年需求預估將進一步提升，測試和組裝及封裝設備可望分別成長 17%和 20%。

半導體設備產值預測



資料來源：SEMI 2023 年 12 月設備市場報告

整體而言，半導體產業仍然充滿潛力和長期發展趨勢，包含：(1)智慧型裝置：隨著智慧型裝置的普及，如智慧型手機、智慧型家電、智慧型醫療等，將有助於擴大半導體的需求；(2)新能源車：電動車能源政策推動電動車，提升汽車電子整車滲透率，以及支援自動駕駛和安全技術，將有助於半導體不同階段製程；(3)物聯網：物聯網技術的發展將需要大量的半導體元件支持產品間傳輸功能，將有助於擴大半導體產業的應用發展；(4)雲端裝置：雲端計算和大數據將需要大量的半導體元件，將有助於推動半導體產業的發展；(5)新型技術：例如人工智慧、機器學習、量子電腦等新型技術的發展，將對半導體產業帶來新的商機。因此，半導體產業仍然具有很大的潛力和前景，不斷透過技術研發和製程推進，應對市場需求和挑戰，在未來繼續保持強勁的增長動力，繼續擔當著全球科技發展的關鍵角色。

(2) 產業上、中、下游之關聯性



資料來源：產業價值鏈資訊平台

(3) 產品之各種發展趨勢

半導體的前段製程是在晶圓上製造出電路的過程，步驟極其複雜，需要使用的製程包括微影、蝕刻、沉積、參雜與平坦化及製程間之清洗製程等，其中，微影係貫穿半導體製程極為關鍵的製程技術，微影製程是將電路圖案透過已刻好圖案的光罩及光阻「轉印」到晶圓上的過程。由於半導體的製程長，受限於廠房空間及各段製程產速等因素，須將製程分段，對於光罩的保護與潔淨之要求越來越嚴格，光罩儲存與交換之自動化設備需求增加，因此光罩相關之自動化系統不僅提高光罩之壽命也提升生產效率與良率。

半導體產業遵循摩爾定律演進，半導體線寬愈做愈小，電晶體密度愈來愈高，從奈米進入埃米節點的世代，挑戰著光罩設備的極限，在微影製程中進而發展出波長只有 13.5 奈米的極紫外光光源(Extreme Ultraviolet, EUV)，這種波長極小的光解決了繞射問題，滿足現在晶片尺寸的微影需求，然 EUV 容易被空氣等介質吸收因此機器必須維持在高真空狀態下，半導體設備商陸續投入研發新技術所需之功能。近年來，國際半導體大廠擴大資本支出並積極擴充先進製程產能，半導體設備市場維持強勁成長，本

公司藉由與客戶端緊密合作開發各種不同設備應用，持續開發 EUV 與光罩高階製程之光罩相關設備。

(4) 競爭情形

光罩儲存設備競爭者來自海內外，如來自美國的 Brooks Automation、Entegris, Inc. 及日本的樂華科技，國內亦有華景電通、聖鳳科技及凱諾科技等，本公司善用地利之便(臺灣為半導體代工廠重鎮)及多年產業經驗，本公司具有先進者優勢，藉由積極與國內外半導體大廠合作，取得第一手產品規格，搭配家登精密之光罩載具，提供客戶潔淨度及保護力較好的光罩相關設備，並在設計初期與客戶充分討論，於產品設計階段將客戶需求納入考量，縮短開發時程並及早導入量產，經過長期的市場考驗，本公司已成為國際半導體大廠認可的優良廠商。

另，半導體產業有 SEMI Standard 制定規範，對於供應商產品品質有嚴格的測試標準，生產工廠必須要符合無塵室 Class 1 等級，故產業進入門檻較高。目前本公司已陸續獲得多項光罩相關設備相關發明及新型專利，特殊專利提高氣體換氣效率減少成本，並且以乾式清潔方式把光罩正面反面都清潔延長使用壽命，專利之佈局將是本公司與競爭同業區隔與脫穎而出的關鍵。

3. 技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次及研究發展情形

本公司於 105 年由家登精密工業(股)公司投資設立。業務及技術著重於半導體製程中 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，為自有技術品牌之臺灣半導體設備製造商。

本公司在技術與產品發展上，除持續深化光罩潔淨與微環境管理及周邊應用外，並專注客戶需求與客戶共同開發先進製程應用設備，以專業技術力與專案力協助客戶成功。此外，本公司於 109 年收購昇和精技(股)公司，將業務觸角延伸到 PVD 真空鍍膜和 PVD 設備技術，以期兼蓄半導體和面板的 PVD 真空技術，擴展核心技術。

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人

學歷		年度		
		111年度	112年度	截至113年2月29日
學歷分布	博士	1	-	-
	碩士	10	13	13
	學士(含大專)	19	23	23
	高中以下	-	-	-
	合計	30	36	36
平均服務年資(年)		1.54	2.24	2.41

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣千元；%

項目		年度				
		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
研發費用		11,661	15,102	38,612	75,035	150,604
營業收入淨額		219,290	477,773	601,932	1,047,953	1,207,145
占營業收入淨額比率		5.32	3.16	6.41	7.16	12.48

(4)最近五年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
108	高階光罩潔淨設備、光罩交換設備
109	EUV 微環境充氣倉儲
110	EUV 光罩智慧檢測設備、EUV 光罩高潔淨技術、EUV 光罩傳送驛站、PVD 設備
111	EUV光罩交換與長期儲存方案、EUV倉儲整合自動化系統 獲證專利： 1.抽屜更換式清潔設備(新型/TW及CN) 2.用於檢測光罩內盒的夾取機構(新型/TW) 3.光罩清洗設備(新型/TW及CN)
112	新一代EUV光罩載具檢測機台

4.長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計畫

- A.持續深耕關鍵客戶，提供整合性技術解決方案。
- B.擴建技術團隊，鞏固專利壁壘，以厚植技術能力。
- C.與供應商協同合作，提升品質，建立互惠共生夥伴關係。
- D.持續製程管理進化，建立高效穩定、品質優異之製造系統。

(2)長期業務發展計畫

- A.以「深耕關鍵客戶」、「開拓新客戶」、「發展新市場」三大策略重點聚焦發展，擴大創新服務效益，協助客戶成功。
- B.以智慧工廠自動化技術發展為目標，虛實整合精密機械技術與自動化控制技術，開創製造新層次。
- C.建構堅實完整之供應鏈，以垂直多角化模式策略及技術聯盟供應體系，共創產業價值。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售地區

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	111 年度		112 年度	
		銷售額	比率	銷售額	比率
內銷		852,374	81.34	879,304	72.84
外銷	亞洲	101,841	9.72	117,131	9.70
	歐洲	21,457	2.04	50,749	4.21
	美洲	72,281	6.90	159,961	13.25
	小計	195,579	18.66	327,841	27.16
合計		1,047,953	100.00	1,207,145	100.00

資料來源：本公司提供。

(2)市場占有率

台灣半導體協會(TSIA)預估，台灣半導體產業產值 113 年將達 5.01 兆元，年增 15.4%，可望創下歷史新高，超越全球半導體業的年增 13.1%，主要是反映終端應用市場出貨量將於 113 年恢復正成長的格局，加上庫存調整已於 112 年告一段落所致。隨著 112 年 3 奈米進入量產新世代，全球半導體廠軍備競賽白熱化，更是積極投資 EUV 產能，加上製程推進帶動光罩層數增加，本公司業務可望獲益。

本公司主要客戶皆為國際半導體大廠，112 年營收 1,207,145 千元，較前一年度成長 15.19%，本公司占全球半導體前段設備產值，市占率約 0.04%。經營策略以深耕關鍵客戶，兼併延伸業務觸角至新應用領域與新市場，以逐步擴大市場占有率。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

國際半導體產業協會(SEMI)預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，從 111 年的歷史高點 995 億美元下滑 15%至 840 億美元；隨後於 113 年回升 15%，達到 970 億美元。

113 年的晶圓廠設備支出復甦將可望在半導體庫存調整結束，以及高效能運算(HPC)、記憶體等需求增加而有所提升。受惠於產業對於先進和成熟製程節點的長期需求持續成長，晶圓代工產業 112 年維持投資規模，微幅成長 1%至 490 億美元，持續引領半導體產業成長；預計 113 年產業回溫，帶動設備採購金額擴增至 515 億美元，較 112 年成長 5%。

台灣將在 113 年穩坐全球晶圓廠設備支出的領先地位，年增加 4%來到 230 億美元。韓國居次，預計 113 年的支出將達到 220 億美元，較 112 年增 41%，同時反映了記憶體領域的復甦。此外，受限於美國出口管制，中國先進製程發展和海外廠商投資受阻，113 年總支出額雖以 200 億美元排名全球第三，但較 112 年水平下降。儘管受到限制，但中國的晶圓代工業者 and IDM(垂直整合製造商)將持續以成熟製程進行投資及佈局。

美洲地區仍維持第四大支出地區並創下歷年新高，支出總額預計將來到 140 億美元，年成長率達 23%；歐洲和中東地區也將續創佳績，支出總額成長 41.5%至 80 億美元。而日本和東南亞地區的晶圓廠設備支出將在 113 年分別增長至 70 億美元和 30 億美元。

隨著國際半導體大廠 5 奈米及 3 奈米技術節點製程陸續量產，2 奈米預期亦將於 2024 年進入生產，先進製程的推進下，EUV 光罩層數將呈倍數成長。而當微影圖案越精細，倍縮光罩污染的風險也越高，舉凡外來粉塵與化學殘留物，都是潛在的污染來源。倍縮光罩塗層具有精細與易於損壞等特點。無論是製程中的應有零件(例如機械手臂)，或是預期外的污染物(例如人體毛髮)，只要有任何物件觸碰到倍縮光罩，都有可能造成損壞。保護造價高昂的 EUV 光罩需求也成為了製程發展重點，進而帶動本公司 EUV 光罩相關週邊設備需求成長。未來隨著半導體全球化發展將有助本公司業務蓬勃成長。

(4)競爭利基

A.產品取得客戶認證

半導體設備具有高技術門檻且認證不易，使得欲切入半導體廠商之合格供應商體系，需經相當時間之溝通配合及技術驗證，才能建立與客戶間之信任關係，且一旦獲得採用，其他供應商將難以跨入。本公司憑藉著優異之技術能力，已打入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

B.與客戶夥伴關係

本公司與國內外半導體大廠建立互信合作之夥伴關係，掌握客戶需求之初，各產品之開發設計即與客充分討論溝通規格，以提供其最完善之技術方案協助客戶成功，雙贏夥伴關係使本公司業務穩定成長。

C.擁集團資源綜效

本公司隸屬家登集團，承集團業務渠道、技術及專業人才支援，以及管理運營經驗等各資源共享之合作綜效，有助於本公司業務推展、技術整合運用及殷實專業團隊之建立，進而維持高效率之營運。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

(A)AI 人工智慧、5G 通訊、雲端運算及電動車等興起

隨著全球科技創新趨勢，持續帶動各產業的變革與成長，而受惠於物聯網、AI 人工智慧、5G 通訊、雲端運算及電動車等新興科技興起，背後扮演中樞角色的核心產業-半導體，需求持續擴大呈顯著成長趨勢。

(B)半導體供應鏈具技術進入門檻

半導體設備具有高技術門檻且認證不易，使得欲切入半導體廠之合格供應商體系，需經相當時間之溝通配合及技術驗證，一旦獲得採用，將拉開與其他供應商之競爭距離。本公司憑藉著優異的技術能力與豐富的服務及製造經驗，已成功跨入多家國際半導體廠商之供應鏈，有利未來產品與服務持續拓展。

(C)製造供應鏈完整建立

由於本公司及所屬集團擁有多年半導體領域經營經驗，業務渠道與技術實力堅實，除集團自身產銷及研發能力累積精進外，亦扶植協力廠商之製造生產能力，藉由穩定及長期開發之合作關係，增進彼此之產品品質及良率，建立穩定產業供應鏈。

B.不利因素

(A)景氣循環之營運風險

本公司產品應用於微影製程之光罩相關半導體設備及相關零組件，主要銷售予晶圓代工廠及記憶體廠，因此本公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運受半導體產業資本支出需求狀況所影響。半導體市場受景氣循環影響、且產品需求變化快速，故晶圓製造商若面臨不景氣或是產能過剩的狀況，不僅調降資本支出也將會削減對本公司之下單致影響營收及獲利。

因應對策

(1)本公司具備多年設備開發設計及製造經驗，已累積豐富的實績，並擁有多項專利，本公司除了加強生產製程管理，提高產品品質與效

率，以降低生產成本，促進有效經營管理方式，另外，持續投入優化產品設計開發，加強產品技術與終端客戶技術需求開發，以擴大新產品開發領域，滿足新客戶產品需求。

(2)本公司產品應用領域廣泛，目前除應用在如晶圓代工廠、DRAM製造廠，也陸續拓展半導體後段製造及工廠自動化智能製造等，另以既有產品提升功能規格，積極開發新產品，藉由適當調整經營策略並拓展新業務，期在經濟環境及產業變化下，公司營運能持續成長。

(B)專業人才取得與留任面臨挑戰

臺灣地緣風險提高，各國期盼半導體產業在地化，使全球爭奪半導體技術人才情形加劇，且面臨國內理工科畢業生逐年下滑，本公司之規模及品牌能見度不及國內大型科技企業與國際大廠，此外由於本公司生產據點位於南部，距離如竹科等半導體產業聚落較遠，人才招募上較為不易。

因應對策

本公司申請股票上櫃以提高企業知名度，吸引優秀人才；推行人性化管理制度，建立以績效導向之激勵機制並順暢升遷管道，同時，持續優化各項福利制度，致力創造愉快又有競爭力的工作環境，凝聚員工對公司的向心力，並增加員工留任率。

(C)銷貨集中

隨著 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，各產業為提升自身競爭力，致力生產技術升級與深化自動化製造技術，故近年來半導體代工業者擴大先進製程與產能規模，帶動資本支出預算陸續增加。然半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡佔的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致本公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，且本公司考量整體營運規模，選擇優先滿足領導大廠資本支出需求，而出現銷貨集中之情事。

因應對策

(1)技術延伸至新產品或新市場開發

本公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用本公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，

隨著全球產業市場對於微環境管理設備需求與日俱增趨勢，本公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

(2)鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，本公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，本公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外本公司與其長期合作的關係，且本公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場具領導地位，本公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為本公司帶來廣大的客戶效益，有助於本公司銷售策略之運用。

(3)積極開發其他客戶

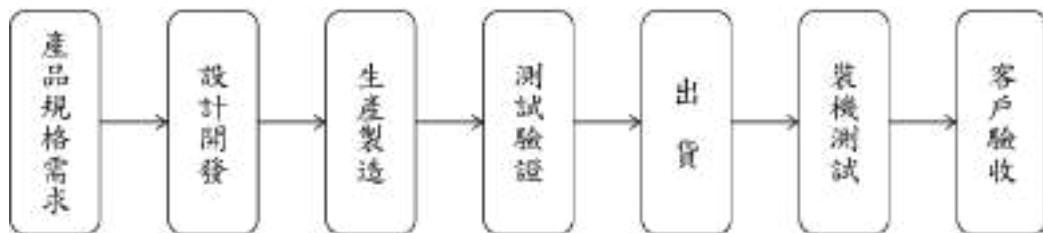
本公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。本公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展本公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

主要產品	用途
機器設備	應用於 EUV 及高階光罩製程，包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理之自動化等。

(2)產製過程



3.主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應來源	供應狀況
電料	國內廠商	良好
金屬加工件	國內廠商	良好
電控、管路組件	國內廠商	良好

4.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

(1)最近二年度毛利率變動情形

單位：新臺幣千元；%

年度 產品別	111 年度			112 年度			毛利率 變動率
	營業收入	營業毛利	毛利率	營業收入	營業毛利	毛利率	
機器設備	914,800	358,665	39.21	1,060,559	479,619	45.22	15.33
其他	133,153	92,214	69.25	146,586	105,919	72.26	4.35
合計	1,047,953	450,879	43.02	1,207,145	585,538	48.51	12.76

(2)毛利率變動達 20%以上之分析：無。

5.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新臺幣千元；%

項目	111 年度				112 年度			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係
1	鑫達懋業	94,057	13.79%	無	鑫達懋業	68,346	12.80%	無
2	嘉彰	79,839	11.70%	無				
	其他	508,407	74.51%		其他	465,427	87.20%	
	進貨淨額	682,303	100.00%		進貨淨額	533,773	100.00%	

增減變動說明：主係因銷售產品之客製需求差異所致。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新臺幣千元；%

項目	111 年度				112 年度			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係
1	B 集團	461,443	44.03%	無	B 集團	393,741	32.62%	無
2	A 集團	258,304	24.65%	無	A 集團	277,381	22.98%	無
3	G 集團	105,358	10.05%	無	G 集團	260,897	21.61%	無
	其他	222,848	21.27%		其他	275,126	22.79%	
	銷貨淨額	1,047,953	100.00%		銷貨淨額	1,207,145	100.00%	

增減變動說明：主係配合客戶調整設備系統之整合策略所致。

6.最近二年度生產量值表

單位：台；新臺幣千元

生產量值 年度 主要商品(或部門別)	111 年度			112 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
機器設備	註 1	159	581,275	註 1	248	600,972
其他	註 1	註 2	40,939	註 1	註 2	40,665
合計	註 1	159	622,214	註 1	248	641,637

註 1：本公司產品主要係以客製化為主，並自行設計生產其產品搭配之零件各異，故無法依產品別估計產能，其產能數據不具比較性，故不予列示。

註 2：其他主要係零件備品及維修服務等，品項複雜，單位不一，其產量不具可加性，故不予列示。

變動原因說明：主係客戶需求增加所致。

7.最近二年度銷售量值表

單位：台；新臺幣千元

銷售量值 年度 主要商品(或部門別)	111 年度				112 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
機器設備	61	738,052	98	176,748	64	773,747	184	286,813
其他	註	114,322	註	18,831	註	105,557	註	41,028
合計	61	852,374	98	195,579	64	879,304	184	327,841

註：其他主要係零件備品及維修服務等，品項複雜，單位不一，其產量不具可加性，故不予列示。

變動原因說明：主係客戶需求增加所致。

(三)最近二年度從業員工人數

單位：人；歲；年；%

項目	年度	111 年度	112 年度	截至 113 年 2 月 29 日
	員工人數(人)	一般人員	67	92
研發人員		30	36	36
合計		97	128	127
平均年歲		40	40	40
平均服務年資(年)		3.09	3.01	3.14
學歷分佈比率(%)	博士	2.06	0.78	0.79
	碩士	18.56	26.56	27.55
	大專	78.35	71.88	70.87
	高中	1.03	0.78	0.79
	高中以下	-	-	-

(四)環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：不適用。
- 2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- 3.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- 4.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- 5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

(五)勞資關係

- 1.公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。

(1)員工福利措施及實施情形

本公司除依勞基法辦理法定福利措施外，並設立職工福利委員會，統籌辦理員工福利事項及各類文康活動事宜，目前本公司福利措施要點如下：

- A.公司法定福利措施：全民健康保險、勞工保險、提撥勞工退休準備金、提撥積欠工資墊償基金、提撥職業災害保險、提繳勞工退休金。
- B.福利委員會提供：婚喪喜慶補助及其他各種福利優惠活動等。

(2)進修訓練與其實施情形

本公司為提升人力資源素質、提高員工工作效能及培養專業知識，不定期實施內部教育訓練，亦積極鼓勵員工參加各項訓練課程，以期達到培訓專業人才之目標。

(3)退休制度與實施情形

本公司依勞工退休金條例之勞退新制規定，按月提繳不低於其每月工資6%勞工退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司依據勞基法規定，定期召開勞資會議協調、溝通意見，以維持良好勞資關係。

- 2.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無此情形。

(六)資通安全管理

- 1.敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

本公司資訊安全管理係透過建置相關資訊安全管理措施並進行相關風險評估，採取之主要管理措施如下：

- (1)成立資通安全推動組織，強化本公司資訊安全管理，確保所屬各項資產、資訊的機密性、完整性及可用性，以符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅。
 - (2)內部控制制度之電腦化資訊系統中訂有資通安全檢查之控制作業，作為同仁遵行依據，同時不定期檢討內控制度之有效性，以保障資通安全。
 - (3)稽核人員每年對公司資訊安全管理進行稽查，以了解資安運作狀況，評估對各項風險控制及異常事項之改善是否確實，以降低及避免相關資安風險。
 - (4)為確保資料之保護及機密性，程式及資料存取均須經適當之核決及授權，以防範機密資料外流之風險。
- 2.列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
 - 3.本公司確保資通安全及掌控離職員工危害公司技術程度，避免技術外流暨進行資安稽查，降低資安風險之相應措施

(1)本公司已訂定相關資訊系統循環內控制度，規定員工離職時，其使用帳號應立即註銷，且於人員離職時，離職人員須由資訊單位人員檢核完畢後才算完成離職手續。此外，本公司人員在職期間之相關研發成果屬公司所有，所有研發人員均有簽署保密條款，規範機密資訊之保密義務，為避免人員流動造成研發中斷風險，亦已訂定相關研發循環內控制度，對於研發過程完整保存記錄，對於研發成果申請智慧財產權保護。綜上所述，透過落實資訊及研發循環內控制度，本公司在在員工流動性大狀況之下，能確保資通安全並避免技術外流。

(2)本公司於內控制度中訂定資通安全檢查控制作業，規範公司內部資訊系統之控管政策，並定期向員工宣達資訊安全政策及規定，以確保公司資訊系統之安全性；此外，本公司於其中訂定各項網路系統安全評估、防火牆之安全管理及電腦病毒及惡意軟體之防範等相關規範，並由資訊室人員定期或適時評估。另本公司因應資訊安全制度規劃、建置、監督及執行資訊安

全管理作業，已於 112 年 11 月 7 日經董事會通過資訊安全主管任命案，由蘇衍文經理擔任資訊安全主管，本公司之稽核主管亦於每年度稽核計畫中定期針對資通安全檢查作業進行稽查，112 年度之稽核項目如下所列，本公司藉由稽核主管定期稽查，以確保資訊安全。

- A.負責資訊安全之人員，每年是否接受資訊安全專業課程訓練。
- B.系統設定應有適當之申請程序。
- C.遠端登入管理資訊系統是否經適當之核准。
- D.是否定期覆核各項資安項目之 System Log，追蹤異常之情形，並建立檢核表定期覆核各 Log 紀錄。
- E.是否定期辦理電子郵件社交工程演練，並對誤開信件或連結之人員進行訓練。
- F.是否訂定資安事件應變處置及通報作業程序，包含判定事件影響及損害評估、內外部通報程序、通知其他受影響機關之方式、通報窗口聯繫方式。
- G.是否設置防火牆及防毒軟體。
- H.個人端及網路伺服器端電腦安裝防毒軟體，並即時更新程式及病毒碼。
- I.電腦媒體報廢銷毀程序是否依規定辦理。
- J.與委外廠商或第三方簽訂資訊相關合約，是否依規定辦理。
- K.資訊處理之執行是否有專人覆核及追蹤。

(七)公司及其子公司於申請上櫃年度及其前二年度如有委託單一加工工廠於年度內加工金額達五千萬元以上者，應增露該加工工廠之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表：無此情形。

(八)有無爭訟事件，及勞資間關係有無尚須協調之處：無此情形。

(九)有無因應景氣變動之能力

本公司擁有專業的經營團隊，隨時蒐集市場資訊及分析市場動向和同業產品發展情形，使公司營運能在景氣變化時有立即因應措施，將景氣變動對公司營運的風險降至最低。

(十)關係人間交易事項是否合理

本公司與關係人間交易，與一般交易條件無重大差異，亦無非常規交易情事，相關交易事項及說明請參閱本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(十一)如其事業係屬生物技術工業、製藥工業或醫療儀器工業者，應增列其依法令取得主管機關許可進行人體臨床試驗或田間實驗者或在國內從事生物技術工業或醫療儀器工業研究發展，且已有生物技術或醫療儀器相關產品製造及銷售或提供技術服務之實績暨最近一年度產品及相關技術服務之營業額、研究發展費用所占該公司總營業額之比例情形：不適用。

(十二)公司如於提出上櫃申請前一年度因調整事業經營，終止其部分事業，或已將其部分之事業獨立另設公司、移轉他公司或與他公司合併者，應分別予以記載說明其終止、移出或合併之事業暨目前存續之營業項目，並提出目前存續營業項目前一年度之營業額、研究發展費用占公司該年度總營業額之比例情形：無此情形。

二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產

(一)自有資產

- 1.列明取得成本達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之不動產、廠房及設備名稱、數量、取得日期、取得成本、重估增值及未折減餘額，並揭露其使用及保險情形、設定擔保及權利受限制之其他情事：無。
- 2.列明閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產名稱、面積、座落地點、取得日期、取得成本、重估增值、未折減餘額、公告現值或房屋評定價值、公允價值及預計未來處分或開發計畫：無。

(二)使用權資產

列明金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之使用權資產租賃標的名稱、數量、租賃期間、出租人名稱、原始帳面金額、未折減餘額，並揭露其保險情形及租約之重要約定事項：無。

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率

1.各生產工廠之使用狀況

113年2月29日

工廠	項目	建物面積(坪)	員工人數	生產商品種類	目前使用狀況
臺南廠 (樹谷園區)		511.63	73	機器設備	良好

2.最近二年度設備產能利用率

單位：台；新臺幣千元

生產量值 主要產品	年度	111年度				112年度			
		產能	產量	產能 利用率	產值	產能	產量	產能 利用率	產值
機器設備		註1	159	註1	581,275	註1	248	註1	600,972
合計		註1	159	註1	581,275	註1	248	註1	600,972

註1：本公司產品主要係為客製化為主，並自行設計生產其產品搭配之零件各異，故無法依產品別估列產能及產能利用率，其數據不具比較性，故不予列示。

三、轉投資事業

(一)轉投資事業概況

112年12月31日；單位：新臺幣千元；股

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利	
昇和精技(股)公司	半導體製程用物理氣相沈積設備及相關零組件之製造及銷售	70,000	76,440	3,451,424	100%	69,897	-	權益法	2,733	14,737	3,451,424
Gudeng Inc.	經營各種電子零組件業務	USD208	7,960	208,000	4%	7,543	-	權益法	(32)	-	208,000

(二)綜合持股比例

112年12月31日；單位：新臺幣千元；股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
昇和精技(股)公司	3,451,424	100%	-	-	3,451,424	100%
Gudeng Inc.	208,000	4%	2,652,000	51%	208,000	4%

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：不適用。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數：無。

(五)於已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者，應增列該投資事業之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表：無。

四、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
借款合同	永豐商業銀行	112.11.08-113.08.31	短期借款額度 新臺幣 80,000 千元	無
借款合同	元大商業銀行	112.11.08-113.11.07	短期借款額度 新臺幣 50,000 千元	無
借款合同	台北富邦商業銀行	113.03.22-113.12.29	短期借款額度 新臺幣 100,000 千元	無

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃合約	家登精密工業(股)公司	112.01.01-116.12.31	台南廠區租賃(I)	無
租賃合約	家登精密工業(股)公司	112.01.01-116.12.31	台南廠區租賃(II)	無
租賃合約	家登精密工業(股)公司	113.01.01-113.12.31	新北辦公室租賃	無
租賃合約	財團法人褒忠亭義民中學財團	111.12.01-117.12.31	竹北辦公室租賃(I)	無
租賃合約	財團法人褒忠亭義民中學財團	112.01.01-117.12.31	竹北辦公室租賃(II)	無
租賃合約	東捷科技(股)公司	112.02.01-113.01.31	外倉租賃	無
租賃合約	靄歲科技(股)公司	112.07.01-115.06.30	外倉租賃	無
租賃合約	林 OO	112.05.18-115.05.17	外倉租賃	無

肆、發行計畫及執行情形

一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析

本公司並無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債，而本公司資金運用計畫實際完成日距申報時未逾三年之前次現金增資案，茲就該有價證券發行計畫相關內容及執行情形說明如後：

(一)111年11月現金增資

1.計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：111年12月7日新北府經司字第1118086929號函核准。

(2)計畫所需資金總額：新臺幣132,000千元。

(3)資金來源：現金增資發行新股6,000千股，每股面額新臺幣10元，每股發行價格22元，募集總金額為新臺幣132,000千元。

(4)計畫項目及資金運用情形：

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			112年第1季
充實營運資金	111年第4季	132,000	132,000

(5)預計效益：

為因應本公司營運規模成長及長期營運發展需求，擬辦理現金增資發行新股用以充實營運資金，藉此強化公司償債能力及健全財務結構，以提高公司競爭力。

(6)變更計畫內容、變更原因以變更前後效益：不適用。

(7)本計畫輸入證期局指定申報網站日期：不適用。

2.執行情形

單位：新臺幣千元；%

計畫項目	執行狀況		112年第1季	進度超前或落後情形、原因及改進計畫
	支用金額	預定	實際	
充實營運資金		預定	132,000	本計畫業依原定資金運用進度如期執行完畢。
		實際	132,000	
	執行進度(%)	預定	100%	
		實際	100%	

3. 效益評估

單位：新臺幣千元；%

項目/年度		110年 (增資前)	111年 (增資後)
基本財務資訊	流動資產	922,123	1,578,449
	流動負債	765,862	1,083,569
	負債總額	765,862	1,104,529
	營業收入	601,932	1,047,953
	利息支出	117	139
	每股盈餘(元)	4.08	11.91
財務結構(%)	負債比率	78.23	66.73
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,717.71	3,706.17
償債能力(%)	流動比率	120.40	145.67
	速動比率	58.81	84.65

資料來源：本公司自結數。

本公司該次募集資金總額為新臺幣 132,000 千元，全數用於充實營運資金，已於 111 年 11 月完成募集，並依計畫進度執行完畢。

在充實營運資金之效益部份，本公司於募集資金後，在償債能力方面，籌資後流動比率自 120.40% 增加至 145.67%，速動比率自 58.81% 增加至 84.65%；在財務結構方面，籌資後負債比率自 78.23% 下降至 66.73%，長期資金占不動產、廠房及設備比率自 1,717.71% 提升至 3,706.17%；在營運規模方面，流動資產及營業收入均較 110 年度增加，負債總額則因 111 年預收貨款較 110 年增加所致。整體而言，本公司本次增資效益應已顯現。

二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫分析：

(一) 資金來源

1. 計畫所需資金總額：新臺幣 696,612 千元。
2. 資金來源：現金增資發行普通股 2,717 千股，每股面額新臺幣 10 元整，每股發行價格為新臺幣 216.80 元，預計募集金額為新臺幣 696,612 千元。
3. 計畫項目及預訂資金運用進度

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			113 年第二季
充實營運資金	113 年第二季	696,612	696,612

4. 預計可能產生之效益

本次籌資計畫中之 696,612 千元將用以充實營運資金，有助於提升資金運用調度彈性，健全公司財務結構，並強化公司長期競爭力。

5. 本次募集之資金如有不足，其籌措方法及來源

本次現金增資發行普通股計畫如每股實際發行價格因市場價格變動而調整，至募集資金不足時，其差額將減少充實營運資金；如實際募集資金金額高於預計募集資金金額時，增加之部分亦將全數用以充實營運資金。

- (二)本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法。如有委託經本會核准或認可之信用評等機構評等者，並應揭露該機構名稱、評等日期及公司債信用評等結果。如附有轉換、交換或認股權利者，並應揭露發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響：不適用。
- (三)本次發行特別股者，應揭露每股面額、發行價格、發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項。如附有轉換權利或認股權利者，並應揭露發行及轉換辦法或認股辦法(含轉換前原特別股未分配之股息等權利義務於強制轉換後之歸屬)：不適用。
- (四)上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者，應揭露發行目的、不擬上市或上櫃原因、對現有股東及潛在投資人權益之影響及未來有無申請上市或上櫃之計畫：不適用。
- (五)股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者，應說明未來上市(櫃)計畫：不適用。
- (六)本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法：不適用。
- (七)本次發行限制員工權利新股者，應揭露限制員工權利新股之發行辦法：不適用。
- (八)說明本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額

1. 本次募集與發行有價證券計畫之可行性

(1) 法定程序之可行性

本公司本次辦理上櫃前現金增資發行普通股計畫，業經 112 年 4 月 14 日董事會及 112 年 5 月 31 日股東會決議通過辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷案，並於 113 年 3 月 26 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，且授權董事長全權處理相關增資事宜。經查與「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令規定並無不符，並經律師對本次募集現金增資計畫之內容出具法律事項檢查表，顯示本次現金增資發行普通股計畫確已符合相關法令之規定，故本公司本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

(2) 募集資金完成之可行性

本公司本次現金增資發行新股 2,717 千股，其中依公司法第二百六十七條規定保留百分之十五，計 407 千股由員工認購，餘 2,310 千股則依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」之規定，以現金增資發行新股方式委託證券商承銷商辦理上櫃前公開銷售，並按證券交易法第二十八條之一規定，於 112 年 5 月 31 日股東會決議通過，排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用。

本公司本次辦理現金增資發行新股預計採部份競價拍賣，部份公開申購方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，將授權董事長按發行價格洽特定人認購

之，而對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故本公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

(3) 資金運用計畫之可行性

本公司本次現金增資募集金額，考量主管機關審核與承銷作業時程，預計於 113 年第二季完成 696,612 千元資金募集後，將全數用於充實營運資金，可望強化本公司之財務結構，提升資金靈活調度之彈性，藉以提升競爭力及降低企業經營風險，故本次增資用於充實營運資金之計畫應屬可行。

2. 本次募集與發行有價證券計畫之必要性

本公司本次辦理現金增資發行新股係依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」規定，以現金增資發行新股方式委託證券商承銷商辦理上櫃前公開承銷，故本次辦理現金增資發行新股係配合主管機關初次上櫃新股承銷制度予以辦理，實有其必要性。

3. 本次募集與發行有價證券計畫之合理性評估

(1) 資金運用計畫及預定進度之合理性

本公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理初次上櫃前公開銷售之用，募得之資金將用於充實營運資金，本次增資計畫之運用進度，將視主管機關審查時間、公開承銷期間及繳款作業時程等因素而定，預計於 113 年第二季收足股款，待資金募集完成後，即用於充實營運資金，透過本次現金增資發行新股，除強化本公司財務結構外，適時挹注營運資金以增加資金靈活運用之彈性，更可有效提升本公司之競爭力，降低營運及財務風險，故本次資金運用計畫及預計進度應屬合理。

(2) 預計可能產生效益之合理性

單位：新臺幣千元；%

項目/年度		112年度增資前	增資後
財務結構(%)	負債占資產比率	61.01	44.52
	長期資金占固定資產比率	1,004.44	1,915.50
償債能力(%)	流動比率	153.56	216.17

註：本次籌資後各項財務比率係以 112 年度經會計師查核簽證之財務報告設算

本公司本次辦理現金增資用以充實營運資金，將可增加財務調度靈活性。就財務結構面觀之，本公司預計流動比率及速動比率將由籌資前之 153.56% 及 102.36% 分別提升至 216.17% 及 164.97%，長期資金占不動產、廠房及設備比率則由 1,004.44% 上升至 1,915.50%，而負債比率將由籌資前之 61.01% 降至 44.52%，故對本公司整體營運發展及健全財務結構等面相均有正面助益，故其現增效益尚屬合理。

4. 各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

本公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式辦理初次上櫃前之公開銷售作業，故僅就發行新股對本年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

本公司本次辦理現金增資發行普通股 2,717,000 股，占本公司擬掛牌股本 30,014,600 股之 9.05%，本次增資預計於 113 年第二季募集完成，考量本公司未來整體營運應能維持穩定成長之趨勢，故本次現金增資發行新股對 112 年度每股盈餘

稀釋之影響尚屬有限。

5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(九)說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式：請參閱本公開說明書附件十八承銷價格計算書。

(十)資金運用概算及可能產生之效益：說明資金之運用進度及本計畫完成後預計可能產生之效益

1.如為收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構(含總成本及單位成本)、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：不適用。

2.轉投資其他公司者，應列明下列事項：不適用。

3.充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表

A.公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形：不適用。

B.目前營運資金狀況：請參閱本公司公開說明書第 57~58 頁之 113~114 年度現金收支預測表

C.所需資金額度及預計運用情形

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			113 年第二季
充實營運資金	113 年第二季	696,612	696,612

D.申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：請詳後附之 113 年及 114 年度現金收支預測表。

113 年度各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣千元

	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	953,785	904,138	944,240	935,082	830,420	1,555,773	1,584,514	1,600,755	1,629,496	1,658,237	1,674,478	1,703,219	953,785
加：非融資性收入													
應收款項收現	34,569	87,705	111,281	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	1,235,075
其他收入	7,640	5,537	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	17,677
收入合計(2)	42,209	93,242	111,731	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	1,252,752
減：非融資性支出													
應付款項付現	48,892	39,127	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	664,969
薪資付現	35,533	8,903	12,000	24,564	14,000	14,000	26,500	14,000	14,000	26,500	14,000	14,000	218,000
不動產、廠房及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,000	192,000
其他	7,431	5,110	51,194	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	165,381
支出合計(3)	91,856	53,140	120,889	93,553	82,989	82,989	95,489	82,989	82,989	95,489	82,989	274,989	1,240,350
要求最低現金餘額(4)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	391,856	353,140	420,889	393,553	382,989	382,989	395,489	382,989	382,989	395,489	382,989	574,989	1,540,350
融資前可供支用現金剩餘(短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	604,138	644,240	635,082	653,259	559,161	1,284,514	1,300,755	1,329,496	1,358,237	1,374,478	1,403,219	1,239,960	666,187
加：融資淨額													
發行新股	-	-	-	-	696,612	-	-	-	-	-	-	-	696,612
借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000	96,000
支付股利	-	-	-	(122,839)	-	-	-	-	-	-	-	-	(122,839)
融資合計(7)	-	-	-	(122,839)	696,612	-	-	-	-	-	-	96,000	669,773
期 末 現 金 餘 額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	904,138	944,240	935,082	830,420	1,555,773	1,584,514	1,600,755	1,629,496	1,658,237	1,674,478	1,703,219	1,635,960	1,635,960

114 年度各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣千元

	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	1,635,960	1,628,626	1,659,712	1,618,798	1,462,318	1,493,404	1,452,490	1,471,076	1,502,162	1,461,248	1,479,834	1,510,920	1,635,960
加：非融資性收入													
應收款項收現	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	1,435,488
其他收入	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
收入合計(2)	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	1,440,888
減：非融資性支出													
應付款項付現	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	764,712
薪資付現	51,380	12,960	12,960	25,460	12,960	12,960	25,460	12,960	12,960	25,460	12,960	12,960	231,440
不動產、廠房及設備	-	-	144,000	-	-	144,000	-	-	144,000	-	-	144,000	576,000
其他	12,302	12,302	12,302	52,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	187,624
支出合計(3)	127,408	88,988	232,988	141,488	88,988	232,988	101,488	88,988	232,988	101,488	88,988	232,988	1,759,776
要求最低現金餘額(4)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	427,408	388,988	532,988	441,488	388,988	532,988	401,488	388,988	532,988	401,488	388,988	532,988	2,059,776
融資前可供支用現金剩餘(短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	1,328,626	1,359,712	1,246,798	1,297,384	1,193,404	1,080,490	1,171,076	1,202,162	1,089,248	1,179,834	1,210,920	1,098,006	1,017,072
加：融資淨額													
借款	-	-	72,000	-	-	72,000	-	-	72,000	-	-	72,000	288,000
償債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(96,000)	(96,000)
支付股利	-	-	-	(135,066)	-	-	-	-	-	-	-	-	(135,066)
融資合計(7)	-	-	72,000	(135,066)	-	72,000	-	-	72,000	-	-	(24,000)	56,934
期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7)	1,628,626	1,659,712	1,618,798	1,462,318	1,493,404	1,452,490	1,471,076	1,502,162	1,461,248	1,479,834	1,510,920	1,374,006	1,374,006

- (2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因

A.應收帳款收款與應付帳款付款政策

在應收帳款收款政策方面，本公司係根據客戶以往歷史交易情形、營運規模及營運狀況而給予適當之授信額度及收款條件，而本公司所編製之 113 及 114 年度之現金收支預測表，其每月應收款收現數之編製基礎係依據本公司已往每月之實際收款情形，並參酌 113 及 114 年度預估營業收入預算、主要客戶之授信條件，按保守穩健之原則作為推估未來每月應收款項之收現情形，預估 113 及 114 年度應收帳款之收款政策與 112 年度並無明顯差異，故其編製基礎假設應屬合理。

在應付帳款付款政策方面，本公司所編製之 113 及 114 年度現金收支預測表之各月應付款項及費用付款情形，主要係依本公司之付款政策為參考依據，並預估未來之付款條件、薪資等費用作為推估未來每月應付款項付現之基礎，故編製基礎假設應屬合理。

綜上所述，本公司 113 及 114 年度現金流量預測表每月應收帳款收現及應付帳款付現基礎係考量廠商收付款條件、進銷貨需求情形等予以編製，尚無重大異常。

B.資本支出計畫

本公司 113 及 114 年度之資本支出計畫係依經營策略及營運發展擬定，主要項目為擴建新廠，113 年 1~2 月之資本支出實際數為 0 千元，113 年 3~12 月及 114 年度預估之資本支出為 768,000 千元。此資本支出計畫主係因應營運所需並依據年度計畫需求進行編製，其資金來源預計以自有資金或銀行借款支應，經評估編製基礎尚屬合理。

C.財務槓桿及負債比率

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險，評估利息費用之變動對於營業利益影響之程度，該項指標數值愈高，表示公司所承擔之財務風險愈大。本公司 111~112 年度之財務槓桿度皆為 1.00 倍，其數值顯示本公司之財務風險控管尚屬穩健，惟本公司為持續拓展事業版圖，為能保持正常營運資金所需，實有必要規劃長期而穩定之資金來源，故本次現金增資發行新股用以充實營運資金，將有助於降低本公司未來經營風險。

負債比率係用以衡量公司財務結構與財務風險，本公司 111~112 年度之負債比率分別為 66.73%及 61.01%，預計本次辦理現金增資發行新股充實營運資金後，負債比率將可降低至 44.52%，除可降低本公司財務負擔及增加資金調度之彈性，亦可提升償債能力及改善財務結構，進一步鞏固並加深本公司之獲利能力，對於強化財務結構及降低營運風險均有正面之助益。

- (3)增資計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程，應就預計自購置該營建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，說明原借款原因，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形

本次辦理現金增資發行新股係用於充實營運資金，故不適用本項評估。

- (4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益

經檢視本公司編製之 113 年度及 114 年度之現金收支預測表，113 年 1~2 月為實際數，113 年 3~12 月及 114 年度預計投入之資本支出金額為 768,000 千元，主係計畫用於興建廠房，該資本支出已逾本次募集資金 696,612 千元之百分之六十(417,967 千元)。

本公司業經 112 年 11 月 7 日審計委員會及董事會決議通過，向南部科學園區租地作為建廠所需，本公司擬於 113 年 7 月起租，預計 115 年完竣，預計 116 年開始量產，本次資本支出計畫係興建廠房，該重大資本支出之資金來源、用途及預計效益說明如下：

A. 資金來源

本公司 113~114 年度預計投入興建工程及購置機器設備合計為 768,000 千元，資金來源係以銀行借款及自有資金支應，另本公司截至 113 年 2 月之個體現金餘額為 944,240 千元，且本公司最近三年度個體營業活動淨現金分別為 144,823 千元、121,405 千元及 515,336 千元，此外本公司規劃 113 年向銀行申請建築融資額度 4.8 億元，然建築融資採階段性申請動用，本公司預計於動用年度之次年度還款，其餘以自有資金支應。綜上所述，本公司本次資本支出之資金來源應屬可行。

B. 資本支出用途

本公司係屬半導體設備業，主要產品需求來自客戶擴廠擴線之產能提升、製程升級及良率提升新方案，以及維修技術服務。近年面對全球半導體產能供不應求，本公司於進入國際半導體大廠供應鏈後，與客戶密切互動，自 110 年起接單情形持續成長，綜合業務及市場面之觀察探知，主要客戶全球擴張計畫、先進製程對光罩潔淨度要求越趨嚴格、因應廠房自動化及數位轉型及半導體後段先進封裝延伸應用所帶來之業務機會，及既有廠區之運作侷限，為滿足本公司中長期業務發展，在永續經營及提供員工良好工作環境之理念下，故興建自有廠房以供未來營運擴線所需。

C. 預計效益說明

本公司本次興建廠辦，展現公司永續經營之決心，以提供舒適工作環境為目標，使員工更有歸屬感及向心力，對公司之營運更有信心進而提升人員之穩定性及向心力，不僅有助於公司業務之拓展，更預留營運規模更加擴大之後，人員擴編所需之辦公空間，對公司整體資源之使用有正面之助益。本公司現有生產之廠房為租賃，且另外租賃倉儲空間，為有效整合廠區並因應營收規模逐年增加，預期未來廠房建置完成後，可視未來客戶訂單需求逐步擴充產線，隨著規模經濟效益浮現，將可挹注營收及獲利。

- 4.購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益

本次辦理現金增資預計用途為充實營運資金，故不適用本項評估。

5.購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響

本次辦理現金增資預計用途為充實營運資金，故不適用本項評估。

三、本次受讓他公司股份發行新股情形：不適用。

四、本次併購發行新股情形：不適用。

伍、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

1.簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣千元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)				
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
流動資產			561,900	922,123	1,578,449	1,708,726
採用權益法之投資			-	-	-	7,543
不動產、廠房及設備			12,868	12,407	15,421	76,461
使用權資產			-	3,933	20,668	37,797
無形資產			56,688	32,588	28,923	29,101
其他資產			3,574	7,927	11,637	21,086
資產總額			635,030	978,978	1,655,098	1,880,714
流動負債	分配前		489,446	765,862	1,083,569	1,112,712
	分配後		489,446	765,862	1,128,689	尚未分配
非流動負債			-	-	20,960	34,695
負債總額	分配前	不適用 (註 2)	489,446	765,862	1,104,529	1,147,407
	分配後		489,446	765,862	1,149,649	尚未分配
歸屬於母公司業主之權益			145,584	213,116	550,569	733,307
股本			55,200	110,400	225,600	272,976
資本公積			19,457	19,457	93,495	93,495
保留盈餘	分配前		70,927	83,259	231,474	367,221
	分配後		15,727	28,059	138,978	尚未分配
其他權益			-	-	-	(385)
庫藏股票			-	-	-	-
非控制權益			-	-	-	-
權益總額	分配前		145,584	213,116	550,569	733,307
	分配後		145,584	213,116	505,449	尚未分配

註 1：經會計師查核簽證之財務報告。

註 2：本公司於 109 年 12 月 31 日收購昇和精技公司 100% 之股權，故 108 年度無須編製合併財務報告。

2.簡明綜合損益表-國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣千元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)			
	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
營業收入		477,773	601,932	1,047,953	1,207,145
營業毛利		156,597	215,994	450,879	585,538
營業損益		79,781	113,203	242,329	260,034
營業外收入及支出		(118)	(22,243)	13,029	17,281
稅前淨利		79,663	90,960	255,358	277,315
繼續營業單位本期淨利		79,663	90,960	255,358	277,315
停業單位損失		-	-	-	-
本期淨利(損)	不適用 (註 2)	63,663	67,532	203,415	228,243
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	(385)
本期綜合損益總額		63,663	67,532	203,415	227,858
淨利歸屬於母公司業主		63,663	67,532	203,415	228,243
淨利歸屬於非控制權益		-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主		63,663	67,532	203,415	227,858
綜合損益總額歸屬於非控制權益		-	-	-	-
每股盈餘(元)(註 3)		3.18	3.37	9.84	8.36

註 1：經會計師查核簽證之財務報告。

註 2：本公司於 109 年 12 月 31 日收購昇和精技公司 100%之股權，故 108 年度無須編製合併財務報告。

註 3：本公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響。

3.簡明資產負債表-國際財務報導準則(個體)

單位：新臺幣千元

項目	年度	最近五年度財務資料(註)				
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
流動資產		420,975	506,042	850,074	1,501,318	1,650,360
不動產、廠房及設備		2,231	12,868	12,004	15,185	76,391
使用權資產		561	-	3,933	20,668	37,797
無形資產		604	431	259	86	1,107
其他資產		1,363	73,449	62,149	78,785	97,488
資產總額		425,734	592,790	928,419	1,616,042	1,863,143
流動負債	分配前	343,814	447,206	715,303	1,044,513	1,100,255
	分配後	343,814	447,206	715,303	1,089,633	尚未分配
非流動負債		-	-	-	20,960	29,581
負債總額	分配前	343,814	447,206	715,303	1,065,473	1,129,836
	分配後	343,814	447,206	715,303	1,110,593	尚未分配
歸屬於母公司業主之權益		81,920	145,584	213,116	550,569	733,307
股本		34,500	55,200	110,400	225,600	272,976
資本公積		19,457	19,457	19,457	93,495	93,495
保留盈餘	分配前	27,963	70,927	83,259	231,474	367,221
	分配後	7,263	15,727	28,059	138,978	尚未分配
其他權益		-	-	-	-	(385)
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	81,920	145,584	213,116	550,569	733,307
	分配後	81,920	145,584	213,116	504,449	尚未分配

註：各年度財務資料業經會計師查核簽證。

4.簡明綜合損益表-國際財務報導準則(個體)

單位：新臺幣千元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)				
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
營業收入		219,290	477,773	551,551	989,427	1,163,487
營業毛利		93,105	156,597	187,118	407,216	551,427
營業損益		33,497	79,781	105,827	225,243	255,872
營業外收入及支出		(1,358)	(118)	(17,453)	25,808	20,511
稅前淨利		32,139	79,663	88,374	251,051	276,383
繼續營業單位本期淨利		32,139	79,663	88,374	251,051	276,383
停業單位損失		-	-	-	-	-
本期淨利(損)		25,682	63,663	67,532	203,415	228,243
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-	(385)
本期綜合損益總額		25,682	63,663	67,532	203,415	227,858
淨利歸屬於母公司業主		25,682	63,663	67,532	203,415	228,243
淨利歸屬於非控制權益		-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主		25,682	63,663	67,532	203,415	227,858
綜合損益總額歸屬於非控制權益		-	-	-	-	-
每股盈餘(註 2)(元)		1.28	3.18	3.37	9.84	8.36

註 1：各年度財務資料業經會計師查核簽證。

註 2：本公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響。

(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響：無。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1.最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所	簽證會計師姓名	查核意見
108 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	林宜慧	無保留意見
109 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	林宜慧	無保留意見
110 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	曾建銘、王攀發	無保留意見
111 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	曾建銘、王攀發	無保留意見
112 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	曾建銘、王攀發	無保留意見

2.最近五年度如有更換會計師之情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：因原簽證會計師退休，故 110 年度更換會計師，且因應本公司擬申請公開發行所需，財務簽證增加第二簽證會計師。

(四)本國發行人自公開發行後最近連續七年或外國發行人最近連續七年由相同會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施：無。

(五)外國發行人申請股票登錄興櫃者，得僅列示最近二年度之財務資料；外國發行人申請股票第一上櫃者，得僅列示最近三年度之財務資料：不適用。

(六)財務分析

1.國際財務報導準則(合併)

分析項目		年度	最近五年度財務分析			
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	不適用 (註 2)	77.07	78.23	66.73	61.01
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率(%)		1,131.36	1,717.71	3,706.17	1,004.44
償債能力	流動比率(%)		114.80	120.40	145.67	153.56
	速動比率(%)		57.93	58.81	84.65	102.36
	利息保障倍數		9,958.88	778.44	1,838.11	379.33
經營能力	應收款項週轉率(次)		5.47	8.34	5.79	5.62
	平均收現日數		67	44	64	65
	存貨週轉率(次)		1.39	1.08	1.12	1.04
	應付款項週轉率(次)		2.89	2.45	2.43	2.86
	平均銷貨日數		263	338	326	351
	不動產、廠房及設備 週轉率(次)		63.29	47.63	75.32	26.28
獲利能力	總資產週轉率(次)		0.90	0.75	0.80	0.68
	資產報酬率(%)		12.00	8.38	15.45	12.94
	權益報酬率(%)		55.97	37.65	53.27	35.56
	稅前純益占實收資本 比率(%)		144.32	82.39	113.19	101.59
	純益率(%)		13.32	11.22	19.41	18.91
現金流量	每股盈餘(註 3)(元)	3.18	3.37	9.84	8.36	
	現金流量比率(%)	33.41	20.42	13.87	45.38	
	現金流量允當比率 (%)	註 4	91.53	93.20	148.40	
槓桿度	現金再投資比率(%)	108.51	70.68	25.70	57.94	
	營運槓桿度	2.17	2.24	1.93	2.08	
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達者可免分析)

(1)長期資金占不動產、廠房及設備比率：主要係增加設備所致。

(2)速動比率：主要係預付費用減少，以及應收帳款收回，使現金及約當現金增加所致。

(3)利息保障倍數：主要係利息支出增加所致。

(4)不動產、廠房及設備週轉率：主要係不動產、廠房及設備增加所致。

(5)權益報酬率：主要係業績成長，淨利增加所致。

(6)現金流量比率、現金流量允當比率、現金再投資比率：主要係預收貨款增加及應收帳款收回，營業活動現金流量增加所致。

註 1：經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註 2：本公司於 109 年 12 月 31 日收購昇和精技公司 100%之股權，故 108 年度無須編製合併財務報告。

註 3：本公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響。

註 4：此財務指標未滿五年度，故無法計算。

註 5：各財務比率計算公式如下

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

(3)稅前純益占實收資本額比率=稅前純益/期末實收資本額。

(4)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(5)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

2.國際財務報導準則(個體)

分析項目		最近五年度財務分析				
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	80.76	75.44	77.05	65.93	60.64
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	3,671.94	1,131.36	1,775.37	3,763.77	998.66
償債能力	流動比率(%)	122.44	113.16	118.84	143.73	150.00
	速動比率(%)	63.74	53.95	53.79	80.93	98.31
	利息保障倍數	1,461.86	9,958.88	756.33	1,807.12	378.06
經營能力	應收款項週轉率(次)	2.75	5.80	9.48	5.88	5.56
	平均收現日數	133	63	39	63	66
	存貨週轉率(次)	0.95	1.43	1.05	1.10	1.03
	應付款項週轉率(次)	1.62	2.95	2.38	2.40	2.82
	平均銷貨日數	385	256	348	332	355
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	93.71	63.29	44.35	72.78	25.41
	總資產週轉率(次)	0.71	0.94	0.73	0.78	0.67
獲利能力	資產報酬率(%)	8.34	12.50	8.89	16.00	13.15
	權益報酬率(%)	32.89	55.97	37.65	53.27	35.56
	稅前純益占實收資本比率(%)	93.16	144.32	80.05	111.28	101.25
	純益率(%)	11.71	13.32	12.24	20.56	19.62
	每股盈餘(註 2)(元)	1.28	3.18	3.37	9.84	8.36
現金流量	現金流量比率(%)	18.83	36.56	20.25	12.80	46.84
	現金流量允當比率(%)	註 3	註 3	87.45	87.39	144.37
	現金再投資比率(%)	53.55	108.51	65.47	22.87	59.66
槓桿度	營運槓桿度	2.98	2.17	2.10	1.90	1.98
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20%者可免分析)

(1)長期資金占不動產、廠房及設備比率：主要係增加設備所致。

(2)速動比率：主要係預付費用減少，以及應收帳款收回，使現金及約當現金增加所致。

(3)利息保障倍數：主要係利息支出增加所致。

(4)不動產、廠房及設備週轉率：主要係不動產、廠房及設備增加所致。

(5)權益報酬率：主要係業績成長，使淨利增加所致。

(6)現金流量比率、現金流量允當比率、現金再投資比率：主要係預收貨款增加及應收帳款收回，營業活動現金流量增加所致。

註 1：各年度財務資料業經會計師查核簽證。

註 2：本公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響。

註 3：此財務指標未滿五年度，故無法計算。

註 4：各財務比率計算公式如下

1.財務結構

- (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
- (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。
2. 償債能力
- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。
- (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。
3. 經營能力
- (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。
- (3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。
- (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。
- (6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。
- (7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。
4. 獲利能力
- (1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。
- (2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。
- (3) 稅前純益占實收資本額比率 = 稅前純益 / 期末實收資本額。
- (4) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。
- (5) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。
5. 現金流量
- (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。
- (2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。
- (3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。
6. 槓桿度
- (1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。
- (2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

(七)會計項目重大變動說明

最近二年度資產負債表及綜合損益表之會計項目金額變動達百分之十以上且金額達當年度資產總額百分之一者，其變化說明如下：

1.國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣千元

會計項目	111 年度		112 年度		增減變動		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
現金及約當現金	624,263	37.72	997,697	53.05	373,434	59.82	主要係業績成長及應收帳款收回所致。
應收帳款－非關係人	273,760	16.54	130,760	6.95	(143,000)	(52.24)	主要係帳款收回所致。
預付款項	54,672	3.30	4,040	0.21	(50,632)	(92.61)	主要係預付款項減少所致。
合約負債	616,648	37.26	766,588	40.76	149,940	24.32	主要係預收貨款增加所致。
應付帳款－非關係人	277,014	16.74	136,367	7.25	(140,647)	(50.77)	主要係應付帳款到期支付所致。
普通股股本	225,600	13.63	272,976	14.51	47,376	21.00	主要係辦理盈餘轉增資所致。
未分配盈餘	213,758	12.92	367,221	19.53	153,463	71.79	主要係稅後淨利增加所致。
銷貨收入	1,047,953	100.00	1,207,145	100.00	159,192	15.19	主要係銷售量增加所致。
營業毛利	450,879	43.02	585,538	48.51	134,659	29.87	主要係銷售量增加所致。
管理費用	78,582	7.50	106,510	8.82	27,928	35.54	主要係營運成長，管理費用增加所致。
研究發展費用	75,035	7.16	150,604	12.48	75,569	100.71	主要係因公司持續投入研發專案所致。
本年度淨利	203,415	19.41	228,243	18.91	24,828	12.21	主要係稅前淨利增加所致。

2.國際財務報導準則(個體)

單位：新臺幣千元

會計項目	111 年度		112 年度		增減變動		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
現金及約當現金	578,860	35.82	953,785	51.19	374,925	64.77	主要係業績成長及應收帳款收回所致。
應收帳款－非關係人	266,313	16.48	127,563	6.85	(138,750)	(52.10)	主要係應收帳款收回所致。
預付款項	54,660	3.38	3,840	0.21	(50,820)	(92.97)	主要係預付款項減少所致。
合約負債	589,091	36.45	762,289	40.91	173,198	29.40	主要係預收貨款增加所致。
應付帳款－非關係人	276,811	17.13	135,482	7.27	(141,329)	(51.07)	主要係應付帳款到期支付所致。
普通股股本	225,600	13.96	272,976	14.65	47,376	21.00	主要係辦理盈餘轉增資所致。
未分配盈餘	213,758	13.23	367,221	19.71	153,463	71.79	主要係稅後淨利增加所致。
銷貨收入	989,427	100.00	1,163,487	100.00	174,060	17.59	主要係銷售量增加所致。
營業毛利	407,216	41.16	551,427	47.39	144,211	35.41	主要係銷售量增加所致。
管理費用	65,300	6.60	97,219	8.36	31,919	48.88	主要係營運所需，管理費用增加所致。
研究發展費用	64,158	6.48	133,402	11.47	69,244	107.93	主要係因公司持續投入研發專案所致。
營業淨利	225,243	22.76	255,872	21.99	30,629	13.60	主要係業績成長所致。
稅前淨利	251,051	25.37	276,383	23.75	25,332	10.09	主要係營業淨利增加，以及利息收入增加所致。
本年度淨利	203,415	20.56	228,243	19.62	24,828	12.21	主要係稅前淨利增加所致。

二、財務報告應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告

1.111 年度合併財務報表及會計師查核報告書：請參閱附件一。

2.112 年度合併財務報告及會計師查核報告書：請參閱附件二。

(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告：

1.111 年度財務報表及會計師查核報告書：請參閱附件三。

2.112 年度財務報告及會計師查核報告書：請參閱附件四。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無。

三、財務概況及其他重要事項應記載事項

(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無此情形。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露下列資訊：無。

(三)期後事項：無。

(四)其他：無。

四、財務狀況及經營結果之檢討與分析

(一)財務狀況分析

1.最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新臺幣千元

項目	年度	111 年度	112 年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,578,449	1,708,726	130,277	8.25
採權益法之投資		-	7,543	7,543	100.00
不動產、廠房及設備		15,421	76,461	61,040	395.82
使用權資產		20,668	37,797	17,129	82.88
無形資產		28,923	29,101	178	0.62
其他資產		11,637	21,086	9,449	81.20
資產總額		1,655,098	1,880,714	225,616	13.63
流動負債		1,083,569	1,112,712	29,143	2.69
非流動負債		20,960	34,695	13,735	65.53
負債總計		1,104,529	1,147,407	42,878	3.88
股本		225,600	272,976	47,376	21.00
資本公積		93,495	93,495	-	-
保留盈餘		231,474	367,221	135,747	58.64
其他權益		-	(385)	(385)	(100.00)
權益總額		550,569	733,307	182,738	33.19
最近二年度發生重大變動項目(前後期變動達 20%以上，且絕對變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響：					
(1)不動產、廠房及設備增加：主要係機器設備所致。					
(2)使用權資產增加：主要係新增租賃廠辦所致。					
(3)非流動負債增加：主要係新增租賃廠辦所致。					
(4)股本增加：主要係辦理盈餘轉增資發行新股所致。					
(5)保留盈餘增加：主要係稅後淨利增加所致。					

(二)財務績效分析

1.最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新臺幣千元

項目	年度	111 年度	112 年度	差異	
				金額	比率(%)
營業收入		1,047,953	1,207,145	159,192	15.19
營業成本		597,074	621,607	24,533	4.11
營業毛利		450,879	585,538	134,659	29.87
營業費用		208,550	325,504	116,954	56.08
營業利益		242,329	260,034	17,705	7.31
營業外收入及支出		13,029	17,281	4,252	32.63
稅前淨利		255,358	277,315	21,957	8.60
所得稅費用		51,943	49,072	(2,871)	(5.53)
本期淨利		203,415	228,243	24,828	12.21
最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動(前後期變動達 20%以上，且絕對變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因：					
(1)營業毛利增加：主要係銷貨量增加，使營業毛利增加所致。					
(2)營業費用增加：主要係營運成長，研究發展費用及管理費用增加所致。					

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司銷售數量係依據本公司年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢及客戶營運概況等因素，並參酌本公司目前接單情形之合理編制，預估本公司業績呈穩定成長趨勢，對財務業務狀況有正面影響。

(三)現金流量

1.最近年度(112 年度)現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣千元

項目	年度	111 年度	112 年度	增(減)變動	
				金額	%
營業活動		137,802	504,980	367,178	266.45
投資活動		(25,221)	(75,730)	(50,509)	(200.27)
籌資活動		126,426	(53,285)	(179,711)	(142.15)
現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動流入增加：主要係應收帳款收回增加及預付款減少所致。					
(2)投資活動流出增加：主要係取得不動產、廠房及設備增加所致。					
(3)籌資活動流出增加：主要係上期辦理現金增資及本期發放現金股利所致。					

2.流動性不足之改善計畫：

本公司無現金不足額之情形，尚無資金流動性不足之虞。

3.未來一年(113 年度)現金流動性分析

單位：新臺幣千元

年初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動 淨現金流量 (2)	預計全年來自投資活動 淨現金流量 (3)	預計全年來自籌資活動 淨現金流量 (4)	預計現金 剩餘(不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金餘絀 之因應措施	
					投資 計畫	融資 計畫
997,697	32,011	(37,865)	303,681	1,295,524	無	無
未來一年現金流量變動情形分析：						
(1)營業活動：主要係預估業績持續成長，購料支出、人力成本等相應增加。						
(2)投資活動：主要係建廠相關費用增加。						
(3)籌資活動：主要係辦理金增資所致。						

(四)最近年度(112 年度)重大資本支出對財務業務之影響：無。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1.轉投資政策

本公司轉投資政策係基於永續經營及營運成長性考量，對本業發展或拓展業務範圍有利之事業，並訂有「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」，為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關財務業務狀況。

2.最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新臺幣千元

轉投資事業	主要營業項目	112年度認列之投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
昇和精技(股)公司	半導體製程用物理氣相沈積設備(PVD 設備)及相關零組件之製造及銷售。	2,733	經營穩定	無
Gudeng Inc.	經營各種電子零組件業務	(32)	經營穩定	無

3.未來一年投資計畫：無。

(六)其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

- (一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議：無。
- (二)最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形：本公司內部稽核人員於執行稽核過程中，並無發現足以影響本公司營運之重大缺失。
- (三)內部控制聲明書：請參閱本公開說明書附件五。
- (四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：本公司為股票初次申請上櫃，委託會計師專案審查內部控制，未有缺失事項，請參閱本公開說明書附件六。

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：請參閱本公開說明書附件七。

四、律師法律意見書：請參閱本公開說明書附件八。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形：不適用。

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金融監督管理委員會證券期貨局通知應補充揭露之事項：無。

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：無。

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：請參閱本公開說明書附件九。

十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：不適用。

十三、本國發行人自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書：請參閱本公開說明書附件六。

十四、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常規交易情事之書面承諾，及其重要業務之政策：請參閱本公開說明書附件十。

十五、發行人是否有與其他公司共同使用申請貸款額度：無。

十六、發行人有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人：無。

十七、發行人申請公司債上櫃者，應說明公司債本金及利息償還之資金來源，暨發行標的或

保證金融機構之信用評等等級、評等理由及評等展望等信用評等結果：不適用。

- 十八、發行人有財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查準則第十條第一項第四款或外國審查準則第九條第一項第三款情事者，應將該重大未改善之非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會：無。
- 十九、充分揭露發行人與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式：請參閱本公開說明書附件十八。
- 二十、發行人分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響：本公司截至公開說明書刊印日止，並未有已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，故不適用。
- 二一、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明：誠信聲明書請參閱附件十二。
- 二二、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見：不適用。
- 二三、其他必要補充說明事項：

(一)有關貴公司對業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見。

家碩科技股份有限公司(以下簡稱家碩公司)主要從事光罩相關半導體設備之研發、製造及銷售，其最近二年度及 112 年前三季之業績變化情形如下表，有關家碩公司業績變化之合理性及未來發展性為何？家碩公司說明及推薦證券商出具評估意見如后：

單位：新臺幣千元

項目/年度	110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入(淨額)	601,932	100.00	1,047,953	100.00	1,016,063	100.00
營業成本	(385,938)	(64.12)	(597,074)	(56.98)	(523,859)	(51.56)
營業毛利	215,994	35.88	450,879	43.02	492,204	48.44
營業費用	(102,791)	(17.08)	(208,550)	(19.90)	(259,221)	(25.51)
營業利益	113,203	18.80	242,329	23.13	232,983	22.93
營業外收入及支出	(22,243)	(3.69)	13,029	1.24	34,667	3.41
稅前淨利	90,960	15.11	255,358	24.37	267,650	26.34
所得稅費用	(23,428)	(3.89)	(51,943)	(4.96)	(51,702)	(5.09)
稅後純益	67,532	11.22	203,415	19.41	215,948	21.25
期末資本額	110,400		225,600		272,976	
每股稅後	追溯前(註 1)		11.06		7.54	
純益(元)	追溯後(註 2)		9.13		7.54	

資料來源：申請公司各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

註 1：係以當年度加權平均流通在外股數計算之稀釋每股稅後純益

註 2：係以申請年度最近期財報為基準往前追溯調整之稀釋每股稅後純益

公司說明：

1. 本公司所屬行業之產業概況及所營業務之主要內容

(1) 本公司所屬行業之產業概況

光罩係積體電路製造過程中使用的必要材料，其主要用途在於將積體電路之各種電路設計圖形轉化為晶圓製造廠大量生產所需的介面模具，扮演電路設計被轉印到晶圓上之重要角色。隨半導體製程持續精進，更精細的電路圖案需要更多層的光罩來協助生產，半導體代工廠所需保存的光罩持續增加，且為增加微影製程之良率，須持續清潔光罩上之 HAZE(霧狀污染物)及微塵等，本公司主要係開發及製造光罩相關之機器設備，包含光罩儲存櫃、光罩清洗機、EIP 檢查機及光罩交換機等，以協助客戶保存及確保製程中之光罩為潔淨狀態；另本公司之子公司昇和精技目前主係提供 PVD(Physical vapor deposition, 物理氣相沉積技術)真空鍍膜機台改造服務(110 年度~111 年度及 112 年前三季占整體合併營收比重分別為 8.37%、5.52%及 4.31%)。茲就半導體產業及半導體設備產業概況說明如下：

A. 半導體產業概況

根據世界半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)統計資料指出，111 年全球半導體銷售值為 5,741 億美元，相較於 110 年銷售值僅微幅成長 3.3%，主係 111 年受到俄烏戰爭、通貨膨脹、央行升息、終端消費萎縮、總體經濟下修等因素影響，成長力道明顯趨緩。112 年第一季因持續受到通膨及終端市場需求低迷影響，全球半導體市場銷售值 1,195 億美元，較 111 年第四季衰退 8.7%，112 年第二季因庫存持續去化中，全球半導體市場銷售值為 1,245 億美元，雖整體終端需求復甦力道不如預期，惟較上季成長 4.2%。

臺灣是全球主要半導體生產基地之一，根據資策會產業情報研究所(Market Intelligence & Consulting Institute, MIC)統計資料指出，111 年臺灣半導體產值為新臺幣 4.408 兆元，年成長 18.6%，成長率優於全球半導體產業。112 年全球半導體產業面臨庫存調整期拉長、IC 設計與記憶體產業需求下滑、美中科技戰未停歇等情事，臺灣半導體預估產值為 3.77 兆元，衰退 14.4%。展望 113 年，預期各次產業(如：IC 設計、晶圓代工、記憶體/IDM 及 IC 封測)將有一至二成的成長幅度，故預估產值將達 4.29 兆元，成長 13.7%，其中晶圓代工仍為主要動能，特別是先進製程部分。

B. 半導體設備產業

半導體設備是半導體產業的核心，設備品質和性能對半導體元件良率有很大的影響，由於半導體產業的快速發展，相關設備市場需求持續成長，例如：增設生產線、擴產擴廠，因此半導體設備廠商亦隨產業發展同步成長。根據國際半導體產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)公布之 112 年第三季《全球晶圓廠預測報告》，受到晶片需求疲軟及消費性產品、行動裝置庫存增加影響，112 年第三季全球半導體設備出貨金額 256 億美元，較第二季 258 億美元減少 1%，較去年同期 288 億美元減少 11%，並預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，112 年從 111 年的歷史高點 995 億美元，下滑 15%至 840 億美元，113 年隨著半導體庫存調整結束及高效能運算、記憶體等需求增加，有助晶圓廠設備支出復甦，將回升 15%，達到 970 億美元。

整體而言，半導體產業仍充滿潛力和長期發展趨勢，包含：(1)智慧型裝置(如智慧型手機、智慧型家電、智慧型醫療等)普及；(2)新能源車：電動車能源政策推動電動車發展；(3)物聯網：物聯網技術的發展將需要大量的半導體元件支持產品間傳輸功能；(4)雲端裝置：雲端計算和大數據將需要大量的半導體元件；(5)新型技術：例如人工智慧、機器學習、量子電腦等新型技術的發展，將有助於擴大半導體應用面，為半導體產業帶來新的商機。

(2)本公司所營業務之主要內容

單位：新臺幣千元

產品項目	重要用途及功能	110年度		111年度		112年前三季	
		營收淨額	%	營收淨額	%	營收淨額	%
EUV相關光罩機器設備	應用於 EUV(7 奈米以下先進製程)及高階製程(DUV)光罩之相關半導體設備，主係半導體微影製程中所使用之光罩價格高昂，產生降低人工作業以減少失誤之需求，及對潔淨度要求提升，故為維護 EUV 光罩潔淨且延長光罩使用壽命，本公司提供包含光罩儲存櫃、光罩清洗機、光罩交換機及 EIP 檢查機等設備，以滿足自動化的光罩潔淨需求。	345,857	57.46	539,223	51.45	359,380	35.37
高階相關光罩機器設備	其中光罩儲存櫃主要功能為透過持續充氣保持光罩潔淨度；光罩清洗機可清除光罩表面微塵(Particle)或其他污染物，使光罩迅速恢復可生產狀態；光罩交換機主要係為使光罩於儲存櫃及產線間交換時保持潔淨度且自動化，降低人為疏失且達維持光罩一定潔淨度之需求；EIP 檢查機主要係在光罩要放進光罩盒(EUV Pod)前，檢查 EUV 光罩盒內盒(EUV Inner Pod)是否為潔淨狀態，以避免光罩受污染。	158,199	26.28	375,577	35.84	536,955	52.85
其他	包含 PVD 設備改造、本公司銷售之設備維修、售後服務及相關零組件銷售等產生之收入。	97,876	16.26	133,153	12.71	119,728	11.78
合計		601,932	100.00	1,047,953	100.00	1,016,063	100.00

資料來源：本公司提供

本公司主要產品光罩儲存櫃，及光罩清洗、交換及檢查等設備，係屬半導體微影製程中所衍生之周邊設備，目的為協助維持光罩之潔淨程度，非直接應用於微影製程之主製程設備，故本公司相關設備非屬客戶需周期性採購更替之設備，需求主要來自於客戶新建廠房或擬提升現有廠房之光罩潔淨程度所產生，其中儲存櫃可能視客戶廠房空間規劃有不同數量及規格之需求，光罩清洗、交換及檢查等設備則依各廠區晶圓產量而不同配置相關設備。

2.最近二年度及申請年度業績變化原因及其合理性分析

(1)列示最近二年度及申請年度各主要產品別業績及毛利率變動表

單位：新臺幣千元

年度 產品	110年度				111年度			
	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)
EUV 相關光罩機器設備	345,857	239,100	106,757	30.87	539,223	357,493	181,730	33.70
高階相關光罩機器設備	158,199	102,294	55,905	35.34	375,577	198,642	176,935	47.11
其他	97,876	44,544	53,332	54.49	133,153	40,939	92,214	69.25
合計	601,932	385,938	215,994	35.88	1,047,953	597,074	450,879	43.02

資料來源：本公司提供

單位：新臺幣千元

年度 產品	111年前三季				112年前三季			
	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)	營業收入	營業成本	營業毛利	毛利率(%)
EUV 相關光罩機器設備	401,872	275,690	126,182	31.40	359,380	212,295	147,085	40.93
高階相關光罩機器設備	153,011	87,316	65,695	42.93	536,955	277,776	259,179	48.27
其他	114,968	34,523	80,445	69.97	119,728	33,788	85,940	71.78
合計	669,851	397,529	272,322	40.65	1,016,063	523,859	492,204	48.44

資料來源：本公司提供

A.營業收入

本公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業收入分別為 477,773 千元、601,932 千元、1,047,953 千元及 1,016,063 千元；營業收入變動率分別為 25.99%、74.10%及 51.68%，110 年度營業收入較 109 年度營業收入增加 124,159 千元，成長 25.99%，主係 110 年新冠(COVID-19)疫情使各國對半導體供應鏈中斷產生疑慮，加上遠距生活型態加速數位轉型，全球對半導體的需求超過供給，為因應晶片需求攀升，晶圓製造廠持續擴廠，加上為提供晶片效能，各廠持續開發先進製程，故本公司 110 年度來自 EUV 光罩相關機器設備之營業收入較 109 年度增加 80,119 千元，另本公司於 109 年底收購子公司昇和精技，110 年度來自於子公司 PVD 真空鍍膜機台改造服務營業收入增加 50,381 千元所致；111 年度營業收入較 110 年度大幅增加 446,021 千元，成長 74.10%，主係全球半導體產業大舉投入擴廠，對本公司產品需求增加所致，其中因 A 集團部分廠區訂單委由 B 集團統籌下單，故對 B 集團之營業收入較 110 年度增加 402,764 千元，另本公司為 G 集團開發客製化設備，因持續獲其訂單並陸續驗收設備，故 111 年度對 G 集團之營業收入較 110 年度增加 82,663 千元；112 年前三季營業收入較 111 年前三季增加 346,212 千元，成長 51.68%，主係配合 A 集團擴廠計畫及產品持續受到 G 集團青睞，使對 A 集團及 G 集團之營業收入分別較 111 年前三季增加 114,114 千元及 209,102 千元。

(A) EUV 相關光罩機器設備

本公司 EUV 光罩相關機器設備主要包含 EUV 光罩儲存櫃、EUV 光罩清洗機、EUV 光罩檢測機等客製化功能性機器設備，主係應用於極紫外光(Extreme Ultraviolet, EUV)微影製程所使用之光罩。本公司 110~111 年度及 112 年前三季 EUV 光罩相關機器設備之營業收入分別為 345,857 千元、539,223 千元及 359,380 千元，其占整體營業收入淨額之比率分別為 57.46%、51.45%及 35.37%。111 年度銷售 EUV 光罩相關設備金額較 110 年度增加 193,366 千元，主係因應 A 集團持續擴產，對於大型之 EUV 光罩相關設備需求增加，雖銷售之設備數量無顯著成長，惟平均單價較高之大型設備銷售占比上升所致；112 年前三季銷售金額較 111 年同期減少 42,492 千元，主係 112 年前三季雖 EUV 光罩相關設備銷售數量成長，惟平均單價較低之小型 EUV 光罩相關設備銷售占比增加，使 112 年前三季之 EUV 光罩相關設備銷售金額較去年同期下降。

(B) 高階相關光罩機器設備

本公司高階光罩相關機器設備主要包含高階光罩儲存櫃、高階光罩清洗機及高階光罩交換機等客製化功能性設備，主係應用於深紫外光(Deep Ultraviolet, DUV)微影製程所使用之光罩，提供高階光罩微污染防治之解決方案。本公司 110~111 年度及 112 年前三季高階光罩相關設備之營業收入分別為 158,199 千元、375,577 千元及 536,955 千元，占整體營業收入淨額之比率分別為 26.28%、35.84%及 52.85%。111 年度銷售高階光罩相關機器設備金額較 110 年度增加 217,378 千元，主係因應 A 集團擴廠之設備需求，使高階光罩相關設備之營收增加 125,544 千元，另本公司積極協助 G 集團及開發其產線所須之客製化設備，使高階光罩相關設備之營收增加 54,271 千元；112 年前三季銷售高階光罩相關機器設備金額較去年同期增加 383,944 千元，主係客製化產品持續受 G 集團青睞，大量採購運用至其不同廠區，使本公司 112 年前三季對 G 集團高階光罩相關機器設備之營業收入較 111 年同期增加 193,835 千元，另配合 A 集團擴廠計劃，本公司 112 年前三季對 A 集團高階光罩相關設備之營業收入較 111 年同期增加 69,403 千元。

(C) 其他

本公司 110~111 年度及 112 年前三季其他之營業收入分別為 97,876 千元、133,153 千元及 119,728 千元，占整體營業收入淨額之比率分別為 16.26%、12.71%及 11.78%。本公司其他收入主要來自 PVD 機台客製化改造，及隨本公司機台銷售衍生之設備維修、備品零組件銷售等產生之收入，其中 PVD 機台客製化改造服務係因 PVD 設備價格昂貴，客戶主要採更換零件或是系統更新，使設備可持續使用並降低升級成本，由本公司之子公司昇和精技依客戶需求，協助其於現有設備上新增、更換零組件或是改良設備功能。110~111 年度及 112 年前三季其他收入中由昇和精技提供 PVD 設備改造服務產生之收入分別為 50,381 千元、58,526 千元及 41,477 千元，111 年度較 110 年度成長 8,144 千元，主係因 J 公司終端客戶對於 PVD 設備改造需求增加所致；112 年前三季則較去年同期減少 14,252 千元，主係光電產業整體需求疲軟，客戶對設備升級暫緩所致；另本公司 110~111 年度及 112 年前三季來自維修及機台設備零組件買賣之營業收入分別為 47,495 千元、74,627 千元及 78,251 千元，呈成長趨勢，

主係隨本公司機台設備銷售數量持續增加，所衍生之維修服務、機台改造、零組件買賣等相關收入持續增加所致。

B.營業成本、營業毛利及毛利率

本公司營業成本主要為原料、直接人工及製造費用，原料包含電料、金屬加工件及電控、管路組件占產品成本比重平均約 80~85%，原料主要為內購。

(A)EUV 相關光罩機器設備

本公司 110~111 年度及 112 年前三季 EUV 光罩相關機器設備之毛利率分別為 30.87%、33.70%及 40.93%。本公司 EUV 光罩相關機器設備包含大型光罩儲存櫃、小型光罩儲存櫃、EIP 檢查機及光罩清洗機等，110~111 年度及 112 年前三季 EUV 大型光罩儲存櫃產生之營業收入占 EUV 相關光罩機器設備營業收入比重均達 8 成以上。本公司 110~111 年度及 112 年前三季 EUV 光罩相關設備之毛利率逐年增加，主係 A 集團為縮短裝機時程及提高設備生產效率，自 110 年起部分廠區之 EUV 大型光罩儲存櫃設備改委託 B 集團進行下單並進行整體規劃，本公司因設備規格持續進階等因素，使本公司 EUV 大型光罩儲存櫃毛利率由 110 年度之 29.42%成長至 111 年度之 33.55%，112 年前三季再成長為 40.7%。

(B)高階相關光罩機器設備

本公司 110~111 年度及 112 年前三季高階光罩相關設備之毛利率分別為 35.34%、47.11%及 48.27%。本公司高階光罩相關設備包含大型高階光罩儲存櫃、小型高階光罩儲存櫃、光罩清洗機及光罩交換機等。111 年度及 112 年前三季小型光罩儲存櫃及清洗機及交換機等平均毛利較高之設備銷售占比及數量均較前期增加，其中以 G 集團為主要銷售客戶，其交易幣別為美元，近年因美國實施貨幣緊縮政策及美國持續升息，使平均美元兌新臺幣匯率由 110 年 27.42 元、111 年 29.04 元升值至 112 年前三季的 30.45 元，進而提高 G 集團之小型光罩儲存櫃毛利率，致 111 年度及 112 年前三季整體高階光罩相關設備之毛利率均較前期成長。

(C)其他

本公司 110~111 年度及 112 年前三季來自其他之毛利率分別為 54.49%、69.25%及 71.78%。110 年度其他收入毛利率偏低僅 54.49%，主係本公司 109 年底收購子公司昇和精技，其存貨公允價值較帳面價值高，產生股權淨值差異 5,795 千元，因該存貨已於 110 年度出售，故相關股權淨值差異於 110 年度攤銷完畢，致 110 年度成本增加 5,795 千元。111 年度來自其他之毛利率上升 14.76%，主係 111 年度本公司新增較多來自 J 公司 PVD 機器設備改造之需求，此類服務毛利率較高，故使營業毛利及毛利率均較前一年度增加；112 年前三季來自其他收入之毛利率較 111 年同期上升 1.81%，與 111 年同期相較變動不大。

(2)主要銷售對象變化分析
最近二年度及申請年度前十大客戶變動表

單位：新臺幣千元

	110 年度			111 年度			112 年前三季		
	名稱	金額	%	名稱	金額	%	名稱	金額	%
1	A 集團	407,577	67.71	B 集團	461,443	44.03	B 集團	308,339	30.35
2	B 集團	58,679	9.75	A 集團	258,304	24.65	G 集團	243,520	23.97
3	J 公司	45,310	7.53	G 集團	105,358	10.05	A 集團	236,614	23.29
4	K 集團	26,506	4.40	J 公司	51,620	4.93	K 集團	67,289	6.62
5	G 集團	22,695	3.77	M 集團	49,002	4.68	J 公司	35,224	3.47
6	E 集團	11,060	1.84	K 集團	22,561	2.15	H 公司	34,269	3.37
7	F 集團	6,439	1.07	N 集團	17,662	1.69	P 公司	20,955	2.06
8	L 公司	5,439	0.90	O 公司	15,769	1.50	O 公司	17,571	1.73
9	M 集團	4,772	0.79	D 集團	14,852	1.42	F 集團	16,541	1.63
10	Brooks 集團	2,733	0.45	L 公司	11,997	1.14	E 集團	16,037	1.58
	小計	591,210	98.21	小計	1,008,568	96.24	小計	996,359	98.07
	其他	10,722	1.79	其他	39,385	3.76	其他	19,704	1.93
	總計	601,932	100.00	總計	1,047,953	100.00	總計	1,016,063	100.00

資料來源：本公司提供

本公司主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。110~111 年度及 112 年前三季之營業收入淨額分別為 601,932 千元、1,047,953 千元及 1,016,063 千元，呈現逐年成長趨勢，主係本公司積極維繫與客戶穩定合作之關係，並於近年來開發新產品應用及拓展新客戶所致。

茲將本公司之前十大銷售對象之變化情形說明如下：

A. 終端客戶為 A 集團

(A) A 集團

A 集團成立於民國 76 年，總部位於臺灣新竹市，為全球最主要之專業積體電路製造服務公司，主要產品為先進製程之邏輯積體電路(Logic IC)及特定應用積體電路(ASIC)，其產品廣泛應用於各個終端市場，包含高效能運算、智慧型手機、物聯網車用電子與消費性電子產品等領域。

本公司與 A 集團交易始於 105 年，對 A 集團主要銷售產品為 EUV 及高階光罩儲存櫃、清洗機等功能性設備、機器設備相關耗材及維修服務等。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 407,577 千元、258,304 千元及 236,614 千元，銷售比重分別為 67.71%、24.65%及 23.29%。雖過去二年度隨著疫情造成的區域封鎖、區域衝突及地緣政治的緊張局勢，嚴重擾亂全球供應鏈，惟來自 5G、高效能運算(HPC)和人工智慧(AI)等相關應用產業之發展趨勢，仍使長期半導體需求結構呈現持續增長；A 集團在配合其客戶長期需求之情況下，持續規劃產能及全球生產版圖，並由本公司負責提供其所需之設備，故 A 集團最近二年度及 112 年截至第三季止均為本公司之前三大銷售客戶，另自 110 年度起 A

集團為縮短裝機時程及提高設備生產效率，部分廠區設備委託 B 集團進行下單並規劃，故相關設備訂單係轉由 B 集團下單，致本公司對 A 集團之直接銷售金額減少。

(B) B 集團

B 集團成立於民國 26 年，總部位於日本大阪，於民國 73 年即深耕台灣。B 集團為自動搬運系統產業界之領導廠商，主要生產高科技產業無塵室之自動化倉儲運送機械設備，如工廠自動化物流搬送系統、無塵室工廠自動化系統等。

本公司與 B 集團交易始於 106 年，對 B 集團主要銷售產品為 EUV 及高階光罩充氣儲存櫃及設備盤面模組。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 58,679 千元、461,443 千元及 308,339 千元，銷售比重分別為 9.75%、44.03%及 30.35%。本公司最近二年度及 112 年度截至第三季止對 B 集團銷售金額呈現逐年上升，主係自 110 年度起，A 集團為縮短裝機時程及提高設備生產效率，將部分廠區設備之規劃委由 B 集團統籌，故本公司對 B 集團之銷售金額顯著增加。目前本公司對 B 集團所銷售之設備主係為 A 集團所需，致 B 集團最近二年度及 112 年截至第三季止皆為本公司之前十大銷售客戶。

(C) M 集團

M 集團成立於民國 24 年，為日本代表性機械設備商之一，主要從事纖維機械、工作機械、板金加工機械、自動化物流系統、無塵室搬送系統相關設備之銷售及售後服務。

本公司與 M 集團交易始於 106 年，對 M 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及設備封板壓條模組等。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 4,772 千元、49,002 千元及 6,463 千元，銷售比重分別為 0.79%、4.68%及 0.64%。111 年度本公司對 M 集團銷售金額上升，係因物聯網、5G 應用及電動車對半導體的需求不斷增加，且 A 集團部分廠區為縮短裝機時程及提高效率，指定由 M 集團進行下單並進行設備整合，使 M 集團 110~111 年度皆為本公司及子公司銷貨前十大客戶；112 年前三季因 M 集團來自 A 集團之訂單減少，故 M 集團退出前十大銷售客戶。

B. 終端客戶為 N 集團

(A) N 集團

N 集團成立於民國 98 年，總部位於美國加利福尼亞州，為世界前五大專業晶圓代工廠，提供客戶 IC 製造服務，生產一系列半導體產品，主要應用包含智慧型手機、電動車、資料中心及物聯網等應用領域，在美國、德國、新加坡均有設立晶圓廠。

本公司與 N 集團交易始於 106 年，對 N 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機、機台改造服務及設備相關耗材。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 1,996 千元、17,662 千元及 7 千元，銷售比重分別為 0.33%、1.69%及 0.00%。111 年度本公司對 N 集團銷售金額上升，主要係全球終端數位電子產品及半導體需求增加使晶圓產量上升，N 集團於 110 年擴建廠區，並向本公司採購一台光罩清洗機，以因應晶片生產需求，111 年度於廠房基礎建設完成後，相關晶圓製程所需設備陸續進機所

致，110 年度主係銷售設備相關耗材，故 N 集團僅 111 年度為本公司之銷貨前十大客戶，另自 112 年度起考量銷售區域服務便利之因素，N 集團係委託 P 公司進行設備組裝，故相關設備訂單轉由 P 公司向本公司下單。

(B) P 公司

P 公司成立於民國 74 年，總部位於新加坡，主要經營微污染控制工程服務，提供無塵室和無塵空氣設備之設計及製造、無塵室性能測試及認證、微污染儀器的銷售、校準及維修等，本公司與 P 公司交易始於 106 年。

本公司對 P 公司主要銷售產品為高階光罩清洗機及機器設備相關耗材等。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 93 千元、47 千元及 20,955 千元，銷售比重分別為 0.02%、0.00%及 2.06%。110~111 年度之交易主要為設備相關零組件需求及維修服務等，112 年前三季主係因應 N 集團建廠之需求，對於本公司之光罩相關半導體設備採購增加，並由 P 公司向本公司採購及負責機台後續組裝等相關服務，故於 112 年前三季為本公司銷貨前十大客戶。

C. 其他

(A) J 公司

J 公司成立於民國 94 年，位於臺灣臺南市，主要經營半導體及顯示器相關設備及材料之製造及銷售，包含 FPD 顯示技術相關設備及半導體顯示設備之技術服務，為本公司於 109 年 12 月 31 日收購 100% 子公司昇和精技之原主要客戶，故本公司與 J 公司交易始於 110 年。

本公司對 J 公司主要提供物理氣相沉積(PVD)系統改造及材料更換等客製化服務。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 45,310 千元、51,620 千元及 35,224 千元，銷售比重分別為 7.53%、4.93%及 3.47%。本公司對 J 公司銷售金額呈現逐年上升，主係本公司於 PVD 真空設備設計與改造擁有多年經驗，並可提供客戶客製化之設備關鍵技術及材料更新及改造，故本公司 110~111 年度及 112 年前三季持續獲得 J 公司之訂單挹注並為本公司銷貨前十大客戶。

(B) K 集團

K 集團成立於民國 69 年，總部位於臺灣新竹市，主要經營積體電路及半導體相關零組件，包含邏輯/混合信號、嵌入式高壓解決方案及嵌入式非揮發性記憶體等。本公司與 K 集團交易始於 109 年，對 K 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及機器設備相關耗材等。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 26,506 千元、22,561 千元及 67,289 千元，銷售比重分別為 4.40%、2.15%及 6.62%。本公司 110~111 年度對 K 集團銷售金額變動不大，各有一台高階光罩儲存櫃完成驗收認列收入，另因 112 年前三季 K 集團擴充廠區產能，陸續有 3 台光罩清洗機及 1 台高階光罩儲存櫃完成驗收認列收入，故使 K 集團 110~111 年度及 112 年前三季皆為本公司銷貨前十大客戶。

(C) G 集團

G 集團成立於民國 57 年，總部位於美國加利福尼亞州，主要經營業

務為中央處理器(CPU)、伺服器及其相關解決方案之設計、製造、銷售及服務，產品應用包含邊緣計算、5G、雲端服務、AI和自動駕駛等新興領域。本公司與G集團交易始於106年，對G集團主要銷售產品為高階光罩儲存櫃、全自動EIP表面檢查機及其他小型設備輔助器具等。110~111年度及112年前三季對其銷售金額分別為22,695千元、105,358千元及243,520千元，銷售比重分別為3.77%、10.05%及23.97%。本公司對G集團銷售金額呈現逐年上升的趨勢，主係因G集團分別於美國、歐盟地區及以色列等地區興建半導體晶圓廠並投入研發、設計及製造，對半導體設備需求增加。因本公司為G集團開發客製化機器設備，機器設備之妥善率受到G集團肯定，故本公司持續獲得訂單挹注，使G集團110~111年及112年前三季皆為本公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

(D) E 集團

E集團成立於民國89年，總部位於中國上海市，為中國境內主要的積體電路晶圓代工廠之一，主要經營業務為8吋及12吋晶圓代工與技術服務，其產品應用於智慧型手機、智能家電及消費性電子等領域。本公司與E集團交易始於109年，對E集團主要銷售產品為高階光罩清洗機、機台改造及設備相關耗材等。110~111年度及112年前三季對其銷售金額分別為11,060千元、4,168千元及16,037千元，銷售比重分別為1.84%、0.40%及1.58%。為因應全球對於半導體需求大增，且中國政府持續支持半導體產業發展，110年度及112年前三季E集團持續擴充產能及對各廠產品製程優化，對半導體機台設備需求增加，故110年度及112年前三季成為銷貨前十大客戶；111年度之銷售產品主係設備改造及相關耗材，使本公司對其營業收入下降並未列入銷貨前十大之列。

(E) F 集團

F集團成立於民國67年，總部位於美國愛達荷州，為全球記憶體解決方案之領導廠商，主要經營業務為記憶體及儲存裝置之設計、開發及製造等，包含動態隨機存取存儲器(DRAM)、NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體及儲存產品等。本公司與F集團交易始於106年，對F集團主要銷售產品為EUV及高階光罩儲存櫃、光罩清洗機、設備維護服務及機器設備相關耗材等。110~111年度及112年前三季對其銷售金額分別為6,439千元、5,816千元及16,541千元，銷售比重分別為1.07%、0.55%及1.63%。隨各家DRAM廠將製程推進至EUV製程，為因應技術升級及擴增無塵室空間，F集團於108年宣布擴建晶圓廠，隨製程演進對於半導體設備需求大幅增加，故分別於110年度及112年度向本公司採購光罩相關半導體設備，故110年度及112年前三季成為銷貨前十大客戶；111年度主要交易產品為小型半導體相關機器設備、設備維護服務及機器設備相關零組件等，故使得本公司對其營業收入下降並未列入前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

(F) L 公司

L公司成立於民國104年，位於安徽省合肥市，主要經營晶圓代工服務，包含液晶面板、手機等消費電子相關之晶片，本公司與L公司交易始於107年。

本公司對L公司主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃等。110~111

年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 5,439 千元、11,997 千元及 454 千元，銷售比重分別為 0.90%、1.14%及 0.04%。本公司於 111 年度對 L 公司銷售金額上升，主係 L 公司關注面板驅動晶片相關產品布局，且為因應半導體產業持續擴張，故持續積極擴充產能，並於 110 年進行晶圓廠擴廠，故對於本公司光罩儲存櫃需求隨之增加，使 L 公司 110~111 年度皆為本公司銷貨前十大客戶，然隨 L 公司擴廠逐漸完工，使得本公司對其營業收入下降並退出銷貨前十大之列。

(G) Brooks 集團

Brooks Automation US LLC 成立於民國 67 年，總部位於美國馬薩諸塞州，主要經營業務為自動化及機器人之解決方案，包含半導體工廠自動化及生技協作機器人相關技術服務等。本公司與 Brooks 集團交易始於 106 年，對 Brooks 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及機器設備相關耗材等。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 2,733 千元、11,233 千元及 3,607 千元，銷售比重分別為 0.45%、1.07%及 0.35%。110~111 年度因應其終端客戶需求，故向本公司購置光罩儲存櫃，使 Brooks 集團 110 年度成為本公司之前十大客戶；然 112 年前三季終端客戶委託 Brooks 集團之專案接近尾聲，故 Brooks 集團退出前十大銷售客戶。

(H) O 公司

O 公司成立於民國 76 年，總部位於臺灣台中市，主要經營記憶體 IC 設計、製造與銷售，包含利基型記憶體、行動記憶體以及編碼型快閃記憶體等，本公司與 O 公司交易始於 105 年，對 O 公司主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃、光罩清洗機及機器設備相關耗材等。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 0 千元、15,769 千元及 17,571 千元，銷售比重分別為 0%、1.50%及 1.73%。本公司 111 年度對 O 公司之銷售金額較 110 年度增加，主要係 O 公司因應產能需求，於 111 年擴廠，隨建廠進度推進，對於本公司之光罩相關半導體設備需求增加，故 O 公司 111 年度及 112 年前三季皆為本公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

(I) D 集團

D 集團成立於民國 105 年，總部位於安徽省合肥市，主要經營業務為動態隨機存取記憶體(DRAM)之設計、研發、生產及銷售，主要產品有 DDR4 SDRAM、LPDDR4x 及相關模組，應用於智慧型手機、電腦、伺服器、VR 及物聯網等領域，本公司與 D 集團交易始於 109 年，對 D 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機及設備相關耗材。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 0 千元、14,852 千元及 960 千元，銷售比重分別為 0%、1.42%及 0.09%。111 年度主係 D 集團進行 DRAM 廠房擴產計畫，故向本公司採購高階光罩清洗機所致，112 年前三季主係銷售設備相關耗材，致使 D 集團僅 111 年度為本公司之銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

(J) H 公司

H 公司成立於民國 97 年，位於臺灣新竹市，主要經營業務為 12 吋及 8 吋晶圓專業代工服務，包含邏輯暨特殊應用產品及記憶體產品之晶圓代工，產品終端應用於電腦、通訊應用、消費性電子及車用電子等，

本公司與 H 公司交易始於 109 年。

本公司對 H 公司主要銷售產品為高階光罩清洗機及設備相關耗材。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 186 千元、179 千元及 34,269 千元，銷售比重分別為 0.03%、0.02%及 3.37%。112 年前三季 H 公司配合其擴廠計畫，向本公司購買光罩相關設備(光罩交換機與光罩清洗機各一台)，使 H 公司 112 年前三季為本公司銷貨前十大客戶，然 110~111 年度之交易主要為設備相關零組件需求及維修服務等，故於 110 年度未列入前十大銷售客戶。

(3)營業費用及營業利益變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣千元

項目	110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率	金額	占營收比率
推銷費用	30,664	5.09	46,997	4.48	50,499	4.97
管理費用	42,067	6.99	78,582	7.50	84,904	8.36
研究發展費用	38,612	6.41	75,035	7.16	113,712	11.19
預期信用減損(利益)損失	(8,552)	(1.42)	7,936	0.76	10,106	0.99
營業費用合計	102,791	17.08	208,550	19.90	259,221	25.51
營業利益	113,203	18.81	242,329	23.12	232,983	22.93

資料來源：本公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

A.最近二年度及申請年度之營業費用變化分析

(A)推銷費用

本公司 110~111 年及 112 年前三季之推銷費用分別為 30,664 千元、46,997 千元及 50,499 千元，主係業務人員薪資、勞健保費、交際費、旅費及相關費用等，111 年度推銷費用較 110 年度增加 16,333 千元，主係隨人員擴編及獲利成長增加提列績效獎金及員工酬勞使薪資費用增加 11,896 千元，另本公司持續拓展客戶，使旅費增加 1,219 千元；112 年前三季推銷費用較 111 年前三季增加 22,895 千元，主係因獲利成長使薪資費用增加 11,025 千元，另本公司持續拓展客戶，使旅費及交際費分別增加 4,011 千元及 1,303 元，惟在費用控管得宜之情況下，本公司推銷費用並未隨營收成長而大幅增加，110~111 年及 112 年前三季占營業收入之比重分別為 5.09%、4.48%及 4.97%，約略維持在 5%左右。

(B)管理費用

本公司 110~111 年及 112 年前三季之管理費用分別為 42,067 千元、78,582 千元及 84,904 千元，管理費用主係間接人員薪資、勞健保費、捐贈、各項折舊與攤銷及相關費用等，111 年度管理費用較 110 年度增加 36,515 千元，主係隨人員擴編及獲利成長增加提列績效獎金及員工酬勞使薪資費用增加 28,559 千元，以及認列新竹辦公室使用權資產使折舊增加 2,268 千元、捐贈台南市政府農業局及台南警局等使捐贈費用增加 1,870 千元和因應 IPO 作業所需，會計師財稅簽及內控專審相關費用與券商輔導費用分別增加 1,952 千元及 300 千元所致；112 年前三季管理費用較 111 年前三季增加 30,294 千元，主係隨人員擴編及獲利成長使薪資費用增加 21,112 千元，以及捐贈獅子會重建花蓮縣東里國中捐款、贊助台

南市政府等使捐贈增加 3,782 千元和因應 IPO 作業所需，會計師財稅簽及內控專審費用與券商輔導費用分別增加 2,613 千元及 600 千元所致，惟在費用控管得宜之情況下，本公司之管理費用並未隨營收成長而大幅增加，110~111 年及 112 年前三季占營業收入之比重分別為 6.99%、7.50% 及 8.36%。

(C)研發費用

本公司 110~111 年及 112 年前三季之研究發展費用分別為 38,612 千元、75,035 千元及 113,712 千元，研究發展費用主係研發人員薪資、勞健保費、產品開發、認證費及相關費用等，111 年度研發費用較 110 年度增加 36,424 千元，主係隨人員擴編及獲利成長使薪資費用增加 20,617 千元及投入產品研發費用增加 10,270 千元；112 年前三季研發費用較 111 年前三季增加 74,367 千元，主係隨人員擴編及獲利成長使薪資費用增加 18,921 千元、投入產品研發費用及旅費分別增加 7,299 千元及 7,579 千元，及因出貨至客戶的 Demo 機於 112 年第二季評估已無銷售可能，故轉列研發費用 32,496 千元所致，110~111 年及 112 年前三季占營業收入之比重分別為 6.41%、7.16% 及 11.19 %，研發費用逐年增加，主要係因本公司持續開發新型機台及人員擴編所致。

(D)預期信用減損損失

預期信用減損損失(利益)主係因應收款項備抵損失之變動所產生，110 年度預期信用減損利益 8,552 千元，主係收回已提列備抵呆帳損失之應收帳款 9,160 千元所致；111 年度預期信用減損損失 7,936 千元，主係將客戶逾期超過 365 天以上之應收帳款 3,452 千元提列 100%備抵損失所致；112 年前三季之預期信用減損損失為 10,106 千元，主係本公司 111 年底出貨至國外，相關交易因屬出口外銷性質且驗收時間較長，故其相關應收款項逾期時間較長。

B.營業利益

本公司 110~111 年度及 112 年前三季之營業利益分別為 113,203 千元、242,329 千元及 232,983 千元，營業利率分別為 18.81%、23.12% 及 22.93%。本公司 111 年度營業利益較 110 年增加 129,126 千元，且營業利率成長，主係本公司受惠於半導體代工業者持續擴充產能，推升半導體設備需求增加，使營業收入持續成長，營業毛利及毛利率亦呈現上升，致使其營業利益及營業利率成長；112 年前三季營業利益較去年同期增加 83,501 千元，營業利率上升至 22.93%，主係 112 年前三季毛利較高之小型高階光罩相關機器設備銷售占比成長，致毛利率及營業毛利較去年同期上升，另 112 年前三季因應營運規模成長而新聘員工且相應之董事及員工酬勞上升，使營業費用上升，惟整體營業費用增加幅度仍低於營業收入及營業毛利，致當期營業利益較去年同期微幅增加。

(4)營業外收支變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣千元

年度		110 年度	111 年度	112 年前三季
其他收入	利息收入	48	1,069	5,524
	其他收入	3	532	1,735
其他利益及 損失	淨外幣兌換損益	(1,747)	11,777	27,966
	減損損失	(20,435)	-	-
	租賃修改(損失)利益	5	(192)	-
	其他	-	(18)	-
財務成本		(117)	(139)	(558)
合計		(22,243)	13,029	34,667

資料來源：本公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

本公司 110~111 年度及 112 年前三季之營業外收支分別為(22,243)千元、13,029 千元及 34,667 千元，占營收比重分別(3.69)%、1.24%及 3.41%，營業外收支主要包含利息收入(主係銀行存款息及押金設算息)、其他收入、淨外幣兌換(損)益、減損損失等項目，茲就金額較高之減損損失及淨外幣兌換(損)益之變化進行說明：

A.減損損失

本公司 110~111 年度及 112 年第三季之減損損失分別為(20,435)千元、0 千元及 0 千元，主要係本公司於 109 年底為拓展營運範疇，迎合 5G 技術發展與環境需求，為期擴展 PVD 真空鍍膜和相關設備核心技術及縮短自行開發之時程及減少研發成本，達到強化本身競爭優勢，故取得昇和精技(股)公司 100%股權，收購時因昇和精技已有銷售濺鍍設備實績，故預期隨新冠疫情緩解，其他客戶可能會有相關需求，惟收購後因新冠疫情緩解狀況未如預期，故本公司 110 年底評估減損時，認列商譽減損 20,435 千元，111 年度及 112 年前三季商譽並無減損跡象故無認列相關損失，尚無重大異常之情事。

B.淨外幣兌換損益

本公司 110~111 年度及 112 年第三季之淨外幣兌換損益分別為(1,747)千元、11,777 千元及 27,966 千元，本公司銷貨交易幣別主要以新臺幣及美元計價，111 年度及 112 年前三季銷貨交易幣別為美金之比重分別為 18.73% 及 30.14%，進貨及付款主要係以新臺幣為計價貨幣，故外幣淨資產以美元為主，兌換損益主要受美元兌新臺幣匯率變動所影響，110 年度受到新冠肺炎疫情影響等因素，使 110 年度美元兌換新臺幣期末匯率由 28.42 元貶值至 27.69 元，產生匯兌損失(1,747)千元；111 年度及 112 年前三季由於美國實施貨幣緊縮政策及美國持續升息，使得 111 年度及 112 年前三季美元兌新臺幣期末匯率分別為 30.71 元及 32.27 元，相對 110 年度為升值趨勢，故產生匯兌利益 11,777 千元及 27,966 千元，尚無重大異常之情事。

本公司對於匯率風險之控管主係財務單位隨時蒐集匯率變化訊息，與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充分掌握國際間匯率走勢及變化訊息，並視實際資金需求及匯率高低情況於適當時機買賣外幣存款，以降低匯率波動對公司獲利之衝擊。

3.本公司未來發展性之說明

(1)產業變化情形對本公司之影響

隨著國際半導體大廠 5 奈米及 3 奈米技術節點製程陸續量產，2 奈米預期亦將於 112~113 年進入生產，在先進製程的持續推進下，EUV 光罩(即下稱倍縮光罩)層數將呈倍數成長。而當微影圖案越精細，倍縮光罩污染的風險也越高，舉凡外來粉塵與化學殘留物，都是潛在的污染來源，因倍縮光罩塗層具有精細與易於損壞等特點，故製程中零件(例如機械手臂)，或預期外污染物(例如人體毛髮)等，只要有任何物件觸碰到倍縮光罩，都有可能造成損壞。因此保護造價高昂的 EUV 光罩需求也成為了製程發展重點，進而帶動本公司 EUV 光罩相關週邊設備需求成長，未來隨著半導體全球化發展將有助本公司業務蓬勃成長。

(2)本公司產品之未來發展及營運穩定性

本公司自 105 年成立起即致力於光罩潔淨設備之研究與開發，設備業在設備銷售過程皆須通過客戶較長時間驗收測試，於新機種導入時，亦需要經過較長且時間不確定之驗證期，故於本公司目前營運規模仍較小之情況下，較易產生單月營收波動較大之情形。然本公司之相關設備已銷售予於半導體晶圓代工業領導地位之客戶，並持續為其提供客製化設備，延伸現有設備之功能或開發新設備。有關本公司規劃之發展方向及維持營運穩定之相關說明如下：

A.產品已取得客戶認證，未來將持續配合客戶需求進行光罩潔淨度相關設備之開發

半導體設備具有高技術門檻且認證不易，欲取得合格供應商資格，需經相當時間之溝通配合及技術驗證，建立與客戶間之信任關係，故一旦獲得客戶採用，其他供應商擬進入將有一定之門檻，本公司憑藉著優異之技術能力，已打入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

本公司目前主要產品線(如：光罩儲存櫃及光罩清洗機等)之目標客戶已涵蓋國內外半導體代工廠 75%以上之對象，未來將延伸現有應用於客戶之不同產線或廠區。另外，本公司目前開發設備主要應用於半導體前段製程之微影製程，透過持續與客戶之交流，發現潛在光罩相關之半導體功能設備之開發方向，有助於開拓未來商機，目前已針對客戶需求開發光罩清洗機、光罩交換機及 EIP 檢查機等，亦積極開發 AOI 光罩檢測機器設備，以期解決客戶需求並為公司帶來新的營收動能。

B.將設備應用之領域拓展至半導體後段先進封裝製程之應用

本公司依未來研發計畫積極朝半導體光罩前後段製程間相關技術開發，包括前段薄膜製程中 PVD 鍍膜技術跨入、前段光罩檢測技術發展及後段先進封裝製程中所使用光罩之相關設備應用等，將核心技術深化之外並應用到新產品、服務或解決方案或新產業領域，以拓展技術影響力。

C.半導體原有工廠自動化設備更新需求

半導體產業面臨嚴重人才短缺問題，廠房自動化及數位轉型成為全球半導體大廠的最佳解決方案，光罩的潔淨程度直接影響製程良率，故全球半導體廠皆積極尋求光罩潔淨的解決方案，本公司可針對客戶現有廠區畸零地設計符合其需求之光罩儲存櫃，此外，因光罩清潔若是送回光罩廠清潔，需耗費較多時間且金額昂貴，故本公司之光罩清洗機使光罩在進入製程前及完成

製程後皆進行清洗，可提高製程良率且延長光罩壽命，該設備已成為微影製程中不可或缺之設備，本公司將持續與該等客戶積極接洽。

D.開發新應用領域之相關設備

本公司目前產品之應用範圍為 IC 光罩領域，為拓展營運範疇及因應市場需求，於 109 年底收購昇和精技，將觸角延伸至半導體製程用物理氣相沉積(PVD)領域，本公司擬藉由昇和精技現有的 PVD 真空鍍膜技術，擴展核心技術及縮短自行開發之時程及減少研發成本，有望增加產品之多樣性。

目前市場生產矽基氮化鎵磊晶 (GaN Epi on Si Wafer) 的方式主要採用有機金屬化學氣相沉積 (MOCVD) 的方式成長氮化鎵磊晶，但以此方法在生產時仍面臨許多問題，例如氮化鎵成膜後冷卻過程中產生的應力會導致氮化鎵出現裂紋問題、設備原材料利用效率及製程中產生廢水、廢氣、廢渣等環保的問題，本公司為解決以上問題，開發對應矽基板的氮化鋁磊晶成膜技術，目前已完成原型機第一階段之開發，可提供化合物半導體的磊晶製程提供另一種選擇，本公司設備主要特點為製程時間較短、膜厚均勻性較容易控制及採用相對安全的製程氣體使環安管理風險降低，以期該領域將為本公司帶來更多業務機會。

(3)擴廠計畫

本公司係屬半導體設備業，主要產品需求來自客戶擴廠擴線之產能提升、製程升級及良率提升新方案，以及維修技術服務。近年面對全球半導體產能供不應求，本公司於進入國際半導體大廠供應鏈後，與客戶密切互動，自 110 年起接單情形持續成長，綜合業務及市場面之觀察探知，加上既有廠區之運作侷限，為滿足本公司中長期業務發展，在永續經營及提供員工良好工作環境之理念下，故規劃擴廠，說明如下：

A.擴廠之必要性

(A)自有廠房需求：本公司因應營收規模持續成長，機器設備產量亦大幅增加，然本公司目前尚無自有廠房，目前所使用之臺南工廠係向母公司家登精密所承租且空間有限，工作及生產空間侷限，影響工作效率，為滿足本公司中長期業務發展，故規劃興建自有廠房。

(B)業務及市場面之觀察與需求

a.主要客戶全球擴張計畫

A 集團自 110 年起啟動全球建廠計畫並大幅提高資本支出，經觀察其建廠布局之製程，EUV 產能將大爆發，另依其目前在全球三大洲、台美日德中五個國家晶圓廠配置看，台灣依舊是先進製程生產重鎮。除了 A 集團全球擴廠，G 集團及 N 集團亦在全球各地擴建產線。本公司因與客戶合作密切，藉由業務接單情形了解客戶產能擴展方向，並預估未來可能的設備需求。

b.先進製程對光罩潔淨度要求越趨嚴格

隨半導體業界持續挑戰不斷縮減的設計尺寸，極紫外光(EUV)微影技術也於大量生產時擴大應用，為達優質的 EUV 微影良率，光罩須保持超潔淨狀態，各廠積極尋找光罩潔淨之解決方案，本公司產品由過去的選配升級為標配，使本公司成為半導體廠提升良率不可或缺的一員。

c.因應廠房自動化及數位轉型及半導體後段先進封裝延伸應用所帶來之業務機會

d.滿足潛在客戶可能之需求

本公司目前辦公室與工廠分隔兩地且預期未來恐面臨廠房產能不足以支應客戶需求，故規劃擴充現有產能規模並強化競爭力。

B.目前進度及建廠資金來源：

本公司業經 112 年 11 月 7 日審計委員會及董事會決議通過授權董事長以 20 年租期，租金計算依據科學園區土地租金及費用計收辦法，代表本公司向國家科學及技術委員會南部科學園區管理局(以下簡稱南科管理局)議約及簽署相關文件，規劃未來興建廠房，以拓展公司之半導體相關設備業務，並已於 112 年 11 月 13 日接獲南科管理局回函同意核配土地予本公司租用，因目前南科管理局尚在進行整地作業，故本公司預計於 113 年第三季初與南科管理局簽訂土地租賃合約，本公司目前規劃建設 A、B 兩棟，造價市價初估需投入建造成本約 24 億元，惟因建造圖面設計及建築物細節規劃尚未確定，故實際投入成本將視最終建造之規劃、土地實際探勘狀況等因素而定，本公司預計於 113 年第三季董事會決議通過建廠成本，並以自有資金及建築融資支應前開建廠資金，後續包含租地、整地、建置廠房、無塵室工程、倉儲、廠辦搬遷及生產線之機器設備、辦公設備等，未來將視市場需求變化及本公司產能規劃陸續進行規劃及調整。

4.綜合具體結論

本公司 110~111 年度及 112 年前三季之營業收入分別為 601,932 千元、1,047,953 千元及 1,016,063 千元，呈持續成長趨勢，主係長期深耕關鍵客戶，因應客戶擴廠計畫、自動化升級及設備品質深受客戶肯定所致。

本公司 110~111 年度及 112 年前三季之營業毛利分別為 215,994 千元、450,879 千元及 492,204 千元，呈持續成長趨勢，主係隨營業收入成長而增加。本公司 111 年度毛利率及 112 年前三季成長主係因持續開發客製化之功能性機器設備，且經過往的經驗累積，本公司組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，毛利率上升。

在營業費用方面，本公司 110~111 年度及 112 年前三季之營業費用分別為 102,791 千元、208,550 千元及 259,221 千元，持續較前一年度成長，主係本公司人員擴編、收購昇和精技及獲利成長增加提列績效獎金及員工酬勞使薪資費用上升，且本公司持續投入研發新產品，使整體營業費用上升。

在營業利益方面，本公司 110~111 年度及 112 年前三季之營業利益分別為 113,203 千元、242,329 千元及 232,983 千元，持續較前一年度成長主係本公司受惠於半導體代工業者持續擴充產能，致推升半導體設備需求增加，使營業收入持續成長，加上本公司持續開發客製化之功能性機器設備，且經過往的經驗累積，本公司組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，營業毛利及毛利率亦呈現上升，使營業利益及營業利益率持續成長。

在營業外收支方面，本公司及子公司 110~111 年度及 112 年前三季營業外收支分別為(22,243)千元、13,029 千元及 34,667 千元，110 年為營業外支出，主係本公司認列收購子公司昇和精技之商譽減損損失 20,435 千元所致；111 年度及 112 年前三季之營業外收之變動則主係隨美元兌新臺幣匯率之變動所產生之淨外幣

兌換利益，112 年前三季營業外收入較去年同期增加 13,511 千元，主係因本公司營運成長使現金及銀行存款增加，銀行存款利息收入較去年同期增加 5,363 千元及淨外幣兌換利益由於美國實施貨幣緊縮政策及美國持續升息，使得 111 年前三季及 112 年前三季美元兌新臺幣期末匯率分別為 31.75 元及 32.27 元，致淨外幣兌換利益較去年同期增加 6,980 千元所致。

綜上，本公司生產之光罩相關機器設備為半導體產業不可或缺的一環，產品應用客戶多為國內外半導體大廠，品質深獲客戶肯定。此外，由於半導體設備具有高技術門檻且認證不易，本公司憑藉著優異之技術能力，已打入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈，並與國內外半導體大廠建立互信合作之夥伴關係，掌握客戶需求之初，各產品之開發設計即與客戶充分討論溝通，藉以提供完整之解決方案，成為國內外半導體大廠合格之供應廠商，故未來業績及獲利之成長性應屬可期。

推薦證券商評估：

本推薦證券商就家碩科技(股)公司(以下稱該公司)之前開說明內容，就其合理性及所採取之查核程序及查核結論，依序說明如下：

1. 所屬行業之產業概況及所營業務之主要內容

該公司及其子公司主要營業項目為光罩相關半導體設備之研發、製造及銷售，產品廣泛運用於半導體、面板及記憶體等多個行業領域。本推薦證券商經取具台經院產經資料庫等產業資料，並取得同業京鼎、華景電及天虹之公開說明書及股東會年報，以瞭解該產業之現況，並與該公司總經理及財會主管等經營主管晤談並依據該公司之內部財務、業務資料或向外部蒐集產業報導相關資料，另取得該公司及其子公司最近二年度各季或各月份營收/獲利資料，及同業各季營收/獲利資料，以瞭解該行業之產業概況，經評估該公司及其子公司之前開說明內容尚屬合理，且尚無重大異常之情事。

2. 最近二年度及申請年度業績變化原因及其合理性分析

(1) 依主要產品別說明營業收入、營業成本、營業毛利及毛利率變化分析

A. 營業收入

本推薦證券商經取具並檢視該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年第三季之財務報告、及前述之產業資料，分析該公司及其子公司業績變化情形是否異常及是否有所營事業嚴重衰退之情事，另取具並檢視主要產品別之營業收入，並抽核 110~111 年度及 112 年第三季之相關表單，且與該公司及其子公司財會主管等經營團隊訪談，經評估該公司及其子公司之營業收入及單價變化與產業趨勢一致，且其變化尚屬合理，故該公司及其子公司之前開說明內容尚屬合理，尚無重大異常之情事。

B. 營業成本及營業毛利及毛利率

本推薦證券商經取具並檢視該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年第三季之財務報告、前述之產業資料，另取具並檢視主要產品別之營業成本、毛利及毛利率，並抽核相關表單，且與該公司及其子公司財會主管等經營團隊訪談，以瞭解該公司及其子公司各主要產品別之營業成本、毛利及毛利率變化情形。經評估該公司之 110~111 年度及 112 年第三季之營業成本主要隨營收及產品組合而變動，其變化尚屬合理，故該公司及其子公司之前開說明內容尚屬合理，尚無重大異常之情事。

(2) 主要銷售對象變化分析

A. 銷貨客戶查核程序

本推薦證券商經取具並檢視該公司 110~111 年度及 112 年第三季之財務報告、前十大之銷售客戶之基本資料(含工商登記及工商徵信查核報告等)、銷售合約,並抽核相關憑證以查明對該客戶之銷售金額是否正確及評估客戶間之售價及交易條件有無重大差異,並函證、電話訪談及實地訪談以了解該等客戶之營運情形、與該公司之關係、交易目的及交易必要性等,以評估銷貨交易之真實性。經評估,110~111 年度及 112 年第三季該公司及其子公司之前十大銷售客戶多屬國內外上市櫃或其子公司,另針對較不知名之公司加強查核(如:取得徵信報告),其真實性應尚無疑慮,故該公司及其子公司之前開說明內容尚屬合理,尚無重大異常之情事。

B. 銷售金額變化合理性

本推薦證券商取具並檢視及分析 110~111 年度及 112 年第三季前十大銷售客戶銷售明細及產業資料,並與該公司財會主管訪談,以了解銷售金額變動之原因及與產業趨勢是否合理。經評估,110~111 年度及 112 年第三季該公司及其子公司其主要銷售客戶變化與該公司之營運方向及產業趨勢一致,其變化尚屬合理,故該公司及其子公司之前開說明內容尚屬合理,尚無重大異常之情事。

(3) 銷貨集中

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季對前十大銷售客戶之銷售金額分別為 591,210 千元、1,007,701 千元及 996,359 千元,銷售比重分別為 98.21%、96.15%及 98.07%,110~111 年度及 112 年前三季對 A 集團(含透過 B 集團及 M 集團銷售)之銷售比重分別為 78.25%、73.36%及 54.28%,對單一集團有銷售比重超過 50%以上,係有銷貨集中之情形。該公司自 105 年起與 A 集團合作開發,針對客戶需求開發光罩相關之微環境機器設備,經長年合作,不論品質深獲肯定及準時達交率高,且產品皆已通過安全性認證,加上該公司於半導體機台所需之光罩相關微污染防治設備客製化設計能力強,以提供客製化服務來穩固產品與客戶之密切合作關係,在技術、品質、成本及交期均能滿足客戶需求且較同業具有優勢下,故得以維持長期穩定之供應鏈關係,且客戶亦滿意其提供之服務,進而使得該公司有銷貨集中於 A 集團之情形。經本推薦證券商檢視該公司之股東名冊及轉投資組織圖,並訪談該公司財務行政處經理,該公司與 A 集團並無任何投資關係,亦非屬該公司關聯企業,且該公司積極開發新型機台及拓展客戶,以降低銷貨集中風險,故該公司前開說明內容尚屬合理,經評估尚無重大異常之情事。

(4) 營業費用及營業利益變化原因及其合理性分析

本推薦證券商經取得及檢視該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年第三季之財務報告、營業費用明細,及抽核相關憑證,並與該公司財會主管訪談,以瞭解 110~111 年度及 112 年第三季營業費用及營業利益變化情形,經評估,110~111 年度及 112 年第三季該公司及其子公司營業費用及營業利益變化主要隨營收規模而變動,其占比尚屬穩定,故該公司之前開說明內容尚屬合理,尚無重大異常之情事。

(5)營業外收支變化原因及其合理性分析

本推薦證券商取得該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年第三季之財務報告、營業外收支明細，及抽核相關憑證，並與該公司財會主管訪談，以瞭解該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年第三季營業外收支變化情形。經評估，110~111 年度及 112 年第三季該公司營業外收支金額占營收比例甚低，且其性質尚無重大異常，故該公司及其子公司之前開說明內容尚屬合理，尚無重大異常之情事。

綜上，本推薦證券商經執行上述查核程序及評估該公司及其子公司最近二年度及申請年度業績變化原因及其合理性分析，尚無發現有重大異常，該公司及其子公司之前開說明內容尚屬合理，且尚無重大異常之情事。

3.未來發展性之說明

推薦證券商經取得產業研究報告、同業公開說明書、股東會年報，以瞭解該公司及其所屬產業未來發展趨勢，並與該公司經營團隊訪談以瞭解該行業未來發展趨勢對該公司之影響及如何持續保持競爭力，經評估該公司對其現有產品除持續優化品質，並配合客戶要求持續擴充產品應用之領域，應尚可維持其競爭力，另該公司為滿足中長期業務發展規劃擴廠，經訪談客戶及取得董事會議事錄與公開資訊觀測站公告等，該公司業經審計委員會及董事會決議通過向南科管理局租地，經評估擴廠計畫應屬必要且具可行性，故該公司之前開說明內容尚屬合理，且尚無重大異常之情事。

4.綜合具體結論

綜上所述，經本推薦證券商執行上述查核程序後，該公司 110~111 年度及 112 年前三季之業績變化情形、原因及未來發展性，尚屬合理。該公司整體營收及獲利呈成長趨勢，且光罩相關產業屬利基市場，一旦客戶採用該公司之機器設備後，對其後續銷售的機器設備將穩定持續成長，可加強其繼續成長之動能，故隨著該公司持續開發客戶及深化與既有客戶之合作關係，並開發新產品及新客戶，該公司營業收入及營業毛利持續增長。經評估該公司產業發展前景及其具有先進者之優勢，其業績及獲利前景應屬可期。

(二)貴公司近期研發人員離職率高且平均服務年資短，有關貴公司如何提升研發能量，以因應未來產品布局之說明，暨推薦證券商之評估意見。

公司說明

本公司研發人員平均服務年資偏短，主係因應研發團隊擴編，持續增加電子、電機、資工及機械相關背景及具有半導體製程、設備相關實務經驗人員，因大量新進人員加入，109~112 年底各期新進人員占期末研發人員比例約 50%所致；另本公司 112 年度研發人員離職率較高，主係基層研發人員因家庭因素、個人生涯規劃等原因離職，該等人員均非重要管理職且業務銜接亦無中斷情形，故對本公司研發計畫及進程尚無重大影響。有關本公司提升研發能量之作法說明如下：

1.與客戶保持密切合作

本公司產品經客戶技術認證，打入多家國際半導體供應鏈，與客戶建立長期合作關係，客戶有任何需求皆會尋求本公司之協助。本公司主要業務係針對客戶需求開發光罩相關之各式功能性機器設備，於新竹及台南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，故獲得客戶肯定持續下單採購，因主要客戶在半導體市場之領導地位，本公司也因此參與前瞻技術開發之機會，藉由客

戶需求之解決提升本身技術能力，增加與客戶之黏著度。本公司技術累積主要來自解決客戶需求，因此，以專業技術服務取得客戶信賴，成為客戶的首選夥伴，有助本公司技術能量之擴展。

2.持續研發投資

隨著客戶先進製程之推進，本公司之技術發展與其俱進，近年陸續投入 EUV 光罩載具潔淨及缺陷檢測技術、PVD 鍍膜技術、光罩膜面偵測技術及 EUV 光罩儲存兼交換功能之整合設備研究開發，本公司除持續配合客戶需求開發光罩潔淨度相關之設備外，自 109 年起投入 PVD 製程原型機開發，主要應用於矽晶圓長氮化鋁磊晶，以解決市面上主要採用有機金屬化學氣相沉積(MOCVD)方式進行晶圓磊晶，所產生的氮化鎵成膜後冷卻過程中氮化鎵出現裂紋、設備原材料利用效率及製程中產生廢水、廢氣、廢渣等問題。本公司 110 年~112 年第三季研發費用佔營業收入分別為 6.4%、7.2%及 11.2%，整體研發費用呈穩定增加趨勢，未來將隨著營運成長，研發投入比例逐年提升，以厚基技術實力。

3.技術應用多元化

本公司依未來研發計畫積極朝半導體光罩前後段製程間相關技術開發，包括前段薄膜製程中 PVD 鍍膜技術跨入、前段光罩檢測技術發展及後段先進封裝製程中光罩相關設備應用等，將核心技術深化之外並應用到新產品、服務或解決方案或新產業領域，以拓展技術影響力。

4.人才發展

本公司已組建高素質的研發團隊，其組成包括電子、電機、資工及機械相關背景以及半導體製程及設備相關實務經驗之技術專才，持續投入本公司在發展 EUV 光罩製程、微污染防治、AI 檢測相關及 PVD 製程相關之技術方向之發展，未來亦將依研發方向規畫專業人力需求，規劃未來三年持續擴建團隊，人力背景除了電子電機、機械相關科技及半導體設備相關經驗領域專長外，並延攬製程(光學/材料/物理)及演算法(資工/電機)相關背景專才，以因應未來技術研發方向。

5.產學合作

本公司目前有與國內大學及研究中心合作兩項產學合作計畫，透過持續建立與學術界和研究機構的合作夥伴關係，以共同推進技術研發，藉此於合作中產生新的洞察和專業知識，有助於擴展公司技術的前沿性。

推薦證券商評估：

該公司未來將持續透過與客戶保持密切合作及與學術界和研究機構之產學合作，開發符合市場需求之產品，亦藉由合作過程推進技術研發且可節省陌生開發之時間，並結合自有研發量能，擴大新產品開發領域，持續開發具競爭力之產品。此外，該公司將持續補強專業人才，期以透過專業培訓、良好工作環境、福利措施，達納才、留才效果，建立高素質之專業研發團隊，以提升組織整體競爭力。經評估，該公司對其既有技術持續改良與優化，應尚可維持其競爭力，且該公司自成立至今產品除滿足半導體晶圓代工廠之需求外，亦已陸續開發符合半導體封裝及記憶體廠需求之產品，目前亦持續開發新產品以提供客戶最佳解決方案，故該公司之前開說明內容尚屬合理，且尚無重大異常之情事。

二四、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項

(一)董事會運作情形：

112年1月1日至112年5月31日股東會全面改選董監前，董事會共計開會2次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	邱銘乾	2	-	100%	112/5/31 股東會改選卸任
董事	林添瑞	2	-	100%	112/5/31 股東會改選卸任
董事	詹印豐	2	-	100%	
董事	林雅文	1	-	50%	112/1/31 股東臨時會補選新任且 112/5/31 股東會改選卸任
董事	胡瑞卿	2	-	100%	112/1/31 股東臨時會補選新任
監察人	王彩樺	2	-	100%	112/5/31 股東會改選卸任
監察人	沈恩年	2	-	100%	112/1/31 股東臨時會補選新任且 112/5/31 股東會改選卸任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：不適用。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
第三屆第四次	112.2.20	邱銘乾 林添瑞	本公司向母 公司家登精 密工業(股)公 司取得使用 權資產案	為本案利 害關係人	除利害關係人迴 避外，本案經代 理主席徵詢其餘 出席董事無異議 照案通過。
第三屆第四次	112.2.20	詹印豐	一一一年度 員工酬勞及 董監酬勞分 派案	兼任總經 理，為本 案利害關 係人	除利害關係人迴 避外，本案經主 席徵詢其餘出席 董事無異議照案 通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：不適用。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。

(一)本公司董事會運作均依照「董事會議事規則」辦理，以落實公司治理。

(二)本公司訂定並業經董事會通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」。

112年5月31日股東會全面改選後截至公開說明書刊印日止，董事會共計開會5次，董事出席情形如下：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
法人董事長	家登精密工業(股)公司 代表人：邱銘乾	5	-	100%	112/5/31 股東會改選新任
法人董事	家登精密工業(股)公司 代表人：林添瑞	5	-	100%	112/5/31 股東會改選新任
董事	詹印豐	5	-	100%	
董事	胡瑞卿	5	-	100%	
獨立董事	李文中	5	-	100%	112/5/31 股東會改選新任
獨立董事	陳瑞杏	5	-	100%	112/5/31 股東會改選新任
獨立董事	林秀怡	5	-	100%	112/5/31 股東會改選新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已依法設置審計委員會，請參閱「審計委員會運作情形」之說明。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
第四屆第一次	112.5.31	李文中 陳瑞杏 林秀怡	本公司委任第一屆薪資報酬委員會委員案	為本案利害關係人	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第二次	112.8.2	詹印豐	本公司經理人一一二二年第二季績效獎金案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第三次	112.11.7	詹印豐	本公司經理人一一二二年第三季及第四季績效獎金案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
第四屆第四次	113.3.4	詹印豐	一一二年度經理人員工酬勞分配案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第五次	113.3.26	詹印豐	訂定初次上櫃前現金增資員工認股辦法及經理人認購案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第五次	113.3.26	詹印豐	本公司經理人一一三年第一季績效評估及獎金案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年應至少執行一次	112年1月1日至12月31日	整體董事會、董事會成員、功能性委員會之績效評估	評估方式包括董事會自評、董事成員自評及功能性委員會自評，並每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行績效評估	【董事會績效評估報告】

【董事會績效評估報告】

(一)為落實公司治理及提升本公司董事會及功能性委員會功能，本公司董事會訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依規定定期執行評估，各評估之衡量項目考量公司狀況與需要至少含括以下面向：

1. 董事會自評：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制。
2. 董事成員自評：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制。
3. 功能性委員會自評：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。

(二)112年度績效評估結果：評估期間內之董事會、董事成員及功能性委員會自我績效評估均達95分以上，並於113年3月4日提報董事會。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。

(一)本公司董事會運作均依照「董事會議事規則」辦理，以落實公司治理。

(二)本公司於112年5月31日改選董事，並成立審計委員會及委任全數獨立董事擔任委員，以行使證交法、公司法及其他法令規定之職權。

(三)本公司於112年5月31日成立薪資報酬委員會，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，已加強董事會執行其職責。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.審計委員會運作情形

自 112 年 5 月 31 日由全體獨立董事組成審計委員會至公開說明書刊印日止，審計委員會共計開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	李文中	5	-	100%	112/5/31 股東會改選新任
獨立董事	陳瑞杏	5	-	100%	
獨立董事	林秀怡	5	-	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會屆次	審計委員會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
第一屆第二次	112.8.2	一一二年第二季合併財務報表案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第一屆第三次	112.11.7	本公司一一一年十月一日至一一二年九月三十日「內部控制制度聲明書」案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司一一三年度稽核計劃案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司擬向南部科學園區管理局租賃土地案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		修訂「取得或處分資產處理程序」案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司稽核主管任命案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第一屆第四次	113.03.04	本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司一一二年度盈餘分派案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司一一三年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性及適任性案	全體出席委員無異議照案通過	不適用

第一屆 第五次	113.03.26	初次上櫃掛牌前現 金增資案	全體出席委員無 異議照案通過	不適用
------------	-----------	------------------	-------------------	-----

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

(一)內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計畫、內部控制自行評估結果及已完成之稽查業務執行情形，根據查核缺失進行溝通，溝通意見作成紀錄提董事會報告。

(二)會計師向獨立董事報告本公司財務狀況及內控查核情形，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

(三)其他發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜：可以不定期隨時召開會議溝通。

2. 監察人參與董事會運作情形

112年1月1日至112年5月31日股東會全面改選董監事前，董事會共計開會2次，監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 B	實際出席率(%) 【 B/A 】	備註
監察人	王彩樺	2	-	112/5/31 股東會改選卸任
監察人	沈恩年	2	-	112/1/31 股東臨時會補選新任且 112/5/31 股東會改選卸任

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：監察人之組成係由股東會就有行為能力之人或法人股東代表人中選任之；本公司原章程所訂監察人之職權為：(1)業務之查詢、(2)簿冊文件及財務狀況之查核、(3)公司業務情形之查詢、(4)其他依照法令及股東會決議賦與之職權。

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為有必要時得與員工、股東或利害關係人直接聯繫。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前，將稽核報告及追蹤報告交付各監察人，並及時回覆監察人所垂詢事項，雙方溝通順暢。本公司稽核主管與會計師間亦保持順暢溝通管道，並已依主管機關規定，將次一年度稽核計畫及上一年度之年度稽核計畫執行情形與年度內部控制缺失及異常事項改善情形，於完成申報作業後，一份送簽會計師存查。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則(以下簡稱公司治理實務守則)差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定，並揭露「公司治理實務守則」於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並依程序實施。	無重大差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司已委由專業股務代理機構負責股東事務，並按月申報董事、經理人及持股 10% 大股東之持有股份。	無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業業務往來，均依內部控制制度及相關法令辦理，實施必要之控管機制以杜絕非常規交易情形。	無重大差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並依程序實施。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則(以下簡稱公司治理實務守則)差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		1. 本公司已訂定「公司治理實務守則」，於第三章「強化董事會職能」擬訂多元化方針。本公司董事成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」審慎評估各候選人之資格，以確保董事成員之多元性及獨立性。 2. 本公司第四屆董事會由 7 席董事組成，包含 2 位法人董事、2 位自然人董事及 3 位獨立董事，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事有 3 席，比率達 43%。 3. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會，並無設置其他各類功能性委員會。	未來將視實際營運需求評估設置。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司已於112年11月7日董事會通過制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於112年首次實施，該評估結果於113年3月4日提報董事會，未來將運用於個別董事薪酬及提名續任之參考。	無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		依本公司「公司治理實務守則」第二十九條規定，每年至少一次評估簽證會計師之獨立性，本年度評估未發現影響獨立性之情事，並將結果提報113年3月4日董事會審議通過。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於112年11月7日董事會任命公司治理主管，並由財務、股務及內部稽核等跨領域人員組成公司治理推動小組，負責公司治理相關事務，以持續推動並建置有效公司治理架構。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則(以下簡稱公司治理實務守則)差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人制度對外與股東及利害關係人進行溝通管道，並設有專責人員及電子郵件信箱，處理相關問題。另本公司網站設置投資人專區，公司財務業務及公司治理相關資訊予以連結，以利股東及利害關係人等參考。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司股務作業委由專業股務代辦機構-元大證券股份有限公司股務代理部為本公司辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已架設企業網站並設置投資人專區，及時揭露公司財務業務及公司治理相關資訊，以利股東及利害關係人等參考。	無重大差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		本公司已架設中、英文企業網站並設置投資人專區，及時揭露公司財務業務及公司治理相關資訊，並有專人負責公司資訊之蒐集及揭露，亦設有發言人及代理發言人制度並落實執行。	無重大差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司於112年6月26日登錄興櫃，已依規定於期限內完成申報及公告第二季財務報告及每月份營運情形。	無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益：本公司力求落實執行勞基法及相關法令，確保員工應有之權益。 (二)僱員關懷：本公司成立職工福利委員會，推行各項補助及舉辦休閒活動，重視員工身心平衡。 (三)投資者關係：本公司除了於公司網站上不定期提供投資人活動訊息，對於有疑問之投資人亦開關相關窗口直接提供服務。 (四)供應商關係：本公司秉誠信與供應商建立互惠互榮關係。 (五)利害關係人之權利：本公司有與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、股東、員工、客戶、消費者、供應商、社區等，保持暢通之溝通管道。 (六)董事進修之情形：本公司不定期提供課程資訊予各董事，本公司董事已於112年5月31日進修公司治理與證券法規共3小時課程，並取得證明文件。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形；依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則(以下簡稱 公司治理實務守則) 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(八)客戶政策之執行情形：公司與客戶維持穩定良好關係，並秉持以客為尊、彈性機動之政策，以創造公司利潤。 (九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，保險期間自 112 年 5 月 1 日至 113 年 5 月 1 日。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：不適用。				

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

113年3月27日

身分別	姓名	條件	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
		專業資格與經驗	
獨立董事 召集人	林秀怡	請參閱第16頁獨立董事資料相關內容	0
獨立董事	李文中		0
獨立董事	陳瑞杏		0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員會任期：第一屆任期為112年5月31日至115年5月30日，最近年度(112)及申請年度截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會開會5次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	林秀怡	5	-	100%	112/5/31 股東會改選新任
委員	李文中	5	-	100%	
委員	陳瑞杏	5	-	100%	

其他應記載事項：

- 1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
- 2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因；符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		✓	本公司已訂定「永續發展實務守則」，並著手籌設推動永續發展之治理架構及專(兼)職單位。	依公司發展及相關法令計畫辦理中。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		✓	本公司經董事會通過訂定「永續發展實務守則」，未來將依據重大性原則，評估公司營運相關之環境、社會及公司治理等議題之風險，並依評估結果推展系統化管理策略。	依公司發展及相關法令計畫辦理中。
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司為設備製造商，於製造過程中並無空汙、汙染廢液及廢水等有害或有毒廢棄物產生，對於環境之管理，均依環安衛生相關法令規定辦理。	無重大差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司致力於提升各項資源之利用效率，例如落實垃圾分類、推行電子化行政作業並宣導文書雙面使用，減少紙張用量，降低對環境之衝擊。	無重大差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		本公司已初始進行評估氣候變遷對企業現在及未來之潛在風險與機會，並參與家登集團「供應鏈低碳化轉型輔導計畫」，進行溫室氣體盤查及管理，期許低碳供應，邁向永續未來。未來將持續關注氣候變遷對企業之影響，推行相關策略。	無重大差異。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		✓	本公司自112年初始進行溫室氣體盤查，並著手進行水量及廢棄物總重量之統計，也將陸續制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水及其他廢棄物管理之政策。	初始進行中。
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司遵循國際公認之勞動人權，明訂禁用童工、不歧視、不強迫勞動、人道待遇，對於招募、任用、考核、升遷等人力資源運用政策以工作績效為依歸，不因性別種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差異而有不同等等之人權政策及相關管理措施。	無重大差異。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司已制定「工作規則」、「績效及專案獎金給付辦法」等員工福利措施制度，並將經營成果依員工績效表現適當反應於員工薪酬。	無重大差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司已依職業安全衛生法規定對員工應施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練，並依據作業內容提供防護具，實施自動檢查，以及定期防災演練。另定期舉辦員工健康檢查，關心員工健康情形。並每季召開職業安全衛生委員會檢討相關議題執行與改善。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司藉由定期的績效考核與部門溝通會議，適才適性的多元評估員工之專業與職涯發展方向，擬定相關之培訓計畫。	無重大差異。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司產品均遵循銷售地區別相關國際法規之規定，進行各項檢測與認證後出售。與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序。	無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？		✓	本公司已制定「供應商管理程序作業指導書」，對於往來之供應商均須經一定評估程序，並擬規範供應商對環境、職業安全衛生或勞動人權等議題應遵循相關規定。	研擬進行中。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司目前尚未編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，未來將視實際需要及法令規範進行報告書之編製。	研擬計畫中。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，其運作情形皆與「上市上櫃公司永續發展實務守則」內所規範之精神及原則一致，尚無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司網站已初建「ESG永續發展」專區，未來陸續將永續發展執行情形揭露於該專區，網址： https://www.gdauto.com.tw 。				

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站，董事會與管理階層均承諾積極落實。	無重大差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明訂禁止不誠信行為及利益之態樣，以具體規範及防範不誠信行為。	無重大差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，闡明誠信及行為準則且遵循辦理，並參考法規及因應時勢變化定期檢討修正。	無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司所有往來對象均經公司審核通過，亦研擬將誠信條款加入往來交易相關合約。	無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司由財務行政處負責推動誠信經營守則及行為指南之制定及執行，未來將向董事會報告相關情事、其處理方式及後續檢討改善措施。	無重大差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，內容涵蓋防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並據以執行。	無重大差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司稽核單位藉由例行查核作業，了解誠信經營之落實情形，以確保會計制度及內部控制之有效性。	無重大差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司每年將公司治理及誠信經營相關之內外訓資訊轉知董事及經理人，並協助安排訓練事宜。另於內部公告宣導「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，並擬定期於員工內訓及新人訓宣導誠信之企業精神及相關規範。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並建立便利檢舉管道，針對被檢舉對象指派適當之受理單位處理，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司已於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂定受理檢舉事項之調查及相關保密機制。	無重大差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，具體揭露保護檢舉人之措施，截至目前為止未有檢舉之情事。	無重大差異。
四、加強資訊揭露				
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於公開資訊觀測站及公司網站揭露所訂之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以建立誠信經營之企業文化，實際運作情形與所定守則並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)： 1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本要求。 2. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避規定，對董事會所列之議案，與其自身或其代表之法人有利害關係致損及公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，討論時應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互支援。				

- (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司已訂定公司治理守則及相關規章，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露。
- (八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

113年3月27日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
內部稽核主管	阮淨	111年12月19日	112年10月13日	個人生涯規劃

- (九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：可於公開資訊觀測站或本公司網頁查詢本公司相關項目。

柒、重要決議、公司章程及相關法規

一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)

- (一)與本次發行有關之決議文：請參閱附件十三。
- (二)公司章程(含章程修正條文對照表)：請參閱附件十五。
- (三)盈餘分配表：請參閱附件十四。

二、未來股利發放政策

依本公司章程規定，本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，次再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。再依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，連同上年度累積未分配盈餘由董事會評估未來營運計畫所需資金部分予以保留後，擬具盈餘分派議案提請股東會議定之。

本公司股利之政策，應配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，作為股利發放之依據。股利發放提撥之數額不低於當年度可供分配盈餘之百分之十，得以股票股利或現金股利之方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。

本公司股票公開發行後，本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用相關股東會決議之規定。

三、截至公開說明書刊印日止之背書保證相關資訊：無。

附件一

111 年度合併財務報告暨會計師查核報告

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)
及子公司

合併財務報告暨會計師查核報告
民國111及110年度

地址：新北市土城區中央路4段2號8樓之5

電話：(02)2268-9141

§ 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、關係企業合併財務報告聲明書	3		-
四、會計師查核報告	4~6		-
五、合併資產負債表	7		-
六、合併綜合損益表	8~9		-
七、合併權益變動表	9		-
八、合併現金流量表	11~12		-
九、合併財務報表附註			
(一) 公司沿革	13		一
(二) 通過財務報告之日期及程序	13		二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	13~17		三
(四) 重大會計政策之彙總說明	17~26		四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	26~27		五
(六) 重要會計項目之說明	27~47		六~二七
(七) 關係人交易	48~49		二八
(八) 質抵押之資產	-		-
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	50		二九
(十) 重大之災害損失	-		-
(十一) 重大之期後事項	-		-
(十二) 其 他	50		三一
(十三) 附註揭露事項			
1. 重大交易事項相關資訊	51~53		三二
2. 轉投資事業相關資訊	51~53		三二
3. 大陸投資資訊	51		三二

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 111 年度（自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：家碩科技股份有限公司

負責人：邱 銘 乾



中 華 民 國 112 年 3 月 8 日

會計師查核報告

家碩科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達家碩科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與家碩科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

家碩科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估家碩科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算家碩科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

家碩科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對家碩科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使家碩科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致家碩科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 建 銘

曾建銘



會計師 王 攀 發

王攀發



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 8 日

家碩科技股份有限公司 (原名：聚豐南興化股份有限公司) 及子公司



民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 624,263	38	\$ 372,718	38		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註七)	19,000	1	-	-		
1170	應收帳款—非關係人 (附註四、八及二一)	273,760	16	77,665	8		
1180	應收帳款—關係人 (附註四、八、二一及二八)	101	-	-	-		
1200	其他應收款 (附註八)	14	-	-	-		
130X	存貨 (附註四及九)	606,561	37	449,309	46		
1410	預付款項 (附註十五)	54,672	3	22,431	2		
1470	其他流動資產 (附註十五)	78	-	-	-		
11XX	流動資產總計	<u>1,578,449</u>	<u>95</u>	<u>922,123</u>	<u>94</u>		
非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十一)	15,421	1	12,407	1		
1755	使用權資產 (附註四、十二及二八)	20,668	1	3,933	-		
1780	無形資產 (附註四及十四)	4,301	-	7,966	1		
	商譽 (附註四及十三)	24,622	2	24,622	3		
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二三)	8,504	1	2,090	-		
1920	存出保證金 (附註二八)	1,133	-	1,237	-		
1900	其他非流動資產 (附註十五及二九)	2,000	-	4,600	1		
15XX	非流動資產總計	<u>76,649</u>	<u>5</u>	<u>56,855</u>	<u>6</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,655,098</u>	<u>100</u>	<u>\$ 978,978</u>	<u>100</u>		
負債及權益							
流動負債							
2130	合約負債 (附註二一及二八)	\$ 616,648	37	\$ 437,686	45		
2170	應付帳款—非關係人 (附註十六)	277,014	17	210,695	22		
2180	應付帳款—關係人 (附註十六及二八)	1,689	-	1,487	-		
2200	其他應付款—非關係人 (附註十七)	112,991	7	67,031	7		
2220	其他應付款項—關係人 (附註十七及二八)	111	-	904	-		
2230	本期所得稅負債 (附註四及二三)	43,810	3	13,820	1		
2250	負債準備—流動 (附註四及十八)	26,618	2	28,786	3		
2280	租賃負債—流動 (附註四、十二及二八)	3,013	-	3,965	-		
2399	其他流動負債 (附註十七)	1,675	-	1,488	-		
21XX	流動負債總計	<u>1,083,569</u>	<u>66</u>	<u>765,862</u>	<u>78</u>		
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	2,937	-	-	-		
2600	租賃負債—非流動 (附註四及十二)	18,023	1	-	-		
25XX	非流動負債總計	<u>20,960</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
2XXX	負債總計	<u>1,104,529</u>	<u>67</u>	<u>765,862</u>	<u>78</u>		
權益 (附註二十)							
3110	普通股股本	225,600	13	110,400	11		
3200	資本公積	93,495	6	19,457	2		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	17,716	1	10,963	1		
3350	未分配盈餘	213,758	13	72,296	8		
3300	保留盈餘總計	231,474	14	83,259	9		
3XXX	權益總計	<u>550,569</u>	<u>33</u>	<u>213,116</u>	<u>22</u>		
	負債與權益總計	<u>\$1,655,098</u>	<u>100</u>	<u>\$ 978,978</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家碩科技股份有限公司（原名中國醫藥自動化股份有限公司）及子公司

合併損益表

民國 111 年及 110 年七月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二一及二八）			
4100	\$ 1,047,953	100	\$ 601,932	100
5000	營業成本（附註九、二二及二八）			
	(597,074)	(57)	(385,938)	(64)
5900	營業毛利			
	450,879	43	215,994	36
	營業費用（附註十九、二二及二八）			
6100	46,997	4	30,664	5
6200	78,582	8	42,067	7
6300	75,035	7	38,612	6
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）			
	7,936	1	(8,552)	(1)
6000	營業費用合計			
	208,550	20	102,791	17
6900	營業淨利			
	242,329	23	113,203	19
	營業外收入及支出（附註二二及二八）			
7100	1,069	-	48	-
7190	532	-	3	-
7020	11,567	1	(22,177)	(4)
7050	財務成本			
	(139)	-	(117)	-
7000	營業外收入及支出合計			
	13,029	1	(22,243)	(4)
7900	稅前淨利			
	255,358	24	90,960	15
7950	所得稅費用（附註四及二三）			
	(51,943)	(5)	(23,428)	(4)
8200	本年度淨利			
	\$ 203,415	19	\$ 67,532	11

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二四)	111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
9710	基 本	\$ 11.91		\$ 4.08	
9810	稀 釋	\$ 11.06		\$ 3.85	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家碩科技股份有限公司（原名：家碩科技股份有限公司）及子公司

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股	本	資	本	公	保 留 盈 餘		權 益 總 額
							積	法 定 盈 餘 公 積	
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 55,200	\$ 19,457	\$ 4,597	\$ 66,330	\$ 145,584			
	109 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	6,366	(6,366)	-			
B9	股東股票股利	55,200	-	-	(55,200)	-			
D1	110 年度淨利	-	-	-	67,532	67,532			
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	110,400	19,457	10,963	72,296	213,116			
	110 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	6,753	(6,753)	-			
B5	股東股票股利	55,200	-	-	(55,200)	-			
N1	本公司發行員工認股權	-	2,038	-	-	2,038			
E1	現金增資	60,000	72,000	-	-	132,000			
D1	111 年度淨利	-	-	-	203,415	203,415			
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 225,600	\$ 93,495	\$ 17,716	\$ 213,758	\$ 550,569			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家碩科技股份有限公司（原名：國盛自動化股份有限公司）及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 255,358	\$ 90,960
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	7,936	(8,552)
A20100	折舊費用	11,629	7,572
A20200	攤銷費用	3,665	3,665
A20900	財務成本	139	117
A21200	利息收入	(1,069)	(48)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,038	-
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	4,557	(1,197)
A23500	減損損失	-	20,435
A29900	租賃修改損失（利益）	192	(5)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(204,132)	(13,800)
A31180	其他應收款	(14)	-
A31200	存 貨	(161,809)	(188,010)
A31230	預付款項	(32,241)	(4,172)
A31240	其他流動資產	(78)	89
A32150	應付帳款	66,521	108,856
A32180	其他應付款	45,167	19,581
A32200	負債準備	(2,168)	-
A32210	合約負債	178,962	144,746
A32230	其他流動負債	187	460
A33000	營運產生之現金	174,840	180,697
A33200	收取之利息	1,069	48
A33300	支付之利息	(139)	(117)
A33500	支付之所得稅	(25,430)	(24,215)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>150,340</u>	<u>156,413</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 19,000)	\$ -
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	20,000
B02700	購置不動產、廠房及設備	(8,925)	(2,611)
B03700	存出保證金增加	-	(158)
B03800	存出保證金減少	104	-
B07100	預付設備款減少(增加)	<u>2,600</u>	<u>(4,600)</u>
BBBB	投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(25,221)</u>	<u>12,631</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(5,574)	(4,463)
C04600	現金增資	<u>132,000</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>126,426</u>	<u>(4,463)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	251,545	164,581
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>372,718</u>	<u>208,137</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 624,263</u>	<u>\$ 372,718</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家碩科技股份有限公司（原名「家登自動化股份有限公司」）及子公司

合併財務報表附註

民國 111 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（除另註明外，金額以新台幣仟元為單位）

一、公司沿革及營業

家碩科技股份有限公司（以下稱「本公司」），係於 105 年 7 月 18 日設立，於新北市之股份有限公司，並於同年 7 月開始營業。所營業務主要為各種精密儀器之買賣、維修及保養業務。

本公司原名「家登自動化股份有限公司」，經 112 年 1 月 31 日臨時股東會決議更名為「家碩科技股份有限公司」，並於 112 年 2 月 10 日經新北市政府核准。

本財務報表係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於 112 年 2 月 20 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成家碩科技股份有限公司及子公司（以下稱「合併公司」）會計政策之重大變動。

- (二) 112 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IAS1 之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日（註 1）
IAS8 之修正「會計估計值之定義」	2023 年 1 月 1 日（註 2）
IAS12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023 年 1 月 1 日（註 3）

註 1：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間適用此項修正。

註 2：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計值變動及會計政策變動適用此項修正。

註 3：除於 2022 年 1 月 1 日就租賃及除役義務之暫時性差異認列遞延所得稅外，該修正係適用於 2022 年 1 月 1 日以後所發生之交易。

1. IAS 1 之修正「會計政策之揭露」

該修正明訂合併公司應依重大之定義，決定應揭露之重大會計政策資訊。若會計政策資訊可被合理預期將影響一般用途財務報表之主要使用者以該等財務報表為基礎所作之決策，則該會計政策資訊係屬重大。該修正並釐清：

- 與不重大之交易、其他事項或情況相關之會計政策資訊係屬不重大，合併公司無需揭露該等資訊。
- 本公司可能因交易、其他事項或情況之性質而判斷相關會計政策資訊屬重大，即使金額不重大亦然。
- 並非與重大交易、其他事項或情況相關之所有會計政策資訊皆屬重大。

此外，該修正並舉例說明若會計政策資訊係與重大交易、其他事項或情況相關，且有下列情況時，該資訊可能屬重大：

- (1) 合併公司於報導期間改變會計政策，且該變動導致財務報表資訊之重大變動；
- (2) 合併公司自準則允許之選項中選擇其適用之會計政策；
- (3) 因缺乏特定準則之規定，合併公司依 IAS 8「會計政策、會計估計值變動及錯誤」建立之會計政策；
- (4) 合併公司揭露其須運用重大判斷或假設所決定之相關會計政策；或
- (5) 涉及複雜之會計處理規定且財務報表使用者仰賴該等資訊方能了解該等重大交易、其他事項或情況。

2. IAS 8 之修正「會計估計值之定義」

該修正明訂會計估計值係指財務報表中受衡量不確定性影響之貨幣金額。合併公司於適用會計政策時，可能須以無法直

接觀察而必須估計之貨幣金額衡量財務報表項目，故須採用衡量技術及輸入值發展會計估計值以達此目的。衡量技術或輸入值變動對會計估計值之影響數若非屬前期錯誤之更正，該等變動係屬會計估計值變動。

3. IAS 12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

該修正釐清，原始認列時產生相同金額之應課稅及可減除暫時性差異之交易，不適用 IAS 12 原始認列之豁免規定。合併公司將於 111 年 1 月 1 日就與租賃及除役義務有關之所有可減除及應課稅暫時性差異認列遞延所得稅資產(若很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異使用)及遞延所得稅負債，並於該日將累積影響數認列為保留盈餘初始餘額之調整。對租賃及除役義務以外之交易則自 111 年 1 月 1 日以後發生者推延適用該修正。

除上述影響外，截至本財務報告通過發布日止，合併公司評估其他準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024 年 1 月 1 日 (註 2)
IFRS 17 「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日

註 1：除另註明外，上述新發布 / 修正 / 修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：賣方兼承租人應對初次適用 IFRS 16 日後簽訂之售後租回交易追溯適用 IFRS 16 之修正。

1. IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

該修正規定，若本公司出售或投入資產予關聯企業（或合資），或本公司喪失對子公司之控制，但保留對該子公司之重大影響（或聯合控制），若前述資產或前子公司符合 IFRS 3「企業合併」對「業務」之定義時，本公司係全數認列該等交易產生之損益。

此外，若本公司出售或投入資產予關聯企業（或合資），或本公司在與關聯企業（或合資）之交易中喪失對子公司之控制，但保留對該子公司之重大影響（或聯合控制），若前述資產或前子公司不符合 IFRS 3「業務」之定義時，本公司僅在與投資者對該等關聯企業（或合資）無關之權益範圍內認列該交易所產生之損益，亦即，屬本公司對該損益之份額者應予以銷除。

2. IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」（2020 年修正）及「具合約條款之非流動負債」（2022 年修正）

2020 年修正係釐清判斷負債是否分類為非流動時，應評估本公司於報導期間結束日是否具有遞延清償期限至報導期間後至少 12 個月之權利。若本公司於報導期間結束日具有該權利，無論本公司是否預期將行使該權利，負債係分類為非流動。

2020 年修正另規定，若本公司須遵循特定條件始具有遞延清償負債之權利，本公司必須於報導期間結束日已遵循特定條件，即使貸款人係於較晚日期測試本公司是否遵循該等條件亦然。2022 年修正進一步釐清，僅有報導期間結束日以前須遵循之合約條款會影響負債之分類。報導期間後 12 個月內須遵循之合約條款雖不影響負債之分類，惟須揭露相關資訊，俾使財務報告使用者了解本公司可能無法遵循合約條款而須於報導期間後 12 個月內還款之風險。

2020 年修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本公司之權益工具予交易對方致負債之

消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本公司之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依 IAS 32「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

3. IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」

該修正釐清，對於售後租回交易，若資產之移轉滿足 IFRS 15「客戶合約之收入」之規定以銷售資產處理者，賣方兼承租人因租回所產生之負債應依 IFRS 16 之租賃負債規定處理，惟若涉及非取決於指數或費率之變動租賃給付，賣方兼承租人應以不認列與所保留使用權有關之損益之方式衡量該負債。後續，納入租賃負債計算之當期租賃給付數與實際支付數之差額列入損益。

除上述影響外，截至合併財務報表通過發布日止，合併公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

合併財務報表係依歷史成本基礎編製。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及

3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體（子公司）之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與合併公司之會計政策一致。於編製合併財務報告時，各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當合併公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。合併公司及非控制權益之帳面金額已予調整，以反映其於子公司相對權益之變動。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益且歸屬於本公司業主。

子公司明細、持股比例及營業項目，請參閱附註十及附表一。

(五) 企業合併

企業合併係採收購法處理。收購相關成本於成本發生及勞務取得當期列為費用。

商譽係按移轉對價之公允價值以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日之公允價值之總額，超過收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額衡量。

(六) 外幣

各個個體編製財務報表時，以個體功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製合併財務報告時，國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司、關聯企業、合資或分公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額認列為其他綜合損益（並分別歸屬予本公司業主及非控制權益）。

若合併公司處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之聯合協議或關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有可歸屬於合併公司業主且與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制，係按比例將累計兌換差額重新歸屬予該子公司之非控制權益，而不認列為損益。在其他任何部分處分國外營運機構之情況下，累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(七) 存 貨

存貨包括原物料、半成品、在製品及製成品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

(八) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。合併公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(九) 商 譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本，後續以成本減除累計減損損失後之金額衡量。

為減損測試之目的，商譽分攤至合併公司預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組（簡稱「現金產生單位」）。

受攤商譽之現金產生單位每年（及有跡象顯示該單位可能已減損時）藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較，進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得，則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額，減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額，次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當期損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

處分受攤商譽現金產生單位內之某一營運時，與該被處分營運有關之商譽金額係包含於營運之帳面金額以決定處分損益。

(十) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷。合併公司至少每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(十一) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）之減損

合併公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，合併公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共有資產係依合理一致基礎分攤至最小現今產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十二) 金融工具

金融資產與金融負債於合併公司成為該工具合約條款之一方時認列於資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

合併公司所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之金融資產

合併公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- A. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- B. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款及存出保證金）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- A. 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- B. 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，應自信用減損後之次一報導期間起以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算利息收入。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產之減損

合併公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損

失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後12個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

2. 金融負債

(1) 後續衡量

金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

(十三) 負債準備

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

保 固

保證產品與所協議之規格相符之保固義務係依管理階層對清償合併公司義務所需支出之最佳估計，於相關商品認列收入時認列。

(十四) 收入認列

合併公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入來自製造半導體設備之銷售。於客戶接受該設備時，即滿足履約義務，客戶對該產品取得控制，始可認列收入及應收帳款。

2. 勞務收入

勞務收入來自維修服務。

隨合併公司提供之維修服務，相關收入係於勞務提供時認列。

(十五) 租 賃

合併公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 合併公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

2. 合併公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付、殘值保證下承租人預期支付之金額、合理確信將行使之購買選擇權之行使價格，及已反映於租賃期間之租賃終止罰款，減除收取之租賃誘因）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、殘值保證下預期支付金額、標的資產購買選擇權之評估或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於資產負債表。

(十六) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

(十七) 股份基礎給付協議

合併公司給與員工之權益交割股份基礎給付協議

權益交割股份基礎給付協議係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積－員工認股權。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。

(十八) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能具有課稅所得以供可減除暫時性差異或虧損扣抵所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映企業於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

合併公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

合併公司將新型冠狀病毒肺炎疫情造成之經濟影響納入重大會計估計之考量。管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

估計及假設不確定性之主要來源

商譽減損估計

決定商譽是否減損時，須估計分攤到商譽之現金產生單位之使用價值。為計算使用價值，管理階層應估計預期自現金產生單位所產生之未來現金流量，並決定計算現值所使用之適當折現率。若實際現金流量少於預期，可能會產生重大減損損失。

六、現金及約當現金

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
庫存現金及週轉金	\$ 90	\$ 90
銀行支票及活期存款	604,173	352,628
約當現金（原始到期日在3個月 內之投資）		
銀行定期存款	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>
	<u>\$ 624,263</u>	<u>\$ 372,718</u>

銀行定期存款於資產負債表日之利率區間如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
銀行存款	0.001%~1.05%	0.01%~0.2%
定期存款	0.31%~0.435%	0.05%~0.08%

七、按攤銷後成本衡量之金融資產

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流動</u>		
國內投資		
原始到期日超過3個月之定期存款	<u>\$ 19,000</u>	<u>\$ -</u>

截至111年12月31日止，原始到期日超過3個月之定期存款利率區間為年利率0.45%~0.48%。

八、應收帳款、其他應收款及催收款

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>應收帳款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 278,802	\$ 78,657
減：備抵損失	(<u>5,042</u>)	(<u>992</u>)
	<u>\$ 273,760</u>	<u>\$ 77,665</u>
<u>應收帳款－關係人</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 101	\$ -
減：備抵損失	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 101</u>	<u>\$ -</u>
<u>其他應收款</u>		
其他應收款－非關係人	<u>\$ 14</u>	<u>\$ -</u>
<u>催收款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 4,298	\$ 412
減：備抵損失	(<u>4,298</u>)	(<u>412</u>)
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

應收帳款

合併公司對商品銷售之平均授信期間為 30 天至 60 天。於決定應收帳款可回收性時，合併公司考量應收帳款自原始授信日至資產負債表日信用品質之任何改變。為減輕信用風險，合併公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，合併公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，合併公司管理階層認為本公司之信用風險已顯著減少。

合併公司採用 IFRS 9 之簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況及產業經濟情勢。因合併公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因

此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款立帳天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期超過 365 天，合併公司直接重分類催收款，並持續追索活動，追索回收之金額則沖銷相關催收款。

合併公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

111 年 12 月 31 日

	1 ~ 90 天	91~180 天	181~270 天	271 天以上	合 計
預期信用損失率	0.66%	4.93%	12.11%	15.19%	
總帳面金額	\$ 218,512	\$ 53,943	\$ 1,379	\$ 5,069	\$ 278,903
備抵損失(存續期間 預期信用損失)	(<u>1,445</u>)	(<u>2,660</u>)	(<u>167</u>)	(<u>770</u>)	(<u>5,042</u>)
攤銷後成本	<u>\$ 217,067</u>	<u>\$ 51,283</u>	<u>\$ 1,212</u>	<u>\$ 4,299</u>	<u>\$ 273,861</u>

110 年 12 月 31 日

	1 ~ 90 天	91~180 天	181~270 天	271 天以上	合 計
預期信用損失率	0.76%	3.19%	4.91%	-	
總帳面金額	\$ 67,380	\$ 4,268	\$ 7,009	\$ -	\$ 78,657
備抵損失(存續期間 預期信用損失)	(<u>512</u>)	(<u>136</u>)	(<u>344</u>)	-	(<u>992</u>)
攤銷後成本	<u>\$ 66,868</u>	<u>\$ 4,132</u>	<u>\$ 6,665</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 77,665</u>

以上係以立帳日為基準進行之帳齡分析。

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	111年度	110年度
年初餘額	\$ 992	\$ 796
加：本年度提列減損損失	8,348	608
減：本年度重分類	(<u>4,298</u>)	(<u>412</u>)
年底餘額	<u>\$ 5,042</u>	<u>\$ 992</u>

催收款備抵損失之變動資訊如下：

	111年度	110年度
年初餘額	\$ 412	\$ 9,160
加：本年度重分類	4,298	412
加：本年度迴轉減損損失	(<u>412</u>)	(<u>9,160</u>)
年底餘額	<u>\$ 4,298</u>	<u>\$ 412</u>

九、存 貨

	111年12月31日	110年12月31日
原 物 料	\$ 54,365	\$ 30,570
半 成 品	-	311
在 製 品	552,196	418,231
製 成 品	-	197
	<u>\$ 606,561</u>	<u>\$ 449,309</u>

銷貨成本之性質如下：

	111年度	110年度
已銷售之存貨成本	\$ 592,610	\$ 387,289
存貨跌價損失（回升利益）	4,557	(1,197)
存貨盤盈	(8)	(102)
其 他	(85)	(52)
	<u>\$ 597,074</u>	<u>\$ 385,938</u>

存貨淨變現價值回升係因出售已提列跌價損失之存貨所致。

十、子 公 司

列入合併財務報告之子公司

投資公司名稱	子 公 司 名 稱	業 務 性 質	所有權權益及表決權百分比		說 明
			111年12月31日	110年12月31日	
家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司（以下簡稱昇和精技公司）	各種精密儀器製造買賣、維修及保養	100%	100%	

十一、不 動 產、廠 房 及 設 備

自 用

	辦 公 設 備	運 輸 設 備	其 他 設 備	合 計
<u>成 本</u>				
111年1月1日餘額	\$ 5,700	\$ 930	\$ 13,949	\$ 20,579
增 添	740	-	8,185	8,925
處 分	-	-	(523)	(523)
111年12月31日餘額	<u>\$ 6,440</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 21,611</u>	<u>\$ 28,981</u>
<u>累計折舊</u>				
111年1月1日餘額	\$ 3,894	\$ 543	\$ 3,735	\$ 8,172
處 分	-	-	(523)	(523)
折舊費用	923	186	4,802	5,911
111年12月31日餘額	<u>\$ 4,817</u>	<u>\$ 729</u>	<u>\$ 8,014</u>	<u>\$ 13,560</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 1,623</u>	<u>\$ 201</u>	<u>\$ 13,597</u>	<u>\$ 15,421</u>

（接次頁）

(承前頁)

	辦公設備	運輸設備	其他設備	合計
<u>成本</u>				
110年1月1日餘額	\$ 4,449	\$ 930	\$ 12,589	\$ 17,968
增 添	<u>1,251</u>	<u>-</u>	<u>1,360</u>	<u>2,611</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 5,700</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 13,949</u>	<u>\$ 20,579</u>
<u>累計折舊</u>				
110年1月1日餘額	\$ 3,248	\$ 357	\$ 1,495	\$ 5,100
折舊費用	<u>646</u>	<u>186</u>	<u>2,240</u>	<u>3,072</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 3,894</u>	<u>\$ 543</u>	<u>\$ 3,735</u>	<u>\$ 8,172</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ 1,806</u>	<u>\$ 387</u>	<u>\$ 10,214</u>	<u>\$ 12,407</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

辦公設備	3至5年
運輸設備	5年
其他設備	3至8年

十二、租賃協議

(一) 使用權資產

	111年12月31日	110年12月31日
使用權資產帳面金額		
建築物	<u>\$ 20,668</u>	<u>\$ 3,933</u>
使用權資產之增添	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
使用權資產之折舊費用	<u>\$ 22,516</u>	<u>\$ 8,999</u>
建築物	<u>\$ 5,718</u>	<u>\$ 4,500</u>

(二) 租賃負債

	111年12月31日	110年12月31日
租賃負債帳面金額		
流動	<u>\$ 3,013</u>	<u>\$ 3,965</u>
非流動	<u>\$ 18,023</u>	<u>\$ -</u>

租賃負債之折現率區間如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
建築物	1.7%	1.6%

(三) 重要承租活動及條款

合併公司承租建築物做為員工之辦公場所，租賃期間為 6—7 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，本公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

(四) 其他租賃資訊

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
短期租賃費用	\$ 549	\$ 1,927
租賃之現金（流出）總額	(\$ 6,251)	(\$ 6,504)

合併公司選擇對符合短期租賃之房屋建築適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

租賃期間於資產負債表日後開始之所有承租承諾如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
承諾承租	\$ 30,568	\$ 5,760

十三、商譽

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
<u>成本</u>		
年初餘額	\$ 45,057	\$ 45,057
年底餘額	\$ 45,057	\$ 45,057
<u>累計減損損失</u>		
年初餘額	(\$ 20,435)	\$ -
本年度認列減損損失	-	(20,435)
年底餘額	(\$ 20,435)	(\$ 20,435)
年初淨額	\$ 24,622	\$ 45,057
年底淨額	\$ 24,622	\$ 24,622

合併公司於 109 年 12 月 31 日收購昇和精技公司，產生商譽 45,047 仟元，主要係來自控制溢價，包含預期產生之合併綜效、收入成長及未來發展。

由於合併後之實際營業收入成長不如預期，經評估昇和精技公司之可回收金額小於帳面金額，故於 110 年度認列商譽減損 20,435 仟元。

昇和精技公司之可回收金額係以使用價值為基礎決定，以合併公司管理階層核定未來 5 年財務預算之現金流量估計，並使用年折現率 12.9% 予以計算。

十四、其他無形資產

	專	利	權	技	術	客	戶	關	係	合	計
<u>成 本</u>											
111 年 1 月 1 日餘額	\$	1,035		\$	5,900		\$	5,300		\$	12,235
111 年 12 月 31 日餘額	\$	1,035		\$	5,900		\$	5,300		\$	12,235
<u>累計攤銷及減損</u>											
111 年 1 月 1 日餘額	\$	776		\$	843		\$	2,650		\$	4,269
攤銷費用		173			842			2,650			3,665
111 年 12 月 31 日餘額	\$	949		\$	1,685		\$	5,300		\$	7,934
111 年 12 月 31 日淨額	\$	86		\$	4,215		\$	-		\$	4,301
<u>成 本</u>											
110 年 1 月 1 日餘額	\$	1,035		\$	5,900		\$	5,300		\$	12,235
110 年 12 月 31 日餘額	\$	1,035		\$	5,900		\$	5,300		\$	12,235
<u>累計攤銷及減損</u>											
110 年 1 月 1 日餘額	\$	604		\$	-		\$	-		\$	604
攤銷費用		172			843			2,650			3,665
110 年 12 月 31 日餘額	\$	776		\$	843		\$	2,650		\$	4,269
110 年 12 月 31 日淨額	\$	259		\$	5,057		\$	2,650		\$	7,966

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年限計提：

專 利 權	6 年
技 術	7 年
客 戶 關 係	2 年

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
依功能別彙總攤銷費用		
營業成本	\$ 842	\$ 843
管理費用	2,650	2,650
研發費用	<u>173</u>	<u>172</u>
	<u>\$ 3,665</u>	<u>\$ 3,665</u>

十五、其他資產

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
預付款項		
預付貨款	\$ 51,013	\$ 13,222
進項稅額	2,259	6,921
其他預付費用	<u>1,400</u>	<u>2,288</u>
	<u>\$ 54,672</u>	<u>\$ 22,431</u>
其他流動資產		
暫付款	<u>\$ 78</u>	<u>\$ -</u>
<u>非流動</u>		
其他非流動資產		
預付設備款	<u>\$ 2,000</u>	<u>\$ 4,600</u>

十六、應付帳款

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>應付帳款</u>		
因營業而發生－非關係人	<u>\$ 277,014</u>	<u>\$ 210,695</u>
因營業而發生－關係人	<u>\$ 1,689</u>	<u>\$ 1,487</u>

購買部分商品之平均賒帳期間為 1 至 3 個月，對應付帳款不加計利息。合併公司訂有財務風險管理政策，以確保所有應付款於預先約定之信用期限內償還。

十七、其他負債

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
其他應付款		
應付薪資及獎金	\$ 61,926	\$ 36,860
應付員工及董監酬勞	37,419	13,871
應付退休金	766	537
應付保險費	1,410	1,047
應付休假給付	3,896	2,747
銷項稅額	159	3,290
應付設備款	-	3,255
其 他	<u>7,415</u>	<u>5,424</u>
	<u>\$ 112,991</u>	<u>\$ 67,031</u>
其他應付款－關係人	<u>\$ 111</u>	<u>\$ 904</u>
其他負債		
暫 收 款	\$ 223	\$ 297
代 收 款	<u>1,452</u>	<u>1,191</u>
	<u>\$ 1,675</u>	<u>\$ 1,488</u>

十八、負債準備

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
保 固	<u>\$ 26,618</u>	<u>\$ 28,786</u>

保固負債準備係依銷售商品合約約定，合併公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質之事件而進行調整。

十九、退職後福利計畫

確定提撥計畫

合併公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。合併公司 111 及 110 年度認列之退休金成本為 3,904 仟元及 3,125 仟元。

二十、權益

(一) 普通股股本

	111年12月31日	110年12月31日
額定股數(仟股)	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
額定股本	<u>\$ 500,000</u>	<u>\$ 500,000</u>
已發行且已收足股款之股數 (仟股)	<u>22,560</u>	<u>11,040</u>
已發行股本	<u>\$ 225,600</u>	<u>\$ 110,400</u>

本公司為調整資本結構，分別於111年5月17日及110年7月28日經股東會決議，以未分配盈餘55,200仟元及55,200仟元辦理轉增資發行新股，經報奉主管機關核准，並分別於111年6月1日及110年8月24日完成變更登記。

111年10月20日董事會決議現金增資發行新股60,000仟元，每股面額10元，並以每股新台幣22元溢價發行，增資後實收股本為225,600仟元。並經董事會決議，以111年10月24日為增資基準日。

(二) 資本公積

	111年12月31日	110年12月31日
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)</u>		
股票發行溢價	\$ 93,238	\$ 19,200
已失效員工認股權	<u>257</u>	<u>257</u>
	<u>\$ 93,495</u>	<u>\$ 19,457</u>

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派

股東股息紅利。本公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二二之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於 111 年 5 月 17 日及 110 年 7 月 28 日舉行股東會，分別決議通過 110 及 109 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案		每 股 股 利 (元)	
	110年度	109年度	110年度	109年度
法定盈餘公積	\$ 6,753	\$ 6,366	\$ -	\$ -
股票股利	55,200	55,200	5.00	10.00

本公司 112 年 2 月 20 日董事會擬議 111 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案	每 股 股 利 (元)
法定盈餘公積	\$ 20,341	\$ -
現金股利	45,120	2.00
股票股利	47,376	2.10

有關 111 年度之盈餘分配案尚待預計於 112 年 4 月 7 日召開之股東常會決議。

二一、收 入

	111年度	110年度
客戶合約收入		
商品銷貨收入	\$ 925,878	\$ 505,676
其他營業收入	122,075	96,256
	<u>\$ 1,047,953</u>	<u>\$ 601,932</u>

合約餘額

	111年12月31日	110年12月31日	110年1月1日
應收帳款	<u>\$ 273,861</u>	<u>\$ 77,665</u>	<u>\$ 55,313</u>
合約負債－預收貨款			
商品銷貨	<u>\$ 616,648</u>	<u>\$ 437,686</u>	<u>\$ 292,940</u>

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當年度認列為收入之金額如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
來自年初合約負債		
商品銷貨	<u>\$ 414,850</u>	<u>\$ 257,900</u>

二二、稅前淨利

(一) 利息收入

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
利息收入		
銀行存款	\$ 1,057	\$ 95
押金設算息	<u>12</u>	<u>(47)</u>
	<u>\$ 1,069</u>	<u>\$ 48</u>

(二) 其他收入

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
其 他	<u>\$ 532</u>	<u>\$ 3</u>

(三) 其他利益（損失）

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
淨外幣兌換利益（損失）	\$ 11,777	(\$ 1,747)
減損損失	-	(20,435)
租賃修改（損失）利益	(192)	5
其 他	<u>(18)</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 11,567</u>	<u>(\$ 22,177)</u>

(四) 財務成本

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
銀行借款利息	\$ 11	\$ 3
租賃負債之利息	<u>128</u>	<u>114</u>
	<u>\$ 139</u>	<u>\$ 117</u>

(五) 折舊及攤銷

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 5,426	\$ 6,165
營業費用	<u>6,203</u>	<u>1,407</u>
	<u>\$ 11,629</u>	<u>\$ 7,572</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 842	\$ 843
營業費用	<u>2,823</u>	<u>2,822</u>
	<u>\$ 3,665</u>	<u>\$ 3,665</u>

(六) 員工福利費用

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
退職後福利		
確定提撥計畫	\$ 3,904	\$ 3,125
股份基礎給付		
權益交割 (附註二五)	2,038	-
其他員工福利	<u>204,228</u>	<u>126,381</u>
員工福利費用合計	<u>\$ 210,170</u>	<u>\$ 129,506</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 57,474	\$ 38,477
營業費用	<u>152,696</u>	<u>91,029</u>
	<u>\$ 210,170</u>	<u>\$ 129,506</u>

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董監事酬勞前之稅前利益分別以 3% 以上及不高於 3% 提撥員工酬勞及董監事酬勞。111 及 110 年度估列之員工酬勞及董監事酬勞分別於 112 年 2 月 20 日及 111 年 3 月 3 日經董事會決議如下：

估列比例

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
員工酬勞	10%	10%
董監事酬勞	2.5%	2.5%

金 額

	111年度		110年度	
	現	金	現	金
員工酬勞		\$ 28,691		\$ 10,099
董監事酬勞		7,172		2,524

年度財務報表通過發佈日後若金額有變動，則依會計估計變動處理，於下一年度調整入帳。

111 及 110 年度員工酬勞及董監事酬勞董事會決議之實際配發金額與 111 及 110 年度財務報表之認列金額並無差異。

二三、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

	111年度	110年度
當期所得稅		
本年度產生者	\$ 55,411	\$ 22,993
以前年度之調整	(2)	30
	<u>55,409</u>	<u>23,023</u>
遞延所得稅		
本年度產生者	(3,477)	405
以前年度之調整	11	-
	<u>(3,466)</u>	<u>405</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 51,943</u>	<u>\$ 23,428</u>

會計所得與當期所得稅費用之調節如下：

	111年度	110年度
稅前淨利	<u>\$ 255,358</u>	<u>\$ 90,960</u>
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$ 51,072	\$ 18,192
稅上不可減除之費損	856	6,083
暫時性差異產生之稅額影響	6	(877)
以前年度之遞延所得稅費用於本年度之調整	11	-
以前年度之當期所得稅費用於本年度之調整	(2)	30
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 51,943</u>	<u>\$ 23,428</u>

(二) 本期所得稅負債

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
本期所得稅負債		
應付所得稅	\$ <u>43,810</u>	\$ <u>13,820</u>

(三) 遞延所得稅資產

遞延所得稅資產之變動如下：

111 年度

	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認 列 於 損 益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>			
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 571	\$ 911	\$ 1,482
未實現兌換損益	835	(835)	-
應付休假給付	549	230	779
備抵呆帳	135	1,161	1,296
保固損失	-	<u>4,947</u>	<u>4,947</u>
	<u>\$ 2,090</u>	<u>\$ 6,414</u>	<u>\$ 8,504</u>

遞 延 所 得 稅 負 債

暫時性差異			
未實現兌換損益	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 2,937)</u>	<u>(\$ 2,937)</u>

110 年度

	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認 列 於 損 益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>			
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 811	(\$ 240)	\$ 571
未實現兌換損益	228	607	835
應付休假給付	420	129	549
備抵呆帳	<u>1,036</u>	<u>(901)</u>	<u>135</u>
	<u>\$ 2,495</u>	<u>(\$ 405)</u>	<u>\$ 2,090</u>

(四) 所得稅核定情形

本公司及昇和精技公司之營利事業之所得稅申報，除 110 年度外，截至 109 年度以前之申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二四、每股盈餘

	111年度	110年度
基本每股盈餘	<u>\$ 11.91</u>	<u>\$ 4.08</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 11.06</u>	<u>\$ 3.85</u>

計算每股盈餘時，無償配股之影響業已追溯調整，該無償配股基準日訂於 111 年 5 月 24 日。因追溯調整，110 年度基本及稀釋每股盈餘變動如下：

	追 溯 調 整 前	追 溯 調 整 後
基本每股盈餘	<u>\$ 6.12</u>	<u>\$ 4.08</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.77</u>	<u>\$ 3.85</u>

單位：每股元

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	111年度	110年度
用以計算基本每股盈餘之淨利	<u>\$ 203,415</u>	<u>\$ 67,532</u>
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	<u>\$ 203,415</u>	<u>\$ 67,532</u>

股 數

	111年度	110年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	17,086	16,560
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工酬勞	<u>1,309</u>	<u>980</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	<u>18,395</u>	<u>17,540</u>

單位：仟股

若合併公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二五、股份基礎給付協議

員工認股權計畫

本公司於 111 年 10 月給與員工認股權 600 仟股，給與對象為本公司之員工。

員工認股權之相關資訊如下：

員 工 認 股 權	111年度	
	單 位 (仟)	加 權 平 均 行 使 價 格 (元)
年初流通在外	-	\$ -
本年度給與	600	22
本年度行使	(600)	
年底流通在外	-	
年底可行使	-	
本年度給與之認股權加權平均 公允價值 (元)	\$ 3.3963	

於 111 年度行使之員工認股權，其於行使日之加權平均股價為 22 元。

本公司於 111 年 10 月給與之員工認股權均使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

	111年10月
給與日市價	25.23 元
執行價格	22 元
預期波動率	39.61%
存續期間	30 天
預期股利率	0%
無風險利率	1.157%

111 年度認列之酬勞成本為 2,038 仟元。

二六、資本風險管理

合併公司目前營運穩定，資本風險管理目標為確保能夠在繼續經營與成長前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。

合併公司採用審慎之風險管理策略並定期審核，依業務發展策略及營運需求做整體性規劃，以決定合併公司適當之資本結構。

二七、金融工具

(一) 公允價值資訊－非按公允價值衡量之金融工具

合併公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 金融工具之種類

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產 (註1)	\$ 918,271	\$ 451,620
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量之負債 (註2)	391,805	280,117

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款（含關係人）、其他應收款、按攤銷後成本衡量之金融資產及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款（含關係人）及其他應付款（含關係人）等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(三) 財務風險管理目的與政策

合併公司主要金融工具包括現金及約當現金、應收帳款及應付帳款。上述金融工具與營運有關之財務風險。（包含匯率風險、利率風險及其他價格風險）、信用風險及流動性風險。

1. 市場風險

合併公司之營運活動使合併公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）以及利率變動風險（參閱下述(2)）。

合併公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司之子公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使合併公司產生匯率變動暴險。

合併公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目），參閱附註三一。

敏感度分析

合併公司主要受到美元及日幣波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少 1% 時，合併公司之敏感性分析如下。1% 係為集團內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。

	美金貨幣之影響		日幣貨幣之影響	
	111年度	110年度	111年度	110年度
損益	\$ 3,504	\$ 1,065	\$ 226	\$ 92

以上主要源自於合併公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之美金貨幣計價銀行存款、應收款項。

(2) 利率風險

因合併公司內之個體同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。

合併公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	111年12月31日	110年12月31日
具公允價值利率風險		
— 金融資產	\$ 20,000	\$ 20,000
— 金融負債	21,036	3,965
具現金流量利率風險		
— 金融資產	623,173	352,628
— 金融負債	-	-

敏感度分析

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係

假設資產負債表日流通在外之負債金額於報導期間皆流通在外。集團內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 0.25% 基點，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加／減少 0.25% 基點，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司 111 及 110 年度之稅前淨利將分別增加／減少 1,558 仟元及 882 仟元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成集團財務損失之風險。截至資產負債表日，合併公司可能因交易對方未履行義務及合併公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於：

- (1) 合併資產負債表所認列之金融資產帳面金額。
- (2) 合併公司提供財務保證所產生之或有負債金額。

合併公司採行之政策係僅與信譽卓著之對象進行交易，並於必要情形下取得足額之擔保以減輕因拖欠所產生財務損失之風險。為減輕信用風險，合併公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，合併公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為合併公司之信用風險已顯著減少。故該信用風險係屬有限。

合併公司之信用風險主要係集中於合併公司最大客戶，截至 111 年及 110 年 12 月 31 日止，總應收帳款來自前述客戶之比率分別 11% 及 54%。

3. 流動性風險

合併公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。截至 111 及 110 年度止，合併公司未動用之短期銀行融資額度，參閱下列(2)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依合併公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

111年12月31日

	短於1年	1至2年	2至3年	3年以上	合計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 278,703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,703
其他應付款	113,102	-	-	-	113,102
租賃負債	3,349	3,479	3,537	11,821	22,186
其他流動負債	1,675	-	-	-	1,675
	<u>\$ 396,829</u>	<u>\$ 3,479</u>	<u>\$ 3,537</u>	<u>\$ 11,821</u>	<u>\$ 415,666</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~2年	2~3年	3~5年	5年以上
租賃負債	<u>\$ 3,349</u>	<u>\$ 3,479</u>	<u>\$ 3,537</u>	<u>\$ 7,881</u>	<u>\$ 3,940</u>

110年12月31日

	短於1年	1至2年	2至3年	3年以上	合計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 212,182	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,182
其他應付款	67,935	-	-	-	67,935
租賃負債	4,000	-	-	-	4,000
其他流動負債	1,488	-	-	-	1,488
	<u>\$ 285,605</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 285,605</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~2年	2~3年	3~5年	5年以上
租賃負債	<u>\$ 4,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

(2) 融資額度

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
無擔保銀行借款額度 (雙方同意下得展期)		
— 已動用金額	\$ -	\$ -
— 未動用金額	<u>50,000</u>	<u>110,000</u>
	<u>\$ 50,000</u>	<u>\$ 110,000</u>

二八、關係人交易

本公司及子公司（係本公司之關係人）間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，合併公司與其他關係人間之交易如下。

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)	母公司
Gudeng Inc. (以下簡稱家登美國公司)	兄弟公司

(二) 營業收入

帳列項目	關係人名稱	111年度	110年度
銷貨收入	家登公司	\$ 1,672	\$ 328

本公司對關係人之銷貨價格與一般客戶相當。

(三) 進貨

關係人名稱	111年度	110年度
家登公司	\$ 10,353	\$ 9,481
家登美國公司	\$ 105	\$ -

進貨係依市價扣除折扣，以反映購買之數量及與該關係人之關係。

(四) 應收關係人款項

帳列項目	關係人名稱	111年12月31日	110年12月31日
應收帳款－關係人	家登公司	\$ 101	\$ -

(五) 應付關係人款項（不含向關係人借款）

帳列項目	關係人名稱	111年12月31日	110年12月31日
應付帳款－關係人	家登公司	\$ 1,689	\$ 1,487

(六) 承租協議

關係人名稱	111年度	110年度
取得使用權資產		
家登公司	\$ -	\$ 7,866

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年12月31日	110年12月31日
租賃負債	家登公司	\$ <u> -</u>	\$ <u> 3,965</u>

關 係 人 名 稱	111年度	110年度
<u>利息費用</u>		
家登公司	\$ <u> 35</u>	\$ <u> 99</u>

本公司於 110 年 1 月 1 日向家登公司承租建築物做為廠房及辦公室使用，租賃期間均為 2 年，租金係參考類似資產之租金水準，並依租約按月支付固定租賃給付。

(七) 其他關係人交易

1. 租金支出

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年度	110年度
營業費用	家登公司	\$ <u> 12</u>	(\$ <u> 33</u>)
製造費用	家登公司	\$ <u> 11</u>	\$ <u> 10</u>

2. 其他費用

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年度	110年度
營業費用	家登公司	\$ <u> 248</u>	\$ <u> 16</u>
製造費用	家登公司	\$ <u> 488</u>	\$ <u> 1,716</u>

3. 其他收入

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年度	110年度
利息收入	家登公司	\$ <u> 9</u>	(\$ <u> 47</u>)

4. 其他資產及負債

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年12月31日	110年12月31日
存出保證金	家登公司	\$ <u> 669</u>	\$ <u> 669</u>
其他應付款—關係人	家登公司	\$ <u> 111</u>	\$ <u> 904</u>
合約負債	家登公司	\$ <u> 96</u>	\$ <u> 120</u>

(八) 主要管理階層薪酬

	111年度	110年度
短期員工福利	\$ <u> 43,969</u>	\$ <u> 26,141</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

重大承諾

合併公司與各廠商契約承諾購置裝修工程，其合約總價計新台幣 8,018 仟元，截至 111 年 12 月 31 日止已支付 2,000 仟元（帳列預付設備款），餘新台幣 6,018 仟元尚未支付。

三十、重大之期後事項：無。

三一、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按合併公司各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債如下：

111 年 12 月 31 日

	外	幣	匯	率	帳	面	金	額
<u>外幣資產</u>								
<u>貨幣性項目</u>								
美 元	\$	11,409	30.71	(美元：新台幣)	\$	350,358		
日 圓		97,341	0.2324	(日圓：新台幣)		22,622		
歐 元		34	32.72	(歐元：新台幣)		1,112		
						<u>\$ 374,092</u>		

110 年 12 月 31 日

	外	幣	匯	率	帳	面	金	額
<u>外幣資產</u>								
<u>貨幣性項目</u>								
美 元	\$	3,849	27.68	(美元：新台幣)	\$	106,540		
日 圓		38,392	0.2405	(日圓：新台幣)		9,233		
						<u>\$ 115,773</u>		

具重大影響之外幣兌換損益（未實現）如下：

外	幣	111年度		110年度	
		匯	率	匯	率
美	元	30.71 (美元：新台幣)	\$ 15,870	27.68 (美元：新台幣)	(\$ 3,715)
日	圓	0.2324 (日圓：新台幣)	(1,149)	0.2405 (日圓：新台幣)	(458)
歐	元	32.72 (歐元：新台幣)	(2)	31.32 (歐元：新台幣)	-
			<u>\$ 14,719</u>		<u>(\$ 4,173)</u>

三二、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊及(二)轉投資事業相關資訊：

編號	項	目	說	明
1	資金貸與他人。			無
2	為他人背書保證。			無
3	期末持有有價證券情形。(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)			無
4	累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣3億元或實收資本額 20%以上。			無
5	取得不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上。			無
6	處分不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上。			無
7	與關係人進、銷貨之金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上。			無
8	應收關係人款項達 1 億元或實收資本額 20%以上。			無
9	從事衍生性商品交易。			無
10	其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。			附表二
11	被投資公司資訊			附表一

(三) 大陸投資資訊

編號	項	目	說	明
1	大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本期損益及認列之投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。			無
2	與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：			
	(1)進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比。			無
	(2)銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比。			無
	(3)財產交易金額及其所產生之損益數額。			無
	(4)票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的。			無
	(5)資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額。			無
	(6)其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等。			無

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司

被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：除股數外，為新台幣及外幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地	主要營業項目	原本期	投資		金額	期	未	持		有	本	司	本	期	認	列	之	備	註
					始	未				帳	面										
家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司	新竹縣竹北市復興三路二段106號	半導體與面板的PVD真空技術相關機台設計及改造	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 70,000	年底	1,977,686	100	\$	67,164	\$	16,375	\$	12,882						註1及2

註 1：被投資公司本期（損）益及本期認列之投資（損）益係經會計師查核之金額。

註 2：於編製合併財務報告時，業已合併沖銷。

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司
 母子公司間業務關係及重要交易往來情形

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：除另註明者外
 ，為新台幣仟元

編號 (註 1)	交易人 名稱	交易往來對象	與交易人之關係 (註 2)	交易		往來金額	交易條件 (註 4)	情形 佔合併總資產之比率 (註 3)
				交款科目	易目金			
0	家碩科技股份有限公司	昇和精科技股份有限公司	1	租金收入	\$ 720	-	-	-

註 1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

1. 母公司填 0。
 2. 子公司依公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。
- 註 2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可：
1. 母公司對子公司。
 2. 子公司對母公司。
 3. 子公司對子公司。

註 3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債科目者，以期未餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益科目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註 4：係與非關係人雷同。

註 5：此附表僅揭露單向交易資訊，於編制合併報表時，業已沖銷上述交易。

附件二

112 年度合併財務報告暨會計師查核報告

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)
及子公司

合併財務報告暨會計師查核報告
民國112及111年度

地址：新北市土城區中央路4段2號8樓之5

電話：(02)2268-9141

§ 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、關係企業合併財務報表聲明書	3		-
四、會計師查核報告	4~7		-
五、合併資產負債表	8		-
六、合併綜合損益表	9~10		-
七、合併權益變動表	11		-
八、合併現金流量表	12~13		-
九、合併財務報表附註			
(一) 公司沿革	14		一
(二) 通過財務報告之日期及程序	14		二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	14~15		三
(四) 重大會計政策之彙總說明	15~27		四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	27		五
(六) 重要會計項目之說明	27~51		六~二九
(七) 關係人交易	51~54		三十
(八) 質抵押之資產	-		-
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	54		三一
(十) 重大之災害損失	-		-
(十一) 重大之期後事項	-		三二
(十二) 其 他	55		三三
(十三) 附註揭露事項			
1. 重大交易事項相關資訊	56、58~59		三四
2. 轉投資事業相關資訊	56、58~59		三四
3. 大陸投資資訊	56		三四
4. 主要股東資訊	56、60		三四
(十三) 部門資訊	57		三五

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 112 年度（自 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：家碩科技股份有限公司

負責人：邱 銘 乾



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 4 日

會計師查核報告

家碩科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及其子公司（家碩集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達家碩集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與家碩集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對家碩集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對家碩集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

家碩集團合併營業收入主要來源為設備機台之銷售，產品係屬客製化機台，其中 112 年度機器設備銷售金額重大，佔合併營業收入 88%；設備機台銷售交易條件為交機完成且經客戶接受後始完成履約義務，因涉及判斷銷貨商品之控制權移轉是否發生，故可能造成收入認列存有不適當之情形，以及審計準則對收入認列預設為顯著風險，故將其設備機台銷貨收入認列之真實性列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱合併財務報表附註四(十五)及附註二二。

針對上述重要事項，本會計師執行下列主要查核程序：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制制度係合理且有效執行。
2. 以設備機台銷貨收入明細進行選樣，核對認列收入之相關文件，以確認銷貨收入是否發生。
3. 取得期後銷貨退回明細，抽核其相關憑證並檢視退貨原因之合理性。

其他事項

家碩科技股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估家碩集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算家碩集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

家碩集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對家碩集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使家碩集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致家碩集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對家碩集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 建 銘

曾建銘



會計師 王 攀 發

王攀發



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 4 日

家碩科技股份有限公司 (原名：家登自動化股份有限公司) 及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 997,697	53	\$ 624,263	38
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註七)	10,000	1	19,000	1
1170	應收帳款—非關係人 (附註四、八及二二)	130,760	7	273,760	16
1180	應收帳款—關係人 (附註四、八、二二及三十)	-	-	101	-
1200	其他應收款 (附註八)	304	-	14	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二四)	205	-	-	-
130X	存貨 (附註四及九)	565,681	30	606,561	37
1410	預付款項 (附註十六)	4,040	-	54,672	3
1470	其他流動資產 (附註十六)	39	-	78	-
11XX	流動資產總計	<u>1,708,726</u>	<u>91</u>	<u>1,578,449</u>	<u>95</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)	7,543	1	-	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十二及三十)	76,461	4	15,421	1
1755	使用權資產 (附註四、十三及三十)	37,797	2	20,668	1
1780	無形資產 (附註四及十五)	4,479	-	4,301	-
	商譽 (附註四及十四)	24,622	1	24,622	2
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二四)	13,725	1	8,504	1
1920	存出保證金 (附註三十)	4,255	-	1,133	-
1900	其他非流動資產 (附註十六)	3,106	-	2,000	-
15XX	非流動資產總計	<u>171,988</u>	<u>9</u>	<u>76,649</u>	<u>5</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,880,714</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,655,098</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債 (附註二二及三十)	\$ 766,588	41	\$ 616,648	37
2170	應付帳款—非關係人 (附註十七)	136,367	7	277,014	17
2180	應付帳款—關係人 (附註十七及三十)	19,777	1	1,689	-
2200	其他應付款—非關係人 (附註十八)	114,034	6	112,991	7
2220	其他應付款項—關係人 (附註十八及三十)	220	-	111	-
2230	本期所得稅負債 (附註四及二四)	35,849	2	43,810	3
2250	負債準備—流動 (附註四及十九)	29,250	2	26,618	2
2280	租賃負債—流動 (附註四、十三及三十)	9,471	-	3,013	-
2399	其他流動負債 (附註十八)	1,156	-	1,675	-
21XX	流動負債總計	<u>1,112,712</u>	<u>59</u>	<u>1,083,569</u>	<u>66</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	302	-	2,937	-
2600	租賃負債—非流動 (附註四、十三及三十)	29,279	2	18,023	1
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及二十)	5,114	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>34,695</u>	<u>2</u>	<u>20,960</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>1,147,407</u>	<u>61</u>	<u>1,104,529</u>	<u>67</u>
	權益 (附註二一)				
3110	普通股股本	272,976	14	225,600	13
3200	資本公積	93,495	5	93,495	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	38,057	2	17,716	1
3350	未分配盈餘	329,164	18	213,758	13
3300	保留盈餘總計	367,221	20	231,474	14
3400	其他權益	(385)	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>733,307</u>	<u>39</u>	<u>550,569</u>	<u>33</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,880,714</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,655,098</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾

經理人：詹印豐

會計主管：石惠文

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	112年度		111年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二二及三十）			
4100	\$ 1,207,145	100	\$ 1,047,953	100
	營業成本（附註九、二三及三十）			
5000	(621,607)	(51)	(597,074)	(57)
5900	<u>585,538</u>	<u>49</u>	<u>450,879</u>	<u>43</u>
	營業費用（附註二十、二三及三十）			
6100	62,375	5	46,997	4
6200	106,510	9	78,582	8
6300	150,604	12	75,035	7
6450	6,015	1	7,936	1
6000	<u>325,504</u>	<u>27</u>	<u>208,550</u>	<u>20</u>
6900	<u>260,034</u>	<u>22</u>	<u>242,329</u>	<u>23</u>
	營業外收入及支出（附註二三）			
7100	10,534	1	1,069	-
7190	273	-	532	-
7020	7,239	-	11,567	1
7050	(733)	-	(139)	-
7060	(32)	-	-	-
7000	<u>17,281</u>	<u>1</u>	<u>13,029</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 277,315	23	\$ 255,358	24
7950	所得稅費用(附註四及二四)	(49,072)	(4)	(51,943)	(5)
8200	本年度淨利	<u>228,243</u>	<u>19</u>	<u>203,415</u>	<u>19</u>
	其他綜合損益				
	後續可能重分類至損益				
	之項目				
8361	國外營運機構財務				
	報表換算之兌換				
	差額	(385)	-	-	-
8300	本年度其他綜合損				
	益(稅後淨額)				
	合計	(385)	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 227,858</u>	<u>19</u>	<u>\$ 203,415</u>	<u>19</u>
	每股盈餘(附註二五)				
9710	基 本	<u>\$ 8.36</u>		<u>\$ 9.84</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 7.96</u>		<u>\$ 9.13</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾

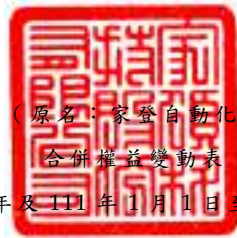


經理人：詹印豐



會計主管：石惠文





家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司
合併權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 本		保 留 盈 餘		其 他 權 益		
		股數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	11,040	\$ 110,400	\$ 19,457	\$ 10,963	\$ 72,296	\$ -	\$ 213,116
	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	6,753	(6,753)	-	-
B5	股東股票股利	5,520	55,200	-	-	(55,200)	-	-
N1	本公司發行員工認股權	-	-	2,038	-	-	-	2,038
E1	現金增資	6,000	60,000	72,000	-	-	-	132,000
D1	111 年 度 淨 利	-	-	-	-	203,415	-	203,415
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	22,560	225,600	93,495	17,716	213,758	-	550,569
	111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	20,341	(20,341)	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(45,120)	-	(45,120)
B9	股東股票股利	4,738	47,376	-	-	(47,376)	-	-
D1	112 年 度 淨 利	-	-	-	-	228,243	-	228,243
D3	112 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(385)	(385)
D5	112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	228,243	(385)	227,858
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	27,298	\$ 272,976	\$ 93,495	\$ 38,057	\$ 329,164	(\$ 385)	\$ 733,307

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾



經理人：詹印豐



會計主管：石惠文



家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 277,315	\$ 255,358
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	21,070	11,629
A20200	攤銷費用	1,069	3,665
A20300	預期信用減損損失	6,015	7,936
A20900	財務成本	733	139
A21200	利息收入	(10,534)	(1,069)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	2,038
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	32	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	9,505	4,557
A24100	外幣兌換損失（利益）	626	(18,020)
A22900	租賃修改損失	-	192
A29900	廉價購買利益	(1,512)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	138,890	(198,650)
A31160	應收帳款－關係人	101	-
A31180	其他應收款	14	(14)
A31200	存 貨	31,375	(161,809)
A31230	預付款項	50,632	(32,241)
A31240	其他流動資產	39	(78)
A32150	應付帳款	(140,647)	66,521
A32160	應付帳款－關係人	18,088	-
A32180	其他應付款	490	45,167
A32190	其他應付款－關係人	109	-
A32200	負債準備	2,632	(2,168)
A32210	合約負債	149,940	178,962
A32230	其他流動負債	(519)	187
A32240	淨確定福利負債	5,114	-
A33000	營運產生之現金	560,577	162,302
A33200	收取之利息	10,230	1,069
A33300	支付之利息	(733)	(139)
A33500	支付之所得稅	(65,094)	(25,430)
AAAA	營業活動之淨現金流入	504,980	137,802

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 10,000)	(\$ 19,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	19,000	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(6,448)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(70,807)	(8,925)
B03700	存出保證金增加	(3,122)	-
B03800	存出保證金減少	-	104
B04500	購置無形資產	(1,247)	-
B07100	預付設備款(增加)減少	(3,106)	2,600
BBBB	投資活動之淨現金流出	(75,730)	(25,221)
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(8,165)	(5,574)
C04500	發放現金股利	(45,120)	-
C04600	現金增資	-	132,000
CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(53,285)	126,426
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,531)	12,538
EEEE	現金及約當現金淨增加	373,434	251,545
E00100	年初現金及約當現金餘額	624,263	372,718
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 997,697	\$ 624,263

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾



經理人：詹印豐



會計主管：石惠文



家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司

合併財務報表附註

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（除另註明外，金額以新台幣仟元為單位）

一、公司沿革及營業

家碩科技股份有限公司（以下稱「本公司」），係於 105 年 7 月 18 日設立，於新北市之股份有限公司，並於同年 7 月開始營業。所營業務主要為各種精密儀器之買賣、維修及保養業務。

本公司原名「家登自動化股份有限公司」，經 112 年 1 月 31 日臨時股東會決議更名為「家碩科技股份有限公司」，並於 112 年 2 月 10 日經新北市政府核准。

本公司股票自 112 年 6 月起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。

本財務報表係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於 113 年 3 月 4 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRS 會計準則」）

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則將不致造成家碩科技股份有限公司及子公司（以下稱「合併公司」）會計政策之重大變動。

(二) 113 年適用之金管會認可之 IFRS 會計準則

<u>新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋</u>	<u>IASB 發布之生效日(註1)</u>
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024 年 1 月 1 日(註2)
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日
IAS 7 及 IFRS 7 之修正「供應商融資安排」	2024 年 1 月 1 日(註3)

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：賣方兼承租人應對初次適用 IFRS 16 日後簽訂之售後租回交易追溯適用 IFRS 16 之修正。

註 3：第一次適用本修正時，豁免部分揭露規定。

截至本財務報告通過發布日止，合併公司評估上述準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則

<u>新發布／修正／修訂準則及解釋</u>	<u>IASB 發布之生效日(註1)</u>
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IAS 21 之修正「缺乏可兌換性」	2025 年 1 月 1 日 (註 2)

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：適用於 2025 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間。首次適用該修正時，將影響數認列於首次適用日之保留盈餘。當合併公司以非功能性貨幣作為表達貨幣時，將影響數調整首次適用日權益項下之國外營運機構兌換差額。

截至合併財務報表通過發布日止，合併公司仍持續評估上述準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則編製。

(二) 編製基礎

合併財務報表係依歷史成本基礎編製。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體（子公司）之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與合併公司之會計政策一致。於編製合併財務報告時，各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當合併公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。合併公司及非控制權益之帳面金額已予調整，以反映其於子公司相對權益之變動。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益且歸屬於本公司業主。

子公司明細、持股比例及營業項目，請參閱附註十及附表一。

(五) 企業合併

企業合併係採收購法處理。收購相關成本於成本發生及勞務取得當期列為費用。

商譽係按移轉對價之公允價值以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日之公允價值之總額，超過收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額衡量。

(六) 外幣

各個體編製財務報表時，以個體功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製合併財務報告時，國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司、關聯企業、合資或分公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額認列為其他綜合損益。

若合併公司處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之聯合協議或關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制，係按比例將累計兌換差額重新歸屬予該子公司之非控制權益，而不認列為損益。在其他任何部分處分國外營運機構之情況下，累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(七) 存 貨

存貨包括原物料、半成品、在製品及製成品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

(八) 投資關聯企業

關聯企業係指合併公司具有重大影響，但非屬子公司或合資之企業。

合併公司對投資關聯企業係採用權益法。

權益法下，投資關聯企業原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨合併公司所享有之關聯企業損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對關聯企業權益之變動係按持股比例認列。

取得成本超過合併公司於取得日所享有關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；合併公司於取得日所享有關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期損益。

關聯企業發行新股時，合併公司若未按持股比例認購，致使持股比例發生變動，並因而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積—採權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數及採用權益法之投資。惟若未按持股比例認購或取得致使對關聯企業之所有權權益減少者，於其他綜合損益中所認列與該關聯企業有關之金額按減少比例重分類，其會計處理之基礎係與關聯企業若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同；前項調整如應借記資本公積，而採用權益法之投資所產生之資本公積餘額不足時，其差額借記保留盈餘。

當合併公司對關聯企業之損失份額等於或超過其在該關聯企業之權益（包括權益法下投資關聯企業之帳面金額及實質上屬於合併公司對該關聯企業淨投資組成部分之其他長期權益）時，即停止認列進一步之損失。合併公司僅於發生法定義務、推定義務或已代關聯企業支付款項之範圍內，認列額外損失及負債。

合併公司於評估減損時，係將投資之整體帳面金額（含商譽）視為單一資產比較可回收金額與帳面金額，進行減損測試，所認列之減損損失不分攤至構成投資帳面金額組成部分之任何資產，包括商譽。減損損失之任何迴轉，於該投資之可回收金額後續增加之範圍內予以認列。

合併公司自其投資不再為關聯企業之日停止採用權益法，其對原關聯企業之保留權益以公允價值衡量，該公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，列入當期損益。此外，於其他綜合損益中所認列與該關聯企業有關之所有金額，其會計處理之基礎係與關聯企業若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。若對關聯企業之投資成為合資之投資，或對合資之投資成為對關聯企業之投資，本公司係持續採用權益法而不對保留權益作再衡量。

合併公司與關聯企業間之逆流、順流及側流交易所產生之損益，僅在與本公司對關聯企業權益無關之範圍內，認列於合併財務報告。

(九) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。合併公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計值變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(十) 商 譽

企業合併所取得之商譽係依收購日所認列之商譽金額作為成本，後續以成本減除累計減損損失後之金額衡量。

為減損測試之目的，商譽分攤至合併公司預期因該合併綜效而受益之各現金產生單位或現金產生單位群組（簡稱「現金產生單位」）。

受攤商譽之現金產生單位每年（及有跡象顯示該單位可能已減損時）藉由包含商譽之該單位帳面金額與其可回收金額之比較，進行該單位之減損測試。若分攤至現金產生單位之商譽係當年度企業合併所取得，則該單位應於當年度結束前進行減損測試。若受攤商譽之現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額，減損損失係先減少該現金產生單位受攤商譽之帳面金額，次就該單位內其他各資產帳面金額之比例減少各該資產帳面金額。任何減損損失直接認列為當期損失。商譽減損損失不得於後續期間迴轉。

處分受攤商譽現金產生單位內之某一營運時，與該被處分營運有關之商譽金額係包含於營運之帳面金額以決定處分損益。

(十一) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷。合併公司至少每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計值變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(十二) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）之減損

合併公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，合併公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共有資產係依合理一致基礎分攤至最小現金產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十三) 金融工具

金融資產與金融負債於合併公司成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

合併公司所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之金融資產

合併公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- A. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- B. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款及存出保證金）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- A. 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- B. 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，應自信用減損後之次一報導期間起以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算利息收入。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產之減損

合併公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後12個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

合併公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

2. 金融負債

(1) 後續衡量

金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

(十四) 負債準備

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

保 固

保證產品與所協議之規格相符之保固義務係依管理階層對清償合併公司義務所需支出之最佳估計，於相關商品認列收入時認列。

(十五) 收入認列

合併公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入來自製造半導體設備之銷售。於客戶接受該設備時，即滿足履約義務，客戶對該產品取得控制，始可認列收入。

2. 勞務收入

勞務收入來自維修服務。

隨合併公司提供之維修服務，相關收入係於勞務提供時認列。

(十六) 租賃

合併公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 合併公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

2. 合併公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付、殘值保證下承租人預期支付之金額、合理確信將行使之購買選擇權之行使價格，及已反映於租賃期間之租賃終止罰款，減除收取之租賃誘因）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、殘值保證下預期支付金額、標的資產購買選擇權之評估或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，合併公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於合併資產負債表。

(十七) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益、資產上限影響數之變動及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債（資產）係確定福利退休計畫之提撥短絀（剩餘）。淨確定福利資產不得超過從該計畫退還提撥金或可減少未來提撥金之現值。

(十八) 股份基礎給付協議

合併公司給與員工之權益交割股份基礎給付協議

權益交割股份基礎給付協議係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積－員工認股權。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。

(十九) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

合併公司依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能具有課稅所得以供可減除暫時性差異或虧損扣抵所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司、關聯企業及聯合協議相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟合併公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能具有足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映合併公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

合併公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

經合併公司之管理階層評估後，並無重大會計判斷、估計及假設不確定性之情形。

六、現金及約當現金

	112年12月31日	111年12月31日
庫存現金及週轉金	\$ 90	\$ 90
銀行支票及活期存款	783,491	604,173
約當現金（原始到期日在3個月內之投資）		
銀行定期存款	214,116	20,000
	<u>\$ 997,697</u>	<u>\$ 624,263</u>

銀行存款於資產負債表日之利率區間如下：

	112年12月31日	111年12月31日
銀行活期存款	0.001%~1.45%	0.001%~1.05%
銀行定期存款	0.55%~4.95%	0.31%~0.435%

七、按攤銷後成本衡量之金融資產

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>流動</u>		
國內投資		
原始到期日超過3個月之		
定期存款	<u>\$ 10,000</u>	<u>\$ 19,000</u>

原始到期日超過3個月之定期存款於資產負債表日之利率區間如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
銀行定期存款	0.56%	0.45%~0.48%

八、應收帳款、其他應收款及催收款

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>應收帳款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 138,116	\$ 278,802
減：備抵損失	(7,356)	(5,042)
	<u>\$ 130,760</u>	<u>\$ 273,760</u>
<u>應收帳款－關係人</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ -	\$ 101
減：備抵損失	-	-
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 101</u>
<u>其他應收款</u>		
其他應收款－非關係人	<u>\$ 304</u>	<u>\$ 14</u>
<u>催收款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 7,999	\$ 4,298
減：備抵損失	(7,999)	(4,298)
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

應收帳款

合併公司對商品銷售之平均授信期間為30天至60天。於決定應收帳款可回收性時，合併公司考量應收帳款自原始授信日至資產負債表日信用品質之任何改變。為減輕信用風險，合併公司管理階層指派

專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，合併公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為合併公司之信用風險已顯著減少。

合併公司採用 IFRS 9 之簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況及產業經濟情勢。因合併公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款立帳天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期超過 365 天，合併公司直接重分類催收款，並持續追索活動，追索回收之金額則沖銷相關催收款。

合併公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

112 年 12 月 31 日

	1 ~ 90 天	91~180 天	181~270 天	271 天以上	合 計
預期信用損失率	2.00%	9.37%	16.41%	18.16%	
總帳面金額	\$ 102,233	\$ 10,134	\$ 17,974	\$ 7,775	\$ 138,116
備抵損失（存續期間 預期信用損失）	(<u>2,045</u>)	(<u>950</u>)	(<u>2,949</u>)	(<u>1,412</u>)	(<u>7,356</u>)
攤銷後成本	<u>\$ 100,188</u>	<u>\$ 9,184</u>	<u>\$ 15,025</u>	<u>\$ 6,363</u>	<u>\$ 130,760</u>

111 年 12 月 31 日

	1 ~ 90 天	91~180 天	181~270 天	271 天以上	合 計
預期信用損失率	0.66%	4.93%	12.11%	15.19%	
總帳面金額	\$ 218,512	\$ 53,943	\$ 1,379	\$ 5,069	\$ 278,903
備抵損失（存續期間 預期信用損失）	(<u>1,445</u>)	(<u>2,660</u>)	(<u>167</u>)	(<u>770</u>)	(<u>5,042</u>)
攤銷後成本	<u>\$ 217,067</u>	<u>\$ 51,283</u>	<u>\$ 1,212</u>	<u>\$ 4,299</u>	<u>\$ 273,861</u>

以上係以立帳日為基準進行之帳齡分析。

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	112年度	111年度
年初餘額	\$ 5,042	\$ 992
加：本年度提列減損損失	10,313	8,348
減：本年度重分類	(7,999)	(4,298)
年底餘額	<u>\$ 7,356</u>	<u>\$ 5,042</u>

催收款備抵損失之變動資訊如下：

	112年度	111年度
年初餘額	\$ 4,298	\$ 412
加：本年度重分類	7,999	4,298
減：本年度迴轉減損損失	(4,298)	(412)
年底餘額	<u>\$ 7,999</u>	<u>\$ 4,298</u>

九、存 貨

	112年12月31日	111年12月31日
原物料	\$ 34,475	\$ 54,365
半成品	213	-
在製品	530,993	552,196
	<u>\$ 565,681</u>	<u>\$ 606,561</u>

銷貨成本之性質如下：

	112年度	111年度
已銷售之存貨成本	\$ 612,435	\$ 592,610
存貨跌價及呆滯損失	9,505	4,557
存貨盤盈	(333)	(8)
其他	-	(85)
	<u>\$ 621,607</u>	<u>\$ 597,074</u>

十、子 公 司

列入合併財務報告之子公司

投資公司名稱	子 公 司 名 稱	業 務 性 質	所有權權益及表決權百分比		說 明
			112年12月31日	111年12月31日	
家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司(以下簡稱昇和精技公司)	各種精密儀器製造買賣、維修及保養	100%	100%	-

十一、採用權益法之投資

	112年12月31日	111年12月31日
個別不重大之關聯企業	<u>\$ 7,543</u>	<u>\$ -</u>

合併公司於112年6月28日董事長核准參與Gudeng Inc. 112年度現金增資案，112年9月30日以現金每股美金1元取得Gudeng Inc. 普通股208仟股，持股比例為4%，產生廉價購買利益1,512仟元。合併公司之母公司持有Gudeng Inc. 51%之額外股份，故合併公司對該公司具重大影響。

十二、不動產、廠房及設備

自 用	機器設備	辦公設備	運輸設備	其他設備	租賃改良	合 計
<u>成 本</u>						
112年1月1日餘額	\$ -	\$ 6,440	\$ 930	\$ 21,611	\$ -	\$ 28,981
增 添	59,365	1,270	-	2,200	8,525	71,360
處 分	-	(164)	-	-	-	(164)
重分類	-	-	-	-	2,000	2,000
112年12月31日餘額	<u>\$ 59,365</u>	<u>\$ 7,546</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 23,811</u>	<u>\$ 10,525</u>	<u>\$ 102,177</u>
<u>累計折舊</u>						
112年1月1日餘額	\$ -	\$ 4,817	\$ 729	\$ 8,014	\$ -	\$ 13,560
處 分	-	(164)	-	-	-	(164)
折舊費用	3,958	970	186	5,684	1,522	12,320
112年12月31日餘額	<u>\$ 3,958</u>	<u>\$ 5,623</u>	<u>\$ 915</u>	<u>\$ 13,698</u>	<u>\$ 1,522</u>	<u>\$ 25,716</u>
112年12月31日淨額	<u>\$ 55,407</u>	<u>\$ 1,923</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ 10,113</u>	<u>\$ 9,003</u>	<u>\$ 76,461</u>
<u>成 本</u>						
111年1月1日餘額	\$ -	\$ 5,700	\$ 930	\$ 13,949	\$ -	\$ 20,579
增 添	-	740	-	8,185	-	8,925
處 分	-	-	-	(523)	-	(523)
111年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,440</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 21,611</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 28,981</u>
<u>累計折舊</u>						
111年1月1日餘額	\$ -	\$ 3,894	\$ 543	\$ 3,735	\$ -	\$ 8,172
處 分	-	-	-	(523)	-	(523)
折舊費用	-	923	186	4,802	-	5,911
111年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,817</u>	<u>\$ 729</u>	<u>\$ 8,014</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,560</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,623</u>	<u>\$ 201</u>	<u>\$ 13,597</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15,421</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

機器設備	5年
辦公設備	3至5年
運輸設備	5年
其他設備	2至8年
租賃改良	2至4年

十三、租賃協議

(一) 使用權資產

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
使用權資產帳面金額		
建築物	\$ 36,203	\$ 20,668
運輸設備	<u>1,594</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 37,797</u>	<u>\$ 20,668</u>
	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
使用權資產之增添	<u>\$ 25,879</u>	<u>\$ 14,796</u>
使用權資產之折舊費用		
建築物	\$ 8,295	\$ 5,718
運輸設備	<u>455</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 8,750</u>	<u>\$ 5,718</u>

(二) 租賃負債

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
租賃負債帳面金額		
流動	<u>\$ 9,471</u>	<u>\$ 3,013</u>
非流動	<u>\$ 29,279</u>	<u>\$ 18,023</u>

租賃負債之折現率區間如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
建築物	1.7%	1.7%
運輸設備	1.7%	-

(三) 重要承租活動及條款

合併公司承租若干建築物做為廠房及辦公室，租賃期間為3至7年。於租賃期間終止時，合併公司對所租賃之建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，合併公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

合併公司承租若干運輸設備做為公務車使用，租賃期間為3年。

(四) 其他租賃資訊

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
短期租賃費用	<u>\$ 2,913</u>	<u>\$ 549</u>
租賃之現金(流出)總額	<u>(\$ 11,772)</u>	<u>(\$ 6,251)</u>

合併公司選擇對符合短期租賃之房屋建築及符合低價值租賃之辦公設備租賃適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

租賃期間於資產負債表日後開始之所有承租承諾如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
承諾承租	<u>\$ -</u>	<u>\$ 30,568</u>

十四、商 譽

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
<u>成 本</u>		
年初餘額	<u>\$ 45,057</u>	<u>\$ 45,057</u>
年底餘額	<u>\$ 45,057</u>	<u>\$ 45,057</u>
<u>累計減損損失</u>		
年初餘額	<u>(\$ 20,435)</u>	<u>(\$ 20,435)</u>
年底餘額	<u>(\$ 20,435)</u>	<u>(\$ 20,435)</u>
年初淨額	<u>\$ 24,622</u>	<u>\$ 24,622</u>
年底淨額	<u>\$ 24,622</u>	<u>\$ 24,622</u>

昇和精技公司之可回收金額係以使用價值為基礎決定，以合併公司管理階層核定未來5年財務預算之現金流量估計，並於112年及111年分別使用年折現率13.9%及14.3%予以計算。

經評估112年及111年度昇和精技公司之可回收金額大於帳面金額，故未認列減損損失。

十五、其他無形資產

	專 利 權	技 術	客 戶 關 係	電 腦 軟 體	合 計
<u>成 本</u>					
112年1月1日餘額	\$ 1,035	\$ 5,900	\$ 5,300	\$ -	\$ 12,235
單獨取得	-	-	-	1,247	1,247
處分	(1,035)	-	-	-	(1,035)
112年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 5,900</u>	<u>\$ 5,300</u>	<u>\$ 1,247</u>	<u>\$ 12,447</u>
<u>累計攤銷</u>					
112年1月1日餘額	\$ 949	\$ 1,685	\$ 5,300	\$ -	\$ 7,934
攤銷費用	86	843	-	140	1,069
處分	(1,035)	-	-	-	(1,035)
112年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,528</u>	<u>\$ 5,300</u>	<u>\$ 140</u>	<u>\$ 7,968</u>
112年12月31日淨額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,372</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,107</u>	<u>\$ 4,479</u>
<u>成 本</u>					
111年1月1日餘額	\$ 1,035	\$ 5,900	\$ 5,300	\$ -	\$ 12,235
111年12月31日餘額	<u>\$ 1,035</u>	<u>\$ 5,900</u>	<u>\$ 5,300</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,235</u>
<u>累計攤銷</u>					
111年1月1日餘額	\$ 776	\$ 843	\$ 2,650	\$ -	\$ 4,269
攤銷費用	173	842	2,650	-	3,665
111年12月31日餘額	<u>\$ 949</u>	<u>\$ 1,685</u>	<u>\$ 5,300</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,934</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 86</u>	<u>\$ 4,215</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,301</u>

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年限計提：

專 利 權	6年
技 術	7年
客 戶 關 係	2年
電 腦 軟 體 成 本	2至3年

	112年度	111年度
依功能別彙總攤銷費用		
營業成本	\$ 843	\$ 842
管理費用	140	2,650
研發費用	86	173
	<u>\$ 1,069</u>	<u>\$ 3,665</u>

十六、其他資產

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
預付款項		
預付貨款	\$ -	\$ 51,013
進項稅額	-	2,259
留抵稅額	2,664	-
其他預付費用	1,376	1,400
	<u>\$ 4,040</u>	<u>\$ 54,672</u>
其他流動資產		
暫付款	<u>\$ 39</u>	<u>\$ 78</u>
<u>非 流 動</u>		
其他非流動資產		
預付設備款	<u>\$ 3,106</u>	<u>\$ 2,000</u>

十七、應付帳款

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>應付帳款</u>		
因營業而發生－非關係人	<u>\$ 136,367</u>	<u>\$ 277,014</u>
因營業而發生－關係人	<u>\$ 19,777</u>	<u>\$ 1,689</u>

購買部分商品之平均賒帳期間為 1 至 3 個月，對應付帳款不加計利息。合併公司訂有財務風險管理政策，以確保所有應付款於預先約定之信用期限內償還。

十八、其他負債

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
其他應付款		
應付薪資及獎金	\$ 60,483	\$ 61,926
應付員工及董監酬勞	39,984	37,419
應付退休金	1,818	766
應付保險費	1,981	1,410
應付休假給付	958	3,896
應付設備款	553	-
其 他	8,257	7,574
	<u>\$ 114,034</u>	<u>\$ 112,991</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
其他應付款－關係人	<u>\$ 220</u>	<u>\$ 111</u>
其他負債		
暫收款	\$ -	\$ 223
代收款	<u>1,156</u>	<u>1,452</u>
	<u>\$ 1,156</u>	<u>\$ 1,675</u>

十九、負債準備

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>流動</u>		
保固	<u>\$ 29,250</u>	<u>\$ 26,618</u>

保固負債準備係依銷售商品合約約定，合併公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質之事件而進行調整。

二十、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

合併公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。合併公司112及111年度認列之退休金成本為5,817仟元及3,904仟元。

(二) 確定福利計畫

合併公司中之昇和公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算。該等公司按員工每月薪資總額2%提撥退休金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度3月底前將一次

提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，合併公司並無影響投資管理策略之權利。

列入合併公司資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	112年12月31日	111年12月31日
確定福利義務現值	\$ 5,151	\$ -
計畫資產公允價值	(37)	-
淨確定福利負債	<u>\$ 5,114</u>	<u>\$ -</u>

淨確定福利負債變動如下：

	確 定 福 利 計 畫 資 產 淨 確 定	義 務 現 值 公 允 價 值 福 利 負 債
112年1月1日	\$ -	\$ -
服務成本		
前期服務成本	<u>5,151</u>	<u>(37)</u>
認列於損益	<u>5,151</u>	<u>(37)</u>
112年12月31日	<u>\$ 5,151</u>	<u>(\$ 37)</u>

確定福利計畫認列於損益之金額依功能別彙總如下：

	112年度	111年度
管理費用	<u>\$ 5,114</u>	<u>\$ -</u>

合併公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟合併公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行2年定期存款利率計算而得之收益。
2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。
3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

合併公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
折現率	1.300%	-
薪資預期增加率	2.000%	-

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
折現率		
增加 0.25%	(\$ <u>85</u>)	\$ <u>-</u>
減少 0.25%	\$ <u>86</u>	\$ <u>-</u>
薪資預期增加率		
增加 0.25%	\$ <u>84</u>	\$ <u>-</u>
減少 0.25%	(\$ <u>83</u>)	\$ <u>-</u>

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
預期1年內提撥金額	\$ <u>64</u>	\$ <u>-</u>
確定福利義務平均到期期間	6年	-

二一、權益

(一) 普通股股本

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
額定股數（仟股）	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
額定股本	\$ <u>500,000</u>	\$ <u>500,000</u>
已發行且已收足股款之股數 （仟股）	<u>27,298</u>	<u>22,560</u>
已發行股本	\$ <u>272,976</u>	\$ <u>225,600</u>

本公司為調整資本結構，分別於112年4月7日及111年5月17日經股東會決議，以未分配盈餘47,376仟元及55,200仟元辦理轉增資發行新股，經報奉主管機關核准，並分別於112年5月12日及111年6月1日完成變更登記。

111年10月20日董事會決議現金增資發行新股60,000仟元，每股面額10元，並以每股新台幣22元溢價發行，增資後實收股本為225,600仟元。並經董事會決議，以111年10月24日為增資基準日。

(二) 資本公積

	112年12月31日	111年12月31日
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)</u>		
股票發行溢價	\$ 93,238	\$ 93,238
已失效員工認股權	<u>257</u>	<u>257</u>
	<u>\$ 93,495</u>	<u>\$ 93,495</u>

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二三之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於112年4月7日及111年5月17日舉行股東會，分別決議通過111及110年度盈餘分配案如下：

	<u>盈 餘 分 配 案</u>		<u>每 股 股 利 (元)</u>	
	111年度	110年度	111年度	110年度
法定盈餘公積	\$ 20,341	\$ 6,753	\$ -	\$ -
現金股利	45,120	-	2.00	-
股票股利	47,376	55,200	2.10	5.00

本公司 113 年 3 月 4 日董事會擬議 112 年度盈餘分配案如下：

	<u>盈餘分配案</u>	<u>每股股利(元)</u>
法定盈餘公積	\$ 22,824	\$ -
特別盈餘公積	385	-
現金股利	122,839	4.5

有關 112 年度之盈餘分配案尚待預計於 113 年 5 月 22 日召開之股東常會決議。

二二、收入

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
客戶合約收入		
商品銷貨收入	\$ 1,060,559	\$ 925,878
其他營業收入	<u>146,586</u>	<u>122,075</u>
	<u>\$ 1,207,145</u>	<u>\$ 1,047,953</u>

合約餘額

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>	<u>111年1月1日</u>
應收帳款	<u>\$ 130,760</u>	<u>\$ 273,861</u>	<u>\$ 77,665</u>
合約負債—預收貨款			
商品銷貨	\$ 762,289	\$ 589,091	\$ 399,838
其他	<u>4,299</u>	<u>27,557</u>	<u>37,848</u>
	<u>\$ 766,588</u>	<u>\$ 616,648</u>	<u>\$ 437,686</u>

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當年度認列為收入之金額如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
<u>來自年初合約負債</u>		
商品銷貨	\$ 492,067	\$ 383,728
其他	<u>27,557</u>	<u>31,122</u>
	<u>\$ 519,624</u>	<u>\$ 414,850</u>

二三、稅前淨利

(一) 利息收入

	112年度	111年度
銀行存款	\$ 10,509	\$ 1,057
押金設算息	25	12
	<u>\$ 10,534</u>	<u>\$ 1,069</u>

(二) 其他收入

	112年度	111年度
其他	<u>\$ 273</u>	<u>\$ 532</u>

(三) 其他利益及(損失)

	112年度	111年度
淨外幣兌換利益	\$ 5,735	\$ 11,777
租賃修改損失	-	(192)
廉價購買利益	1,512	-
其他	(8)	(18)
	<u>\$ 7,239</u>	<u>\$ 11,567</u>

(四) 財務成本

	112年度	111年度
銀行借款利息	\$ 39	\$ 11
租賃負債之利息	694	128
	<u>\$ 733</u>	<u>\$ 139</u>

(五) 折舊及攤銷

	112年度	111年度
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 5,996	\$ 5,426
營業費用	15,074	6,203
	<u>\$ 21,070</u>	<u>\$ 11,629</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 843	\$ 842
營業費用	226	2,823
	<u>\$ 1,069</u>	<u>\$ 3,665</u>

(六) 員工福利費用

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
退職後福利		
確定提撥計畫 (附註二十)	\$ 5,817	\$ 3,904
確定福利計畫 (附註二十)	<u>5,156</u>	<u>-</u>
	10,973	3,904
股份基礎給付		
權益交割 (附註二六)	-	2,038
其他員工福利	<u>247,067</u>	<u>204,228</u>
員工福利費用合計	<u>\$ 258,040</u>	<u>\$ 210,170</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 67,143	\$ 57,474
營業費用	<u>190,897</u>	<u>152,696</u>
	<u>\$ 258,040</u>	<u>\$ 210,170</u>

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董監事酬勞前之稅前利益分別以 3% 以上及不高於 3% 提撥員工酬勞及董監事酬勞。112 及 111 年度估列之員工酬勞及董監事酬勞分別於 113 年 3 月 4 日及 112 年 2 月 20 日經董事會決議如下：

估列比例

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
員工酬勞	10%	10%
董監事酬勞	2.5%	2.5%

金 額

	<u>112年度</u>		<u>111年度</u>	
	現	金	現	金
員工酬勞	\$ 31,587		\$ 28,691	
董監事酬勞		7,897		7,172

年度財務報表通過發佈日後若金額有變動，則依會計估計變動處理，於下一年度調整入帳。

111 及 110 年度員工酬勞及董監事酬勞董事會決議之實際配發金額與 111 及 110 年度財務報表之認列金額並無差異。

有關本公司董事會決議之員工酬勞及董監事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二四、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
當期所得稅		
本年度產生者	\$ 63,517	\$ 55,411
未分配盈餘加徵	3,303	-
以前年度之調整	(4,947)	(2)
投資抵減	<u>(4,945)</u>	<u>-</u>
	<u>56,928</u>	<u>55,409</u>
遞延所得稅		
本年度產生者	(7,856)	(3,477)
以前年度之調整	<u>-</u>	<u>11</u>
	<u>(7,856)</u>	<u>(3,466)</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 49,072</u>	<u>\$ 51,943</u>

會計所得與當期所得稅費用之調節如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
稅前淨利	<u>\$ 277,315</u>	<u>\$ 255,358</u>
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$ 55,463	\$ 51,072
稅上不可減除之費損	198	856
未分配盈餘加徵	3,303	-
暫時性差異產生之稅額影響	-	6
以前年度之遞延所得稅費用於本年度之調整	-	11
以前年度之當期所得稅費用於本年度之調整	(4,947)	(2)
投資抵減	<u>(4,945)</u>	<u>-</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 49,072</u>	<u>\$ 51,943</u>

(二) 本期所得稅資產及負債

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
本期所得稅資產		
應收退稅款	<u>\$ 205</u>	<u>\$ -</u>
本期所得稅負債		
應付所得稅	<u>\$ 35,849</u>	<u>\$ 43,810</u>

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

112 年度

	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認 列 於 損 益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>			
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 1,482	\$ 1,897	\$ 3,379
未實現兌換損益	-	530	530
應付休假給付	779	(587)	192
備抵損失	1,296	1,489	2,785
保固損失	4,947	870	5,817
確定福利退休計畫	-	1,022	1,022
	<u>\$ 8,504</u>	<u>\$ 5,221</u>	<u>\$ 13,725</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>			
暫時性差異			
未實現兌換損益	(\$ 2,937)	\$ 2,937	\$ -
廉價購買利益	-	(302)	(302)
	<u>(\$ 2,937)</u>	<u>\$ 2,635</u>	<u>(\$ 302)</u>

111 年度

	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認 列 於 損 益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>			
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 571	\$ 911	\$ 1,482
未實現兌換損益	835	(835)	-
應付休假給付	549	230	779
備抵損失	135	1,161	1,296
保固損失	-	4,947	4,947
	<u>\$ 2,090</u>	<u>\$ 6,414</u>	<u>\$ 8,504</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>			
暫時性差異			
未實現兌換損益	\$ -	(\$ 2,937)	(\$ 2,937)

(四) 所得稅核定情形

本公司及昇和精技公司之營利事業之所得稅申報，除 111 年度外，截至 110 年度以前之申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二五、每股盈餘

單位：每股元

	112年度	111年度
基本每股盈餘	<u>\$ 8.36</u>	<u>\$ 9.84</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 7.96</u>	<u>\$ 9.13</u>

計算每股盈餘時，無償配股之影響業已追溯調整，該無償配股基準日訂於112年5月6日。因追溯調整，111年度基本及稀釋每股盈餘變動如下：

單位：每股元

	追 溯 調 整 前	追 溯 調 整 後
基本每股盈餘	<u>\$ 11.91</u>	<u>\$ 9.84</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 11.06</u>	<u>\$ 9.13</u>

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	112年度	111年度
用以計算基本每股盈餘之淨利	<u>\$ 228,243</u>	<u>\$ 203,415</u>
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	<u>\$ 228,243</u>	<u>\$ 203,415</u>

股 數

單位：仟股

	112年度	111年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	27,298	20,674
具稀釋作用潛在普通股之影響： 員工酬勞	<u>1,374</u>	<u>1,597</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	<u>28,672</u>	<u>22,271</u>

若合併公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二六、股份基礎給付協議

員工認股權計畫

本公司於 111 年 10 月給與員工認股權 600 仟股，給與對象為本公司之員工。

員工認股權之相關資訊如下：

員 工 認 股 權	111年度	
	單 位 (仟)	加 權 平 均 行 使 價 格 (元)
年初流通在外	-	\$ -
本年度給與	600	22
本年度行使	(600)	
年底流通在外	-	
年底可行使	-	
本年度給與之認股權加權平均 公允價值 (元)	\$ 3.3963	

於 111 年度行使之員工認股權，其於行使日之加權平均股價為 22 元。

本公司於 111 年 10 月給與之員工認股權均使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

	111年10月
給與日市價	25.23 元
執行價格	22 元
預期波動率	39.61%
存續期間	30 天
預期股利率	0%
無風險利率	1.157%

111 年度認列之酬勞成本為 2,038 仟元。

二七、現金流量資訊

(一) 非現金交易

除已於其他附註揭露外，合併公司於 112 年度進行下列非現金交易之投資活動：

合併公司取得不動產、廠房及設備價款截至 112 年 12 月 31 日尚未支付，帳列其他應付款 553 仟元。

(二) 來自籌資活動之負債變動

112年1月1日至12月31日

租賃負債	112年1月1日	現金流量	非現金之變動			其他	112年12月31日
	\$ 21,036	(\$ 8,165)	新增租賃	財務成本			\$ 38,750
			\$ 25,879	\$ 694	(\$ 694)		

111年1月1日至12月31日

租賃負債	111年1月1日	現金流量	非現金之變動			其他	111年12月31日
	\$ 3,965	(\$ 5,574)	新增租賃	財務成本	租賃修改		\$ 21,036
			\$ 14,796	\$ 128	\$ 7,849	(\$ 128)	

二八、資本風險管理

合併公司目前營運穩定，資本風險管理目標為確保能夠在繼續經營與成長前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。

合併公司採用審慎之風險管理策略並定期審核，依業務發展策略及營運需求做整體性規劃，以決定合併公司適當之資本結構。

二九、金融工具

(一) 公允價值資訊－非按公允價值衡量之金融工具

合併公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 金融工具之種類

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產(註1)	\$ 1,143,016	\$ 918,271
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量(註2)	271,554	393,480

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款(含關係人)、其他應收款、按攤銷後成本衡量之金融資產及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款(含關係人)、其他應付款(含關係人)及其他流動負債等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(三) 財務風險管理目的與政策

合併公司主要金融工具包括現金及約當現金、應收帳款及應付帳款。上述金融工具與營運有關之財務風險。(包含匯率風險及利率風險)、信用風險及流動性風險。

1. 市場風險

合併公司之營運活動使合併公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險(參閱下述(1))以及利率變動風險(參閱下述(2))。

合併公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

合併公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使合併公司產生匯率變動暴險。

合併公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額(包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目)，參閱附註三三。

敏感度分析

合併公司主要受到美元及日幣波動之影響。

下表詳細說明當新台幣(功能性貨幣)對各攸關外幣之匯率增加及減少1%時，合併公司之敏感性分析如下。1%係為集團內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。

	美金貨幣之影響		日幣貨幣之影響	
	112年度	111年度	112年度	111年度
損益	\$ 3,354	\$ 3,504(i)	\$ 39	\$ 226(ii)

(i) 主要源自於合併公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之美金貨幣計價銀行存款及應收款項。

(ii) 主要源自於合併公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之日幣貨幣計價銀行存款、應收款項及應付款項。

(2) 利率風險

因合併公司之銀行存款、按攤銷後成本衡量之金融資產及租賃負債包含固定及浮動利率計息，因而產生利率暴險。

合併公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	112年12月31日	111年12月31日
具公允價值利率風險		
— 金融資產	\$ 214,116	\$ 20,000
— 金融負債	38,750	21,036
具現金流量利率風險		
— 金融資產	793,491	623,173
— 金融負債	-	-

敏感度分析

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之負債金額於報導期間皆流通在外。集團內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 25 基點，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加／減少 25 基點，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司 112 及 111 年度之稅前淨利將分別增加／減少 1,984 仟元及 1,558 仟元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成合併公司財務損失之風險。截至資產負債表日，合併公司可能因交易對方未履行義務及合併公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於：

- (1) 合併資產負債表所認列之金融資產帳面金額。
- (2) 合併公司提供財務保證所產生之或有負債金額。

合併公司採行之政策係僅與信譽卓著之對象進行交易，並於必要情形下取得足額之擔保以減輕因拖欠所產生財務損失之風險。為減輕信用風險，合併公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，合併公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為合併公司之信用風險已顯著減少。故該信用風險係屬有限。

合併公司之信用風險主要係集中於合併公司當年度最大客戶，截至 112 年及 111 年 12 月 31 日止，總應收帳款來自前述客戶之比率分別 26% 及 11%。

3. 流動性風險

合併公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。合併公司管理階層監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合同條款之遵循。

合併公司未動用之融資額度，參閱下列(2)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依合併公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

112 年 12 月 31 日

	短於 1 年	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年 以 上	合 計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 156,144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156,144
其他應付款	114,254	-	-	-	114,254
租賃負債	10,065	10,122	8,579	11,443	40,209
其他流動負債	1,156	-	-	-	1,156
	<u>\$ 281,619</u>	<u>\$ 10,122</u>	<u>\$ 8,579</u>	<u>\$ 11,443</u>	<u>\$ 311,763</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~2年	2~3年	3~5年	5年以上
租賃負債	\$ 10,065	\$ 10,122	\$ 8,579	\$ 11,443	\$ -

111年12月31日

	短於1年	1至2年	2至3年	3年以上	合計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 278,703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,703
其他應付款	113,102	-	-	-	113,102
租賃負債	3,349	3,479	3,537	11,821	22,186
其他流動負債	1,675	-	-	-	1,675
	\$ 396,829	\$ 3,479	\$ 3,537	\$ 11,821	\$ 415,666

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~2年	2~3年	3~5年	5年以上
租賃負債	\$ 3,349	\$ 3,479	\$ 3,537	\$ 7,881	\$ 3,940

(2) 融資額度

	112年12月31日	111年12月31日
無擔保銀行借款額度 (雙方同意下得展期)		
— 已動用金額	\$ -	\$ -
— 未動用金額	130,000	50,000
	\$ 130,000	\$ 50,000

三十、關係人交易

本公司之母公司為公司家登精密工業股份有限公司，於112及111年持有本公司普通股分別為46.83%及50.10%。

本公司及子公司（係本公司之關係人）間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，合併公司與其他關係人間之交易如下。

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
家登精密工業股份有限公司（以下簡稱家登公司）	母公司
Gudeng Inc.（以下簡稱家登美國公司）	關聯企業
家崎科技股份有限公司（以下簡稱家崎公司）	兄弟公司
上海家登貿易有限公司（以下簡稱上海家登公司）	兄弟公司
垚鉸系統科技股份有限公司（以下簡稱垚鉸公司）	實質關係人
鍊恩帕斯科技股份有限公司（以下簡稱鍊恩帕斯公司）	實質關係人

(二) 營業收入

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年度	111年度
銷貨收入	家登公司	\$ 367	\$ 1,672
	上海家登公司	58	-
		<u>\$ 425</u>	<u>\$ 1,672</u>

合併公司對關係人之銷貨價格與一般客戶相當。

(三) 進 貨

關 係 人 名 稱	112年度	111年度
家登公司	\$ 10,578	\$ 10,353
家登美國公司	-	105
家崎公司	231	-
壺鎡公司	19,882	-
鍊恩帕斯公司	<u>33,350</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 64,041</u>	<u>\$ 10,458</u>

合併公司進貨之商品主要係屬客製化規格之產品，並無可比較對象。

(四) 應收關係人款項

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年12月31日	111年12月31日
應收帳款－關係人	家登公司	<u>\$ -</u>	<u>\$ 101</u>

流通在外之應收關係人款項未收取保證。111年度應收關係人款項並未提列預期信用減損損失。

(五) 應付關係人款項

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年12月31日	111年12月31日
應付帳款－關係人	家登公司	\$ 2,046	\$ 1,689
	壺鎡公司	3,344	-
	鍊恩帕斯公司	<u>14,387</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 19,777</u>	<u>\$ 1,689</u>
其他應付款－關係人	家登公司	<u>\$ 220</u>	<u>\$ 111</u>

流通在外之應付關係人款項餘額係未提供擔保。

(六) 取得之不動產、廠房及設備

關 係 人 名 稱	取 得 價 款	
	112年度	111年度
家登公司	\$ 1,340	\$ -

(七) 承租協議

關 係 人 名 稱	112年度	111年度
<u>取得使用權資產</u> 家登公司	\$ 17,045	\$ -

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年12月31日	111年12月31日
租賃負債	家登公司	\$ 13,754	\$ -

關 係 人 名 稱	112年度	111年度
<u>利息費用</u> 家登公司	\$ 271	\$ 35

合併公司於112年1月1日向家登公司承租建築物做為廠房及辦公室使用，租賃期間均為5年，租金係參考類似資產之租金水準，並依租約按月支付固定租賃給付。

(八) 取得其他資產

關係人類別／名稱	帳 列 項 目	取 得 價 款	
		112年度	111年度
家登美國公司	採用權益法之投資	\$ 6,448	\$ -

合併公司參與家登美國公司112年度現金增資案，產生廉價購買利益1,512仟元。

(九) 其他關係人交易

1. 租金支出

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年度	111年度
營業費用	家登公司	\$ 20	\$ 12
	家登美國公司	62	-
		\$ 82	\$ 12
製造費用	家登公司	\$ -	\$ 11

租金係依一般市場行情簽訂契約，並依租約按月支付。

2. 其他費用

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年度	111年度
營業費用	家登公司	\$ 1,789	\$ 302
	家登美國公司	166	-
	上海家登公司	89	-
		<u>\$ 2,044</u>	<u>\$ 302</u>
製造費用	家登公司	<u>\$ 1,280</u>	<u>\$ 488</u>

3. 其他收入

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年度	111年度
利息收入	家登公司	<u>\$ 9</u>	<u>\$ 9</u>

4. 其他資產及負債

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年12月31日	111年12月31日
存出保證金	家登公司	<u>\$ 596</u>	<u>\$ 669</u>
合約負債	家登公司	\$ 13,500	\$ 96
	上海家登	<u>18,419</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 31,919</u>	<u>\$ 96</u>

(十) 主要管理階層薪酬

	112年度	111年度
短期員工福利	\$ 55,698	\$ 43,969
股份基礎給付	-	2,038
	<u>\$ 55,698</u>	<u>\$ 46,007</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會（於 112 年 5 月 31 日設置）依照個人績效及市場趨勢決定。

三一、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，合併公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

重大承諾

合併公司未認列之合約承諾如下：

	112年12月31日	111年12月31日
購置不動產、廠房及設備	<u>\$ 1,155</u>	<u>\$ 6,018</u>

三二、重大之期後事項：無。

三三、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按合併公司各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債如下：

112年12月31日

<u>外幣資產</u>	<u>外</u>	<u>幣</u>	<u>匯</u>	<u>率</u>	<u>帳</u>	<u>面</u>	<u>金</u>	<u>額</u>
<u>貨幣性項目</u>								
美 元	\$ 10,922		30.705 (美元：新台幣)					\$ 335,361
日 圓	37,149		0.2172 (日圓：新台幣)					8,069
歐 元	35		33.98 (歐元：新台幣)					1,175
								<u>\$ 344,605</u>

非貨幣性項目

採權益法之關聯
企業

美 元	246		30.705 (美元：新台幣)					\$ 7,543
-----	-----	--	-----------------	--	--	--	--	----------

外幣負債

貨幣性項目

日 圓	19,000		0.2172 (日圓：新台幣)					\$ 4,127
歐 元	8		33.98 (歐元：新台幣)					285
								<u>\$ 4,412</u>

111年12月31日

<u>外幣資產</u>	<u>外</u>	<u>幣</u>	<u>匯</u>	<u>率</u>	<u>帳</u>	<u>面</u>	<u>金</u>	<u>額</u>
<u>貨幣性項目</u>								
美 元	\$ 11,409		30.71 (美元：新台幣)					\$ 350,358
日 圓	97,341		0.2324 (日圓：新台幣)					22,622
歐 元	34		32.72 (歐元：新台幣)					1,112
								<u>\$ 374,092</u>

具重大影響之外幣兌換損益（未實現）如下：

外 幣	112年度		111年度	
	匯 率	淨兌換(損)益	匯 率	淨兌換(損)益
美 元	30.705 (美元：新台幣)	(\$ 2,357)	30.71 (美元：新台幣)	\$ 15,870
日 圓	0.2172 (日圓：新台幣)	(291)	0.2324 (日圓：新台幣)	(1,149)
歐 元	33.98 (歐元：新台幣)	35	32.72 (歐元：新台幣)	(2)
		<u>(\$ 2,613)</u>		<u>\$ 14,719</u>

三四、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊及(二)轉投資事業相關資訊：

編號	項	目	說	明
1	資金貸與他人。			無
2	為他人背書保證。			無
3	期末持有有價證券情形。(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)			無
4	累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。			無
5	取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。			無
6	處分不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。			無
7	與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元或實收資本額20%以上。			無
8	應收關係人款項達1億元或實收資本額20%以上。			無
9	從事衍生性商品交易。			無
10	其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。			附表二
11	被投資公司資訊			附表一

(三) 大陸投資資訊

編號	項	目	說	明
1	大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本期損益及認列之投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。			無
2	與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：			
	(1)進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比。			無
	(2)銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比。			無
	(3)財產交易金額及其所產生之損益數額。			無
	(4)票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的。			無
	(5)資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額。			無
(6)其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等。			無	

(四) 主要股東資訊：股權比例達5%以上之股東名稱、持股數額及比例。

(附表三)

三五、營運部門

合併公司係以單一營運部門進行組織管理及分配資源，營運活動均與精密儀器之買賣、維修及保養業務相關。故合併公司被單獨視為一應報導部門，提供營運決策者之個別部門資訊基礎係與財務報表一致，部門於 112 及 111 年度之營運收入及營運成果可參照合併財務報表中之綜合損益表；部門總資產及總負債衡量方式係與資產負債表一致。

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司
被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：除股數外，為新台幣及外幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期 末 持 有 股 數	比 率 (%)	帳 面 金 額	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備 註
				本 期 期 末	去 年 年 底						
家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司	新竹縣竹北市復興三路二段 106 號	半導體與面板的 PVD 真空技術相 關機台設計及改造	\$ 70,000	\$ 70,000	3,451,424	100	\$ 69,897	\$ 3,576	\$ 2,733	註 1 及 2
家碩科技股份有限公司	Gudeng Inc.	1798 Technology DR, #298 San Jose, CA, 95110	經營各種電子零組件業務	USD 208 (6,448)	USD -	208,000	4	7,543	USD 558 (17,050)	(32)	註 1

註 1：被投資公司本期（損）益及本期認列之投資（損）益係經會計師查核之金額。

註 2：於編製合併財務報告時，業已合併沖銷。

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）及子公司

母子公司間業務關係及重要交易往來情形

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

編號 (註 1)	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係 (註 2)	交易往來情形			佔合併總營收或 總資產之比率 (註 3)
				科目	金額	交易條件	
0	家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司	1	進貨	\$ 2,799	註 4	—
0	家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司	1	應付帳款—關係人	542	註 4	—
0	家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司	1	租金收入	720	註 4	—

註 1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

1. 母公司填 0。
2. 子公司依公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可：

1. 母公司對子公司。
2. 子公司對母公司。
3. 子公司對子公司。

註 3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債科目者，以期末餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益科目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註 4：係依雙方議定條件決定。

註 5：此附表僅揭露單向交易資訊，於編制合併報表時，業已沖銷上述交易。

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

主要股東資訊

民國 112 年 12 月 31 日

附表三

主 要 股 東 名 稱	股 份	
	持 有 股 數	持 股 比 例
家登精密工業股份有限公司	12,782,268	46.83%
士大投資有限公司	1,713,422	6.28%
詹 印 豐	1,503,771	5.51%

註 1：本表主要股東資訊係以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5% 以上資料。本公司合併財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

附件三

111 年度個體財務報告暨會計師查核報告

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

個體財務報告暨會計師查核報告
民國111及110年度

地址：新北市土城區中央路4段2號8樓之5

電話：(02)22689141

§ 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、會計師查核報告	3~5		-
四、個體資產負債表	6		-
五、個體綜合損益表	7~8		-
六、個體權益變動表	9		-
七、個體現金流量表	10~11		-
八、個體財務報表附註			
(一) 公司沿革	12		一
(二) 通過財務報告之日期及程序	12		二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	12~16		三
(四) 重大會計政策之彙總說明	16~24		四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	25		五
(六) 重要會計項目之說明	25~45		六~二六
(七) 關係人交易	45~47		二七
(八) 重大或有負債及未認列之合約承諾	47		二八
(九) 重大之災害損失	-		-
(十) 重大之期後事項	47		二九
(十一) 其 他	47~48		三十
(十二) 附註揭露事項			
1. 重大交易事項相關資訊	48、50		三一
2. 轉投資事業相關資訊	48、50		三一
3. 大陸投資資訊	49		三一
(十三) 部門資訊	-		-
九、重要會計項目明細表	51~62		-

會計師查核報告

家碩科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達家碩科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與家碩科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估家碩科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算家碩科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

家碩科技股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對家碩科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使家碩科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意

見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致家碩科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於家碩科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責家碩科技股份有限公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成家碩科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 曾建銘



曾建銘

會計師 王攀發



王攀發

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 112 年 3 月 8 日

聚隆洋行有限公司
(原名：三信洋行有限公司)

民國三十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 578,860	36	\$ 324,962	35
1170	應收帳款-非關係人(附註四、七及二十)	266,313	17	39,775	7
1180	應收帳款-關係人(附註四、七、二十及二七)	101	-	-	-
1200	其他應收款(附註七)	14	-	-	-
130X	存貨(附註四及八)	601,292	37	443,184	48
1410	預付款項(附註十三)	54,660	3	22,153	2
1470	其他流動資產(附註十四)	78	-	-	-
11XX	流動資產總計	<u>1,501,318</u>	<u>93</u>	<u>850,074</u>	<u>92</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四及九)	67,164	4	54,282	6
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十)	15,185	1	12,004	1
1755	使用權資產(附註四、十一及二七)	20,668	1	3,933	-
1780	無形資產(附註四及十二)	86	-	259	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	8,504	1	2,090	-
1920	存出保證金(附註二七)	1,117	-	1,177	-
1900	其他非流動資產(附註十四及二八)	2,000	-	4,600	1
15XX	非流動資產總計	<u>114,724</u>	<u>7</u>	<u>78,345</u>	<u>8</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,616,042</u>	<u>100</u>	<u>\$ 928,419</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債(附註二十及二七)	\$ 589,091	36	\$ 399,838	43
2170	應付帳款-非關係人(附註十五)	276,811	17	205,268	22
2180	應付帳款-關係人(附註十五及二七)	1,689	-	1,487	-
2200	其他應付款-非關係人(附註十六)	106,937	7	62,866	7
2220	其他應付款項-關係人(附註十六及二七)	111	-	904	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二二)	40,817	3	11,558	1
2250	負債準備-流動(附註四及十七)	24,736	2	28,246	3
2280	租賃負債-流動(附註四、十一及二七)	3,013	-	3,965	1
2399	其他流動負債(附註十六)	1,308	-	1,171	-
21XX	流動負債總計	<u>1,044,513</u>	<u>65</u>	<u>715,303</u>	<u>77</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	2,937	-	-	-
2580	租賃負債-非流動(附註四及十一)	18,023	1	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>20,960</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>1,065,473</u>	<u>66</u>	<u>715,303</u>	<u>77</u>
	權益(附註十九)				
3110	普通股股本	225,600	14	110,400	12
3200	資本公積	93,495	6	19,457	2
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	17,716	1	10,963	1
3350	未分配盈餘	213,758	13	72,296	8
3300	保留盈餘總計	231,474	14	83,259	9
3XXX	權益總計	<u>550,569</u>	<u>34</u>	<u>213,116</u>	<u>23</u>
	負債與權益總計	<u>\$1,616,042</u>	<u>100</u>	<u>\$ 928,419</u>	<u>100</u>

後附之附註係本報財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家碩科技股份有限公司
(原名：家登資訊科技股份有限公司)

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四、二十及 二七)				
4100	銷貨收入	\$ 989,427	100	\$ 551,551	100
5000	營業成本 (附註八、二一及 二七)	(582,211)	(59)	(364,433)	(66)
5900	營業毛利	407,216	41	187,118	34
	營業費用 (附註十八、二一 及二七)				
6100	推銷費用	44,504	4	27,215	5
6200	管理費用	65,300	7	32,711	6
6300	研究發展費用	64,158	6	25,815	5
6450	預期信用減損損失 (迴 轉利益)	8,011	1	(4,450)	(1)
6000	營業費用合計	181,973	18	81,291	15
6900	營業淨利	225,243	23	105,827	19
	營業外收入及支出 (附註二 一)				
7100	利息收入 (附註二七)	963	-	30	-
7190	其他收入 (附註二七)	751	-	3	-
7020	其他利益及損失	11,351	1	(22,086)	(4)
7050	財務成本 (附註二七)	(139)	-	(117)	-
7060	採用權益法之子公司損 益份額	12,882	2	4,717	1
7000	營業外收入及支出 合計	25,808	3	(17,453)	(3)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
7900 稅前淨利	\$ 251,051	26	\$ 88,374	16
7950 所得稅費用(附註四及二二)	(47,636)	(5)	(20,842)	(4)
8200 本年度淨利	<u>\$ 203,415</u>	<u>21</u>	<u>\$ 67,532</u>	<u>12</u>
	每股盈餘(附註二三)			
9710 基 本	<u>\$ 11.91</u>		<u>\$ 4.08</u>	
9810 稀 釋	<u>\$ 11.06</u>		<u>\$ 3.85</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家鄉莊建設股份有限公司
(原名：家鄉莊建設有限公司)

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股 本		保 留 盈 餘		權 益 總 額
		實 收 資 本	公 積 金	法定盈餘公積	未分配盈餘	
A1	110年1月1日餘額	\$ 55,200	\$ 19,457	\$ 4,597	\$ 66,330	\$ 145,584
	109年度盈餘指撥及分配					
B1	法定盈餘公積	-	-	6,366	(6,366)	-
B9	股東股票股利	55,200	-	-	(55,200)	-
D1	110年度淨利	-	-	-	67,532	67,532
Z1	110年12月31日餘額	110,400	19,457	10,963	72,296	213,116
	110年度盈餘指撥及分配					
B1	法定盈餘公積	-	-	6,753	(6,753)	-
B9	股東股票股利	55,200	-	-	(55,200)	-
N1	本公司發行員工認股權	-	2,038	-	-	2,038
E1	現金增資	60,000	72,000	-	-	132,000
D1	111年度淨利	-	-	-	203,415	203,415
Z1	111年12月31日餘額	\$ 225,600	\$ 93,495	\$ 17,716	\$ 213,758	\$ 550,569

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家碩科技股份有限公司
 (原名：家碩自動控制股份有限公司)

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 251,051	\$ 88,374
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,462	7,475
A20200	攤銷費用	173	172
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	8,011	(4,450)
A20900	財務成本	139	117
A21200	利息收入	(963)	(30)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,038	-
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	(12,882)	(4,717)
A23500	減損損失	-	20,435
A23700	存貨跌價損失(回升利益)	4,557	(1,197)
A29900	租賃修改損失(利益)	192	(5)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(214,650)	(5,587)
A31180	其他應收款	(14)	-
A31200	存 貨	(162,665)	(194,859)
A31230	預付款項	(32,507)	(4,513)
A31240	其他流動資產	(78)	-
A32150	應付帳款	71,745	107,737
A32180	其他應付款	43,278	15,679
A32200	負債準備	(3,510)	4,327
A32210	合約負債	189,253	138,710
A32230	其他流動負債	137	364
A33000	營運產生之現金	154,767	168,032
A33200	收取之利息	963	30
A33300	支付之利息	(139)	(117)
A33500	支付之所得稅	(21,854)	(23,122)
AAAA	營業活動之淨現金流入	133,737	144,823

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 8,925)	(\$ 2,111)
B03700	存出保證金增加	-	(223)
B03800	存出保證金減少	60	-
B07100	預付設備款減少(增加)	<u>2,600</u>	<u>(4,600)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(6,265)</u>	<u>(6,934)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(5,574)	(4,463)
C04600	現金增資	<u>132,000</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>126,426</u>	<u>(4,463)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	253,898	133,426
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>324,962</u>	<u>191,536</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 578,860</u>	<u>\$ 324,962</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



家碩科技股份有限公司

(原名：家登自動化股份有限公司)

個體財務報表附註

民國 111 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革及營業

家碩科技股份有限公司(以下稱「本公司」)，係於 105 年 7 月 18 日設立，於新北市之股份有限公司，並於同年 7 月開始營業。所營業務主要為各種精密儀器之買賣、維修及保養業務。

本公司原名「家登自動化股份有限公司」，經 112 年 1 月 31 日臨時股東會決議更名為「家碩科技股份有限公司」，並於 112 年 2 月 10 日經新北市政府核准。

本財務報表係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於 112 年 2 月 20 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱「IFRSs」)

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動。

- (二) 112 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
IAS1 之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日(註 1)
IAS8 之修正「會計估計值之定義」	2023 年 1 月 1 日(註 2)
IAS12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023 年 1 月 1 日(註 3)

註 1：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間適用此項修正。

註 2：於 2023 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計值變動及會計政策變動適用此項修正。

註 3：除於 2022 年 1 月 1 日就租賃及除役義務之暫時性差異認列遞延所得稅外，該修正係適用於 2022 年 1 月 1 日以後所發生之交易。

1. IAS 1 之修正「會計政策之揭露」

該修正明訂本公司應依重大之定義，決定應揭露之重大會計政策資訊。若會計政策資訊可被合理預期將影響一般用途財務報表之主要使用者以該等財務報表為基礎所作之決策，則該會計政策資訊係屬重大。該修正並釐清：

- 與不重大之交易、其他事項或情況相關之會計政策資訊係屬不重大，本公司無需揭露該等資訊。
- 本公司可能因交易、其他事項或情況之性質而判斷相關會計政策資訊屬重大，即使金額不重大亦然。
- 並非與重大交易、其他事項或情況相關之所有會計政策資訊皆屬重大。

此外，該修正並舉例說明若會計政策資訊係與重大交易、其他事項或情況相關，且有下列情況時，該資訊可能屬重大：

- (1) 本公司於報導期間改變會計政策，且該變動導致財務報表資訊之重大變動；
- (2) 本公司自準則允許之選項中選擇其適用之會計政策；
- (3) 因缺乏特定準則之規定，本公司依 IAS 8「會計政策、會計估計值變動及錯誤」建立之會計政策；
- (4) 本公司揭露其須運用重大判斷或假設所決定之相關會計政策；或
- (5) 涉及複雜之會計處理規定且財務報表使用者仰賴該等資訊方能了解該等重大交易、其他事項或情況。

2. IAS 8 之修正「會計估計值之定義」

該修正明訂會計估計值係指財務報表中受衡量不確定性影響之貨幣金額。本公司於適用會計政策時，可能須以無法直接

觀察而必須估計之貨幣金額衡量財務報表項目，故須採用衡量技術及輸入值發展會計估計值以達此目的。衡量技術或輸入值變動對會計估計值之影響數若非屬前期錯誤之更正，該等變動係屬會計估計值變動。

3. IAS 12 之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

該修正釐清，原始認列時產生相同金額之應課稅及可減除暫時性差異之交易，不適用 IAS 12 原始認列之豁免規定。本公司將於 111 年 1 月 1 日就與租賃及除役義務有關之所有可減除及應課稅暫時性差異認列遞延所得稅資產(若很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異使用)及遞延所得稅負債，並於該日將累積影響數認列為保留盈餘初始餘額之調整。對租賃及除役義務以外之交易則自 111 年 1 月 1 日以後發生者推延適用該修正。

除上述影響外，截至本財務報告通過發布日止，本公司評估其他準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未定
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024 年 1 月 1 日 (註 2)
IFRS 17 「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日

註 1：除另註明外，上述新發布 / 修正 / 修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：賣方兼承租人應對初次適用 IFRS 16 日後簽訂之售後租回交易追溯適用 IFRS 16 之修正。

1. IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」

該修正規定，若本公司出售或投入資產予關聯企業（或合資），或本公司喪失對子公司之控制，但保留對該子公司之重大影響（或聯合控制），若前述資產或前子公司符合 IFRS 3「企業合併」對「業務」之定義時，本公司係全數認列該等交易產生之損益。

此外，若本公司出售或投入資產予關聯企業（或合資），或本公司在與關聯企業（或合資）之交易中喪失對子公司之控制，但保留對該子公司之重大影響（或聯合控制），若前述資產或前子公司不符合 IFRS 3「業務」之定義時，本公司僅在與投資者對該等關聯企業（或合資）無關之權益範圍內認列該交易所產生之損益，亦即，屬本公司對該損益之份額者應予以銷除。

2. IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」（2020 年修正）及「具合約條款之非流動負債」（2022 年修正）

2020 年修正係釐清判斷負債是否分類為非流動時，應評估本公司於報導期間結束日是否具有遞延清償期限至報導期間後至少 12 個月之權利。若本公司於報導期間結束日具有該權利，無論本公司是否預期將行使該權利，負債係分類為非流動。

2020 年修正另規定，若本公司須遵循特定條件始具有遞延清償負債之權利，本公司必須於報導期間結束日已遵循特定條件，即使貸款人係於較晚日期測試本公司是否遵循該等條件亦然。2022 年修正進一步釐清，僅有報導期間結束日以前須遵循之合約條款會影響負債之分類。報導期間後 12 個月內須遵循之合約條款雖不影響負債之分類，惟須揭露相關資訊，俾使財務報告使用者了解本公司可能無法遵循合約條款而須於報導期間後 12 個月內還款之風險。

2020 年修正規定，為負債分類之目的，前述清償係指移轉現金、其他經濟資源或本公司之權益工具予交易對方致負債之

消滅。惟若負債之條款，可能依交易對方之選擇，以移轉本公司之權益工具而導致其清償，且若該選擇權依 IAS 32「金融工具：表達」之規定係單獨認列於權益，則前述條款並不影響負債之分類。

3. IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」

該修正釐清，對於售後租回交易，若資產之移轉滿足 IFRS 15「客戶合約之收入」之規定以銷售資產處理者，賣方兼承租人因租回所產生之負債應依 IFRS 16 之租賃負債規定處理，惟若涉及非取決於指數或費率之變動租賃給付，賣方兼承租人應以不認列與所保留使用權有關之損益之方式衡量該負債。後續，納入租賃負債計算之當期租賃給付數與實際支付數之差額列入損益。

除上述影響外，截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

本財務報表係依歷史成本基礎編製。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及

3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外 幣

本公司編製財務報表時，以本公司功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

(五) 存 貨

存貨包括原物料、半成品、在製品及製成品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

(六) 投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。

子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下，投資原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益。

當本公司對子公司之損失份額等於或超過其在該子公司之權益（包括權益法下子公司之帳面金額及實質上屬於本公司對該子公司淨投資組成部分之其他長期權益）時，係繼續按持股比例認列損失。

取得成本超過本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期收益。

本公司評估減損時，係以財務報表整體考量現金產生單位並比較其可回收金額與帳面金額。嗣後若資產可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面金額，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列攤銷後之帳面金額。歸屬於商譽之減損損失不得於後續期間迴轉。

當喪失對子公司控制時，本公司係按喪失控制日之公允價值衡量其對前子公司之剩餘投資，剩餘投資之公允價值及任何處分價款與喪失控制當日之投資帳面金額之差額，列入當期損益。此外，於其他綜合損益中所認列與該子公司有關之所有金額，其會計處理係與本公司直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於財務報表予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益，僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內，認列於財務報表。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(八) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷。本公司至少每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(九) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共有資產係依合理一致基礎分攤至最小現今產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得

或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

本公司所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- A. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- B. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款及存出保證金）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- A. 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- B. 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，應自信用減損後之次一報導期間起以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算利息收入。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

2. 金融負債

(1) 後續衡量

金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

(十一) 負債準備

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

保 固

保證產品與所協議之規格相符之保固義務係依管理階層對清償本公司義務所需支出之最佳估計，於相關商品認列收入時認列。

(十二) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入來自製造半導體設備之銷售。於客戶接受該設備時，即滿足履約義務，客戶對該產品取得控制，始可認列收入及應收帳款。

2. 勞務收入

勞務收入來自維修服務。

隨合併公司提供之維修服務，相關收入係於勞務提供時認列。

(十三) 租 賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接

成本及復原標的資產之估計成本) 衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付(包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付、殘值保證下承租人預期支付之金額、合理確信將行使之購買選擇權之行使價格，及已反映於租賃期間之租賃終止罰款，減除收取之租賃誘因)之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、殘值保證下預期支付金額、標的資產購買選擇權之評估或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於資產負債表。

(十四) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

(十五) 股份基礎給付協議

本公司給與員工之權益交割股份基礎給付協議

權益交割股份基礎給付協議係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並

同時調整資本公積－員工認股權。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。

(十六) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能具有課稅所得以供可減除暫時性差異或虧損扣抵所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映企業於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司將新型冠狀病毒肺炎疫情造成之經濟影響納入重大會計估計之考量。管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

估計及假設不確定性之主要來源

包含於投資子公司之商譽減損

決定包含於投資子公司之商譽是否減損時，並估計受攤商譽現金產生單位之使用價值。為計算使用價值，管理階層應估計預期自受攤商譽現金產生單位所產生之未來現金流量，並決定計算現值所使用之適當折現率。若實際現金流量少於預期，可能會產生重大減損損失。

六、現金及約當現金

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
庫存現金及週轉金	\$ 90	\$ 90
銀行支票及活期存款	<u>578,770</u>	<u>324,872</u>
	<u>\$578,860</u>	<u>\$324,962</u>

銀行定期存款於資產負債表日之利率區間如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
銀行活期存款	0.001%~1.05%	0.01%~0.2%

七、應收帳款、其他應收款及催收款

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>應收帳款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$271,250	\$ 60,587
減：備抵損失	(<u>4,937</u>)	(<u>812</u>)
	<u>\$266,313</u>	<u>\$ 59,775</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>應收帳款—關係人</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 101	\$ -
減：備抵損失	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 101</u>	<u>\$ -</u>
<u>其他應收款</u>		
其他應收款—非關係人	<u>\$ 14</u>	<u>\$ -</u>
<u>催收款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 4,298	\$ 412
減：備抵損失	<u>(4,298)</u>	<u>(412)</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

應收帳款

本公司對商品銷售之平均授信期間為 30 天至 60 天。於決定應收帳款可回收性時，本公司考量應收帳款自原始授信日至資產負債表日信用品質之任何改變。為減輕信用風險，本公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為本公司之信用風險已顯著減少。

本公司採用 IFRS 9 之簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況及產業經濟情勢。因本公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款立帳天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期超過 365 天，本公司直接重分類催收款，並持續追索活動，追索回收之金額則沖銷相關催收款。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

111年12月31日

	<u>1 ~ 90天</u>	<u>91~180天</u>	<u>181~270天</u>	<u>271天以上</u>	<u>合 計</u>
預期信用損失率	0.64%	4.93%	12.11%	15.19%	
總帳面金額	\$210,960	\$ 53,943	\$ 1,379	\$ 5,069	\$271,351
備抵損失（存續期間預期 信用損失）	(<u>1,340</u>)	(<u>2,660</u>)	(<u>167</u>)	(<u>770</u>)	(<u>4,937</u>)
攤銷後成本	<u>\$209,620</u>	<u>\$ 51,283</u>	<u>\$ 1,212</u>	<u>\$ 4,299</u>	<u>\$266,414</u>

110年12月31日

	<u>1 ~ 90天</u>	<u>91~180天</u>	<u>181~270天</u>	<u>271天以上</u>	<u>合 計</u>
預期信用損失率	0.67%	3.19%	4.91%	-	
總帳面金額	\$ 49,310	\$ 4,268	\$ 7,009	\$ -	\$ 60,587
備抵損失（存續期間預期 信用損失）	(<u>332</u>)	(<u>136</u>)	(<u>344</u>)	-	(<u>812</u>)
攤銷後成本	<u>\$ 48,978</u>	<u>\$ 4,132</u>	<u>\$ 6,665</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 59,775</u>

以上係以立帳日為基準進行之帳齡分析。

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
年初餘額	\$ 812	\$ 740
加：本年度提列減損損失	8,423	484
減：本年度重分類	(<u>4,298</u>)	(<u>412</u>)
年底餘額	<u>\$ 4,937</u>	<u>\$ 812</u>

催收款備抵損失之變動資訊如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
年初餘額	\$ 412	\$ 4,934
加：本年度重分類	4,298	412
減：本年度迴轉減損損失	(<u>412</u>)	(<u>4,934</u>)
年底餘額	<u>\$ 4,298</u>	<u>\$ 412</u>

八、存 貨

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
原物料	\$ 54,258	\$ 30,570
半成品	-	311
在製品	547,034	412,106
製成品	-	197
	<u>\$601,292</u>	<u>\$443,184</u>

銷貨成本之性質如下：

	111年度	110年度
已銷售之存貨成本	\$577,747	\$365,784
存貨跌價損失（回升利益）	4,557	(1,197)
存貨盤盈	(8)	(102)
其他	(85)	(52)
	<u>\$582,211</u>	<u>\$364,433</u>

存貨淨變現價值回升係因出售已提列跌價損失之存貨所致。

九、採用權益法之投資

投資子公司

	111年12月31日	110年12月31日
昇和精技股份有限公司 （以下簡稱昇和精技公司）	<u>\$ 67,164</u>	<u>\$ 54,282</u>

子 公 司 名 稱	所有權權益及表決權百分比	
	111年12月31日	110年12月31日
昇和精技公司	100%	100%

由於收購後之實際營業收入成長不如預期，經評估昇和精技公司之可回收金額小於帳面金額，故於 110 年度認列減損損失 20,435 仟元。

昇和精技公司 110 年度之可回收金額係以使用價值為基礎決定，以本公司管理階層核定未來 5 年財務預算之現金流量估計，並使用年折現率 12.9% 予以計算。

十、不動產、廠房及設備

自 用

	辦公設備	運輸設備	其他設備	合 計
成 本				
111年1月1日餘額	\$ 5,200	\$ 930	\$ 13,949	\$ 20,079
增 添	740	-	8,185	8,925
處 分	-	-	(523)	(523)
111年12月31日餘額	<u>\$ 5,940</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 21,611</u>	<u>\$ 28,481</u>

（接次頁）

(承前頁)

	辦公設備	運輸設備	其他設備	合計
<u>累計折舊</u>				
111年1月1日餘額	\$ 3,797	\$ 543	\$ 3,735	\$ 8,075
處分	-	-	(523)	(523)
折舊費用	<u>756</u>	<u>186</u>	<u>4,802</u>	<u>5,744</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 4,553</u>	<u>\$ 729</u>	<u>\$ 8,014</u>	<u>\$ 13,296</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 1,387</u>	<u>\$ 201</u>	<u>\$ 13,597</u>	<u>\$ 15,185</u>
<u>成本</u>				
110年1月1日餘額	\$ 4,449	\$ 930	\$ 12,589	\$ 17,968
增添	<u>751</u>	<u>-</u>	<u>1,360</u>	<u>2,111</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 5,200</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 13,949</u>	<u>\$ 20,079</u>
<u>累計折舊</u>				
110年1月1日餘額	\$ 3,248	\$ 357	\$ 1,495	\$ 5,100
折舊費用	<u>549</u>	<u>186</u>	<u>2,240</u>	<u>2,975</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 3,797</u>	<u>\$ 543</u>	<u>\$ 3,735</u>	<u>\$ 8,075</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ 1,403</u>	<u>\$ 387</u>	<u>\$ 10,214</u>	<u>\$ 12,004</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

辦公設備	3至5年
運輸設備	5年
其他設備	3至8年

十一、租賃協議

(一) 使用權資產

	111年12月31日	110年12月31日
使用權資產帳面金額		
建築物	<u>\$ 20,668</u>	<u>\$ 3,933</u>
使用權資產之增添	<u>111年度</u> <u>\$ 22,516</u>	<u>110年度</u> <u>\$ 8,999</u>
使用權資產之折舊費用		
建築物	<u>\$ 5,718</u>	<u>\$ 4,500</u>

(二) 租賃負債

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
租賃負債帳面金額		
流動	<u>\$ 3,013</u>	<u>\$ 3,965</u>
非流動	<u>\$ 18,023</u>	<u>\$ -</u>

租賃負債之折現率區間如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
建築物	1.7%	1.6%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租建築物做為員工之辦公場所，租賃期間為6—7年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，本公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

(四) 其他租賃資訊

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
短期租賃費用	<u>\$ 549</u>	<u>\$ 1,059</u>
租賃之現金（流出）總額	<u>(\$ 6,251)</u>	<u>(\$ 5,636)</u>

本公司選擇對符合短期租賃之房屋建築適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

租賃期間於資產負債表日後開始之所有承租承諾如下：

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
承諾承租	<u>\$ 30,568</u>	<u>\$ 5,760</u>

十二、其他無形資產

<u>成本</u>	<u>專 利 權</u>
111年1月1日餘額	<u>\$ 1,035</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 1,035</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>專</u> <u>利</u> <u>權</u>
<u>累計攤銷</u>	
111年1月1日餘額	\$ 776
攤銷費用	<u>173</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 949</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 86</u>
<u>成 本</u>	
110年1月1日餘額	<u>\$ 1,035</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 1,035</u>
<u>累計攤銷</u>	
110年1月1日餘額	\$ 604
攤銷費用	<u>172</u>
110年12月31日餘額	<u>\$ 776</u>
110年12月31日淨額	<u>\$ 259</u>

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年限計提：

專 利 權 6年

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
依功能別彙總攤銷費用		
研發費用	<u>\$ 173</u>	<u>\$ 172</u>

十三、預付款項

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
預付貨款	\$ 51,013	\$ 13,222
進項稅額	2,247	6,679
其他預付費用	<u>1,400</u>	<u>2,252</u>
	<u>\$ 54,660</u>	<u>\$ 22,153</u>

十四、其他資產

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流動</u>		
<u>其他流動資產</u>		
暫付款	\$ <u>78</u>	\$ <u>-</u>
<u>非流動</u>		
<u>其他非流動資產</u>		
預付設備款	\$ <u>2,000</u>	\$ <u>4,600</u>

十五、應付帳款

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>應付帳款</u>		
因營業而發生－非關係人	\$ <u>276,811</u>	\$ <u>205,268</u>
因營業而發生－關係人	\$ <u>1,689</u>	\$ <u>1,487</u>

購買部分商品之平均賒帳期間為 1 至 3 個月，對應付帳款不加計利息。本公司訂有財務風險管理政策，以確保所有應付款於預先約定之信用期限內償還。

十六、其他負債

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>流動</u>		
<u>其他應付款</u>		
應付薪資及獎金	\$ 58,483	\$ 35,060
應付員工及董監酬勞	35,863	12,623
應付退休金	658	497
應付保險費	1,206	969
應付休假給付	3,896	2,747
銷項稅額	-	2,508
應付設備款	-	3,255
其他	<u>6,831</u>	<u>5,207</u>
	<u>\$106,937</u>	<u>\$ 62,866</u>
其他應付款－關係人	\$ <u>111</u>	\$ <u>904</u>
<u>其他負債</u>		
暫收款	\$ 31	\$ 20
代收款	<u>1,277</u>	<u>1,151</u>
	<u>\$ 1,308</u>	<u>\$ 1,171</u>

十七、負債準備

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
流動 保 固	<u>\$ 24,736</u>	<u>\$ 28,246</u>

保固負債準備係依銷售商品合約約定，本公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質之事件而進行調整。

十八、退職後福利計畫

確定提撥計畫

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。本公司 111 及 110 年度認列之退休金成本為 3,404 仟元及 2,686 仟元。

十九、權 益

(一) 普通股股本

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
額定股數(仟股)	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
額定股本	<u>\$500,000</u>	<u>\$500,000</u>
已發行且已收足股款之股數 (仟股)	<u>22,560</u>	<u>11,040</u>
已發行股本	<u>\$225,600</u>	<u>\$110,400</u>

本公司為調整資本結構，分別於 111 年 5 月 17 日及 110 年 7 月 28 日經股東會決議，以未分配盈餘 55,200 仟元及 55,200 仟元辦理轉增資發行新股，經報奉主管機關核准，並分別於 111 年 6 月 1 日及 110 年 8 月 24 日完成變更登記。

111 年 10 月 20 日董事會決議現金增資發行新股 60,000 仟元，每股面額 10 元，並以每股新台幣 22 元溢價發行，增資後實收股本為 225,600 仟元。並經董事會決議，以 111 年 10 月 24 日為增資基準日。

(二) 資本公積

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)</u>		
股票發行溢價	\$ 93,238	\$ 19,200
已失效員工認股權	<u>257</u>	<u>257</u>
	<u>\$ 93,495</u>	<u>\$ 19,457</u>

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二一之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於 111 年 5 月 17 日及 110 年 7 月 28 日舉行股東會，分別決議通過 110 及 109 年度盈餘分配案如下：

	<u>盈 餘 分 配 案</u>		<u>每 股 股 利 (元)</u>	
	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>	<u>110年度</u>	<u>109年度</u>
法定盈餘公積	\$ 6,753	\$ 6,366	\$ -	\$ -
股票股利	55,200	55,200	5.00	10.00

本公司 112 年 2 月 20 日董事會擬議 111 年度盈餘分配案如下：

	<u>盈 餘 分 配 案</u>	<u>每 股 股 利 (元)</u>
法定盈餘公積	\$ 20,341	\$ -
現金股利	45,120	2.00
股票股利	47,376	2.10

有關 111 年度之盈餘分配案尚待預計於 112 年 4 月 7 日召開之股東常會決議。

二十、收入

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
客戶合約收入		
商品銷貨收入	\$925,878	\$505,676
其他營業收入	<u>63,549</u>	<u>45,875</u>
	<u>\$989,427</u>	<u>\$551,551</u>

合約餘額

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>	<u>110年1月1日</u>
應收帳款	<u>\$ 266,414</u>	<u>\$ 59,775</u>	<u>\$ 49,738</u>
合約負債－預收貨款			
商品銷貨	<u>\$ 589,091</u>	<u>\$ 399,838</u>	<u>\$ 261,128</u>

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當年度認列為收入之金額如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
<u>來自年初合約負債</u>		
商品銷貨	<u>\$ 383,728</u>	<u>\$ 226,088</u>

二一、稅前淨利

(一) 利息收入

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
利息收入		
銀行存款	\$ 951	\$ 77
押金設算息	<u>12</u>	(<u>47</u>)
	<u>\$ 963</u>	<u>\$ 30</u>

(二) 其他收入

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
租賃收入	\$ 742	\$ -
其他	<u>9</u>	<u>3</u>
	<u>\$ 751</u>	<u>\$ 3</u>

(三) 其他利益 (損失)

	111年度	110年度
淨外幣兌換利益 (損失)	\$ 11,561	(\$ 1,656)
減損損失	-	(20,435)
租賃修改 (損失) 利益	(192)	5
其他	(18)	-
	<u>\$ 11,351</u>	<u>(\$ 22,086)</u>

(四) 財務成本

	111年度	110年度
銀行借款利息	\$ 11	\$ 3
租賃負債之利息	128	114
	<u>\$ 139</u>	<u>\$ 117</u>

(五) 折舊及攤銷

	111年度	110年度
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 5,426	\$ 6,165
營業費用	6,036	1,310
	<u>\$ 11,462</u>	<u>\$ 7,475</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業費用	<u>\$ 173</u>	<u>\$ 172</u>

(六) 員工福利費用

	111年度	110年度
退職後福利		
確定提撥計畫	\$ 3,404	\$ 2,686
股份基礎給付		
權益交割 (附註二四)	2,038	-
其他員工福利	185,497	106,579
員工福利費用合計	<u>\$190,939</u>	<u>\$109,265</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 57,084	\$ 38,477
營業費用	133,855	70,788
	<u>\$190,939</u>	<u>\$109,265</u>

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董監事酬勞前之稅前利益分別以 3% 以上及不高於 3% 提撥員工酬勞及董監事酬勞。111 及 110 年度估列之員工酬勞及董監事酬勞分別於 112 年 2 月 20 日及 111 年 3 月 3 日經董事會決議如下：

估列比例

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
員工酬勞	10%	10%
董監事酬勞	2.5%	2.5%

金 額

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
	現 金	現 金
員工酬勞	\$ 28,691	\$ 10,099
董監事酬勞	7,172	2,524

年度財務報表通過發佈日後若金額有變動，則依會計估計變動處理，於下一年度調整入帳。

111 及 110 年度員工酬勞及董監事酬勞董事會決議之實際配發金額與 111 及 110 年度財務報表之認列金額並無差異。

二二、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
當期所得稅		
本年度產生者	\$ 51,104	\$ 20,407
以前年度之調整	(<u>2</u>)	<u>30</u>
	<u>51,102</u>	<u>20,437</u>
遞延所得稅		
本年度產生者	(3,477)	405
以前年度之調整	<u>11</u>	<u>-</u>
	(<u>3,466</u>)	<u>405</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 47,636</u>	<u>\$ 20,842</u>

會計所得與當期所得稅費用之調節如下：

	111年度	110年度
稅前淨利	<u>\$251,051</u>	<u>\$ 88,374</u>
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$ 50,210	\$ 17,675
稅上不可減除之費損	-	3,137
免稅所得	(2,583)	-
以前年度之遞延所得稅費用於本年度之調整	11	-
以前年度之當期所得稅費用於本年度之調整	(2)	30
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 47,636</u>	<u>\$ 20,842</u>

(二) 本期所得稅負債

	111年12月31日	110年12月31日
本期所得稅負債		
應付所得稅	<u>\$ 40,817</u>	<u>\$ 11,558</u>

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

111 年度

	年 初 餘 額	認 列 於 損 益	年 底 餘 額
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>			
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 571	\$ 911	\$ 1,482
未實現兌換損益	835	(835)	-
應付休假給付	549	230	779
備抵呆帳	135	1,161	1,296
保固損失	-	4,947	4,947
	<u>\$ 2,090</u>	<u>\$ 6,414</u>	<u>\$ 8,504</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>			
暫時性差異			
未實現兌換損益	<u>\$ -</u>	(<u>\$ 2,937</u>)	(<u>\$ 2,937</u>)

110 年度

<u>遞延所得稅資產</u>	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認 列 於 損 益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 811	(\$ 240)	\$ 571
未實現兌換損益	228	607	835
應付休假給付	420	129	549
備抵呆帳	<u>1,036</u>	<u>(901)</u>	<u>135</u>
	<u>\$ 2,495</u>	<u>(\$ 405)</u>	<u>\$ 2,090</u>

(四) 所得稅核定情形

本公司之營利事業之所得稅申報，除 110 年度外，截至 109 年度以前之申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二三、每股盈餘

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
基本每股盈餘	<u>\$ 11.91</u>	<u>\$ 4.08</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 11.06</u>	<u>\$ 3.85</u>

計算每股盈餘時，無償配股之影響業已追溯調整，該無償配股基準日訂於 111 年 5 月 24 日。因追溯調整，110 年度基本及稀釋每股盈餘變動如下：

	單位：每股元	
	<u>追 溯 調 整 前</u>	<u>追 溯 調 整 後</u>
基本每股盈餘	<u>\$ 6.12</u>	<u>\$ 4.08</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.77</u>	<u>\$ 3.85</u>

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
用以計算基本每股盈餘之淨利	<u>\$ 203,415</u>	<u>\$ 67,532</u>
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	<u>\$ 203,415</u>	<u>\$ 67,532</u>

股 數	單位：仟股	
	111年度	110年度
用以計算基本每股盈餘之普通 股加權平均股數	17,086	16,560
具稀釋作用潛在普通股之影響： 員工酬勞	<u>1,309</u>	<u>980</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通 股加權平均股數	<u>18,395</u>	<u>17,540</u>

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二四、股份基礎給付協議

員工認股權計畫

本公司於 111 年 10 月給與員工認股權 600 仟股，給與對象為本公司之員工。

員工認股權之相關資訊如下：

員 工 認 股 權	111年度	
	單 位 (仟)	加 權 平 均 行 使 價 格 (元)
年初流通在外	-	\$ -
本年度給與	600	22
本年度行使	(600)	
年底流通在外	<u>-</u>	
年底可行使	<u>-</u>	
本年度給與之認股權加權平均 公允價值 (元)	<u>\$ 3.3963</u>	

於 111 年度行使之員工認股權，其於行使日之加權平均股價為 22 元。

本公司於 111 年 10 月給與之員工認股權均使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

	<u>111年10月</u>
給與日市價	25.23 元
執行價格	22 元
預期波動率	39.61%
存續期間	30 天
預期股利率	0%
無風險利率	1.157%

111 年度認列之酬勞成本為 2,038 仟元。

二五、資本風險管理

本公司目前營運穩定，資本風險管理目標為確保能夠在繼續經營與成長前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。

本公司採用審慎之風險管理策略並定期審核，依業務發展策略及營運需求做整體性規劃，以決定本公司適當之資本結構。

二六、金融工具

(一) 公允價值資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 金融工具之種類

	<u>111年12月31日</u>	<u>110年12月31日</u>
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產 (註1)	\$ 846,405	\$ 385,914
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量(註2)	385,548	270,525

註 1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款（含關係人）、其他應收款及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註 2：餘額係包含應付帳款（含關係人）、其他應付款（含關係人）等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(三) 財務風險管理目的與政策

本公司主要金融工具包括現金及約當現金、應收帳款及應付帳款。上述金融工具與營運有關之財務風險。(包含匯率風險、利率風險及其他價格風險)、信用風險及流動性風險。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險(參閱下述(1))以及利率變動風險(參閱下述(2))。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使本公司產生匯率變動暴險。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額，參閱附註三十。

敏感度分析

本公司主要受到美元波動之影響。

下表詳細說明當新台幣(功能性貨幣)對各攸關外幣之匯率增加及減少1%時，本公司之敏感性分析如下。1%係為集團內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。

	美金貨幣之影響		日幣貨幣之影響	
	111年度	110年度	111年度	110年度
損益	\$ 3,483	\$ 1,050	\$ 207	\$ 91

以上主要源自於本公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之美金貨幣計價銀行存款、應收款項。

(2) 利率風險

因本公司內之銀行存款及租賃負債包含以固定及浮動利率計息，因而產生利率暴險。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	111年12月31日	110年12月31日
具公允價值利率風險		
— 金融資產	\$ -	\$ -
— 金融負債	21,036	3,965
具現金流量利率風險		
— 金融資產	578,770	324,872
— 金融負債	-	-

敏感度分析

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之負債金額於報導期間皆流通在外。集團內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 0.25% 基點，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加／減少 0.25% 基點，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 111 及 110 年度之稅前淨利將分別增加／減少 1,447 仟元及 812 仟元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於：

- (1) 資產負債表所認列之金融資產帳面金額。
- (2) 本公司提供財務保證所產生之或有負債金額。

本公司採行之政策係僅與信譽卓著之對象進行交易，並於必要情形下取得足額之擔保以減輕因拖欠所產生財務損失之風險。為減輕信用風險，本公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司於資產負債表日會逐一複

核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為公司之信用風險已顯著減少。故該信用風險係屬有限。

本公司之信用風險主要係集中於本公司最大客戶，截至 111 年及 110 年 12 月 31 日止，總應收帳款來自前述客戶之比率分別 11% 及 54%。

3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。截至 111 及 110 年度止，本公司未動用之短期銀行融資額度，參閱下列(2)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

111 年 12 月 31 日

	短於 1 年	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 278,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,500
其他應付款	107,048	-	-	-	107,048
租賃負債	3,349	3,479	3,537	11,821	22,186
其他流動負債	1,308	-	-	-	1,308
	<u>\$ 390,205</u>	<u>\$ 3,479</u>	<u>\$ 3,537</u>	<u>\$ 11,821</u>	<u>\$ 409,042</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於 1 年	1 ~ 2 年	2 ~ 3 年	3 ~ 5 年	5 年以上
租賃負債	<u>\$ 3,349</u>	<u>\$ 3,479</u>	<u>\$ 3,537</u>	<u>\$ 7,881</u>	<u>\$ 3,940</u>

110 年 12 月 31 日

	短於 1 年	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 206,755	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,755
其他應付款	63,770	-	-	-	63,770
租賃負債	4,000	-	-	-	4,000
其他流動負債	1,171	-	-	-	1,171
	<u>\$ 275,696</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 275,696</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~2年	2~3年	3~5年	5年以上
租賃負債	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(2) 融資額度

	111年12月31日	110年12月31日
無擔保銀行借款額度 (雙方同意下得展期)		
— 已動用金額	\$ -	\$ -
— 未動用金額	50,000	110,000
	<u>\$ 50,000</u>	<u>\$ 110,000</u>

二七、關係人交易

本公司之母公司為家登精密工業股份有限公司，於111年12月31日及110年12月31日分別持有本公司普通股50.10%及50.93%。

(一) 關係人名稱及其關係

關 係 人 名 稱	與本公司之關係
家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)	母 公 司
昇和精技股份有限公司(以下簡稱昇和公司)	子 公 司
Gudeng Inc. (以下簡稱家登美國公司)	兄 弟 公 司

(二) 營業收入

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年度	110年度
銷貨收入	家登公司	<u>\$ 1,672</u>	<u>\$ 328</u>

本公司對關係人之銷貨價格與一般客戶相當。

(三) 進 貨

關 係 人 名 稱	111年度	110年度
家登公司	<u>\$ 10,353</u>	<u>\$ 9,481</u>
家登美國公司	<u>\$ 105</u>	<u>\$ -</u>

進貨係依市價扣除折扣，以反映購買之數量及與該關係人之關係。

(四) 應收關係人款項

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年12月31日	110年12月31日
應收帳款—關係人	家登公司	<u>\$ 101</u>	<u>\$ -</u>

(五) 應付關係人款項 (不含向關係人借款)

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年12月31日	110年12月31日
應付帳款－關係人	家登公司	<u>\$ 1,689</u>	<u>\$ 1,487</u>

(六) 承租協議

關 係 人 名 稱	111年度	110年度
<u>取得使用權資產</u>		
家登公司	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,866</u>

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年12月31日	110年12月31日
租賃負債	家登公司	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,965</u>

關 係 人 名 稱	111年度	110年度
<u>利息費用</u>		
家登公司	<u>\$ 35</u>	<u>\$ 99</u>

本公司於 110 年 1 月 1 日向家登公司承租建築物做為廠房及辦公室使用，租賃期間均為 2 年，租金係參考類似資產之租金水準，並依租約按月支付固定租賃給付。

(七) 其他關係人交易

1. 租金支出

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年度	110年度
營業費用	家登公司	<u>\$ 12</u>	<u>(\$ 33)</u>
製造費用	家登公司	<u>\$ 11</u>	<u>\$ 10</u>

2. 其他費用

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年度	110年度
營業費用	家登公司	<u>\$ 302</u>	<u>\$ 16</u>
製造費用	家登公司	<u>\$ 488</u>	<u>\$ 1,716</u>

3. 其他收入

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年度	110年度
利息收入	家登公司	<u>\$ 9</u>	<u>(\$ 47)</u>
租金收入	昇和公司	<u>\$ 720</u>	<u>\$ -</u>

4. 其他資產及負債

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	111年12月31日	110年12月31日
存出保證金	家登公司	\$ 669	\$ 669
其他應付款—關係人	家登公司	\$ 111	\$ 904
合約負債	家登公司	\$ 96	\$ 120

(八) 主要管理階層薪酬

	111年度	110年度
短期員工福利	\$ 33,007	\$ 17,040

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

重大承諾

本公司與各廠商契約承諾購置裝修工程，其合約總價計新台幣 8,018 仟元，截至 111 年 12 月 31 日止已支付 2,000 仟元（帳列預付設備款），餘新台幣 6,018 仟元尚未支付。

二九、重大之期後事項：無。

三十、具重大影響之外幣資產及負債資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

111 年 12 月 31 日

外 幣 資 產	外	幣 匯	率	帳 面 金 額
<u>貨幣性項目</u>				
美 元	\$ 11,341	30.71	(美元：新台幣)	\$ 348,282
日 圓	88,884	0.2324	(日圓：新台幣)	20,657
歐 元	34	32.72	(歐元：新台幣)	1,112
				<u>\$ 370,051</u>

110年12月31日

外幣資產		外幣	匯率	帳面金額
貨幣性項目				
美元		\$ 3,792	27.68 (美元：新台幣)	\$ 104,970
日圓		37,811	0.2405 (日圓：新台幣)	9,093
				<u>\$ 114,063</u>

具重大影響之外幣兌換損益（未實現）如下：

外幣	111年度		110年度	
	匯率	淨兌換(損)益	匯率	淨兌換(損)益
美元	30.71 (美元：新台幣)	\$ 15,866	27.68 (美元：新台幣)	(\$ 3,717)
日圓	0.2324 (日圓：新台幣)	(1,178)	0.2405 (日圓：新台幣)	(458)
歐元	32.72 (歐元：新台幣)	(2)	31.32 (歐元：新台幣)	-
		<u>\$ 14,686</u>		<u>(\$ 4,175)</u>

三一、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊及(二)轉投資事業相關資訊：

編號	項	目	說	明
1	資金貸與他人。			無
2	為他人背書保證。			無
3	期末持有有價證券情形。(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)			無
4	累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。			無
5	取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。			無
6	處分不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。			無
7	與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元或實收資本額20%以上。			無
8	應收關係人款項達1億元或實收資本額20%以上。			無
9	從事衍生性商品交易。			無
10	被投資公司資訊			附表一

(三) 大陸投資資訊

編號	項	目	說	明
1	大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本期損益及認列之投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。			無
2	與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：			
	(1)進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比。			無
	(2)銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比。			無
	(3)財產交易金額及其所產生之損益數額。			無
	(4)票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的。			無
	(5)資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額。			無
(6)其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等。			無	

附件四

112 年度個體財務報告暨會計師查核報告

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

個體財務報告暨會計師查核報告
民國112及111年度

地址：新北市土城區中央路4段2號8樓之5

電話：(02)22689141

§ 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 告 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、會計師查核報告	3~6		-
四、個體資產負債表	7		-
五、個體綜合損益表	8~9		-
六、個體權益變動表	10		-
七、個體現金流量表	11~12		-
八、個體財務報表附註			
(一) 公司沿革	13		一
(二) 通過財務報告之日期及程序	13		二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	13~14		三
(四) 重大會計政策之彙總說明	14~25		四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	25		五
(六) 重要會計項目之說明	25~46		六~二六
(七) 關係人交易	46~49		二七
(八) 重大或有負債及未認列之合約承諾	50		二八
(九) 重大之災害損失	-		-
(十) 重大之期後事項	-		二九
(十一) 其 他	50~51		三十
(十二) 附註揭露事項			
1. 重大交易事項相關資訊	51、53		三一
2. 轉投資事業相關資訊	51、53		三一
3. 大陸投資資訊	52		三一
4. 主要股東資訊	52、54		三一
九、重要會計項目明細表	55~66		-

會計師查核報告

家碩科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

家碩科技股份有限公司（原名：家登自動化股份有限公司）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達家碩科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與家碩科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對家碩科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對家碩科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

家碩科技股份有限公司營業收入主要來源為設備機台之銷售，產品係屬客製化機台，其中 112 年度設備機台銷售金額重大，佔個體營業收入 91%；設備機台銷售交易條件為交機完成且經客戶接受後始完成履約義務，因涉及判斷銷貨商品之控制權移轉是否發生，故可能造成收入認列存有不適當之情形，以及審計準則對收入認列預設為顯著風險，故將其設備機台銷貨收入認列之真實性列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱個體財務報告附註四(十三)及附註十九。

針對上述重要事項，本會計師執行下列主要查核程序：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制制度係合理且有效執行。
2. 以設備機台銷貨收入明細進行選樣，核對認列收入之相關文件是否相符，以確認銷貨收入之正確性。
3. 取得期後銷貨退回明細，抽核其相關憑證並檢視退貨原因之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估家碩科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算家碩科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

家碩科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對家碩科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使家碩科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致家碩科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於家碩科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責家碩科技股份有限公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成家碩科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對家碩科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 建 銘

曾建銘



會計師 王 攀 發

王攀發



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 4 日

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	953,785	51	\$	578,860	36
1170	應收帳款—非關係人(附註四、七及十九)		127,563	7		266,313	17
1180	應收帳款—關係人(附註四、七、十九及二七)		-	-		101	-
1200	其他應收款(附註七)		296	-		14	-
130X	存貨(附註四及八)		564,837	31		601,292	37
1410	預付款項(附註十三)		3,840	-		54,660	3
1470	其他流動資產(附註十三)		39	-		78	-
11XX	流動資產總計		<u>1,650,360</u>	<u>89</u>		<u>1,501,318</u>	<u>93</u>
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資(附註四及九)		77,440	4		67,164	4
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十及二七)		76,391	4		15,185	1
1755	使用權資產(附註四、十一及二七)		37,797	2		20,668	1
1780	無形資產(附註四及十二)		1,107	-		86	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)		12,703	1		8,504	1
1920	存出保證金(附註二七)		4,239	-		1,117	-
1900	其他非流動資產(附註十三)		3,106	-		2,000	-
15XX	非流動資產總計		<u>212,783</u>	<u>11</u>		<u>114,724</u>	<u>7</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 1,863,143</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,616,042</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2130	合約負債(附註十九及二七)	\$	762,289	41	\$	589,091	36
2170	應付帳款—非關係人(附註十四)		135,482	7		276,811	17
2180	應付帳款—關係人(附註十四及二七)		20,319	1		1,689	-
2200	其他應付款—非關係人(附註十五)		106,736	6		106,937	7
2220	其他應付款項—關係人(附註十五及二七)		220	-		111	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)		35,849	2		40,817	3
2250	負債準備—流動(附註四及十六)		29,087	2		24,736	2
2280	租賃負債—流動(附註四、十一及二七)		9,471	-		3,013	-
2399	其他流動負債(附註十五)		802	-		1,308	-
21XX	流動負債總計		<u>1,100,255</u>	<u>59</u>		<u>1,044,513</u>	<u>65</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)		302	-		2,937	-
2580	租賃負債—非流動(附註四、十一及二七)		29,279	2		18,023	1
25XX	非流動負債總計		<u>29,581</u>	<u>2</u>		<u>20,960</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>1,129,836</u>	<u>61</u>		<u>1,065,473</u>	<u>66</u>
	權益(附註十八)						
3110	普通股股本		272,976	14		225,600	14
3200	資本公積		93,495	5		93,495	6
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		38,057	2		17,716	1
3350	未分配盈餘		329,164	18		213,758	13
3300	保留盈餘總計		367,221	20		231,474	14
3400	其他權益		(385)	-		-	-
3XXX	權益總計		<u>733,307</u>	<u>39</u>		<u>550,569</u>	<u>34</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 1,863,143</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,616,042</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾

經理人：詹印豐

會計主管：石惠文

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、十九及 二七）				
4100	銷貨收入	\$ 1,163,487	100	\$ 989,427	100
5000	營業成本（附註八、二十及 二七）	(612,060)	(53)	(582,211)	(59)
5900	營業毛利	551,427	47	407,216	41
	營業費用（附註十七、二十 及二七）				
6100	推銷費用	58,814	5	44,504	4
6200	管理費用	97,219	8	65,300	7
6300	研究發展費用	133,402	11	64,158	6
6450	預期信用減損損失	6,120	1	8,011	1
6000	營業費用合計	295,555	25	181,973	18
6900	營業淨利	255,872	22	225,243	23
	營業外收入及支出（附註二 十）				
7100	利息收入（附註二七）	10,217	1	963	-
7190	其他收入（附註二七）	993	-	751	-
7020	其他利益及損失（附註 二七）	7,333	1	11,351	1
7050	財務成本（附註二七）	(733)	-	(139)	-
7060	採用權益法之子公司損 益份額	2,701	-	12,882	2
7000	營業外收入及支出 合計	20,511	2	25,808	3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 276,383	24	\$ 251,051	26
7950	所得稅費用(附註四及二一)	(48,140)	(4)	(47,636)	(5)
8200	本年度淨利	<u>228,243</u>	<u>20</u>	<u>203,415</u>	<u>21</u>
	其他綜合損益				
	後續可能重分類至損益				
	之項目				
8361	國外營運機構財務				
	報表換算之兌換				
	差額	(385)	-	-	-
8300	本年度其他綜合損				
	益(稅後淨額)				
	合計	(385)	-	-	-
8500	本年度綜合損益(稅後淨額)				
	總額	<u>\$ 227,858</u>	<u>20</u>	<u>\$ 203,415</u>	<u>21</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 8.36</u>		<u>\$ 9.84</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 7.96</u>		<u>\$ 9.13</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾



經理人：詹印豐



會計主管：石惠文



家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

個體權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股	本	保	留	盈	餘	其 他 權 益	
							國 外 營 運 機 構	權 益 總 額
	股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	之 兌 換 差 額	權 益 總 額	
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	11,040	\$ 110,400	\$ 19,457	\$ 10,963	\$ 72,296	\$ -	\$ 213,116
	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	6,753	(6,753)	-	-
B9	股東股票股利	5,520	55,200	-	-	(55,200)	-	-
N1	本公司發行員工認股權	-	-	2,038	-	-	-	2,038
E1	現金增資	6,000	60,000	72,000	-	-	-	132,000
D1	111 年 度 淨 利	-	-	-	-	203,415	-	203,415
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	22,560	225,600	93,495	17,716	213,758	-	550,569
	111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	20,341	(20,341)	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(45,120)	-	(45,120)
B9	股東股票股利	4,738	47,376	-	-	(47,376)	-	-
D1	112 年 度 淨 利	-	-	-	-	228,243	-	228,243
D3	112 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(385)	(385)
D5	112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	228,243	(385)	227,858
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	27,298	\$ 272,976	\$ 93,495	\$ 38,057	\$ 329,164	(\$ 385)	\$ 733,307

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾



經理人：詹印豐



會計主管：石惠文



家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 276,383	\$ 251,051
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	20,904	11,462
A20200	攤銷費用	226	173
A20300	預期信用減損損失	6,120	8,011
A20900	財務成本	733	139
A21200	利息收入	(10,217)	(963)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	2,038
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	(2,701)	(12,882)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	9,481	4,557
A24100	外幣兌換損失(利益)	863	(18,273)
A22900	租賃修改損失	-	192
A29900	廉價購買利益	(1,512)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	134,163	(208,608)
A31160	應收帳款－關係人	101	(101)
A31180	其他應收款	14	(14)
A31200	存 貨	26,974	(162,665)
A31230	預付款項	50,820	(32,507)
A31240	其他流動資產	39	(78)
A32150	應付帳款	(141,329)	71,543
A32160	應付帳款－關係人	18,630	202
A32180	其他應付款	(754)	44,071
A32190	其他應付款－關係人	109	(793)
A32200	負債準備	4,351	(3,510)
A32210	合約負債	173,198	189,253
A32230	其他流動負債	(506)	137
A33000	營運產生之現金	566,090	142,435
A33200	收取之利息	9,921	963

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 733)	(\$ 139)
A33500	支付之所得稅	(59,942)	(21,854)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>515,336</u>	<u>121,405</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(6,448)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(70,807)	(8,925)
B03700	存出保證金增加	(3,122)	-
B03800	存出保證金減少	-	60
B04500	購置無形資產	(1,247)	-
B07100	預付設備款(增加)減少	(3,106)	<u>2,600</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(84,730)</u>	<u>(6,265)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(8,165)	(5,574)
C04500	發放現金股利	(45,120)	-
C04600	現金增資	-	<u>132,000</u>
CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流 入	<u>(53,285)</u>	<u>126,426</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(2,396)</u>	<u>12,332</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	374,925	253,898
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>578,860</u>	<u>324,962</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 953,785</u>	<u>\$ 578,860</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：邱銘乾



經理人：詹印豐



會計主管：石惠文



家碩科技股份有限公司

(原名：家登自動化股份有限公司)

個體財務報表附註

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革及營業

家碩科技股份有限公司(以下稱「本公司」)，係於 105 年 7 月 18 日設立，於新北市之股份有限公司，並於同年 7 月開始營業。所營業務主要為各種精密儀器之買賣、維修及保養業務。

本公司原名「家登自動化股份有限公司」，經 112 年 1 月 31 日臨時股東會決議更名為「家碩科技股份有限公司」，並於 112 年 2 月 10 日經新北市政府核准。

本公司股票自 112 年 6 月起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。

本財務報表係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於 113 年 3 月 4 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱「IFRS 會計準則」)

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則將不致造成本公司會計政策之重大變動。

- (二) 113 年適用之金管會認可之 IFRS 會計準則

<u>新發布 / 修正 / 修訂準則及解釋</u>	<u>IASB 發布之生效日(註 1)</u>
IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」	2024 年 1 月 1 日(註 2)
IAS 1 之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
IAS 1 之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日
IAS 7 及 IFRS 7 之修正「供應商融資安排」	2024 年 1 月 1 日(註 3)

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：賣方兼承租人應對初次適用 IFRS 16 日後簽訂之售後租回交易追溯適用 IFRS 16 之修正。

註 3：第一次適用本修正時，豁免部分揭露規定。

截至本財務報告通過發布日止，本公司評估上述準則、解釋之修正將不致對財務狀況與財務績效造成重大影響。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則

<u>新發布／修正／修訂準則及解釋</u>	<u>IASB 發布之生效日(註 1)</u>
IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
IFRS 17「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正	2023 年 1 月 1 日
IFRS 17 之修正「初次適用 IFRS 17 及 IFRS 9—比較資訊」	2023 年 1 月 1 日
IAS 21 之修正「缺乏可兌換性」	2025 年 1 月 1 日 (註 2)

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註 2：適用於 2025 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間。首次適用該修正時，將影響數認列於首次適用日之保留盈餘。當本公司以非功能性貨幣作為表達貨幣時，將影響數調整首次適用日權益項下之國外營運機構兌換差額。

截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估上述準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

本財務報表係依歷史成本基礎編製。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債，以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外 幣

本公司編製財務報表時，以本公司功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製個體財務報告時，國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司、關聯企業、合資或分公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額列於其他綜合損益。

若本公司處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之聯合協議或

關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

(五) 存 貨

存貨包括原物料、半成品、在製品及製成品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算係採加權平均法。

(六) 投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。

子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下，投資原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益。

當本公司對子公司之損失份額等於或超過其在該子公司之權益（包括權益法下子公司之帳面金額及實質上屬於本公司對該子公司淨投資組成部分之其他長期權益）時，係繼續按持股比例認列損失。

取得成本超過本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期收益。

本公司評估減損時，係以財務報表整體考量現金產生單位並比較其可回收金額與帳面金額。嗣後若資產可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面金額，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列攤銷後之帳面金額。歸屬於商譽之減損損失不得於後續期間迴轉。

當喪失對子公司控制時，本公司係按喪失控制日之公允價值衡量其對前子公司之剩餘投資，剩餘投資之公允價值及任何處分價款與喪失控制當日之投資帳面金額之差額，列入當期損益。此外，於其他綜合損益中所認列與該子公司有關之所有金額，其會計處理係與本公司直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於財務報表予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益，僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內，認列於個體財務報表。

(七) 投資關聯企業

關聯企業係指本公司具有重大影響，但非屬子公司或合資之企業。

本公司對投資關聯企業係採用權益法。

權益法下，投資關聯企業原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之關聯企業損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對關聯企業權益之變動係按持股比例認列。

取得成本超過本公司於取得日所享有關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本公司於取得日所享有關聯企業可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期損益。

關聯企業發行新股時，本公司若未按持股比例認購，致使持股比例發生變動，並因而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積—採權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數及採用權益法之投資。惟若未按持股比例認購或取得致使對關聯企業之所有權權益減少者，於其他綜合損益中所認列與該關聯企業有關之金額按減少比例重分類，其會計處理之基礎係與關聯企業若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同；前項調整如應借記資本公積，而採用權益法之投資所產生之資本公積餘額不足時，其差額借記保留盈餘。

當本公司對關聯企業之損失份額等於或超過其在該關聯企業之權益（包括權益法下投資關聯企業之帳面金額及實質上屬於本公司對該關聯企業淨投資組成部分之其他長期權益）時，即停止認列進一步之損失。本公司僅於發生法定義務、推定義務或已代關聯企業支付款項之範圍內，認列額外損失及負債。

本公司於評估減損時，係將投資之整體帳面金額（含商譽）視為單一資產比較可回收金額與帳面金額，進行減損測試，所認列之減損損失不分攤至構成投資帳面金額組成部分之任何資產，包括商譽。減損損失之任何迴轉，於該投資之可回收金額後續增加之範圍內予以認列。

本公司自其投資不再為關聯企業之日停止採用權益法，其對原關聯企業之保留權益以公允價值衡量，該公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，列入當期損益。此外，於其他綜合損益中所認列與該關聯企業有關之所有金額，其會計處理之基礎係與關聯企業若直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。若對關聯企業之投資成為合資之投資，或對合資之投資成為對關聯企業之投資，本公司係持續採用權益法而不對保留權益作再衡量。

本公司與關聯企業間之逆流、順流及側流交易所產生之損益，僅在與本公司對關聯企業權益無關之範圍內，認列於個體財務報告。

(八) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司至少於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計值變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(九) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷。本公司至少每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視，並推延適用會計估計值變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除 列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(十) 不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產（商譽除外）可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共有資產係依合理一致基礎分攤至最小現金產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

當減損損失於後續迴轉時，該資產或現金產生單位之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十一) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得

或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

本公司所持有之金融資產種類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之金融資產

本公司投資金融資產若同時符合下列兩條件，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產：

- A. 係於某經營模式下持有，該模式之目的係持有金融資產以收取合約現金流量；及
- B. 合約條款產生特定日期之現金流量，該等現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

按攤銷後成本衡量之金融資產（包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之應收帳款及存出保證金）於原始認列後，係以有效利息法決定之總帳面金額減除任何減損損失之攤銷後成本衡量，任何外幣兌換損益則認列於損益。

除下列兩種情況外，利息收入係以有效利率乘以金融資產總帳面金額計算：

- A. 購入或創始之信用減損金融資產，利息收入係以信用調整後有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算。
- B. 非屬購入或創始之信用減損，但後續變成信用減損之金融資產，應自信用減損後之次一報導期間起以有效利率乘以金融資產攤銷後成本計算利息收入。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）之減損損失。

應收帳款均按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。12 個月預期信用損失係代表金融工具於報導日後 12 個月內可能違約事項所產生之預期信用損失，存續期間預期信用損失則代表金融工具於預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，惟透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之備抵損失係認列於其他綜合損益，並不減少其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。

2. 金融負債

(1) 後續衡量

金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

(十二) 負債準備

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

保 固

保證產品與所協議之規格相符之保固義務係依管理階層對清償本公司義務所需支出之最佳估計值，於相關商品認列收入時認列。

(十三) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，將交易價格分攤至各履約義務，並於滿足各履約義務時認列收入。

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入來自製造半導體設備之銷售。於客戶接受該設備時，即滿足履約義務，客戶對該產品取得控制，始可認列收入。

2. 勞務收入

勞務收入來自維修服務。

隨本公司提供之維修服務，相關收入係於勞務提供時認列。

(十四) 租 賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計

折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付（包含固定給付、實質固定給付、取決於指數或費率之變動租賃給付、殘值保證下承租人預期支付之金額、合理確信將行使之購買選擇權之行使價格，及已反映於租賃期間之租賃終止罰款，減除收取之租賃誘因）之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間、殘值保證下預期支付金額、標的資產購買選擇權之評估或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於個體資產負債表。

(十五) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務期間將應提撥之退休金數額認列為費用。

(十六) 股份基礎給付協議

本公司給與員工之權益交割股份基礎給付協議

權益交割股份基礎給付協議係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積－員工認股權。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。

(十七) 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異或虧損扣抵所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司、關聯企業及聯合協議相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能具有足夠課稅所得用以實現暫時性差異，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

經本公司之管理階層評估後，並無重大會計判斷、估計及假設不確定性之情形。

六、現金及約當現金

	112年12月31日	111年12月31日
庫存現金及週轉金	\$ 90	\$ 90
銀行支票及活期存款	761,579	578,770
約當現金(原始到期日在3個月內之投資)		
銀行定期存款	<u>192,116</u>	-
	<u>\$ 953,785</u>	<u>\$ 578,860</u>

銀行存款於資產負債表日之利率區間如下：

	112年12月31日	111年12月31日
銀行活期存款	0.001%~1.45%	0.001%~1.05%
銀行定期存款	1.28%~4.95%	-

七、應收帳款、其他應收款及催收款

	112年12月31日	111年12月31日
<u>應收帳款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$134,919	\$271,250
減：備抵損失	(<u>7,356</u>)	(<u>4,937</u>)
	<u>\$127,563</u>	<u>\$266,313</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>應收帳款—關係人</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ -	\$ 101
減：備抵損失	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 101</u>
<u>其他應收款</u>		
其他應收款—非關係人	<u>\$ 296</u>	<u>\$ 14</u>
<u>催收款</u>		
按攤銷後成本衡量		
總帳面金額	\$ 7,999	\$ 4,298
減：備抵損失	<u>(7,999)</u>	<u>(4,298)</u>
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

應收帳款

本公司對商品銷售之平均授信期間為 30 天至 60 天。於決定應收帳款可回收性時，本公司考量應收帳款自原始授信日至資產負債表日信用品質之任何改變。為減輕信用風險，本公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為本公司之信用風險已顯著減少。

本公司採用 IFRS 9 之簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況及產業經濟情勢。因本公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶群，僅以應收帳款立帳天數訂定預期信用損失率。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期超過 365 天，本公司直接重分類催收款，並持續追索活動，追索回收之金額則沖銷相關催收款。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

112年12月31日

	<u>1~90天</u>	<u>91~180天</u>	<u>181~270天</u>	<u>271天以上</u>	<u>合計</u>
預期信用損失率	2.06%	9.37%	16.41%	18.16%	
總帳面金額	\$ 99,036	\$ 10,134	\$ 17,974	\$ 7,775	\$134,919
備抵損失(存續期間預期 信用損失)	(<u>2,045</u>)	(<u>950</u>)	(<u>2,949</u>)	(<u>1,412</u>)	(<u>7,356</u>)
攤銷後成本	<u>\$ 96,991</u>	<u>\$ 9,184</u>	<u>\$ 15,025</u>	<u>\$ 6,363</u>	<u>\$127,563</u>

111年12月31日

	<u>1~90天</u>	<u>91~180天</u>	<u>181~270天</u>	<u>271天以上</u>	<u>合計</u>
預期信用損失率	0.64%	4.93%	12.11%	15.19%	
總帳面金額	\$210,960	\$ 53,943	\$ 1,379	\$ 5,069	\$271,351
備抵損失(存續期間預期 信用損失)	(<u>1,340</u>)	(<u>2,660</u>)	(<u>167</u>)	(<u>770</u>)	(<u>4,937</u>)
攤銷後成本	<u>\$209,620</u>	<u>\$ 51,283</u>	<u>\$ 1,212</u>	<u>\$ 4,299</u>	<u>\$266,414</u>

以上係以立帳日為基準進行之帳齡分析。

應收帳款備抵損失之變動資訊如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
年初餘額	\$ 4,937	\$ 812
加：本年度提列減損損失	10,418	8,423
減：本年度重分類	(<u>7,999</u>)	(<u>4,298</u>)
年底餘額	<u>\$ 7,356</u>	<u>\$ 4,937</u>

催收款備抵損失之變動資訊如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
年初餘額	\$ 4,298	\$ 412
加：本年度重分類	7,999	4,298
減：本年度迴轉減損損失	(<u>4,298</u>)	(<u>412</u>)
年底餘額	<u>\$ 7,999</u>	<u>\$ 4,298</u>

八、存 貨

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
原 物 料	\$ 34,466	\$ 54,258
半 成 品	213	-
在 製 品	<u>530,158</u>	<u>547,034</u>
	<u>\$564,837</u>	<u>\$601,292</u>

銷貨成本之性質如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
已銷售之存貨成本	\$602,912	\$577,747
存貨跌價及呆滯損失	9,481	4,557
存貨盤盈	(333)	(8)
其他	<u>-</u>	<u>(85)</u>
	<u>\$612,060</u>	<u>\$582,211</u>

九、採用權益法之投資

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
投資子公司	\$ 69,897	\$ 67,164
投資關聯企業	<u>7,543</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 77,440</u>	<u>\$ 67,164</u>

(一) 投資子公司

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
昇和精技股份有限公司 (以下簡稱昇和精技公司)	<u>\$ 69,897</u>	<u>\$ 67,164</u>

<u>子 公 司 名 稱</u>	<u>所有權權益及表決權百分比</u>	
	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
昇和精技公司	100%	100%

(二) 投資關聯企業

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
個別不重大之關聯企業	<u>\$ 7,543</u>	<u>\$ -</u>

本公司於 112 年 6 月 28 日董事長核准參與 Gudeng Inc. 112 年度現金增資案，112 年 9 月 30 日以現金每股美金 1 元取得 Gudeng Inc. 普通股 208 仟股，持股比例為 4%，產生廉價購買利益 1,512 仟元。本公司之母公司持有 Gudeng Inc. 51% 之額外股份，故本公司對該公司具重大影響。

十、不動產、廠房及設備

自 用

	機器設備	辦公設備	運輸設備	其他設備	租賃改良	合 計
<u>成 本</u>						
112年1月1日餘額	\$ -	\$ 5,940	\$ 930	\$ 21,611	\$ -	\$ 28,481
增 添	59,365	1,270	-	2,200	8,525	71,360
處 分	-	(164)	-	-	-	(164)
重分類	-	-	-	-	2,000	2,000
112年12月31日餘額	<u>\$ 59,365</u>	<u>\$ 7,046</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 23,811</u>	<u>\$ 10,525</u>	<u>\$ 101,677</u>
<u>累計折舊</u>						
112年1月1日餘額	\$ -	\$ 4,553	\$ 729	\$ 8,014	\$ -	\$ 13,296
處 分	-	(164)	-	-	-	(164)
折舊費用	3,958	804	186	5,684	1,522	12,154
112年12月31日餘額	<u>\$ 3,958</u>	<u>\$ 5,193</u>	<u>\$ 915</u>	<u>\$ 13,698</u>	<u>\$ 1,522</u>	<u>\$ 25,286</u>
112年12月31日淨額	<u>\$ 55,407</u>	<u>\$ 1,853</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ 10,113</u>	<u>\$ 9,003</u>	<u>\$ 76,391</u>
<u>成 本</u>						
111年1月1日餘額	\$ -	\$ 5,200	\$ 930	\$ 13,949	\$ -	\$ 20,079
增 添	-	740	-	8,185	-	8,925
處 分	-	-	-	(523)	-	(523)
111年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 5,940</u>	<u>\$ 930</u>	<u>\$ 21,611</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 28,481</u>
<u>累計折舊</u>						
111年1月1日餘額	\$ -	\$ 3,797	\$ 543	\$ 3,735	\$ -	\$ 8,075
處 分	-	-	-	(523)	-	(523)
折舊費用	-	756	186	4,802	-	5,744
111年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,553</u>	<u>\$ 729</u>	<u>\$ 8,014</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,296</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,387</u>	<u>\$ 201</u>	<u>\$ 13,597</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15,185</u>

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

機器設備	5年
辦公設備	3至5年
運輸設備	5年
其他設備	2至8年
租賃改良	2至4年

十一、租賃協議

(一) 使用權資產

	112年12月31日	111年12月31日
使用權資產帳面金額		
建築物	\$ 36,203	\$ 20,668
運輸設備	1,594	-
	<u>\$ 37,797</u>	<u>\$ 20,668</u>

	112年度	111年度
使用權資產之增添	<u>\$ 25,879</u>	<u>\$ 14,796</u>
使用權資產之折舊費用		
建築物	\$ 8,295	\$ 5,718
運輸設備	<u>455</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 8,750</u>	<u>\$ 5,718</u>
使用權資產轉租收益 (帳列其他收入)	(<u>\$ 720</u>)	(<u>\$ 720</u>)

(二) 租賃負債

	112年12月31日	111年12月31日
租賃負債帳面金額		
流動	<u>\$ 9,471</u>	<u>\$ 3,013</u>
非流動	<u>\$ 29,279</u>	<u>\$ 18,023</u>

租賃負債之折現率區間如下：

	112年12月31日	111年12月31日
建築物	1.7%	1.7%
運輸設備	1.7%	-

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租若干建築物做為廠房及辦公室，租賃期間為 3 至 7 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之建築物並無優惠承購權，並約定未經出租人同意，本公司不得將租賃標的之全部或一部轉租或轉讓。

本公司承租若干運輸設備做為公務車使用，租賃期間為 3 年。

(四) 其他租賃資訊

	112年度	111年度
短期租賃費用	<u>\$ 2,913</u>	<u>\$ 549</u>
租賃之現金(流出)總額	(<u>\$ 11,772</u>)	(<u>\$ 6,251</u>)

本公司選擇對符合短期租賃之房屋建築及符合低價值租賃之辦公設備租賃適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

租賃期間於資產負債表日後開始之所有承租承諾如下：

	112年12月31日	111年12月31日
承諾承租	<u>\$ -</u>	<u>\$ 30,568</u>

十二、其他無形資產

	專 利 權	電 腦 軟 體	合 計
<u>成 本</u>			
112年1月1日餘額	\$ 1,035	\$ -	\$ 1,035
單獨取得	-	1,247	1,247
處 分	(<u>1,035</u>)	-	(<u>1,035</u>)
112年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,247</u>	<u>\$ 1,247</u>
<u>累計攤銷</u>			
112年1月1日餘額	\$ 949	\$ -	\$ 949
攤銷費用	86	140	226
處 分	(<u>1,035</u>)	-	(<u>1,035</u>)
112年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 140</u>	<u>\$ 140</u>
112年12月31日淨額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,107</u>	<u>\$ 1,107</u>
<u>成 本</u>			
111年1月1日餘額	<u>\$ 1,035</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,035</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 1,035</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,035</u>
<u>累計攤銷</u>			
111年1月1日餘額	\$ 776	\$ -	\$ 776
攤銷費用	<u>173</u>	-	<u>173</u>
111年12月31日餘額	<u>\$ 949</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 949</u>
111年12月31日淨額	<u>\$ 86</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 86</u>

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年限計提：

專 利 權	6年
電 腦 軟 體	2至3年

	112年度	111年度
依功能別彙總攤銷費用		
管理費用	\$ 140	\$ -
研發費用	<u>86</u>	<u>173</u>
	<u>\$ 226</u>	<u>\$ 173</u>

十三、其他資產

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
預付款項		
預付貨款	\$ -	\$ 51,013
進項稅額	-	2,247
留抵稅額	2,664	-
其他預付費用	<u>1,176</u>	<u>1,400</u>
	<u>\$ 3,840</u>	<u>\$ 54,660</u>
其他流動資產		
暫付款	<u>\$ 39</u>	<u>\$ 78</u>
<u>非 流 動</u>		
其他非流動資產		
預付設備款	<u>\$ 3,106</u>	<u>\$ 2,000</u>

十四、應付帳款

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>應付帳款</u>		
因營業而發生－非關係人	<u>\$135,482</u>	<u>\$276,811</u>
因營業而發生－關係人	<u>\$ 20,319</u>	<u>\$ 1,689</u>

購買部分商品之平均賒帳期間為 1 至 3 個月，對應付帳款不加計利息。本公司訂有財務風險管理政策，以確保所有應付款於預先約定之信用期限內償還。

十五、其他負債

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>流 動</u>		
其他應付款		
應付薪資及獎金	\$ 54,417	\$ 58,483
應付員工及董監酬勞	39,484	35,863
應付退休金	1,643	658
應付保險費	1,773	1,206
應付休假給付	958	3,896
應付設備款	553	-
其 他	<u>7,908</u>	<u>6,831</u>
	<u>\$106,736</u>	<u>\$106,937</u>

(接次頁)

(承前頁)

	112年12月31日	111年12月31日
其他應付款－關係人	<u>\$ 220</u>	<u>\$ 111</u>
其他負債		
暫收款	\$ -	\$ 31
代收款	<u>802</u>	<u>1,277</u>
	<u>\$ 802</u>	<u>\$ 1,308</u>

十六、負債準備

	112年12月31日	111年12月31日
<u>流動</u>		
保固	<u>\$ 29,087</u>	<u>\$ 24,736</u>

保固負債準備係依銷售商品合約約定，本公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質等因素調整。

十七、退職後福利計畫

確定提撥計畫

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。本公司112及111年度認列之退休金成本為5,200仟元及3,404仟元。

十八、權益

(一) 普通股股本

	112年12月31日	111年12月31日
額定股數(仟股)	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
額定股本	<u>\$500,000</u>	<u>\$500,000</u>
已發行且已收足股款之股數 (仟股)	<u>27,298</u>	<u>22,560</u>
已發行股本	<u>\$272,976</u>	<u>\$225,600</u>

本公司為調整資本結構，分別於 112 年 4 月 7 日及 111 年 5 月 17 日經股東會決議，以未分配盈餘 47,376 仟元及 55,200 仟元辦理轉增資發行新股，經報奉主管機關核准，並分別於 112 年 5 月 12 日及 111 年 6 月 1 日完成變更登記。

111 年 10 月 20 日董事會決議現金增資發行新股 60,000 仟元，每股面額 10 元，並以每股新台幣 22 元溢價發行，增資後實收股本為 225,600 仟元。並經董事會決議，以 111 年 10 月 24 日為增資基準日。

(二) 資本公積

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)</u>		
股票發行溢價	\$ 93,238	\$ 93,238
已失效員工認股權	<u>257</u>	<u>257</u>
	<u>\$ 93,495</u>	<u>\$ 93,495</u>

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二十之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於 112 年 4 月 7 日及 111 年 5 月 17 日舉行股東會，分別決議通過 111 及 110 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案		每 股 股 利 (元)	
	111年度	110年度	111年度	110年度
法定盈餘公積	\$ 20,341	\$ 6,753	\$ -	\$ -
現金股利	45,120	-	2.00	-
股票股利	47,376	55,200	2.10	5.00

本公司 113 年 3 月 4 日董事會擬議 112 年度盈餘分配案如下：

	盈 餘 分 配 案	每 股 股 利 (元)
法定盈餘公積	\$ 22,824	\$ -
特別盈餘公積	385	-
現金股利	122,839	4.5

有關 112 年度之盈餘分配案尚待預計於 113 年 5 月 22 日召開之股東常會決議。

十九、收 入

	112年度	111年度
客戶合約收入		
商品銷貨收入	\$ 1,060,559	\$ 914,800
其他營業收入	102,928	74,627
	<u>\$ 1,163,487</u>	<u>\$ 989,427</u>

	112年12月31日	111年12月31日	111年1月1日
應收帳款	<u>\$ 127,563</u>	<u>\$ 266,414</u>	<u>\$ 59,775</u>
合約負債－預收貨款			
商品銷貨	<u>\$ 762,289</u>	<u>\$ 589,091</u>	<u>\$ 399,838</u>

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當年度認列為收入之金額如下：

	112年度	111年度
來自年初合約負債		
商品銷貨	<u>\$ 492,067</u>	<u>\$ 383,728</u>

二十、稅前淨利

(一) 利息收入

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
銀行存款	\$ 10,192	\$ 951
押金設算息	<u>25</u>	<u>12</u>
	<u>\$ 10,217</u>	<u>\$ 963</u>

(二) 其他收入

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
租賃收入	\$ 720	\$ 742
其他	<u>273</u>	<u>9</u>
	<u>\$ 993</u>	<u>\$ 751</u>

(三) 其他利益及（損失）

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
淨外幣兌換利益	\$ 5,829	\$ 11,561
租賃修改損失	-	(192)
廉價購買利益	1,512	-
其他	<u>(8)</u>	<u>(18)</u>
	<u>\$ 7,333</u>	<u>\$ 11,351</u>

(四) 財務成本

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
銀行借款利息	\$ 39	\$ 11
租賃負債之利息	<u>694</u>	<u>128</u>
	<u>\$ 733</u>	<u>\$ 139</u>

(五) 折舊及攤銷

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	\$ 5,996	\$ 5,426
營業費用	<u>14,908</u>	<u>6,036</u>
	<u>\$ 20,904</u>	<u>\$ 11,462</u>
攤銷費用依功能別彙總		
營業費用	<u>\$ 226</u>	<u>\$ 173</u>

(六) 員工福利費用

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
退職後福利		
確定提撥計畫 (附註十七)	\$ 5,200	\$ 3,404
股份基礎給付		
權益交割 (附註二三)	-	2,038
其他員工福利	<u>223,975</u>	<u>185,497</u>
員工福利費用合計	<u>\$229,175</u>	<u>\$190,939</u>
依功能別彙總		
營業成本	\$ 62,457	\$ 57,084
營業費用	<u>166,718</u>	<u>133,855</u>
	<u>\$229,175</u>	<u>\$190,939</u>

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董監事酬勞前之稅前利益分別以 3% 以上及不高於 3% 提撥員工酬勞及董監事酬勞。112 及 111 年度估列之員工酬勞及董監事酬勞分別於 113 年 3 月 4 日及 112 年 2 月 20 日經董事會決議如下：

估列比例

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
員工酬勞	10%	10%
董監事酬勞	2.5%	2.5%

金額

	<u>112年度</u>		<u>111年度</u>	
	現	金	現	金
員工酬勞	\$ 31,587		\$ 28,691	
董監事酬勞	7,897		7,172	

年度財務報表通過發佈日後若金額有變動，則依會計估計變動處理，於下一年度調整入帳。

111 及 110 年度員工酬勞及董監事酬勞董事會決議之實際配發金額與 111 及 110 年度財務報表之認列金額並無差異。

有關本公司董事會決議之員工酬勞及董監事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二一、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

所得稅費用之主要組成項目如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
當期所得稅		
本年度產生者	\$ 61,563	\$ 51,104
未分配盈餘加徵	3,303	-
以前年度之調整	(4,947)	(2)
投資抵減	<u>(4,945)</u>	<u>-</u>
	<u>54,974</u>	<u>51,102</u>
遞延所得稅		
本年度產生者	(6,834)	(3,477)
以前年度之調整	<u>-</u>	<u>11</u>
	<u>(6,834)</u>	<u>(3,466)</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 48,140</u>	<u>\$ 47,636</u>

會計所得與當期所得稅費用之調節如下：

	<u>112年度</u>	<u>111年度</u>
稅前淨利	<u>\$276,383</u>	<u>\$251,051</u>
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅費用	\$ 55,276	\$ 50,210
免稅所得	(547)	(2,583)
未分配盈餘加徵	3,303	-
以前年度之遞延所得稅費用於 本年度之調整	-	11
以前年度之當期所得稅費用於 本年度之調整	(4,947)	(2)
投資抵減	<u>(4,945)</u>	<u>-</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 48,140</u>	<u>\$ 47,636</u>

(二) 本期所得稅負債

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
本期所得稅負債		
應付所得稅	<u>\$ 35,849</u>	<u>\$ 40,817</u>

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

112 年度

	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認 列 於 損 益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>			
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 1,482	\$ 1,897	\$ 3,379
未實現兌換損益	-	530	530
應付休假給付	779	(587)	192
備抵損失	1,296	1,489	2,785
保固損失	4,947	870	5,817
	<u>\$ 8,504</u>	<u>\$ 4,199</u>	<u>\$ 12,703</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>			
暫時性差異			
未實現兌換損益	(\$ 2,937)	\$ 2,937	\$ -
廉價購買利益	-	(302)	(302)
	<u>(\$ 2,937)</u>	<u>\$ 2,635</u>	<u>(\$ 302)</u>

111 年度

	<u>年 初 餘 額</u>	<u>認 列 於 損 益</u>	<u>年 底 餘 額</u>
<u>遞 延 所 得 稅 資 產</u>			
暫時性差異			
未實現存貨跌價損失	\$ 571	\$ 911	\$ 1,482
未實現兌換損益	835	(835)	-
應付休假給付	549	230	779
備抵損失	135	1,161	1,296
保固損失	-	4,947	4,947
	<u>\$ 2,090</u>	<u>\$ 6,414</u>	<u>\$ 8,504</u>
<u>遞 延 所 得 稅 負 債</u>			
暫時性差異			
未實現兌換損益	\$ -	(\$ 2,937)	(\$ 2,937)

(四) 所得稅核定情形

本公司之營利事業之所得稅申報，除 111 年度外，截至 110 年度以前之申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二二、每股盈餘

單位：每股元

	112年度	111年度
基本每股盈餘	<u>\$ 8.36</u>	<u>\$ 9.84</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 7.96</u>	<u>\$ 9.13</u>

計算每股盈餘時，無償配股之影響業已追溯調整，該無償配股基準日訂於112年5月6日。因追溯調整，111年度基本及稀釋每股盈餘變動如下：

單位：每股元

	追 溯 調 整 前	追 溯 調 整 後
基本每股盈餘	<u>\$ 11.91</u>	<u>\$ 9.84</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 11.06</u>	<u>\$ 9.13</u>

用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利

	112年度	111年度
用以計算基本每股盈餘之淨利	<u>\$ 228,243</u>	<u>\$ 203,415</u>
用以計算稀釋每股盈餘之淨利	<u>\$ 228,243</u>	<u>\$ 203,415</u>

股 數

單位：仟股

	112年度	111年度
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	27,298	20,674
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工酬勞	<u>1,374</u>	<u>1,597</u>
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	<u>28,672</u>	<u>22,271</u>

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二三、股份基礎給付協議

員工認股權計畫

本公司於 111 年 10 月給與員工認股權 600 仟股，給與對象為本公司之員工。

員工認股權之相關資訊如下：

員 工 認 股 權	111年度	
	單 位 (仟)	加 權 平 均 行 使 價 格 (元)
年初流通在外	-	\$ -
本年度給與	600	22
本年度行使	(600)	
年底流通在外	-	
年底可行使	-	
本年度給與之認股權加權平均 公允價值 (元)	\$ 3.3963	

於 111 年度行使之員工認股權，其於行使日之加權平均股價為 22 元。

本公司於 111 年 10 月給與之員工認股權均使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

	111年10月
給與日市價	25.23 元
執行價格	22 元
預期波動率	39.61%
存續期間	30 天
預期股利率	0%
無風險利率	1.157%

111 年度認列之酬勞成本為 2,038 仟元。

二四、現金流量資訊

(一) 非現金交易

除已於其他附註揭露外，本公司於 112 年度進行下列非現金交易之投資活動：

本公司取得不動產、廠房及設備價款截至 112 年 12 月 31 日尚未支付，帳列其他應付款 553 仟元。

(二) 來自籌資活動之負債變動

112年1月1日至12月31日

租賃負債	112年1月1日	現金流量	非現金之變動			其他	112年12月31日
	\$ 21,036	(\$ 8,165)	新增租賃	財務成本	租賃修改		\$ 38,750
			\$ 25,879	\$ 694	(\$ 694)		

111年1月1日至12月31日

租賃負債	111年1月1日	現金流量	非現金之變動			其他	111年12月31日
	\$ 3,965	(\$ 5,574)	新增租賃	財務成本	租賃修改		\$ 21,036
			\$ 14,796	\$ 128	\$ 7,849	(\$ 128)	

二五、資本風險管理

本公司目前營運穩定，資本風險管理目標為確保能夠在繼續經營與成長前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。

本公司採用審慎之風險管理策略並定期審核，依業務發展策略及營運需求做整體性規劃，以決定本公司適當之資本結構。

二六、金融工具

(一) 公允價值資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 金融工具之種類

	112年12月31日	111年12月31日
<u>金融資產</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產 (註1)	\$ 1,085,883	\$ 846,405
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量(註2)	263,559	386,856

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款(含關係人)、其他應收款及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款(含關係人)、其他應付款(含關係人)及其他流動負債等按攤銷後成本衡量之金融負債。

(三) 財務風險管理目的與政策

本公司主要金融工具包括現金及約當現金、應收帳款及應付帳款。上述金融工具與營運有關之財務風險。(包含匯率風險及利率風險)、信用風險及流動性風險。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險(參閱下述(1))以及利率變動風險(參閱下述(2))。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使本公司產生匯率變動暴險。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額，參閱附註三十。

敏感度分析

本公司主要受到美元波動之影響。

下表詳細說明當新台幣(功能性貨幣)對各攸關外幣之匯率增加及減少1%時，本公司之敏感性分析如下。1%係為本公司向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。

	美金貨幣之影響		日幣貨幣之影響	
	112年度	111年度	112年度	111年度
損益	\$ 3,333	\$ 3,483(i)	\$ 9	\$ 207(ii)

(i) 主要源自於本公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之美金貨幣計價銀行存款及應收款項。

(ii) 主要源自於本公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之日幣貨幣計價銀行存款及應付款項。

(2) 利率風險

因本公司內之銀行存款及租賃負債包含以固定及浮動利率計息，因而產生利率暴險。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	112年12月31日	111年12月31日
具公允價值利率風險		
－金融資產	\$ 192,116	\$ -
－金融負債	38,750	21,036
具現金流量利率風險		
－金融資產	761,579	578,770
－金融負債	-	-

敏感度分析

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之負債金額於報導期間皆流通在外。本公司向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 25 基點，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加／減少 25 基點，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 112 及 111 年度之稅前淨利將分別增加／減少 1,904 仟元及 1,447 仟元。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於：

- (1) 資產負債表所認列之金融資產帳面金額。
- (2) 本公司提供財務保證所產生之或有負債金額。

本公司採行之政策係僅與信譽卓著之對象進行交易，並於必要情形下取得足額之擔保以減輕因拖欠所產生財務損失之風

險。為減輕信用風險，本公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此，本公司管理階層認為公司之信用風險已顯著減少。故該信用風險係屬有限。

本公司之信用風險主要係集中於本公司當年度最大客戶，截至 112 年及 111 年 12 月 31 日止，總應收帳款來自前述客戶之比率分別 26% 及 11%。

3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。截至 112 及 111 年度止，本公司未動用之短期銀行融資額度，參閱下列(2)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

112 年 12 月 31 日

	短於 1 年	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合 計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 155,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,801
其他應付款	106,956	-	-	-	106,956
租賃負債	10,065	10,122	8,579	11,443	40,209
其他流動負債	802	-	-	-	802
	<u>\$ 273,624</u>	<u>\$ 10,122</u>	<u>\$ 8,579</u>	<u>\$ 11,443</u>	<u>\$ 303,768</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於 1 年	1 ~ 2 年	2 ~ 3 年	3 ~ 5 年	5 年以上
租賃負債	<u>\$ 10,065</u>	<u>\$ 10,122</u>	<u>\$ 8,579</u>	<u>\$ 11,443</u>	<u>\$ -</u>

111年12月31日

	短於1年	1至2年	2至3年	3年以上	合計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 278,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,500
其他應付款	107,048	-	-	-	107,048
租賃負債	3,349	3,479	3,537	11,821	22,186
其他流動負債	1,308	-	-	-	1,308
	<u>\$ 390,205</u>	<u>\$ 3,479</u>	<u>\$ 3,537</u>	<u>\$ 11,821</u>	<u>\$ 409,042</u>

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	短於1年	1~2年	2~3年	3~5年	5年以上
租賃負債	<u>\$ 3,349</u>	<u>\$ 3,479</u>	<u>\$ 3,537</u>	<u>\$ 7,881</u>	<u>\$ 3,940</u>

(2) 融資額度

	112年12月31日	111年12月31日
無擔保銀行借款額度 (雙方同意下得展期)		
— 已動用金額	\$ -	\$ -
— 未動用金額	<u>130,000</u>	<u>50,000</u>
	<u>\$ 130,000</u>	<u>\$ 50,000</u>

二七、關係人交易

本公司之母公司為家登精密工業股份有限公司，於112年及111年12月31日分別持有本公司普通股46.83%及50.10%。

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)	母公司
昇和精技股份有限公司(以下簡稱昇和公司)	子公司
Gudeng Inc.(以下簡稱家登美國公司)	關聯企業
家崎科技股份有限公司(以下簡稱家崎公司)	兄弟公司
上海家登貿易有限公司(以下簡稱上海家登公司)	兄弟公司
堯鉉系統科技股份有限公司(以下簡稱堯鉉公司)	實質關係人
鍊恩帕斯科技股份有限公司(以下簡稱鍊恩帕斯公司)	實質關係人

(二) 營業收入

帳列項目	關係人名稱	112年度	111年度
銷貨收入	家登公司	\$ 367	\$ 1,672
	上海家登公司	<u>58</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 425</u>	<u>\$ 1,672</u>

本公司對關係人之銷貨價格與一般客戶相當。

(三) 進 貨

關 係 人 名 稱	112年度	111年度
家登公司	\$ 10,578	\$ 10,353
家登美國公司	-	105
昇和公司	2,799	-
家崎公司	231	-
堯鉸公司	19,882	-
銖恩帕斯公司	33,350	-
	<u>\$ 66,840</u>	<u>\$ 10,458</u>

本公司進貨之商品主要係屬客製化規格之產品，並無可比較對象。

(四) 應收關係人款項

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年12月31日	111年12月31日
應收帳款－關係人	家登公司	<u>\$ -</u>	<u>\$ 101</u>

流通在外之應收關係人款項未收取保證。111年度應收關係人款項並未提列預期信用減損損失。

(五) 應付關係人款項

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年12月31日	111年12月31日
應付帳款－關係人	家登公司	\$ 2,046	\$ 1,689
	昇和公司	542	-
	堯鉸公司	3,344	-
	銖恩帕斯公司	14,387	-
		<u>\$ 20,319</u>	<u>\$ 1,689</u>
其他應付款－關係人	家登公司	<u>\$ 220</u>	<u>\$ 111</u>

流通在外之應付關係人款項餘額係未提供擔保。

(六) 取得之不動產、廠房及設備

關 係 人 名 稱	取得價款	
	112年度	111年度
家登公司	<u>\$ 1,340</u>	<u>\$ -</u>

(七) 承租協議

關係人名稱	112年度	111年度
<u>取得使用權資產</u>		
家登公司	<u>\$ 17,045</u>	<u>\$ -</u>

帳列項目	關係人名稱	112年12月31日	111年12月31日
租賃負債	家登公司	<u>\$ 13,754</u>	<u>\$ -</u>

關係人名稱	112年度	111年度
<u>利息費用</u>		
家登公司	<u>\$ 271</u>	<u>\$ 35</u>

本公司於 112 年 1 月 1 日向家登公司承租建築物做為廠房及辦公室使用，租賃期間均為 5 年，租金係參考類似資產之租金水準，並依租約按月支付固定租賃給付。

(八) 取得其他資產

關係人名稱	帳列項目	取 得 價 款	
		112年度	111年度
家登美國公司	採用權益法之投資	\$ 6,448	\$ -

本公司參與家登美國公司 112 年度現金增資案，產生廉價購買利益 1,512 仟元。

(九) 其他關係人交易

1. 租金支出

帳列項目	關係人名稱	112年度	111年度
營業費用	家登公司	\$ 20	\$ 12
	家登美國公司	<u>62</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 82</u>	<u>\$ 12</u>
製造費用	家登公司	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>

租金係依一般市場行情簽訂契約，並依租約按月支付。

2. 其他費用

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年度	111年度
營業費用	家登公司	\$ 1,789	\$ 302
	家登美國公司	166	-
	上海家登公司	89	-
		<u>\$ 2,044</u>	<u>\$ 302</u>
製造費用	家登公司	<u>\$ 1,280</u>	<u>\$ 488</u>

3. 其他收入

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年度	111年度
利息收入	家登公司	<u>\$ 9</u>	<u>\$ 9</u>
租賃收入	昇和公司	<u>\$ 720</u>	<u>\$ 720</u>

4. 其他資產及負債

帳 列 項 目	關 係 人 名 稱	112年12月31日	111年12月31日
存出保證金	家登公司	<u>\$ 596</u>	<u>\$ 669</u>
合約負債	家登公司	\$ 13,500	\$ 96
	上海家登	18,419	-
		<u>\$ 31,919</u>	<u>\$ 96</u>

(十) 主要管理階層薪酬

	112年度	111年度
短期員工福利	<u>\$ 48,183</u>	<u>\$ 33,007</u>
股份基礎給付	<u>-</u>	<u>2,038</u>
	<u>\$ 48,183</u>	<u>\$ 35,045</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會（於 112 年 5 月 31 日設置）依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、重大或有負債及未認列之合約承諾：

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

重大承諾

本公司未認列之合約承諾如下：

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
購置不動產、廠房及設備	<u>\$ 1,155</u>	<u>\$ 6,018</u>

二九、重大之期後事項：無。

三十、具重大影響之外幣資產及負債資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

112年12月31日

<u>外幣資產</u>	<u>外</u>	<u>幣</u>	<u>匯</u>	<u>率</u>	<u>帳面金額</u>
<u>貨幣性項目</u>					
美 元	\$ 10,854		30.705	(美元：新台幣)	\$ 333,266
日 圓	23,049		0.2172	(日圓：新台幣)	5,006
歐 元	35		33.98	(歐元：新台幣)	<u>1,175</u>
					<u>\$ 339,447</u>
<u>非貨幣性項目</u>					
採權益法之關聯企業					
美 元	246		30.705	(美元：新台幣)	<u>\$ 7,543</u>
<u>外幣負債</u>					
<u>貨幣性項目</u>					
日 圓	19,000		0.2172	(日圓：新台幣)	\$ 4,127
歐 元	8		33.98	(歐元：新台幣)	<u>285</u>
					<u>\$ 4,412</u>

111年12月31日

外幣資產	外幣	匯率	帳面金額
<u>貨幣性項目</u>			
美元	\$ 11,341	30.71 (美元：新台幣)	\$ 348,282
日圓	88,884	0.2324 (日圓：新台幣)	20,657
歐元	34	32.72 (歐元：新台幣)	1,112
			<u>\$ 370,051</u>

具重大影響之外幣兌換損益（未實現）如下：

外幣	112年度		111年度	
	匯率	淨兌換(損)益	匯率	淨兌換(損)益
美元	30.705 (美元：新台幣)	(\$ 2,471)	30.71 (美元：新台幣)	\$ 15,866
日圓	0.2172 (日圓：新台幣)	(263)	0.2324 (日圓：新台幣)	(1,178)
歐元	33.98 (歐元：新台幣)	35	32.72 (歐元：新台幣)	(2)
		<u>(\$ 2,699)</u>		<u>\$ 14,686</u>

三一、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊及(二)轉投資事業相關資訊：

編號	項	目	說明
1	資金貸與他人。		無
2	為他人背書保證。		無
3	期末持有有價證券情形。(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)		無
4	累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。		無
5	取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。		無
6	處分不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上。		無
7	與關係人進、銷貨之金額達新台幣1億元或實收資本額20%以上。		無
8	應收關係人款項達1億元或實收資本額20%以上。		無
9	從事衍生性商品交易。		無
10	被投資公司資訊		附表一

(三) 大陸投資資訊

編號	項	目	說	明
1	大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、本期損益及認列之投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。			無
2	與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益：			
	(1)進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比。			無
	(2)銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比。			無
	(3)財產交易金額及其所產生之損益數額。			無
	(4)票據背書保證或提供擔保品之期末餘額及其目的。			無
	(5)資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額。			無
(6)其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等。			無	

(四) 主要股東資訊：股權比例達 5% 以上之股東名稱、持股數額及比例。

(附表二)

家碩科技股份有限公司
 (原名：家登自動化股份有限公司)
 被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊
 民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：除股數外，為新台幣及外幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末		持有	被投資公司	本期認列之	備註
				本期	期末	去年	年底				
家碩科技股份有限公司	昇和精技股份有限公司	新竹縣竹北市復興三路二段 106 號	半導體與面板的 PVD 真空技術相關機台設計及改造	\$ 70,000	\$ 70,000	3,451,424	100	\$ 69,897	\$ 3,576	\$ 2,733	註
家碩科技股份有限公司	Gudeng Inc.	1798 Technology DR, #298 San Jose, CA, 95110	經營各種電子零組件業務	USD 208 (6,448)	USD -	208,000	4	7,543	USD 558 (17,050)	(32)	註

註：被投資公司本期(損)益及本期認列之投資(損)益係經會計師查核之金額。

家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)

主要股東資訊

民國 112 年 12 月 31 日

附表二

主 要 股 東 名 稱	股 份	
	持 有 股 數	持 股 比 例
家登精密工業股份有限公司	12,782,268	46.83%
士大投資有限公司	1,713,422	6.28%
詹印豐	1,503,771	5.51%

註 1：本表主要股東資訊係以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5% 以上資料。本公司個體財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

附件五

內部控制制度聲明書

家碩科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期 113 年 03 月 04 日

本公司民國 112 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 112 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開發行說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法之情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 113 年 03 月 04 日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

家碩科技股份有限公司

董事長：邱銘乾

簽章

總經理：詹印豐

簽章



家碩科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期 112 年 11 月 7 日

本公司民國 111 年 10 月 1 日至 112 年 9 月 30 日之內部控制制度，依據自行評估結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度，其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變，惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業，每個組成要素又包括若干項目，前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 112 年 09 月 30 日之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、為申請股票上櫃之需要，本公司依據「處理準則」第二十五條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查有價證券上櫃作業程序」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與外部財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下逕行取得、使用或處分之重大缺失。
- 七、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開，上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法之情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 八、本聲明書業經本公司民國 112 年 11 月 7 日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

家碩科技股份有限公司

董事長：邱銘乾

簽章



總經理：詹印豐

簽章



附件六

內部控制制度審查報告

內部控制制度審查 會計師合理確信報告

家碩科技股份有限公司 公鑒：

家碩科技股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 112 年 9 月 30 日之設計及執行情形及於民國 112 年 11 月 7 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 112 年 9 月 30 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行必要程序竣事。確信標的、確信標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊分別為家碩科技股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 112 年 9 月 30 日之設計及執行情形及家碩科技股份有限公司於民國 112 年 11 月 7 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 112 年 9 月 30 日係有效設計及執行之聲明書，詳附件。

用以衡量或評估上開確信標的及標的資訊之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故家碩科技股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的及標的資訊執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的及標的資訊在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則 1 號「會計師事務所之品質管理」，該品質管理準則規定會計師事務所設計、付諸實行及執行品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及適用之法令規範相關之政策或程序。

所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關標的及標的資訊之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他確信程序。

確信結論

依本會計師意見，家碩科技股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 112 年 9 月 30 日之設計及執行，在所有重大方面已遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性；家碩科技股份有限公司於民國 112 年 11 月 7 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面係屬允當表達。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 曾 建 銘



會計師 王 攀 發



中 華 民 國 112 年 12 月 20 日

附件七

證券承銷商評估總結意見

承銷商總結意見

家碩科技股份有限公司(以下簡稱該公司或家碩公司)本次為辦理初次上櫃現金增資發行普通股2,717千股，每股面額新臺幣壹拾元整，發行總額為新臺幣27,170千元整，依法向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，家碩公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

元大證券股份有限公司



負責人：陳修偉



承銷部門主管：林佩宸



中 華 民 國

113

年

3

月

7

日

附件八

律師法律意見書

律師法律意見書

家碩科技股份有限公司本次為申請股票上櫃，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請股票上櫃。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查有價證券上櫃作業程序」、「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心初次申請上櫃用之公開說明書應行記載事項準則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，家碩科技股份有限公司本次向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，並未發現有違反法令致影響股票上櫃之情事。

此致

家碩科技股份有限公司

翰辰法律事務所
邱雅文律師



中華民國 112 年 12 月 27 日

律師法律意見書

家碩科技股份有限公司(以下稱該公司) 本次為辦理現金增資發行普通股 2,717,000 股，每股面額新台幣壹拾元，發行總金額為新台幣 27,170,000 元，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，該公司本次向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

家碩科技股份有限公司

翰辰法律事務所

邱雅文律師



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 27 日

附件九

不得退還或收取承銷相關費用聲明書

聲明書

本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

發行人：家碩科技股份有限公司



負責人：邱銘乾



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

聲明書

本公司為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之法人董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事：家登精密工業股份有限公司



負責人：邱銘乾



中華民國 113 年 3 月 27 日

聲明書

本人為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之法人董事代表人，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事代表人：邱銘乾



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

聲明書

本人為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之法人董事代表人，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事代表人：林添瑞



中 華 民 國 113 年 3 月 29 日

聲明書

本人為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之董事暨總經理，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事暨總經理：詹印豐

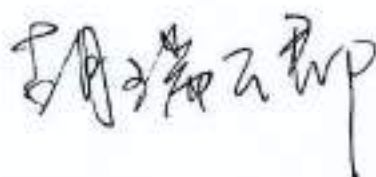


中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

聲明書

本人為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董事：胡瑞卿



中華民國 113 年 3 月 27 日

聲明書

本人為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：李文中



中 華 民 國

113

年

3

月

27

日

聲明書

本人為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：陳瑞杏

陳瑞杏

中 華 民 國

112 年


3 月

12 日

聲明書

本人為家碩科技股份有限公司(下稱「該公司」)之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：林秀怡



中 華 民 國

113

年

3

月

27

日

聲明書

本人為家碩股份有限公司(下稱「該公司」)之經理人，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：陳毓正

陳毓正

莊少杰

莊少杰

王安邦

王安邦

杜林焯

杜林焯

石惠文

石惠文

聲明書

本公司受家碩科技股份有限公司(下稱該公司)委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、該公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司



負責人：陳修偉



中華民國

113

年

3

月

27

日

聲明書

本公司受家碩科技股份有限公司(下稱該公司)委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、該公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

負責人：羅瑞燕



中華民國 113 年 3 月 27 日

聲明書

本公司受家碩科技股份有限公司(下稱該公司)委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、該公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：永豐金證券股份有限公司

負責人：朱士廷



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

聲明書

本公司受家碩科技股份有限公司(下稱該公司)委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、該公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



協辦證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：方維昌



中華民國 1 1 3 年 4 月 27 日

附件十

無非常規交易情事之聲明書

聲 明 書

本公司聲明與集團企業公司(詳附件)間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後若有財務、業務往來時，將依本公司所訂之各項管理制度規章正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公司名稱：家碩科技股份有限公司



代 表 人：邱銘乾

中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

附件

	有交易者：	無交易者：
1	家登精密工業股份有限公司	家登創業投資股份有限公司
2	家崎科技股份有限公司	Rich Point Global Corp.
3	Gudeng Inc.(USA)	Partner one Ltd.
4	上海家登貿易有限公司	家宇航太股份有限公司
5	昇和精技股份有限公司	家碩建設股份有限公司
6		恆陽綠能股份有限公司
7		Sun Park Development Limited
8		Gudeng Investment Co., Ltd.
9		蘇州瑩鉅貿易有限公司 (已於112年9月14日註銷登記)
10		Gudeng Investment (HK)
11		富瑞昇實業股份有限公司
12		碩頂精密工業股份有限公司
13		柏升工業股份有限公司

聲 明 書

本公司聲明與家碩科技股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來，並無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：家登精密工業股份有限公司



代 表 人：邱銘乾



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

聲 明 書

本公司聲明與家碩科技股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來，並無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：家崎科技股份有限公司



代 表 人：邱銘乾

中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

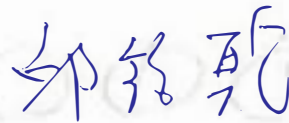
聲 明 書

本公司聲明與家碩科技股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來，並無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：Gudeng Inc.(USA)

代 表 人：邱銘乾



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

聲 明 書

本公司聲明與家碩科技股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來，並無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：上海家登貿易有限公司

代 表 人：邱銘乾



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

聲 明 書

本公司聲明與家碩科技股份有限公司間有財務、業務往來，並無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：昇和精技股份有限公司



代 表 人：詹印豐



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

附件十一

不受理特定對象投標聲明書

聲 明 書

茲聲明本公司本次辦理初次上櫃前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售時之推薦證券商。
- 十、股票申請創新版初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 十一、前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。

特此聲明

此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

家碩科技股份有限公司

負責人：邱銘乾



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

聲 明 書

茲聲明本公司本次辦理家碩科技股份有限公司初次上櫃前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售時之推薦證券商。
- 十、股票申請創新版初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 十一、前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。

特此聲明

此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

聲 明 書

茲聲明本公司本次辦理家碩科技股份有限公司初次上櫃前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售時之推薦證券商。
- 十、股票申請創新板初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 十一、前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。

特此聲明
此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

合作金庫證券股份有限公司

負責人：羅瑞燕



中 華 民 國

113

年

3

月

27

日

聲 明 書

茲聲明本公司本次辦理家碩科技股份有限公司初次上櫃前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售時之推薦證券商。
- 十、股票申請創新版初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 十一、前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。

特此聲明
此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

永豐金證券股份有限公司

負責人：朱士廷



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

聲 明 書

茲聲明本公司本次辦理家碩科技股份有限公司初次上櫃前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

- 一、發行公司(發行機構)採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司(發行機構)之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司(發行機構)之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
- 四、受發行公司(發行機構)捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司(發行機構)之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
- 八、承銷團各證券商。
- 九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市(櫃)公開銷售時之推薦證券商。
- 十、股票申請創新版初次上市案件未具第四十三條之一第二項所訂合格投資人資格者。
- 十一、前各款之人利用他人名義參與應募者(指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人)。

特此聲明
此 致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

凱基證券股份有限公司

負責人：方維昌



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

附件十二

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

申請人：家碩科技股份有限公司

負責人：邱銘乾



中華民國 112 年 12 月 21 日

本公司為家碩科技股份有限公司之法人董事及持股超過百分之十之大股東，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

法人董事：家登精密工業股份有限公司

負責人：邱銘乾



中華民國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之法人董事代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

法人董事：家登精密工業股份有



法人董事代表人：邱銘乾



中華民國 112 年 12 月 29 日

本人為家碩科技股份有限公司之法人董事代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

法人董事：家登精密工業股份有限公司



法人董事代表人：林添瑞 林添瑞

中華民國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之董事暨總經理，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

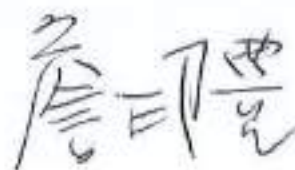
二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事暨總經理：詹印豐



中華民國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事：胡瑞卿



中華民國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

獨立董事：

中華民國 112 年 12 月 29 日

本人為家碩科技股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

獨立董事：陳瑞杏

陳瑞杏

中華民國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

獨立董事：林秀怡



中華民國 112 年 12 月 29 日

本人為家碩科技股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。


- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

經理人：陳毓正



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

經理人：莊少杰



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

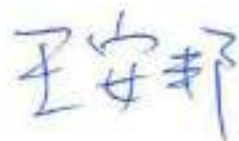
- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

經理人：王安邦



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

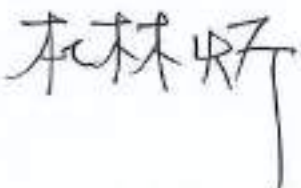
- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

經理人：杜林忻



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。


- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

經理人：石惠文



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本人為家碩科技股份有限公司之受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

受僱人：羅儀珊 

中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷家碩科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司



負責人：陳 修 偉



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷家碩科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

負責人：呂瑞齡



中華民國 112 年 12 月 27 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷家碩科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦證券承銷商：永豐金證券股份有限公司

負責人：朱士廷



中華民國 112 年 12 月 27 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷家碩科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：方 維 昌



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

本會計師承辦家碩科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師：曾建銘



會計師：王攀發



中華民國 112 年 12 月 27 日

本律師承辦家碩科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

律師事務所：翰辰法律事務所

律師：邱雅文



中華民國 112 年 12 月 27 日

本律師承辦家碩科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

律師事務所：莊植焜律師事務所

律師：莊 植 焜



中 華 民 國 112 年 12 月 27 日

附件十三

與本次發行有關之決議文



家碩科技股份有限公司
第三屆第五次董事會議事錄(節錄本)

時間：中華民國一一二年四月十四日(星期五)下午一時三十分

地點：新北市土城區中央路四段二號九樓南華山廳

出席董事：邱銘乾董事、林添瑞董事、詹印豐董事、胡瑞卿董事、林雅文董事，共計五席。

請假董事：無

列席監察人：王彩樺監察人、沈恩年監察人，共計二席。

其他列席人員：石惠文財務暨會計主管、阮淨稽核主管

主席：邱銘乾董事長

記錄：蔡欣芳



一、宣佈開會：出席已達法定人數，依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：(略)

四、討論事項

(一)上次會議保留之討論事項：無

(二)本次會議討論事項：

第一案：(略)

第二案

案由：申請股票上櫃案，提請討論。

說明：1、本公司擬申請股票上櫃，並授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃申請。

2、以上，提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案由：初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案，提請 討論。

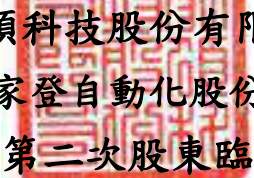
- 說明：1、本公司為配合上櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
- 2、本次增資擬依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購，員工放棄之部分，擬授權董事長洽特定人認足。
- 3、除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%由原股東按持股比例認購之部分，擬提請股東臨時會同意放棄公司法第 267 條第 3 項關於原股東優先認購之權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。
- 4、本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。
- 5、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
- 6、本次增資發行之普通股俟股東臨時會通過後，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日。
- 7、依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司增資新股之承銷方式，擬提請股東臨時會授權董事會視市場狀況決定之。
- 8、本案經董事會核議後，提請股東臨時會討論。
- 9、以上，提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案 ~ 第十七案：(略)

五、臨時動議：無

六、散會。


家碩科技股份有限公司
(原名：家登自動化股份有限公司)
一一二年第二次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：民國一一二年五月三十一日(星期三)下午一時整

地點：新竹縣竹北市復興三路二段 106 號(本公司會議室)

出席股東：本公司已發行股份總數 22,560,000 股，出席股東及代理人所代表之股份為 21,940,297 股，佔本公司已發行股份總數 97.25%。

出席董事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾董事、家登精密工業(股)公司代表人林添瑞董事、胡瑞卿董事、詹印豐董事

列席：勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師

主席：邱銘乾



記錄：蔡欣芳



一、宣布開會：出席股東及代理人代表之股數已達法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

報告案一

案由：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告，敬請 鑑察。

說明：為導引本公司董事、審計委員會及經理人行為符合道德標準，並建立良好商業運作架構，擬訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」，請參閱附件一至附件五。

四、討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案，謹提請 討論。

說明：(一) 本公司為配合上櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。

(二) 本次增資擬依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購，員工放棄之部分，擬授權董事長洽特定人認足。

(三) 除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%由原股東按持股比例認購之部分，擬提請股東臨時會同意放棄公司法第 267 條第 3 項關於原股東優先認購之權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。

(四) 本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。

(五) 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

(六) 本次增資發行之普通股俟股東臨時會通過後，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日。

(七) 依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司增資新股之承銷方式，擬提請股東臨時會授權董事會視市場狀況決定之。

(八) 謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數 21,940,297 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 21,940,297 權	100.00%
反對權數 0 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司第四屆董事改選案，謹提請 討論。

說明：(一) 本公司第三屆董事及監察人任期自 111 年 5 月 17 日至 114 年 5 月 16 日止，為配合實際營運需要，擬提前全面改選董監事，現任董事及監察人於新任董事選任後解任。

(二) 本公司擬依證券交易法設置審計委員會，依法應不設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。

(三) 本次選舉案擬選出第四屆董事七席(含獨立董事三席)，其中，獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。新任董事任期自 112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日止，共計三年，連選得連任。

(四) 獨立董事候選人名單，請參閱附件六。

(五) 謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾	24,340,297 權
1	家登精密工業股份有限公司 代表人：林添瑞	22,208,297 權
2	詹印豐	22,182,383 權
A2204*****	胡瑞卿	22,070,731 權

獨立董事當選名單

戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	得票權數
F1214*****	李文中	21,009,863 權
A2210*****	林秀怡	20,898,211 權
A2210*****	陳瑞杏	20,872,297 權

六、其他議案

第一案

董事會提

案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：(一) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

(二) 擬提請股東臨時會同意本公司新任董事及其代表人之行為於無損及本公司利益下，解除其競業禁止之限制，本次董事候選人兼任情形如下：

董事名稱	解除競業禁止限制內容
家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾	家登精密工業(股)公司 董事長 家崎科技(股)公司 董事長 家碩建設(股)公司 法人代表董事長 恆陽綠能(股)公司 法人代表董事長 家登創業投資(股)公司 法人代表董事 富瑞昇實業(股)公司 法人代表董事長 柏升工業(股)公司 法人代表董事長 碩頂精密工業(股)公司 法人代表董事 愛思分析儀器(股)公司 董事 迅得機械(股)公司 法人代表董事 上海家登貿易有限公司 代表人 蘇州堃鉅貿易有限公司 執行董事 Gudeng INC 代表人 Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人 Partner one Limited 董事長
家登精密工業股份有限公司 代表人：林添瑞	家登精密工業(股)公司 副董事長 家崎科技(股)公司 董事 家登創業投資(股)公司 法人代表董事長 富瑞昇實業(股)公司 法人代表董事 柏升工業(股)公司 法人代表董事 碩頂精密工業(股)公司 法人代表董事 愛思分析儀器(股)公司 監察人 蘇州堃鉅貿易有限公司 監事 Gudeng Investment Limited(HK) 董事長 Sun Park Development Limited 代表人

董事名稱	解除競業禁止限制內容
詹印豐	昇和精技(股)公司 董事長 台林電通(股)公司 獨立董事 瑞峰半導體(股)公司 監察人
胡瑞卿	瀟杰(股)公司 法人代表董事長 祥誠科技(股)公司 法人代表董事長 公信電子(股)公司 獨立董事
李文中	中華國際聯合法律事務所 主持律師/所長 輔仁大學法律系 兼任助理教授 桃園汽車客運(股)公司 法人常務董事代表人 豐運通開發有限公司 負責人 中玲投資有限公司 負責人
陳瑞杏	三商投資控股(股)公司 董事長特助 三商行(股)公司 董事長特助 三商餐飲(股)公司 監察人 三友藥妝(股)公司 法人董事代表人 心樸市集(股)公司 法人監察人代表人
林秀怡	怡睿國際法律事務所 主持律師 實億投資(股)公司 監察人

(三) 謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數 21,940,297 權


表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 21,940,297 權	100.00%
反對權數 0 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無

八、散會：下午一時二十四分

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)



家碩科技股份有限公司
第四屆第三次董事會議事錄(節錄本)

時間：中華民國一一二年十一月七日(星期二)下午三時整

地點：新北市土城區中央路四段二號九樓玉山廳

<https://us02web.zoom.us/j/89438841181?pwd=RitSTEJINmJZTUlaOEI0SnI4Ykhwdz09>

出席董事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾董事、詹印豐董事、胡瑞卿董事、李文中獨立董事、陳瑞杏獨立董事、林秀怡獨立董事(以上親自出席)、家登精密工業(股)公司代表人林添瑞董事(視訊方式出席)，共計七席。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師、元大證券陳秀梅副總、鍾志豪資深經理及葉玟秀專員、石惠文財務暨會計主管、羅儀珊稽核主管。

主席：邱銘乾董事長

記錄：陳曉婷

一、宣佈開會：出席已達法定人數，依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：(略)

四、討論事項

(一)上次會議保留之討論事項：無

(二)本次會議討論事項：

第一案~第十四案及第十六案：(略)

第十五案

案由：本公司與主辦證券承銷商元大證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案，提請討論。

說明：1、為配合上櫃掛牌後執行價格穩定措施，依據中華民國證券商業同業公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，應於申請上市(櫃)前與主辦推薦證券商元大證券(股)公司，簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」，以辦理特定股東集保及過額配售相關事宜，惟後續相關法令更新時，擬授權董事長代為處理相關事宜。

2、本公司與元大證券(股)公司簽訂之「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」，

請參閱附件十六。

3、擬請董事會授權董事長協調公司股東及特定股東辦理過額配售及特定股東集保事宜。

4、以上，提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會。


家碩科技股份有限公司
第四屆第五次董事會議事錄(節錄本)

時 間：中華民國一一三年三月二十六日(星期二)下午二時三十分

地 點：新北市土城區中央路四段二號九樓玉山廳

出席董事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾董事及林添瑞董事、詹印豐董事、胡瑞卿董事、李文中獨立董事、陳瑞杏獨立董事、林秀怡獨立董事，共計七席。

其他列席人員：元大證券鍾志豪資深經理及葉政秀專員、石惠文財務暨會計主管。

主 席：邱銘乾董事長

記 錄：石惠文 

一、宣佈開會：出席已達法定人數，依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：(略)

四、討論事項

(一)上次會議保留之討論事項：無

(二)本次會議討論事項：

第一案 (審計委員會提)

案 由：初次上櫃掛牌前現金增資案，提請 討論。

說 明：1、本公司股票初次上櫃申請案，業經證券櫃檯買賣中心於113年2月21日上櫃審議委員會及113年3月22日董事會決議通過。

2、本公司業於112年5月31日股東臨時會決議通過初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購案，作為初次上櫃前提出公開承銷之新股來源，並授權董事會處理發行新股相關事宜。

3、本公司擬辦理現金增資發行普通股2,717千股，每股新台幣10元，計新台幣27,170千元，每股發行價格暫定以新台幣215元溢價發行，預計募集總金額為新台幣584,155千元，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

4、本次現金增資發行計畫之資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益，請參閱附件二。

5、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計407千股由員工認購外，其餘85%計2,310千股依證券交易法第28

條之1規定及本公司112年5月31日股東臨時會決議，由原股東放棄認購權利，以供推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。

- 6、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。
- 7、本次現金增資案係主管機關申報生效後，授權董事長訂定員工認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。
- 8、本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資金總額、資金來源、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理之。
- 9、本案經審計委員會審議通過後，提請董事會決議。
- 10、本案經董事會決議後，將報呈主管機關申請，後續依相關法令辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案 - 第三案：(略)

五、臨時動議：無

六、散會。

附件十四

盈餘分配表

家碩科技股份有限公司
一一二年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
民國 111 年期末分配盈餘	100,920,428
加：本期稅後淨利	228,243,080
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(22,824,308)
減：依法提列特別盈餘公積	(384,907)
截至民國 112 年底可分配保留盈餘	305,954,293
分配項目	
普通股現金股利 (每股新台幣 4.5 元)	122,839,200
期末未分配保留盈餘	183,115,093

董事長：邱銘乾



經理人：詹印豐



會計主管：石惠文



附件十五

公司章程及新舊條文對照表

家碩科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「家碩科技股份有限公司」。

本公司英文名稱為Gudeng Equipment Co., LTD.。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CQ01010 模具製造業。
2. C805050 工業用塑膠製品製造業。
3. CC01080 電子零組件製造業。
4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
5. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
6. F106030 模具批發業。
7. F119010 電子材料批發業。
8. F206030 模具零售業。
9. F219010 電子材料零售業。
10. H701010 住宅及大樓開發租售業。
11. H701020 工業廠房開發租售業。
12. E604010 機械安裝業。
13. E603050 自動控制設備工程業。
14. CB01010 機械設備製造業。
15. CB01990 其他機械製造業。
16. E599010 配管工程業。
17. E401010 國際貿易業。
18. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資，不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。另就業務上之需要，經董事會決議通過，得對外提供背書及保證。

第四條：本公司設總公司於新北市，必要時得於其他適當地點設立分支機構，其設立及裁撤由董事會決定之。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。其中得保留新台幣伍仟萬元整，分為伍佰萬股，供發行員工認股權時使用。本公司員工認股權憑證發給對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股東常會開會前三十日內，或股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股東名簿記載之變更。

本公司股票於公開發行後，股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第九條：本公司股東會分常會及臨時會兩種，股東常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，股東臨時會於必要時依法召集之。

股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。股東會開會通知應載明開會日期、地點及召集事由，其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十條：本公司股東除有公司法一百七十九條之情事外，每股有一表決權。

本公司股票登錄興櫃後，於召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十一條：股東會之主席由董事長任之，董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條：股東不能出席股東會者，得出具委託書，載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。

本公司股票公開發行後，股東委託出席之辦法及委託書之使用，除依公司法相關規定外，另依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十四條：股東會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，於本公司股票公開發行後，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事五至七人，監察人二人組織董事會，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。

本公司股票公開發行後，全體董事及監察人合計持股比例，應依證券主管機關之規定。

本公司股票公開發行後，得選任獨立董事人數至少三人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司股票公開發行後，得依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會及其成員負責執行相關法令規定之監察人職權。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依「公

開發行公司審計委員會行使職權辦法」相關規定，以審計委員會組織章程另訂之，審計委員會成立後替代監察人職務。

本公司股票登錄興櫃後，董事選舉採候選人提名制度。

董事及監察人於任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十七條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條之規定辦理。

第十八條：董事會之召集應載明事由，於法定日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集通知得以書面或傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第十九條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第二十條：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得出具委託書列明授權範圍委託其他董事代理之，前項代理人，以受一人委託為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊會議參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：董事會得決議支給董事及監察人相當之交通費或其他津貼；另董事及監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之。

第五章 經 理 人

第二十二條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第二十三條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第二十四條：本公司年度如有獲利，應提撥3%以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董監酬勞。

員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

第二十五條：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，次再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。再依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，連同上年度累積未分配盈餘

由董事會評估未來營運計畫所需資金部分予以保留後，擬具盈餘分派議案提請股東會議定之。

本公司股利之政策，應配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，作為股利發放之依據。股利發放提撥之數額不低於當年度可供分配盈餘之百分之十，得以股票股利或現金股利之方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。

本公司股票公開發行後，本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用相關股東會決議之規定。

第七章 附 則

第二十六條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第二十七條：本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。

第二十八條：本章程訂立於中華民國105年06月22日。

第一次修訂於民國105年08月01日。

第二次修訂於民國108年05月30日。

第三次修訂於民國110年07月28日。

第四次修訂於民國111年05月17日。

第五次修訂於民國112年01月31日。

家碩科技股份有限公司

董事長：邱銘乾



家碩科技股份有限公司

(原名稱：家登自動化股份有限公司)

Gudeng Equipment Co., Ltd.

公司章程修正條文對照表

現行條文	修正後條文	修正原因
第一條： 本公司依照 <u>公司法股份有限公司之規定</u> 組織之，定名為「 <u>家登自動化股份有限公司</u> 」。	第一條： 本公司依照 <u>公司法</u> 規定組織之，定名為「 <u>家碩科技股份有限公司</u> 」。 <u>本公司英文名稱為 Gudeng Equipment Co., LTD.。</u>	1. 依實務需求變更公司名稱。 2. 新增公司英文名稱。
第三條： 本公司轉投資，不受 <u>公司法第十三條</u> 所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。另就業務上之需要，經董事會決議通過，得對外提供保證。	第三條： 本公司轉投資，不受 <u>公司法第十三條</u> 所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。另就業務上之需要，經董事會決議通過，得對外提供 <u>背書及保證</u> 。	依實務需求修訂。
(新增)	<u>第五條：</u> 本公司之公告方法依照 <u>公司法第二十八條</u> 規定辦理。	依實務需求訂定。
<u>第五條：</u> 本公司資本總額定為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行。	<u>第六條：</u> 本公司資本總額定為新台幣伍億元 <u>整</u> ，分為伍仟萬股，每股 <u>金額</u> 新台幣壹拾元，分次發行。 <u>其中得保留新台幣伍仟萬元整，分為伍佰萬股，供發行員工認股權時使用。</u> <u>本公司員工認股權憑證發給對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</u>	1. 條次調整。 2. 依公司法第 167 條之 2 規定訂定。
<u>第六條：</u> 本公司得發行股票。本公司 <u>發行之股票</u> 概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。	<u>第七條：</u> 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。 <u>本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。</u>	1. 條次調整。 2. 依公司法第 161 條之 2 規定訂定。
<u>第七條：</u> 本公司股東應將其姓名住址及印鑑報明本	(刪除)	依實務需求刪除。

現行條文	修正後條文	修正原因
<p>公司存查，遇有變更時亦同，凡領取股息紅利或與本公司書面行使股東權利等，均以送存本公司印鑑為憑。</p>		
<p>第八條： <u>股份轉讓時，應由轉讓人及受讓人填具股份過戶書，並於股票背面簽名或蓋章，交由受讓人將股票送本公司驗明過戶登載於股東名簿，其因繼承關係請求過戶者應提出證明文件。</u></p>	(刪除)	依實務需求刪除。
<p>第九條： <u>股票污損或須分合時，得向本公司請求換發，但污損程度至不易辨識時，本公司得請求股東登報公告及覓保再予換發。</u></p>	(刪除)	依實務需求刪除。
<p>第十條： <u>股票遺失或毀滅時，應即報告本公司，並登報三天聲明作廢，自公告日期經卅日別無糾葛方可覓保補發。</u></p>	(刪除)	依實務需求刪除。
<p>第十一條： <u>股票過戶換發或遺失補發時，應酌收工本費。</u></p>	(刪除)	依實務需求刪除。
<p>第十二條： 股東常會開會前三十日內，或股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股東名簿記載之變更。</p>	<p>第八條： 股東常會開會前三十日內，或股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股東名簿記載之變更。 <u>本公司股票於公開發行後，股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。</u></p>	1. 條次調整。 2. 依公司法第 165 條規定訂定。
<p>第十三條： 本公司股東會分常會及臨時會兩種，股東常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後</p>	<p>第九條： 本公司股東會分常會及臨時會兩種，股東常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後</p>	1. 條次調整。 2. 依公司法第 172 條、第 172 條之 2 規定訂定。

現行條文	修正後條文	修正原因
<p>六個月內召開，股東臨時會於必要時依法召集之。</p> <p>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p>	<p>六個月內召開，股東臨時會於必要時依法召集之。</p> <p><u>股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。股東會開會通知應載明開會日期、地點及召集事由，其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</u></p> <p>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p> <p><u>如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。</u></p>	
<p>第十四條：</p> <p><u>本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。</u></p>	<p>第十條：</p> <p><u>本公司股東除有公司法一百七十九條之情事外，每股有一表決權。</u></p> <p><u>本公司股票登錄興櫃後，於召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u></p>	<p>1. 條次調整。</p> <p>2. 依公司法第 179 條、第 177 條之 1 規定訂定。</p>
<p>第十五條：</p> <p>股東會之主席由董事長任之，董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。</p>	<p>第十一條：</p> <p>股東會之主席由董事長任之，董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。</p>	<p>條次調整。</p>
<p>第十六條：</p> <p>股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>第十二條：</p> <p>股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>條次調整。</p>
<p>第十七條：</p> <p>股東不能出席股東會者，得出具委託書，載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。<u>但一人同時受兩人以上股東之委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總表決數之百分之三。</u></p>	<p>第十三條：</p> <p>股東不能出席股東會者，得出具委託書，載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。</p> <p><u>本公司股票公開發行後，股東委託出席之辦法及委託書之使用，除依公司法相關規定外，另依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。</u></p>	<p>1. 條次調整。</p> <p>2. 依公司法第 177 條規定訂定。</p>

現行條文	修正後條文	修正原因
<p>第十八條： 股東會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後<u>法定</u>日內將議事錄分發各股東。</p>	<p>第十四條： 股東會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後<u>二十日內</u>，將議事錄分發各股東。<u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u> <u>前項議事錄之分發，於本公司股票公開發行後，得以公告方式為之。</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 條次調整。 2. 依公司法第 183 條規定訂定。
<p>第十九條： <u>本公司股東如僅為法人股東一人時，董事監察人由法人股東指派之，任期三年。本公司股東會職權則由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。</u></p>	(刪除)	依實務需求刪除。
<p>第四章 董事會</p>	<p>第四章 董事及監察人</p>	章名調整
<p>第<u>廿</u>條： 本公司設董事<u>三人</u>組織董事會，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。</p>	<p>第十五條： 本公司設董事<u>五至七人</u>，監察人<u>二人</u>組織董事會，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。 <u>本公司股票公開發行後，全體董事及監察人合計持股比例，應依證券主管機關之規定。</u> <u>本公司股票公開發行後，得選任獨立董事人數至少三人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</u> <u>本公司股票公開發行後，得依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會及其成員負責執行相關法令規定之監察人職權。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依「公開發行公司審計委員會行使</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 條次調整。 2. 依公司法第 192 條、第 192 條之 1、第 193 條之 1 規定訂定。

現行條文	修正後條文	修正原因
	<p><u>職權辦法</u>，相關規定，以審計委員會組織章程另訂之，審計委員會成立後替代監察人職務。</p> <p><u>本公司股票登錄興櫃後，董事選舉採候選人提名制度。</u></p> <p><u>董事及監察人於任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。</u></p>	
<p>第廿一條： 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。</p>	<p>第十六條： 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。</p>	條次調整。
<p>第廿二條： <u>董事會之職權如下：</u></p> <p><u>一、營業計劃之決定。</u></p> <p><u>二、編製重要章程及契約。</u></p> <p><u>三、分支機構之設立及裁撤。</u></p> <p><u>四、編造預算及決算。</u></p> <p><u>五、重要職員之任免。</u></p> <p><u>六、其他公司法及本章程所規定事項。</u></p>	(刪除)	依實務需求刪除。
<p>第廿三條： 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條之規定辦理。</p>	<p>第十七條： 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條之規定辦理。</p>	1. 條次調整。 2. 依實務需求修訂文字。
<p>第廿四條： 董事會之召集應載明事由，於法定日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項之召集通知得以書面或傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。</p>	<p>第十八條： 董事會之召集應載明事由，於法定日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項之召集通知得以書面或傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。</p>	條次調整。
<p>第廿五條：</p>	<p>第十九條：</p>	條次調整。

現行條文	修正後條文	修正原因
<p>董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。</p>	<p>董事會之決議除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。</p>	
<p>第廿六條： <u>董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人委託為限。</u> 董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊會議參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>第二十條： <u>董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得出具委託書列明授權範圍委託其他董事代理之，前項代理人，以受一人委託為限。</u> 董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊會議參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>1. 條次調整。 2. 依公司法第 205 條規定修訂。</p>
<p>(新增)</p>	<p>第二十一條： <u>董事會得決議支給董事及監察人相當之交通費或其他津貼；另董事及監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之。</u></p>	<p>依公司法第 196 條規定訂定。</p>
<p>第五章 監察人</p>	<p>(調整至第四章)</p>	<p>章名調整</p>
<p>第廿七條： <u>本公司設監察人一人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。</u></p>	<p>(調整至第十五條)</p>	<p>依實務需求調整。</p>
<p>第廿八條： <u>監察人之職權如下：</u> <u>一、業務之查詢。</u> <u>二、簿冊文件及財務狀況之查核。</u> <u>三、公司業務情形之查詢。</u> <u>四、其他依照法令及股東會決議賦與之職權。</u></p>	<p>(刪除)</p>	<p>依實務需求刪除。</p>
<p>第廿九條： <u>監察人得列席董事會議陳述意見但無表決權。</u></p>	<p>(刪除)</p>	<p>依實務需求刪除。</p>
<p>第六章 經理人</p>	<p>第五章 經理人</p>	<p>章次調整</p>
<p>第卅條：</p>	<p>第二十二條：</p>	<p>1. 條次調整。 2. 依公司法第 29</p>

現行條文	修正後條文	修正原因
<p>本公司得設經理人，<u>秉承董事會決議之方針綜理本公司一切業務，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意任免之。</u></p>	<p>本公司得設經理人，<u>其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。</u></p>	<p>條規定修訂。</p>
<p>第七章 會計</p>	<p>第六章 會計</p>	<p>章次調整</p>
<p>第卅一條： <u>本公司年終決算後董事會應造具下列表冊於股東常會開會法定日前交監察人查核後提交股東會請求承認：</u> 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。</p>	<p>第二十三條： <u>本公司應於每會計年度終了，由董事會造具</u> 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 <u>等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。</u></p>	<p>1. 條次調整。 2. 依公司法第 228 條規定修訂。</p>
<p>第卅二條： <u>本公司年度如有獲利，應提撥 3%以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董監酬勞。</u> <u>員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告</u>—但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p>	<p>第二十四條： <u>本公司年度如有獲利，應提撥 3%以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董監酬勞。</u> <u>員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告</u>，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p>	<p>條次調整。</p>
<p>第卅三條： <u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p>	<p>第二十五條： <u>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，次再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。再依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，連同上年度累積未分配盈餘由董事會評估未來營運計畫所需資金部分予以保留後，擬具盈餘分派議案提請股東會議定之。</u> <u>本公司股利之政策，應配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，作為股利發放之依據。股利發放提撥之數額不低於當年度可供</u></p>	<p>1. 條次調整。 2. 依公司法第 228 條之 1 規定修訂。</p>

現行條文	修正後條文	修正原因
	<p><u>分配盈餘之百分之十，得以股票股利或現金股利之方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。</u></p> <p><u>本公司股票公開發行後，本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用相關股東會決議之規定。</u></p>	
第 八 章 附則	第 七 章 附則	章次調整
<p>第卅四條： 本公司組織規程及辦事細則另訂之。</p>	<p>第二十六條： 本公司組織規程及辦事細則另訂之。</p>	條次調整。
<p>第卅五條： 本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。</p>	<p>第二十七條： 本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。</p>	條次調整。
<p>第卅六條： 本章程訂立於中華民國 105 年 06 月 22 日。 第一次修訂於民國 105 年 08 月 01 日。 第二次修訂於民國 108 年 05 月 30 日。 第三次修訂於民國 110 年 07 月 28 日。 第四次修訂於民國 111 年 05 月 17 日。</p>	<p>第二十八條： 本章程訂立於中華民國 105 年 06 月 22 日。 第一次修訂於民國 105 年 08 月 01 日。 第二次修訂於民國 108 年 05 月 30 日。 第三次修訂於民國 110 年 07 月 28 日。 第四次修訂於民國 111 年 05 月 17 日。 <u>第五次修訂於民國 112 年 01 月 31 日。</u></p>	<p>1. 條次調整。 2. 新增修訂日期。</p>

附件十六

股票初次上櫃證券承銷商評估報告

家碩科技股份有限公司

股票初次申請上櫃 推薦證券商評估報告

主辦推薦證券商：元大證券股份有限公司



協辦推薦證券商：合作金庫證券股份有限公司



永豐金證券股份有限公司



凱基證券股份有限公司



中華民國 112 年 1 月 27 日 編 製

中華民國 113 年 4 月 17 日 修 訂

家碩科技股份有限公司

產業、營運及其他重要風險

一、產業風險

(一)景氣循環之營運風險

該公司及其子公司產品應用於微影製程之光罩相關半導體設備及相關零組件，主要銷售予晶圓代工廠及記憶體廠，因此該公司及其子公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運受半導體產業資本支出需求狀況所影響。半導體市場受景氣循環影響、且產品需求變化快速，故晶圓製造商若面臨不景氣或是產能過剩的狀況，不僅調降資本支出也將會削減對該公司及其子公司之下單致影響營收及獲利。

因應對策：

- (1)該公司及其子公司具備多年設備開發設計及製造經驗，已累積豐富的實績，並擁有多項專利，該公司及其子公司除了加強生產製程管理，提高產品品質與效率，以降低生產成本，促進有效經營管理方式，另外，持續投入優化產品設計開發，加強產品技術與終端客戶技術需求開發，以擴大新產品開發領域，滿足新客戶產品需求。
- (2)該公司及其子公司產品應用領域廣泛，目前除應用在如晶圓代工廠、DRAM製造廠，也陸續拓展半導體後段製造及工廠自動化智能製造等，另以既有產品提升功能規格，積極開發新產品，藉由適當調整經營策略並拓展新業務，期在經濟環境及產業變化下，公司營運能持續成長。

二、營運風險

(一)專業人才取得與留任面臨挑戰

臺灣地緣風險提高，各國期盼半導體產業在地化，使全球爭奪半導體技術人才情形加劇，且面臨國內理工科畢業生逐年下滑，該公司及其子公司之規模及品牌能見度不及國內大型科技企業與國際大廠，此外由於該公司及其子公司生產據點位於南部，距離如竹科等半導體產業聚落較遠，人才招募上較為不易。

因應對策：

該公司及其子公司申請股票上櫃以提高企業知名度，吸引優秀人才；推行人性化管理制度，建立以績效導向之激勵機制並順暢升遷管道，同時，持續優化各項福利制度，致力創造愉快又有競爭力的工作環境，凝聚員工對公司的向心力，並增加員工留任率。

(二)銷貨集中風險

隨著5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，各產業為提升自身競爭力，致力生產技術升級與深化自動化製造技術，故近年來半導體代工業者擴大先進製程與產能規模，帶動資本支出預算陸續增加。然半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡佔的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致該公司及其子公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，且該公司及其子公司考量整體營運規模，選擇優先滿足領導大廠資本支出需求，而出現銷貨集中之情事。

因應對策：

(1)技術延伸至新產品或新市場開發

該公司及其子公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用該公司及其子公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境管理設備需求與日俱增趨勢，該公司及其子公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

(2)鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，該公司及其子公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，該公司及其子公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外該公司及其子公司與其長期合作的關係，且該公司及其子公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場具領導地位，該公司及其子公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為該公司及其子公司帶來廣大的客戶效益，有助於該公司及其子公司銷售策略之運用。

(3)積極開發其他客戶

該公司及其子公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。該公司及其子公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展該公司及其子公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

三、其他重要風險

請詳評估報告「參、二、發行公司營運風險」說明。

綜上所述，該公司及其子公司之產業、營運及其他重要風險三方面，分別予以評估其各項可能風險之因應措施，該公司及其子公司已具備因應相關風險之能力，各項因應措施尚屬妥適，應可有效降低相關風險。

目錄

壹、評估報告總評	1
一、承銷總股數說明	1
二、具體說明申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式	2
三、承銷風險因素	16
四、綜合具體結論	17
貳、推薦證券商就外國申請公司應列示說明其註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估外國申請公司所採行相關因應措施之適當性	20
參、產業狀況及營運風險	20
一、申請公司所屬行業營運風險	20
二、發行公司營運風險	28
肆、業務狀況	54
一、營業概況	54
二、存貨概況	82
三、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期之業績概況	90
四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素	100
伍、財務狀況	100
一、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之分析，與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力與現金流量	100
二、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止申請公司及其各子公司暨母子公司間背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估對其財務狀況之影響	112
三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性	113
四、個體及合併財務報告之轉投資事業	115
五、申請公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響	119
六、公營事業申請股票上櫃時，其檢送之財務報告以經審計機關審定之審定報告書替代者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見	119
七、推薦證券商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響	119
陸、關係人交易評估	120
一、應針對申請公司交易金額重大或性質特殊之關係人交易執行相關評估程序(包括與	

同業及非關係人交易之比較)，以瞭解其交易之必要性，決策過程合法性，暨價格與款項收付情形之合理性	120
二、應瞭解申請公司金額重大之關係企業應收款項是否逾期，針對逾期者，應查明其原因及有無重大異常情事	131
三、申請公司與關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來者，應查明其原因，及利率、收付息情形有無重大異常之情事。	131
柒、重要子公司營運情形	131
一、推薦證券商派員實地瞭解申請公司之重要子公司營運情形者，應具體列示其是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見	131
二、本國申請公司生產據點或獲利主要來自海外重要子公司者，應具體列示申請公司對其海外重要子公司在財務操作及資金調度、帳務處理、內控內稽執行及盈餘決策等事項之監管措施及實際執行情形之評估意見	131
捌、法令之遵循及對公司營運影響	131
一、申請公司是否違反相關法令規章	131
二、申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人是否違反相關法令，而有違誠信原則或影響其職務之行使	132
三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事	132
四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件	132
五、申請公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件	134
六、外國申請公司之推薦證券商應洽律師對申請公司、申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人最近三年內就下列事項出具之法律意見書，依據其意見，推薦證券商再就該等項目具體評估對申請公司營運影響及因應之道	134
玖、列明依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見及申請公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦法之評估意見 .	134
一、列明依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見	134
二、列明申請公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦法之評估意見	134
拾、評估申請公司是否依本中心「申請有價證券於證券商營業處所買賣之公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達申請公司推動永續發展之執行情形。評估申請公司之公司治理評鑑自評報告是否允當表達申請公司之公司治理運作情形 .	135
一、公開說明書是否允當表達申請公司推動永續發展之執行情形	135
二、公司治理評鑑自評報告是否允當表達申請公司之公司治理運作情形	135
拾壹、評估本國申請公司是否符合集團企業、建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申情股票上櫃之補充規定	137
一、評估本國申請公司是否符合集團企業申情股票上櫃之補充規定	137
二、評估本國申請公司是否符合建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股	

公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定	145
三、評估外國申請公司是否符合「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第十六條至第十九條有關集團企業及第二十條至第二十二條有關投資控股公司之規定	145
四、評估外國申請公司是否符合本中心「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第四條第六項有關建設公司申請股票上櫃之規定	145
拾貳、以投資控股公司身分申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商亦應就其被控股公司依本應行記載事項要點第五條、第七條第四項、第十條及第十一條規定逐項評估	145
拾參、本國上櫃(市)公司之海外子公司申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商應評估本國上櫃(市)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施	145
拾肆、自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，推薦證券商對上列各項目應加以更新說明與評估	146
拾伍、其他補充揭露事項	146
附件一、推薦證券商就財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見	147

壹、評估報告總評

一、承銷總股數說明

(一)已發行股份總數

家碩科技股份有限公司(以下簡稱家碩科技或該公司)股票初次申請上櫃時之實收資本額為新臺幣 272,976 千元，每股面額新臺幣 10 元整，已發行股數為 27,298 千股。該公司擬於股票初次申請上櫃案經主管機關審查通過後，預計辦理現金增資發行新股 2,717 千股，扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，全數委託證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，預計股票上櫃掛牌時股數為 30,015 千股，實收資本額為 300,146 千元。

(二)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第 2 條規定，公開發行公司初次申請股票上櫃時，至少應提出擬上櫃股份總額百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售。但應提出承銷之股數超過二千萬股以上者，得以不低於二千萬股之股數辦理公開銷售。另若公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷總股數之百分之三十。

(三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度內，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)依據該公司 112 年 12 月 28 日之股東名冊，記名股東人數共計 1,025 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東為 1,013 人，其所持有股份合計為 9,388,046 股，占已發行股份總額之 34.39%，已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第三條有關股權分散之標準，該公司擬於主管機關核准後辦理公開承銷，並於上櫃掛牌前完成股權分散事宜。

(五)綜上所述，該公司依規定預計辦理現金增資發行新股 2,717 千股，扣除依公司法規定保留百分之十五予員工優先認購之 407 千股後，餘 2,310 千股依據「證券交易法」第二十八之一條規定，經 112 年 5 月 31 日股東臨時會決議通過由原股東全數放棄認購以辦理上櫃前公開承銷作業，排除公司法第 267 條第三項原股東優先認購之適用。該公司本次提出公開承銷股數 2,310 千股，加計興櫃徵提可扣除股數 693 千股，合計 3,003 千股已高於擬上櫃股份總額 30,015 千股之 10%，符合前揭規定。

另該公司已於 112 年 11 月 7 日經董事會通過與主辦證券承銷商簽訂「過額配售協議

及特定股東閉鎖期協議書」，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數百分之十五之額度範圍內，供主辦證券承銷商辦理過額配售及價格穩定作業，惟主辦承銷商得依市場需求決定實際過額配售數量。

二、具體說明申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

目前證券投資分析較常使用之股票價值評價方法主要包括市場法與成本法及收益法。各種方法皆有其優缺點，且採用方法不同，評估結果亦有所差異。其中，市場法包括本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)及股價淨值比法(Price/Book value ratio, P/B ratio)，皆係透過已公開的資訊，與整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，進行公司價值評估，再依被評價公司與採樣公司之差異，進行折溢價調整，作成公司價值之結論；成本法主係為淨值法，並以帳面歷史成本作為公司價值之評估基礎；收益法主係以未來利益流量(如：現金流量...等)作為公司價值之評估基礎。茲將市場法、成本法及收益法等計算方式、優缺點與適用時機整理列示如下：

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與同業公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，據以評估企業整體價值。
優點	<ol style="list-style-type: none"> 1.最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2.所估算之價值與市場的股價較接近。 3.較能反映市場、研判多空氣氛及投資價值認定。 4.市場價格資料容易取得。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.淨值係長期且穩定之指標。 2.當盈餘為負數時之替代評估方法。 3.市場價格資料容易取得。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.評估資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同而影響。 3.反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
缺點	1.盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3.企業盈餘為負數時不適用。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。 3.不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較為困難。	1.使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。
適用時機	1.企業生命週期屬成長型公司。 2.獲利型公司。	1.有鉅額資產但股價偏低的公司。 2.獲利波動幅度較大之公司。	1.適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。 2.虧損或營運衰退型公司。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

上述股價評價之各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦多有差異，其中因現金流量折現法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數之參考價值相對較低下，國內實務上較少採用此方法。因此，以市場法做為股價評價之基礎。

2.承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1)採樣同業之選擇

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，屬於半導體前段製程相關設備供應商。綜觀目前國內上市、上櫃及興櫃公司，就營業項目、業務型態及市場定位等因素綜合考量，選擇京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱京鼎公司，股票代碼 3413，上市半導體業)、華景電通股份有限公司(以下簡稱華景電公司，股票代碼 6788，上櫃半導體業)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱天虹公司，股票代碼 6937，上市半導體業)作為採樣同業。京鼎公司主要營業項目為先進設備設計及製造，其產品主要應用在半導體產業、面板產業及光電產業等，在半導體產業部分，其設備用途包含半導體前段晶圓製造之薄膜、蝕刻、化學機械研磨等製程所需之設備、晶圓傳輸自動化設備、微污染防治及惰性氣體充填裝置及晶圓外觀自動檢查設備；華景電公司主要營業項目為晶圓製程微粒子或氣態分子污染物(AMC)微污染防治設備、晶圓盒承載裝置無線射頻辨識(RFID)整合派工系統及其他等；天虹公司主要營業項目為半導體設備及相關零組件之技術與研發、製造、維修及銷售業務等。因上述公司與該公司之主要產品較類似，故選擇這三家作為採樣公司，並進行下列分析：

(2)市場法

A.該公司財務資料

單位：新臺幣千元；新臺幣元

項目	109 年度	110 年度	111 年度	111 年第四季至 112 年第三季
本期淨利	63,663	67,532	203,415	283,378
權益總額	145,584	213,116	550,569	721,397
擬上櫃掛牌股數	30,015			
每股盈餘(元)(註)	2.12	2.25	6.78	9.44
每股淨值(元)(註)	4.85	7.10	18.34	24.03

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

註：每股盈餘及每股淨值係以擬上櫃掛牌股數追溯調整計算

B.本益比法

單位：新臺幣元

公司	期間	每股盈餘(註)	平均收盤價	平均本益比(倍)
京鼎 (3413)	112 年 9 月	19.58	186.60	9.53
	112 年 10 月		187.30	9.57
	112 年 11 月		191.61	9.79
華景電 (6788)	112 年 9 月	9.48	135.48	14.30
	112 年 10 月		132.18	13.95
	112 年 11 月		129.52	13.67
天虹 (6937)	112 年 9 月	4.57	203.97	44.63
	112 年 10 月		189.12	41.38
	112 年 11 月		194.71	42.61
上櫃公司 -半導體業	112 年 9 月	—	—	14.61
	112 年 10 月		—	15.08
	112 年 11 月		—	18.27
上市公司 -半導體業	112 年 9 月	—	—	21.52
	112 年 10 月		—	22.20
	112 年 11 月		—	28.32

資料來源：臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站及公開資訊觀測站

註：每股盈餘係以最近四季稅後純益除以 112 年 9 月 30 日之股本計算

該公司採樣同業及上市櫃「半導體」類股最近三個月(112 年 9 月~112 年 11 月)之平均本益比區間介於 9.53~44.63 倍之間，然為避免取樣區間受極端值之影響，剔除京鼎及天虹，排除極端值後建構取樣之本益比區間約介於 13.67~28.32 倍，若以該公司最近四季之每股盈餘約為 9.44 元，按上述本益比區間計算，參考價格區間介於 129.04~267.34 元，考量該公司經營績效、獲利情形、財務結構、產業未來發展前景、興櫃市場近期股價及流動性不足之風險予以折價後，該公司此次上櫃與本證券承銷商議定之暫定承銷價格每股新臺幣 160 元尚屬合理。

C. 股價淨值比法

單位：新臺幣元

公司	期間	最近期財報 每股淨值(註 2)	平均收盤價	平均股價 淨值比(倍)
京鼎 (3413)	112 年 9 月	114.24	186.60	1.63
	112 年 10 月		187.30	1.64
	112 年 11 月		191.61	1.68
華景電 (6788)	112 年 9 月	44.19	135.48	3.07
	112 年 10 月		132.18	3.00
	112 年 11 月		129.52	2.94
天虹 (6937)	112 年 9 月	32.23	203.97	6.33
	112 年 10 月		189.12	5.87
	112 年 11 月		194.71	6.04
上櫃公司 - 半導體	112 年 9 月	—	—	3.53
	112 年 10 月		—	3.58
	112 年 11 月		—	3.79
上市公司 - 半導體	112 年 9 月	—	—	3.14
	112 年 10 月		—	3.16
	112 年 11 月		—	3.52

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站

註 1：平均股價淨值比=平均收盤價/每股淨值

註 2：每股淨值係以 112 年 9 月 30 日歸屬於母公司業主之權益除以之股本計算

註 3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算

該公司採樣同業及上市櫃「半導體」類股最近三個月之平均股價淨值比介於 1.63~6.33 倍，以該公司擬以掛牌股數 30,015 千股計算之每股淨值 24.03 元為基礎計算，價格區間約為 39.17~152.11 元；惟股價淨值比法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本證券承銷商不擬採用此法作為議定承銷價格參考之依據。

(3) 成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等。其中，股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總和扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業價值，同時成本法使用上的限制有下列四項，因此國際上慣用成本法以評估企業價值者並不多見：

- A.無法表達目前真正及外來之經濟貢獻值。
- B.忽略了技術經濟壽命。
- C.技術廢舊及變革對於其所造成之風險無法預測。
- D.成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，且該公司 112 年 9 月 30 日經會計師核閱之歸屬母公司業主權益 721,397 千元及擬以掛牌股數 30,015 千股計算之每股淨值為 24.03 元，與興櫃市場交易價格差異甚大，且成本法並未考量公司成長性，較常用於評估傳統產業類股或衰退型公司，因此本證券承銷商不擬採用此種方法作為承銷價格訂定之參考依據。

(4)收益法-現金流量折現法

收益法係以公司預估未來產生之現金流量折現總和合計數認定為股東權益價值。由於未來之現金流量無法精確掌握，需推估公司未來數年之獲利及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，在未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握情況下，不確定性風險相對高，亦不能合理評估公司應有之價值，故不擬採用收益法。

綜上所述，考量該公司產品市場定位、產業未來發展前景及發行市場環境等因素後，本推薦證券商經評估為能計算合理、客觀及具市場性之承銷價格，決定採以市場法中之本益比法作為該公司上櫃申請之承銷價格計算依據。

(二)申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

茲就該公司與採樣同業公司京鼎、華景電及天虹之財務狀況、獲利情形及本益比之比較分析列示如下：

單位：%；次；每股元

評估項目		年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
		公司				
財務 結構	負債占資產比率(%)	家碩	77.07	78.23	66.73	61.79
		京鼎	52.01	46.94	44.99	39.42
		華景電	25.92	21.30	32.79	36.26
		天虹	80.06	51.66	37.74	33.45
		同業	48.40	50.50	46.50	註 3
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率(%)	家碩	1,131.36	1,717.71	3,706.17	922.85
		京鼎	504.07	502.92	366.86	354.01
		華景電	448.12	668.98	305.06	283.56
		天虹	102.67	189.17	291.17	286.04
		同業	210.53	216.45	226.24	註 3

評估項目		年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
		公司				
償債能力	流動比率(%)	家碩	114.80	120.40	145.67	151.36
		京鼎	234.06	285.58	220.98	266.73
		華景電	460.90	501.35	341.43	284.99
		天虹	97.26	167.12	260.61	304.45
		同業	198.10	187.10	224.60	註 3
	速動比率(%)	家碩	57.93	58.81	84.65	102.51
		京鼎	186.74	209.60	161.20	207.25
		華景電	366.96	357.67	249.66	188.38
		天虹	41.64	76.12	127.04	109.23
		同業	136.20	125.00	148.80	註 3
	利息保障倍數(倍)	家碩	9,958.88	778.44	1,838.11	480.66
		京鼎	63.57	74.19	74.04	56.69
		華景電	224.91	299.17	185.83	80.84
		天虹	8.94	8.56	35.16	38.37
		同業	2,960.00	3,644.80	3,730.60	註 3
經營能力	應收款項週轉率(次) (註 2)	家碩	5.47	8.34	5.79	5.32
		京鼎	9.11	9.24	11.06	13.99
		華景電	4.41	7.32	7.51	6.62
		天虹	4.22	6.44	4.88	4.51
		同業	3.90	4.70	4.80	註 3
	應收款項收現天數 (註 2)	家碩	67	44	64	69
		京鼎	41	40	34	27
		華景電	83	50	49	56
		天虹	87	57	75	81
		同業	94	78	77	註 3
	存貨週轉率(次) (註 2)	家碩	1.39	1.08	1.12	1.20
		京鼎	4.58	3.90	3.06	2.84
		華景電	1.84	1.62	1.42	1.16
		天虹	0.70	1.13	0.99	0.86
		同業	2.60	2.80	2.40	註 3
平均售貨天數 (註 2)	家碩	263	338	326	305	
	京鼎	80	94	120	129	
	華景電	198	225	257	315	
	天虹	522	324	369	425	
	同業	141	131	153	註 3	

評估項目		年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
		公司				
經營能力	不動產、廠房及設備 週轉率(次)	家碩	63.29	47.63	75.32	27.78
		京鼎	6.33	6.92	5.33	3.52
		華景電	4.05	5.33	3.41	2.24
		天虹	1.79	2.15	2.48	2.31
		同業	2.80	3.50	3.10	註 3
	總資產週轉率(次)	家碩	0.90	0.75	0.80	0.76
		京鼎	1.01	0.95	0.88	0.68
		華景電	0.76	0.78	0.68	0.58
		天虹	0.50	0.71	0.70	0.60
		同業	0.50	0.60	0.60	註 3
獲利能力	資產報酬率(%)	家碩	12.00	8.38	15.45	16.29
		京鼎	12.76	11.99	14.03	10.61
		華景電	16.83	16.45	16.94	12.36
		天虹	3.49	10.75	12.61	7.37
		同業	4.50	4.60	6.40	註 3
	權益報酬率(%)	家碩	55.97	37.65	53.27	45.27
		京鼎	25.29	23.29	25.54	18.06
		華景電	22.91	21.29	23.35	18.64
		天虹	13.74	28.97	21.79	11.15
		同業	7.60	7.20	11.00	註 3
	營業利益占實收資本 額比率(%)	家碩	144.53	102.54	107.42	113.80
		京鼎	197.24	226.19	304.07	199.08
		華景電	63.76	84.70	125.16	107.21
		天虹	4.75	35.00	47.52	35.76
		同業	註 1	註 1	註 1	註 1
	稅前純益占實收資本 額比率(%)	家碩	144.32	82.39	113.19	130.73
		京鼎	183.03	217.80	297.85	254.86
		華景電	64.49	86.00	128.86	112.09
		天虹	42.00	44.34	60.40	43.33
		同業	註 1	註 1	註 1	註 1
純益率(%)	家碩	13.32	11.22	19.41	21.25	
	京鼎	12.49	12.40	15.79	15.36	
	華景電	21.91	21.08	24.67	20.91	
	天虹	6.19	13.57	17.45	11.90	
	同業	6.70	6.10	10.20	註 3	
獲利能力	每股稅後盈餘(元)	家碩(註 4)	3.18	3.37	9.84	7.91
		京鼎	14.91	17.01	24.64	15.29
		華景電	5.19	7.08	10.08	6.36
		天虹	1.63	4.57	5.66	2.62
		同業	註 1	註 1	註 1	註 1

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率、每股稅後盈餘及現金流量允當比率

註 2：應收款項週轉率及存貨週轉率係以總額計算；應收款項收現天數及平均售貨天數係以無條件進位計算

註 3：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版該年度之主要行業財務比率

註 4：該公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響

1.財務結構

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之負債占資產比率分別為 77.07%、78.23%、66.73%及 61.79%。110 年度受 COVID-19 疫情停工和缺櫃塞港影響，加上遠距生活型態加速數位轉型，終端數位產品對晶片需求提升，半導體產業供應鏈供不應求，使全球半導體產業紛紛大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，該公司及其子公司依客戶訂單進行購料生產，加上該公司及其子公司於交機後驗收前預收客戶 8 成以上款項，致使 110 年度應付帳款及合約負債增加，故 110 年度負債占資產比率較 109 年度上升；111 年度則因該公司辦理現金增資及業績持續成長，使 111 年度現金及約當現金及應收帳款大幅增加，致 111 年度負債占資產比率較 110 年度大幅下降；112 年前三季因業績持續成長，現金及約當現金大幅增加，致 112 年前三季負債占資產比率較 111 年度下降，經評估該公司及其子公司之負債占資產比率變化應無異常之情事。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司除 109 年度僅低於天虹公司外，其餘年度及 112 年前三季均高於其他採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，加上該公司之股本相較其他採樣同業為低(以 112 年前三季而言，該公司股本 272,976 千元，採樣同業京鼎公司、華景電公司及天虹公司之股本分別為 971,861 千元、347,397 千元及 606,773 千元)，致負債占資產比率占比較採樣同業高，惟該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司及其子公司未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情形，經評估尚無重大異常情事。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率為 1,131.36%、1,717.71%、3,706.17%及 922.85%。該公司 109~111 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率逐年上升，主要係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求提升，使該公司及其子公司之營運及獲利持續成長，且

該公司於 111 年度辦理現金增資，股東權益逐年增加所致；112 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率大幅降低，主要係因該公司於 112 年前三季因研發所需，增加機器設備所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率皆高於其他採樣同業及同業平均，且該等比率大於 100%，顯示該公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之財務結構各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

2.償債能力

(1)流動比率及速動比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之流動比率分別為 114.80%、120.40%、145.67%及 151.36%，速動比率分別為 57.93%、58.81%、84.65%及 102.51%，其流動比率及速動比率皆呈現上升之趨勢，主係雖過去幾年度因疫情造成的區域封鎖、區域衝突及地緣政治的緊張局勢，嚴重擾亂了全球供應鏈，惟來自 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等相關應用產業之發展趨勢，仍使得長期半導體需求結構呈現持續增長，該公司及其子公司在配合客戶擴充產能及建廠規劃之需求情況下，最近三年度及 112 年前三季之營運規模及獲利呈現持續成長之趨勢，且該公司於 111 年度辦理現金增資，致其流動資產與速動資產均較各年度前期持續增加，致使流動比率及速動比率逐期上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司除 109 年度之流動比率與速動比率高於天虹公司，低於其他採樣同業及同業平均外，其餘年度及 112 年前三季皆低於採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，使流動負債大幅增加所致；另該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司及其子公司之財務與營運狀況皆屬穩健，且應收款項收現情況良好，經評估其短期償債能力尚無重大異常情事。

(2)利息保障倍數

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之利息保障倍數分別為 9,958.88 倍、778.44 倍、1,838.11 倍及 480.66 倍。110 年度利息保障倍數較 109 年度大幅下降，主要係因該公司 110 年度向家登精密承租臺南辦公室認列租賃負債利息費用所致；111 年度利息保障倍數較 110 年度大幅上升，則係因該公司營運成長，稅前淨利增加所致；112 年前三季較 111 年度大幅下降，主係因 111 年底新增新竹辦公室及 112 年前三季新增臺南及臺中倉儲租賃，租賃負債利息費用增加所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109 年度之利息保障倍數係優於採樣同業及同業平均；110~111 年度及 112 年前三季則優於採樣同業，低於同業平均，該公司及其子公司之利息保障倍數主要係受租賃負債利息費用及稅前淨利變動影響，經評估該公司及其子公司因營運獲利穩定而償債能力尚屬穩健，整體而言尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

3.經營能力

(1)應收款項週轉率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之應收款項週轉率分別為 5.47 次、8.34 次、5.79 次及 5.32 次，應收款項收現天數分別為 67 天、44 天、64 天及 69 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。該公司及其子公司 110 年度應收帳款週轉率較前一年度上升，主要係因 110 年度全球半導體產業大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，致該公司及其子公司營業收入增加，應收帳款週轉率上升；111 年度應收帳款週轉率較前一年度下降，主係該公司及其子公司仍因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致其營業收入持續攀升，期末應收款項隨之增加所致；112 年前三季應收款項週轉率持續下降，雖該公司截至 112 年 9 月底營業收入換算全年度營收較去年度成長 29.28%，惟因 111 年底大量出貨，且今年出貨量持續增加，致平均應收帳款餘額大幅成長 40.65%，應收款項週轉率微幅下降。

與採樣同業及同業平均相較，109~111 年度及 112 年前三季應收款項週轉率皆介於採樣同業，高於同業平均。該公司及其子公司之往來客戶大多為國內外知名大廠，財務狀況及營運狀況均為穩健，其授信條件與收款情形尚屬合理，且該公司及其子公司定期追蹤應收帳款期後收回情形，整體而言尚無重大異常情事。

(2)存貨週轉率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之存貨週轉率分別為 1.39 次、1.08 次、1.12 次及 1.20 次，平均售貨天數分別為 263 天、338 天、326 天及 305 天。110 年度受 COVID-19 疫情停工和缺櫃塞港影響，加上智慧型手機、高效能運算產品、物聯網及車用市場需求攀升，晶片需求隨之提升，使全球半導體產業紛紛大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，惟該公司及其子公司所生產之機台設備於出貨後，尚待客戶完成驗收後始得認列營業收入，又其驗收時程受機台設備安裝及客戶驗收測試排程所影響，致使 110 年底已出貨尚未完成驗收之機台設備大幅增加，故該公司及其子公司 110 年度之存貨週轉率較前一年度下降；111 年度因營運規模持續成長，加上 110 年底已出貨未驗收之機台陸續驗收完畢，致營業成本增加幅度大於存貨，致使期末存貨週轉率上升；112 年前三季較 111 年度存貨週轉率上升，主係 111 年度已出貨未驗收之在製品於 112 年前三季陸續驗收認列收入，使營業收入成長連帶影響營業成本增加，其營業成本增幅大於平均存貨，致存貨週轉率微幅上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109、111 年度及 112 年前三季之存貨週轉率高於天虹，低於其他採樣同業及同業平均；110 年度之存貨週轉率則低於採樣同業及同業平均。該公司及其子公司最近三年度及 112 年前三季持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司及其子公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司及其子公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使存貨週轉率較採樣同業及同業平均為低，惟該公司及其子公司之產品主要係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故其存貨尚無可能產生跌價減損或未能去化之情形。經評估該公司及其子公司之存貨週轉率及平均售貨天數變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(3)不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 63.29 次、47.63 次、75.32 次及 27.78 次，總資產週轉率分別為 0.90 次、0.75 次、0.80 次及 0.76 次。110 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 109 年度下降，主要係因該公司於 109 年度整建臺南樹谷廠，109 年度不動產、廠房及設備期初數尚未包含臺南樹谷廠之廠房整建、空調、電力等工程成本，故 109 年度期初不動產、廠房及設備金額較低所致；111 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 110 年度上升，主要係因該公司及其子公司受半導體產業需求提升，營業收

入大幅成長所致；112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度大幅下降，主要係因該公司因研發所需，增加機器設備所致。110 年度之總資產週轉率較 109 年度下降，主要係因半導體產業供應鏈供不應求，使全球半導體產業紛紛大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，惟其所生產之機台設備於出貨後，尚待客戶完成驗收後始得認列營業收入，故已出貨待驗收之機台帳列該公司及其子公司之在製品，另驗收時程主係受機台設備安裝及客戶驗收測試排程影響，驗收期程較長，致使 110 年度期末存貨金額大幅增加，且該公司之現金及約當現金亦受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且營業收入亦逐年上升，惟平均總資產金額增加幅度較營業收入增加幅度高，故總資產週轉率於 110 年度呈下滑趨勢；111 年度則因營業收入大幅成長，致總資產週轉率略為上升；112 年前三季之總資產週轉率較 111 年度下降，主要係因該公司及其子公司之現金及約當現金受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且營業收入亦呈上升趨勢，惟平均總資產金額增加幅度較營業收入增加幅度高，致總資產週轉率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率均高於採樣同業及同業平均。就總資產週轉率而言，該公司及其子公司 109~111 年度之總資產週轉率介於採樣同業，高於同業平均；112 年前三季則高於採樣同業，顯示其經營能力與同業相較尚屬良好，整體而言，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之經營能力各項指標變動尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

4.獲利能力

(1)資產報酬率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之資產報酬率分別為 12.00%、8.38%、15.45%及 16.29%。110 年度資產報酬率較 109 年度下降，主係其流動資產因業績與營業規模持續成長，使存貨及現金部位較前一年度大幅成長，致 110 年度總資產金額增加，惟稅後淨利因認列於 109 年 12 月 31 日收購子公司昇和精技股份有限公司(以下簡稱「昇和精技公司」)而產生之商譽減損 20,435 千元，致稅後淨利成長幅度低於總資產所致；111 年度及 112 年前三季資產報酬率逐期受半導體產業需求持續提升，該公司及其子公司業績成長，稅後淨利大幅增加所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司資產報酬率 109 及 111 年度介於採樣同業，高於同業平均；110 年度低於採樣同業，高於同業平均；112 年前三季高於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之資產運用尚屬得宜，並能創造合理之利潤，經評估其資產報酬率之變化應無重大異常情事。

(2) 權益報酬率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之權益報酬率分別為 55.97%、37.65%、53.27%及 45.27%。110 年度權益報酬率較 109 年度下降，主要係因該公司於 110 年度認列收購子公司昇和精技公司所產生之商譽減損損失，致稅後淨利成長幅度降低所致；111 年度權益報酬率較 110 年度上升，主要係因該公司 111 年度業績成長，稅後淨利增加幅度大於股東權益增加幅度所致；112 年前三季權益報酬率較 111 年度下降，主要係該公司業績持續成長，惟平均股東權益增加幅度大於稅後淨利增加幅度所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司權益報酬率 109~111 年度及 112 年前三季皆高於採樣同業及同業平均。隨營運規模擴大，該公司及其子公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(3) 營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業利益占實收資本額比率分別為 144.53%、102.54%、107.42%及 113.80%；稅前純益占實收資本額比率分別為 144.32%、82.39%、113.19%及 130.73%。110 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 109 年度下降，主要係因該公司於 110 年度配發股票股利，該公司之實收資本額上升所致；111 年度及 112 年前三季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率逐期上升，主要則係該公司及其子公司之營業規模持續受惠於半導體產業需求成長，致營業利益及稅前純益均逐期成長所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣同業，顯示該公司及其子公司獲利能力尚屬良好，整體而言尚應重大異常情事。

(4) 純益率及每股稅後盈餘

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之純益率分別為 13.32%、11.22%、19.41%及 21.25%；每股盈餘分別為 3.18 元、3.37 元、9.84 元及 7.91 元。110 年度純益率較 109 年度下降，主要係因該公司認列收購子公司昇和精技公司產生之商譽減損損失所致；111 年度及 112 年前三季則因半導體產業需求持續擴張，使該公司及其子公司之營業規模及獲利持續增長，致稅後淨利大幅增加，致使純益率逐期上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109 及 111 年度純益率介於採樣同業，高於同業平均；110 年度低於採樣同業，高於同業平均；112 年前三季高於採樣同業。另就每股盈餘而言，109、111 年度及 112 年前三季每股盈餘介於採樣同業；110 年度則低於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之營

運仍保持穩定成長之趨勢，最近年度及最近期之營運獲利亦持續擴張，經評估其獲利能力應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之獲利能力尚屬穩定，其獲利能力各項指標變化尚屬合理，經評估其變化應無重大異常情事。

5.本益比

請參閱本評估報告「壹、二、(一)、2、(2)、B 本益比法」之說明。

(三)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本次承銷價格之議訂並無採取專家意見或鑑價報告。

(四)申請公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

時間	成交股數	成交總金額	平均價格
112年11月	2,706,369股	596,713千元	218.82元

資料來源：財團法人證券櫃檯買賣中心興櫃交易資訊

該公司於112年6月26日於興櫃市場掛牌，最近一個月(112年11月)之月平均股價及成交量分別為218.82元及2,706,369股。另經查核該公司自申請上興櫃日迄今並無依「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第4條規定公告「興櫃公布注意股票」或依「興櫃股票買賣辦法」第11條之1規定暫停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事，故該公司股價並無波動較大之情事。

(五)推薦證券商就其與申請公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本證券承銷商經考量該公司之獲利能力、產業未來發展前景及初次上櫃股票流動性等因素，採用市場法之本益比法，並參酌採樣同業公司及上市櫃「半導體」類股最近三個月(112年9月~112年11月)之本益比，其區間介於13.67~28.32倍之間，並考量該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價等方式，以該公司最近四季之每股盈餘約9.44元，按上述本益比區間計算，參考價格區間介於129.04~267.34元，本證券承銷商與該公司共同議定之承銷價格暫定為每股160元。另實際承銷價格將於屆辦理上櫃前公開承銷時，採用競價拍賣等方式發現市場合理價格，並於向券商公會申報競拍約定書前，依券商公會再行銷售辦法之相關規定辦理，與該公司共同議定上櫃掛牌之承銷價格，期能訂定合理之承銷價格。

三、承銷風險因素

(一)股價變化過鉅

該公司本次暫訂之承銷價格，已考量該公司未來經營績效、同業狀況及發行市場現況等因素後而予以調整，因此，本次承銷價格應尚能合理反映該公司之市場價值，且辦理公開承銷時，將針對市場對案件承銷價格的接受條件及認購情形進行調查，做為調整承銷價格之參考依據。另本證券承銷商亦已依「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，擬定穩定價格策略，期能降低股價變化過鉅之風險。

(二)穩定價格策略

1.過額配售機制

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券承銷商已與該公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖協議書」，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數之 15%為上限，提供已發行普通股股票供主辦證券承銷商辦理過額配售。主辦證券承銷商負責規劃及執行穩定價格操作，以穩定承銷價格。

2.特定股東集保

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券承銷商已與該公司簽訂特定股東閉鎖協議，除依規定應提出強制集保股份外，並由該公司協調特定股東，就其所持有之已發行普通股股票，於掛牌日起三個月內，自願送存臺灣集中保管結算所股份有限公司集保並不得賣出，以維持承銷價格穩定。

(三)本次承銷之相關費用及承銷手續費率

該公司本次辦理公開承銷所需之費用主要包括公開說明書印製費用、相關承銷書件印製費用、會計師與律師之勞務費以及承銷手續費等；而承銷手續費將參考未來辦理公開銷售時之市場行情議定，惟依國際財務報導準則實務指引(IFRS Manual of Accounting)及參酌 IAS32 第 37 段之說明，企業於發行或取得本身之權益工具時，通常會發生各種成本，此權益交易之交易成本應按扣除所有相關所得稅利益後之淨額作權益之減項處理，但以直接可歸屬該權益交易之可避免增額成本為限，而本次承銷手續費係可直接歸屬於該權益交易之可避免增額成本，故對該公司之獲利狀況並無重大影響。

(四)新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利

該公司本次預估辦理現金增資 27,170 千元發行新股，與該公司擬掛牌之實收資本額 300,146 千元相較，新股承銷導致股本膨脹對每股盈餘稀釋比率為 9.05%，惟本

證券承銷商與該公司議定承銷價格時業已考量本次發行新股之稀釋效果，故對本次承銷風險之影響尚屬有限。

綜上分析，該公司已依法令規定計算應提出公開承銷股數，並全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，經評估本次新股承銷之相關費用對其獲利之稀釋程度有限，股本膨脹對該公司獲利之稀釋效果亦已於本次議定承銷價格時納入考量，另本證券承銷商已針對承銷價格擬定穩定價格策略，整體而言，其承銷風險應屬有限。

四、綜合具體結論

本證券承銷商經評估該公司及其子公司之財務及業務狀況後，綜合說明該公司及其子公司之營運風險及財務風險如下：

(一)營運風險

1.專業人才取得與留任面臨挑戰

臺灣地緣風險提高，各國期盼半導體產業在地化，使全球爭奪半導體技術人才情形加劇，且面臨國內理工科畢業生逐年下滑，該公司及其子公司之規模及品牌能見度不及國內大型科技企業與國際大廠，此外由於該公司及其子公司生產據點位於南部，距離如竹科等半導體產業聚落較遠，人才招募上較為不易。

因應措施：

該公司及其子公司申請股票上櫃以提高企業知名度，吸引優秀人才；推行人性化管理制度，建立以績效導向之激勵機制並順暢升遷管道，同時，持續優化各項福利制度，致力創造愉快又有競爭力的工作環境，凝聚員工對公司的向心力，並增加員工留任率。

2.銷貨集中風險

隨著 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，各產業為提升自身競爭力，致力生產技術升級與生化自動化製造技術，故近年來半導體代工業者擴大先進製程與產能規模，帶動資本支出預算陸續增加。然半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡占的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致該公司及其子公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，且該公司考量整體營運規模，選擇優先滿足領導大廠資本支出需求，而出現銷貨集中之情事。

因應措施：

(1)技術延伸至新產品或新市場開發

該公司及其子公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市

場，將利用研發設計能力，有效運用該公司及其子公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境設備需求與日俱增趨勢，該公司及其子公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

(2)鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，該公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，該公司及其子公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外該公司及其子公司與其長期合作的關係，且該公司及其子公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場具領導地位，該公司及其子公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為該公司及其子公司帶來廣大的客戶效益，有助於該公司銷售策略之運用。

(3)積極開發其他客戶

該公司及其子公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。該公司及其子公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展該公司及其子公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

(二)財務風險

1.匯率變動風險

該公司及其子公司銷售對象主係以國內外知名半導體大廠為主，內銷交易約占整體營收 7~8 成，外銷交易計價幣別係以美元為主；在採購方面，該公司及其子公司採購對象多以臺灣供應商為主，內購交易占整體進貨約 9 成，付款幣別以新臺幣為主，該公司及其子公司產生之兌換損益主要係外幣進銷貨所產生，資產負債互抵後，期末以美元產生之外幣淨資產部位較大，故兌換損益主係受美元兌新臺幣匯率變動所影響。

因應對策：

該公司及其子公司財務單位隨時蒐集匯率變化訊息，與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充分掌握國際間匯率走勢及變化訊息，並視實際資金需求及匯率高低情況於適當時機買賣外幣存款，以降低匯率波動對公司獲利之衝擊。

(三)潛在風險

1.半導體產業景氣循環之風險

該公司及其子公司產品應用於微影製程之光罩相關半導體設備及相關零組件，主要銷售予晶圓代工廠及記憶體廠，因此該公司及其子公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運易受半導體產業資本支出需求狀況所影響。半導體市場易受景氣循環影響、且產品需求變化快速，故晶圓製造商若面臨不景氣或是產能過剩的狀況，不僅調降資本支出也將會削減對該公司及其子公司之下單致影響其營收及獲利。

因應對策：

- (1)該公司及其子公司具備多年設備開發設計及製造經驗，已累積豐富的實績，並擁有多項專利，該公司及其子公司除了加強生產製程管理，提高產品品質與效率，以降低生產成本，促進有效經營管理方式，另外，持續投入優化產品設計開發，加強產品技術與終端客戶技術需求開發，以擴大新產品開發領域，滿足新客戶產品需求。
- (2)該公司及其子公司產品應用領域廣泛，目前除應用在如晶圓代工廠、DRAM 製造廠，也陸續拓展半導體後段製造及工廠自動化智能製造等，另以既有產品提升功能規格，積極開發新產品，藉由適當調整經營策略並拓展新業務，期在經濟環境及產業變化下，公司營運能持續成長。

(四)綜合結論

綜上所述，本證券承銷商針對該公司及其子公司所處行業之營運風險、經營體質及其營運和財務風險綜合評估，該公司及其子公司已具備降低或分散風險之能力，且其經營穩健、獲利情況穩定，企業體質良好，本證券承銷商並就該公司及其子公司申請上櫃各項基本條件進行檢視及不宜上櫃條款之查核，據此評估該公司已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」所規定之上櫃標準，且其產業未來前景應屬樂觀，該公司及其子公司若能經由上櫃之路，透過資本市場募集長期發展所需之資金，並藉此提高公司知名度及吸引優秀人才，對該公司及其子公司永續經營及社會廣大投資人均有所助益，故本證券承銷商推薦該公司申請股票上櫃。

貳、推薦證券商就外國申請公司應列示說明其註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估外國申請公司所採行相關因應措施之適當性

該公司非屬外國申請公司，故不適用本項之評估。

參、產業狀況及營運風險

一、申請公司所屬行業營運風險

(一)產業狀況

1.全球半導體產業

半導體產業是一種採用半導體材料(III-V 族化學元素)去製造電子元件的產業，主要用於控制、計算、處理、記憶、傳輸。因為半導體是電子產品的基礎元件，常見的終端應用，例如：電腦、手機、相機、計算機、伺服器、顯示器、汽車、航空、軍武等。目前半導體產業已是一個高度全球化、高技術競爭、高資本門檻的產業。全球知名的半導體廠商，包含台積電、聯電、英特爾、美光、艾司摩爾、中芯國際、長江存儲等。半導體產業隨著摩爾定律持續發展和進步，積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，促使科技創新、社會改革、生產效率提升、產品應用擴展，對全球經濟發展有重大的貢獻，隨著科技的進步和需求的增加，半導體產業仍然具有很大的潛力和前景。

根據世界半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)統計資料指出，111 年全球半導體銷售值為 5,741 億美元，相較於 110 年全球半導體銷售值僅微幅成長 3.3%，主要係因 111 年受到俄烏戰爭、通貨膨脹、央行升息、終端消費萎縮、總體經濟下修等因素影響，成長力道明顯趨緩許多。112 年第一季因持續受到通膨及終端市場需求低迷影響，全球半導體市場銷售值 1,195 億美元，較 111 年第四季衰退 8.7%，112 年第二季全球半導體產業庫存持續去化中，全球半導體市場銷售值達 1,245 億美元，雖整體終端需求復甦力道不如預期，惟較上季成長 4.2%，顯示半導體市場低迷時期結束。

全球半導體市場季度成長趨勢



資料來源：WSTS，工研院產科國際所(112/09)整理

Gartner 數據與預測指出，112 年雖 GPU 等 AI 晶片需求強勁，但仍無法填補終端需求疲弱缺口，以致 112 年全球半導體營收預計將衰退 10.9%至 5,340 億美元；然而，在記憶體需求呈現強勁復甦下，113 年預計將成長 16.8%，達到 6,240 億美元，更預估 114 年將增 15.5%至 7,210 億美元。

全球半導體收入預測



資料來源：Gartner(112/12)

2. 臺灣半導體產業

臺灣是全球主要的半導體生產基地之一，在全球半導體產業中占有重要地位，處於全球半導體產業的領先地位，亦是臺灣經濟的重要支柱之一，產業發展受到政府的大力支持，通過設立科技基金、開發技術、政策補助等措施，促進臺灣半導體產業快速發展。時至今日，臺灣半導體產業的主要優勢，具有強大的晶圓製造能力，為全球半導體廠商或終端應用品牌客戶提供最佳的製造選擇，產值位居全球半導體領先地位。同時具有領先技術研發能力，不斷推陳出新，配合國際知名企業和研究機構建立密切的合作關係，共同研發和生產創新產品，設計開發出全球領先的半導體產品。此外，臺灣擁有領域廣泛的半導體供應鏈，涵蓋設備製造、IC 設計、材料生產、封裝檢測等多個製造關鍵節點。臺灣半導體產業長期建立出產業良好形象及巨大的品牌影響力，在全球市場上享有聲譽，將在未來繼續發揮重要作用，成為全球半導體產業中不可忽視的成員。

根據資策會產業情報研究所(Market Intelligence & Consulting Institute, MIC)統計資料指出，111 年臺灣半導體產值為新臺幣 44,088 億，年成長 18.6%。111 年相較過去 110 年，同樣經歷 110 年發生 26.8% 的爆發性增長，111 年受到高基期的影響，成長率仍優於全球半導體產業。112 年全球半導體產業面臨庫存調整期間拉長、IC 設計與記憶體產業需求下滑、美中科技戰未停歇等情勢，整體年度半導體規模陷入衰退態勢，預估 112 年臺灣半導體產業產值為 3.77 兆新臺幣，衰退 14.4%。

展望 113 年，預期各次產業將有一至二成的成長幅度，故預估產值將達 4.29 兆新臺幣，成長 13.7%。其中，晶圓代工仍為主要動能，特別是先進製程部分；記憶體部分，由於國際記憶體大廠持續減產，短期記憶體價格回穩，供需可望恢復穩定；IC 設計與 IC 封測產業，由於與終端消費性電子產品有較大關聯，未來兩季較難如同有先進製程助益的晶圓代工產值，有較好的復甦表現。

臺灣半導體產業產值

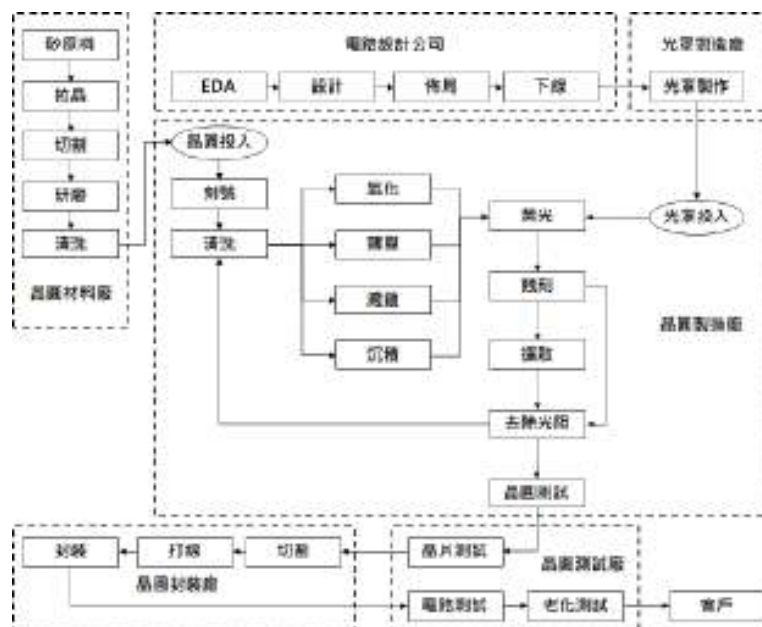


資料來源：MIC(112/11)

3. 半導體設備產業

半導體設備是半導體產業的核心，設備的品質和性能對半導體元件的良率和性能有很大的影響，是製造半導體元件所不可或缺的部分。全球知名的半導體設備商，包含應材、艾斯摩爾、東京威力科創、柯林研發、科磊等。其中，半導體製造過程包含：晶圓投入製造前所需的拉晶、切割、研磨、清洗，黃光製程所需的光罩製作，晶圓投入製造後所需的薄膜、濺鍍、黃光、蝕刻、擴散、清洗等製程，以後晶圓出廠後所需的測試、切割、打線、封裝。每個製造環節都需要半導體設備廠參與其中，例如：長晶爐、晶圓切割機、光罩交換機、極紫外光刻機、晶圓清洗機、檢測設備等，由半導體設備廠商提供先進設備及技術支援，以確保半導體元件生產具備穩定度和可靠度。因此，半導體設備廠商屬於整個半導體產業的重要合作夥伴，由於半導體產業的快速發展，相關設備的市場需求持續成長，例如：增設生產線、擴建擴廠，因此半導體設備廠商亦伴隨產業同步成長。

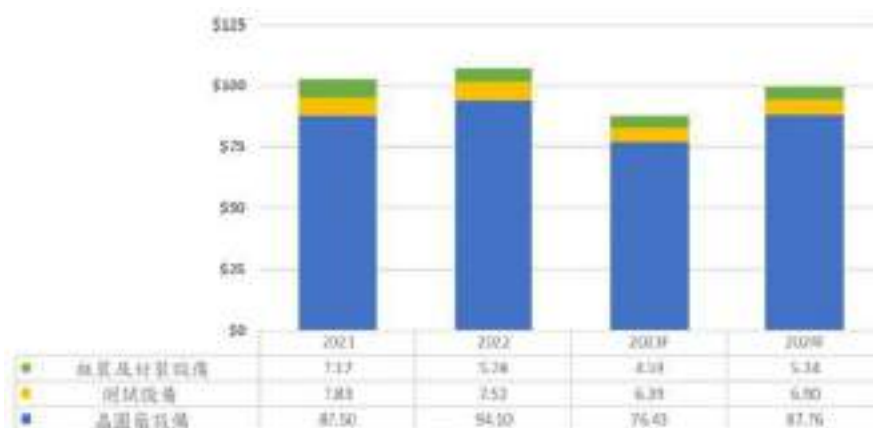
半導體設備相關製程站點



資料來源：<http://www.semiinsights.com>

根據國際半導體產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)統計資料指出，111 年半導體設備前段晶圓製造相關產值將為 941 億美元，年成長 7.5%。112 年預估產值將下降 18.8%至 764 億美元，主要是終端消費減弱，客戶端庫存堆積，使訂單削減，晶圓廠擴產需求形成一個週期，直至 113 年全球半導體設備產值將出現復甦跡象，重回千億美元，其中以晶圓廠設備為大宗，單一部門產值即來到 878 億美元，成長 14.8%。

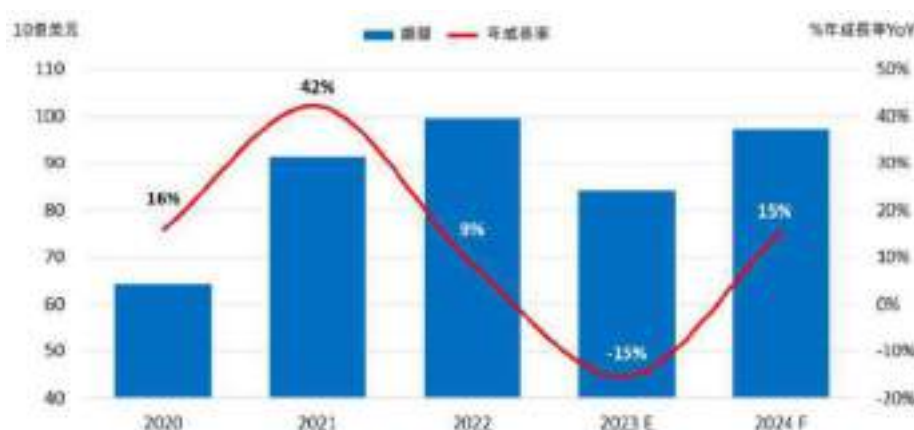
半導體設備產值預測



資料來源：SEMI(112/07)

SEMI 公布 112 年第三季《全球晶圓廠預測報告》指出，受到晶片需求疲軟以及消費性產品、行動裝置庫存增加影響，112 年第三季全球半導體設備出貨金額 256 億美元，較第二季 258 億美元減少 1%，較去年同期 288 億美元減少 11%，並預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，112 年從 111 年的歷史高點 995 億美元，下滑 15% 至 840 億美元，113 年隨著半導體庫存調整結束，以及高效能運算、記憶體等需求增加，有助晶圓廠設備支出復甦，將回升 15%，達到 970 億美元。

晶圓設備支出總額



資料來源：SEMI(112/09)

整體而言，半導體產業仍然充滿潛力和長期發展趨勢，包含：(1)智慧型裝置：隨著智慧型裝置的普及，如智慧型手機、智慧型家電、智慧型醫療等，將有助於擴大半導體的需求；(2)新能源車：電動車能源政策推動電動車，提升汽車電子整車滲透率，以及支援自動駕駛和安全技術，將有助於半導體不同階段製程；(3)物聯網：物聯網技術的發展將需要大量的半導體元件支持產品間傳輸功能，將有助於擴大半導體產業的應用發展；(4)雲端裝置：雲端計算和大數據將需要大量的半導體元件，將有助於推動半導體產業的發展；(5)新型技術：例如人工智慧、機器學習、量子電腦等新型技術的發展，將對半導體產業帶來新的商機。因此，半導體產業仍然具有

很大的潛力和前景，不斷透過技術研發和製程推進，應對市場需求和挑戰，在未來繼續保持強勁的增長動力，繼續擔當著全球科技發展的關鍵角色。

(二)所屬行業營運風險

茲就該公司及其子公司營運所屬之行業，分別說明景氣循環、行業上下游變化、行業未來發展及產品可替代性之營運風險如下：

1.景氣循環之營運風險

半導體業是一個具有循環性的行業，主要係因受到科技變化、技術進步、市場供需、地緣政治、全球經濟狀況等因素影響。尤其半導體業才剛經歷過去三年(109~111年)，因為疫情停工和缺櫃塞港造成產業鏈供不應求的現象，導致半導體不論在設計、製造、封裝階段，都呈現爆炸性的需求推動產業成長，半導體業紛紛大舉投入擴廠，這次晶片荒使得半導體業推上景氣循環週期的高峰。半導體業進入今年(112年)受到通貨膨脹，接續各國央行陸續升息，打擊疫情後全球景氣復甦，重挫終端電子產品消費信心，影響終端客戶下單意願，間接影響半導體業擴廠速度和資本支出投入。

然而，該公司及其子公司主要交易對象之技術涵蓋 EUV(Extreme Ultraviolet)製程，由於透過 EUV 的技術，晶圓代工廠得以製造出更小更密集的高階晶片，所需光刻、光罩較為特殊，與傳統設備相異，並且需要重新投入大量的研發和實驗，視為半導體業主力發展方向，不易受到總體經濟環境和投資縮減等因素影響。因此，該公司及其子公司並沒有發生傳統半導體設備業的景氣循環現象，反而因為 EUV 相關半導體設備市場的合格認證競爭對手較少，促進設備業市場需求穩定增長。

2.行業上下游變化之營運風險

該公司及其子公司之半導體設備應用於 EUV、高階光罩製程及 PVD(Physical Vapor Deposition)等，包含光罩潔淨、交換、檢測等，其主要原料可分為電料、金屬加工件、電控、管路組件等，提供設備設計、製造及維修服務及客製化解決方案。茲就該公司及其子公司所屬行業上下游之關聯性，列示如下：



資料來源：產業價值鏈資訊平台

(1)上游原物料供應變化

該公司及其子公司主要向上游供應商採購電料、電控、金屬加工件、管路組件等，用以組裝、整合、設計、製造半導體設備及自動化智慧倉儲管理等。該公司及其子公司之供應廠商眾多，並與供應商建立穩定之合作關係，目前各主要原物料供應充足，尚無原物料供應變化之風險。

(2)下游產品銷售變化

該公司及其子公司主要向下游客戶銷售半導體設備，應用於 EUV、高階光罩製程及 PVD 製程，包含光罩潔淨、交換、檢測等，且主要銷貨客戶為產業領導廠商，與客戶深耕多年並維持良好關係，透過不斷提高自身水平技術，伴隨客戶通過認證，共同打入新一代高階製程，維持產業領導地位，目前各主要產品銷貨穩定，尚無產品銷售變化之風險。

3.行業未來發展之營運風險

(1)行業未來發展之趨勢

A.半導體製程持續演進

隨著 5G 與物聯網裝置的日漸普及，無論日常生活與工作中所需傳輸與處理的資料呈指數型增長，帶動了高運算效率(High Performance Computing, HPC)的需求持續上升。為了達到高運算效率，並滿足低功耗的需求，各家先進製程廠商持續提高研發強度，先進製程從 7 奈米發展至 3 奈米；依據台積電 111 年股東會年報所述，3 奈米製程(N3)已於 111 年第四季進入量產，並致力於發展 2 奈米技術，提供高效能低功耗的效益，以滿足日益增加的節能運算需求，預計於 114 年開始量產。晶圓廠持續不段突破電晶體微縮的極限，在製程提升下，帶動半導體資本支出需求成長。

B.新產品應用需求旺盛

5G 的普及化、AI 快速增長以及加速數位化轉型等產業趨勢，使智慧型手機、高效能運算產品、物聯網及車用市場需求攀升，因電子產品採用半導體的含量提高，使積體電路製造服務領域成長強勁。智慧型手機市場部分，從原本僅要求高性能與高能源效率的積體電路技術，提升至高度整合的晶片與先進的 3D 封裝設計，提供成本、能耗及規格最佳化；高效能運算部分，包含個人電腦、平板電腦、遊戲機、伺服器及基地台等，其中以伺服器與數據中心需求較為強勁，滿足在人工智慧應用上日益增加的需求，以容載快速成長的資訊流量以及持續的 5G 基地台部署；物聯網部分，包含各樣的智慧聯網裝置，如穿戴裝置、音箱、健康裝置、家庭自動化裝置、城市與製造等，由於 Covid-19 疫情改變了消費者的生活與工作型態，並加速企業的數位轉型，使相關需求上升；車用電子部分，汽車產業朝更環保、安全及智慧的方向邁進，加速電動汽車、

先進駕駛輔助系統及智慧座艙資訊娛樂系統等發展，帶動相關處理器、車內網路、感測器及電源管理晶片的需求提升；消費性電子產品部分，主要需求落在高階產品，如大尺寸螢幕、高幀率電視、語音 AI 及 Wi-Fi 6 無線連接。隨終端產品應用需求擴增，帶動半導體產業持續成長。

C.各國半導體供應鏈在地化政策

為推動半導體在地化生產，減少對境外晶片的依賴，各國陸續執行半導體供應鏈的扶植政策，美國政府於 111 年 8 月通過規模 527 億美元的晶片與科學法案(Chips and Science Act)，其中 390 億美元將用於補助興建半導體廠房及購置設備，132 億美元用於先進製程的研發與人才培訓；歐盟則於 111 年 2 月通過規模 430 億歐元的歐盟晶片法案(European Chips Act)，將用於半導體製程研發與建廠補貼；隨著美中關係逐漸惡化，中國取得半導體關鍵零組件困難，故在十四五規劃中，將半導體產業發展納入規劃中，將全力支持發展第三代半導體，承諾將持續投入 1.4 兆美元，以期能實現半導體產業的獨立自主。在各國強力發展半導體產業下，晶圓大廠台積電、三星及美光紛紛宣佈於美國設廠，將對半導體設備廠商增添營運成長動能。

D.晶圓廠設備支出長期成長

依據 SEMI 預估全球用於前段晶圓廠設備支出預計 113 年全球晶圓廠規模將同比增長 21%，市場規模達到 920 億美元，其中臺灣為全球晶圓廠設備支出領頭羊，總額較 112 年增加 4.2%來到 249 億美元；韓國排名第二，總額 210 億美元，同比成長 41.5%；中國大陸則排名全球設備支出第三位，預期受美國出口管制下，先進製程發展有所受限，投資額維持 160 億美元；美洲地區排名第四，可望達到創紀錄的 110 億美元，同比成長 23.9%；歐洲和中東地區的投資額預期也將續創新高，支出總額增加 36%至 82 億美元；日本和東南亞晶圓廠設備支出預計到 113 年也將分別回升至 70 億美元和 30 億美元。因應終端市場需求強勁，半導體廠商持續擴大產能，使半導體設備廠商持續成長。

(2)行業未來發展之營運風險

A.半導體產業伴隨技術升級，產品應用拓展迅速

該公司及其子工司主要產品主係應用於半導體製程中光罩相關設備，包含光罩儲存、交換、潔淨及檢測等功能。半導體製程演進快速，高效能、低能耗的要求使晶圓製造廠商更加重視製程良率，因應客戶需求，該公司及其子公司須即時開發符合市場需求之產品，根據客戶需求客製化設備，以爭取訂單。

因應對策：

該公司及其子公司研發團隊秉持多年經驗開發符合客戶需求之產品，並提供完整的微環境解決方案，持續開發高階製程之設備。研發團隊與重點客戶維持良好互動，即時參與新功能、新規格之設備開發，以提高研發能量，且該公司及其子公司在設計產品之初期，與客戶充分討論，於產品設計階段將客戶需求納入考量，增進公司產品品質，生產符合客戶期待之產品。

4. 產品可替代性之營運風險

該公司及其子公司主要提供光罩相關設備之設計、製造及銷售等服務，為全臺少數能提供多樣化及客製化的光罩相關微環境設備及解決方案之本土廠商。因光罩金額高，且因製程演進，光罩使用的數量大增，該公司及其子公司之產品對於晶圓廠微光製程良率助益大，公司經營團隊本身具有半導體設備之產品開發及設計之技術能力，擁有多年產業經驗，與家登精密之光罩載具配合，提供客戶完整微環境解決方案，其安全規範、技術能力及服務均獲得客戶的肯定及認同，客戶遍及半導體產業、光電產業等，產品應用領域廣泛，未來除持續精進開發符合客戶需求之光罩相關設備，並期望得以開發新型機台，進而降低在設備製造市場被取代之風險。

二、發行公司營運風險

(一) 業務之營運風險

1. 市場未來供需變化情形

根據國際半導體產業協會(SEMI)報告，全球前端晶圓廠設備支出自 109 年起已連續三年呈現成長趨勢，111 年支出金額來到 980 億美元新高，惟受晶片庫存修正以及終端消費需求衰退影響，使 112 年設備支出下修至 760 億美元，但 5G、AI、高效能運算等技術創新推動市場規模持續擴張，另車用市場及物聯網等終端產品之半導體含量持續提升，使半導體長期需求仍持續看漲，預期將帶動 113 年晶圓廠設備廠支出回彈至 920 億美元。儘管前端晶圓廠設備支出受總體經濟局勢影響，惟長期策略投資的基本面仍然暢旺，以支持人工智慧、汽車和其他成長中應用的重大技術發展。112 年第三季全球半導體設備出貨金額為 256 億美元，其中臺灣出貨金額為 37.7 億美元，穩居全球前三，展望 113 年各地區別晶圓設備廠支出，臺灣將持續穩坐全球晶圓廠設備支出領先地位，總額較 112 年增加 4% 來到 230 億美元；韓國排名第二，總額 220 億美元，成長 41%；中國則以 200 億美元排名全球設備支出第三位，預期受美國出口管制下，先進製程發展有所受限，其將持續以成熟製程進行投資及布局。



資料來源：國際半導體產業協會(SEMI)

雖然 112 年半導體設備市場支出因需求調整過渡期減緩，但依國際半導體產業協會(SEMI)報告指出，基於高效能運算及車用電子之市場強勁，推動 113 至 115 年半導體設備資本支出出現雙位數成長，預估 12 吋晶圓廠設備支出將出現成長浪潮，113 年預計投入 820 億美元，並於 114 年成長至 1,019 億美元，115 年達到 1,188 億美元。此外，受惠於 AI 人工智慧及及高效能運算之應用，各半導體晶圓積極發展先進製程，其中 EUV 機台為先進製程之關鍵生產環節，其屬中長期之產能規劃一環，較不受短期景氣循環波動影響。



資料來源：國際半導體產業協會(SEMI)

綜上所述，雖 112 年半導體設備廠受庫存修正及終端需求疲軟影響遭遇短暫逆風，但因 AI 人工智慧、5G 通訊、高效能運算及車用電子市場之長期需求看漲，使 113 年對半導體設備需求恢復成長趨勢。

2.該公司及其子公司同業間之地位、市場占有率、相關機器設備及人力資源

(1)同業間之地位

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要產品係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能。綜觀目前國內上市櫃公司，並無與該公司所營事業完全相同之公司，故就該公司之產品性質、營運模式及應用領域等因素予以綜合考量，選取京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱：京鼎)、華景電通股份有限公司(以下簡稱：華景電)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱：天虹)為其比較同業，京鼎主要從事先進設備設計及製造，其產品主要應用在半導體產業、面板產業、光電產業等，並提供高科技產業全廠自動化整合規劃服務，生產的設備模組與零組件，其應用領域涵蓋物理氣相沉積(PVD)、原子層沉積(ALD)薄膜製程；華景電主要從事半導體設備暨關鍵性零組件、自動化設備及系統整合，主要產品為晶圓製程 AMC(Airborne Molecular Contamination)微污染防治設備及 RFID(Radio-frequency identification)派工整合系統；天虹主要從事半導體設備機台與半導體設備零備件產品之研究開發、製造及銷售，主要產品為物理氣相沉積設備(PVD)、原子層沉積薄設備(ALD)及晶圓鍵和機及解鍵合機設備等。

該公司及其子公司 110~111 年度之營業收入分別為 601,932 千元及 1,047,953 千元，營業收入成長率分別為 25.99%及 74.10%，整體與同業相較其營收成長幅度大幅增加。茲將採樣同業之資料列示如下：

單位：新臺幣千元；%

公司名稱	營業項目	111 年度		合併營收淨額				
		資本額	資產總額	109 年度	110 年度	111 年度	110 年度 成長率	111 年度 成長率
家碩	臺灣櫃買中心興櫃公司，代號 6953，主要營業項目為半導體設備及相關零組件設計、製造、銷售及維修服務，應用於 EUV 光罩及高階製程之光罩傳載自動化技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等。	225,600	1,655,098	477,773	601,932	1,047,953	25.99	74.10
京鼎	臺灣證交所上市公司，代號 3413，主要營業項目為半導體設備與平面顯示器設備、次系統與系統整合服務，產品主要應用在半導體產業、面板產業、光電產業等	970,509	19,690,192	9,942,056	12,246,437	14,843,221	23.18	21.20
華景電	臺灣櫃買中心上櫃公司代號 6788，主要營業項目半導體設備暨關鍵性零組件、自動化設備及系統整合之設計製造與銷售。	347,397	2,369,207	730,182	1,108,984	1,416,410	51.88	27.72
天虹	臺灣證交所上市公司，代號 6937，主要營業項目為半導體設備機台與半導體設備零備件產品之研究開發、製造及銷售。經營自有品牌半導體設備，設備零組件業務則以客製、翻修、改良改進客戶現場設備為主。	606,773	2,970,646	998,574	1,655,712	1,815,477	65.81	9.65

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告；公開資訊觀測站

(2)市場占有率

該公司及其子公司主要業務為產品主要營業項目為半導體設備及相關零組件設計、製造、銷售及維修服務，應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)製程所需之光罩傳載解決方案，產品包含光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等。其產品多屬高度客製化，目前市場上並無相同或相似領域之同業，故未有相關統計資料可一致性基礎比較其市場占有率。惟該公司及其子公司之主要銷售客戶皆為國際知名半導體大廠，且其產品皆通過相關認證，並與客戶建立有長期合作關係，短期內難以有供應商可跨足進入該供應鏈。另對高效能運算及車用電子市場強勁及記憶體需求之增加，帶動先進製程需求增加，連帶使 EUV 設備及其相關需求上升，可望進一步助益該公司及其子公司業績。

該公司及其子公司 111 年營業收入為 1,047,953 千元，較前一年度成長 74.1%，為全球半導體前段設備產值，約占全球半導體設備出貨金額 0.03%，其持續深耕關鍵客戶，兼併延伸業務觸角至新應用領域與新市場，以逐步擴大市場占有率。

(3)相關機器設備

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，為 EUV 光罩設備及高階光罩設備之供應商，其產品屬高度客製化，並以人工方式進行機台組裝，該公司及其子公司之機器設備係研發用 PVD 製程相關設備，未有從事生產製造之機器設備，截至 112 年 9 月底止之機器設備淨額為 59,365 千元，尚無重大異常情形。

(4)人力資源

日期：111 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元；人

公司名稱	營收淨額 (A)	稅後淨利 (B)	員工人數 (C)	員工平均 營收貢獻度 (A/C)	員工平均 淨利貢獻度 (A/B)
家碩	1,047,953	203,415	97	10,804	2,097
京鼎	14,843,221	2,344,363	2,885	5,145	813
華景電	1,416,410	349,442	257	5,511	1,360
天虹	1,815,477	316,862	310	5,856	1,022

資料來源：該公司提供；各公司 111 年度經會計師查核簽證之合併財務報告；各公司 111 年度股東會年報

該公司及其子公司 111 年 12 月 31 日之員工人數為 97 人，111 年度每位員工平均營收入貢獻度 10,804 千元及平均淨利貢獻度 2,097 千元。與採樣同業相較，該公司平均營收貢獻度及平均淨利貢獻度皆大於所有採樣同業，顯見該公司

及其子公司之人力資源效益良好，就人力資源狀況分析其於採樣同業地位中尚屬穩健。

3.影響該公司及其子公司未來發展之有利及不利因素及其相關因應措施

(1)有利因素

A.半導體產業需求持續暢旺

近年受 Covid-19 影響改變消費者生活及工作型態，亦促使全球企業積極推動數位轉型，使消費性電子、AI 人工智慧、5G 通訊及物聯網需求持續成長，此外，環保意識抬頭連帶刺激電動車市場之發展，而相關技術之發展對於大量資料處理及複雜運算能力要求增加，使的高效能運算市場需求湧現。全球在相關技術及產品的創新趨勢堆動下，使半導體需求結構性成長，除成熟製程晶片需求暢旺外，在對晶片高效能低功率要求下，使製程技術要求提升，連帶推動半導體設備升級以滿足先進製程需求。因此，伴隨人類對科技創新及便利生活之追求，持續提供半導體產業成長動能。

B.半導體設備供應鏈進入門檻高

半導體產業係一高度精密產業，對製程工序有高度要求且容錯率極低，為使各階段製程品質穩定，其所使用半導體設備有舉足輕重之影響。故各家半導體廠商對半導體設備之要求皆採嚴格控管，唯有通過認證之設備方可投入生產，惟通過認證需經相當時間溝通及技術驗證，一但成為其合格供應商不會輕易更動，將可拉開與其他供應商之競爭距離。而該公司及其子公司目前主要提供光罩儲存、清洗及交換設備，已成功進入多家知名半導體廠商供應鏈，其憑藉優異之技術能力及豐富之製造經驗，以及對於產品品質之穩定、交期及產能之配合度，取得客戶之信賴，奠定其競爭利基，有利於未來產品及服務持續拓展。

C.擁有高品質穩定之製造供應鏈

該公司及其子公司深耕半導體領域多年，隨著半導體進入先進製程，對生產之良率及污染容許度要求更加嚴格，故除持續精進自身產銷及研發能力外，為確保其產品品質、交期產能之穩定性，該公司及其子公司亦積極開發相關原物料供應商，並透過長期穩定之合作關係，提升各供應商提供之原物料之產品品質及良率，另藉由採購團隊對各供應商對原物料交期之積極掌握，降低其原物量管控成本，亦可避免原物料有斷貨或遲交之可能，建立穩定之原物料供應鏈。

(2)不利因素

A.專業人才取得與留任面臨挑戰

臺灣地緣風險提高，各國期盼半導體產業在地化，使全球爭奪半導體技術人才情形加劇，且面臨國內理工科畢業生逐年下滑，該公司及其子公司之規模及品牌能見度不及國內大型科技企業與國際大廠，此外由於該公司及其子公司生產據點位於南部，距離如竹科等半導體產業聚落較遠，人才招募上較為不易。

因應對策：

該公司及其子公司申請股票上櫃以提高企業知名度，吸引優秀人才；推行人性化管理制度，建立以績效導向之激勵機制並順暢升遷管道，同時，持續優化各項福利制度，致力創造愉快又有競爭力的工作環境，凝聚員工對公司的向心力，並增加員工留任率。

B.銷貨集中風險

隨著 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，各產業為提升自身競爭力，致力生產技術升級與生化自動化製造技術，故近年來半導體代工業者擴大先進製程與產能規模，帶動資本支出預算陸續增加。然半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡占的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致該公司及其子公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，且該公司考量整體營運規模，選擇優先滿足領導大廠資本支出需求，而出現銷貨集中之情事。

因應對策：

(1)技術延伸至新產品或新市場開發

該公司及其子公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用該公司及其子公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境設備需求與日俱增趨勢，該公司及其子公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

(2)鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，該公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，該公司及其子公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外該公司及其子公司與其長期合作的關係，且該公司及其子公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場

具領導地位，該公司及其子公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為該公司及其子公司帶來廣大的客戶效益，有助於該公司銷售策略之運用。

(3)積極開發其他客戶

該公司及其子公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。該公司及其子公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展該公司及其子公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

4.該公司目的事業成就與不成就之關鍵因素

(1)產品取得客戶認證

半導體設備具有高技術門檻，且欲進入半導體廠商之合格供應體系，需花費相當時間之溝通及技術驗證方能取得認證。不過一但獲得採用，其他供應商將難以跨入。該公司及其子公司憑藉優異之技術能力及豐富之製造經驗，已成功打入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

(2)與客戶及供應商夥伴關係供應鏈關係良好

該公司及其子公司深耕半導體市場，與國內外半導體大廠已建立良好互信之合作夥伴關係，在產品開發設計之初，即完整掌握客戶需求，並充分討論溝通規格，以提供其最完善之技術方案。透過穩定之供應鏈關係，使該公司及其子公司業績可穩定成長。

(3)集團資源綜效

該公司及其子公司隸屬家登集團，承集團業務渠道、技術及專業人才支援，以及管理運營經驗等各資源共享之合作綜效，對於其業務與技術整合及專業管理團隊之建立有極大助益。殷實之專業管理團隊可極大化公司之業務策略推展及整合性解決方案效益，為公司長遠之營運規劃打下良好基礎。

(二)技術能力、研發及專利權之營運風險

1.取得技術專家之評估意見佐證。

本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司及其子公司之研發技術能力出具意見或報告，故不適用本項評估。

2.取得申請公司研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以瞭解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近三年度及申請年度截至最近期止研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險。

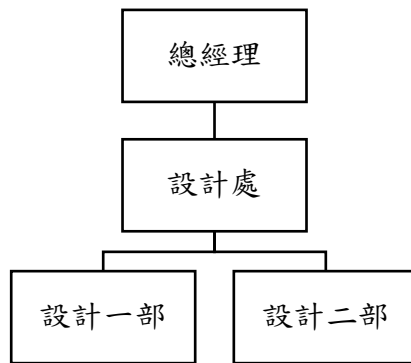
(1)研究發展部門之沿革及組織

該公司係於 105 年由母公司家登精密工業股份有限公司投資設立，主係從事半導體 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，包含光罩清洗、光罩交換、光罩檢查、光罩儲存、光罩管理等，為經營自有品牌的半導體設備製造商。

該公司過去已累積多年設備開發經驗，近年來，研發團隊更與半導體製造商客戶共同合作開發光罩先進製程應用機台，維持良好夥伴關係，在技術上也不斷精進自我領先同業，持續推廣光罩週邊設備應用，並將技術領域推升至自動光學檢測(AOI)及極紫外光微影製程(EUV)設備。該公司後續再於 109 年收購子公司昇和精技公司，將技術觸角延伸到物理氣相沉積(PVD)真空鍍膜相關機台設計及濺鍍設備改造。

該公司研發部門專指設計處，茲將該公司之研發部門組織架構及其工作職掌列示如下：

A.研發部門組織圖



資料來源：該公司及其子公司提供

B.研發部門職掌

研發部門	工作職掌
設計一部	<ul style="list-style-type: none"> ● 機台設計與異常排除 ● 機構設計
設計二部	<ul style="list-style-type: none"> ● 機台連結與整合 ● 電控程式開發 ● 應用工程 ● 軟體開發

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)研發部門人員之人數、學經歷、平均年資、流動情形及離職率

單位：人；年；%

年度		109 年度	110 年度	111 年度	112 年度 截至 11 月底
項目					
期初研發人員合計		7	10	18	30
本期新增	新進人員	5	8	14	18
	轉進人員	—	—	—	—
本期減少	轉出人員	—	—	—	1
	資遣人員	2	—	1	—
	退休人員	—	—	—	—
	離職人員	—	—	1	10
期末研發人員合計		10	18	30	37
離職率(註 2)		16.67	—	6.25	21.28
平均服務年資(註 3)		1.51	1.61	1.54	1.88
學歷分佈	博士	—	1	1	—
	碩士	3	7	10	14
	大學(專)	7	10	19	23
	高中以下	—	—	—	—

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：離職率=(離職人數+資遣及退休人員)/(期末人數+離職人數+資遣及退休人員)

註 2：該公司係於 109 年 12 月 31 日收購子公司昇和精技公司，昇和精技公司之員工服務年資自 109 年 12 月 31 日起算

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年截至 11 月底之研發人員分別為 10 人、18 人、30 人及 37 人，占員工總數之比率分別為 15.63%、23.38%、30.61% 及 28.91%。其中，碩士以上學歷之研發人員分別為 3 人、8 人、11 人及 14 人，占研發人員之比率分別為 30.00%、44.44%、36.67%及 37.84%，且多具備半導體、電機機械或自動化設備相關產業工作資歷，顯示該公司及其子公司對研發人員之素質相當重視。

在研發人員流動情形方面，109~111 年度及 112 年截至 11 月底之離職率分別為 16.67%、0%、6.25%及 21.28%，離職人員多為基層研發人員，離職原因主要係個人職涯規劃或家庭因素等。資遣及退休方面，該公司 109~110 年度及 112 年截至 11 月底止無退休人員；109~110 年度及 112 年截至 11 月底止資遣人數分別為 2 人、0 人、1 人及 0 人，係因工作績效未如預期，經勞資雙方充分溝通同意後，該公司依法向主管機關通報並依規定支付資遣費，並無損及資遣員工權益之情事。該等離職人員非重要管理職，並未掌握核心技術，且皆有妥善安排後續接任之人員交接，並持續招募新進人員，業務上之銜接亦無中斷情形，故尚不足以對該公司及其子公司研發計畫及進程造成顯著影響，研發部門人力尚屬穩定。

該公司及其子公司研發人員在職期間之相關研發成果屬該公司所有，且所有研發人員均有簽署保密條款，規範機密資訊之保密義務。為避免人員流動造成研發中斷風險，已訂定相關研發循環內控管理，對於研發過程完整保存記錄，對於研發成果申請智慧財產權保護。整體而言，研發人員之流動尚不至對該公司及其子公司研發部門之運作及公司整體營運產生重大之影響。

(3)最近三年度及申請年度截至最近期止研發費用

單位：新臺幣千元；%

	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
研發費用	15,102	38,612	75,035	113,712
合併營業收入淨額	477,773	601,932	1,047,953	1,016,063
占當年度營收淨額比率(%)	3.16	6.41	7.16	11.19

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之研發費用分別為 15,102 千元、38,612 千元、75,035 千元及 113,712 千元，占各年度營業收入淨額比例分別為 3.16%、6.41%、7.16%及 11.19%。研發費用主要係研發人員薪資支出及折舊費用。109~111 年度及 112 年前三季之研發費用逐年增加，主要係因該公司及其子公司持續招募優秀人才，以及獲利成長產生相應獎酬，使薪資支出增加所致。顯示該公司及其子公司為維持產業競爭力，投入大量資源致力留任公司發展所需之人才積極培養研發團隊。綜上所述，該公司及其子公司研發費用占營業收入淨額比例之變動情形尚屬合理，尚無重大異常情事。

(4)重要研發成果

茲將最近五個會計年度截至本評估報告出具日止，該公司及其子公司之重要研發成果彙總列示如下：

年度	研發成果
107 年	光罩儲存管理設備
108 年	高階光罩潔淨設備、光罩交換設備
109 年	EUV 微環境充氣倉儲
110 年	EUV 光罩智慧檢測設備、EUV 光罩高潔淨技術、EUV 光罩傳送驛站
111 年	EUV 光罩交換與長期儲存方案、EUV 倉儲整合自動化系統
112 年	新一代 EUV 光罩檢測機台

資料來源：該公司及其子公司提供

(5)主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司及其子公司主係提供半導體 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，包含光罩清洗、光罩交換、光罩檢查、光罩儲存、光罩管理等，主要核心技術來自於內部專業研發技術團隊，研發部門人員累積長期開發設備產品經驗，深耕產業多年，建立自有核心技術，並藉由配合客戶需求，由研發團隊與國際知名大廠密切合作開發，進而創造研發動能，提升產品技術層次與服務品質；此外，該公司及其子公司除掌握有自有技術來源外，必要時亦與大專院校產學合作及與技術顧問進行技術開發計畫，直接或間接提升公司技術能力。該公司及其子公司每年均持續投入研發資源，進行專案規劃及新產品開發，及長期累積豐富的實務經驗。該公司及其子公司截至評估報告出具日止，尚屬技術開發階段，故尚無支付權利金之情事，茲將相關技術契約列示如下：

合作對象	契約起訖日期	主要內容	技術報酬金或權利金之支付方式
學校	112/05/01~113/04/30	技術開發	依合約
技術顧問	110/04/08~ 雙方義務履行完成	技術開發	依合約

資料來源：該公司及其子公司提供

上述技術合約內容，對該公司並無重大限制條款，而相關技術開發完成後，對提昇該公司開發能力具正面助益，並將對未來營運成長有所幫助，並可增加公司之營收及獲利。

(6)研發工作未來發展方向

該公司及其子公司持續投入 EUV 光罩製程、高階光罩製程相關設備及關鍵零組件之研發，精進製程培養穩定之研發團隊及技術。未來投入之研發費用將視營運狀況逐年提升。

A.短期研發方向

(A)EUV 相關機台開發

EUV 設備為當今半導體產業先進製程的主流方向，發展 EUV 設備有利於提高整體行業的競爭力及產品市場，短期內該公司將配合客戶需求，開發及優化 EUV 光罩交換機、智慧光罩儲存櫃及 EIP 檢查機等設備。依照客戶需求開發新功能，一方面提高機台穩定度，另一方面確保客戶在製程上有更好的良率與效率。

(B)光罩 AOI 相關機台開發

光罩 AOI 設備用於取代人工檢測光罩上殘留的微小粒子，以及光罩中的缺陷和異常，並提高其準確性和一致性，提供資訊以判斷進行修復或替換。短期內該公司將開發符合客戶需求規格的光罩 AOI 檢查機，並不斷提升機台的穩定度及檢驗能力，確保提供客戶更準確的檢驗結果。

B. 中期研發方向

(A)光罩 AOI 與清洗機結合

該公司將結合內部已有穩定技術的光罩清洗機，以及新開發的 AOI 檢查機，在清洗後可立即驗證清洗結果，並進行參數結果，減少清洗後送到其他機台檢驗來回搬運的時程，並降低因前述作業，來回搬運過程中對光罩造成的風險。

(B)光罩 AOI 與交換機結合

該公司將結合內部已有穩定技術的光罩交換機，以及新開發的 AOI 檢查機，可在每次載具交換過程中，對光罩進行檢測，當發現重大瑕疵可立即提供資訊以判斷進行修復或替換，大幅降低客戶使用瑕疵光罩的機率。

C. 長期研發方向

(A)發展光罩 AOI 檢測能力

隨著半導體產業的應用，對光罩精度要求越來越高，為了檢出極小的缺陷，將使用非可見光源的 AOI 檢測方式，搭配矩陣運算得到更精確的結果。該公司將發展更加高效及智能化的光罩 AOI 檢查機，持續提高檢測的精度和速度，並強化針對缺陷的計算及分類的能力。

(7)目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形

該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度，並無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事。茲將該公司及其子公司已取得或申請中之專利權及商標權列示如下：

A. 專利權

(A) 已取得

項次	專利名稱	專利號	權利期間	註冊地
1	光罩清洗裝置	I317149	2009/11/11~2026/08/14	中華民國
2	Photomask cleaner	US20080041429A1	2010/03/09~2028/08/21	美國
3	充氣設備	I379171	2012/12/11~2027/12/26	中華民國
4	Gas filling apparatus	US8286672B2	2012/10/16~2031/05/22	美國
5	氣體充填承座、氣體充填承座組，及氣體充填設備	I357474	2012/02/01~2028/10/13	中華民國
6	光罩清洗方法及其系統	I452423	2014/09/11~2032/11/18	中華民國
7	Method and system for cleaning photomasks	US20140137890A1	2016/12/13~2034/06/29	美國
8	Method and system for cleaning photomask	10-1436125-0000	2014/09/01~2033/04/16	南韓
9	氣閥結構及應用彼之充氣座	I563198	2016/12/21~2033/04/11	中華民國
10	氣壓閥件結構及應用彼之充氣座以及充氣櫃	I551799	2016/10/01~2033/08/22	中華民國
11	晶圓輸送系統及其運作方法	I536489	2016/06/01~2034/05/22	中華民國
12	Wafer transport system and method for operating the same	US9786535B2	2017/10/10~2036/01/20	美國
13	密封元件	M506908	2015/08/11~2025/01/22	中華民國
14	半導體容器清洗機的運作方法	I544973	2016/08/11~2035/03/19	中華民國
15	Operating methods of purge devices for containers	US9543176B2	2017/01/10~2035/07/29	美國
16	Operating methods of purge devices for containers	10201505659V	2016/10/28~2035/07/21	新加坡
17	針孔式噴嘴清潔設備及其運作方法	I580488	2017/05/01~2035/04/06	中華民國
18	Purge devices having micronozzles and operating methods thereof	US20160300735A1	2016/10/13~2035/11/04	美國
19	Purge devices having micronozzles and operating methods thereof	10201503808R	2016/11/29~2035/05/14	新加坡
20	Thin substrate pitch measurement equipment	US7663129B1	2010/02/16~2028/09/30	美國
21	Gas filling apparatus and gas filling port thereof	US7694498B2	2010/04/13~2028/12/18	美國
22	Gas filling apparatus	US8286674B2	2012/10/16~2031/08/12	美國
23	Temperature and humidity measuring device deployed on substrate	US8413505B2	2013/04/09~2031/08/15	美國
24	Wafer box conveyor	US8657310B2	2014/02/25~2032/07/18	美國
25	Photomask cleaning device	US8973199B2	2015/03/10~2033/09/05	美國

項次	專利名稱	專利號	權利期間	註冊地
26	Air-blown cleaning system for photomasks and method thereof	US9296023B2	2016/03/29~2034/11/30	美國
27	充氣設備	CN101587823A	2012/04/18~2028/05/21	中國大陸
28	光罩清洗設備	M623801	2022/02/21~2031/11/17	中華民國
29	光掩膜清洗設備	CN216622955U	2022/05/27~2031/12/21	中國大陸
30	智能控制流量的充氣承座	M636444	2023/01/11~2032/08/24	中華民國
31	一體式充氣盤面	M637910	2023/02/21~2032/08/24	中華民國
32	用於檢測光罩內盒的夾取機構	M635531	2022/12/11~2032/09/18	中華民國
33	晶圓載具的充氣盤面	M636554	2023/01/11~2032/09/25	中華民國
34	量測光罩載具之溫濕度的治具	M639219	2023/04/01~2032/10/19	中華民國
35	自動量測光罩載具之流量的治具	M640851	2023/05/11~2032/11/16	中華民國
36	光罩載具的充氣承盤	M641070	2023/05/11~2033/01/17	中華民國
37	具有吸塵功能的光罩清潔裝置	M643993	2023/07/21~2032/12/11	中華民國
38	光罩盒次元件的檢測裝置	M644099	2023/07/21~2033/03/02	中華民國
39	光罩盒表面的光學檢查裝置	M644100	2023/07/21~2033/03/02	中華民國
40	光罩盒表面高速檢查系統	M644101	2023/07/21~2033/03/02	中華民國
41	降低粉塵汙染的光罩內盒承載裝置及光罩內盒的光學檢查設備	M644162	2023/07/21~2033/03/29	中華民國
42	抽屜更換式清潔設備	I813073	2023/08/21~2041/11/17	中華民國
43	抽屜更換式清潔設備	CN216728381U	2022/06/14~2031/12/21	中國大陸
44	光罩內盒的夾持具	I819840	2023/10/21~2042/10/10	中華民國

資料來源：該公司及其子公司提供

註：第 1~27 項專利權為家登精密工業股份有限公司於 106 年讓與該公司

(B)申請中

項次	專利名稱	申請號	申請日期	註冊地
1	用於檢測光罩內盒的夾取機構	111135313	2022/09/19	中華民國
2	量測光罩載具之溫濕度的治具	111139769	2022/10/20	中華民國
3	自動量測光罩載具之流量的治具	111143876	2022/11/17	中華民國
4	光罩盒次元件的檢測裝置	112107863	2023/03/03	中華民國
5	光罩盒表面的光學檢查裝置及光罩盒表面的光學檢查方法	112107864	2023/03/03	中華民國
6	光罩盒表面高速檢查系統以及光罩盒表面高速檢查方法	112107865	2023/03/03	中華民國

項次	專利名稱	申請號	申請日期	註冊地
7	降低粉塵污染的光罩內盒承載裝置及光罩內盒的光學檢查設備	112112233	2023/03/30	中華民國
8	用於光罩傳送盒承載平台之除塵裝置	112125799	2023/07/11	中華民國
9	高潔淨度的光罩夾取模組	112146629	2023/11/30	中華民國
10	可消除影像雜訊的光學檢測系統	112148097	2023/12/11	中華民國
11	光罩夾取模組	112148765	2023/12/14	中華民國
12	抽屜更換式清潔設備	17/989,709	2022/11/18	美國
13	用於檢測光罩內盒的夾取機構	18/079,899	2022/12/13	美國
14	量測光罩載具之溫濕度的治具	18/091,398	2022/12/30	美國
15	光罩內盒的夾持具	18/091,411	2022/12/30	美國
16	自動量測光罩載具之流量的治具	18/091,413	2022/12/30	美國
17	光罩盒表面高速檢查系統以及光罩盒表面高速檢查方法	18/319,508	2023/05/18	美國
18	光罩盒表面的光學檢查裝置及光罩盒表面的光學檢查方法	18/319,510	2023/05/18	美國
19	降低粉塵污染的光罩內盒承載裝置及光罩內盒的光學檢查設備	18/321,799	2023/05/23	美國
20	光罩盒次元件的檢測裝置	18/319,512	2023/05/18	美國
21	抽屜更換式清潔設備	202111574982.1	2021/12/21	中國大陸

資料來源：該公司及其子公司提供

B.商標權

(A)已取得：無。

(B)申請中

項次	類別	申請號	商標內容	申請日期	註冊地
1	07、09、37、42	112049236	家碩科技	2023/07/20	中華民國
2	07、09、37、42	112049229		2023/07/20	中華民國

資料來源：該公司及其子公司提供

C.著作權：無。

3.取得申請公司目前重要技術合作契約，就其內容評估對申請公司營運之風險。

該公司及其子公司產品技術主要是依據客戶需求自行開發及改良，截至評估報告刊印日止，與他人簽訂技術合作契約，除大專院校產學合作外，主要係半導體新應用相關設備的共同技術開發協議，其契約內容並無重大不利限制條款，故對該公司及其子公司營運尚無不利之影響。

4.以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫，以及生產開發技術之層次、來源等資料，以評估市場定位、需求及研究發展之內部控制暨保全措施。

該公司非以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃，故不適用本項評估。

5.以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得參與經營決策之董事、持股超過股份總額百分之五之股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三年度及申請年度內股權移轉變化暨實際投入經營之時間與情形等，以評估該等人員未來若未能繼續參與經營對申請公司之營運風險，及其因應之措施。

該公司非以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃，故不適用本項評估。

(三)人力資源分析之營運風險

1.最近三年度及申請年度截至最近期止依產品別區分之每人每年生產量值表，並就重大變動情形者，加以分析其原因

該公司及其子公司之主要產品別可區分為 EUV 光罩相關機器設備、高階光罩相關機器設備及其他，其中 EUV 光罩相關機器設備及高階光罩相關機器設備主要係依客戶端應用製程差異區分，該公司主要由工程處負責生產組裝機器設備，惟因工程處並未直接區分生產 EUV 光罩相關機器設備及高階光罩相關機器設備之人員，故無法按 EUV 光罩相關機器設備及高階光罩相關機器設備產品別區分每人每年生產量值，另其他主要係零件備品及維修服務等，品項複雜，計量單位不一，亦無法以產能、產量、產值資訊加以分析，故以下僅就該公司及其子公司最近三年度及 112 年前三季之光罩相關機器設備計算每人每年生產量值表列示如下：

單位：新臺幣千元

主要 產品項目		年度別		109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		產量	產值	產量	產值	產量	產值	產量	產值		
光罩 相關 機器 設備	生產量值	62	299,247	85	350,787	159	581,275	227	506,722		
	直接人員	平均 量值	3	13,011	3	14,031	6	22,357	6	14,478	
		人數	23		25		26		35		
	直接及 間接人員	平均 量值	1	4,676	1	4,616	2	5,993	2	4,022	
		人數	64		76		97		126		

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，因係採接單式生產，主要依客戶需求之功能及規格予以客製化，故生產產量及產值隨客戶訂單波動。該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季光罩機器設備產值分別為 299,247 千元、350,787 千元、581,275 千元及 506,722 千元，直接人員每人平均產值分別為 13,011 千元、14,031 千元、22,357 千元及 14,478 千元，直接及間接人員每人平均產值分別為 4,676 千元、4,616 千元、5,993 千元及 4,022 千元。109~111 年度及 112 年前三季光罩機器設備產量及產值隨營運規模成長呈逐年上升趨勢；就直接人員平均產值而言，除 112 年前三季因應營運規模擴大，增聘直接員工，致直接人員平均產值略微下降外，其餘年度直接人員平均產值呈成長趨勢；另就直接及間接人員平均產值而言，110 年度及 112 年前三季因應營運規模擴大，增聘直接及間接員工，使得在整體產值成長之情況下，直接及間接人員平均產值仍略微下降。綜上評估，該公司最近三年度及 112 年前三季員工平均每人每年生產量值，其變動尚無重大異常之情事。

2.最近三年度及申請年度截至最近期止員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料，以評估離職率之變化情形及其合理性以及對申請公司營運之風險

(1)員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資

單位：人；年；歲

年度		109 年度	110 年度	111 年度	112 年截至 11 月底
人數	期初人員	56	64	76	97
	新進人員	15	16	28	50
	離職人員	4	4	5	18
	資遣人員	3	—	2	1
	退休人員	—	—	—	—
	期末 人數	合計	64	76	97
平均服務年資(年)		2.71	3.01	3.09	3.13
平均年齡(歲)		39.83	40.48	40.41	40.25
學歷 分布	博士	1	2	2	1
	碩士	13	16	18	34
	大學(專)	49	57	76	92
	高中及以下	1	1	1	1
	合計	64	76	97	128

資料來源：該公司及其子公司提供

註：該公司係於 109 年 12 月 31 日收購子公司昇和精技公司，昇和精技公司之員工服務年資自 109 年 12 月 31 日起算

(2)離職率之變化情形

單位：人；%

年度 人數	109 年度			110 年度			111 年度			112 年截至 11 月底		
	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)
主管級 人員	9	—	—	9	1	10.00	11	1	8.33	11	2	15.38
直接 人員	23	5	17.86	25	—	—	26	1	3.70	33	3	8.33
間接 人員	32	2	5.88	42	3	6.67	60	5	7.69	84	14	14.29
合計	64	7	9.86	76	4	5.00	97	7	6.73	128	19	12.93

資料來源：該公司及其子公司提供

註：離職率=離職人數(含資遣及退休)/(期末人數+離職人數(含資遣及退休))

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年 11 月底期末人數分別為 64 人、76 人、97 人及 128 人，人數逐年增加，主要係 109 年度收購子公司昇和精技公司及為因應營運規模拓展增加員工人數所致；該公司員工平均年齡為 39.83 歲~40.48 歲，顯示該公司及其子公司員工主要為青壯年人口；在員工服務年資方面，該公司員工平均服務年資約 2.71 年~3.13 年，人力資源為該公司之競爭利基，該公司注重員工的培訓及長期經驗累積，提供完善之福利及專業在職訓練。

該公司 109~111 年度及 112 年截至 11 月底總離職人數(含資遣及退休)分別為 7 人、4 人、7 人及 19 人，離職率分別為 9.86%、5.00%、6.73%及 12.93%，其離職率除 110 年度較 109 年度下降外，111 年度及 112 年截至 11 月底呈上升趨勢，離職人員以間接人員居多、直接人員居次、少數為公司之主管級人員。經詢問公司管理階層，直接及間接人員資遣原因係因員工無法勝任工作，離職原因則多為個人生涯規劃、健康與家庭因素所致，考量該等人員其職務替代性高，該公司及其子公司藉由人員調配或即時招募適任人員，故於人員交接及訓練上尚無困難；經理人員離職原因主要為個人生涯規劃考量，其工作職掌交接均按相關程序辦理，且其管理階層人員尚屬穩定，該公司及其子公司已適時藉由內部組織調整及向外招募適任人員遞補之，對該公司及其子公司營運不致造成重大影響。

整體而言，該公司人員流動原因尚無重大異常，且藉由完善激勵制度，提升員工之工作向心力，並推動申請股票上櫃事宜，藉以吸引更多優秀人才加入公司營運團隊。該公司除持續招募業界菁英外，離職人員其工作交接亦均按照相關程序辦理，故對該公司營運尚不致產生重大影響。

(四)各主要產品之成本分析

1.最近期及最近三個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素之比率變化對發行公司營運之風險

單位：新臺幣千元；%

產品名稱	類別	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關 機器設備	原物料	168,230	83.35	200,748	83.96	305,648	85.50	191,723	90.31
	直接人工	17,618	8.73	24,104	10.08	28,015	7.84	13,759	6.48
	製造費用	15,986	7.92	14,248	5.96	23,830	6.66	6,813	3.21
	合計	201,834	100.00	239,100	100.00	357,493	100.00	212,295	100.00
高階 光罩相關 機器設備	原物料	74,524	75.15	74,997	73.31	159,124	80.11	223,283	80.38
	直接人工	11,022	11.12	13,551	13.25	21,611	10.88	29,303	10.55
	製造費用	13,615	13.73	13,746	13.44	17,908	9.01	25,190	9.07
	合計	99,161	100.00	102,294	100.00	198,643	100.00	277,776	100.00
其他	原物料	17,313	85.79	36,086	81.01	35,480	86.67	27,963	82.76
	直接人工	633	3.14	2,406	5.40	639	1.56	1,323	3.92
	製造費用	2,235	11.07	6,052	13.59	4,819	11.77	4,502	13.32
	合計	20,181	100.00	44,544	100.00	40,938	100.00	33,788	100.00
合計	原物料	260,067	80.97	311,831	80.80	500,252	83.78	442,969	84.56
	直接人工	29,273	9.12	40,061	10.38	50,265	8.42	44,385	8.47
	製造費用	31,836	9.91	34,046	8.82	46,557	7.80	36,505	6.97
	合計	321,176	100.00	385,938	100.00	597,074	100.00	523,859	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司主要從事光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。整體產品成本結構以原物料占比最高，直接人工及製造費用比重則依客戶產品需求規格及功能差異消長，茲就各年度主要產品之原料、直接人工及製造費用比例變化情形說明如下：

(1)EUV 光罩相關機器設備

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季 EUV 光罩相關設備之原物料占該產品比重分別為 83.35%、83.96%、85.50%及 90.31%，原物料占比之波動主要受直接人工及製造費用消長影響，其占比自 110 年起逐年增加，主係因該公司前期對 EUV 光罩相關機器設備仍在發展階段，投入之生產工時及製造費用等學習成本較高，後續隨業績逐步成長，生產流程日趨成熟，其生產效率提升，使直接人工及製造費用占比下降，整體原物料比重逐年增加；直接人工占該產品比重分別為 8.73%、10.08%、7.84%及 6.48%，其中 110 年度之直接人工占比增加主係因該年度銷售之小型 EUV 光罩相關機器設備數量占比較高，惟其原物料成

本金額較低，使整體 EUV 光罩相關機器設備直接人工占比上升，111 年度及 112 年前三季直接人工占比下降主係因該公司及其子公司對於 EUV 光罩相關設備之生產製程進入成熟期，其生產效率提升，使直接人工占比下降；製造費用占該產品比重分別為 7.92%、5.96%、6.66%及 3.21%，其中 110 年度及 112 年前三季之製造費用占比下降，主係該年度銷售之小型 EUV 光罩相關機器設備體數量較多，其相關之吊掛、包裝及運送等費用較低，使製造費用占比下降，111 年度之製造費用占比增加，主係因本年度銷售之大型 EUV 光罩相關機器設備較多，因其體積較大使相關吊掛、包裝及運送等相關製造費用增加，另該年度有外銷一台全自動 EIP 表面檢查機，此機台需至美國協助安裝，相關差旅費用支出增加，致製造費用比重上升。

(2)高階光罩相關機器設備

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季高階光罩相關機器設備之成本結構中，以原物料所占比例最高，分別占銷貨成本之 75.15%、73.31%、80.11%及 80.38%，其中 110 年之原物料占比偏低，主係因該年度銷售之小型高階儲存設備數量較多，其原物料占比相對大型高階儲存設備低，使 110 年度原物料占比較低，111 年度及 112 年前三季原物料占比增加，主係因高階光罩相關機器設備初期仍在開發階段，投入之生產工時及製造費用等學習成本較高，後續隨業績逐步成長，生產流程日趨成熟，其生產效率提升，使直接人工及製造費用占比下降，整體原物料比重增加；直接人工占該產品比重分別為 11.12%、13.25%、10.88%及 10.55%，其中 110 年度之直接人工占比較高主係因該年度銷售之大型光罩相關機器設備數量占比較高，其直接人工支出相較小型光罩相關機器設備為多，使整體直接人工占比上升，而 111 年度及 112 年前三季直接人工下降主係因高階光罩相關機器設備生產流程日趨成熟，其生產效率提升，且 111 年度及 112 年前三季小型光罩相關機器設備數量銷售數量較多，其直接人工支出較小型光罩相關機器設備少，使直接人工占比下降；製造費用占該產品比重分別為 13.73%、13.44%、9.01%及 9.07%，其中 111 年度及 112 年前三季製造費用下降，主係因其銷售小型高階光罩相關機器設備體數量較多，其相關之吊掛、包裝及運送等費用較低，使製造費用占比下降。

(3)其他

該公司及其子公司其他類產品主要為機台客製化改造、機台維修及機台設備零組件買賣等，109~111 年度及 112 年前三季其他項之成本分別為 20,181 千元、44,544 千元、40,938 千元及 33,788 千元。其中因該公司於 109 年底收購子公司昇和精技公司新增 PVD 機台改造服務，致使其自 110 年度起成本大幅增加，而其原物料、直接人工及製造費用比重之變化則受不同銷貨客戶出貨比重及不同產品項目變化影響。

整體而言，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之原料、直接人工及製造費用比率之變化尚屬合理，無重大異常之情事。

2.最近三年度及申請年度截至最近期止主要產品之主要原料每年採購量及單價，並評估價格變化情形

單位：新臺幣千元；件

年度 項目	109 年度			110 年度			111 年度			112 年前三季		
	數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	單價	金額
電料	65,380	2.43	158,613	147,522	1.74	256,309	179,960	1.78	319,873	80,036	2.24	179,469

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司主要從事光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。其採購種類繁多，包含電料、金屬加工件及電控、管路組件等，其中電料占進貨淨額 30%以上，為主要原料。

該公司及其子公司因高效能運算產業、5G 通訊及車用電子等需求強勁，以及半導體產業先進製程推進，連帶推升半導體設備需求增加，使業績逐步呈長，致採購量自 110 年起大幅成長，致使整體進貨平均單價較 109 年度下降，而 112 年前三季受總體經濟情勢影響，全球原物料價格上漲，使部分原物料單價增加，致平均單價略微提升，惟因各客戶所需之機台設備規格不盡相同，其原料規格互有差異，故該公司採購數量及單價變化主係受客戶需求規格差異及與供應商議價情形波動影響。綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止，主要原料採購量及單價受公司業績及客戶需求規格差異影響，變化情形尚屬合理。

3.最近三年度及申請年度截至最近期止長期供貨契約，暨供貨有短缺或中斷情形資料，以評估供貨契約有無重大限制條款及貨源過度集中之風險

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，其產品依客戶訂單需求客製化生產，故為保持原物料採購之彈性，並未與供應商簽定長期供貨契約。採購單位係依客戶訂單及預測未來訂單情形進行備料，其主要原物料皆一間以上供應商，並維持長期往來之合作關係，另為降低進貨集中風險，亦持續開發其他供應商，以確保供貨來源之穩定性。最近三年度及申請年度截至最近期止，並無供貨短缺或中斷之情形。

4.建設公司申請股票上櫃者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，公司與地主之分配比率是否合理。

該公司及其子公司非屬建設公司申請股票上櫃者，故不適用本項評估。

(五)匯率變動情形

1.最近三年度及申請年度截至最近期止兌換損益占營業利益之比率及內外銷、內外購比率以評估匯率變動對申請公司營運之風險

(1)內外銷之金額及其比率

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	比率%	金額	比率%	金額	比率%	金額	比率%
內銷		394,721	82.62	527,932	87.71	852,374	81.34	719,930	70.85
外銷	美洲	11,800	2.47	24,691	4.10	72,281	6.90	144,112	14.18
	亞洲	65,478	13.70	46,549	7.73	101,841	9.72	101,283	9.97
	歐洲	5,774	1.21	2,760	0.46	21,457	2.04	50,738	5.00
	小計	83,052	17.38	74,000	12.29	195,579	18.66	296,133	29.15
合計		477,773	100.00	601,932	100.00	1,047,953	100.00	1,016,063	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)內外購之金額及其比率

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	比率%	金額	比率%	金額	比率%	金額	比率%
內購	新臺幣	308,351	99.98	507,129	99.85	679,274	99.56	421,038	99.96
	美元	—	—	66	0.01	—	—	—	—
	日幣	—	—	—	—	1,472	0.21	—	—
	小計	308,351	99.98	507,195	99.86	680,746	99.77	421,038	99.96
外購	日幣	—	—	362	0.07	1,038	0.15	125	0.03
	美元	—	—	—	—	—	—	55	0.01
	歐元	—	—	357	0.07	519	0.08	—	—
	人民幣	66	0.02	—	—	—	—	—	—
	小計	66	0.02	719	0.14	1,557	0.23	180	0.04
合計		308,417	100.00	507,914	100.00	682,303	100.00	421,218	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，其中主要包括應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。該公司及其子公司銷售對象主係以國內外知名半導體大廠為主，內銷交易約占整體營收 7~8 成，其外銷市場則包含亞洲、歐洲及美洲地區，外銷交易計價幣別係以美元為主；在採購方面，該公司及其子公司採購對象多以臺灣供應商為主，內購交易占整體進貨約 9 成，付款幣別以新臺幣為主，其他付款幣別包含美元、歐元、日幣及人民幣等。該公司及其子公司應收及應付外幣款項相互沖抵下，會產生一定之自然避險效果，然因外幣收入大於外幣支出，無法互抵之外幣應收款項在轉換成新臺幣時，仍會因持有外幣淨資產部位產生匯兌損益，惟該公司及其子公司隨時注意市場匯率之變化，參酌往來銀行所提供之匯率變動趨勢資訊，掌握最新之

匯率變動資訊，適時進行外匯部位調節暨管理，降低匯率變動對公司損益造成之影響。

(3) 兌換損益占營業利益之比率

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
兌換利益(損失)淨額(A)		(5,015)	(1,747)	11,777	27,966
營業收入淨額(B)		477,773	601,932	1,047,953	1,016,063
營業利益(C)		79,781	113,203	242,329	232,983
占營業收入之比率(A)/(B)(%)		(1.05)	(0.29)	1.12	2.75
占營業利益之比率(A)/(C)(%)		(6.29)	(1.54)	4.86	12.00

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司 109~110 年度及 112 年前三季之兌換利益(損失)淨額分別為(5,015)千元、(1,747)千元、11,777 千元及 27,966 千元，占營業收入之比率分別為(1.05)%、(0.29)%、1.12%及 2.75%，占營業利益之比率分別為(6.29)%、(1.54)%、4.86%及 12.00%，該公司及其子公司產生之兌換損益主要係外幣進銷貨所產生，資產負債互抵後，期末以美元產生之外幣淨資產部位較大，故兌換損益主係受美元兌新臺幣匯率變動所影響。

109 年度受到新冠肺炎疫情影響，美國聯準會大幅降息並實施量化寬鬆政策，致美元兌新臺幣匯率持續走貶，對於持有美元淨資產部位不利，因而產生淨兌換損失；110 年度其後，美元持續弱勢但波動幅度縮減故匯兌損失(1,747)千元較 109 年減少；111 年度及 112 年前三季由於美國實施貨幣緊縮政策，以及美國持續升息，使得美元兌新臺幣大幅升值致分別產生匯兌利益 11,777 千元及 27,966 千元。

綜上所述，該公司及其子公司兌換損益之變化情形與匯率變動趨勢尚屬合理，且對該公司合併營業收入淨額及營業利益尚無重大影響，因此該公司將更積極注意市場變動，蒐集相關外匯市場訊息，以掌握匯率之變動。

2. 申請公司之避險措施

該公司目前營運受匯率波動之影響有限，惟因應匯率變動所產生之經營風險，該公司管理當局除平日積極蒐集匯率相關資訊，以隨時掌握匯率變動趨勢外，並採取以下措施以降低匯率變動而可能產生之損失：

- (1) 該公司及其子公司之匯率風險控管以自然避險為主要策略，對於進、銷貨之交易均有部分比重以外幣計價，其整體對於匯率變動之影響可達到部分應收及應付相互平衡之效果，並適時調整外幣資產與負債之部位以降低匯率變動之風險。

- (2)財務單位隨時蒐集匯率變化訊息，與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充分掌握國際間匯率走勢及變化訊息，並視實際資金需求及匯率高低情況於適當時機買賣外幣存款，以降低匯率波動對公司獲利之衝擊。
- (3)依股東會決議通過之「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性金融商品相關作業程序，必要時得視外幣部位及匯率變動情形依該程序執行，以降低該公司業務經營所產生之匯率風險。

肆、業務狀況

一、營業概況

(一)申請公司最近三年度及申請年度截至最近期主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析

1.最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象、價格及條件之變化原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述申請公司之銷售政策。

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新臺幣千元；%

排名	109 年度				110 年度				111 年度				112 年前三季			
	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係
1	A 集團	340,231	71.21	無	A 集團	407,577	67.71	無	B 集團	461,443	44.03	無	B 集團	308,339	30.35	無
2	C 公司	30,804	6.45	無	B 集團	58,679	9.75	無	A 集團	258,304	24.65	無	G 集團	243,520	23.97	無
3	D 集團	18,534	3.88	無	J 公司	45,310	7.53	無	G 集團	105,358	10.05	無	A 集團	236,614	23.29	無
4	家登精密	16,182	3.39	母公司	K 集團	26,506	4.40	無	J 公司	51,620	4.93	無	K 集團	67,289	6.62	無
5	E 集團	14,778	3.09	無	G 集團	22,695	3.77	無	M 集團	49,002	4.68	無	J 公司	35,224	3.47	無
6	F 集團	14,487	3.03	無	E 集團	11,060	1.84	無	K 集團	22,561	2.15	無	H 公司	34,269	3.37	無
7	G 集團	12,607	2.64	無	F 集團	6,439	1.07	無	N 集團	17,662	1.69	無	P 公司	20,955	2.06	無
8	H 公司	12,000	2.51	無	L 公司	5,439	0.90	無	O 公司	15,769	1.50	無	O 公司	17,571	1.73	無
9	Brooks 集團	5,755	1.20	無	M 集團	4,772	0.79	無	D 集團	14,852	1.42	無	F 集團	16,541	1.63	無
10	I 公司	4,049	0.85	無	Brooks 集團	2,733	0.45	無	L 公司	11,997	1.14	無	E 集團	16,037	1.58	無
	小計	469,427	98.25	—	小計	591,210	98.21	—	小計	1,008,568	96.24	—	小計	996,359	98.07	—
	其他	8,346	1.75		其他	10,722	1.79		其他	39,385	3.76		其他	19,704	1.93	
	合計	477,773	100.00		合計	601,932	100.00		合計	1,047,953	100.00		合計	1,016,063	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)主要銷售對象、價格及條件變化原因並分析是否合理

該公司及其子公司主要從事光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。109~111 年度及 112 年前三季之營業收入淨額分別為 477,773 千元、601,932 千元、1,047,953 千元及 1,016,063 千元，呈現逐年成長趨勢，主係該公司及其子公司積極維繫與客戶穩定合作之關係，並於近年來開發新產品應用以及拓展新客戶所致。茲將該公司及其子公司之前十大銷售對象之變化情形說明如下：

A. A 集團

A 集團為臺灣上市公司，成立於民國 76 年，總部位於臺灣新竹市，為全球最主要之專業積體電路製造服務公司，主要產品為先進製程之邏輯積體電路 (Logic IC) 及特定應用積體電路 (ASIC)，其產品廣泛應用於各個終端市場，包含高效能運算、智慧型手機、物聯網車用電子與消費性電子產品等領域。該公司及其子公司與 A 集團交易始於 105 年。

該公司及其子公司對 A 集團主要銷售產品為 EUV 及高階光罩儲存櫃、清洗機等功能性設備、機器設備相關耗材及維修服務等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 340,231 千元、407,577 千元、258,304 千元及 236,614 千元，銷售比重分別為 71.21%、67.71%、24.65% 及 23.29%。雖過去三年度隨著疫情造成的區域封鎖、區域衝突及地緣政治的緊張局勢，嚴重擾亂了全球供應鏈，惟來自 5G、高效能運算(HPC)和人工智慧(AI)等相關應用產業之發展趨勢，仍使得長期半導體需求結構呈現持續增長；A 集團在配合其客戶長期需求之情況下，持續規劃產能及全球生產版圖，並由該公司及其子公司負責提供其所需之設備，故 A 集團最近三年度及 112 年截至第三季止均為該公司及其子公司之前三大銷售客戶，另自 110 年度起 A 集團為縮短裝機時程及提高設備生產效率，部分廠區設備委託 B 集團進行下單並規劃，故相關設備訂單係轉由 B 集團下單，致該公司及其子公司對 A 集團之直接銷售金額減少，經評估其變化尚屬合理。

B. B 集團

B 集團為東京證券交易所之上市公司，成立於民國 26 年，總部位於日本大阪，於民國 73 年即深耕臺灣。B 集團為自動搬運系統產業界之領導廠商，主要生產高科技產業無塵室之自動化倉儲運送機械設備，如工廠自動化物流搬送系統、無塵室工廠自動化系統等，從開發、製造到提供全系列符合任何需求的自動化與物流解決方案與服務。該公司及其子公司與 B 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 B 集團主要銷售產品為光罩充氣儲存櫃及設備盤面模組。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 245 千元、58,679 千元、461,443 千元及 308,339 千元，銷售比重分別為 0.05%、9.75%、44.03%及 30.35%。該公司及其子公司最近三年度及 112 年度截至第三季止對 B 集團銷售金額呈現逐年上升，主係自 110 年度起，A 集團為縮短裝機時程及提高設備生產效率，將部分廠區設備之規劃委由 B 集團統籌，故該公司及其子公司對 B 集團之銷售金額顯著增加。目前該公司及其子公司對 B 集團所銷售之設備主係皆為 A 集團所需，致 B 集團最近二年度及 112 年截至第三季止皆為該公司及其子公司之前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

C. C 公司

C 公司成立於民國 105 年，位於湖北省武漢市，為中國大陸記憶體晶片製造之領導廠商之一，主要業務為 3D 儲存型快閃記憶體(3D NAND Flash)之設計、製造及銷售，其產品主要包含無線通訊、行動支付、伺服器及資料中心等領域之記憶體解決方案，該公司及其子公司與 C 公司交易始於 107 年。

該公司及其子公司對 C 公司主要銷售產品為高階光罩交換機、光罩清洗機及機器相關耗材等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 30,804 千元、32 千元、1,473 千元及 142 千元，銷售比重分別為 6.45%、0.01%、0.14%及 0.01%。109 年度 C 公司因應廠房建廠需求，向該公司及其子公司採購高階光罩交換機及清洗機所致，其餘年度及 112 年前三季主係銷售設備相關耗材，致使 C 公司僅 109 年度為該公司及其子公司之銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

D. D 集團

D 集團成立於民國 105 年，總部位於安徽省合肥市，主要經營業務為動態隨機存取記憶體(DRAM)之設計、研發、生產及銷售，主要產品有 DDR4 SDRAM、LPDDR4x 及相關模組，應用於智慧型手機、電腦、伺服器、VR 及物聯網等領域，該公司及其子公司與 D 集團交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 D 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機及設備相關耗材。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 18,534 千元、0 千元、14,852 千元及 960 千元，銷售比重分別為 3.88%、0%、1.42%及 0.09%。109 及 111 年度主係 D 集團於北京進行 DRAM 廠房擴產計畫，故向該公司及其子公司採購高階光罩清洗機所致，其餘年度及 112 年前三季主係銷售設備相關耗材，致使 D 集團僅 109 及 111 年度為該公司及其子公司之銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

E. 家登精密工業股份有限公司(以下簡稱：家登精密)

家登精密為臺灣上櫃公司(股票代碼：3680)，成立於民國 87 年，位於臺

灣新北市，係全球極紫外光光罩盒(EUVPOD)主要供應商之一，且為該公司及其子公司之母公司，主要經營業務為光罩及晶圓之儲存、傳送及清洗等解決方案，主要產品為光罩及晶圓傳載載具及相關解決方案，該公司及其子公司與家登精密交易始於 105 年。

該公司及其子公司對家登精密主要銷售產品為全自動 EIP 刮傷機台檢查機及設備相關改造服務等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 16,182 千元、328 千元、1,672 千元及 341 千元，銷售比重分別為 3.39%、0.05%、0.16%及 0.03%。該公司及其子公司 109 年向家登精密銷售客製化半導體設備，主要係因應家登精密半導體載具銷售量大增，為維持其產品出貨品質，於出貨前自行檢驗載具內部潔淨度，且因機台設備金額較大，故於 109 年成為前十大銷售客戶；110~111 年度及 112 年前三季主要係以機台維修及改造服務，使得營業收入下降並退出前十大之列，經評估其變化尚屬合理。

F. E 集團

E 集團為上海證券交易所上市公司及香港交易所上市公司，成立於民國 89 年，總部位於中國上海市，為中國境內主要的積體電路晶圓代工廠之一，主要經營業務為 8 吋及 12 吋晶圓代工與技術服務，其產品應用於智慧型手機、智能家電及消費性電子等領域。該公司及其子公司與 E 集團交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 E 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機、機台改造及設備相關耗材等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 14,778 千元、11,060 千元、4,168 千元及 16,037 千元，銷售比重分別為 3.09%、1.84%、0.40%及 1.58%。為因應全球對於半導體需求大增，且中國政府持續支持半導體產業發展，109~110 年度及 112 年前三季 E 集團持續擴充產能及對各廠產品製程優化，對半導體機台設備需求增加，故 109~110 年度及 112 年前三季成為銷貨前十大客戶；111 年度之銷售產品主係設備改造及相關耗材，故使得該公司及其子公司對其營業收入下降並未列入銷貨前十大之列，經評估其變化尚屬合理。

G. F 集團

F 集團為美國納斯達克交易所上市公司，成立於民國 67 年，總部位於美國愛達荷州，為全球記憶體解決方案之領導廠商，主要經營業務為記憶體及儲存裝置之設計、開發及製造等，包含動態隨機存取存儲器(DRAM)、NAND 快閃記憶體、NOR 快閃記憶體及儲存產品等。該公司及其子公司與 F 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 F 集團主要銷售產品為 EUV 及高階光罩儲存櫃、光罩清洗機、設備維護服務及機器設備相關耗材等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 14,487 千元、6,439 千元、5,816 千元及 16,541 千元，銷售比重分別為 3.03%、1.07%、0.55%及 1.63%。隨各家 DRAM 廠將製程推進至 EUV 製程，為因應技術升級及擴增無塵室空間，F 集團於 108 年宣布擴建臺中晶圓廠，隨製程演進對於半導體設備需求大幅增加，故分別於 109~110 年度及 112 年度向該公司及其子公司採購光罩相關半導體設備，故 109~110 年度及 112 年前三季成為銷貨前十大客戶；111 年度主要交易產品為小型半導體相關機器設備、設備維護服務及機器設備相關零組件等，故使得該公司及其子公司對其營業收入下降並未列入前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

H. G 集團

G 集團為美國納斯達克交易所上市公司，成立於民國 57 年，總部位於美國加利福尼亞州，主要經營業務為中央處理器(CPU)、伺服器及其相關解決方案之設計、製造、銷售及服務，產品應用包含邊緣計算、5G、雲端服務、AI 和自動駕駛等新興領域。該公司及其子公司與 G 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 G 集團主要銷售產品為高階光罩儲存櫃、全自動 EIP 表面檢查機及其他小型設備輔助器具等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 12,607 千元、22,695 千元、105,358 千元及 243,520 千元，銷售比重分別為 2.64%、3.77%、10.05%及 23.97%。該公司及其子公司對 G 集團銷售金額呈現逐年上升的趨勢，主係因 G 集團分別於美國及歐盟地區興建半導體晶圓廠，並投入研發、設計及製造，使對半導體設備需求增加。因該公司及其子公司為 G 集團開發客製化機器設備，機器設備之妥善率受到 G 集團肯定，故該公司及其子公司持續獲得訂單挹注，使 G 集團 109~111 年及 112 年前三季皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

I. H 公司

H 公司為臺灣上市公司，成立於民國 97 年，位於臺灣新竹市，主要經營業務為 12 吋及 8 吋晶圓專業代工服務，包含邏輯暨特殊應用產品及記憶體產品之晶圓代工，產品終端應用於電腦、通訊應用、消費性電子及車用電子等，該公司及其子公司與 H 公司交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 H 公司主要銷售產品為高階光罩清洗機及設備相關耗材。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 12,000 千元、186 千元、179 千元及 34,269 千元，銷售比重分別為 2.51%、0.03%、0.02%及 3.37%。H 公司 109 年度及 112 年前三季分別因應製程潔淨度要求提升及擴廠計畫，向該公司及其子公司購買光罩相關設備，使 H 公司 109 年度及 112 年前三季為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，然 110~111 年度之交易主要為設備相關零組件需求及維修服務等，故於 110 年度未列入前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

J. Brooks 集團

Brooks 集團成立於民國 67 年，總部位於美國馬薩諸塞州，主要經營業務為自動化及機器人之解決方案，包含半導體工廠自動化及生技協作機器人相關技術服務等。該公司及其子公司與 Brooks 集團交易始於 106 年，目前與 Brooks 集團主要交易對象為 Brooks Automation CCS RS AG 及 Brooks Automation (Germany) GmbH。

該公司及其子公司對 Brooks 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及機器設備相關耗材等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 5,755 千元、2,733 千元、11,233 千元及 3,607 千元，銷售比重分別為 1.20%、0.45%、1.07%及 0.35%。109~111 年度因應終端客戶需求，故向該公司及其子公司購置光罩儲存櫃，使 Brooks 集團 109~110 年度成為該公司及其子公司之前十大客戶；然 112 年前三季終端客戶委託 Brooks 集團之專案接近尾聲，故使 Brooks 集團退出前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

K. I 公司

I 公司成立於民國 83 年，位於臺灣新竹市，主要經營機械搬遷服務，該公司及其子公司與 I 公司交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 I 公司主要銷售產品為 EUV 光罩充氣櫃體。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 4,049 千元、0 千元、0 千元及 0 千元，銷售比重分別為 0.85%、0%、0%及 0%。I 公司於 109 年進入前十大，主要係因 I 公司於運送過程損壞機器，經與原客戶協議，由 I 公司重新下單購買 EUV 光罩充氣櫃體以賠償原客戶，之後年度並無與 I 公司交易，故於 110 年度退出前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

L. J 公司

J 公司成立於民國 94 年，位於臺灣臺南市，主要經營半導體及顯示器相關設備及材料之製造及銷售，包含 FPD 顯示技術相關設備及半導體顯示設備之技術服務，為該公司於 109 年 12 月 31 日收購 100% 子公司昇和精技公司之原主要客戶，故該公司及其子公司與 J 公司交易始於 110 年。

該公司及其子公司對 J 公司主要銷售產品為物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition, PVD)系統改造及材料更換等客製化服務。110~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 45,310 千元、51,620 千元及 35,224 千元，銷售比重分別為 7.53%、4.93%及 3.47%。該公司及其子公司對 J 公司銷售金額呈現逐年上升，主係因該公司及其子公司對於 PVD 真空設備之設計與改造擁有多年經驗，並可提供客戶客製化之設備關鍵技術及材料更新及改造，故該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季持續獲得 J 公司之訂單挹注並為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

M. K 集團

K 集團為臺灣上市公司，成立於民國 69 年，總部位於臺灣新竹市，主要經營積體電路及半導體相關零組件，包含邏輯/混合信號、嵌入式高壓解決方案及嵌入式非揮發性記憶體等。該公司及其子公司與 K 集團交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 K 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及機器設備相關耗材等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 1,908 千元、26,506 千元、22,561 千元及 67,289 千元，銷售比重分別為 0.40%、4.40%、2.15%及 6.62%。該公司及其子公司 110 年度對 K 集團銷售金額較 109 年度增加，主係中國半導體內需規模持續成長，且中國政府積極扶植當地半導體產業，K 集團為貼近市場並滿足中國在地之 IC 設計業者需求，於中國地區擴建晶圓廠，故對該公司及其子公司光罩半導體相關設備需求增加，並進入該公司及其子公司之銷貨前十大客戶；該公司及其子公司 110~111 年度對 K 集團銷售金額變動不大，另因 112 年前三季仍持續擴充臺南廠區產能，故使 K 集團 110~111 年度及 112 年前三季皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

N. L 公司

L 公司為上海證券交易所科創板上市股票，L 公司成立於民國 104 年，位於安徽省合肥市，主要經營晶圓代工服務，包含液晶面板、手機等消費電子相關之晶片，該公司及其子公司與 L 公司交易始於 107 年。

該公司及其子公司對 L 公司主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 0 千元、5,439 千元、11,997 千元及 454 千元，銷售比重分別為 0.90%、1.14%及 0.04%。該公司及其子公司於 110~111 年度對 L 公司銷售金額逐年上升，主係因 L 公司關注面板驅動晶片相關產品布局，且為因應半導體產業持續擴張，故 L 公司持續積極擴充產能，並於 110 年進行晶圓廠擴廠，晶圓廠設備陸續進機安裝，故對於該公司及其子公司光罩相關半導體設備需求也隨之增加，使 L 公司 110~111 年度皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，然隨 L 公司擴廠逐漸完工，使得該公司及其子公司對其營業收入下降並退出銷貨前十大之列，經評估其變化尚屬合理。

O. M 集團

M 集團成立於民國 24 年，為日本代表性機械設備商之一，主要從事纖維機械、工作機械、板金加工機械、自動化物流系統、無塵室搬送系統相關設備之銷售及售後服務。該公司及其子公司與 M 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 M 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及設備封板壓條模組等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 648 千元、4,772 千元、49,002 千元及 6,463 千元，銷售比重分別為 0.14%、0.79%、4.68%及 0.64%。109~111 年度該公司及其子公司對 M 集團銷售金額呈現逐年上升，係因物聯網、5G 應用及電動車對半導體的需求不斷增加，且 A 集團部分廠區為縮短裝機時程及提高設備生產效率，指定由 M 集團進行下單並進行設備整合，致使 M 集團 110~111 年度皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶；112 年前三季因 M 集團來自 A 集團之訂單減少，故使 M 集團退出前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

P. N 集團

N 集團為美國納斯達克交易所上市公司(NASDAQ:GFS)，成立於民國 98 年，總部位於美國加利福尼亞州，為世界前五大專業晶圓代工廠，提供客戶 IC 製造服務，生產一系列半導體產品，主要應用包含智慧型手機、電動車、資料中心及物聯網等應用領域，在美國、德國、新加坡均有設立晶圓廠。該公司及其子公司與 N 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 N 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機、機台改造服務及設備相關耗材。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 124 千元、1,996 千元、17,662 千元及 7 千元，銷售比重分別為 0.03%、0.33%、1.69%及 0.00%。109~111 年度該公司及其子公司對 N 集團銷售金額呈現逐年上升，主要係全球終端數位電子產品及半導體需求增加使晶圓產量上升，N 集團於 110 年擴建東南亞廠區，以因應晶片需求，並於廠房基礎建設完成後相關晶圓製程所需設備陸續進機，故對於該公司及其子公司光罩相關半導體設備產品需求隨之增加，109~110 年度主係銷售設備相關耗材，致使 N 集團僅 111 年度為該公司及其子公司之銷貨前十大客戶，另自 112 年度起，考量銷售區域之服務便利之因素，N 集團委託 P 公司進行下單及設備組裝，故相關設備訂單轉由 P 公司下單，經評估其變化尚屬合理。

Q. O 公司

O 公司為臺灣上市公司，成立於民國 76 年，總部位於臺灣臺中市，主要經營記憶體 IC 設計、製造與銷售，包含利基型記憶體、行動記憶體以及編碼型快閃記憶體等，該公司及其子公司與 O 公司交易始於 105 年。

該公司及其子公司對 O 公司主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃、光罩清洗機及機器設備相關耗材等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 1,836 千元、0 千元、15,769 千元及 17,571 千元，銷售比重分別為 0.38%、0%、1.50%及 1.73%。該公司及其子公司 110 年度對 O 公司之銷售金額較 109 年度減少，主要係 109 年度因 NOR Flash 晶片供不應求情形加劇，產能供給吃緊，在需求暢旺下 O 公司持續擴充產能，對該公司及其子公司光罩相關半導體設備需求上升，110 年則無此情事；該公司及其子公司 111 年度對 O 公司之銷售金額較 110 年度增加，主要係 O 公司因應產能需求，於 111 年於高雄擴廠，隨建廠進度推進，對於該公司及其子公司之光罩相關半導體設備需求增加，故 O 公司 111 年度及 112 年前三季皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

R. P 公司

P 公司成立於民國 74 年，總部位於位於新加坡，主要經營微污染控制工程服務，提供無塵室和無塵空氣設備之設計及製造、無塵室性能測試及認證、微污染儀器的銷售、校準及維修等，該公司及其子公司與 P 公司交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 P 公司主要銷售產品為高階光罩清洗機及機器設備相關耗材等。109~111 年度及 112 年前三季對其銷售金額分別為 302 千元、93 千元、47 千元及 20,955 千元，銷售比重分別為 0.06%、0.02%、0.00%及 2.06%。109~111 年度之交易主要為設備相關零組件需求及維修服務等，112 年前三季主係因應 N 集團建廠之需求，對於該公司及其子公司之光罩相關半導體設備採購增加，並由 P 公司負責機台後續組裝及相關服務，故於 112 年前三季為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

(3) 是否有銷貨集中之風險

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季對前十大銷售客戶之銷售金額分別為 469,427 千元、591,210 千元、1,008,568 千元及 996,359 千元，銷售比重分別為 98.25%、98.21%、96.24%及 98.07%，其中 109~110 年對 A 集團銷售金額占營收比重分別為 71.21%及 67.71%，另 A 集團因將部分廠區設備之規劃委由 B 集團統籌，故該公司及其子公司 111 年度及 112 年前三季對 B 集團銷售金額占營收比重分別為 44.03%及 30.35%。該公司及其子公司雖有銷貨集中之情形，惟目前 A 集團為全球最主要且技術領先之晶圓代工業者，該公司及其子公司不僅憑藉著迅速服務及彈性的交期、穩定的產品品質及客製化的產品設計，以及整體解決方案服務等優勢深獲客戶的信賴，更因此與其他主要客戶均維持長期且良好之合作關係；此外，該公司及其子公司持續致力於開發新客戶及新產品線以爭取不同的客戶群，期以擴大並分散業務來源。以下就其銷貨集中之合理性及因應對策進行說明：

A. 銷貨集中之原因

(A) 半導體產業特性

由於半導體晶圓在製程當中，環境中的微粒會對良率造成影響，隨著製程的微縮，環境中的微粒對良率影響越大，當晶圓製程達到 28 奈米以下時，晶圓於載具輸送時的環境條件控制及潔淨化將變得相當重要；當達到 20 奈米以下的等級時，此種微污染防治設備裝置成為晶圓廠載具傳輸設備的標準配備，因此亦隨著客戶製程之演進推升，對於此製程微污染防治設備之需求將會更加殷切。

根據集邦科技(TrendForce)旗下拓璞產業研究院進行的調查，2022 年第四季全球晶圓代工的市占率排名前三名業者市占率合計占 80.6%，顯示因

半導體製造屬高度寡占市場，半導體設備廠商之銷售對象有限，晶圓代工產能集中於少數晶圓大廠中，A 集團市占達 58.5%，且 A 集團持續推進先進製程並保持業界技術領先地位，近年來資本支出金額為業界最高，該公司及其子公司雖有銷貨集中於 A 集團情形，乃產業特性所致。

由於半導體為技術與資本密集行業，晶圓代工產業集中於少數晶圓大廠，經檢視半導體設備供應商之京鼎及華景電 111 年度對其第一大銷售客戶之銷售比重分別為 82.98%及 69.92%，顯示該公司及其子公司銷貨集中現象，與同業相較係符合產業特性。

(B) 半導體設備進入門檻高，且供應鏈更換不易

客戶對晶圓製造環境的污染控制要求甚高，廠商一旦成為其合格供應商後，除非所提供之服務或品質發生嚴重瑕疵，否則客戶更換供應商之可能性甚低，且客戶要採用其他供應商，必須先通過認證且機台各式規格不同也需逐一認證，所需耗費時間及成本可觀。近年來，客戶對於光罩潔淨度越趨嚴格，該公司及其子公司自 105 年起與 A 集團合作開發，針對客戶需求開發光罩相關之微環境機器設備，經長年合作，不論品質深獲肯定及準時達交率高，且產品皆已通過安全性認證，加上該公司及其子公司於半導體機台所需之光罩相關微污染防治設備客製化設計能力強，以提供客製化服務來穩固產品與客戶之密切合作關係，在技術、品質、成本及交期均能滿足客戶需求且較同業具有優勢下，故得以維持長期穩定之供應鏈關係，且客戶亦滿意其提供之服務，進而使得該公司有銷貨集中於該主要客戶集團之情形。

綜上所述，隨著客戶的需求攀升，致該公司及其子公司對該主要客戶集團之銷貨金額逐年成長，此乃該客戶在市場具有領先之地位，對相關產品亦有一定的需求，該公司在半導體領域耕耘多年，秉持提供客戶客製化服務，強化競爭利基並獲致客戶的肯定，也陸續反映在公司近年的營收規模增長。因此除了上述客戶外，該公司亦積極開發新客戶及新型全自動機台，隨著新客戶、認證產品之增加，期以提高該公司及其子公司營業收入金額以逐步降低對單一客戶銷售之比重。

B. 銷貨集中之風險及因應措施

(A) 銷貨集中之風險

a. 更換供應商的風險或倒帳的風險

半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡占的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致該公司及其子公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，而出現銷貨集中之情事，若主要客戶出現更換供應商或倒帳情形，將對公司營運產

生重大影響。該公司及其子公司產品推出前，會針對客戶製程所需規格客製化設計開發階段至驗證約 3~6 個月的前置期，故經重點客戶採用後，以客戶觀點考量其已投入的時間成本，除非有產品品質問題否則不會輕易更換，致影響其產線之運作。

另檢視該公司對 A 集團、B 集團之收款條件、應收帳款帳齡及應收帳款收回情形，其收款條件為出貨後即收取出機款，約銷貨金額之 80%，設備驗收後收取尾款，約銷貨金額之 20%，應收帳款未曾發生應收帳款逾期而無法收回之情形，故其對該公司應收帳款倒帳風險尚低。

b. 因品質而被抽單的風險

考量半導體設備進入門檻高及產業特性，廠商一旦成為其合格供應商後，除非所提供之服務或品質發生嚴重瑕疵，否則客戶更換供應商之可能性甚低；一座 Fab 廠約上千機台設備且幾乎是歐美日十數家國際設備廠所囊括，尤其是晶圓廠內一台動輒數億的機台，搭配的相關客製化機台零組件雖然造價相對較低，但附屬機台若無法與主製程設備良好搭配，亦會影響晶圓廠的生產良率，因此供應商若因產品品質問題將可能面臨抽單風險。

綜上，因該公司及其子公司產品通過客戶嚴峻之品質考驗，並配合開發客製化產品，同時具備售後維護的能力，且價格具競爭力。因此，透過維持產品品質及客製化服務，更可增加客戶與該公司的緊密度，藉此降低供應商更換或因品質而被抽單之風險。加上，相關主要客戶均為財務健全且營運良好之國際大廠，整體而言，該公司及其子公司面臨上述風險之可能性較低。

(B) 因應措施

a. 技術延伸至新產品或新市場開發

該公司及其子公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用該公司及其子公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境設備需求與日俱增趨勢，該公司及其子公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

b. 鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，該公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，該公司及其子公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外該公司及其

子公司與其長期合作的關係，且該公司及其子公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場具領導地位，該公司及其子公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為該公司及其子公司帶來廣大的客戶效益，有助於該公司銷售策略之運用。

c.積極開發其他客戶

該公司及其子公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。該公司及其子公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展該公司及其子公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

(4)該公司及其子公司之銷售政策

該公司及其子公司主要營業項目為光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售，主要銷售產品為 EUV 相關半導體設備、高階相關半導體設備及零組件買賣等，產品多屬高度客製化為主。茲將該公司及其子公司之銷售政策列示如下：

- A.即時掌握客戶需求，共創雙贏局面。
- B.強化售後服務，維持強化現有客戶之支援及服務，積極開拓新產品線。
- C.專注及掌握客戶應用需求，開發符合客戶及市場脈動，建立產品口碑及快速成長等雙贏目標。
- D.積極拓展潛在市場，分散市場風險。

2.最近三年度及申請年度截至最近期止各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，分析最近三年度及申請年度截至最近期止主要供應商名稱、價格及條件之變化原因是否合理，是否有進貨集中之風險，並簡述申請公司之進貨政策。

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新臺幣千元；%

項目	109 年度				110 年度				111 年度				112 年前三季			
	名稱	進貨淨額	%	與發行人關係	名稱	進貨淨額	%	與發行人關係	名稱	進貨淨額	%	與發行人關係	名稱	進貨淨額	%	與發行人關係
1	鑫達懋業	80,813	26.20	無	鑫達懋業	103,300	20.34	無	鑫達懋業	94,057	13.79	無	鑫達懋業	56,774	13.48	無
2	皇乾企業	34,995	11.35	無	嘉彰	56,626	11.15	無	嘉彰	79,839	11.70	無	嘉彰	42,792	10.16	無
3	嘉彰	23,925	7.76	無	皇乾企業	35,923	7.07	無	皇乾企業	45,280	6.64	無	盟立	31,700	7.52	無
4	甲公司	23,662	7.67	無	銖恩帕斯集團	31,202	6.14	無	銖恩帕斯集團	41,924	6.14	無	銖恩帕斯集團	21,600	5.13	註 1
5	銖恩帕斯集團	19,422	6.30	無	甲公司	26,098	5.14	無	立明板金	38,324	5.62	無	竺揚工程	21,182	5.03	無
6	乙公司	17,490	5.67	無	乙公司	23,581	4.64	無	甲公司	25,258	3.70	無	乙公司	20,915	4.96	無
7	立明板金	9,482	3.07	無	光鈦國際	19,028	3.75	無	竺揚工程	24,623	3.61	無	元宸	20,171	4.79	無
8	光鈦國際	9,339	3.03	無	立明板金	18,584	3.66	無	乙公司	23,836	3.49	無	丙公司	17,299	4.11	無
9	台灣理研	6,112	1.98	無	強新工業	17,105	3.37	無	丙公司	17,948	2.63	無	堯鉉	14,437	3.43	註 2
10	竺揚工程	6,046	1.96	無	丙公司	9,861	1.94	無	士林電機	13,206	1.93	無	皇乾企業	12,854	3.05	無
	小計	231,286	74.99	—	小計	341,308	67.20	—	小計	404,295	59.25	—	小計	259,724	61.66	—
	其他	77,131	25.01		其他	166,606	32.80		其他	278,008	40.75		其他	161,494	38.34	
	進貨淨額	308,417	100.00		進貨淨額	507,914	100.00		進貨淨額	682,303	100.00		進貨淨額	421,218	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：銖恩帕斯集團於 112/7 成為實質關係人

註 2：堯鉉於 112/2 成為實質關係人

(2)主要供應商變化情形之原因分析

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。該公司及其子公司主要進貨項目為組裝設備所需之零組件如：質量流量控制器、微塵過濾器、含氧感知器等電料及充氣底板、金屬加工件及電控、管路組件等。109~111 年度及 112 年前三季之進貨淨額分別為 308,417 千元、507,914 千元、682,303 千元及 421,218 千元，採購金額變動主係隨營業規模持續成長及採購策略等因素，並配合客戶訂單產品及交期進行下單所致。以下茲就該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季主要供應商之變化情形分析說明如下：

A. 鑫達懋業股份有限公司(以下簡稱：鑫達懋業)

鑫達懋業成立於民國 80 年，位於臺中市，為專業自動控制產品代理商，主要引進 Fuji、OMRON 及 Rockwell Automation 等美、日知名大廠產品，並提供技術整合服務。該公司及其子公司自 105 年開始與鑫達懋業交易。

該公司及其子公司對鑫達懋業主要進貨項目為質量流量控制器及通訊閘道等電料，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 80,813 千元、103,300 千元、94,057 千元及 56,774 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 26.20%、20.34%、13.79%及 13.48%，其中 110 年度較 109 年度上升主係因高效能運算產業、5G 通訊及車用電子等需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連帶推升半導體設備需求增加，及受新冠肺炎疫情影響，致對鑫達懋業之主要進貨項目交期拉長，故該公司及其子公司依訂單需求提前備料，使進貨金額大幅上升；111 年度較 110 年度下降主係因交期回歸正常區間及 110 年度已提前備料，致進貨金額略為下降。整體而言，該公司及其子公司對鑫達懋業採購金額之變動主係配合客戶訂單交期對其進行下單所致，其 109~111 年度及 112 年前三季供應商排名皆為第一大，經評估尚無重大異常之情事。

B. 皇乾企業有限公司(以下簡稱：皇乾企業)

皇乾企業成立於民國 89 年，位於新竹縣，主要提供半導體先進製程相關設備、氣體分裝系統及光罩檢查設備等各式自動化系統工程服務。該公司及其子公司自 105 年度開始與皇乾企業交易。

該公司及其子公司對皇乾企業主要進貨項目為電控軟、硬體組件及 SECS(SEMI Equipment Communications Standard))通訊元件等電控、管路組件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 34,995 千元、35,923 千元、45,280 千元及 12,854 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 11.35%、7.07%、6.64%及 3.05%，電控、管路組件係搭配光罩充氣儲存櫃體、光罩清洗機及光

罩交換機及等產品生產，該公司及其子公司 109~111 年度因高效能運算產業、5G 通訊及車用電子等需求強勁，以及半導體產業先進製程推進所帶動之相關設備需求，使業績逐步成長，對皇乾之進貨金額亦同步上升；112 年前三季進貨金額略為下降，主係配合客戶訂單產品需求調整所致，其 109~111 年度及 112 年前三季供應商排名分別為第二大、第三大、第三大及第十大，經評估尚無重大異常之情事。

C. 嘉彰股份有限公司(以下簡稱：嘉彰)

嘉彰成立於民國 74 年，位於桃園市，為臺灣上市公司(股票代碼：4942)，係金屬沖壓之專業製造商，主要產品應用於光電、資訊及通訊等內外部金屬沖壓零部件及相關精密沖壓模具設計與製造。該公司及其子公司自 106 年開始與嘉彰交易。

該公司及其子公司對嘉彰主要進貨項目為一體式充氣底板及盤面板金等金屬加工件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 23,925 千元、56,626 千元、79,839 千元及 42,792 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 7.76%、11.15%、11.70%及 10.16%，來自嘉彰之主要進貨主係使用於光罩充氣儲存櫃體之生產，隨著該公司及其子公司之業績逐年持續成長，109~111 年度對嘉彰之進貨金額亦同步上升；112 年前三季進貨金額略為下降，主係配合客戶訂單交期調整所致，其 109~111 年度及 112 年前三季供應商排名分別為第三大、第二大、第二大及第二大，經評估尚無重大異常之情事。

D. 甲公司

甲公司成立於民國 107 年，位於新竹市，為臺灣創櫃版公司，主要提供材料光學、雷射光學、自動化領域、精密模具之開發、設備及管路規劃之安裝服務。該公司及其子公司自 108 年開始與甲公司交易。

該公司及其子公司對甲公司主要進貨項目為流量顯示器、限流控制閥及氣鏟刀頭等電料及管路配置工程及管路二次配工程等電控、管路組件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 23,662 千元、26,098 千元、25,258 千元及 6,103 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 7.67%、5.14%、3.70%及 1.45%，最近三年度對甲公司之進貨金額主係配合產品生產所需而變動，另 111 年度因設備訂單大幅增加，該公司及其子公司為降低進貨集中風險及靈活調整採購來源，將部份電控、管路組件轉向其他合格供應商採購，致進貨金額略微下降；其 109~111 年度供應商排名分別為第四大、第五大及第六大，112 年前三季進貨金額下降，主係配合客戶訂單交期調整下單，故退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

E. 鍊恩帕斯集團

鍊恩帕斯集團成立於民國 98 年，位於臺南市，主要營運項目為製程管路設計和製程管路配管工程管理服務，以及半導體設備相關零組件製作。該公司及其子公司自 105 年開始與鍊恩帕斯交易，目前與鍊恩帕斯集團主要交易對象為鍊恩帕斯科技股份有限公司及匯聚光能管理顧問有限公司。

該公司及其子公司對鍊恩帕斯集團主要進貨項目為分氣管等金屬加工件及管路配置工程及管路二次配工程等電控、管路組件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 19,422 千元、31,202 千元、41,924 千元及 21,600 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 6.30%、6.14%、6.14%及 5.13%，鍊恩帕斯集團主要進貨項目係使用於光罩充氣儲存櫃體之生產，故該公司及其子公司 109~111 年度對其之進貨金額主係伴隨業績逐步成長而同步上升；112 年前三季進貨金額下降，主係因其自 111 年起逐步調整採購策略，將部分金屬加工件轉向其他合格供應商採購，及配合客戶訂單交期調整進貨時程所致，其 109~111 年度及 112 年前三季供應商排名分別為第五大、第四大、第四大及第四大，經評估尚無重大異常之情事。

F. 乙公司

乙公司成立於民國 76 年，位於臺北市，主要提供精密流體過濾器與系統及高精密流體流量控制機構以及高真空壓力測量部件及其他相關廠務設備及技術服務。該公司及其子公司自 106 年開始與乙公司交易。

該公司及其子公司對乙公司主要進貨項目為微塵過濾器等電料，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 17,490 千元、23,581 千元 23,836 千元及 20,915 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 5.67%、4.64%、3.49%及 4.96%。該公司及其子公司最近三年度持續受惠於半導體產業需求成長，致相關設備採購訂單持續增加，故對相關零配件之採購金額持續上升，另因受新冠肺炎疫情影響，對乙公司採購之品項交期被迫拉長，故該公司及其子公司依訂單需求提前備料，使進貨金額上升；111 年度與 110 年度變動微小，主係因交期回歸正常區間及 110 年度已提前備料，使進貨金額約當；112 年第三季進貨金額增加主係該公司因應客戶需求持續備料，且受全球原物料價格上漲使進貨單價上升所致，其 109~111 年度及 112 年前三季供應商排名分別為第六大、第六大、第八大及第六大，經評估尚無重大異常之情事。

G. 立明板金股份有限公司(以下簡稱：立明板金)

立明板金成立於民國 106 年，位於臺中市，主要營業項目為精密機械板金零件及機台骨架製造及機台代工組裝服務，跨足半導體製程、光電、醫療等領域之。該公司及其子公司自 107 年開始與立明板金交易。

該公司及其子公司對立明板金主要進貨項目為各式板金及固定座等金屬加工件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 9,482 千元、18,584 千元、38,324 千元及 12,215 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.07%、3.66%、5.62%及 2.90%，立明板金之主要進貨項目於全數機台皆可使用，故該公司及其子公司 109~111 年度因營業規模持續受惠於半導體產業需求成長，致相關設備採購訂單持續增加，對立明板金之進貨金額亦同步上升，109~111 年度供應商排名分別為第七大、第八大及第五大，112 年前三季進貨金額下降，主係因調整採購策略，新增多家合格供貨廠商，致其退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

H. 光鈦國際工業股份有限公司(以下簡稱：光鈦國際)

光鈦國際成立於民國 86 年，位於桃園市，主要生產製造鋁擠型彈性組合框架，另有代理銷售國外知名品牌產品如：空壓元件、光電開關及音圈馬達等。該公司及其子公司自民國 105 年開始與光鈦國際交易。

該公司及其子公司對光鈦國際主要進貨項目為鋁擠框體等金屬加工件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 9,339 千元、19,028 千元、3,560 千元及 0 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.03%、3.75%、0.52%及 0.00%。鋁擠框體於全數機台皆可使用，其中 110 年度較 109 年度上升主係因該公司及其子公司來自半導體客戶之相關設備採購訂單持續增加，使進貨金額大幅上升；其自 111 年起進貨金額大幅下降主係因鋁擠框體之進貨價格受國際鋁價波動影響，該公司及其子公司有向相關合格供應商議價以控制價格波動，惟光鈦國際配合意願較低，故轉向其他合格供應商採購，致進貨金額下降，其 109 及 110 年度供應商排名分別為第八大及第七大，後續即退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

I. 台灣理研計器股份有限公司(以下簡稱：台灣理研)

台灣理研成立於民國 74 年，位於臺南市，為日本理研計器株式会社(東京證券交易所上市公司，代號：7734)之子公司，主要代理日本母公司研發生產之氣體偵測器及分析儀等相關產品，並提供校正、維修、組裝、系統規劃和施工服務。該公司及其子公司自 108 年開始與台灣理研交易。

該公司及其子公司對台灣理研主要進貨項目為含氧感知器，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 6,112 千元、8,544 千元、6,432 千元及 6,288 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.98%、1.68%、0.94%及 1.49%，台灣理研主要進貨項目係使用於光罩充氣儲存櫃體之生產，其中 110 年度較 109 年度上升主係因受新冠肺炎疫情影響，致對台灣理研之主要進貨項目交期拉長，故依訂單需求提前備料，使進貨金額上升，後續即回復正常往來情形。台灣理研僅 109 年度為該公司及其子公司第九大供應商，後續雙方仍有持續正常交易往來，惟其金額占整體成本比重不高，故未再列入該公司及其子公司

前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

J. 竺揚工程有限公司(以下簡稱：竺揚工程)

竺揚工程成立於民國 95 年，位於新竹市，主要營業項目為鋁擠型機構架組裝及銷售鋁擠型材料、配建及耗材之買賣批發零售和人力服務。該公司及其子公司自 105 年開始與竺揚工程交易。

該公司及其子公司對竺揚工程主要進貨項目為鋁擠框體等金屬加工件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 6,046 千元、7,757 千元、24,623 千元及 21,182 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.96%、1.53%、3.61%及 5.03%。該公司及其子公司對竺揚工程之進貨品項主係用於其設備機台組裝所需，故最近三年度及 112 年前三季其因來自半導體客戶之相關設備採購訂單持續增加，致對竺揚工程進貨金額持續上升，另因鋁擠框體之進貨價格受國際鋁價波動影響，竺揚工程積極配合該公司及其子公司備料，故其轉向竺揚工程採購，致 111 年度及 112 年前三季之進貨金額大幅增加。竺揚工程於 109 年度供應商排名為第十大；110 年度雖對其進貨金額增加，惟未列入十大供應商；111 年度及 112 年前三季供應商排名分別為第七大及第五大，經評估尚無重大異常之情事。

K. 強新工業股份有限公司(以下簡稱：強新工業)

強新工業成立於民國 82 年，位於臺南市，其主要營業項目為碳鋼、合金鋼及不銹鋼線材製造，並自 92 年跨足生產超潔淨電解拋光管線與管配件，提供半導體、光電業及花工業等建廠工程所需。該公司及其子公司自 108 年開始與強新工業交易。

該公司及其子公司對強新工業主要進貨項目為 EUV N2 盤面管路及分氣管等金屬加工件，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 2,594 千元、17,105 千元、6,122 千元及 0 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0.84%、3.37%、0.90%及 0.00%。該公司及其子公司最近三年度因營業規模持續擴展，故依其取得客戶之訂單需求，對於相關零配件等採購金額亦持續增加，惟 111 年度在成本考量之情況下，將部分採購訂單轉向其他符合品質需求及規格之同類別合格供應商，致對強新工業之進貨金額下降，故強新工業僅 110 年度進入前十大供應商為第九名，經評估尚無重大異常之情事。

L. 丙公司

丙公司成立於民國 101 年，位於宜蘭縣，主要營業項目為圖控軟體(SCADA)、人機介面及通信閘道器(Gateway)整合，其圖控軟體可適用於 OEM 人機及半導體設備業等。該公司及其子公司自 105 年開始與丙公司交易。

該公司及其子公司對丙公司主要進貨項目為圖控軟體及相關系統等品項，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 4,078 千元、9,861 千元、

17,948 千元及 17,299 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.32%、1.94%、2.63%及 4.11%，其主要進貨項目係搭配光罩充氣儲存櫃體、光罩清洗機及光罩交換機及等產品生產，最近三年度及 112 年前三季其因來自半導體客戶之相關設備採購訂單持續增加，使業績逐步成長，對丙公司之進貨金額亦同步上升，使其 110~111 年度及 112 年前三季進入前十大供應商，分別為第十大、第九大及第八大，經評估尚無重大異常之情事。

M.士林電機廠股份有限公司(以下簡稱：士林電機)

士林電機成立於民國 44 年，為臺灣上市公司(股票代碼：1503)，主要產品有電力配電、車輛零件、自動化設備及零件及數位家電相關等產品。該公司及其子公司自 106 年開始與士林電機交易。

該公司及其子公司對士林電機主要進貨項目為三菱 CC-Link 遠端輸入模組、斷路器、可程式控制器及伺服電機等電料，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 5,480 千元、7,997 千元、13,206 千元及 5,382 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.78%、1.57%、1.93%及 1.28%，其主要進貨項目係搭配光罩充氣儲存櫃體、光罩清洗機及光罩交換機等產品生產，109~111 年度其因來自半導體客戶之相關設備採購訂單持續增加，使業績逐步成長，對士林電機之進貨金額亦同步上升，使其 111 年度進入前十大供應商，為第十大，112 年前三季進貨金額下降，主係配合客戶訂單產品需求調整下單，故退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

N.盟立自動化股份有限公司(以下簡稱：盟立)

盟立成立於民國 78 年，為臺灣上市公司(股票代碼：2464)，主要提供自動化設備系統及其零組件等產品。該公司及其子公司自 112 年開始與盟立交易。

該公司及其子公司對盟立主要進貨項目為 Mini Stoker 儲存系統工程電控、管路組件等，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 0 千元、0 千元、0 千元及 31,700 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、0%、0%及 7.52%，該公司及其子公司與盟立自 111 年起合作開發 Mini Stoker 櫃儲存體所需之電控、管路組件，並於 112 年開始出貨，使其 112 年前三季進入前十大供應商，為第三大，經評估尚無重大異常之情事。

O.元宸新材料科技股份有限公司(以下簡稱：元宸)

元宸成立於民國 110 年，位於新竹縣，主要產品為半導體氣體配管材料及配管工程服務等產品。該公司及其子公司自 111 年開始與元宸交易。

該公司及其子公司對元宸主要進貨項目為 EUV N2 盤面管路、分氣管等金屬加工件及電控、管路組件等，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 0 千元、0 千元、9,438 千元及 20,171 千元，其占各年度進貨淨額之比

率分別為 0%、0%、1.38%及 4.79%，該公司與其子公司自 111 年開始與元宸交易，隨該公司業務成長及因應客戶需求持續備料，對元宸之進貨金額亦同步上升，其 112 年前三季進入前十大供應商，為第七大，經評估尚無重大異常之情事。

P. 堯鉉系統科技股份有限公司(以下簡稱：堯鉉)

堯鉉成立於民國 101 年，位於臺中市，主要產品工程配管施工及規劃服務及相關配管材料等產品。該公司及其子公司自 111 年開始與堯鉉交易。

該公司及其子公司對堯鉉主要進貨項目為調壓閥、壓力錶及壓力開關等電料、分氣管等金屬加工件及電控、管路組件等，109~111 年度及 112 年前三季對其進貨淨額分別為 0 千元、0 千元、12,328 千元及 14,437 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、0%、1.81%及 3.43%，自 111 年開始與堯鉉交易，隨該公司業務成長及因應客戶需求，對堯鉉之進貨金額亦同步上升，使其 112 年前三季進入前十大供應商，為第九大，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期主要供應商主增減變動情形主要受該公司營業規模持續成長及採購策略等因素所影響，惟自 109 年起，全球因受到新冠疫情之影響，封城、居家辦公之情況帶動晶片需求增加，另高效能運算產業、5G 通訊及車用電子等需求強勁，使半導體產業持續擴充產能，連帶推升半導體設備需求增加，使該公司及其子公司進貨金額隨營業規模持續擴大而連年增加，其 112 年前三季進貨金額略微下降，主係配合客戶訂單產品及交期調整進貨時程所影響。該公司及其子公司之採購單位除依客戶訂單進行備料外，亦積極瞭解各合格供應商之原物料庫存及交期，以避免生產進度因為缺料而中斷。經評估，其主要供應商之變動情形尚屬合理，並無重大異常之情事。

(3) 是否有進貨集中之風險與供貨來源穩定性

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年第三季之前十大供應商進貨淨額分別為 231,286 千元、341,308 千元、404,295 千元及 259,724 千元，占各期進貨淨額比重分別為 74.99%、67.20%、59.25%及 61.66%。其單一供應商占該公司及其子公司進貨比率尚無占進貨淨額比率高於 30%之情形，顯見該公司及其子公司並無進貨集中於特定供應商之情事。

該公司及其子公司主要進貨項目為質量流量控制器、微塵過濾器及含氧感知器等電料及金屬加工件及電控、管路組件等。其主要原物料除客戶指定外，皆有一間以上合格供應商，並維持長期往來之合作關係，採購單位進行原物料採購時會考量訂單需求、供應商產能及交期等，並適時進行議價以確保進貨價格之合理性。因該公司及其子公司為客製化訂單生產，除依客戶訂單進行備料外，亦積極

瞭解各供應商之產能及可能到貨之預估時間，以避免生產因為缺料而中斷。截至評估報告出具日止，該公司及其子公司並無供貨短缺或中斷情形發生。

(4)申請公司之進貨政策

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，其產品主係依客戶訂單需求客製化生產，採購單位依客戶訂單及預測未來訂單情形進行備料，並同時參酌供應商之最低採購量及現有庫存決定適當之採購量，如市場上主要原物料有缺料之可能性，則評估過去採購交期及預測未來訂單情形提前進行備料，以降低後續生產缺料風險。另亦定期召開產銷會議，以了解生產排程狀況、檢討供應商交貨狀況，並掌握訂單交期時效性，作為採購部門及時調整備貨之依據，以減少進貨中斷或短缺之可能性。在供應商管理方面，主要原物料除客戶指定外，皆有一間以上供應商，對供應商有事前評估調查，並定期進行供應商評鑑，以確保其廠商交期及品質符合公司需求，並適時與現有供應商進行議價，以降低進貨成本及維持產品競爭力。綜上所述，經評估其進貨政策尚屬允當。

(二)申請公司最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告應收款項變動合理性、備抵損失提列適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.應收款項變動之合理性

單位：新臺幣千元

項目	110 年度		111 年度		112 年前三季
	個體	合併	個體	合併	合併
營業收入淨額	551,551	601,932	989,427	1,047,953	1,016,063
應收票據-非關係人	—	—	—	—	—
應收帳款-非關係人	60,999	79,069	275,548	283,100	226,233
應收帳款-關係人	—	—	101	101	107
小計	60,999	79,069	275,649	283,201	226,340
備抵損失提列數	(1,224)	(1,404)	(9,235)	(9,340)	(19,446)
應收款項淨額	59,775	77,665	266,414	273,861	206,894
應收款項週轉率(次)	9.48	8.34	5.88	5.79	5.32
應收款項收現天數(天)	39	44	63	64	69
授信條件	該公司依客戶之資本規模、營業規模、財務狀況及過往交易情形、收款紀錄等而訂定不同之授信條件，收款條件主要為月結 30 天~120 天。				

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之個體及合併財務報告

(1) 個體財務報告

該公司 110~111 年度個體財務報告之應收款項總額分別為 60,999 千元及 275,649 千元，111 年底應收款項總額較 110 年底增加 214,650 千元，成長幅度為 351.89%，主係光罩相關半導體機器設備營收規模成長，以及因應客戶需求，111 年底出貨增加，相關應收款項集中於 111 年年底所致。整體而言，該公司最近二年度應收款項變化情形主係隨出貨情形而變動，尚無重大異常。

在應收款項週轉率方面，該公司 110~111 年度應收款項週轉率分別為 9.48 次及 5.88 次，應收款項收現天數分別為 39 天及 63 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。111 年度應收款項週轉率較前一年度下降，主係雖該公司 111 年度營業收入較去年同期成長 79.39%，惟因 111 年底大量出貨，致平均應收帳款餘額大幅成長 189.19%，致應收款項週轉率下降。

整體而言，該公司 110~111 年度個體財務報告之應收款項總額及應收款項週轉率之變動情形尚屬合理，且平均收現天數與與授信條件區間未有重大差異，經評估尚無重大異常之情事。

(2) 合併財務報告

該公司 110~111 年度及 112 年前三季列入合併財務報告之公司除該公司外，尚有轉投資公司昇和精技公司。該公司統籌集團經營策略，主要負責光罩相關半導體設備、相關零組件及維修服務等，而子公司昇和精技公司則負責物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition, PVD)設備改造及材料更換等客製化服務。該公司及其子公司合併應收帳款主要來自於該公司。

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季合併財務報告之應收款項總額分別為 79,069 千元、283,201 千元及 226,340 千元。111 年底應收款項總額較 110 年底增加 204,132 千元，成長幅度為 258.17%，主係光罩相關半導體機器設備營收規模成長，以及因應客戶需求，111 年底出貨增加，相關應收款項集中於 111 年年底所致；112 年 9 月應收款項總額較 111 年底減少 56,861 千元，變動比率為(20.08)%，主係於 112 年前三季收回部分機台款項所致。整體而言，該公司及其子公司最近二年度及最近期合併應收款項變化情形主係隨出貨情形而變動，尚無重大異常。

在應收款項週轉率方面，該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季應收款項週轉率分別為 8.34 次、5.79 次及 5.32 次，應收款項收現天數分別為 44 天、64 天及 69 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。該公司及其子公司應收款項週轉率 111 年度較 110 年度下降，雖該公司及其子公司 111 年度營業收入較去年同期成長 74.10%，惟因 111 年底大量出貨，致平均期末應收帳款餘額大幅成長 165.32%，致應收款項週轉率下降；112 年前三季之

應收款項週轉率較 111 年度下降，雖該公司截至 112 年度 9 月底營業收入換算全年度營收較去年度成長 29.28%，惟因 111 年底大量出貨，且今年出貨量持續增加，致平均期末應收帳款餘額仍較前期成長 40.65%，致應收款項週轉率微幅下降。

整體而言，該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季合併財務報告之應收款項總額及應收款項週轉率之變動情形尚屬合理，且平均收現天數與與授信條件區間未有重大差異，經評估尚無重大異常之情事。

2. 備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

(1) 備抵損失提列政策

該公司及其子公司採用 IFRS9 之簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況及產業經濟情勢。因該公司及其子公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶，僅以應收帳款立帳天數訂定預期信用損失率。該公司及其子公司依準備矩陣衡量之預期信用損失率列示如下：

應收帳款 立帳天數	預期信用損失率		
	110 年度	111 年度	112 年 前三季
1-90 天	0.76%	0.66%	1.00%
90-180 天	3.19%	4.93%	4.99%
181-270 天	4.91%	12.11%	12.46%
271-365	—	15.19%	13.83%
366 天以上	—	100.00%	100.00%

資料來源：該公司及其子公司提供

(2) 備抵損失提列之適足性

A. 個體財務報告

單位：新臺幣千元；%

項目	110 年度	111 年度
應收款項總額(B)	60,999	275,649
備抵損失金額(A)	1,224	9,235
備抵損失提列比率(A)/(B)(%)	2.01	3.35

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證之個體財務報告

該公司 110~111 年度個體財務報告之應收款項總額分別為 60,999 千元及 275,649 千元，備抵損失提列金額分別為 1,224 千元及 9,235 千元，占應收款項總額之提列比率分別為 2.01% 及 3.35%。該公司已依其應收帳款帳齡分佈期

間，並考量個別客戶經營狀況及帳款收回之可能性，綜合評估提列備抵呆帳。111 年度備抵損失提列金額較 110 年度增加 8,011 千元，主係因受客戶建廠計畫延宕，及驗收流程尚在進行所致。

綜上所述，該公司最近二個會計年度提列之備抵減損金額依所訂之政策執行，備抵損失金額應足以涵蓋該公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵減損提列之金額尚屬合理，適足性應無疑慮，尚無重大異常之情事。

B. 合併財務報告

單位：新臺幣千元；%

項目	110 年度	111 年度	112 年 前三季
應收款項總額(B)	79,069	283,201	226,340
備抵損失金額(A)	1,404	9,340	19,446
備抵損失提列比率(A)/(B)(%)	1.78	3.30	8.59

資料來源：該公司及其子公司各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季提列之備抵呆帳金額分別為 1,404 千元、9,340 千元及 19,446 千元，占各年度期末應收款項總額比率分別為 1.78%、3.30%及 8.59%。該公司及其各子公司已依其應收帳款立帳天數分佈期間，並考量個別客戶經營狀況及帳款收回之可能性，綜合評估提列備抵呆帳。該公司及其子公司提列之備抵呆帳逐年增加，主係因受客戶建廠計畫延宕，及驗收流程尚在進行所致。

綜上所述，該公司及其子公司最近二個會計年度及最近期提列之備抵減損金額依所訂之政策執行，備抵損失金額應足以涵蓋該公司及其子公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵減損提列之金額尚屬合理，適足性應無疑慮，尚無重大異常之情事。

(3) 應收款項收回可能性評估

單位：新臺幣千元

項目	112年9月底	截至112年11月底之收回情形		截至112年11月底之未收回情形	
		金額	%	金額	%
應收票據	—	—	—	—	—
應收帳款	226,233	63,337	28.00	162,896	72.00
應收帳款-關係人	107	107	100.00	—	—
合計	226,340	63,444	28.03	162,896	71.97

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司112年9月底之合併應收帳款餘額為226,340千元，截至112年11月30日止，合併應收帳款已收回金額及比率分別為63,444千元及28.03%，未收回金額及比率則分別為162,896千元及71.97%，未收回金額中主係客戶建廠延宕，且供應商付款相關系統尚未建立完善及因設備銷售為分批付款，未收回款項約100,926千元，該公司已依照政策提列足額備抵呆帳金額；其餘未收回帳款，係因客戶建廠及裝機時程影響，故應收帳款帳齡較長，根據該公司歷史經驗，其收回可能性應無重大疑慮，且該公司已依照政策提列足額備抵呆帳金額。

綜上所述，該公司及其子公司已針對立帳天數366天以上之帳款提列100%之備抵呆帳，其餘帳齡亦依政策提列足額備抵呆帳金額，該公司及其子公司持續對應收帳款積極追蹤並每月召開檢討會議，惟因其產業特性，客戶通常採階段性付款，設備驗收期間約為30~180天，故有部分應收帳款立帳天數較長，然該公司之銷售客戶多為國內外長期合作之知名廠商，110~111年度及112年前三季客戶應收款項收回情形尚屬良好，經評估尚無重大異常之情事。

3. 與同業比較

單位：新臺幣千元

項目	公司	110年度		111年度		112年 前三季
		個體	合併	個體	合併	合併
營業收入	家碩	551,551	601,932	989,427	1,047,953	1,016,063
	京鼎	9,888,272	12,246,437	12,055,139	14,843,221	9,671,457
	華景電	951,417	1,089,854	1,261,775	1,416,410	1,045,562
	天虹	1,511,901	1,655,712	1,741,090	1,815,477	1,337,551

項目	公司	110 年度		111 年度		112 年 前三季
		個體	合併	個體	合併	合併
應收款項 總額	家碩	60,999	79,069	275,649	283,201	226,340
	京鼎	1,489,034	1,702,545	798,466	981,065	861,968
	華景電	121,019	154,556	123,628	222,744	198,700
	天虹	275,056	299,286	375,018	444,872	346,611
備抵損失 帳列金額	家碩	1,224	1,404	9,235	9,340	19,446
	京鼎	422	1,523	215	3,221	257
	華景電	2,869	4,093	2,869	4,744	4,840
	天虹	538	538	909	1,625	987
應收款項 週轉率 (次)	家碩	9.48	8.34	5.88	5.79	5.32
	京鼎	8.92	9.46	10.54	11.06	13.99
	華景電	8.49	7.32	10.32	7.51	6.62
	天虹	6.01	6.44	5.36	4.88	4.51
應收款項 週轉天數 (天)	家碩	39	44	63	64	69
	京鼎	41	39	35	34	27
	華景電	43	50	36	49	56
	天虹	61	57	69	75	81
備抵損失 占應收帳 款之比重 (%)	家碩	2.01	1.78	3.35	3.30	8.59
	京鼎	0.03	0.09	0.03	0.33	0.03
	華景電	2.37	2.65	2.32	2.13	2.44
	天虹	0.20	0.18	0.24	0.37	0.28

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之個體及合併財務報告

(1)個體財務報告

該公司 110~111 年度個體應收款項週轉率分別為 9.48 次及 5.88 次，應收款項收現天數分別為 39 天及 63 天，該公司最近二年度個體應收款項變化情形主係出貨情形而變動。與採樣同業相較，110 年度應收款項週轉率高於採樣同業，111 年度則介於同業之間，該公司應收款項週轉率呈現下降趨勢，主係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致該公司及其子公司營業收入持續攀升，惟增加之幅度較平均應收款項增加幅度小，使得應收款項週轉率下降。

該公司 110~111 年度提列個體備抵損失金額分別為 1,224 千元及 9,235 千元，占各期應收帳款之比重分別為 2.01%與 3.35%。與採樣同業相較，110 年度介於同業之間，111 年度高於同業，主係依其備抵損失提列政策提列所致，惟該公司目前之應收款項收回情形尚屬良好，且其備抵損失金額應足以涵蓋該公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵損失提列之金額應屬允當。

綜上所述，該公司最近二個會計年度之應收款項週轉率、應收款項收現天數、備抵損失占應收款項比重，與同業比較評估，尚無重大異常之情事。

(2) 合併財務報告

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季之合併應收款項週轉率分別為 8.34 次、5.79 次及 5.32 次，應收款項收現天數分別為 44 天、64 天及 69 天，該公司及其子公司最近二年度及 112 年前三季合併應收款項變化情形主係隨出貨情形而變動。與採樣同業相較，該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季應收款項週轉率介於採樣同業，該公司及其子公司應收款項週轉率呈現下降趨勢，主係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致該公司及其子公司營業收入持續攀升，惟增加之幅度較平均應收款項增加幅度小，使得應收款項週轉率下降；另該公司及其子公司之往來客戶大多為國外知名大廠，財務狀況及營運狀況均為穩健，其授信條件與收款情形尚屬合理，且該公司及其子公司定期追蹤應收帳款期後收回情形，經評估尚無重大異常之情事。

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季提列備抵損失金額分別為 1,404 千元、9,340 千元及 19,446 千元，110 年備抵損失金額介於採樣同業，111 年度及 112 年前三季備抵損失金額高於同業，主係受客戶建廠及裝機時程影響，致應收帳款帳齡較長；該公司及其子公司已依照政策提列足額備抵呆帳金額，然根據該公司歷史經驗，其收回可能性應無重大疑慮。該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季備抵損失占應收帳款之比重分別為 1.78%、3.30%及 8.59%。與採樣同業相較，均高於採樣同業；該公司及其子公司提列之備抵呆帳比例逐年增加，主係因受客戶建廠及裝機時程影響，該公司及其子公司最近二年度及最近期提列之備抵減損金額依所訂之政策執行，備抵損失金額應足以涵蓋該公司及其子公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵減損提列之金額尚屬合理，適足性應無疑慮，尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近二個會計年度及最近期之應收款項週轉率、應收款項收現天數、備抵損失占應收款項比重，與同業比較評估，尚無重大異常之情事。

二、存貨概況

(一)申請公司最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告存貨淨額變動合理性及去化情形、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列適足性之評估，並與同業比較評估

1.存貨淨額變動合理性

單位：新臺幣千元

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年 前三季
		個體	合併	個體	合併	合併
營業收入		551,551	601,932	989,427	1,047,953	1,016,063
營業成本		364,433	385,938	582,211	597,074	523,859
期末 存貨 總額	原物料	33,427	33,427	60,158	60,264	55,885
	半成品	311	311	307	307	303
	在製品	412,106	418,231	548,241	553,404	496,073
	製成品	197	197	—	—	1,994
	總計	446,041	452,166	608,706	613,975	554,255
備抵存貨跌價損失及呆滯 損失		2,857	2,857	7,414	7,414	10,590
期末存貨淨額		443,184	449,309	601,292	606,561	543,665
存貨週轉率(次)		1.05	1.08	1.10	1.12	1.20
存貨週轉天數(天)		348	338	332	326	305

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之個體及合併財務報告

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，其合併報表編製主體包含該公司本身暨其轉投資公司昇和精技公司。其中該公司統籌集團經營策略，主要負責 EUV 光罩設備、高階光罩設備及零組件及維修服務等，而子公司昇和精技公司則負責 PVD 真空技術相關機台設計及改造。該公司及其子公司其主要原物料為質量流量控制器及微塵過濾器電料、金屬加工件及電控、管路組件等；半成品主係機台維修備料等；在製品為尚在組裝及已出貨予客戶尚未驗收之機台；製成品為已完工待出售之產品。該公司及其子公司之存貨主係依銷售客戶訂單需求而備料並投入生產，整體生產週期約需 3~4 個月。

(1)個體財務報告

該公司 110~111 年之個體財務報告存貨淨額分別為 443,184 千元及 601,292 千元，111 年底存貨淨額較 110 年底增加 158,108 千元，主係因高效能運算(HPC)產業、5G 通訊、AI 人工智慧物聯網及車用電子晶片需求強勁，使半導體產業積極擴充產能，連帶提升半導體設備需求，其中 EUV 充氣儲存櫃體需求強勁，故針對其主要原物料質量流量控制器及料微塵過濾器等持續備料，致原物料金額增加，此外，因 111 年市場對半導體設備訂單需求暢旺及客戶機台驗收時程影響，致已出貨未驗收之機台增加，在製品金額上升。綜上所述，該公司最近兩年

度存貨淨額變化主係因訂單需求增加備料及投入生產所致，尚無重大異常情事。

在存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 110~111 年度之存貨週轉率分別為 1.05 次及 1.10 次；週轉天數分別為 348 天及 332 天，其中 111 年度存貨週轉率較 110 年度上升，雖該公司 111 年度期末存貨金額因客戶訂單需求備料及已出貨未驗收之機台增加而上升，惟 110 年度已出貨未驗收之機台於已陸續完成驗收，使營業成本增加幅度大於存貨，致存貨週轉率微幅上升，週轉天數下降。該公司目前之備料多有客戶訂單支持，另在製成品受半導體設備產業特性影響，使該公司之已出貨但客戶尚未驗收之機台皆帳列在製品，惟其驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，致其驗收時常較長，該部分已於出貨後收取預收貨款，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司 110~111 年度之個體財務報告存貨淨額、週轉率及週轉天數變動情形尚屬合理，並無重大異常之情形。

(2) 合併財務報告

該公司及其子公司 110~111 年底及 112 年前三季合併財務報告存貨淨額分別為 449,309 千元、606,561 千元及 543,665 千元，111 年底存貨淨額較 110 年底增加 157,252 千元，主係因高效能運算(HPC)產業、5G 通訊、AI 人工智慧物聯網及車用電子晶片需求強勁，使半導體產業積極擴充產能，連帶提升半導體設備需求，其中 EUV 充氣儲存櫃體需求強勁，故針對其主要原物料質量流量控制器及料微塵過濾器等持續備料，致原物料金額增加，此外，因 111 年市場對半導體設備訂單需求暢旺及客戶機台驗收時程影響，致已出貨未驗收之機台增加，在製品金額上升；112 年前三季存貨淨額較 111 年底減少 62,896 千元，主係 111 年度已出貨未驗收之在製品於 112 年前三季陸續出貨認列收入，使在製品金額下降，致整體存貨淨額減少，尚無重大異常情事。

在存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司及其子公司於 110~111 年度及 112 年前三季存貨週轉率分別為 1.08 次、1.12 次及 1.20 次；週轉天數分別為 338 天、326 天、及 305 天，其中 111 年度存貨週轉率較 110 年度上升，雖 111 年度期末存貨金額因客戶訂單需求備料及已出貨未驗收之機台增加而上升，惟 110 年度已出貨未驗收之機台於已陸續完成驗收，使營業成本增加幅度大於存貨，致存貨週轉率微幅上升，週轉天數下降；112 年前三季較 111 年度存貨週轉率上升，主係 111 年度已出貨未驗收之在製品於 112 年前三季陸續出貨認列收入，使營業收入成長連帶影響營業成本增加，其營業成本增幅大於平均存貨，致使存貨週轉率微幅上升，週轉天數下降。使該公司及其子公司之已出貨但客戶尚未驗收之機台皆帳列在製品，惟其驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，致其驗收時常較長，該部分已於出貨後收取預收貨款，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司 110~111 年底及 112 年前三季之合併財務報告存貨淨額、週轉率及週轉天數變動情形尚屬合理，並無重大異常之情形。

2.最近期存貨去化情形

單位：新臺幣千元

項 目	112 年 9 月底 存貨金額	截至 112 年 11 月底 存貨去化情形		112 年 11 月底 餘額
		金額	比率(%)	
原 物 料	55,885	17,811	31.87	38,074
半 成 品	303	120	39.60	183
在 製 品	496,073	60,764	12.25	435,309
製 成 品	1,994	10	0.50	1,984
合 計	554,255	78,705	14.20	475,550

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司 112 年 9 月底存貨總額為 554,255 千元，截至 112 年 11 月底存貨去化金額為 78,705 千元，去化比率為 14.20%，未去化金額 475,550 千元，未去化比率為 85.80%，茲就各項存貨之去化情形分別說明如下：

(1)原物料

原物料存貨總額為 55,885 千元，占期末存貨總額 10.08%，截至 112 年 11 月底存貨去化金額為 17,811 千元，去化比率為 31.87%。未去化之原物料金額為 38,074 千元，其原物料主要為電料、金屬加工件及電控、管路組件等，主係依客戶訂單需求備料，原物料未去化金額占 112 年 11 月底比率 68.13%，惟該公司及其子公司營收持續增長，因應客戶訂單需求進行備料係有其必要性與合理性，經評估尚無重大異常之情事。

(2)半成品

半成品存貨總額為 303 千元，占期末存貨總額 0.06%，截至 112 年 11 月底存貨去化金額為 120 千元，去化比率為 39.60%。未去化之半成品金額為 183 千元，主係機台維修備料，占整體存貨總額之金額微小，經評估尚無重大異常情事。

(3)在製品

在製品存貨總額為 496,073 千元，占期末存貨總額 89.50%，截至 112 年 11 月底存貨去化金額為 60,764 千元，去化比率為 12.25%。未去化之在製品金額為 435,309 千元，包含尚在組裝之機台 72,671 千元及已出貨予客戶尚未驗收之機台 362,638 千元，其中已出貨予客戶尚未驗收之機台，其驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，有驗收時程較長之情形，惟該公司及其子公司於設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，應無存貨跌價或遭客戶取消訂單之風險，經評估尚無重大異常之情事。

(4)製成品

製成品存貨總額為 1,994 千元，占期末存貨總額 0.36%，截至 112 年 11 月底存貨去化金額為 10 千元，去化比率為 0.50%，係因子公司昇和精技公司之設備零件置換專案出貨。未去化之製成品金額為 1,984 千元，主係已出貨尚未驗收之小型高階光罩儲存設備，經評估尚無重大異常情事。

3.備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列適足性之評估

(1)備抵存貨跌價損失提列政策

該公司及其子公司存貨係以成本與淨變現價值孰低法衡量，存貨成本之計算係採加權平均法，比較成本與淨變現價值孰低時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚須投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(2)備抵存貨呆滯損失提列政策

A.110 年度(含)以前

(A)該公司及其子公司 110 年度(含)以前，存貨呆滯損失提列政策如下：

項目	庫齡	1 年以下	1 年~2 年	2~3 年以上	3 年以上
	原物料		0%	25%	50%
半成品		0%	100%	0%	0%
在製品		0%	100%	0%	0%
製成品		0%	100%	0%	0%

資料來源：該公司及其子公司提供

(B)已出貨逾一年之在製品，依期末成本高於已收取款項之金額差額提列 100% 之備抵呆滯損失，採逐項認定。

(C)未出貨逾一年之在製品，採逐項認定。

B.111 年度以後

該公司及其子公司之存貨為客製化訂單生產，依客戶訂單進行備料，基於穩健原則，以採購入庫日做為庫齡計算基礎，並依存貨實際去化情形、產品性質、同業提列政策及過去生產週期評估後，於 111 年 12 月 24 日經核准通過訂定備抵跌價及呆滯損失提列政策如下：

(A)針對原物料、半成品、在製品及製成品提列呆滯損失如下：

項目	庫齡	1 年以下	1 年以上
	原物料		0%
半成品		0%	100%
在製品		0%	100%
製成品		0%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供

(B)已出貨逾一年之在製品，依期末成本高於已收取款項之金額差額提列 100% 之備抵呆滯損失，採逐項認定。

(C)未出貨逾一年之在製品，採逐項認定。

該公司及其子公司之存貨以在製品為主，原物料次之，原物料主係電料、金屬加工件及電控、管路組件等；在製品主係尚在組裝及已出貨予客戶尚未驗收之機台。其多數原物料交期平均約為 1 個月，少數機台之專用料件交期平均約為 3~6 個月，此外，該公司及其子公司定期開立產銷會議檢視原物料庫存、客戶訂單及預測未來訂單情形隨時調整其原物料進貨數量，在製品部分多數為已出貨予客戶尚未驗收之機台，其機台驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，致驗收時程較長，其可能驗收時程可能為出貨後 3~12 個月。在考量上述因素及自 110 年度起該公司及其子公司逐步增長之業績與營運規模、加強存貨庫存管理效益及提升存貨流動性，依存貨實際去化情形、產品性質、同業提列政策及過去生產週期評估後，根據穩健原則，該公司及其子公司遂於 111 年度改變其原物料之備抵存貨呆滯損失提列方式，以庫齡超過一年以上提列 100%備抵存貨呆滯損失，其餘則維持不變。

綜上評估，該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策係以國際會計準則為依據，並考量所處行業特性、產品性質、產品生命週期及過往產銷經驗等，經評估其提列政策尚屬合理，並未發現重大異常之情事。

(2)備抵存貨跌價及呆滯損失提列適足性之評估

單位：新臺幣千元；%

項目	110 年度		111 年度		112 年 前三季
	個體	合併	個體	合併	合併
備抵存貨跌價及呆滯損失期末餘額(A)	2,857	2,857	7,414	7,414	10,590
存貨總額(B)	446,041	452,166	608,706	613,975	554,255
提列比率(A)/(B)(%)	0.64	0.63	1.22	1.21	1.91

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之個體及合併財務報告

A. 個體財務報告

該公司 110~111 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 2,857 及 7,414 千元，占各期期末存貨總額比率分別為 0.64% 及 1.22%，111 年度提列比例較 110 年度微幅增加，主係因該公司及其子公司於 111 年度調整備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列政策，此外，因業績及營運規模逐步成長，其依客戶訂單需求備料時同步採購後續維護機台所需之原物料增加，亦使其提列金額增加，致整體提列比例逐步上升。惟該公司各年度均依照訂定之提列政策執行，經評估該公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額尚屬適足，並無重大異常情事。

B. 合併財務報告

該公司 110~111 年度及 112 前三季之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 2,857、7,414 千元及 10,590 千元，占各期期末存貨總額比率分別為 0.63%、1.21% 及 1.91%。其中子公司昇和精技 112 年前三季存貨呆滯提列 24 千元，占合併財務報告存貨跌價及呆滯損失金額 0.23%，故合併財務報告 110~111 年度及 112 年前三季之之備抵存貨跌價及呆滯損失金額變動，主係因該公司之業績及營運規模逐步成長，其依客戶訂單需求備料時同步採購後續維護機台所需之原物料增加，使其提列金額增加。惟該公司及其子公司各年度均依照訂定之提列政策執行，經評估該公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額尚屬適足，無重大異常情事。

4. 同業比較

單位：新臺幣千元；次；天；%

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年 前三季
		個體	合併	個體	合併	合併
營業成本	家碩	364,433	385,938	582,211	597,074	523,859
	京鼎	8,247,610	9,153,770	9,619,283	10,399,687	7,182,290
	華景電	497,128	536,028	641,378	683,179	483,513
	天虹	1,029,030	993,184	1,079,411	969,505	772,323
期末存貨總額 (B)	家碩	446,041	452,166	608,706	613,975	554,255
	京鼎	527,469	2,918,256	546,582	3,867,885	2,865,118
	華景電	394,950	468,313	387,638	492,963	616,571
	天虹	872,440	823,467	1,026,679	1,127,893	1,257,922
備抵存貨跌價 及呆滯損失 (A)	家碩	2,857	2,857	7,414	7,414	10,590
	京鼎	1,431	53,629	2,047	60,832	73,783
	華景電	31,016	32,386	43,119	44,539	48,632
	天虹	114,864	124,608	120,372	125,238	115,005

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年 前三季
		個體	合併	個體	合併	合併
期末存貨淨額	家碩	443,184	449,309	601,292	606,561	543,665
	京鼎	526,038	2,864,627	544,535	3,807,053	2,791,335
	華景電	363,934	435,927	344,519	448,424	567,939
	天虹	757,576	698,859	906,307	1,002,655	1,142,917
備抵存貨跌價 及呆滯損失提 列比率(% (A)/(B)	家碩	0.64	0.63	1.22	1.21	1.91
	京鼎	0.27	1.84	0.37	1.57	2.58
	華景電	7.85	6.92	11.12	9.03	7.89
	天虹	13.17	15.13	11.72	11.10	9.14
存貨週轉率 (次)	家碩	1.05	1.08	1.10	1.12	1.20
	京鼎	16.14	3.90	17.91	3.06	2.84
	華景電	1.85	1.62	1.64	1.42	1.16
	天虹	1.08	1.13	1.14	0.99	0.86
存貨週轉天數 (天)	家碩	348	338	332	326	305
	京鼎	23	94	21	120	129
	華景電	198	226	223	258	315
	天虹	338	324	321	369	425

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之個體及合併財務報告

(1)個體財務報告

該公司 110~111 年度之個體存貨週轉率分別為 1.05 次及 1.10 次，個體存貨週轉天數分別為 348 天及 322 天，與採樣同業相較，其存貨週轉率低於採樣同業公司，該公司 110~111 年度持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使存貨週轉率較採樣同業及同業平均為低，惟隨該公司營業規模大幅成長，其 111 年度之存貨週轉率已較 110 年度微幅上升，且該公司之產品主要係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，並考量該公司及採樣同業間其銷售產品及策略以及公司營運規模皆有所不同。整體而言，該公司個體存貨週轉率應無重大異常情形。

該公司 110~111 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率分別為 0.64%及 1.22%，與採樣同業相較，京鼎採多角化經營，其產品涵蓋半導體、顯示器、光電及綠能、工廠自動化等產業之先進製程暨自動化設備，主要為半導體設備製造商進行代工，其相關存貨去化速度較快，備抵存貨跌價及呆滯損失提列比例較低；華景電主要業務為半導體晶圓製程 AMC 微污染防治設備及 RFID 整合派工系統解決方案，因其原物料規格眾多，為避免斷料及進貨時間影響排程，且受訂單需求增加、分批交貨交期拉長及供應商最低採購量限制，致使有部分存貨庫齡較長，備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額較高；天虹主要產品有物理氣相沉積設備、原子層沉積設備、鍵合機、解鍵合機等薄膜製程設備及設備零備件，其中設備依客戶訂單需求備料外，設備零備件受零件稀缺性及供應商最低採購量影響其備料，其將存貨中屬標準品零件且呆滯過久者，視是否有未來訂單支應提列備抵存貨跌價及呆滯損失，使備抵存貨跌價及呆滯損失提列為高。綜上所述，該公司與採樣公司在銷售產品及營運規模不盡相同，其備抵存貨跌價及呆滯損失提列比例介於採樣同業間，且皆依訂定之提列政策執行，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司最近二年度之存貨變動及其週轉率變化情形與採樣同業比較評估、備抵存貨跌價及呆滯損失提列之適足性，尚無重大異常之情事。

(2)合併財務報告

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季之合併存貨週轉率分別為 1.08 次、1.12 次及 1.20 次，合併存貨週轉天數分別為 338 天、326 天及 305 天，與採樣同業相較，該公司及其子公司 110 年度存貨週轉率低於採樣同業公司；111 年度及 112 年前三季介於採樣同業間，主係因該公司及其子公司持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司及其子公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司及其子公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使 110 年度存貨週轉率較採樣同業為低，惟隨該公司及其子公司營業規模持續大幅成長，其 111 年度及 112 年前三季之存貨週轉率已小幅上升，介於採樣同業間，且該公司及其子公司之主要產品係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，並考量該公司及採樣同業間其銷售產品及策略以及公司營運規模皆有所不同。整體而言，該公司及其子公司合併存貨週轉率應無重大異常情形。

該公司及其子公司 110~111 年度及 112 年前三季之備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率分別為 0.63%、1.21%及 1.91%，與採樣同業相較，110~111 年度及 112 年前三季之備抵存貨跌價及呆滯損失皆低於同業，主係其依客戶訂單進行備料生產，並訂期開立產銷會議檢視原物料庫存、客戶訂單及預測未來訂單情形隨時調整其原物料進貨數量及投入生產情形，積極管控其存貨庫齡，降低其存貨跌價及呆滯之風險。惟該公司及其子公司與採樣同業間之銷售產品、存貨組成及公司營運規模不盡相同，且其皆依訂定之提列政策執行，經評估該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額應屬適足，無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近二年度及最近期之存貨變動及其週轉率變化情形與採樣同業比較評估、備抵存貨跌價及呆滯損失提列之適足性，尚無重大異常之情事。

三、申請公司最三年度及申請年度截至最近期之業績概況

(一)列表並說明發行公司最近期及最近三個會計年度營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	金額	成長率 (%)	金額	成長率 (%)	金額	成長率 (%)	
營業收入	家碩	477,773	601,932	25.99	1,047,953	74.10	1,016,063	51.68	
	京鼎	9,942,056	12,246,437	23.18	14,843,221	21.20	9,671,457	(9.29)	
	華景電	730,182	1,089,854	49.26	1,416,410	29.96	1,045,562	3.41	
	天虹	998,574	1,655,712	65.81	1,815,477	9.65	1,337,551	12.82	
營業毛利	家碩	156,597	215,994	37.93	450,879	108.75	492,204	80.74	
	京鼎	2,548,102	3,092,667	21.37	4,443,534	43.68	2,489,167	(19.41)	
	華景電	376,194	553,826	47.22	733,231	32.39	562,049	11.17	
	天虹	390,197	662,528	69.79	845,972	27.69	565,228	6.11	
營業利益	家碩	79,781	113,203	41.89	242,329	114.07	232,983	55.86	
	京鼎	1,635,235	1,988,339	21.59	2,951,060	48.42	1,451,110	(27.81)	
	華景電	201,451	294,243	46.06	434,807	47.77	279,322	(4.19)	
	天虹	8,723	190,685	2,086.00	288,343	51.21	162,758	(3.60)	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司主要從事光罩相關半導體設備之研究開發、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，包含檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。檢視目前上市櫃公司，選樣條件以產業類別同屬半導體設備之公司，並參酌營業項目較為相近者，選取京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱京鼎，股票代碼 3413，上市半導體業)、華景電通股份有限公司(以下簡稱華景電，股票代碼 6788 上櫃半導體業)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱天虹，股票代碼 6937，上市半導體業)作為採樣同業。京鼎主要經營業務為半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務、半導體/工業自動化高端設備之

研發、製造及銷售等；華景電主要營業項目為半導體製程微污染防治設備與 RFID 自動化派工系統解決方案之研發、生產與銷售；天虹主要營業項目為半導體設備及相關零組件之研發、生產與銷售等，主要產品有物理氣相沉積設備、鍵合機、解鍵合機與原子層沉積設備等薄膜製程設備。

茲就該公司及其子公司與採樣同業京鼎、華景電及天虹之營業收入、營業毛利及營業利益比較說明如下：

1.營業收入

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業收入分別為 477,773 千元、601,932 千元、1,047,953 千元及 1,016,063 千元，營業收入成長率分別為 25.99%、74.10%及 51.68%。110 年度營業收入成長 25.99%，主係因 110 年度新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續蔓延，各國對於半導體供應鏈中斷產生疑慮，加上遠距生活型態加速數位轉型，使得全球對半導體的需求超過供給，為因應晶片需求攀升，晶圓製造廠持續擴廠，且為提供晶片效能，各廠持續開發先進製程，故該公司及其子公司 110 年度來自 EUV 光罩相關機器設備之營業收入增加 80,119 千元；另於 109 年底收購昇和精技公司，將業務觸角延伸到 PVD (Physical vapor deposition, 物理氣相沉積技術) 真空鍍膜和相關設備領域，該子公司為公司帶來新的成長動能，故該公司及其子公司 110 年度來自於 PVD 真空鍍膜機台改造服務之營業收入也增加 50,381 千元。111 年度營業收入成長 74.10%，主係該公司及其子公司除持續深耕既有客戶外，客戶擴廠計畫持續進行，積極尋求微影製程中光罩潔淨之解決方案，使該公司及其子公司整體光罩相關之機器設備營業收入增加 410,744 千元。112 年前三季較去年同期成長 51.68%，主要係因該公司及其子公司高階光罩相關機器設備深受客戶青睞，並持續提供客戶客製化之機器設備及服務，使該公司及其子公司高階光罩相關機器設備營業收入增加 383,944 千元。

與採樣同業相較，除京鼎 112 年前三季營收下降外，該公司及其子公司與採樣同業 109~111 年度及 112 年前三季之營業收入皆呈現持續成長，109 年起新冠肺炎疫情改變全球經濟活動，居家辦公、遠距教學、影音串流等生活型態出現，使得資料傳輸量倍增，帶動 5G 及高效能運算 (High Performance Computing, HPC) 相關產業應用持續擴增，致晶片、半導體元件需求及晶圓廠因擴充產能增加設備採購，使 110 年該公司及其子公司與採樣同樣營收成長；111 年初起，因新冠轉病毒疫情造成的區域封鎖、烏克蘭衝突、地緣政治的緊張局勢及貿易限制，使消費性產品需求放緩，惟在巨量數據運算及應用創新的驅動下，高速運算及 5G 相關應用等產業的成長，使得長期半導體需求結構性增長依然強勁，使 111 年及 112 年前三季該公司及其子公司與採樣同樣營收成長。整體而言，該公司及其子公司與採樣同業之營業收入均呈現成長態勢，尚無異常之情事。

綜上所述，109~110 年因 COVID 疫情持續蔓延，對於供應鏈中斷的疑慮及遠端生活型帶加速了數位轉型，使得全球對半導體的需求增加，111 年起雖烏俄戰爭、地緣政治與貿易限制的衝擊，但來自 5G 及高效能運算相關應用等產業的長期趨勢，

使長期半導體需求仍持續增長，除京鼎最近期營收呈下降，其餘各公司最近三年度及最近期之營業收入均呈現成長趨勢，惟各公司之產品組合及銷售市場略有不同，致使營收成長之幅度亦有所差異，經評估應無重大異常之情事。

2.營業毛利

單位：新臺幣千元；%

年度 公司	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	毛利率 (%)	金額	毛利率 (%)	金額	毛利率 (%)	金額	毛利率 (%)
家碩	156,597	32.78	215,994	35.88	450,879	43.02	492,204	48.44
京鼎	2,548,102	25.63	3,092,667	25.25	4,443,534	29.94	2,489,167	25.74
華景電	376,194	51.52	553,826	50.82	733,231	51.77	562,049	53.76
天虹	390,197	39.08	662,528	40.01	845,972	46.60	565,228	42.26

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業毛利分別為 156,597 千元、215,994 千元、450,879 千元及 492,204 千元，毛利率分別為 32.78%、35.88%、43.02%及 48.44%。110~111 年度及 112 年前三季營業毛利分別較上一年度同期增加 59,397 千元、234,885 千元及 219,882 千元，主係隨營業收入成長而增加。該公司及其子公司 109~111 年度毛利率逐年成長主係因該公司及其子公司持續開發客製化之功能性機器設備，且經過往的經驗累積，該公司及其子公司組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，使毛利率上升；112 年前三季較去年同期增加 7.79%，成長幅度為 19.16%，主係該公司及其子公司 112 年前三季毛利率較高之高階光罩相關機器設備銷售占比較高所致。

與採樣同業相較，各公司毛利率變動主係受其產品組合變化所影響，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之毛利率均係介於採樣同業之間。整體而言，該公司及其子公司之營業毛利變動應無重大異常之情事。

3.營業利益

單位：新臺幣千元；%

年度 公司	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	營業利益率 (%)	金額	營業利益率 (%)	金額	營業利益率 (%)	金額	營業利益率 (%)
家碩	79,781	16.70	113,203	18.81	242,329	23.12	232,983	22.93
京鼎	1,635,235	16.45	1,988,339	16.24	2,951,060	19.88	1,451,110	15.00
華景電	201,451	27.59	294,243	27.00	434,807	30.70	279,322	26.72
天虹	8,723	0.87	190,685	11.52	288,343	15.88	162,758	12.17

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業利益分別為 79,781 千元、113,203 千元、242,329 千元及 232,983 千元，營業利益率分別為 16.70%、18.81%、23.12%及 22.93%。109~111 年度之營業利益及營業利益率持續較前一年度成長主

係該公司及其子公司受惠於半導體代工業者持續擴充產能，致推升半導體設備需求增加，使其營業收入持續成長，加上該公司及其子公司持續開發客製化之功能性機器設備，且經過往的經驗累積，該公司及其子公司組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，使營業毛利及毛利率亦呈現上升，致使其營業利益及營業利益率持續成長；112年前三季營業利益較去年同期增加 83,501 千元，營業利益率上升至 22.93%，主係 112 年前三季較去年同期毛利較高之高階光罩相關機器設備銷售成長，致毛利率及營業毛利較去年同期上升，另外 112 年前三季則因應營運規模成長而新聘員工且相應之董事及員工酬勞上升，使營業費用上升，綜上因素使 112 年前三季營業費用亦較去年同期增加，惟整體營業費用增加幅度仍低於營業收入及營業毛利，致當期營業利益較去年同期微幅增加，經評估其變動情形應尚屬合理。

與採樣同業相較，109~111 年度及 112 年前三季該公司及其子公司之營業利益率介於採樣同業之間，產品毛利率及營業利益均有所上升，經評估應無重大異常情事。

(二)列表並說明最近期及最近三個會計年度以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

主要產品別銷貨收入變動表

單位：新臺幣千元

產品別	年度	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關機器設備		265,738	55.62	345,857	57.46	539,223	51.45	359,380	35.37
高階光罩相關機器設備		173,004	36.21	158,199	26.28	375,577	35.84	536,955	52.85
其他		39,031	8.17	97,876	16.26	133,153	12.71	119,728	11.78
合計		477,773	100.00	601,932	100.00	1,047,953	100.00	1,016,063	100.00

主要產品別銷貨成本變動表

單位：新臺幣千元

產品別	年度	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關機器設備		201,834	62.84	239,100	61.95	357,493	59.87	212,295	40.53
高階光罩相關機器設備		99,161	30.88	102,294	26.51	198,642	33.27	277,776	53.02
其他		20,181	6.28	44,544	11.54	40,939	6.86	33,788	6.45
合計		321,176	100.00	385,938	100.00	597,074	100.00	523,859	100.00

主要產品別銷貨毛利變動表

單位：新臺幣千元

產品別	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關機器設備	63,904	40.81	106,757	49.43	181,730	40.31	147,085	29.88
高階光罩相關機器設備	73,843	47.15	55,905	25.88	176,935	39.24	259,179	52.66
其他	18,850	12.04	53,332	24.69	92,214	20.45	85,940	17.46
合計	156,597	100.00	215,994	100.00	450,879	100.00	492,204	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究開發、製造及銷售，主要產品為 EUV 光罩相關機器設備、高階光罩相關設備及其他等。茲就該公司及其子公司主要產品別營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形說明如下：

1. EUV 光罩相關機器設備

該公司及其子公司 EUV 光罩相關機器設備主要包含 EUV 光罩儲存櫃、EUV 光罩清洗機、EUV 光罩檢測機等客製化功能性機器設備，主係應用於 EUV 半導體之微影製程，並提供 EUV 光罩微環境防治之解決方案。該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季 EUV 光罩相關機器設備之營業收入分別為 265,738 千元、345,857 千元、539,223 千元及 359,380 千元，其占整體營業收入淨額之比率分別為 55.62%、57.46%、51.45%及 35.37%。110 年度銷售 EUV 光罩相關機器設備金額較 109 年度增加 80,119 千元，主要係隨著半導體產業持續往先進製程邁進，對於 EUV 光罩相關半導體設備需求增加，銷售機台數量成長所致；111 年度銷售 EUV 光罩相關半導體設備金額較 110 年度增加 193,366 千元，主要係因應晶圓代工廠擴產，客戶對於大型之 EUV 光罩相關機器設備需求增加，雖機台數量並無成長，惟大型機台銷售占比上升，使 111 年度之 EUV 光罩相關半導體設備銷售金額增加；112 年前三季銷售金額較去年同期減少 42,492 千元，主係 112 年前三季雖 EUV 光罩相關設備銷售數量成長，惟平均單價較低之小型 EUV 光罩相關設備銷售占比增加，使 112 年前三季之 EUV 光罩相關設備銷售金額較去年同期下降。

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季 EUV 光罩相關機器設備之營業成本分別為 201,834 千元、239,100 千元、357,493 千元及 212,295 千元，營業毛利分別為 63,904 千元、106,757 千元、181,730 千元及 147,085 千元，毛利率分別為 24.05%、30.87%、33.70%及 40.93%。109~111 年度及 112 年前三季 EUV 光罩相關機器設備之毛利率逐年增加，主係因該公司及其子公司持續開發高毛利之功能性設備及拓展小型機台設備之市場，且因應客戶需求調整產品整合模式，使生產效率提升，另透過過往的經驗累積，該公司及其公司更具備組裝經驗及客製化調整之能力，使機台組裝成本降低所致。整體而言，其變化尚無異常之情事。

2.高階光罩相關機器設備

該公司及其子公司高階光罩相關機器設備主要包含高階光罩儲存櫃、高階光罩清洗機、高階光罩交換機及高階光罩轉換機等客製化功能性機器設備，主係應用於DUV 半導體之微影製程，並提供高階光罩微環境防治之解決方案。該公司及其子公司109~111年度及112年前三季高階光罩相關設備之營業收入分別為173,004千元、158,199千元、375,577千元及536,955千元，占整體營業收入淨額之比率分別為36.21%、26.28%、35.84%及52.85%。110年度銷售高階光罩相關機器設備金額較109年度減少14,805千元，主要係因應客戶客製化需求，110年度銷售商品、小型高階光罩儲存櫃占比較高，單價較低，使高階光罩相關機器設備銷售金額微幅下降；主係因應客戶擴廠之設備需求，使高階光罩相關設備之營收增加125,544千元，另本公司積極協客戶開發其產線所須之客製化設備，使高階光罩相關設備之營收增加54,271千元；112年前三季銷售高階光罩相關機器設備金額較去年同期增加383,944千元，主係客製化產品持續受客戶青睞，大量採購運用至其不同廠區，使本公司112年前三季高階光罩相關機器設備之營業收入較111年同期增加193,835千元，另配合客戶擴廠計劃，本公司112年前三季高階光罩相關設備之營業收入較111年同期增加69,403千元。

該公司及其子公司109~111年度及112年前三季高階光罩相關設備之營業成本分別為99,161千元、102,294千元、198,642千元及277,776千元，營業毛利分別為73,843千元、55,905千元、176,935千元及259,179千元，毛利率分別為42.68%、35.34%、47.11%及48.27%。110年度高階光罩相關設備之營業毛利較109年度減少17,938千元，毛利率下降7.34%，主係110年度高階光罩相關設備之銷貨收入品項係以毛利較低之大型高階光罩儲存櫃為主所致；111年度及112年前三季則係因主要銷售產品均為毛利率較高之小型高階光罩儲存櫃及其他功能性機器設備且銷售設備之數量亦均較前期增加，致使111年度及112年前三季高階光罩相關機器設備之營業毛利及毛利率均較前期成長。整體而言，其變化尚無異常之情事。

3.其他

該公司及其子公司其他產品主要為機台客製化改造、修改、維修及機台設備零組件買賣等。該公司及其子公司109~111年度及112年前三季其他之營業收入分別為39,031千元、97,876千元、133,153千元及119,728千元，占整體營業收入淨額之比率分別為8.17%、16.26%、12.71%及11.78%。110年度來自其他之營業收入金額較109年度增加58,845千元，主要係該公司於109年收購昇和精技公司將業務觸角延伸到PVD(Physical vapor deposition, 物理氣相沉積技術)真空鍍膜和相關設備領域，使該子公司為公司帶來新的成長動能，致該公司及其公司來自於PVD機台改造服務之營業收入增加50,381千元，另因半導體市場景氣良好，晶圓廠機台使用率增加同步帶動零組件銷及相關機台維修需求，致零組件及維修收入增加；111年度來自其他之營業收入金額較110年度增加35,277千元，及112年前三季來自

其他之營業收入金額較去年同期增加 4,760 千元，主要係隨機台設備銷售數量持續增加，所衍生之維修服務、機台改造、零組件更換等持續增加所致。

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季來自其他之營業成本分別為 20,181 千元、44,544 千元、40,938 千元及 33,788 千元，營業毛利分別為 18,850 千元、53,332 千元、92,214 千元及 85,940 千元，毛利率分別為 48.29%、54.49%、69.25%及 71.78%。110 年度來自其他之營業毛利較 109 年度增加 34,482 千元，毛利率上升 6.20%，主係因該公司於收購昇和子公司後，增加昇和所提供之機台改造服務收入及其機台改造之毛利率較高所致；111 年度來自其他之營業毛利較 110 年度增加 38,882 千元，毛利率上升 14.76%，主係 111 年度該公司新增較多來自客戶客製化機台修改之需求，此類服務毛利率較高，故使營業毛利及毛利率均較前一年度增加；112 年前三季來自其他之營業毛利較去年同期增加 5,495 千元，毛利率上升 1.81%，營業毛利隨營業收入上升而微幅增加，毛利率亦微幅上升。整體而言，其變化尚無異常之情事。

(三)最近期及最近三個會計年度營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度之營業收入及毛利率變動率如下表所示：

單位：新臺幣千元

項目	109 年度		110 年度		111 年度		111 年前三季		112 年前三季	
	金額	金額	變動率	金額	變動率	金額	金額	變動率		
營業收入	477,773	601,932	25.99	1,047,953	74.10	669,851	1,016,063	51.68		
營業毛利	156,597	215,994	37.93	450,879	108.75	272,322	492,204	80.74		
毛利率(%)	32.78	35.88	9.46	43.02	19.90	40.65	48.44	19.16		

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司最近三度及 112 年前三季之營業收入變動率均達 20%以上，故進行價量分析。另該公司及其子公司之其他收入，主係例行或一次性維修服務、機台客製化改造、修改及零備件銷售，且非屬主要量產之產品業務，故不擬評估其價量分析。以下茲就該公司及其子公司之主要產品別價量變動情形及合理性分析說明如下：

單位：新臺幣千元

主要產品	分析項目	109 及 110 年度	110 及 111 年度	111 年前三季及 112 年前三季
EUV 相關 半導體 設備	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q'-Q)	265,739	(37,056)	200,936
	Q(P'-P)	(92,810)	258,073	(162,285)
	(P'-P)(Q'-Q)	(92,810)	(27,651)	(81,143)
	P'Q'-PQ	80,119	193,366	(42,492)
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q'-Q)	201,834	(25,618)	137,845
	Q(P'-P)	(82,284)	161,292	(134,160)
	(P'-P)(Q'-Q)	(82,284)	(17,281)	(67,080)
	P'Q'-PQ	37,266	118,393	(63,395)
	(三)毛利變動金額：	42,853	74,973	20,903
高階 相關 半導體 設備	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q'-Q)	32,438	213,707	422,197
	Q(P'-P)	(39,784)	1,561	(10,176)
	(P'-P)(Q'-Q)	(7,459)	2,110	(28,077)
	P'Q'-PQ	(14,805)	217,378	383,944
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q'-Q)	18,593	138,185	240,927
	Q(P'-P)	(13,019)	(17,796)	(13,425)
	(P'-P)(Q'-Q)	(2,441)	(24,041)	(37,042)
	P'Q'-PQ	3,133	96,348	190,460
	(三)毛利變動金額：	(17,938)	121,030	193,484

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：P'、Q'為本期之單價及數量；P、Q 為前期之單價及數量

1.EUV 相關半導體設備

(1)109 及 110 年度

A.營業收入增加 80,119 千元

110 年主係半導體產業持續推向先進製程之極紫外光(EUV)微影，隨客戶先進製程產能持續擴增，EUV 光罩相關機器設備需求上升，使得 EUV 光罩相關機器設備銷售量增加，故產生數量有利差異 265,739 千元；109 年度配合客戶大量儲存光罩之需求，客製化大量儲存迭代光罩之機台，110 年度則無銷售此類機器設備，使 110 年度 EUV 光罩相關機器設備平均單價下降，故產生價格不利差異 92,810 千元，價量相乘效果產生營業收入組合不利差異 92,810 千元。

B.營業成本增加 37,266 千元

110 年度因 EUV 光罩相關機器設備銷售量增加，故產生數量不利差異 201,834 千元；109 年度配合客戶大量儲存光罩之需求，客製化大量儲存迭代

光罩之機台，組裝成本較高，110 年度則無銷售此類機器設備，使 110 年度 EUV 光罩相關機器設備平均成本下降，故產生價格有利差異 82,284 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 82,284 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年度 EUV 光罩相關機器設備之營業毛利較 109 年度增加 42,853 千元。

(2)110 及 111 年度

A.營業收入增加 193,366 千元

111 年 EUV 光罩銷售數量微幅下降，故產生數量不利差異 37,056 千元，然配合客戶廠區規劃，使單價較高之大型 EUV 儲存櫃銷售及功能性機器設備占比成長，故 111 年產生價格有利差異 258,073 千元，價量相乘效果產生營業收入組合不利差異 27,651 千元。

B.營業成本增加 118,393 千元

111 年度 EUV 光罩銷售數量微幅下降，故產生數量有利差異 25,618 千元，然 111 年度大型 EUV 光罩儲存櫃銷售占比成長且高單價功能性機器設備銷售數量增加，使平均單位成本增加，故產生價格不利差異 161,292 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 17,281 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 111 年度 EUV 相關半導體設備之營業毛利較 110 年度增加 74,973 千元。

(3)111 年前三季及 112 年前三季

A.營業收入減少 42,492 千元

112 年前三季 EUV 光罩銷售數量上升，故產生數量有利差異 200,936 千元，單價較高之小型 EUV 儲存櫃銷售及功能性機器設備占比較高，故 112 年前三季產生價格不利差異 162,285 千元，價量相乘效果產生營業收入組合不利差異 81,143 千元。

B.營業成本增加 63,395 千元

112 年前三季 EUV 光罩銷售數量上升，故產生數量不利差異 137,845 千元，然 112 年前三季小型 EUV 光罩儲存櫃銷售占比較高，使平均單位成本下降，故產生價格有利差異 134,160 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 67,080 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 112 年前三季 EUV 相關半導體設備之營業毛利較 111 年前三季增加 20,903 千元。

2.高階相關半導體設備

(1)109 及 110 年度

A.營業收入減少 14,805 千元

110 年度為因應晶片需求擴張，全球晶圓代工廠積極擴廠，且該公司及其子公司積極擴展客戶，使高階光罩相關機器設備銷售數量上升，故 110 年高階相關機器設備產生數量有利差異 32,438 千元；110 年度單價較低之小型高階光罩儲存設備銷售大幅成長，且高單價之高階功能性機器設備銷售數量下降，使高階光罩相關機器設備平均單價下降，故產生價格不利差異 39,784 千元，價量相乘效果產生營業收入組合不利差異 7,459 千元。

B.營業成本增加 3,133 千元

110 年因高階相關機器設備銷售量上升，故產生數量不利差異 18,593 千元；此外，小型高階相關機器設備比重上升，相對所需料件較少，故使單位成本下降，致產生價格有利差異 13,019 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 2,441 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年度高階相關半導體設備之營業毛利較 109 年度減少 17,938 千元。

(2)110 及 111 年度

A.營業收入增加 217,378 千元

為支撐高效能運算及汽車等關鍵終端市場之長期成長與創新需求，推升產能，推升全球晶圓廠產能，延續擴廠計畫，且該公司及其子公司積極拓展客戶，故 111 年高階光罩相關機器設備產生數量有利差異 213,707 千元；111 年度因海外客戶小型高階光罩儲存櫃及功能性機台需求提升，因海外客戶因裝機及驗證成本較高，故售價亦提高，使小型高階光罩機器設備及功能性機台單價上升，致整體高階光罩相關機器設備單價上升，故產生價格有利差異 1,561 千元，價量相乘效果產生營業收入組合有利差異 2,110 千元。

B.營業成本增加 96,348 千元

111 年度因高階光罩相關機器設備銷售數量上升，故產生數量不利差異 138,185 千元，該客戶針對高階相關光罩設備之組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，故 111 年度高階光罩相關機器設備產生價格有利差異 17,796 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 24,041 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 111 年度高階相關半導體設備之營業毛利較 110 年度增加 121,030 千元。

(3)111 年前三季及 112 年前三季

A.營業收入增加 383,944 千元

該公司及其子公司積極拓展客戶，112 年前三季高階光罩相關機器設備銷售數量大幅上升，故 112 年前三季高階光罩相關機器設備產生數量有利差異 422,197 千元，該公司及其子公司 112 年前三季低單價之小型高階光罩儲存櫃銷售數量大幅提升，使整體高階光罩相關機器設備單價下降，故產生價格不利差異 10,176 千元，價量相乘效果產生營業收入組合不利差異 28,077 千元。

B.營業成本增加 190,460 千元

112 年前三季因高階光罩相關機器設備銷售數量上升，故產生數量不利差異 240,927 千元，該公司及其子公司 112 年前三季低單位成本之小型高階光罩儲存櫃銷售數量較去年同期大幅提升，使整體高階光罩相關機器設備單位成本下降，故 112 年前三季高階光罩相關機器設備產生價格有利差異 13,425 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 37,042 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 112 年前三季高階相關半導體設備之營業毛利較 111 年前三季增加 193,484 千元。

經評估該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之主要產品別之營業收入、營業成本與營業毛利之變化情形，及其價量變化情形，尚屬合理，應無重大異常情事。

四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估併購之目的、效益、交易合理性等因素

該公司及其子公司並無併購他公司尚未屆滿一完整會計年度之情事，故不適用本項評估。

伍、財務狀況

一、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之分析，與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力與現金流量

(一)選取採樣同業公司之理由

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，屬於半導體前段製程相關設備供應商。綜觀目前國內上市、上櫃及興櫃公司，就營業項目、業務型態及市場定位等因素綜合考量，選擇京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱京鼎公司，股票代碼 3413，上市半導體業)、華景電通股份有限公司(以下簡稱華景電公司，股票代碼 6788，上櫃半導體業)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱天虹公司，股票代碼 6937，上市半導體業)作為採樣同業。京鼎公司主要營業項目為先進設備設計及製造，其產品主要應用在半導體產業、面板產業及光電產業等，在半導體產業部

分，其設備用途包含半導體前段晶圓製造之薄膜、蝕刻、化學機械研磨等製程所需之設備、晶圓傳輸自動化設備、微污染防治及惰性氣體充填裝置及晶圓外觀自動檢查設備；華景電公司主要營業項目為晶圓製程微粒子或氣態分子污染物(AMC)微污染防治設備、晶圓盒承載裝置無線射頻辨識(RFID)整合派工系統及其他等；天虹公司主要營業項目為半導體設備及相關零組件之技術與研發、製造、維修及銷售業務等。

此外，參考財團法人金融聯合徵信中心編印之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」中所列「C29 機械設備製造業」之財務比率作為同業平均之財務比率依據。

選取採樣公司之基本資料

公司名稱	代號	主要營業項目
京鼎	3413	半導體、面板及光電等產業之先進製程暨自動化設備，在半導體產業方面用途包含半導體前段晶圓製造之薄膜、蝕刻、化學機械研磨等製程所需之設備及關鍵零組件、晶圓傳輸自動化設備微污染防治及惰性氣體充填裝置及晶圓外觀自動檢查設備
華景電	6788	晶圓製程 AMC 微污染防治設備、RFID 整合派工系統、半導體專業消防工程及設備安裝
天虹	6937	物理氣相沉積設備(PVD)、原子層沉積設備(ALD)、晶圓鏈合機及解鏈合機設備(Bonder/Debonder)、半導體設備零備件及相關服務(Spares & Service)

資料來源：公開資訊觀測站、各公司年報

(二)最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比率之比較分析

單位：%；次；每股元

項目		年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
		公司				
財務 結構	負債占資產比率(%)	家碩	77.07	78.23	66.73	61.79
		京鼎	52.01	46.94	44.99	39.42
		華景電	25.92	21.30	32.79	36.26
		天虹	80.06	51.66	37.74	33.45
		同業	48.40	50.50	46.50	註 4
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率(%)	家碩	1,131.36	1,717.71	3,706.17	922.85
		京鼎	504.07	502.92	366.86	354.01
		華景電	448.12	668.98	305.06	283.56
		天虹	102.67	189.17	291.17	286.04
		同業	210.53	216.45	226.24	註 4

項目		年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
		公司				
償債能力	流動比率(%)	家碩	114.80	120.40	145.67	151.36
		京鼎	234.06	285.58	220.98	266.73
		華景電	460.90	501.35	341.43	284.99
		天虹	97.26	167.12	260.61	304.45
		同業	198.10	187.10	224.60	註 4
	速動比率(%)	家碩	57.93	58.81	84.65	102.51
		京鼎	186.74	209.60	161.20	207.25
		華景電	366.96	357.67	249.66	188.38
		天虹	41.64	76.12	127.04	109.23
		同業	136.20	125.00	148.80	註 4
	利息保障倍數(倍)	家碩	9,958.88	778.44	1,838.11	480.66
		京鼎	63.57	74.19	74.04	56.69
		華景電	224.91	299.17	185.83	80.84
		天虹	8.94	8.56	35.16	38.37
		同業	2,960.00	3,644.80	3,730.60	註 4
經營能力	應收款項週轉率(次)	家碩	5.47	8.34	5.79	5.32
		京鼎	9.11	9.24	11.06	13.99
		華景電	4.41	7.32	7.51	6.62
		天虹	4.22	6.44	4.88	4.51
		同業	3.90	4.70	4.80	註 4
	應收款項收現天數(天)	家碩	67	44	64	69
		京鼎	41	40	34	27
		華景電	83	50	49	56
		天虹	87	57	75	81
		同業	94	78	77	註 4
	存貨週轉率(次)	家碩	1.39	1.08	1.12	1.20
		京鼎	4.58	3.90	3.06	2.84
		華景電	1.84	1.62	1.42	1.16
		天虹	0.70	1.13	0.99	0.86
		同業	2.60	2.80	2.40	註 4
平均售貨天數(天)	家碩	263	338	326	305	
	京鼎	80	94	120	129	
	華景電	198	225	257	315	
	天虹	522	324	369	425	
	同業	141	131	153	註 4	
經營能力	不動產、廠房及設備週轉率(次)	家碩	63.29	47.63	75.32	27.78
		京鼎	6.33	6.92	5.33	3.52
		華景電	4.05	5.33	3.41	2.24
		天虹	1.79	2.15	2.48	2.31
		同業	2.80	3.50	3.10	註 4
	總資產週轉率(次)	家碩	0.90	0.75	0.80	0.76
		京鼎	1.01	0.95	0.88	0.68
		華景電	0.76	0.78	0.68	0.58
		天虹	0.50	0.71	0.70	0.60
		同業	0.50	0.60	0.60	註 4

獲利能力	資產報酬率(%)	家碩	12.00	8.38	15.45	16.29
		京鼎	12.76	11.99	14.03	10.61
		華景電	16.83	16.45	16.94	12.36
		天虹	3.49	10.75	12.61	7.37
		同業	4.50	4.60	6.40	註4
	權益報酬率(%)	家碩	55.97	37.65	53.27	45.27
		京鼎	25.29	23.29	25.54	18.06
		華景電	22.91	21.29	23.35	18.64
		天虹	13.74	28.97	21.79	11.15
		同業	7.60	7.20	11.00	註4
	營業利益占實收資本額比率(%)	家碩	144.53	102.54	107.42	113.80
		京鼎	197.24	226.19	304.07	199.08
		華景電	63.76	84.70	125.16	107.21
		天虹	4.75	35.00	47.52	35.76
		同業	註1	註1	註1	註1
	稅前純益占實收資本額比率(%)	家碩	144.32	82.39	113.19	130.73
		京鼎	183.03	217.80	297.85	254.86
		華景電	64.49	86.00	128.86	112.09
		天虹	42.00	44.34	60.40	43.33
		同業	註1	註1	註1	註1
純益率(%)	家碩	13.32	11.22	19.41	21.25	
	京鼎	12.49	12.40	15.79	15.36	
	華景電	21.91	21.08	24.67	20.91	
	天虹	6.19	13.57	17.45	11.90	
	同業	6.70	6.10	10.20	註4	
獲利能力	每股盈餘(元)	家碩(註5)	3.18	3.37	9.84	7.91
		京鼎	14.91	17.01	24.64	15.29
		華景電	5.19	7.08	10.08	6.36
		天虹	1.63	4.57	5.66	2.62
		同業	註1	註1	註1	註1
現金流量	現金流量比率(%)	家碩	33.41	20.42	13.87	37.03
		京鼎	49.81	21.13	42.66	30.64
		華景電	138.47	38.44	92.46	38.61
		天虹	0.49	28.99	33.40	1.76
		同業	15.60	10.80	12.80	註4
	現金流量允當比率(%)	家碩	註3	91.53	93.20	136.83
		京鼎	121.67	98.91	95.44	86.44
		華景電	註3	72.11	70.50	67.52
		天虹	註3	註3	註3	註3
		同業	註1	註1	註1	註1
	現金再投資比率(%)	家碩	108.51	70.68	25.70	47.99
		京鼎	17.53	1.92	13.56	1.07
		華景電	15.63	(0.56)	15.42	(2.32)
		天虹	0.89	16.16	11.93	(2.01)
		同業	7.20	6.30	2.70	註4

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率

註1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率、每股稅後盈餘及現金流量允當比率

註2：應收款項週轉率及存貨週轉率係以總額計算；應收款項收現天數及平均售貨天數係以無條件進位計算

註3：此財務指標未滿五年度，故無法計算

註4：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版該年度之主要行業財務比率

註5：該公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響

註6：財務分析之計算公式如下

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額

(4)平均銷貨日數=365/存貨週轉率

(5)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額

(6)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額

4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額

(3)營業利益占實收資本額比率=營業利益/期末實收資本額

(4)稅前純益占實收資本額比率=稅前純益/期末實收資本額

(5)純益率=稅後損益/銷貨淨額

(6)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)

1.財務結構

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之負債占資產比率分別為 77.07%、78.23%、66.73%及 61.79%。110 年度受 COVID-19 疫情停工和缺櫃塞港影響，加上遠距生活型態加速數位轉型，終端數位產品對晶片需求提升，半導體產業供應鏈供不應求，使全球半導體產業紛紛大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，該公司及其子公司依客戶訂單進行購料生產，加上該公司及其子公司於交機後驗收前預收客戶 8 成以上款項，致使 110 年度應付帳款及合約負債增加，故 110 年度負債占資產比率較 109 年度上升；111 年度則因該公司辦理現金增資及業績持續成長，使 111 年度現金及約當現金及應收帳款大幅增加，致 111 年度負債占資產比率較 110 年度大幅下降；112 年前三季因業績持續成長，現金及約當現金大幅增加，致 112 年前三季負債占資產比率較 111 年度下降，經評估該公司及其子公司之負債占資產比率變化應無異常之情事。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司除 109 年度僅低於天虹公司外，其餘年度及 112 年前三季均高於其他採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，加上該公司之股本相較其他採樣同業為低(以 112 年前三季而言，該公司股本 272,976 千元，採樣同業京鼎公司、華景電公司及天虹公司之股本分別為 971,861 千元、347,397 千元及 606,773 千元)，致負債占資產比率占比較採樣同業高，惟該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司及其子公司未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情形，經評估尚無重大異常情事。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率為 1,131.36%、1,717.71%、3,706.17%及 922.85%。該公司 109~111 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率逐年上升，主要係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求提升，使該公司及其子公司之營運及獲利持續成長，且該公司於 111 年度辦理現金增資，股東權益逐年增加所致；112 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率大幅降低，主要係因該公司於 112 年前三季因研發所需，增加機器設備所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率皆高於其他採樣同業及同業平均，且該等比率大於 100%，顯示該公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之財務結構各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

2.償債能力

(1)流動比率及速動比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之流動比率分別為 114.80%、120.40%、145.67%及 151.36%，速動比率分別為 57.93%、58.81%、84.65%及 102.51%，其流動比率及速動比率皆呈現上升之趨勢，主係雖過去幾年度因疫情造成的區域封鎖、區域衝突及地緣政治的緊張局勢，嚴重擾亂了全球供應鏈，惟來自 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等相關應用產業

之發展趨勢，仍使得長期半導體需求結構呈現持續增長，該公司及其子公司在配合客戶擴充產能及建廠規劃之需求情況下，最近三年度及 112 年前三季之營運規模及獲利呈現持續成長之趨勢，且該公司於 111 年度辦理現金增資，致其流動資產與速動資產均較各年度前期持續增加，致使流動比率及速動比率逐期上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司除 109 年度之流動比率與速動比率高於天虹公司，低於其他採樣同業及同業平均外，其餘年度及 112 年前三季皆低於採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，使流動負債大幅增加所致；另該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司及其子公司之財務與營運狀況皆屬穩健，且應收款項收現情況良好，經評估其短期償債能力尚無重大異常情事

(2)利息保障倍數

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之利息保障倍數分別為 9,958.88 倍、778.44 倍、1,838.11 倍及 480.66 倍。110 年度利息保障倍數較 109 年度大幅下降，主要係因該公司 110 年度向家登精密承租臺南辦公室認列租賃負債利息費用所致；111 年度利息保障倍數較 110 年度大幅上升，則係因該公司營運成長，稅前淨利增加所致；112 年前三季較 111 年度大幅下降，主係因 111 年底新增新竹辦公室及 112 年前三季新增臺南及臺中倉儲租賃，租賃負債利息費用增加所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109 年度之利息保障倍數係優於採樣同業及同業平均；110~111 年度及 112 年前三季則優於採樣同業，低於同業平均，該公司及其子公司之利息保障倍數主要係受租賃負債利息費用及稅前淨利變動影響，經評估該公司及其子公司因營運獲利穩定而償債能力尚屬穩健，整體而言尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

3.經營能力

(1)應收款項週轉率及應收款項收現天數

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之應收款項週轉率分別為 5.47 次、8.34 次、5.79 次及 5.32 次，應收款項收現天數分別為 67 天、44 天、64 天及 69 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。該公司及其子公司 110 年度應收帳款週轉率較前一年度上升，主要係因 110 年度全球半導體產業大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，致該公司及其子公司營業收入增加，應收帳款週轉率上升；111 年度應收帳款週轉率較前一年度下降，主係該公司及其子公司仍因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致其營業收入持續攀升，期末應收款項隨之增加所致；112 年前三季應收款項週轉率持續下降，雖該公司截至 112 年 9 月底營業收入換算全年度營收較去年度成長 29.28%，惟因 111 年底大量出貨，且今年出貨量持續增加，致平均應收帳款餘額大幅成長 40.65%，應收款項週轉率微幅下降。與採樣同業及同業平均相較，109~111 年度及 112 年前三季應收款項週轉率皆介於採樣同業，高於同業平均。該公司及其子公司之往來客戶大多為國內外知名大廠，財務狀況及營運狀況均為穩健，其授信條件與收款情形尚屬合理，且該公司及其子公司定期追蹤應收帳款期後收回情形，整體而言尚無重大異常情事。

(2)存貨週轉率及平均售貨天數

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之存貨週轉率分別為 1.39 次、1.08 次、1.12 次及 1.20 次，平均售貨天數分別為 263 天、338 天、326 天及 305 天。110 年度受 COVID-19 疫情停工和缺櫃塞港影響，加上智慧型手機、高效能運算產品、物聯網及車用市場需求攀升，晶片需求隨之提升，使全球半導體產業紛紛大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，惟該公司及其子公司所生產之機台設備於出貨後，尚待客戶完成驗收後始得認列營業收入，又其驗收時程受機台設備安裝及客戶驗收測試排程所影響，致使 110 年底已出貨尚未完成驗收之機台設備大幅增加，故該公司及其子公司 110 年度之存貨週轉率較前一年度下降；111 年度因營運規模持續成長，加上 110 年底已出貨未驗收之機台陸續驗收完畢，致營業成本增加幅度大於存貨，致使期末存貨週轉率上升；112 年前三季較 111 年度存貨週轉率上升，主係 111 年度已出貨未驗收之在製品於 112 年前三季陸續驗收認列收入，使營業收入成長連帶影響營業成本增加，其營業成本增幅大於平均存貨，致存貨週轉率微幅上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109、111 年度及 112 年前三季之存貨週轉率高於天虹，低於其他採樣同業及同業平均；110 年度之存貨週轉率則低於採樣同業及同業平均。該公司及其子公司最近三年度及 112 年前三季持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司及其子公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污

染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司及其子公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使存貨週轉率較採樣同業及同業平均為低，惟該公司及其子公司之產品主要係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故其存貨尚無可能產生跌價減損或未能去化之情形。經評估該公司及其子公司之存貨週轉率及平均售貨天數變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(3)不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 63.29 次、47.63 次、75.32 次及 27.78 次，總資產週轉率分別為 0.90 次、0.75 次、0.80 次及 0.76 次。110 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 109 年度下降，主要係因該公司於 109 年度整建臺南樹谷廠，109 年度不動產、廠房及設備期初數尚未包含臺南樹谷廠之廠房整建、空調、電力等工程成本，故 109 年度期初不動產、廠房及設備金額較低所致；111 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 110 年度上升，主要係因該公司及其子公司受半導體產業需求提升，營業收入大幅成長所致；112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度大幅下降，主要係因該公司因研發所需，增加機器設備所致。110 年度之總資產週轉率較 109 年度下降，主要係因半導體產業供應鏈供不應求，使全球半導體產業紛紛大舉投入擴廠，對該公司及其子公司產品需求大增，惟其所生產之機台設備於出貨後，尚待客戶完成驗收後始得認列營業收入，故已出貨待驗收之機台帳列該公司及其子公司之在製品，另驗收時程主係受機台設備安裝及客戶驗收測試排程影響，驗收期程較長，致使 110 年度期末存貨金額大幅增加，且該公司之現金及約當現金亦受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且營業收入亦逐年上升，惟平均總資產金額增加幅度較營業收入增加幅度高，故總資產週轉率於 110 年度呈下滑趨勢；111 年度則因營業收入大幅成長，致總資產週轉率略為上升；112 年前三季之總資產週轉率較 111 年度下降，主要係因該公司及其子公司之現金及約當現金受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且營業收入亦呈上升趨勢，惟平均總資產金額增加幅度較營業收入增加幅度高，致總資產週轉率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率均高於採樣同業及同業平均。就總資產週轉率而言，該公司及其子公司 109~111 年度之總資產週轉率介於採樣同業，高於同業平均；112 年前三季則高於採樣同業，顯示其經營能力與同業相較尚屬良好，整體而言，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之經營能力各項指標變動尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

4.獲利能力

(1)資產報酬率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之資產報酬率分別為 12.00%、8.38%、15.45%及 16.29%。110 年度資產報酬率較 109 年度下降，主係其流動資產因業績與營業規模持續成長，使存貨及現金部位較前一年度大幅成長，致 110 年度總資產金額增加，惟稅後淨利因認列於 109 年 12 月 31 日收購子公司昇和精技公司而產生之商譽減損 20,435 千元，致稅後淨利成長幅度低於總資產所致；111 年度及 112 年前三季資產報酬率逐期受半導體產業需求持續提升，該公司及其子公司業績成長，稅後淨利大幅增加所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司資產報酬率 109 及 111 年度介於採樣同業，高於同業平均；110 年度低於採樣同業，高於同業平均；112 年前三季高於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之資產運用尚屬得宜，並能創造合理之利潤，經評估其資產報酬率之變化應無重大異常情事。

(2)權益報酬率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之權益報酬率分別為 55.97%、37.65%、53.27%及 45.27%。110 年度權益報酬率較 109 年度下降，主要係因該公司於 110 年度認列收購子公司昇和精技公司所產生之商譽減損損失，致稅後淨利成長幅度降低所致；111 年度權益報酬率較 110 年度上升，主要係因該公司 111 年度業績成長，稅後淨利增加幅度大於股東權益增加幅度所致；112 年前三季權益報酬率較 111 年度下降，主要係該公司業績持續成長，惟平均股東權益增加幅度大於稅後淨利增加幅度所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司權益報酬率 109~111 年度及 112 年前三季皆高於採樣同業及同業平均。隨營運規模擴大，該公司及其子公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(3)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業利益占實收資本額比率分別為 144.53%、102.54%、107.42%及 113.80%；稅前純益占實收資本額比率分別為 144.32%、82.39%、113.19%及 130.73%。110 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 109 年度下降，主要係因該公司於 110 年度配發股票股利，該公司之實收資本額上升所致；111 年度及 112 年前三季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率逐期上升，主要則係該公

司及其子公司之營業規模持續受惠於半導體產業需求成長，致營業利益及稅前純益均逐期成長所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣同業，顯示該公司及其子公司獲利能力尚屬良好，整體而言尚應重大異常情事。

(4)純益率及每股盈餘

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之純益率分別為 13.32%、11.22%、19.41%及 21.25%；每股盈餘分別為 3.18 元、3.37 元、9.84 元及 7.91 元。110 年度純益率較 109 年度下降，主要係因該公司認列收購子公司昇和精技公司產生之商譽減損損失所致；111 年度及 112 年前三季則因半導體產業需求持續擴張，使該公司及其子公司之營業規模及獲利持續增長，致稅後淨利大幅增加，致使純益率逐期上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 109 及 111 年度純益率介於採樣同業，高於同業平均；110 年度低於採樣同業，高於同業平均；112 年前三季高於採樣同業。另就每股盈餘而言，109、111 年度及 112 年前三季每股盈餘介於採樣同業；110 年度則低於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之營運仍保持穩定成長之趨勢，最近年度及最近期之營運獲利亦持續擴張，經評估其獲利能力應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之獲利能力尚屬穩定，其獲利能力各項指標變化尚屬合理，經評估其變化應無重大異常情事。

5.現金流量

(1)現金流量比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之現金流量比率分別為 33.41%、20.42%、13.87%及 37.03%。該公司 109~111 年度之現金流量比率逐年下降，主要係因該公司及其子公司合約負債因業績成長逐年增加，應付帳款亦同時受進貨增加大幅增加，致流動負債逐年上升，另該公司及其子公司受營運規模逐漸擴增影響，應收款項隨營業收入成長增加，存貨亦因業績成長待驗收之在製品增加，109~111 年度營業活動之淨現金流入逐年減少，致現金流量比率因而逐年下降；112 年前三季之現金流量比率較以前年度上升，主要係因該公司及其子公司於 112 年前三季陸續收回機台款項，且 111 年底已出貨尚未完成驗收之機台設備於 112 年前三季陸續驗收完畢，加上合約負債因業績成長持續增加，112 年前三季營業活動之淨現金流入大幅增加，致現金流量比率大幅上升。

與採樣公司與同業平均相較，該公司及其子公司 109 年度及 112 年前三季現金流量比率介於採樣同業之間，高於同業平均；110~111 年度則低於採樣同業，高於同業平均。該公司 110~111 年度現金流量比率低於採樣同業主要係因該公

司及其子公司業績逐年成長，依訂單預收客戶貨款及購料生產，流動負債受合約負債及應付帳款增加影響增加，惟該公司流動比率與速動比率均呈增加趨勢，且該公司及其子公司目前仍有充裕之銀行資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形，經評估應無重大異常之情事。

(2)現金流量允當比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季現金流量允當比率分別為-、91.53%、93.20%及 136.83%。該公司因自 106 年度成立，並無 105 年度之財務資訊，故無法計算 109 年度之現金流量允當比率。111 年度及 112 年前三季之現金流量允當比率逐期增加，主要係因該公司營運規模持續擴大，最近五年度營業活動淨現金流量增加所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 110~111 年度現金流量允當比率介於採樣同業之間，112 年前三季則高於採樣同業。該公司及其子公司現金流量允當比率均高於 90%且呈現正向成長，顯示該公司經常性營業活動所產生之現金流入，應可支應其每年資本投資及發放現金股利等活動之現金流量，經評估應無重大異常之情事。

(3)現金再投資比率

該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季現金再投資比率分別為 108.51%、70.68%、25.70%及 47.99%。該公司 109~111 年度之現金再投資比率呈逐年下降趨勢，主要係因該公司之營運規模逐年成長，營運資金大幅增加所致；112 年前三季現金再投資比率上升，主要係因該公司及其子公司於 112 年前三季陸續收回機台款項，且 111 年底已出貨尚未完成驗收之機台設備於 112 年前三季陸續驗收完畢，加上合約負債因業績成長持續增加，112 年前三季營業活動之淨現金流入大幅增加所致。

與採樣同業與同業平均相較，該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季之現金再投資比率均高於採樣同業及同業平均，顯示該公司及其子公司現金再投資能力高於同業，經評估應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之現金流量之各項指標變動尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

二、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止申請公司及其各子公司暨母子公司間背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估對其財務狀況之影響

(一)背書保證

該公司已訂定「背書保證作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理背書保證作業之依據。經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及背書保證備查簿等相關資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無為他人背書保證之情事。

(二)重大承諾事項

該公司訂有「負債承諾及或有事項管理辦法」，業經董事會通過，經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄及相關合約資訊等，該公司及其子公司 109 年度及 112 年前三季並無重大承諾事項，惟 110~111 年度有重大承諾事項，係已簽訂之購置裝修合約，其總價及已支付和尚未支付金額說明如下：

1.110 年度：購置裝修合約合計總價共計新臺幣 7,230 千元(含稅)，截至 110 年 12 月 31 日止已支付新臺幣 4,600 千元，餘新臺幣 2,630 千元尚未支付。

2.111 年度：購置裝修合約合計總價共計新臺幣 8,018 千元(含稅)，截至 111 年 12 月 31 日止已支付新臺幣 2,000 千元，餘新臺幣 6,018 千元尚未支付。

上述重大承諾事項係因營運活動所產生，經抽核相關合約，並無重大限制條款，對該公司及其子公司財務狀況尚不致有重大不利之影響。

(三)資金貸與他人

該公司已訂定「資金貸與他人作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理資金貸與作業之依據，經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及資金貸與他人備查簿等相關資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無資金貸與他人之情事。

(四)衍生性商品交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，其中針對衍生性商品訂定處理程序，業經董事會及股東會決議通過，作為其衍生性商品交易之依據，經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及衍生性金融商品備查簿等相關資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無衍生性商品交易之情事。

(五)重大資產交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為取得或處分資產交易之依據；子公司依該公司訂定並經董事會通過之「子公司監理管理辦法」遵循相關重大資產交易事項。經查閱該公司最近三年度及申請年度截至最近期止之董事會議事錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告、公開資訊觀測站之公告及相關帳冊等資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無達實收資本額百分之二十或金額達三億元以上之重大資產交易之情事。

惟該公司及其子公司應營運需求及未來業務發展，規劃未來興建廠房使用，於112年11月7日董事會通過向南部科學園區管理局租賃土地案，預計於113年第一季簽訂建廠土地租賃合約，係為重大資產交易，相關說明列示如下：

年度	承租公司	租賃標的物	公告日	董事會決議日	租賃期間	使用權資產總額	交易對象	與公司之關係
112年	該公司	臺南科學園區<專46>用地	112/11/7	112/11/7	尚未執行	尚未執行	國家科學及技術委員會 南部科學園區管理局	無

三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性

(一)擴廠原因及必要性

家碩科技自成立以來，主要營業項目為光罩相關半導體機器設備之研發、製造及銷售，該公司自109年度起即與母公司家登精密承租臺南工廠(坐落於臺南市樹谷園區)，作為該公司之生產基地。因半導體產業持續發展，帶動廠商對於半導體設備的需求外，近年來該公司及其子公司產品受國際大廠青睞，使該公司及其子公司營收規模持續成長，機器設備產量亦大幅成長，然因臺南工廠空間有限，致工作及生產空間狹隘，將使工作效率受影響，為滿足該公司中長期業務發展，在永續經營及提供員工良好工作環境之理念下，該公司及其子公司業經於112年11月7日審計委員會及董事會決議通過向國家科學及技術委員會南部科學園區管理局(以下簡稱南科管理局)租地，規劃未來興建廠房，以拓展公司之半導體相關設備業務並就近服務南部科學園區之客戶，該公司擬建設A、B兩廠，A廠擬於113年開始建造，預計114年完竣；B廠擬於115年開始建造，預計116年完竣，包含租地、整地、建置廠房、無塵室工程、倉儲、廠辦搬遷及生產線之機器設備、辦公設備等，未來將視市場需求及產能規劃再陸續擴增產線。

(二)資金來源

該公司擴廠計畫目前已委託建築師規劃廠辦使用配置圖，惟尚未遴選營造商，故未確定實際之建廠金額，後續建廠金額將依進度提報董事會決議，資金來源規劃為自有資金、銀行借款或其他籌資方式。

(三)工作進度

迄評估報告出具日止，該公司預計於 113 年第一季簽訂建廠土地租賃合約，並已委託建築師規劃廠辦使用配置圖，惟尚未遴選營造商，預計 113 年第二季開始興建廠房，A 廠預計工程期為 3 年，於 114 年度取得使用執照，115 年度即可投入生產；B 廠預計工程期為 2 年，於 116 年度取得使用執照，117 年度即可投入生產。

(四)預計效益

該公司本次興建廠辦，展現公司永續經營之決心，以提供舒適工作環境為目標，使員工更有歸屬感及向心力，對公司之營運更有信心進而提升人員之穩定性及向心力，不僅有助於公司業務之拓展，更預留營運規模更加擴大之後，人員擴編所需之辦公空間，對公司整體資源之使用有正面之助益。該公司現有生產之廠房為租賃，且另外租賃倉儲空間，為有效整合廠區並因應營收規模逐年增加，擴充產線並將生產、業務、研發及管理部門集中，可更有效的提升部門間溝通效率，預期未來廠房建置完成後，可視未來客戶訂單需求逐步擴充產線，隨著規模經濟效益浮現，將可挹注營收及獲利。

(五)可行性評估

1.資金取得可行性

該公司擴廠計畫將以自有資金、銀行借款或其他籌資方式支應。該公司截至 112 年 9 月底之現金餘額為 937,719 千元、未動用銀行融資額度達 1.3 億元，該公司將視建廠撥款進度再向銀行洽談融資額度，加上未來辦理股票初次上櫃之現金增資所取得之資金，應足以支應日常營運活動及建廠所需資金，綜上評估，該公司之資金取得應屬可行。

2.銷售之可行性

根據 SEMI 國際半導體產業協會 112 年第三季發布《全球晶圓廠預測報告》(World Fab Forecast, WFF)報告資料顯示，受到晶片需求疲軟以及消費性產品、行動裝置庫存增加影響，預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，從 111 年的歷史高點 995 億美元下滑 15%至 840 億美元；隨後於 113 年回升 15%，達到 970 億美元。顯見全球半導體設備市場規模長期發展呈現持續增加之態勢，且臺灣擁有全球晶圓廠設備支出的領先地位，該公司及其子公司近年來開拓海外市場有成，持續精進機器設備之技術並開發客製化光罩相關機器設備，使 109~111 年及 112 年前三季之營業收入穩定成長，在整體市場前景看好之情況下，該公司建置新廠房於業務上應具可行性。

綜上所述，該公司本次擴廠計畫之資金來源、工作進度及預計效益尚屬合理，擴廠計劃應屬必要且具可行性。

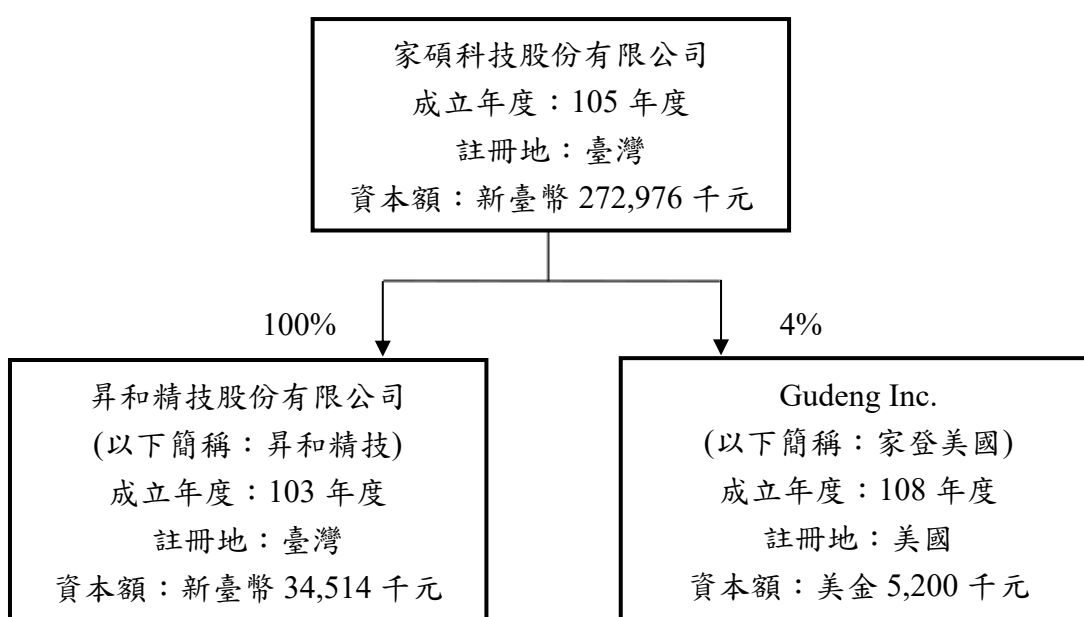
四、個體及合併財務報告之轉投資事業

(一)申請公司申請年度截至最近期止轉投資事業概況，並評估重要轉投資事業(持股比例達二〇%以上或帳面金額或原始投資金額達新臺幣五千萬元以上者)最近年度及申請年度截至最近期止之營運情形及獲利能力

該公司個體財務報告之轉投資事業包含昇和精技公司及 Gudeng Inc.(以下簡稱：家登美國)，其中昇和精技公司係為子公司已納入合併財務報告之編製主體，家登美國為個別不重大之關聯企業，未納入合併財務報告之編製主體，其合併財務報告無其他轉投資事業，茲就個體財務報告之轉投資事業評估說明如下：

1.轉投資事業概況

(1)轉投資架構圖(資料日期：112 年 11 月 30 日)



(2)轉投資事業一覽表

單位：新臺幣千元；美金千元；千股；%

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	原始投資年度	投資目的	評價方法	原始投資狀況			112 年 9 月 30 日				
						金額	股數	持股比例	帳面金額	股數(註)	持股比例	每股面額(元)	股權淨值或市價
昇和精技	半導體與面板的 PVD 真空技術相關機台設計及改造	臺灣	109	長期投資	權益法	NTD 70,000	800	100	76,440	3,451	100	NTD 10	76,440
家登美國	經營各種電子零組件業務	美國	112	長期投資	權益法	USD 208	208	4	7,960	208	4	USD 1	7,960

資料來源：該公司 112 年前三季經會計師核閱之合併財務報告

註：昇和精技公司於 111 年及 112 年通過盈餘轉增資分配 1,177 千股及 1,474 千股

該公司截至 112 年 9 月 30 日止，個體採用權益法投資金額為 84,400 千元，占財務報告所列示股本 279,967 千元之 30.92%，並未超過實收資本額 40%；另依該公司之公司章程第三條規定，該公司轉投資總額不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

2.重要轉投資事業投資過程

該公司截至 112 年 9 月 30 日止，直接持股比例達二〇%以上或帳面金額或原始投資金額達新臺幣五千萬元以上者之轉投資事業為昇和精技公司，茲就該公司轉投資目的、決策過程及取得價格合理性分述如下：

(1)轉投資目的

昇和精技公司成立於 103 年 2 月，為一半導體技術與設備公司，係以半導體製程用物理氣相沈積設備及相關零組件之製造及銷售為主，其 PVD 真空鍍膜和 PVD 設備技術源自日本半導體真空設備大廠的真空機台專家團隊所組成，該公司因營業範圍係 IC 光罩領域，為拓展營運範疇及因應市場需求，迎合 5G 技術發展與環境需求，故投資昇和精技公司，藉由其 PVD 真空鍍膜和相關設備技術領域，擴展核心技術並縮短自行研發之時程及減少研發成本，達到強化本身競爭優勢，未來有望提高集團於整體半導體市場之占有率及增加產品之多樣性。綜上所述，遂於 109 年 12 月取得昇和精技公司 100%股權，經評估其轉投資目的尚屬合理。

(2)決策過程

昇和精技公司原由松本雅文持有 100%股權。該公司為拓展公司未來發展及因應市場需求，於 109 年 12 月 9 日經董事會決議通過以新臺幣七千萬元取得昇和精技公司之全部股權。

(3)取得價格合理性

該交易價格係依據誠正海峽兩岸資產鑑定有限公司出具之昇和精技市場價值分析報告並經獨立專家精譽聯合會計師事務所蔡景峰會計師於 109 年 11 月 30 日出具之昇和精技股權交易價格之會計師覆核意見書，依現金流量折現法算出合理價格區間為 67,697 千元至 77,931 千元，該公司交易價格 70,000 千元係落於該價格範圍，故該公司取得昇和精技公司 100%股權之價格應尚屬合理。

3.重要轉投資事業股權變動情形

單位：新臺幣千元；千股；%

轉投資 事業名稱	原始投資				股權變動情形					截至112年9月30日 投資情形		
	年度	股數	金額	持股 比例	年度	原因	股數	金額	持股 比例	股數	帳面金額	持股 比例
昇和精技	109	800	70,000	100.00	111	股票股利	1,177	—	100.00	3,451	76,440	100.00
					112	股票股利	1,474	—	100.00			

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司之轉投資公司昇和精技為 100%持有之子公司，係為將業務觸角延伸至 PVD 真空鍍膜和相關設備領域，擴展核心技術，藉以提高自身半導體市場占有率及完整度，該公司對轉投資公司之持股變動係因應子公司營運資金所需增資及子公司盈餘轉增資所致，經評估，該公司轉投資事業之股權變動情形，尚無重大異常之情事。

4.對轉投資事業之管理政策

該公司對於轉投資事業之管理政策係依據所制定之「子公司監督管理辦法」、「關係人交易管理辦法」及「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」等相關內部規章或辦法予以辦理。依據該公司轉投資事業管理相關政策，須定期取得採權益法評價轉投資事業之相關財務報表及營運報告，另該公司於董事會下設有稽核人員，針對轉投資事業之監督管理，係由該公司稽核人員規劃其年度稽核計劃，以辦理子公司內控查核，以達適時控管之效，茲將該公司對子公司之控管方式說明如下：

(1)組織及經營策略

針對組織架構管理，董事及監察人之人數，依當地法令規定設立，其過半數之董事及監察人應由該公司派任；管理階層部分，其董事長及總經理之委任由該公司指派或經該公司同意後任命之。該公司派任子公司之董事應定期參加子公司董事會，且應監督子公司營運，對異常事項應查明原因，並作成記錄，若有重大異常事項應即向該公司報告。經營策略方面，子公司應以該公司之經營策略及目標為依據，訂定經營計畫及目標，若其經營計畫與該公司之經營策略衝突或暴露之經營風險太高，該公司即時糾正之。

(2)財務及會計管理

對於重大財務及業務事項和依證券交易法及相關規定應為公告或申報之其他足以影響公司權益及證券價格之重大事項，應於事實發生前呈報該公司核准且即時報告；同時，子公司應每月提供相關財務報表和管理報表，包括營運報告、產銷量月報表、資產負債月報表、損益月報表、現金流量月報表、應收帳款帳齡分析表及逾期帳款明細表、存貨庫齡分析表、資金貸與他人及背書保證月報表、有價證券及衍生性金融商品投資月報、重大財產取得或處分月報表等，進行分析檢討，讓該公司可掌握子公司之經營績效和財務狀況。

(3)稽核管理

該公司對於轉投資事業執行稽核作業，應視子公司之業務性質、營運規模及員工人數，若有需要，應指導其設置內部稽核單位及訂定內部控制制度自行檢查作業之程序及方法，並監督其執行。若子公司依其業務性質、營運規模及員工人數，並不需成立內部稽核單位及訂定內部控制制度自行檢查作業之程序時，該公司內部稽核單位應將各子公司納入內部稽核範圍定期或不定期執行稽核作業，將所發現應行改善事項及其建議作成報告呈核後通知各受查之子公司並應定期追蹤，以確定其已採取適當之改善措施。

6.重要轉投資事業最近年度及申請年度截至最近期止營運情形及獲利能力

單位：新臺幣千元

轉投資事業	111 年度		112 年前三季	
	營業收入	稅後純益	營業收入	稅後純益
昇和精技	58,526	16,375	43,760	9,908

資料來源：該公司及其子公司提供

昇和精技公司為該公司 100%持股之轉投資公司，投資目的係為將業務觸角延伸到 PVD 真空鍍膜和相關設備領域，擴展核心技術，藉以提高自身半導體市場占有率及完整度，其 111 年度及 112 前三季之營業收入分別為 58,526 千元及 43,760 千元，稅後純益分別為 16,375 千元及 9,908 千元，兩期均為獲利狀態，經評估尚無重大異常情事。

(二)申請公司最近三年度及申請年度截至最近期認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形及海外轉投資事業獲利匯回金額

單位：新臺幣千元

轉投資公司名稱	投資損益認列金額				股利分配情形(註)				海外轉投資事業獲利匯回金額			
	109年度	110年度	111年度	112年前三季	109年度	110年度	111年度	112年前三季	109年度	110年度	111年度	112年前三季
昇和精技	—	4,717	12,882	9,276	—	—	11,777	14,737	係國內轉投資事業，故不適用			

資料來源：該公司及其子公司提供；該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

註：昇和精技公司於111年2月21日及112年12月31日經董事會決議通過分派股票股利11,777千元及14,737千元

該公司於109~111年度及112年前三季均依其持股比例認列損益，於股利分配方面，昇和精技公司於111年度及112年前三季分配股票股利11,777千元及14,737千元予該公司。

(三)申請公司申請年度截至最近期止尚未完成之投資案，其預估總投資金額占最近一年度財務報告所列示股本二〇%以上，或逾新臺幣五億元者，應詳加評估說明。但股票為無面額或每股面額非新臺幣十元者，前開有關股本二〇%部分改以歸屬於母公司業主之權益一〇%計算之

該公司申請年度截至最近期止，未有尚未完成之預估總投資金額占最近一年度財務報告所列示股本二〇%以上，或逾新臺幣五億元之投資案，故不適用。

五、申請公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響

截至評估報告日止，該公司及其子公司並無已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，故不適用本項評估。

六、公營事業申請股票上櫃時，其檢送之財務報告以經審計機關審定之審定報告書替代者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見

該公司非屬公營事業申請股票上櫃，故不適用本項評估。

七、推薦證券商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響

該公司非屬外國申請公司，故不適用本項評估。

陸、關係人交易評估

推薦證券商應就申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告之關係人交易，評估以下事項：

- 一、應針對申請公司交易金額重大或性質特殊之關係人交易執行相關評估程序(包括與同業及非關係人交易之比較)，以瞭解其交易之必要性，決策過程合法性，暨價格與款項收付情形之合理性

(一)個體財務報告

1.關係人名單

關係人名稱	與該公司之關係
家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)	母公司
昀陞投資股份有限公司(以下簡稱昀陞公司)	實質關係人
金鵬投資股份有限公司(以下簡稱金鵬公司)	實質關係人
昇和精技股份有限公司	子公司
Gudeng Inc.(以下簡稱家登美國公司)	兄弟公司
家崎科技股份有限公司(以下簡稱家崎公司)	兄弟公司
上海家登貿易有限公司(以下簡稱上海家登公司)	兄弟公司
壺鉉系統科技股份有限公司(以下簡稱壺鉉公司)	實質關係人
鍊恩帕斯科技股份有限公司(以下簡稱鍊恩帕斯公司)	實質關係人

2.關係人重大交易事項

(1)營業收入

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	16,182	328	1,672	341

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

(2) 應收款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	—	—	101	107
合計	—	—	101	107

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

A. 家登公司

該公司 109~111 年度及 112 年前三季對家登公司營業收入金額分別為 16,182 千元、328 千元、1,672 千元及 341 千元，應收帳款金額分別為 0 千元、0 千元、101 千元及 107 千元。家登公司 87 年成立於臺灣，主要營業項目為光罩及晶圓載板之傳載解決方案等，主要客戶為半導體晶圓廠及面板廠，並提供在地化服務，該公司 109 年對其銷售全自動 EIP 刮傷機台檢查機，主要係用於維持家登公司產品出貨品質，110~111 年及 112 年前三季主要係機台改造服務及銷售機器設備相關耗材等，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為發票日後月結 35 天內付款，其交易條件與收款情形與一般銷售客戶相較，尚無重大異常之情形。

(3) 進貨

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	5,534	9,481	10,353	8,630
昇和精技公司	—	—	—	2,283
家登美國公司	—	—	105	—
家崎公司	—	—	—	231
壺鉸公司	—	—	—	9,715
鍊恩帕斯公司	—	—	—	10,800
合計	5,534	9,481	10,458	31,659

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

(4) 應付款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	1,065	1,487	1,689	3,085
鍊恩帕斯公司	—	—	—	7,873
合計	1,065	1,487	1,689	10,958

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

A. 家登公司

該公司 109~111 年度及 112 年前三季對家登公司進貨金額分別為 5,534 千元、9,481 千元、10,353 千元及 8,630 千元，應付帳款金額分別為 1,065 千元、1,487 千元、1,689 千元及 3,085 千元。該公司 109~111 年及 112 年前三季向家登公司主要進貨項目為 PEEK 含管充氣頭及光罩盒等，其產品皆運用於 EUV 光罩相關設備中，該等進貨商品皆為客戶指定供應商及習慣用料，且為製程需求，考量其品質較佳，故持續與家登公司配合進貨。經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

B. 昇和精技公司

該公司 109~111 年度及 112 年前三季對昇和進貨金額分別為 0 千元、0 千元、0 千元及 2,283 千元，應付帳款金額皆為 0 千元。該公司為因應海外客戶交機需求，請昇和協助機器設備機構之組裝工程，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 60 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

C. 家登美國公司

該公司 109~111 年度及 112 年前三季對家登美國公司進貨金額分別為 0 千元、0 千元、105 千元及 0 千元，應付帳款金額皆為 0 千元。該公司為因應美國客戶需求，外派人員至美國進行裝機及維修服務，外派期間借宿家登美國公司之宿舍所產生之專案成本，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 60 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

D. 家崎公司

該公司 109~111 年度及 112 年前三季對家崎公司進貨金額分別為 0 千元、0 千元、0 千元及 231 千元，應付帳款金額皆為 0 千元。該公司因研發設備之需求，向家崎公司採購實驗及檢查用之晶圓片，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

E. 堉鎡公司

堉鎡公司因 112 年 2 月改選董事，成為該公司及其子公司之實質關係人。該公司 112 年前三季對堉鎡公司進貨金額為 9,715 千元，應付帳款金額為 0 千元。該公司因生產設備之需求，向堉鎡公司採購電控、管路組件及電料等材料，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

F. 鍊恩帕斯公司

鍊恩帕斯公司於 112 年 7 月成為該公司之實質關係人，該公司 112 年前三季對鍊恩帕斯公司進貨金額為 10,800 千元，應付帳款金額為 0 千元。該公司因生產設備之需求，向堯鉉公司採購電控、管路組件等材料，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 90 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

(5) 取得之不動產、廠房及設備

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	—	—	—	1,340

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

該公司及其子公司自成立初期即與家登公司購入 PEEK 含管充氣頭，然近期為使產品優化，再度與家登公司共同研發新型 PEEK 含管充氣頭，並向家登公司購買該等模具，經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(6) 承租協議

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司				
取得使用權資產	—	7,866	—	17,045
租賃負債	—	3,965	—	14,582
利息費用	—	99	35	209

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

該公司向家登公司租賃樹谷工業園區之廠商做生產營業之用途，因作為長期生產基地使用，於 110 年簽訂兩年期，並於 111 年底到期後續簽五年期合約，故產生使用權資產、租賃負債及相關利息費用，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(7)租金支出

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	3,217	(32)	23	9
昀陞公司	203	—	—	—
金鵬公司	203	—	—	—
家登美國公司	—	—	—	62
合計	3,623	(32)	23	71

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

A.家登公司

該公司 109 年起以每月 137 千元向家登公司承租位於南部科學園區之廠房作為生產基地，後因家登公司生產規劃等因素，於 109 年 6 月 30 日中途解約，搬遷至家登公司位於臺南樹谷園區之廠房，向其以每月 333 千元承租無塵室、組裝區及辦公室等，作為新的生產基地，該公司依雙方合約議定之價款按月支付；另，該公司自成立之初，向家登公司借址登記於臺北土城，每月支付 1 千元作為租金。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

B.昀陞公司及金鵬公司

該公司 109 年 1 月以每月 36 千元，向昀陞公司承租宿舍，供員工出差使用，後因產權轉換等因素，於 109 年 6 月廢止與昀陞公司之合約，改與金鵬公司承租相同地址之宿舍。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

C.家登美國公司

係該公司員工至美國出差，惟該公司於美國並無設立據點，是以由家登美國公司出租宿舍給該員工，再由該公司支付予家登美國公司之費用支出。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(8)其他關係人交易

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
其他費用—家登公司	42	1,732	790	1,919
其他費用—家登美國公司	—	—	—	166
其他費用—上海家登公司	—	—	—	89
利息收入—家登公司	62	(47)	9	—
租金收入—昇和精技公司	—	—	720	540
其他收入—家登公司	4,200	—	—	—
預付款項—堯鎡公司	—	—	—	1,811

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
存出保證金—家登公司	669	669	669	596
存出保證金—金鵬公司	71	—	—	—
其他應付款—家登公司	1,500	904	111	630
其他應付款—金鵬公司	14	—	—	—
其他應付款—家登美國公司	—	—	—	166
其他預收款—昇和精技公司	—	—	—	180
合約負債—家登公司	—	120	96	13,500
合約負債—上海家登公司	—	—	—	11,313

資料來源：該公司 110~111 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供

A.其他費用—家登公司

該公司 109~111 年度 112 年前三季對家登公司其他費用金額分別為 42 千元、1,732 千元、790 千元及 1,919 千元，主係該公司搬遷至樹谷園區後，承租區域所產生的水電費用、租借公務車及文具費用等費用，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

B.其他費用—家登美國公司

該公司 112 年前三季對家登美國公司其他費用金額為 166 千元，主係該公司員工至美國拓展業務，惟該公司於美國並無設立據點，是以由家登美國公司事先代墊該公司參展等出差費用，再由該公司支付予家登美國公司之費用支出，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

C.其他費用—上海家登公司

係該公司員工至中國拓展業務，惟該公司於中國並無設立據點，是以由上海家登公司事先代墊該公司參展等出差費用，再由該公司支付予上海家登公司之費用支出，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

D.利息收入—家登公司

該公司 109~111 年度對家登公司利息收入金額分別為 62 千元、(47)千元、9 千元及 0 千元，主係該公司向家登公司承租臺南廠房所支付押金所產生之設算息，110 年利息收入為負，主要係因家登公司折讓迴轉 109 年所產生之押金設算息所致，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

E.租金收入－昇和精技公司

該公司於 111 年起以每月 60 千元出租新竹辦公室部分區域，供昇和精技公司作為營業之用途，昇和精技公司依雙方合約議定之價款按月支付，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

F.其他收入－家登公司

該公司 109 年起向家登公司租賃臺南科學園區之廠房做生產營業之用途，惟家登公司因其廠能運用之安排，終止租賃合約所產生之違約賠償金。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

G.預付款項－堯鉉公司

堯鉉公司因 112 年 2 月改選董事，成為該公司及其子公司之實質關係人。該公司對堯鉉公司之預付款項，係該公司向堯鉉公司進貨所產生，屬營業屬營運活動之必要交易。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

H.存出保證金－家登公司

該公司於 109~111 年及 112 年前三季間向家登公司租賃臺南廠房及土城辦公室，於簽約時，提供出租人兩個月租金數額作為保證金，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

I.存出保證金－金鵬公司

該公司於 109 年間向金鵬公司租賃臺南宿舍，於簽約時，提供出租人兩個月租金數額作為保證金，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

J.其他應付款－家登公司

該公司對家登公司之其他應付款，係該公司委託家登公司進行機台測試費用及租賃臺南廠房所產生之水電費等所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

K.其他應付款－金鵬公司

該公司對金鵬公司之其他應付款，係於 109 年下半年向金鵬公司承租臺南宿舍所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

L.其他應付款—家登美國公司

該公司對家登美國公司之其他應付款，係該公司員工至美國拓展業務，惟該公司於美國並無設立據點，是以由家登美國公司事先代墊該公司參展等出差之費用支出所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

M.其他預收款—昇和精技公司

該公司於 111 年起以每月 60 千元出租新竹辦公室部分區域，供昇和精技公司作為營業之用途，昇和精技公司於 112 年 1 月預先支付一年之租金，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

N.合約負債—家登公司

該公司 110~111 年度對家登公司之合約負債，係家登公司委託該公司進行機台維修服務提前付款所產生，其交易之必要性尚屬合理；112 年前三季對家登公司之合約負債，係家登公司向該公司購買機器設備提前付款所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

O.合約負債—上海家登公司

該公司 112 年前三季對上海家登公司之合約負債，係上海家登公司向該公司購買機器設備提前付款所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(二)合併財務報告

1.關係人名單

關係人名稱	與該公司之關係
家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)	母公司
昀陞投資股份有限公司(以下簡稱昀陞公司)	實質關係人
金鵬投資股份有限公司(以下簡稱金鵬公司)	實質關係人
Gudeng Inc. (以下簡稱家登美國公司)	兄弟公司
家崎科技股份有限公司(以下簡稱家崎公司)	兄弟公司
上海家登貿易有限公司(以下簡稱上海家登公司)	兄弟公司
壺鉉系統科技股份有限公司(以下簡稱壺鉉公司)	實質關係人

關係人名稱	與該公司之關係
錄恩帕斯科技股份有限公司(以下簡稱錄恩帕斯公司)	實質關係人

2.關係人重大交易事項

(1)營業收入

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	16,182	328	1,672	341

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

(2)應收款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	—	—	101	107

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告陸、關係人交易評估、(一)與關係人間之重大交易事項、1.個體財務報告、(1)營業收入及(2)應收款項之分析說明。

(3)進貨

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	5,534	9,481	10,353	8,630
家登美國公司	—	—	105	—
家崎公司	—	—	—	231
堯鉉公司	—	—	—	9,715
錄恩帕斯公司	—	—	—	10,800
合計	5,534	9,481	10,458	29,376

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

(4)應付款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	1,065	1,487	1,689	3,085
鍊恩帕斯公司	—	—	—	7,873
合計	1,065	1,487	1,689	10,958

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告陸、關係人交易評估、(一)與關係人間之重大交易事項、1.個體財務報告、(3)進貨及(4)應付款項之分析說明。

(5)取得之不動產、廠房及設備

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	—	—	—	1,340

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告陸、關係人交易評估、(一)與關係人間之重大交易事項、1.個體財務報告、(5)取得之不動產、廠房及設備之分析說明。

(6)承租協議

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
取得使用權資產				
家登公司	—	7,866	—	17,045
租賃負債				
家登公司	—	3,965	—	14,582
利息費用				
家登公司	—	99	35	209

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告陸、關係人交易評估、(一)與關係人間之重大交易事項、1.個體財務報告、(6)承租協議之分析說明。

(7)租金支出

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
家登公司	3,217	(32)	23	9
昀陞公司	203	—	—	—
金鵬公司	203	—	—	—
家登美國公司	—	—	—	62
合計	3,623	(32)	23	71

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告陸、關係人交易評估、(一)與關係人間之重大交易事項、1.個體財務報告、(7)租金支出之分析說明。

(8)其他關係人交易

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 前三季
其他費用—家登公司	42	1,732	790	1,919
其他費用—家登美國公司	—	—	—	166
其他費用—上海家登公司	—	—	—	89
利息收入—家登公司	62	(47)	9	—
其他收入—家登公司	4,200	—	—	—
預付款項—堯鎡公司	—	—	—	1,811
存出保證金—家登公司	669	669	669	596
存出保證金—金鵬公司	71	—	—	—
其他應付款—家登公司	1,500	904	111	630
其他應付款—金鵬公司	14	—	—	—
其他應付款—家登美國公司	—	—	—	166
合約負債—家登公司	—	120	96	13,500
合約負債—上海家登公司	—	—	—	11,313

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告陸、關係人交易評估、(一)與關係人間之重大交易事項、1.個體財務報告、(8)其他關係人交易之分析說明。

二、應瞭解申請公司金額重大之關係企業應收款項是否逾期，針對逾期者，應查明其原因及有無重大異常情事

經檢視該公司 109~111 年度及 112 年第三季應收款項帳齡分析表及期後收款情形，關係企業應收款項多在合理收款條件內，並無重大逾期之情事發生，顯示該公司收款情形良好，尚無重大異常之情形。

三、申請公司與關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來者，應查明其原因，及利率、收付息情形有無重大異常之情事。

經檢視該公司 109~111 年度及 112 年第三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，並無與關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來之情事，應無重大異常之情事。

柒、重要子公司營運情形

一、推薦證券商派員實地瞭解申請公司之重要子公司營運情形者，應具體列示其是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見

該公司尚無符合經檢視「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心推薦證券商辦理股票申請上櫃案之評估查核程序」第七條及「會計師查核簽證財務報表規則」第二條之一第二項規定之重要子公司，故不適用此項評估。

二、本國申請公司生產據點或獲利主要來自海外重要子公司者，應具體列示申請公司對其海外重要子公司在財務操作及資金調度、帳務處理、內控內稽執行及盈餘決策等事項之監管措施及實際執行情形之評估意見

該公司尚無符合經檢視「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心推薦證券商辦理股票申請上櫃案之評估查核程序」第七條及「會計師查核簽證財務報表規則」第二條之一第二項規定之重要子公司，故不適用此項評估。

捌、法令之遵循及對公司營運影響

經參酌本證券承銷商委任莊植焜法律事務所莊植焜律師出具之法律意見書，針對該公司、現任董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人，最近三年內就下列事項出具意見。茲將其意見書及本證券承銷商之評估意見彙總如下：

一、申請公司是否違反相關法令規章

(一)所屬行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章

經參酌莊植焜律師出具之法律意見書，並查閱該公司與主管機關之往來函文，該公司所屬行業之目的事業主管機關為經濟部。影響該行業之重要法律及相關規章，包括公司法、證券交易法、所得稅法、加值型及非加值型營業稅法、勞動基準法、職業安全衛生法、公平交易法、專利法、商標法等相關法令。該公司最近三年度及申請年度截至目前為止，其新竹辦公室(新竹縣竹北市嘉豐十一路一段 117 號)雖未完成室內裝修許可申請，惟經查閱相關資料，並向該公司查詢，新竹縣政府已於 112 年 5 月

29日同意備查該公司使用執照之室內裝修竣工查驗合格乙案，且該府消防局亦於112年8月29日通過建築物消防安全設備圖說審查。故考量該公司目前辦理情形，應可認該公司已積極進行建管合規性之申請，且截至目前為止，該公司並未遭當地建管機關裁罰或勒令停工，故尚不致對該公司財務業務造成重大影響。

(二)依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊

經參酌莊植焜律師出具之法律意見書，並查詢公開資訊觀測站有關該公司所公告及申報事項。該公司自112年3月30日經主管機關核准公開發行後，該公司最近三年度及申請年度截至目前為止，尚依公開發行公司相關法令辦理資訊公開應行公告及申報事項，定期或不定期向主管機關辦理應公告申報事項，尚無違反公開發行公司資訊公開相關法令之情事。

(三)其他法令規章

經參酌莊植焜律師出具之法律意見書，並查閱該公司與主管機關之往來函文及相關明細帳，該公司最近三年度及申請年度截至目前為止，尚無違反其他法令規章之情事。

二、申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人是否違反相關法令，而有違誠信原則或影響其職務之行使

經參酌莊植焜律師出具之法律意見書，並取得該公司申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東及總經理之聲明書、無欠稅證明文件、第二類票據信用資料查覆單及財團法人金融聯合徵信中心無退票紀錄查詢等資料，該公司之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人，尚無違反相關法令，而有違誠信原則或影響其職務之行使其情事。

三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事

經參酌莊植焜律師出具之法律意見書，並查閱該公司與主管機關之往來函文，該公司尚無違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事。

四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參酌莊植焜律師出具之法律意見書，並查詢司法院裁判書系統，該公司於最近三年內除有下列已結訴訟事件外，並無其他尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟等事件：

李瓊慧主張，該公司勞工林志偉積欠李瓊慧債務並經法院判決確定，李瓊慧遂向法院聲請就林志偉對該公司之薪資債權為強制執行，然因該公司之疏失，未保留應扣押而不應發放予林志偉之薪資，導致李瓊慧之債權未能足額受償，故李瓊慧向臺灣新北地方法院起訴請求該公司賠償其損失 30 萬元。針對前述爭議，雙方於 112 年 8 月 15 日在臺灣新北地方法院板橋簡易庭成立調解，由家碩公司給付李瓊慧 3 萬 3,843 元，李瓊慧則拋棄其餘請求，本案終結。經查，該公司雖有前開已結訴訟案件，惟審酌個案事實及該公司處理結果，尚不致對家碩公司財務業務之正常營運造成重大不利影響。

除該公司之法人董事兼持股比例超過百分之十之股東家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)有下述訴訟案尚於進行中外，其餘董事、總經理及實質負責人均未有繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件之情事，相關評估分析如下：

- (一)家登公司主張，其為中華民國發明第 I238804 號「傳送盒之填充裝置改良」專利(以下簡稱系爭專利)之專利權人，因美國 Entegris, Inc. 在其網站公開展示之型號 A300 晶圓傳送盒(以下簡稱系爭產品)，經家登公司比對發現系爭產品已落入系爭專利請求項 1、4、5、8、9 之文義及均等範圍。因此，Entegris, Inc.、其子公司、負責臺灣地區銷售業務之人及實質負責人等七人生產、製造、販賣系爭產品即屬侵害原告專利權之行為。故家登公司遂向智慧財產及商業法院起訴請求 Entegris, Inc. 等七人不得自行或委託、授權他人製造、販賣、使用、進口系爭產品及其他侵害系爭專利權之產品，並應銷毀侵害系爭專利權之物及連帶賠償家登公司 1 億元。查本案經智慧財產及商業法院審理後，因認系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義或均等範圍，故判決駁回家登公司之全部請求。家登公司不服已提出上訴，故本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院第二審審理中，迄未終結。
- (二)Entegris, Inc. 基於與前款相同之原因事實，主張系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義及均等範圍，且系爭專利有得撤銷事由，亦向智慧財產及商業法院起訴請求確認家登公司基於系爭專利，對於 Entegris, Inc. 系爭產品之防止侵害請求權、排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。查本案經智慧財產及商業法院審理後，因認系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義及均等範圍，故判決確認家登公司之前述請求權均不存在。家登公司不服已提出上訴，故本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院第二審審理中，迄未終結。
- (三)美國 Entegris, Inc. 主張，家登公司未經授權製造「300 Diffuser FOUP」前開式晶圓傳送盒，侵害其中華民國發明第 I606534 號或 I515159 號發明專利，故向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求家登公司賠償 3,000 萬元等。查家登公司於 112 年 9 月 12 日收受本案起訴狀繕本後，已委託律師處理後續訴訟程序，本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院審理中，迄未終結。
- (四)家登公司前羅姓勞工主張，其於上班期間發生車禍，發生職業災害，故起訴請求家登公司應補足職災期間(即 109 年 9 月至 111 年 9 月，共二年)原領工資差額及未足額提繳之勞工退休金共 463 千元。又因羅姓勞工前述職災事件經勞工局核定職災期間為 7 個月，非二年，故家登公司亦於 112 年 7 月依民法 179 條不當得利規定，就家登公

司先前多給付之 1 年 5 個月工資補償計 902 千元提起反訴。經查，本案目前尚在法院審理中，迄未終結。

綜上評估，該公司法人董事兼持股比例超過百分之十之股東家登公司雖有上開已結及繫屬中訴訟事件，惟考量所涉個案事實皆與該公司無關，且前述事件並無礙家登公司遂行其法人董事職務，故前述訴訟事件對該公司財務業務之正常營運應無重大影響。

五、申請公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經參酌莊植焜律師出具之法律意見書，並查閱該公司與主管機關之往來函文、相關明細帳及函詢主管機關，該公司最近三年度及申請年度截至目前為止，尚無重大勞資糾紛或污染環境事件之情事。

六、外國申請公司之推薦證券商應洽律師對申請公司、申請時之董事、持股超過股份總額百分之十之股東、總經理及實質負責人最近三年內就下列事項出具之法律意見書，依據其意見，推薦證券商再就該等項目具體評估對申請公司營運影響及因應之道

該公司非屬外國申請公司，故不適用本項評估。

玖、列明依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見及申請公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦法之評估意見

一、列明依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見

經本推薦證券商依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃之具體認定標準審查，並無發現該公司有不宜上櫃情事，詳細說明請參閱附件一。

二、列明申請公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦法之評估意見

該公司於 112 年 5 月 31 日經董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並已訂定薪資報酬委員會組織規程，截至評估報告出具日止，該公司董事會委任李文中、陳瑞杏及林秀怡等三名獨立董事擔任薪資報酬委員會之成員。經本承銷商檢視該公司薪資報酬委員會成員之學經歷資料，其委員會之成員組成尚屬健全，並符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所定之資格要件，故其所召集之會議應屬有效。另經取得該公司薪資報酬委員會之會議紀錄，該公司薪資報酬委員會應屬有效運作，且提交至董事會之建議尚屬合理，董事會就薪資報酬委員會所提之建議事項均經充分討論後進行決議。綜上所述，該公司設置之薪資報酬委員會，已依我國證券法令規定辦理。

拾、評估申請公司是否依本中心「申請有價證券於證券商營業處所買賣之公開說明書應行記載事項準則」規定，於其公開說明書允當表達申請公司推動永續發展之執行情形。評估申請公司之公司治理評鑑自評報告是否允當表達申請公司之公司治理運作情形

一、公開說明書是否允當表達申請公司推動永續發展之執行情形

經檢視該公司申請股票初次上櫃公開說明書，該公司業已按「申請有價證券於證券商營業處所買賣之公開說明書應行記載事項準則」規定於公開說明書中說明其目前推動永續發展之執行情形及差異原因。其中差異主係該公司目前推動永續發展專(兼)職單位仍在籌設中，故針對風險管理政策之訂定與溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之統計和要求供應商應遵循對環境、職業安全衛生或勞動人權等議題之規範仍在著手進行中，此外，因該公司非屬財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定應編製永續報告書之公司，故尚未編製永續報告書，該公司未來將視公司發展需要及依主管機關規定時程，逐步符合永續發展之各項規定。

整體而言，該公司推動永續發展之執行情形正逐步達成上市上櫃公司之永續發展實務守則規定，未來將藉由經營團隊及外部專業機構，以具系統性、策略性之方式整合資源訂定永續發展策略，該公司之公開說明書尚能允當表達其推動永續發展之執行情形。

二、公司治理評鑑自評報告是否允當表達申請公司之公司治理運作情形

經檢視該公司出具之公司治理評鑑自評報告，該公司業依自評報告所列各公司治理評量指標，包括維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展，進行逐項之評估，該公司之公司治理自評報告係已敘明其目前實際運作情形，並符合相關法規制定，確實遵循辦理，故該公司之公司治理自評報告尚足以允當表達公司治理目前運作情形。茲就該公司之公司治理運作情形說明如下：

(一)維護股東權益及平等對待股東

該公司重視股東權益，每年定期依照公司法及相關法規召集股東會，並自公開發行後於開會前上傳年報與議事手冊於「公開資訊觀測站」，於開會通知書載明股東報到時間、地點等應注意事項，以確保股東對公司重大事項享有充分知悉權利，股東會議程係依「股東會議事規則」進行，對於報告及討論事項，均給予股東適當發言及充分參與討論機會，妥善處理股東建議，會後所議決事項亦作成議事錄妥善保存，並揭露於「公開資訊觀測站」。另該公司於公開資訊觀測站及公司網站之公司治理專區設有發言人及代理人發言人，可妥善解答股東之疑義及建議，以保障該公司股東之權益及平等對待股東。故在維護股東權益及平等對待股東方面，該自評報告已依指標評量，尚能表達該公司之公司治理運作情形。

(二)強化董事會結構與運作

該公司目前設有七席董事並有三席女性董事，其中三席為獨立董事，於 112 年 5 月 31 日之股東臨時會選任，同時為落實公司治理先後成立薪資報酬委員會及審計委員會，並均由三位獨立董事組成。該公司於遴選獨立董事時，除須符合獨立性外，並充分考量其學經歷背景，以期能發揮獨立董事應有之功能。獨立董事於股東臨時會選任時採用累積投票制，其選任程序業已依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度，符合上市上櫃公司治理實務守則之規定。該公司每季至少召開一次董事會，重要議案依法提報審計委員會及薪資報酬委員會通過，並已訂定「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」，作為議事有效運作之依據，對於經營策略、財務報告、薪酬架構等重大事項之討論審議程序尚屬良好，並作成議事錄載明決議事項。該公司董事會成員於任期中亦持續參加公司治理主題相關之財務、業務、商務、會計或法律等進修課程，以提升董事成員對公司治理之認知與落實。

該公司考量其整體之營運活動，建立有效之書面內部控制制度，並經董事會通過，且隨時檢討改進，另訂有「內部稽核制度」，董事會並已選任符合資格之人員擔任內部稽核主管，並賦與內部稽核人員充分之權限，每年確實依計劃執行各項稽核工作，而該公司董事會及各相關管理階層則定期檢視各部門內控自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，另獨立董事亦對內部稽核工作定期關注及監督，且會計師出具無保留意見之內部控制專審報告，顯示該公司內控內稽制度有效且已確實執行。此外，該公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，經董事會決議並提報股東會通過後據以執行。故在強化董事會結構與運作方面，該自評報告已依指標評量，且尚能表達該公司之公司治理運作情形。

(三)提升資訊透明度

該公司於公開發行後所編製之財務報告均經會計師查核簽證或核閱，並依規定於期限內公告於公開資訊觀測站，且各項資訊之公開，已依據證券主管機關及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定，指定專人負責公開資訊網路申報作業系統揭露相關重要財務業務資訊；此外，其公司網站已建置公司財務、業務及公司治理之相關資訊，過去一年度亦未有因違反資訊揭露相關法規而受主管機關處分之情事發生，故在資訊透明度方面，股東及利害關係人能及時與充分瞭解公司之財務業務狀況以及實施公司治理之情形。

(四)推動永續發展

該公司業已訂定「永續發展實務守則」，並經董事會決議通過，致力達成環境保護、維護社會公益、促進經濟成長及以達永續發展之目標，且該公司亦隨時注意國內外永續發展之趨勢及企業環境之變遷，據以檢討並改進該公司所建置之永續發展政策，並定期捐贈予慈善公益團體，善盡公司對永續發展之責任。此外，該公司訂有經董事會通過之「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」及「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」，並於公司網站揭露誠信經營申訴信箱，以落實公司治理及防範不誠信行為，董事會及管理階層均積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行，善盡企業經營者之責任。綜上所述，該公司之公司治理評鑑自評報告尚能允當表達其公司治理目前實際運作情形。

綜上所述，該公司之公司治理自評報告尚能依「上市上櫃公司治理實務守則」之規範，允當表達其公司治理運作情形。

拾壹、評估本國申請公司是否符合集團企業、建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申情股票上櫃之補充規定

一、評估本國申請公司是否符合集團企業申情股票上櫃之補充規定

(一)集團企業之認定標準

依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」，所稱「集團企業」係指於申請上櫃會計年度及其上一會計年度內，與申請公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體，其認定標準如下：

1.具有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係：

集團企業之認定標準	符合認定標準之公司	評估說明
(1)屬於母公司及其所有子公司關係者	(1)家登精密工業股份有限公司(家登) (2)家登創業投資股份有限公司(家登創投) (3)家崎科技股份有限公司(家崎) (4) Rich Point Global Corp.(RP) (5) Partner one Ltd.(PO) (6) Gudeng Inc.(USA)(美國家登) (7)家宇航太股份有限公司(家宇航太)	(1)經檢視該公司 111 年度經會計師查核簽證及 112 年第三季經會計師核閱之合併財務報告、股東名冊，該公司係有母公司家登精密工業股份有限公司。 (2)經檢視家登精密工業股份有限公司 111 年度經會計師查核簽證及 112 年第三季經會計師核閱之合併財務報告，母公

集團企業之認定標準	符合認定標準之公司	評估說明
	(8)家碩建設股份有限公司 (家碩建設) (9)恆陽綠能股份有限公司 (恆陽) (10)Sun Park Development Limited(SP) (11)Gudeng Investment Co., Ltd.(GI) (12)上海家登貿易有限公司 (上海家登) (13)蘇州堃鉅貿易有限公司 (蘇州堃鉅) (14)Gudeng Investment (HK)(GIHK) (15)富瑞昇實業股份有限公司(富瑞昇) (16)碩頂精密工業股份有限公司(碩頂) (17)柏升工業股份有限公司(柏升) (18)昇和精技股份有限公司(昇和精技)	司之所有子公司係有左列(2)~(17)等，共 16 家。 (3)經檢視該公司 111 年度經會計師查核簽證及 112 年第三季經會計師核閱之合併財務報告，該公司係有子公司昇和精技股份有限公司。
(2)申請公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制申請公司之人事、財務或業務經營者。其判斷標準如下：		
A.取得對方過半數之董事席位者。	(1)昇和	(1)經檢視該公司最近期變更登記表，其董事席次既有 7 席，其中母公司家登 2 席、自然人 2 席及獨立董事 3 席，故無他公司取得該公司過半數董事席位之情事。 (2)經檢視該公司之子公司最近期變更登記表，該公司取得他公司過半數董事席位，係有左列 1 家。
B.指派人員獲聘為	(1)昇和	(1)經檢視該公司董事會議

集團企業之認定標準	符合認定標準之公司	評估說明
對方總經理者。		<p>事錄，總經理詹印豐係由董事會決議委任，故無他公司指派人員獲聘為該公司總經理之情事。</p> <p>(2)經檢視該公司之子公司最近期變更登記表，該公司指派人員獲聘為他公司總經理，係有左列1家。</p>
C.依合資經營契約規定擁有對方經營權者。	無	經檢視現行有效之重要契約，並無發現該公司有與他公司簽訂合資經營契約之情事。
D.為對方資金融通金額達對方總資產之三分之一以上者。	無	經檢視該公司 111 年度經會計師查核簽證及 112 年第三季經會計師核閱之合併財務報告、董事會議事錄，並無發現該公司為他公司資金融通或他公司為該公司資金融通之情事。
E.為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上者。	無	經檢視該公司 111 年度經會計師查核簽證及 112 年第三季經會計師核閱之合併財務報告、董事會議事錄及銀行借款合同，並無發現該公司為他公司背書保證或他公司為該公司背書保證之情事。
(3)申請公司與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本總額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者。	無	經檢視該公司 111 年度經會計師查核簽證及 112 年第三季經會計師核閱之合併財務報告、董事會議事錄及股東名冊，並無發現該公司與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本總額三分之一以上，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者之情事。

2.具有下列各款情事之一者，即認為申請公司與他公司間具有控制或從屬關係。但經檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限：

集團企業之認定標準	符合認定標準之公司	評估說明
(1)申請公司與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同者。其計算方式包括該等人員之配偶、子女及二親等以內親屬。	無	經檢視該公司董事及總經理之親屬圖、轉投資聲明書，並未發現該公司與他公司之董事、監察人及總經理(含配偶、子女及二親等以內親屬)合計有半數以上相同之情事。
(2)申請公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。	(1)家登創投 (2)家崎 (3)上海家登 (4)GI (5)PO (6)美國家登 (7)家宇航太 (8)SP (9)GIHK	經檢視該公司股東名冊、10%以上大股東之轉投資聲明書，該公司與他公司股份總數過半數為相同股東持有者，為家登創投、家崎、上海家登、GI、PO、美國家登、家宇航太、SP及GIHK，共9家。
(3)對申請公司採權益法評價之他投資公司與其關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份者；或申請公司與其關係人總計持有申請公司採權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者。	(1)家登 (2)昇和	(1)經檢視該公司股東名冊，他公司與其關係人總計持有該公司股份總數過半數之已發行有表決權股份者，為該公司之母公司。 (2)經檢視該公司111年度經會計師查核簽證及112年第三季經會計師核閱之合併財務報告，該公司持有他公司股份總數過半數，為該公司之子公司。

綜上評估，符合該公司集團企業認定標準之公司計有：家登、家登創投、家崎、RP、PO、美國家登、家宇航太、家碩建設、恆陽、SP、GI、上海家登、蘇州堃鉅、GIHK、富瑞昇、碩頂、柏升、昇和，共18家公司。

(二)集團企業中之公開發行公司申請股票上櫃者，雖合於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則有關規定，但不能符合下列各款情事，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心認為不宜上櫃者，應不同意其股票上櫃

1.申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者)，無相互競爭之情形且具有獨立行銷之開發潛力者，所稱「相互競爭」，應以企業型態、商品可否替代及對象客戶等一般性要素綜合判斷之

該公司及其子公司主係從事半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，其中主要包括應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。茲將各集團企業公司以其主要營運項目分類列示如下，並說明有無相互競爭之情形：

項次	集團企業名稱	主要營運項目
1	家登	光罩載具、晶圓載具。
2	家登創投	創業投資、管理顧問。
3	家崎	精密金屬加工、航太零件、蝕刻設備零件。
4	RP	轉投資公司控股。
5	PO	轉投資公司控股。
6	美國家登	美國地區半導體、航太零件貿易。
7	家宇航太	航空器及其零件零售、批發及製造。
8	家碩建設	不動產開發、買賣、租賃。
9	恆陽	能源設備安裝工程。
10	SP	轉投資公司控股。
11	GI	轉投資公司控股。
12	上海家登	大陸地區塑膠製品、電子產品、五金貿易。
13	蘇州堃鉅(註)	汽車銷售、維修、售後服務。
14	GIHK	轉投資公司控股。
15	富瑞昇	轉投資公司控股。
16	碩頂	模具、汽車金屬件、電子連接器。
17	柏升	精密刀具。
18	昇和	濺鍍設備。

資料來源：該公司及其子公司提供

註：蘇州堃鉅已於 112 年 9 月 14 日註銷登記

如上表所示，各集團企業公司之主要營運項目，歸納分類為半導體載具、精密金屬加工、汽車、不動產、投資控股，與該公司之主要業務或產品用途皆不相同，尚無相互競爭之情形。另，該公司及其子公司 111 年度及 112 年前三季銷售予集團企業公司之金額分別為 1,672 千元及 341 千元，占合併營業收入比重為 0.16%及 0.03%，金額及比重微小，顯示該公司及其子公司主要銷售對象非屬集團企業公司，且該公司完全自行掌握產品之研發設計、生產製造及業務銷售，具有獨立行銷之開發潛力。

- 2.申請公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，除各應就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，並經董事會通過

該公司已訂定「關係人交易管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業辦法」，以規範同屬集團企業公司間之財務業務往來事宜，並於112年4月14日經董事會通過。此外，該公司有財務業務往來之集團企業公司包含家登公司、美國家登、家崎公司、上海家登及昇和公司，除昇和為該公司之子公司，故依該公司之「關係人相互間財務業務相關作業辦法」辦理外；集團企業家登公司已有訂定「與關係人、特定公司、集團企業相互財務業務相關作業辦法」，並已由其董事會通過；其餘集團企業美國家登、家崎及上海家登，雖尚無訂定相關作業辦法，另家登公司於113年3月之董事會討論修訂其「與關係人、特定公司及集團企業相互財務業務相關作業辦法」，將其國內外非屬國內外公開發行子公司納入須適用前開作業辦法之範圍，且於相關辦法修訂前美國家登、家崎及上海家登亦依循家登相關作業辦法之規範辦理，應尚屬合理。另該公司與同屬集團間有業務往來者，雙方均已出具財務業務往來無非常規交易情事之書面聲明，而針對無財務業務往來之集團企業公司，亦已出具日後有往來時必無非常規交易情事之書面承諾。

- 3.其財務業務狀況及前述之作業辦法與其他同業比較應無異常現象

經參閱該公司之會計帳冊、內控表單等及會計師出具之內部控制制度專案審查報告，該公司集團企業間之各項財務業務交易，尚依其內部控制制度及相關作業辦法予以執行，尚無發現重大異常之情事。另該公司訂定之「關係人交易管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業辦法」係參酌同業已制定之辦法，並考量自身業務經營狀況所訂定，應無重大異常現象。

- 4.申請上櫃會計年度及最近一會計年度來自集團企業公司之進貨金額不超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，不在此限

經檢視該公司及其子公司111年度及112第三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，該公司及其子公司來自集團企業公司之進貨金額分別為10,458千元及8,861千元，占總進貨金額分別為1.53%及2.10%，並無進貨金額超過百分之七十之情事。

- 5.申請上櫃會計年度及最近一會計年度來自集團企業公司之營業收入或營業利益金額不超過百分之五十；或利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額不超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策、或其他合理原因所造成，且前開比率未超過百分之七十者，不在此限

經檢視該公司及其子公司111年度及112第三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，該公司及其子公司來自集團企業公司之銷貨金額分別為1,672千元及341千元，占總銷貨金額分別為0.16%及0.03%，並無營業收入或營業利益金額超過百分之五十之情事。另該公司因營運生產所需，分別於109年12月9日及112

年2月20日與家登簽訂租賃契約書承租台南樹谷園區之廠房，作為生產使用，111年度及112年前三季帳列使用權資產金額分別為0千元及17,045千元，租賃負債分別為0千元及14,582千元，惟該公司主係採購零組件進行組裝、整合、設計、製造半導體設備，故產線相關生產設備及人員皆可迅速拆卸、移除及復原並遷移至其他地方繼續生產，故評估該公司向家登承租之廠房及辦公室非屬不可取代之資產。另該公司與家登簽訂之租賃契約於116年12月31日到期，若屆時無法繼續向家登承租或家登要求提前終止租約，該公司將可隨時另尋其他適合地點設廠，故無利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十之情事。

綜上所述，該公司尚無違反「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」第二條各款情事之規定。

(三)申請時屬母子公司關係者，母公司申請其股票上櫃者，依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查準則有關規定辦理；子公司申請其股票上櫃者，雖合於同準則有關規定，但不能符合下列各款情事，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心認為不宜上櫃者，應不同意其股票上櫃

1.應檢具母公司與其所有子公司依母公司所在地會計原則編製之財務報告，並應由中華民國會計師就中華民國與母公司所屬國適用會計原則之差異及其對財務報告之影響表示意見。但申請公司係依審查準則第三條第一項第二款「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準、第三條第二項或第四項規定，或「參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定」申請上櫃者；或申請公司於申請上櫃會計年度及其最近一會計年度內與母公司間之進銷貨往來金額未達其進銷貨總金額百分之十者，得不適用上開規定

該公司之母公司家登為國內上櫃公司(證券代號:3680)，其財務報表係依照「中華民國證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及其公告」編製，並經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師及王攀發會計師簽證，與該公司同適用中華民國會計原則，故無差異情形。另，經檢視該公司及其子公司111年度及112第三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，與母公司之進銷貨往來金額，均未達其進銷貨總金額百分之十，得不適用本項評估。

2.依其所檢送財務報告核計，其獲利能力應達本中心審查準則第三條第一項第二款規定。但申請公司基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理因素者，得不適用上開獲利能力之限制

該公司符合前項但書之規定，故不適用本項評估。

3.母公司及其所有子公司，以及前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有公司股份超過發行總額百分之十之股東，與其關係人總計持有該申請公司之股份不得超過發行總額之百分之七十。但申請公司前開相關人員與母公司無直接或間接利害關係者，其持有申請公司之股份不計入

經參閱該公司股東名冊，截至申請上櫃日(112年12月28日)母公司家登持有該公司股份為12,782,268股，持股比例46.83%，家登公司之所有子公司中，家碩公司之董事(包含家登之法人代表人邱銘乾及林添瑞，暨詹印豐董事)暨其二親等親屬及可控公司合計持有該公司股份為6,276,467股，持股比例22.99%，家登公司之其餘子公司及其董事、監察人、代表人或大股東合計持有該公司股份為275,880股，持股比例1.01%，故家登公司及其所有子公司，及前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有公司股份超過發行總額百分之十之股東，與其關係人總計持有該公司股份為19,334,615股，持股比例為70.83%，超過發行總額之百分之七十。

其中，詹印豐董事、其配偶及已成年子女之轉投資公司及已成年子女合計持有該公司股份為4,259,017股，持股比例為15.60%，詹印豐董事係以自然人身份當選該公司董事及以專業經理人之角色出任該公司之總經理，且未曾在家登公司任職，另經詢問並參閱詹印豐董事轉投資資料、配偶、子女及二親等以內親屬之持股明細表、該公司申請上櫃日股東名冊、家登公司110~111年股東會年報，詹印豐董事、其配偶及已成年子女並未在家登公司任職，亦未持有家登公司之股份，故詹印豐董事、其配偶及已成年子女之轉投資公司及成年子女與家登公司並無直接或間接利害關係。

綜上，詹印豐董事、其配偶及已成年子女之轉投資公司及已成年子女之股份15.60%依規無須計入本款計算，排除後母公司家登公司及其前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有公司股份超過發行總額百分之十之股東，與其關係人總計持有該公司股份為15,075,598股，持股比例為55.23%，未超過發行總額之百分之七十，故符合本項規定。

- 4.本國上櫃(市)公司或第一上櫃(市)公司之子公司申請上櫃時，該已掛牌之母公司最近四季未包括申請公司財務數據且經會計師核閱之擬制性財務報表所示之擬制性營業收入或營業利益，未較其同期財務報告衰退達百分之五十以上，且母公司最近二個會計年度未有重大客戶業務移轉之情事。但母子公司間因業務型態、產業類別或產品別不同且無相互競爭，或其他合理原因造成者，得不適用之

該公司之母公司家登自100年8月31日起已在證券商營業處所上櫃買賣，經取得並參閱家登最近四季(111年10月1日至112年9月30日)經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師及王攀發會計師核閱之擬制性合併綜合損益表，所示未包含該公司之擬制性營業收入及營業利益分別為3,706,074千元及790,282千元，較其同期間合併財務報表營業收入5,089,485千元及營業利益1,122,070千元衰退比率分別為27.18%及29.57%，並無衰退達百分之五十以上之情事。又該公司主要從事光罩相關半導體設備產品之業務，而家登主要從事光罩及晶圓相關載體之業務，該公司與母公司所營之產品項目不同並無並無相互競爭之情形得不適用上開規定。

- 5.子公司依前款但書規定申請上櫃者，於申請上櫃前三年內，母公司為降低對子公司持股比例所進行之股權分散行為，應採母公司原有股東優先認購或其他不損及母公司股東權益方式為之，其審查認定標準準用本中心「證券商營業處所買賣有價證券

審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第十款規定

請詳本評估報告「玖、附件一、十、(二)」之說明。

綜上所述，該公司尚無違反「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」第三條各款情事之規定。

二、評估本國申請公司是否符合建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定

該公司非屬建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構，故不適用本項評估。

三、評估外國申請公司是否符合「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第十六條至第十九條有關集團企業及第二十條至第二十二條有關投資控股公司之規定

該公司非屬外國申請公司，故不適用本項評估。

四、評估外國申請公司是否符合本中心「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第四條第六項有關建設公司申請股票上櫃之規定

該公司非屬外國申請公司，故不適用本項評估。

拾貳、以投資控股公司身分申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商亦應就其被控股公司依本應行記載事項要點第五條、第七條第四項、第十條及第十一條規定逐項評估

該公司非以投資控股公司身分申請其股票為櫃檯買賣，故不適用本項評估。

拾參、本國上櫃(市)公司之海外子公司申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商應評估本國上櫃(市)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施

該公司非以上櫃(市)公司之海外子公司身份申請其股票為櫃檯買賣，故不適用本項評估。

拾肆、自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，推薦證券商對上列各項目應加以更新說明與評估

該公司自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書刊印日前，尚無上述所列之情事。

拾伍、其他補充揭露事項

無。

附件一、推薦證券商就財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券
 審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
一、有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事者。	<p>依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心推薦證券商辦理股票上櫃案之評估查核程序」第7條及「會計師查核簽證財務報表規則」第2條之1第2項所列重要子公司標準，該公司並無符合認定標準之子公司。</p> <p>(一)經取得並參閱莊植焜法律事務所莊植焜律師出具之法律意見書、該公司出具之聲明書，並查閱該公司109~111年度及112年度截至目前為止之董事會議事錄、股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，並查詢司法院法學資料檢索系統，以及函詢地方法院，截至評估報告出具日止，該公司未有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>(二)經取得並參閱莊植焜法律事務所莊植焜律師出具之法律意見書、該公司出具之聲明書，並查閱該公司109~111年度及112年度截至目前為止之董事會議事錄、股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、重要契約，並取得票據交換所信用資料、財團法人金融聯合徵信中心之信用報告，截至評估報告出具日止，該公司未有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容，或退票，其結果足使公</p>	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。</p> <p>(三)經取得並參閱莊植焜法律事務所莊植焜律師出具之法律意見書、該公司出具之聲明書，並查閱該公司109~111年度及112年度截至目前為止之董事會議事錄、股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告，截至評估報告出具日止，該公司未有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。</p>				
二、財務或業務未能與他人獨立劃分者。	<p>(一)經核閱該公司109~111年度及112年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告及相關明細帳，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無資金來源過度集中於非金融機構之情事。</p> <p>(二)經核閱該公司現行存續有效之重要契約，參酌莊植焜法律事務所莊植焜律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，尚無發現該公司有與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之情事。</p> <p>(三)經核閱該公司109~111年度及112年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、該公司現行有效之銀行借款合同及銀行回函，該公司並無與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分之情事。</p> <p>(四)經核閱該公司111年度及112年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得</p>	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>該公司出具之聲明書，並無來自非屬集團企業公司之關係人之進貨金額超過百分之七十之情事。</p> <p>(五)經核閱該公司111年度及112年第三經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得該公司出具之聲明書，並無來自非屬集團企業公司之關係人之營業收入或營業利益金額超過百分之五十，或利用前揭關係人提供之關鍵性技術或資產所生營業收入金額超過百分之五十之情事。</p> <p>綜上所述，該公司並無財務或業務未能與他人獨立劃分之情事。</p>				
三、發生重大勞資糾紛或重大環境污染之情事，尚未改善者。	<p>(一)重大勞資糾紛</p> <p>1.經核閱該公司109~111年度及112年截至目前為止與主管機關往來函文、該公司人事相關管理辦法、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、109~111年度及申請年度之營業外支出明細帳及最近四季定期召開之勞資會議記錄等，並參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師所出具之法律意見書與勞動部之回函，和訪談該公司管理當局與員工及取得該公司所出具之聲明書，該公司尚無發生重大勞資爭議。</p> <p>2.經核閱該公司109~111年度及112年截至目前為止與主管機關往來函文、該公司人事相關管理辦法、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、109~111年度及申請年度之營業外支出明細帳及最近四季定期召開之勞資會議記錄等，並參</p>	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>酌莊植焜律師事務所莊植焜律師所出具之法律意見書與勞動部之回函，和訪談該公司管理當局與員工及取得該公司所出具之聲明書，該公司最近三年內尚無因安全衛生設施不良而發生重大職業災害，也無違反職業安全衛生法被處以部分或全部停工，亦無設置危險性機械、設備未檢查合格之情事。</p> <p>3.經核閱該公司109~111年度及112年截至目前為止與主管機關往來函文、該公司人事相關管理辦法、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、109~111年度及112年截至目前為止之營業外支出明細帳及最近四季定期召開之勞資會議記錄等，參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師所出具之法律意見書與勞保局、健保局之回函，並抽核該公司薪資處理程序，和訪談該公司管理當局與員工及取得該公司所出具之聲明書，該公司並無積欠勞工保險保費及滯納金，經依法追訴仍未繳納之情事。</p> <p>(二)重大環境污染</p> <p>1.經核閱該公司109~111年度及112年截至目前為止與主管機關往來函文，詢問該公司管理當局，另經參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師所出具之法律意見書，該公司主係從事半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，過程中並無特殊污染</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>產生，且經查詢行政院環境部列管污染源資料(含裁處資訊)查詢系統，該公司無列管之污染源，故該公司並不適用污染相關設置、操作或排放許可證。</p> <p>2.經查閱該公司109~111年度及112年截至目前為止之往來函文，並詢問該公司相關人員且取得該公司出具之聲明書，及函詢環境部環境管理署、新北市政府環境保護局、新竹縣政府環境保護局及臺南市環境保護局，並參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師所出具之法律意見書，該公司並無因環境污染，而受環保機關按日連續處罰，或經限期改善而未完成改善之情事。</p> <p>3.經核閱該公司109~111年度及112年截至目前為止與主管機關往來函文、公開說明書，並詢問該公司相關人員且取得該公司出具之聲明書，及函詢環境部環境管理署、新北市政府環境保護局、新竹縣政府環境保護局及臺南市環境保護局，該公司並無公害糾紛事件而無有效污染防治設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄之情事。</p> <p>4.經查閱該公司109~111年度及112年截至目前為止與主管機關往來函文，並訪談該公司相關人員、參閱會計師查核簽證或核閱之財務報告、營業外支出帳冊、取得該公司出具之聲明書及函詢環境部環境</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>管理署、新北市政府環境保護局、新竹縣政府環境保護局及臺南市環境保護局，該公司最近三年度及申請年度截至目前為止，尚無因環境污染情事，經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證之情事。</p> <p>5.經查閱該公司109~111年度及112年截至目前為止與主管機關往來函文、並訪談該公司相關人員且取得其出具之聲明書、及參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師所出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書及函詢環境部環境管理署、新北市政府環境保護局、新竹縣政府環境保護局及臺南市環境保護局，該公司並無廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病之情形。</p> <p>6.經詢問該公司相關人員且取得該公司出具之聲明書，並經函詢環境部環境管理署、新北市政府環境保護局、新竹縣政府環境保護局及臺南市環境保護局，該公司非為經主管機關指定公告之事業，該公司之土地並無因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址之情事。</p> <p>7.經詢問該公司相關人員且取得該公司出具之聲明書，該公司並未有製造、加工、或輸入偽禁環境用藥，</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>其負責人經判刑確定之情事。</p> <p>綜上評估，該公司尚無發生重大勞資糾紛或重大環境污染之情事尚未改善者。</p>				
四、有重大非常規交易迄申請時尚未改善者。	<p>(一)進銷貨交易</p> <p>經查閱該公司及其子公司109~111年度及112年前三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並抽核最近三年度及申請年度該公司與關係人及前十大進銷貨廠商客戶之相關進銷貨往來情形，其交易之目的、價格、條件及其交易之處理程序，與一般正常交易相比並無顯不相當或顯欠合理之情形。</p> <p>(二)取得或處分資產</p> <p>經核閱該公司「取得或處分資產處理程序」，均依主管機關之規定辦理，經111年12月19日董事會通過訂定，並於112年1月31日提報股東臨時會同意，然該公司為增進公司治理，於112年11月7日董事會決議通過修訂取得或處分不動產或其他固定資產、有價證券及無形資產之核決層級，並預計113年度提報股東常會同意。另該公司於112年3月30日公開發行，經查閱該公司109~111年度及112年第三季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄、固定資產清冊、取得及處分資產彙總表及抽核相關文件，該公司自公開發行日起迄目前為止重</p>	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>大取得或處分資產交易情形如下：</p> <p>該公司於 112 年 11 月 17 日董事會決議擬向國家科學及技術委員會南部科學園區管理局(下稱南科管理局)承租土地取得使用權資產，並經董事會授權董事長以 20 年租期，租金計算依據南科管理局土地租金及費用計收辦法，代表該公司與南科管理局議定土地租約及簽署相關文件，該公司已於董事會當日依規定發布重大訊息，前開交易截至目前為止尚未正式簽訂租賃合約，該公司已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理，尚未發現有重大異常或不合理之情事。</p> <p>另該公司於 109~111 年度及 112 年公開發行前之重大取得或處分資產交易說明如下：</p> <p>1.109 年取得子公司昇和精技股權</p> <p>經取得董事會議紀錄、誠正海峽兩岸資產鑑定(股)公司出具之股權市場價值分析報告、精譽聯合會計師事務所蔡景峰會計師出具之交易價格合理性會計師覆核意見書及股權收購交易憑證，該公司已依其所訂之「取得或處</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>分資產處理程序」之規定辦理，其取得股權程序、價格依據及合理性尚屬合理。</p> <p>2.112 年 2 月向母公司家登精密續租樹谷園區廠房</p> <p>經取得董事會議事錄、租賃合約，並與鄰近地區租金比價，落於非關係人價格區間，及公告重大訊息及相關交易憑證等，該公司已依其所訂之「取得或處分資產處理程序」之規定辦理，其取得使用權資產程序、價格依據及合理性尚屬合理，另該公司之母公司於 112 年 2 月 20 日已代該公司公告向關係人取得使用權資產 17,045 千元。</p> <p>(三)不動產交易</p> <p>經參閱該公司及其子公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司及其子公司最近五年度及申請年度截至評估報告刊印日止，並未有買賣不動產之情事。</p> <p>(四)資金貸與他人</p> <p>經查閱該公司及其子公司 109~111 年度及 112 年前三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及明細帳，並未發現有非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，而仍資金貸與他人之情事。</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	綜上評估，該公司並無重大非常規交易迄申請時尚未改善之情事。				
五、申請上櫃會計年度已辦理及辦理中之增資發行新股併入最近一年度財務報告所列示股本計算，其獲利能力不符合上櫃規定條件者。	經核閱該公司董事會、股東會議事錄及最近期之財務報告，該公司目前實收資本額為272,976千元，若加計上櫃前預計辦理公開銷售之現金增資27,170千元，增資後之實收資本額為30,015千元，經設算後110及111年度財務報告稅前淨利占預計增資後股本比率分別為303.05%及850.77%，均達百分之三以上，其111年度稅前淨利達4,000千元以上，且111年度決算無累積虧損，獲利能力已符合上櫃規定條件。	V			
六、未依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，或內部控制、內部稽核及書面會計制度未經健全建立且有效執行，其情節重大者。	經查閱該公司最近三年度及申請年度最近期止之經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度、經會計師出具之內部控制制度專案審查報告，該公司已依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，且內部控制、內部稽核及書面會計制度等已確實建立且有效執行。	V			
七、公司或申請時之董事、總經理或實質負責人於最近三年內，有違反誠信原則之行為者。	(一)公司部分 1.經取得該公司台灣票據交換所第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心之信用報告及參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經清償贖回註記之情事。	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>2.經取得財團法人金融聯合徵信中心之信用報告，參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，函詢該公司主要往來銀行並取得該公司出具之聲明書，該公司並無向金融機構貸款而有逾期還款之情事。</p> <p>3.經詢問該公司管理當局，查閱該公司與主管機關往來函文，參酌莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無違反勞動基準法被處以刑罰確定且尚未改善之情事。</p> <p>4.經取具國稅局及稅捐稽徵機關出具之無違章欠稅紀錄回覆函、檢視該公司與主管機關往來函文及核閱該公司相關明細帳冊，參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無因違反稅捐稽徵法，而經判決有罪確定之情事。</p> <p>5.經參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項。</p> <p>6.經核閱該公司董事會及股東會會議記錄、公開資訊觀測站重大訊息、司法院法學資料檢索系統裁判書查詢資料，並參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書及取得該公司出具之聲明書，截至</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>目前為止，該公司並無其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益之情事。</p> <p>(二)董事、總經理或實質負責人部分</p> <p>1.經取得該公司董事及總經理出具之聲明書、台灣票據交換所第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心查詢之信用報告資料、國稅局與稅捐稽徵機關所出具之無違章欠稅記錄之回覆函及參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司董事及總經理並無開立票據經票據交換所公告為拒絕往來戶或發生存款不足而退票、向金融機構貸款有逾期還款、違反勞動基準法被處以刑罰、違反稅捐稽徵法經判決有罪及違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項等之情事。</p> <p>2.經取得該公司董事及總經理所出具之聲明書、查詢司法院法學資料檢索系統之裁判書資料及參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司董事或總經理並無因違反左列法令，而經法院判決有期徒刑以上之刑者。</p> <p>3.經取得該公司董事及總經理所出具之聲明書、查詢司法院法學資料檢索系統之裁判書資料及參閱莊植焜律師事務所莊植焜律師出具之法律意見書，該公司董事及總經理並無經營</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>其他公司涉及惡性倒閉等不良經營之行為。</p> <p>綜上所述，該公司於最近五年內及其現任董事及總經理於最近三年內，並無違反誠信原則之行為。</p>				
八、申請公司之董事會有無法獨立執行其職務者。	<p>(一)經參閱該公司經濟部核准之變更登記表及股東會議事錄，該公司目前設有7席董事，其中包含獨立董事3席，分別為。故已符合董事會成員應至少五席，其中獨立董事席次不得低於三席且不得少於董事席次五分之一之規定。</p> <p>(二)經取得申請公司各董事之親屬表並查核其董事成員之關係，其中邱銘乾董事及林添瑞董事為同一法人之代表人，其餘董事彼此間並未具有左列所示之情形，故超過半數之席次未具有左列關係。</p> <p>(三)獨立董事之任職條件之評估</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.經取得該公司獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡所出具之獨立性聲明書，並無違反公司法第30條各款之情事。 2.經核閱該公司最近期變更登記表及股東會議事錄，該公司之獨立董事均以自然人身份擔任董事，非為公司法第27條規定以政府、法人或其代表人身份當選。 3.經評估該公司獨立董事已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之資格條件，茲說明如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)獨立董事選任程序評估： 	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>參閱該公司之公司章程業已載明獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。另經核閱該公司董事會及股東會議事錄等資料，該公司三席獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡之提名作業、資格審核及選任程序，尚符合「公司法」、「證券交易法」、「公开发行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。</p> <p>(2)獨立董事資格要件評估：</p> <p>經查閱獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡之學經歷資料，茲分別說明如下：</p> <p>A.李文中</p> <p><u>學歷：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.輔仁大學 法律學系財經法學組 學士 2.英國國立萊思特大學 企管研究所 MBA <p><u>經歷：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.中華國際聯合法律事務所 主持律師/所長 2.輔仁大學法律系兼任 助理教授 <p><u>證照：</u></p> <p>中華民國律師證照</p> <p><u>現職：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.中華國際聯合法律事務所 負責人 2.豐運通開發有限公司 負責人 				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	3.中玲投資有限公司 負責人 4.桃園汽車客運(股)公司 法人董事代表人 B.陳瑞杏 <u>學歷：</u> 1.臺灣大學 會計系學士 2.臺灣大學 管理學院碩士 <u>經歷：</u> 1.三商美邦人壽保險(股)公司 副總經理 2.第一創業投資(股)公司 協理 <u>證照：</u> 中華民國會計師執照 <u>現職：</u> 1.三商行(股)公司 董事長特助 2.三商投資控股(股)公司 董事長特助 3.三友藥妝(股)公司 法人董事代表人 4.心樸市集(股)公司 法人監察人代表人 C.林秀怡 <u>學歷：</u> 1.陽明交通大學 EMBA 碩士 2.美國伊利諾大學 法學碩士 <u>經歷：</u> 1.常在國際法律事務所 律師/Integrated Partner 2.理律法律事務所 資深律師、律師顧問 <u>證照：</u> 中華民國律師證照 <u>現職：</u> 1.怡睿國際法律事務所 主持律師 2.實億投資(股)公司 監察人				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>綜上評估，該公司獨立董事具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗，其中獨立董事陳瑞杏為會計或財務之專業人士，尚符合相關規定。</p> <p>(3)獨立董事之獨立性評估</p> <p>A.獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡係於112年5月31日股東臨時會選任，於選任前二年及任職期間無列情事之一：</p> <p>(A)經取得獨立董事所出具之獨立性聲明書及其轉投資情形與學經歷相關資料，該公司獨立董事非為該公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(B)經取得獨立董事所出具之獨立性聲明書、轉投資情形與學經歷相關資料，該公司獨立董事非為該公司或其關係企業之董事或監察人。</p> <p>(C)經取得該公司股東名冊及獨立董事所出具之獨立性聲明書、親屬表與轉投資情形，該公司獨立董事及其配偶、未成年子女或以他人名義持有於選任前二年與任職期間並未持有該公司已發行股份總數百分之以上或為</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>持股前十名之自然人股東。</p> <p>(D)經查閱110~111年度及112年截至評估報告日止之該公司之變更登記表及股東名冊、該公司獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡出具之親屬表、轉投資明細及獨立性聲明書，該公司獨立董事於選任前二年及任職期間並非該公司或其關係企業之經理人、董事、監察人、持有該公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p> <p>(E)經取得該公司股東名冊及獨立董事所出具之獨立性聲明書、轉投資情形與學經歷資料，該公司獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡均非為直接持有該公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任該公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>(F)經取得該公司變更登記表、股東名冊，該公司未有與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之情事，故該公司獨立董事於選任前二年及任職期間未有擔任與該公司董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司之董事、監察人或受僱人之情事。</p> <p>(G)該公司與他公司或機構之董事長同一人為昇和精技公司、家登精密工業股份有限公司、上海家登貿易有限公司、家登創業投資股份有限公司、Gudeng Investment Co., Ltd、家崎科技股份有限公司、Partner One Ltd、家碩建設股份有限公司、Gudeng INC、恆陽綠能股份有限公司、富瑞昇實業股份有限公司、柏升工業股份有限公司。經查詢經濟部商業司工商登記之董監事名單、公開資訊觀測站年報等，及取得並檢視該公司董事長、營運長及總經理</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>之轉投資聲明書、親屬表、獨立董事出具之轉投資聲明書、基本資料表及獨立董事聲明書，該公司獨立董事非為該公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p> <p>(H)與該公司有財務或業務往來之特定公司為家登精密工業股份有限公司、A集團、B集團。經查詢該特定公司之公司登記資料及年報及取得並檢視獨立董事所出具之獨立性聲明書、轉投資聲明書及學經歷資料，該公司獨立董事並非與該公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或為持股百分之五以上股東。</p> <p>(I)經取具獨立董事之獨立性聲明書、轉投資及任職相關資料，並查閱公司勞務費明細帳冊等資料，該公司之獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>於選任前二年及任職期間並非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p> <p>綜上評估，該公司獨立董事李文中、陳瑞杏及林秀怡於選任前二年及任職期間均具有獨立性身分。</p> <p>(四)經取得獨立董事所出具之獨立性聲明書、轉投資情形及學經歷資料，該公司獨立董事並無擔任其他公開發行公司之獨立董事。</p> <p>(五)經取得該公司三位獨立董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第六條第一款、第二款、第四款訂定之進修體系所出具之相關證明文件，該公司之獨立董事已就法律、財務或會計專業知識進修達三小時以上。</p> <p>綜上評估，該公司之董事會並未有無法獨立執行其職務之情事。</p>				
九、申請公司於申請上櫃會計年度及其最近一個會計年度已登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，於掛牌日起，其現任董事及持股超過其股份總額百分之十之股東，有未於興櫃股票市場，而買賣申請公司發行之股票情事者。但因辦理第四條之承	該公司自112年6月26日登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票起，經查閱該公司公告之每月內部人持股異動事後申報表，並取得該公司現任董事所出具之聲明書，尚無發現現任董事有未於興櫃股票市場而買賣該公	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
銷事宜或有其他正當事由者，不在此限。	司發行股票之情事。				
<p>十、申請公司之股份為上櫃(市)公司持有且合於下列條件之一者，於申請上櫃前三年內，上櫃(市)公司為降低對申請公司之持股比例所進行之股權分散行為，未採上櫃(市)公司原有股東優先認購或未採其他不損及上櫃(市)公司股東權益之方式者：</p> <p>(一)申請公司係屬上櫃(市)公司進行分割之分割受讓公司。</p> <p>(二)申請公司係屬上櫃(市)公司之子公司，於申請上櫃前三年內，該上櫃(市)公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上。</p>	<p>(一)該公司非屬上市櫃公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司。</p> <p>(二)該公司係屬上櫃公司家登精密之子公司，經檢視該公司股東名冊，最近三年內家登精密降低對該公司持股比例累積未達百分之二十以上，故不適用本項評估。</p>	V			
<p>十一、所營事業嚴重衰退者。</p>	<p>該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要產品係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能。綜觀目前國內上市櫃公司，並無與該公司所營事業完全相同之公司，故就該公司之產品性質、營運模式及應用領域等因素予以綜合考量，選取京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱：京鼎)、華景電通股份有限公司(以下簡稱：華景電)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱：天虹)為其比較同業。經取得該公司及三家同業公司最近三個會計年度及申請年度截至最近期止經會計師查核簽證或核閱之財務報告，資料彙整如下：</p>	V			

項目	具體認定標準 逐一評估情形		是否適宜上櫃			說明
			是	否	不適用	

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	109 年度		110 年度		111 年度		112 年前三季	
		金額	金額	成長率 (%)	金額	成長率 (%)	金額	成長率 (%)	
營業收入	家碩	477,773	601,932	25.99	1,047,953	74.10	1,016,063	51.68	
	京鼎	9,942,056	12,246,437	23.18	14,843,221	21.20	9,671,457	(9.29)	
	華景電	730,182	1,089,854	49.26	1,416,410	29.96	1,045,562	3.41	
	天虹	998,574	1,655,712	65.81	1,815,477	9.65	1,337,551	12.82	
營業淨利	家碩	79,781	113,203	41.89	242,329	114.07	232,983	55.86	
	京鼎	1,635,235	1,988,339	21.59	2,951,060	48.42	1,451,110	(27.81)	
	華景電	201,451	294,243	46.06	434,807	47.77	279,322	(4.19)	
	天虹	8,723	190,685	2,086.00	288,343	51.21	162,758	(3.60)	
稅前淨利	家碩	79,663	90,960	14.18	255,358	180.74	267,650	56.85	
	京鼎	1,517,437	1,914,615	26.17	2,890,702	50.98	1,857,639	(21.61)	
	華景電	203,762	298,771	46.63	447,651	49.83	292,039	(4.65)	
	天虹	77,090	241,538	213.32	366,469	51.72	197,197	(14.40)	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

<p>(一)最近一會計年度或申請上櫃會計年度之營業收入及營業利益與同業比較，顯有重大衰退者。</p> <p>(二)最近一會計年度或申請上櫃會計年度之稅前淨利與同業比較，顯有重大衰退者。</p> <p>(三)最近三會計年度之營業收入及營業利益，均連續呈現負成長情形者。</p>	<p>(一)該公司111年度及112年前三季之營業收入為1,047,953千元及1,016,063千元、營業利益為242,329千元及232,983千元，營業收入分別較前一年度同期成長74.10%及51.68%，營業利益分別較前一年度同期成長114.07及55.86%，111年度及112年前三季營業收入成長率皆優於同業，故尚無重大衰退之情事。</p> <p>(二)該公司111年度及112年前三季之稅前淨利為255,358千元及267,650千元，分別較前一年度同期成長180.74%及56.85%，111年度及112年前三季稅前淨利成長率皆優於同業，故尚無重大衰退之情事。</p> <p>(三)該公司109~111年度之營業收入分別為477,773千元、601,932千元及1,047,953千元；營業利益分別為79,781千元、113,203千元及242,329千元，營業收入及營業利益皆無連續呈現負成</p>
---	--

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
<p>(四)最近三會計年度之稅前淨利，連續呈現負成長情形者。</p> <p>(五)產品或技術已過時，而未有改善計畫者。</p> <p>(六)對於申請公司最近一會計年度財務報告之稅前淨利不包含非控制權益之淨利(損)占股本之比率達百分之六以上者，不適用前項規定。</p>	<p>長之情形。</p> <p>(四)該公司109~111年度之稅前淨利(損)分別為79,663千元、90,960千元及255,358千元，無連續呈現負成長情形。</p> <p>(五)經參閱該公司相關產業報告，該公司從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用該公司及其子公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境設備需求與日俱增趨勢，該公司及其子公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長，應具未來發展性。綜上所述，該公司產品或技術應無過時，而未有改善計畫之情事。</p> <p>(六)該公司及其子公司111年度之稅前淨利不包含非控制權益之淨利占股本之比率為113.19%，超過6%以上，故不適用前項規定。 綜上所述，該公司尚無所營事業嚴重衰退之情事。</p>				
<p>十二、其他因事業範圍、性質或特殊情況，本中心認為不宜上櫃者。</p>	<p>(一)該公司於111年12月新承租新竹辦公室，承租後進行室內裝修，建築師事務所於112年2月進行室內裝修及申請圖面審查，並於112年5月29日取得圖面審查備查函。該公司已通過室內裝修圖面審查，且建築師依法規標準</p>	V			

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>及審查之圖面施工完竣，惟截至申請上櫃日(112年12月28日)尚在申請辦理室內裝修合格證明及消防安檢核准函，主要係因消防安檢涉及全社區消防系統，故耗時較長，按建築法第77-2條針對建築物室內裝修訂有相關應遵守規定，若未依法辦理建築物室內裝修時，依據同法第95條之1，主管機關得對建築物所有權人、使用人或室內裝修從業者新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦，逾期仍未改善或補辦者得連續處罰；必要時強制拆除其室內裝修違規部分。然該公司業已申請辦理中，尚非未改善之情事，且該辦公室非屬於該公司主要生產據點，僅是做為辦公室使用，應尚不致對該公司之財務、業務產生重大影響。經檢視該公司收發文記錄，該公司已於113年2月26日取得室內裝修竣工查驗合格核備函。</p> <p>(二)該公司之法人董事家登公司有一未決訟案，主要係美國Entegris, Inc.主張家登公司有未經授權製造「300 Diffuser FOUP」前開式晶圓傳送盒，侵害其中華民國發明第I606534號或I515159號發明專利，故向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求家登公司賠償3,000萬元等。家</p>				

項 目	具體認定標準 逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	<p>登公司於 112 年 9 月 12 日收受起訴狀繕本後，已委託律師處理後續訴訟程序，目前仍繫屬於智慧財產及商業法院審理中，迄未終結。然該公司並無生產有關晶圓傳送盒之機器設備，所涉個案事實皆與該公司無關，且前述事件並無礙家登公司遂行其法人董事職務，經評估，前述訴訟事件對該公司財務業務並無重大影響。</p> <p>經評估該公司上述之情事對該公司財務業務並無重大影響，且除上開事項外，尚無其他因事業範圍、性質或特殊情況而有不宜上櫃之情事。</p>				

推薦證券承銷商：元大證券股份有限公司



評估人簽章：陳 秀 梅



鍾 志 豪



葉 玫 秀



楊 佳 蓉



蔡 易 靜



黃 儀 倫



單位主管簽章：林 佩 宸



負 責 人：陳 修 偉



中 華 民 國 1 1 2 年 1 2 月 2 7 日 編 製

中 華 民 國 1 1 3 年 4 月 1 7 日 修 訂

(限家碩科技股份有限公司申請股票上櫃推薦證券商評估報告用)

推薦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司



評估人簽章：李珮瑩



單位主管簽章：曾郁芬



負責人：呂瑞齡



中華民國 112 年 12 月 27 日 編 製

中華民國 113 年 4 月 17 日 修 訂

(限家碩科技股份有限公司申請股票上櫃推薦證券商評估報告用)

推薦證券承銷商：永豐金證券股份有限公司



評估人簽章：陳容寧



單位主管簽章：蔡東良



負責人：朱士廷



中華民國 1 1 2 年 1 2 月 2 7 日 編 製

中華民國 1 1 3 年 4 月 1 7 日 修 訂

(限家碩科技股份有限公司申請股票上櫃推薦證券商評估報告用)

推薦證券承銷商：凱基證券股份有限公司



評估人簽章：林 秉 辰



單位主管簽章：林 能 顯



負 責 人：方 維 昌



中 華 民 國 1 1 2 年 1 2 月 2 7 日 編 製

中 華 民 國 1 1 3 年 4 月 1 7 日 修 訂

(限家碩科技股份有限公司申請股票上櫃推薦證券商評估報告用)

附件十七

股票上櫃前現金增資發行新股之證券承銷商評估報告

家碩科技股份有限公司
初次上櫃前現金增資發行新股
證券承銷商評估報告



元大證券股份有限公司

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 2 8 日

目錄

壹、評估報告總評	1
貳、評估報告內容摘要	2
一、產業狀況	2
二、發行人之競爭地位	7
三、營運風險	2
四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益	24
參、業務狀況	25
一、營業概況	25
二、財務狀況	74
肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	93
一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫	93
二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益	94
三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響	94
四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務週轉困難情事	94
五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開	95
伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	96
一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事(格式如附表九)，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行	96
二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事	96
二之一、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及十九之二所列情事	103
三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定	103
四、法令之遵循及對公司營運影響	115
五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師未具有下列事項	119
陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其	

查核程序及所獲致結論	120
一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性	120
一之一、總括申報發行新股案件者，應另就下列事項提供評估說明	122
二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估	122
三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性	122
三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性	128
四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應就下列事項評估其可行性與合理性	128
五、以低於票面金額辦理現金發行新股者：應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響	128
六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，是否已評估下列事項	128
七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性	129
陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項	129
柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	130
捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	130
玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	130
拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果	130
拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	130
拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	130
拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論	130
拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點個相關事項並加以更新說明與評估	130

壹、評估報告總評

家碩科技股份有限公司(以下簡稱家碩公司或該公司)本次為辦理初次上櫃現金增資發行普通股 2,717 千股，每股面額新臺幣壹拾元整，發行總額為新臺幣 27,170 千元整，依法向金財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，家碩公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。



元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉



承銷部門主管：林佩宸



中 華 民 國 113 年 3 月 27 日

貳、評估報告內容摘要

本承銷商經依「中華民國證券商業同業公會發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」規定辦理查核完畢，所獲至結論如下：

一、產業狀況

(一)全球半導體產業

半導體產業是一種採用半導體材料(III-V 族化學元素)去製造電子元件的產業，主要用於控制、計算、處理、記憶、傳輸。因為半導體是電子產品的基礎元件，常見的終端應用，例如：電腦、手機、相機、計算機、伺服器、顯示器、汽車、航空、軍武等。目前半導體產業已是一個高度全球化、高技術競爭、高資本門檻的產業。全球知名的半導體廠商，包含、聯電、英特爾、美光、艾司摩爾、中芯國際、長江存儲等。半導體產業隨著摩爾定律持續發展和進步，積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，促使科技創新、社會改革、生產效率提升、產品應用擴展，對全球經濟發展有重大的貢獻，隨著科技的進步和需求的增加，半導體產業仍然具有很大的潛力和前景。

根據世界半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)統計資料指出，111 年全球半導體市場規模為 5,741 億美元，相較於 110 年僅微幅成長 3.3%，主要係因 111 年受到俄烏戰爭、通貨膨脹、央行升息、終端消費萎縮、總體經濟下修等因素影響，成長力道明顯趨緩許多。112 年度受記憶晶片需求減弱拖累，全球半導體市場規模下滑 9.4%至 5,201 億美元。WSTS 預期，113 年度在 AI 晶片需求強勁推升下，全球半導體市場年增率將達 13.1%，總規模將攀至創紀錄的 5,884 億美元。

全球半導體市場成長趨勢



資料來源：WSTS(112/12)

Gartner 數據與預測指出，112 年雖 GPU 等 AI 晶片需求強勁，但仍無法填補終端需求疲弱缺口，以致 112 年全球半導體營收預計將衰退 10.9% 至 5,340 億美元；然而，在記憶體需求呈現強勁復甦下，113 年預計將成長 16.8%，達到 6,240 億美元，更預估 114 年將增 15.5% 至 7,210 億美元。

全球半導體收入預測



資料來源：Gartner(112/12)

(二)臺灣半導體產業

臺灣是全球主要的半導體生產基地之一，在全球半導體產業中占有重要地位，處於全球半導體產業的領先地位，亦是臺灣經濟的重要支柱之一，產業發展受到政府的大力支持，通過設立科技基金、開發技術、政策補助等措施，促進臺灣半導體產業快速發展。時至今日，臺灣半導體產業的主要優勢，具有強大的晶圓製造能力，為全球半導體廠商或終端應用品牌客戶提供最佳的製造選擇，產值位居全球半導體領先地位。同時具有領先技術研發能力，不斷推陳出新，配合國際知名企業和研究機構建立密切的合作關係，共同研發和生產創新產品，設計開發出全球領先的半導體產品。此外，臺灣擁有領域廣泛的半導體供應鏈，涵蓋設備製造、IC 設計、材料生產、封裝檢測等多個製造關鍵節點。臺灣半導體產業長期建立出產業良好形象及巨大的品牌影響力，在全球市場上享有聲譽，將在未來繼續發揮重要作用，成為全球半導體產業中不可忽視的成員。

根據資策會產業情報研究所(Market Intelligence & Consulting Institute, MIC)統計資料指出，111 年臺灣半導體產值為新臺幣 44,088 億，年成長 18.6%。111 年相較過去 110 年，同樣經歷 110 年發生 26.8% 的爆發性增長，111 年受到高基期的影響，成長率仍優於全球半導體產業。112 年全球半導體產業面臨庫存調整期間拉長、IC 設計與記憶體產業需求下滑、美中科技戰未停歇等情勢，整體年度半導體規模陷入衰退態勢，預估 112 年臺灣半導體產業產值為 3.77 兆新臺幣，衰退 14.4%。

展望 113 年，預期各次產業將有一至二成的成長幅度，故預估產值將達 4.29 兆新臺幣，成長 13.7%。其中，晶圓代工仍為主要動能，特別是先進製程部分；記憶體部分，由於國際記憶體大廠持續減產，短期記憶體價格回穩，供需可望恢復穩定；IC 設計與 IC 封測產業，由於與終端消費性電子產品有較大關聯，未來兩季較難如同有先進製程助益的晶圓代工產值，有較好的復甦表現。

臺灣半導體產業產值

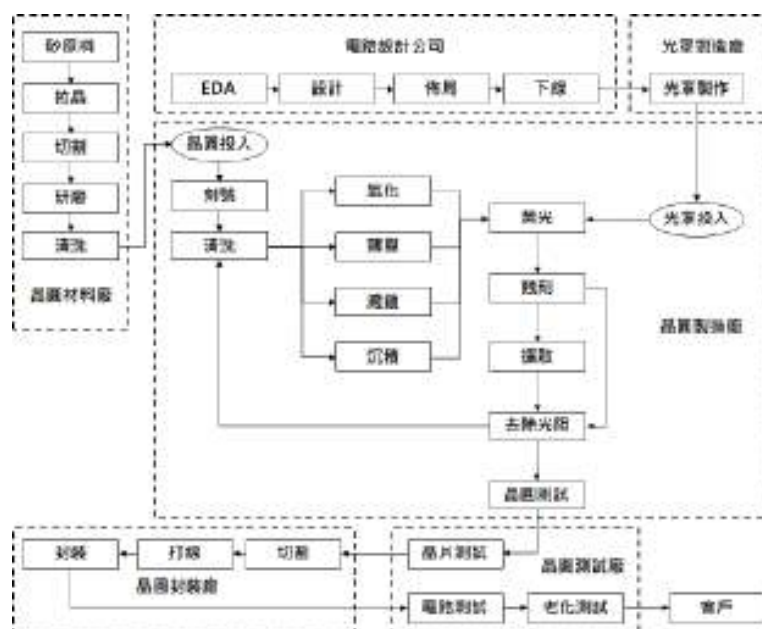


資料來源：MIC(112/11)

(三) 半導體設備產業

半導體設備是半導體產業的核心，設備的品質和性能對半導體元件的良率和性能有很大的影響，是製造半導體元件所不可或缺的部分。全球知名的半導體設備商，包含應材、艾斯摩爾、東京威力科創、柯林研發、科磊等。其中，半導體製造過程包含：晶圓投入製造前所需的拉晶、切割、研磨、清洗，黃光製程所需的光罩製作，晶圓投入製造後所需的薄膜、濺鍍、黃光、蝕刻、擴散、清洗等製程，以後晶圓出廠後所需的測試、切割、打線、封裝。每個製造環節都需要半導體設備廠參與其中，例如：長晶爐、晶圓切割機、光罩交換機、極紫外光刻機、晶圓清洗機、檢測設備等，由半導體設備廠商提供先進設備及技術支援，以確保半導體元件生產具備穩定度和可靠度。因此，半導體設備廠商屬於整個半導體產業的重要合作夥伴，由於半導體產業的快速發展，相關設備的市場需求持續成長，例如：增設生產線、擴建擴廠，因此半導體設備廠商亦伴隨產業同步成長。

半導體設備相關製程站點



資料來源：<http://www.semiinsights.com>

根據國際半導體產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)統計資料指出，111 年半導體設備前段晶圓製造相關產值為 941 億美元，年成長 7.5%。112 年預估產值將達 906 億美元，年減 3.7%，主要是終端消費減弱，客戶端庫存堆積，使訂單削減，晶圓廠擴產需求形成一個週期，直至 113 年全球半導體設備產值將出現復甦跡象，惟因記憶體產能增加有限，晶圓廠設備銷售額預估僅小幅成長 3%。114 年隨著新晶圓廠建成運轉、產能擴張和技術升級的帶動，需求成長加速，全年對於半導體前段設備的投資金額預估將近 1,100 億美元，成長 18%。

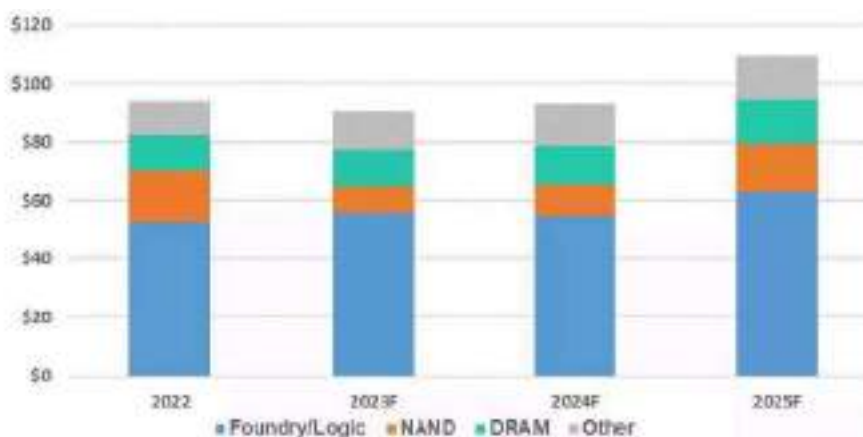
半導體設備產值預測



資料來源：SEMI(112/12)

SEMI 公布最新一季全球晶圓廠預測報告，晶片需求因受終端市場趨弱的環境影響，佔晶圓製造設備銷售總額超過一半的晶圓代工及邏輯製程兩大部門，112 全年預估仍小幅成長 6%，來到 563 億美元，隨著成熟技術擴張減緩，以及前沿技術成本結構的改善，113 年晶圓代工和邏輯製程預估將微幅下降 2%。而在新一輪產能擴張及新製程技術導入的推動下，114 年晶圓代工和邏輯製程投資可望再次轉求，預估銷售成長 15%至 633 億美元。

晶圓設備支出總額



資料來源：SEMI(112/12)

整體而言，半導體產業仍然充滿潛力和長期發展趨勢，包含：(1)智慧型裝置：隨著智慧型裝置的普及，如智慧型手機、智慧型家電、智慧型醫療等，將有助於擴大半導體的需求；(2)新能源車：電動車能源政策推動電動車，提升汽車電子整車滲透率，以及支援自動駕駛和安全技術，將有助於半導體不同階段製程；(3)物聯網：物聯網技術的發展將需要大量的半導體元件支持產品間傳輸功能，將有助於擴大半導體產業的應用發展；(4)雲端裝置：雲端計算和大數據將需要大量的半導體元件，將有助於推動半導體產業的發展；(5)新型技術：例如人工智慧、機器學習、量子電腦等新型

技術的發展，將對半導體產業帶來新的商機。因此，半導體產業仍然具有很大的潛力和前景，不斷透過技術研發和製程推進，應對市場需求和挑戰，在未來繼續保持強勁的增長動力，繼續擔當著全球科技發展的關鍵角色。

二、發行人之競爭地位

(一)市場占有率

該公司及其子公司主要業務為產品主要營業項目為半導體設備及相關零組件設計、製造、銷售及維修服務，應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)製程所需之光罩傳載解決方案，產品包含光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等。其產品多屬高度客製化，目前市場上並無相同或相似領域之同業，故未有相關統計資料可一致性基礎比較其市場占有率。惟該公司及其子公司之主要銷售客戶皆為國際知名半導體大廠，且其產品皆通過相關認證，並與客戶建立有長期合作關係，短期內難以有供應商可跨足進入該供應鏈。另對高效能運算及車用電子市場強勁及記憶體需求之增加，帶動先進製程需求增加，連帶使 EUV 設備及其相關需求上升，可望進一步助益該公司及其子公司業績。

該公司及其子公司 112 年營業收入為 1,207,145 千元，較前一年度成長 15.19%，為全球半導體前段設備產值，約占全球半導體設備出貨金額 0.04%，其持續深耕關鍵客戶，兼併延伸業務觸角至新應用領域與新市場，以逐步擴大市場占有率。

(二)同業間之地位

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要產品係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能。綜觀目前國內上市櫃公司，並無與該公司所營事業完全相同之公司，故就該公司之產品性質、營運模式及應用領域等因素予以綜合考量，選取京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱：京鼎)、華景電通股份有限公司(以下簡稱：華景電)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱：天虹)為其比較同業，京鼎主要從事先進設備設計及製造，其產品主要應用在半導體產業、面板產業、光電產業等，並提供高科技產業全廠自動化整合規劃服務，生產的設備模組與零組件，其應用領域涵蓋物理氣相沉積(PVD)、原子層沉積(ALD)薄膜製程；華景電主要從事半導體設備暨關鍵性零組件、自動化設備及系統整合，主要產品為晶圓製程 AMC(Airborne Molecular Contamination)微污染防治設備及 RFID(Radio-frequency identification)派工整合系統；天虹主要從事半導體設備機台與半導體設備零備件產品之研究開發、製造及銷售，主要產品為物理氣相沉積設備(PVD)、原子層沉積薄設備(ALD)及晶圓鍵和機及解鍵合機設備等。

該公司及其子公司 111~112 年度之營業收入分別為 1,047,953 千元及 1,207,145 千元，營業收入成長率分別為 74.10%及 15.19%，整體與同業相較其營收成長幅度大幅增加。茲將採樣同業之資料列示如下：

單位：新臺幣千元；%

公司名稱	營業項目	112 年度		合併營收淨額				
		資本額	資產總額	110 年度	111 年度	112 年度	111 年度 成長率	112 年度 成長率
家碩	臺灣櫃買中心興櫃公司，代號 6953，主要營業項目為半導體設備及相關零組件設計、製造、銷售及維修服務，應用於 EUV 光罩及高階製程之光罩傳載自動化技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等。	272,976	1,880,714	601,932	1,047,953	1,207,145	74.10	15.19
京鼎	臺灣證交所上市公司，代號 3413，主要營業項目為半導體設備與平面顯示器設備、次系統與系統整合服務，產品主要應用在半導體產業、面板產業、光電產業等	974,393	19,369,723	12,246,437	14,843,221	13,051,357	21.20	(12.07)
華景電	臺灣櫃買中心上櫃公司，代號 6788，主要營業項目半導體設備暨關鍵性零組件、自動化設備及系統整合之設計製造與銷售。	347,397	2,442,643	1,108,984	1,416,410	1,370,598	27.72	(3.23)
天虹	臺灣證交所上市公司，代號 6937，主要營業項目為半導體設備機台與半導體設備零備件產品之研究開發、製造及銷售。經營自有品牌半導體設備，設備零組件業務則以客製、翻修、改良改進客戶現場設備為主。	674,773	4,141,817	1,655,712	1,815,477	1,992,643	9.65	9.76

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告；公開資訊觀測站

三、營運風險

(一)行業營運風險

1.景氣循環之營運風險

半導體業是一個具有循環性的行業，主要係因受到科技變化、技術進步、市場供需、地緣政治、全球經濟狀況等因素影響。尤其半導體業 109~111 年才剛經歷，因為疫情停工和缺櫃塞港造成產業鏈供不應求的現象，導致半導體不論在設計、製造、封裝階段，都呈現爆炸性的需求推動產業成長，半導體業紛紛大舉投入擴廠，這次晶片荒使得半導體業推上景氣循環週期的高峰。112 年半導體業受到通貨膨脹，接續各國央行陸續升息，打擊疫情後全球景氣復甦，重挫終端電子產品消費信心，影響終端客戶下單意願，間接影響半導體業擴廠速度和資本支出投入。

然而，該公司及其子公司主要交易對象之技術涵蓋 EUV(Extreme Ultraviolet)製程，由於透過 EUV 的技術，晶圓代工廠得以製造出更小更密集的高階晶片，所需光刻、光罩較為特殊，與傳統設備相異，並且需要重新投入大量的研發和實驗，視為半導體業主力發展方向，不易受到總體經濟環境和投資縮減等因素影響。因此，該公司及其子公司並沒有發生傳統半導體設備業的景氣循環現象，反而因為 EUV 相關半導體設備市場的合格認證競爭對手較少，促進設備業市場需求穩定增長。

2.行業上下游變化之營運風險

該公司及其子公司之半導體設備應用於 EUV、高階光罩製程及 PVD(Physical Vapor Deposition)等，包含光罩潔淨、交換、檢測等，其主要原料可分為電料、金屬加工件、電控、管路組件等，提供設備設計、製造及維修服務及客製化解決方案。茲就該公司及其子公司所屬行業上下游之關聯性，列示如下：



資料來源：產業價值鏈資訊平台

(1)上游原物料供應變化

該公司及其子公司主要向上游供應商採購電料、電控、金屬加工件、管路組件等，用以組裝、整合、設計、製造半導體設備及自動化智慧倉儲管理等。該公司及其子公司之供應廠商眾多，並與供應商建立穩定之合作關係，目前各主要原物料供應充足，尚無原物料供應變化之風險。

(2)下游產品銷售變化

該公司及其子公司主要向下游客戶銷售半導體設備，應用於 EUV、高階光罩製程及 PVD 製程，包含光罩潔淨、交換、檢測等，且主要銷貨客戶為產業領導廠商，與客戶深耕多年並維持良好關係，透過不斷提高自身水平技術，伴隨客戶通過認證，共同打入新一代高階製程，維持產業領導地位，目前各主要產品銷貨穩定，尚無產品銷售變化之風險。

3.行業未來發展之營運風險

(1)行業未來發展之趨勢

A.半導體製程持續演進

隨著 5G 與物聯網裝置的日漸普及，無論日常生活與工作中所需傳輸與處理的資料呈指數型增長，帶動了高運算效率(High Performance Computing, HPC)的需求持續上升。為了達到高運算效率，並滿足低功耗的需求，各家先進製程廠商持續提高研發強度，先進製程從 7 奈米發展至 3 奈米；依據台積電 111 年股東會年報所述，3 奈米製程(N3)已於 111 年第四季進入量產，並致力於發展 2 奈米技術，提供高效能低功耗的效益，以滿足日益增加的節能運算需求，預計於 114 年開始量產。晶圓廠持續不段突破電晶體微縮的極限，在製程提升下，帶動半導體資本支出需求成長。

B.新產品應用需求旺盛

5G 的普及化、AI 快速增長以及加速數位化轉型等產業趨勢，使智慧型手機、高效能運算產品、物聯網及車用市場需求攀升，因電子產品採用半導體的含量提高，使積體電路製造服務領域成長強勁。智慧型手機市場部分，從原本僅要求高性能與高能源效率的積體電路技術，提升至高度整合的晶片與先進的 3D 封裝設計，提供成本、能耗及規格最佳化；高效能運算部分，包含個人電腦、平板電腦、遊戲機、伺服器及基地台等，其中以伺服器與數據中心需求較為強勁，滿足在人工智慧應用上日益增加的需求，以容載快速成長的資訊流量以及持續的 5G 基地台部署；物聯網部分，包含各樣的智慧聯網裝置，如穿戴裝置、音箱、健康裝置、家庭自動化裝置、城市與製造等，由於 Covid-19 疫情改變了消費者的生活與工作型態，並加速企業的數位轉型，使相關需求上升；車用電子部分，汽車產業朝更環保、安全及智慧的方向邁進，加速電動汽車、

先進駕駛輔助系統及智慧座艙資訊娛樂系統等發展，帶動相關處理器、車內網路、感測器及電源管理晶片的需求提升；消費性電子產品部分，主要需求落在高階產品，如大尺寸螢幕、高幀率電視、語音 AI 及 Wi-Fi 6 無線連接。隨終端產品應用需求擴增，帶動半導體產業持續成長。

C. 各國半導體供應鏈在地化政策

為推動半導體在地化生產，減少對境外晶片的依賴，各國陸續執行半導體供應鏈的扶植政策，美國政府於 111 年 8 月通過規模 527 億美元的晶片與科學法案(Chips and Science Act)，其中 390 億美元將用於補助興建半導體廠房及購置設備，132 億美元用於先進製程的研發與人才培訓；歐盟則於 111 年 2 月通過規模 430 億歐元的歐盟晶片法案(European Chips Act)，將用於半導體製程研發與建廠補貼；隨著美中關係逐漸惡化，中國取得半導體關鍵零組件困難，故在十四五規劃中，將半導體產業發展納入規劃中，將全力支持發展第三代半導體，承諾將持續投入 1.4 兆美元，以期能實現半導體產業的獨立自主。在各國強力發展半導體產業下，晶圓大廠台積電、三星及美光紛紛宣佈於美國設廠，將對半導體設備廠商增添營運成長動能。

D. 晶圓廠設備支出長期成長

依據 SEMI 預估全球用於前段晶圓廠設備支出預計 113 年全球晶圓廠規模將同比增長 21%，市場規模達到 920 億美元，其中臺灣為全球晶圓廠設備支出領頭羊，總額較 112 年增加 4.2% 來到 249 億美元；韓國排名第二，總額 210 億美元，同比成長 41.5%；中國大陸則排名全球設備支出第三位，預期受美國出口管制下，先進製程發展有所受限，投資額維持 160 億美元；美洲地區排名第四，可望達到創紀錄的 110 億美元，同比成長 23.9%；歐洲和中東地區的投資額預期也將續創新高，支出總額增加 36% 至 82 億美元；日本和東南亞晶圓廠設備支出預計到 113 年也將分別回升至 70 億美元和 30 億美元。因應終端市場需求強勁，半導體廠商持續擴大產能，使半導體設備廠商持續成長。

(2) 行業未來發展之營運風險

A. 半導體產業伴隨技術升級，產品應用拓展迅速

該公司及其子工司主要產品主係應用於半導體製程中光罩相關設備，包含光罩儲存、交換、潔淨及檢測等功能。半導體製程演進快速，高效能、低能耗的要求使晶圓製造廠商更加重視製程良率，因應客戶需求，該公司及其子公司須即時開發符合市場需求之產品，根據客戶需求客製化設備，以爭取訂單。

因應對策：

該公司及其子公司研發團隊秉持多年經驗開發符合客戶需求之產品，並提供完整的微環境解決方案，持續開發高階製程之設備。研發團隊與重點客戶維持良好互動，即時參與新功能、新規格之設備開發，以提高研發能量，且該公司及其子公司在設計產品之初期，與客戶充分討論，於產品設計階段將客戶需求納入考量，增進公司產品品質，生產符合客戶期待之產品。

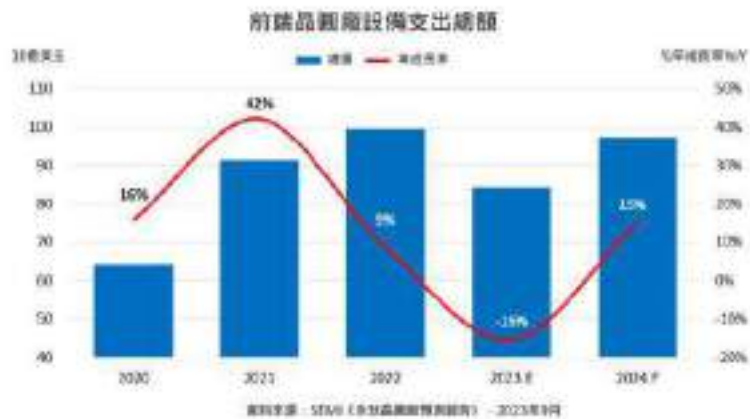
4. 產品可替代性之營運風險

該公司及其子公司主要提供光罩相關設備之設計、製造及銷售等服務，為全臺少數能提供多樣化及客製化的光罩相關微環境設備及解決方案之本土廠商。因光罩金額高，且因製程演進，光罩使用的數量大增，該公司及其子公司之產品對於晶圓廠微光製程良率助益大，公司經營團隊本身具有半導體設備之產品開發及設計之技術能力，擁有多年產業經驗，與家登精密之光罩載具配合，提供客戶完整微環境解決方案，其安全規範、技術能力及服務均獲得客戶的肯定及認同，客戶遍及半導體產業、光電產業等，產品應用領域廣泛，未來除持續精進開發符合客戶需求之光罩相關設備，並期望得以開發新型機台，進而降低在設備製造市場被取代之風險。

(二) 發行公司營運風險

1. 市場未來供需變化情形

根據國際半導體產業協會(SEMI)報告，全球前端晶圓廠設備支出自 109 年起已連續三年呈現成長趨勢，111 年支出金額來到 980 億美元新高，惟受晶片庫存修正以及終端消費需求衰退影響，使 112 年設備支出下修至 760 億美元，但 5G、AI、高效能運算等技術創新推動市場規模持續擴張，另車用市場及物聯網等終端產品之半導體含量持續提升，使半導體長期需求仍持續看漲，預期將帶動 113 年晶圓廠設備廠支出回彈至 920 億美元。儘管前端晶圓廠設備支出受總體經濟局勢影響，惟長期策略投資的基本面仍然暢旺，以支持人工智慧、汽車和其他成長中應用的重大技術發展。112 年第三季全球半導體設備出貨金額為 256 億美元，其中臺灣出貨金額為 37.7 億美元，穩居全球前三，展望 113 年各地區別晶圓設備廠支出，臺灣將持續穩坐全球晶圓廠設備支出領先地位，總額較 112 年增加 4% 來到 230 億美元；韓國排名第二，總額 220 億美元，成長 41%；中國則以 200 億美元排名全球設備支出第三位，預期受美國出口管制下，先進製程發展有所受限，其將持續以成熟製程進行投資及布局。



資料來源：國際半導體產業協會(SEMI)

雖然 112 年半導體設備市場支出因需求調整過渡期減緩，但依國際半導體產業協會(SEMI)報告指出，基於高效能運算及車用電子之市場強勁，推動 113 至 115 年半導體設備資本支出出現雙位數成長，預估 12 吋晶圓廠設備支出將出現成長浪潮，113 年預計投入 820 億美元，並於 114 年成長至 1,019 億美元，115 年達到 1,188 億美元。此外，受惠於 AI 人工智慧及及高效能運算之應用，各半導體晶圓積極發展先進製程，其中 EUV 機台為先進製程之關鍵生產環節，其屬中長期之產能規劃一環，較不受短期景氣循環波動影響。



資料來源：國際半導體產業協會(SEMI)

綜上所述，雖 112 年半導體設備廠受庫存修正及終端需求疲軟影響遭遇短暫逆風，但因 AI 人工智慧、5G 通訊、高效能運算及車用電子市場之長期需求看漲，使 113 年對半導體設備需求恢復成長趨勢。

2.影響該公司及其子公司未來發展之有利及不利因素及其相關因應措施

(1)有利因素

A.半導體產業需求持續暢旺

近年受 Covid-19 影響改變消費者生活及工作型態，亦促使全球企業積極推動數位轉型，使消費性電子、AI 人工智慧、5G 通訊及物聯網需求持續成長，此外，環保意識抬頭連帶刺激電動車市場之發展，而相關技術之發展對於大量資料處理及複雜運算能力要求增加，使的高效能運算市場需求湧現。全球在相關技術及產品的創新趨勢堆動下，使半導體需求結構性成長，除成熟製程晶片需求暢旺外，在對晶片高效能低功率要求下，使製程技術要求提升，連帶推動半導體設備升級以滿足先進製程需求。因此，伴隨人類對科技創新及便利生活之追求，持續提供半導體產業成長動能。

B.半導體設備供應鏈進入門檻高

半導體產業係一高度精密產業，對製程工序有高度要求且容錯率極低，為使各階段製程品質穩定，其所使用半導體設備有舉足輕重之影響。故各家半導體廠商對半導體設備之要求皆採嚴格控管，唯有通過認證之設備方可投入生產，惟通過認證需經相當時間溝通及技術驗證，一但成為其合格供應商不會輕易更動，將可拉開與其他供應商之競爭距離。而該公司及其子公司目前主要提供光罩儲存、清洗及交換設備，已成功進入多家知名半導體廠商供應鏈，其憑藉優異之技術能力及豐富之製造經驗，以及對於產品品質之穩定、交期及產能之配合度，取得客戶之信賴，奠定其競爭利基，有利於未來產品及服務持續拓展。

C.擁有高品質穩定之製造供應鏈

該公司及其子公司深耕半導體領域多年，隨著半導體進入先進製程，對生產之良率及污染容許度要求更加嚴格，故除持續精進自身產銷及研發能力外，為確保其產品品質、交期產能之穩定性，該公司及其子公司亦積極開發相關原物料供應商，並透過長期穩定之合作關係，提升各供應商提供之原物料之產品品質及良率，另藉由採購團隊對各供應商對原物料交期之積極掌握，降低其原物量管控成本，亦可避免原物料有斷貨或遲交之可能，建立穩定之原物料供應鏈。

(2)不利因素

A.專業人才取得與留任面臨挑戰

臺灣地緣風險提高，各國期盼半導體產業在地化，使全球爭奪半導體技術人才情形加劇，且面臨國內理工科畢業生逐年下滑，該公司及其子公司之規模及品牌能見度不及國內大型科技企業與國際大廠，此外由於該公司及其子公司生產據點位於南部，距離如竹科等半導體產業聚落較遠，人才招募上較為不易。

因應對策：

該公司及其子公司申請股票上櫃以提高企業知名度，吸引優秀人才；推行人性化管理制度，建立以績效導向之激勵機制並順暢升遷管道，同時，持續優化各項福利制度，致力創造愉快又有競爭力的工作環境，凝聚員工對公司的向心力，並增加員工留任率。

B.銷貨集中風險

隨著 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，各產業為提升自身競爭力，致力生產技術升級與生化自動化製造技術，故近年來半導體代工業者擴大先進製程與產能規模，帶動資本支出預算陸續增加。然半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡占的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致該公司及其子公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，且該公司考量整體營運規模，選擇優先滿足領導大廠資本支出需求，而出現銷貨集中之情事。

因應對策：

(1)技術延伸至新產品或新市場開發

該公司及其子公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用該公司及其子公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境設備需求與日俱增趨勢，該公司及其子公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

(2)鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，該公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，該公司及其子公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外該公司及其子公司與其長期合作的關係，且該公司及其子公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場

具領導地位，該公司及其子公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為該公司及其子公司帶來廣大的客戶效益，有助於該公司銷售策略之運用。

(3)積極開發其他客戶

該公司及其子公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。該公司及其子公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展該公司及其子公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

3.公司競爭利基

(1)產品取得客戶認證

半導體設備具有高技術門檻，且欲進入半導體廠商之合格供應體系，需花費相當時間之溝通及技術驗證方能取得認證。不過一但獲得採用，其他供應商將難以跨入。該公司及其子公司憑藉優異之技術能力及豐富之製造經驗，已成功打入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

(2)與客戶及供應商夥伴關係供應鏈關係良好

該公司及其子公司深耕半導體市場，與國內外半導體大廠已建立良好互信之合作夥伴關係，在產品開發設計之初，即完整掌握客戶需求，並充分討論溝通規格，以提供其最完善之技術方案。透過穩定之供應鏈關係，使該公司及其子公司業績可穩定成長。

(3)集團資源綜效

該公司及其子公司隸屬家登集團，承集團業務渠道、技術及專業人才支援，以及管理運營經驗等各資源共享之合作綜效，對於其業務與技術整合及專業管理團隊之建立有極大助益。殷實之專業管理團隊可極大化公司之業務策略推展及整合性解決方案效益，為公司長遠之營運規劃打下良好基礎。

(三)技術能力、研發及專利權之營運風險

1.取得技術專家之評估意見佐證。

本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司及其子公司之研發技術能力出具意見或報告，故不適用本項評估。

2.取得發行公司研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以瞭解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近三年度及申請年度截至最近期止研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對申請公司之營運風險。

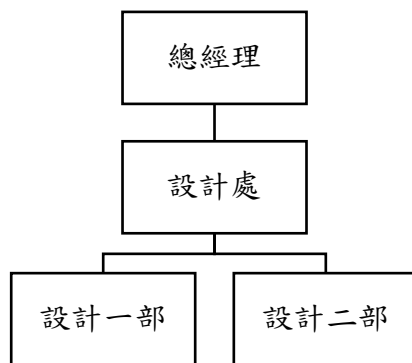
(1)研究發展部門之沿革及組織

該公司係於 105 年由母公司家登精密工業股份有限公司投資設立，主係從事半導體 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，包含光罩清洗、光罩交換、光罩檢查、光罩儲存、光罩管理等，為經營自有品牌的半導體設備製造商。

該公司過去已累積多年設備開發經驗，近年來，研發團隊更與半導體製造商客戶共同合作開發光罩先進製程應用機台，維持良好夥伴關係，在技術上也不斷精進自我領先同業，持續推廣光罩週邊設備應用，並將技術領域推升至自動光學檢測(AOI)及極紫外光微影製程(EUV)設備。該公司後續再於 109 年收購子公司昇和精技公司，將技術觸角延伸到物理氣相沉積(PVD)真空鍍膜相關機台設計及濺鍍設備改造。

該公司研發部門專指設計處，茲將該公司之研發部門組織架構及其工作職掌列示如下：

A.研發部門組織圖



資料來源：該公司及其子公司提供

B.研發部門職掌

研發部門	工作職掌
設計一部	<ul style="list-style-type: none"> ● 機台設計與異常排除 ● 機構設計
設計二部	<ul style="list-style-type: none"> ● 機台連結與整合 ● 電控程式開發 ● 應用工程 ● 軟體開發

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)最近三個會計年度及申請年度截至最近期止研發部門人員之人數、平均年資、學歷、流動情形及離職率

單位：人；年；%

項目		年度			
		110 年度	111 年度	112 年度	113 年度 截至 2 月底
期初研發人員合計		10	18	30	36
本期新增	新進人員	8	14	18	—
	轉進人員	—	—	—	—
本期減少	轉出人員	—	—	1	—
	資遣人員	—	1	—	—
	退休人員	—	—	—	—
	離職人員	—	1	11	—
期末研發人員合計		18	30	36	36
離職率(註 2)		—	6.25	23.40	—
平均服務年資		1.61	1.54	2.24	2.41
學歷分佈	博士	1	1	—	—
	碩士	7	10	13	13
	大學(專)	10	19	23	23
	高中以下	—	—	—	—

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：離職率=(離職人數+資遣及退休人員)/(期末人數+離職人數+資遣及退休人員)

註 2：該公司係於 109 年 12 月 31 日收購子公司昇和精技公司，昇和精技公司之員工服務年資自 109 年 12 月 31 日起算

該公司及其子公司 110~112 年度及 113 年截至 2 月底之研發人員分別為 18 人、30 人、36 人及 36 人，占員工總數之比率分別為 23.68%、30.93%、28.13% 及 28.35%。其中，碩士以上學歷之研發人員分別為 8 人、11 人、13 人及 13 人，占研發人員之比率分別為 44.44%、36.67%、36.11%及 36.11%，且多具備半導體、電機機械或自動化設備相關產業工作資歷，顯示該公司及其子公司對研發人員之素質相當重視。

在研發人員流動情形方面，110~112 年度及 113 年截至 2 月底之離職率分別為 0%、6.25%、23.40%及 0%，離職人員多為基層研發人員，離職原因主要係個人職涯規劃或家庭因素等。資遣及退休方面，該公司 110~112 年度及 113 年截至 2 月底止無退休人員；110~112 年度及 113 年截至 2 月底止資遣人數分別為 0 人、1 人、0 人及 0 人，係因工作績效未如預期，經勞資雙方充分溝通同意後，該公司依法向主管機關通報並依規定支付資遣費，並無損及資遣員工權益之情事。該等離職人員非重要管理職，並未掌握核心技術，且皆有妥善安排後續接任之人員交接，並持續招募新進人員，業務上之銜接亦無中斷情形，故尚不足以對該公司及其子公司研發計畫及進程造成顯著影響，研發部門人力尚屬穩定。

該公司及其子公司研發人員在職期間之相關研發成果屬該公司所有，且所有研發人員均有簽署保密條款，規範機密資訊之保密義務。為避免人員流動造成研發中斷風險，已訂定相關研發循環內控管理，對於研發過程完整保存記錄，對於研發成果申請智慧財產權保護。整體而言，研發人員之流動尚不至對該公司及其子公司研發部門之運作及公司整體營運產生重大之影響。

(3)最近三年度及申請年度截至最近期止研發費用

單位：新臺幣千元；%

	110 年度	111 年度	112 年度
研發費用	38,612	75,035	150,604
合併營業收入淨額	601,932	1,047,953	1,207,145
占當年度營收淨額比率(%)	6.41	7.16	12.48

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司 110~112 年度之研發費用分別為 38,612 千元、75,035 千元及 150,604 千元，占各年度營業收入淨額比例分別為 6.41%、7.16%及 12.48%。研發費用主要係研發人員薪資支出及折舊費用。110~112 年度之研發費用逐年增加，主要係因該公司及其子公司持續招募優秀人才，以及獲利成長產生相應獎勵，使薪資支出增加所致。顯示該公司及其子公司為維持產業競爭力，投入大量資源致力留任公司發展所需之人才積極培養研發團隊。綜上所述，該公司及其子公司研發費用占營業收入淨額比例之變動情形尚屬合理，尚無重大異常情事。

(4)重要研發成果

茲將最近五個會計年度截至本評估報告出具日止，該公司及其子公司之重要研發成果彙總列示如下：

年度	研發成果
107 年	光罩儲存管理設備
108 年	高階光罩潔淨設備、光罩交換設備
109 年	EUV 微環境充氣倉儲
110 年	EUV 光罩智慧檢測設備、EUV 光罩高潔淨技術、EUV 光罩傳送驛站
111 年	EUV 光罩交換與長期儲存方案、EUV 倉儲整合自動化系統
112 年	新一代 EUV 光罩載具檢測機台

資料來源：該公司及其子公司提供

3.主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司及其子公司主係提供半導體 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，包含光罩清洗、光罩交換、光罩檢查、光罩儲存、光罩管理等，主要核心技術來自於內部專業研發技術團隊，研發部門人員累積長期開發設備產品經驗，深耕產業多年，建立自有核心技術，並藉由配合客戶需求，由研發團隊與國際知名大廠密切合作開發，進而創造研發動能，提升產品技術層次與服務品質；此外，該公司及其子公司除掌握有自有技術來源外，必要時亦與大專院校產學合作及與技術顧問進行技術開發計畫，直接或間接提升公司技術能力。該公司及其子公司每年均持續投入研發資源，進行專案規劃及新產品開發，及長期累積豐富的實務經驗。該公司及其子公司截至評估報告出具日止，尚屬技術開發階段，故尚無支付權利金之情事，茲將相關技術契約列示如下：

合作對象	契約起訖日期	主要內容	技術報酬金或權利金之支付方式
學校	112/05/01~113/04/30	技術開發	依合約
技術顧問	110/04/08~ 雙方義務履行完成	技術開發	依合約

資料來源：該公司及其子公司提供

上述技術合約內容，對該公司並無重大限制條款，而相關技術開發完成後，對提昇該公司開發能力具正面助益，並將對未來營運成長有所幫助，並可增加公司之營收及獲利。

4.研發工作未來發展方向

該公司及其子公司持續投入 EUV 光罩製程、高階光罩製程相關設備及關鍵零組件之研發，精進製程培養穩定之研發團隊及技術。未來投入之研發費用將視營運狀況逐年提升。

(1)短期研發方向

A.EUV 相關機台開發

EUV 設備為當今半導體產業先進製程的主流方向，發展 EUV 設備有利於提高整體行業的競爭力及產品市場，短期內該公司將配合客戶需求，開發及優化 EUV 光罩交換機、智慧光罩儲存櫃及 EIP 檢查機等設備。依照客戶需求開發新功能，一方面提高機台穩定度，另一方面確保客戶在製程上有更好的良率與效率。

B.光罩 AOI 相關機台開發

光罩 AOI 設備用於取代人工檢測光罩上殘留的微小粒子，以及光罩中的缺陷和異常，並提高其準確性和一致性，提供資訊以判斷進行修復或替換。短期內該公司將開發符合客戶需求規格的光罩 AOI 檢查機，並不斷提升機台的穩定度及檢驗能力，確保提供客戶更準確的檢驗結果。

(2)中期研發方向

A.光罩 AOI 與清洗機結合

該公司將結合內部已有穩定技術的光罩清洗機，以及新開發的 AOI 檢查機，在清洗後可立即驗證清洗結果，並進行參數結果，減少清洗後送到其他機台檢驗來回搬運的時程，並降低因前述作業，來回搬運過程中對光罩造成的風險。

B.光罩 AOI 與交換機結合

該公司將結合內部已有穩定技術的光罩交換機，以及新開發的 AOI 檢查機，可在每次載具交換過程中，對光罩進行檢測，當發現重大瑕疵可立即提供資訊以判斷進行修復或替換，大幅降低客戶使用瑕疵光罩的機率。

(3)長期研發方向

A.發展光罩 AOI 檢測能力

隨著半導體產業的應用，對光罩精度要求越來越高，為了檢出極小的缺陷，將使用非可見光源的 AOI 檢測方式，搭配矩陣運算得到更精確的結果。該公司將發展更加高效及智能化的光罩 AOI 檢查機，持續提高檢測的精度和速度，並強化針對缺陷的計算及分類的能力。

5.目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形

該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度，並無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事。茲將該公司及其子公司已取得或申請中之專利權及商標權列示如下：

(1) 專利權

A. 已取得

項次	專利名稱	專利號	權利期間	註冊地
1	光罩清洗裝置	I317149	2009/11/11~2026/08/14	中華民國
2	Photomask cleaner	US20080041429A1	2010/03/09~2028/08/21	美國
3	充氣設備	I379171	2012/12/11~2027/12/26	中華民國
4	Gas filling apparatus	US8286672B2	2012/10/16~2031/05/22	美國
5	氣體充填承座、氣體充填承座組，及氣體充填設備	I357474	2012/02/01~2028/10/13	中華民國
6	光罩清洗方法及其系統	I452423	2014/09/11~2032/11/18	中華民國
7	Method and system for cleaning photomasks	US20140137890A1	2016/12/13~2034/06/29	美國
8	Method and system for cleaning photomask	10-1436125-0000	2014/09/01~2033/04/16	南韓
9	氣閥結構及應用彼之充氣座	I563198	2016/12/21~2033/04/11	中華民國
10	氣壓閥件結構及應用彼之充氣座以及充氣櫃	I551799	2016/10/01~2033/08/22	中華民國
11	晶圓輸送系統及其運作方法	I536489	2016/06/01~2034/05/22	中華民國
12	Wafer transport system and method for operating the same	US9786535B2	2017/10/10~2036/01/20	美國
13	密封元件	M506908	2015/08/11~2025/01/22	中華民國
14	半導體容器清洗機的運作方法	I544973	2016/08/11~2035/03/19	中華民國
15	Operating methods of purge devices for containers	US9543176B2	2017/01/10~2035/07/29	美國
16	Operating methods of purge devices for containers	10201505659V	2016/10/28~2035/07/21	新加坡
17	針孔式噴嘴清潔設備及其運作方法	I580488	2017/05/01~2035/04/06	中華民國
18	Purge devices having micronozzles and operating methods thereof	US20160300735A1	2016/10/13~2035/11/04	美國
19	Purge devices having micronozzles and operating methods thereof	10201503808R	2016/11/29~2035/05/14	新加坡
20	Thin substrate pitch measurement equipment	US7663129B1	2010/02/16~2028/09/30	美國
21	Gas filling apparatus and gas filling port thereof	US7694498B2	2010/04/13~2028/12/18	美國
22	Gas filling apparatus	US8286674B2	2012/10/16~2031/08/12	美國
23	Temperature and humidity measuring device deployed on substrate	US8413505B2	2013/04/09~2031/08/15	美國
24	Wafer box conveyor	US8657310B2	2014/02/25~2032/07/18	美國
25	Photomask cleaning device	US8973199B2	2015/03/10~2033/09/05	美國

項次	專利名稱	專利號	權利期間	註冊地
26	Air-blown cleaning system for photomasks and method thereof	US9296023B2	2016/03/29~2034/11/30	美國
27	充氣設備	CN101587823A	2012/04/18~2028/05/21	中國大陸
28	光罩清洗設備	M623801	2022/02/21~2031/11/17	中華民國
29	光掩膜清洗設備	CN216622955U	2022/05/27~2031/12/21	中國大陸
30	智能控制流量的充氣承座	M636444	2023/01/11~2032/08/24	中華民國
31	一體式充氣盤面	M637910	2023/02/21~2032/08/24	中華民國
32	晶圓載具的充氣盤面	M636554	2023/01/11~2032/09/25	中華民國
33	光罩載具的充氣承盤	M641070	2023/05/11~2033/01/17	中華民國
34	具有吸塵功能的光罩清潔裝置	M643993	2023/07/21~2032/12/11	中華民國
35	光罩盒次元件的檢測裝置	M644099	2023/07/21~2033/03/02	中華民國
36	光罩盒表面的光學檢查裝置	M644100	2023/07/21~2033/03/02	中華民國
37	光罩盒表面高速檢查系統	M644101	2023/07/21~2033/03/02	中華民國
38	降低粉塵污染的光罩內盒承載裝置及光罩內盒的光學檢查設備	M644162	2023/07/21~2033/03/29	中華民國
39	抽屜更換式清潔設備	I813073	2023/08/21~2041/11/17	中華民國
40	抽屜更換式清潔設備	CN216728381U	2022/06/14~2031/12/21	中國大陸
41	光罩內盒的夾持具	I819840	2023/10/21~2042/10/10	中華民國

資料來源：該公司及其子公司提供

註：第 1~27 項專利權為家登精密工業股份有限公司於 106 年讓與該公司

B. 申請中

項次	專利名稱	申請號	申請日期	註冊地
1	光罩盒次元件的檢測裝置	112107863	2023/03/03	中華民國
2	光罩盒表面的光學檢查裝置及光罩盒表面的光學檢查方法	112107864	2023/03/03	中華民國
3	光罩盒表面高速檢查系統以及光罩盒表面高速檢查方法	112107865	2023/03/03	中華民國
4	降低粉塵污染的光罩內盒承載裝置及光罩內盒的光學檢查設備	112112233	2023/03/30	中華民國
5	用於光罩傳送盒承載平台之除塵裝置	112125799	2023/07/11	中華民國
6	高潔淨度的光罩夾取模組	112146629	2023/11/30	中華民國
7	可消除影像雜訊的光學檢測系統	112148097	2023/12/11	中華民國
8	光罩夾取模組	112148765	2023/12/14	中華民國
9	抽屜更換式清潔設備	17/989,709	2022/11/18	美國
10	用於檢測光罩內盒的夾取機構	18/079,899	2022/12/13	美國

項次	專利名稱	申請號	申請日期	註冊地
11	量測光罩載具之溫濕度的治具	18/091,398	2022/12/30	美國
12	光罩內盒的夾持具	18/091,411	2022/12/30	美國
13	自動量測光罩載具之流量的治具	18/091,413	2022/12/30	美國
14	光罩盒表面高速檢查系統以及光罩盒表面高速檢查方法	18/319,508	2023/05/18	美國
15	光罩盒表面的光學檢查裝置及光罩盒表面的光學檢查方法	18/319,510	2023/05/18	美國
16	降低粉塵污染的光罩內盒承載裝置及光罩內盒的光學檢查設備	18/321,799	2023/05/23	美國
17	光罩盒次元件的檢測裝置	18/319,512	2023/05/18	美國
18	抽屜更換式清潔設備	202111574982.1	2021/12/21	中國大陸

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)商標權

A.已取得

項次	商標名稱及圖	商標註冊號	商標權利期間	註冊地
1		02356757	2024/02/01~2034/01/31	中華民國
2	家碩科技	02356758	2024/02/01~2034/01/31	中華民國

資料來源：該公司及其子公司提供

B.申請中：無。

(3)著作權：無。

6.重要技術合作契約對發行公司之營運風險。

該公司及其子公司產品技術主要是依據客戶需求自行開發及改良，截至評估報告刊印日止，與他人簽訂技術合作契約，除大專院校產學合作外，主要係半導體新應用相關設備的共同技術開發協議，其契約內容並無重大不利限制條款，故對該公司及其子公司營運尚無不利之影響。

7.以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計畫，以及生產開發技術之層次、來源等資料，以評估市場定

位、需求及研究發展之內部控制暨保全措施。

該公司非以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃，故不適用本項評估。

- 8.以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得參與經營決策之董事、持股超過股份總額百分之五之股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三年度及申請年度內股權移轉變化暨實際投入經營之時間與情形等，以評估該等人員未來若未能繼續參與經營對申請公司之營運風險，及其因應之措施。

該公司非以科技事業、文化創意事業、依「淨值、營業收入及營業活動現金流量」標準或資訊軟體業申請股票上櫃，故不適用本項評估。

(四)人力資源之營運風險

- 1.員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資變動情形

單位：人；年；歲

年度		年度			
		110 年度	111 年度	112 年度	113 年截至 2 月底
人數	期初人員	64	76	97	128
	新進人員	16	28	51	1
	離職人員	4	5	19	2
	資遣人員	—	2	1	—
	退休人員	—	—	—	—
期末 人數	主管級人員	9	11	11	11
	直接人員	25	26	33	34
	間接人員	42	60	84	82
	合計	76	97	128	127
平均服務年資(年)		3.01	3.09	3.01	3.14
平均年齡(歲)		40.48	40.41	40.25	40.33

資料來源：該公司及其子公司提供

註：該公司係於 109 年 12 月 31 日收購子公司昇和精技公司，昇和精技公司之員工服務年資自 109 年 12 月 31 日起算

2.離職率之變化情形

單位：人；%

年度 人數	110 年度			111 年度			112 年度			113 年截至 2 月底		
	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)	期末 人數	離職 人數	離職 率(%)
主管級 人員	9	1	10.00	11	1	8.33	11	2	15.38	11	—	—
直接 人員	25	—	—	26	1	3.70	33	3	8.33	34	—	—
間接 人員	42	3	6.67	60	5	7.69	84	15	15.15	82	2	2.38
合計	76	4	5.00	97	7	6.73	128	20	13.51	127	2	1.55

資料來源：該公司及其子公司提供

註：離職率=離職人數(含資遣及退休)/(期末人數+離職人數(含資遣及退休))

3.員工人數及離職率變化情形之說明

該公司及其子公司 110~112 年度及 113 年 2 月底期末人數分別為 76 人、97 人、128 人及 127 人，110~112 年度人數逐年增加，主要係因應營運規模拓展增加員工人數所致，113 年截至 2 月底員工人數則與 112 年度約當。該公司員工平均年齡為 40.25 歲~40.48 歲，顯示該公司及其子公司員工主要為青壯年人口；在員工服務年資方面，該公司員工平均服務年資約 3.01 年~3.14 年，人力資源為該公司之競爭利基，該公司注重員工的培訓及長期經驗累積，提供完善之福利及專業在職訓練。

該公司 110~112 年度及 113 年截至 2 月底總離職人數(含資遣及退休)分別為 4 人、7 人、20 人及 2 人，離職率分別為 5.00%、6.73%、13.51%及 1.55%，其離職率除 113 年截至 2 月底較 112 年度下降外，111 及 112 年度呈上升趨勢，離職人員以間接人員居多、直接人員居次、少數為公司之主管級人員。經詢問公司管理階層，直接及間接人員資遣原因係因員工無法勝任工作，離職原因則多為個人生涯規劃、健康與家庭因素所致，考量該等人員其職務替代性高，該公司及其子公司藉由人員調配或即時招募適任人員，故於人員交接及訓練上尚無困難；經理人員離職原因主要為個人生涯規劃考量，其工作職掌交接均按相關程序辦理，且其管理階層人員尚屬穩定，該公司及其子公司已適時藉由內部組織調整及向外招募適任人員遞補之，對該公司及其子公司營運不致造成重大影響。

整體而言，該公司人員流動原因尚無重大異常，且藉由完善激勵制度，提升員工之工作向心力，並推動申請股票上櫃事宜，藉以吸引更多優秀人才加入公司營運團隊。該公司除持續招募業界菁英外，離職人員其工作交接亦均按照相關程序辦理，故對該公司營運尚不致產生重大影響。

4.員工學歷分析

單位：人；%

年度 人數	110 年度		111 年度		112 年度		113 年截至 2 月底	
	人數	比例(%)	人數	比例(%)	人數	比例(%)	人數	比例(%)
博士	2	2.63	2	2.06	1	0.78	1	0.79
碩士	16	21.05	18	18.56	34	26.56	35	27.55
大學(專)	57	75.00	76	78.35	92	71.88	90	70.87
高中(職) 及以下	1	1.32	1	1.03	1	0.78	1	0.79
合計	76	100.00	97	100.00	128	100.00	127	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司之員工學歷狀況自 110~112 年度及 113 年截至 2 月底，大學(專)以上學歷之員工占該公司及其子公司全體員工比例分別為 98.68%、98.97%、99.22%及 99.21%，因公司從事光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售等業務，係屬技術密集的產業，故以大學(專)以上學歷員工所占比例較高，達 90%以上。該公司及其子公司因應不同工作性質之需求，招募適任學歷之員工，並有效利用各種學歷員工之專業與技能，有助於強化企業管理，且高階幹部與研發人員以大學(專)以上學歷為主，故整體人員素質尚屬良好，應有助於增強該公司及其子公司經營實力與競爭力。

(五)各主要產品之成本分析

1.最近期及最近三個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素之比率變化對發行公司營運之風險

單位：新臺幣千元；%

產品 名稱	類別	110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關 機器設備	原物料	200,748	83.96	305,648	85.50	244,820	92.51
	直接人工	24,104	10.08	28,015	7.84	15,160	5.73
	製造費用	14,248	5.96	23,830	6.66	4,650	1.76
	合計	239,100	100.00	357,493	100.00	264,630	100.00
高階 光罩相關 機器設備	原物料	74,997	73.31	159,124	80.11	259,967	82.19
	直接人工	13,551	13.25	21,611	10.88	32,163	10.17
	製造費用	13,746	13.44	17,908	9.01	24,182	7.64
	合計	102,294	100.00	198,643	100.00	316,312	100.00
其他	原物料	36,086	81.01	35,480	86.67	35,729	87.86
	直接人工	2,406	5.40	639	1.56	1,428	3.51
	製造費用	6,052	13.59	4,819	11.77	3,508	8.63
	合計	44,544	100.00	40,938	100.00	40,665	100.00

產品名稱	類別	110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
合計	原物料	311,831	80.80	500,252	83.78	540,516	86.96
	直接人工	40,061	10.38	50,265	8.42	48,751	7.84
	製造費用	34,046	8.82	46,557	7.80	32,340	5.20
	合計	385,938	100.00	597,074	100.00	621,607	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司主要從事光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。整體產品成本結構以原物料占比最高，直接人工及製造費用比重則依客戶產品需求規格及功能差異消長，茲就各年度主要產品之原料、直接人工及製造費用比例變化情形說明如下：

(1) EUV 光罩相關機器設備

該公司及其子公司 110~112 年度 EUV 光罩相關設備之原物料占該產品比重分別為 83.96%、85.50%及 92.51%，原物料占比之波動主要受直接人工及製造費用消長影響，其占比逐年增加，主係因該公司前期對 EUV 光罩相關機器設備仍在發展階段，投入之生產工時及製造費用等學習成本較高，後續隨業績逐步成長，生產流程日趨成熟，其生產效率提升，使直接人工及製造費用占比下降，整體原物料比重逐年增加；直接人工占該產品比重分別為 10.08%、7.84%及 5.73%，111 年度及 112 年度直接人工占比下降主係因該公司及其子公司對於 EUV 光罩相關設備之生產製程進入成熟期，其生產效率提升，使直接人工占比下降；製造費用占該產品比重分別為 5.96%、6.66%及 3.21%，其中 111 年度之製造費用占比增加，主係因本年度銷售之大型 EUV 光罩相關機器設備較多，因其體積較大使相關吊掛、包裝及運送等相關製造費用增加，另該年度有外銷一台全自動 EIP 表面檢查機，此機台需至美國協助安裝，相關差旅費用支出增加，致製造費用比重上升，112 年度之製造費用占比下降，主係該年度銷售之小型 EUV 光罩相關機器設備體數量較多，其相關之吊掛、包裝及運送等費用較低，使製造費用占比下降。

(2) 高階光罩相關機器設備

該公司及其子公司 110~112 年度高階光罩相關機器設備之成本結構中，以原物料所占比例最高，分別占銷貨成本之 73.31%、80.11%及 82.19%，其中 110 年之原物料占比偏低，主係因該年度銷售之小型高階儲存設備數量較多，其原物料占比相對大型高階儲存設備低，使 110 年度原物料占比較低，111 年度及 112 年度原物料占比增加，主係因高階光罩相關機器設備初期仍在開發階段，投入之生產工時及製造費用等學習成本較高，後續隨業績逐步成長，生產流程日趨成熟，其生產效率提升，使直接人工及製造費用占比下降，整體原物料比重增加；

直接人工占該產品比重分別為 13.25%、10.88%及 10.17%，其中 110 年度之直接人工占比較高主係因該年度銷售之大型光罩相關機器設備數量占比較高，其直接人工支出相較小型光罩相關機器設備為多，而 111 年度及 112 年度直接人工下降主係因高階光罩相關機器設備生產流程日趨成熟，其生產效率提升，且 111 年度及 112 年度小型光罩相關機器設備數量銷售數量較多，其直接人工支出較小型光罩相關機器設備少，使直接人工占比下降；製造費用占該產品比重分別為 13.44%、9.01%及 7.64%，其中 111 年度及 112 年度製造費用下降，主係因其銷售小型高階光罩相關機器設備體數量較多，其相關之吊掛、包裝及運送等費用較低，使製造費用占比下降。

(3)其他

該公司及其子公司其他類產品主要為機台客製化改造、機台維修及機台設備零組件買賣等，110~112 年度其他項之成本分別為 44,544 千元、40,938 千元及 40,665 千元。其中因該公司於 109 年底收購子公司昇和精技公司新增 PVD 機台改造服務，致使其自 110 年度起成本大幅增加，而其原物料、直接人工及製造費用比重之變化則受不同銷貨客戶出貨比重及不同產品項目變化影響。

整體而言，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之原料、直接人工及製造費用比率之變化尚屬合理，無重大異常之情事。

2.建設公司申請股票上櫃者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，公司與地主之分配比率是否合理。

該公司及其子公司非屬建設公司申請股票上櫃者，故不適用本項評估。

(六)匯率變動情形

1.最近三年度及申請年度截至最近期止兌換損益占營業利益之比率及內外銷、內外購比率以評估匯率變動對申請公司營運之風險

(1)內外銷之金額及其比率

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	比率%	金額	比率%	金額	比率%
內銷		527,932	87.71	852,374	81.34	879,304	72.84
外銷	美洲	24,691	4.10	72,281	6.90	159,961	13.25
	亞洲	46,549	7.73	101,841	9.72	117,131	9.70
	歐洲	2,760	0.46	21,457	2.04	50,749	4.21
	小計	74,000	12.29	195,579	18.66	327,841	27.16
合計		601,932	100.00	1,047,953	100.00	1,207,145	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

(2) 內外購之金額及其比率

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度		110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	比率%	金額	比率%	金額	比率%
內購	新臺幣	507,129	99.85	679,274	99.56	533,307	99.91
	美元	66	0.01	—	—	—	—
	日幣	—	—	1,472	0.21	—	—
	小計	507,195	99.86	680,746	99.77	533,307	99.91
外購	日幣	362	0.07	1,038	0.15	125	0.02
	美元	—	—	—	—	55	0.01
	歐元	357	0.07	519	0.08	286	0.06
	小計	719	0.14	1,557	0.23	466	0.09
合計		507,914	100.00	682,303	100.00	533,773	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，其中主要包括應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。該公司及其子公司銷售對象主係以國內外知名半導體大廠為主，內銷交易約占整體營收 7~8 成，其外銷市場則包含亞洲、歐洲及美洲地區，外銷交易計價幣別係以美元為主；在採購方面，該公司及其子公司採購對象多以臺灣供應商為主，內購交易占整體進貨約 9 成，付款幣別以新臺幣為主，其他付款幣別包含美元、歐元及日幣等。該公司及其子公司應收及應付外幣款項相互沖抵下，會產生一定之自然避險效果，然因外幣收入大於外幣支出，無法互抵之外幣應收款項在轉換成新臺幣時，仍會因持有外幣淨資產部位產生匯兌損益，惟該公司及其子公司隨時注意市場匯率之變化，參酌往來銀行所提供之匯率變動趨勢資訊，掌握最新之匯率變動資訊，適時進行外匯部位調節暨管理，降低匯率變動對公司損益造成之影響。

(3) 兌換損益占營業利益之比率

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	年度		
	110 年度	111 年度	112 年度
兌換利益(損失)淨額(A)	(1,747)	11,777	5,735
營業收入淨額(B)	601,932	1,047,953	1,207,145
營業利益(C)	113,203	242,329	260,034
占營業收入之比率(A)/(B)(%)	(0.29)	1.12	0.48
占營業利益之比率(A)/(C)(%)	(1.54)	4.86	2.21

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司 110~112 年度之兌換利益(損失)淨額分別為(1,747)千元、11,777 千元及 5,735 千元，占營業收入之比率分別為(0.29)%、1.12%及 0.48%，占營業利益之比率分別為(1.54)%、4.86%及 2.21%，該公司及其子公司產生之兌換損益主要係外幣進銷貨所產生，資產負債互抵後，期末以美元產生之外幣淨資產部位較大，故兌換損益主係受美元兌新臺幣匯率變動所影響。

110 年度美元持續弱勢但波動幅度不大，故產生匯兌損失(1,747)千元；111 及 112 年度由於美國實施貨幣緊縮政策，以及美國持續升息，使得美元兌新臺幣大幅升值致分別產生匯兌利益 11,777 千元及 5,735 千元。

綜上所述，該公司及其子公司兌換損益之變化情形與匯率變動趨勢尚屬合理，且對該公司合併營業收入淨額及營業利益尚無重大影響，因此該公司將更積極注意市場變動，蒐集相關外匯市場訊息，以掌握匯率之變動。

2. 因應匯率變動之具體措施

該公司目前營運受匯率波動之影響有限，惟因應匯率變動所產生之經營風險，該公司管理當局除平日積極蒐集匯率相關資訊，以隨時掌握匯率變動趨勢外，並採取以下措施以降低匯率變動而可能產生之損失：

- (1) 該公司及其子公司之匯率風險控管以自然避險為主要策略，對於進、銷貨之交易均有部分比重以外幣計價，其整體對於匯率變動之影響可達到部分應收及應付相互平衡之效果，並適時調整外幣資產與負債之部位以降低匯率變動之風險。
- (2) 財務單位隨時蒐集匯率變化訊息，與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充分掌握國際間匯率走勢及變化訊息，並視實際資金需求及匯率高低情況於適當時機買賣外幣存款，以降低匯率波動對公司獲利之衝擊。
- (3) 依股東會決議通過之「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性金融商品相關作業程序，必要時得視外幣部位及匯率變動情形依該程序執行，以降低該公司業務經營所產生之匯率風險。

四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

參、業務狀況

一、營業概況

(一)申請公司最近三年度及申請年度截至最近期主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析

1.最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象、價格及條件之變化原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述申請公司之銷售政策。

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新臺幣千元；%

排名	110 年度				111 年度				112 年度			
	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係
1	A 集團	407,577	67.71	無	B 集團	461,443	44.03	無	B 集團	393,741	32.62	無
2	B 集團	58,679	9.75	無	A 集團	258,304	24.65	無	A 集團	277,381	22.98	無
3	J 公司	45,310	7.53	無	G 集團	105,358	10.05	無	G 集團	260,897	21.61	無
4	K 集團	26,506	4.40	無	J 公司	51,620	4.93	無	K 集團	67,296	5.57	無
5	G 集團	22,695	3.77	無	M 集團	49,002	4.68	無	H 公司	48,216	3.99	無
6	E 集團	11,060	1.84	無	K 集團	22,561	2.15	無	F 集團	38,690	3.20	無
7	F 集團	6,439	1.07	無	N 集團	17,662	1.69	無	J 公司	35,224	2.92	無
8	L 公司	5,439	0.90	無	O 公司	15,769	1.50	無	P 公司	20,980	1.74	無
9	M 集團	4,772	0.79	無	D 集團	14,852	1.42	無	O 公司	17,576	1.46	無
10	Brooks 集團	2,733	0.45	無	L 公司	11,997	1.14	無	E 集團	16,037	1.33	無
	小計	591,210	98.21	—	小計	1,008,568	96.24	—	小計	1,176,038	97.42	—
	其他	10,722	1.79		其他	39,385	3.76		其他	31,107	2.58	
	合計	601,932	100.00		合計	1,047,953	100.00		合計	1,207,145	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)主要銷售對象、價格及條件變化原因並分析是否合理

該公司及其子公司主要從事光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。110~112 年度之營業收入淨額分別為 601,932 千元、1,047,953 千元及 1,207,145 千元，呈現逐年成長趨勢，主係該公司及其子公司積極維繫與客戶穩定合作之關係，並於近年來開發新產品應用以及拓展新客戶所致。茲將該公司及其子公司之前十大銷售對象之變化情形說明如下：

A.A 集團

A 集團成立於民國 76 年，總部位於臺灣新竹市，為全球最主要之專業積體電路製造服務公司，主要產品為先進製程之邏輯積體電路(Logic IC)及特定應用積體電路(ASIC)，其產品廣泛應用於各個終端市場，包含高效能運算、智慧型手機、物聯網車用電子與消費性電子產品等領域。該公司及其子公司與 A 集團交易始於 105 年。

該公司及其子公司對 A 集團主要銷售產品為 EUV 及高階光罩儲存櫃、清洗機等功能性設備、機器設備相關耗材及維修服務等。110~112 年度對其銷售金額分別為 407,577 千元、258,304 千元及 277,381 千元，銷售比重分別為 67.71%、24.65%及 22.98%。雖過去隨著疫情造成的區域封鎖、區域衝突及地緣政治的緊張局勢，嚴重擾亂了全球供應鏈，惟來自 5G、高效能運算(HPC)和人工智慧(AI)等相關應用產業之發展趨勢，仍使得長期半導體需求結構呈現持續增長；A 集團在配合其客戶長期需求之情況下，持續規劃產能及全球生產版圖，並由該公司及其子公司負責提供其所需之設備，故 A 集團最近三年度均為該公司及其子公司之前三大銷售客戶，另自 110 年度起 A 集團為縮短裝機時程及提高設備生產效率，部分廠區設備委託 B 集團進行下單並規劃，故相關設備訂單係轉由 B 集團下單，致該公司及其子公司對 A 集團之直接銷售金額減少，經評估其變化尚屬合理。

B.B 集團

B 集團成立於民國 26 年，總部位於日本大阪，於民國 73 年即深耕臺灣。B 集團為自動搬運系統產業界之領導廠商，主要生產高科技產業無塵室之自動化倉儲運送機械設備，如工廠自動化物流搬送系統、無塵室工廠自動化系統等，從開發、製造到提供全系列符合任何需求的自動化與物流解決方案與服務。該公司及其子公司與 B 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 B 集團主要銷售產品為光罩充氣儲存櫃及設備盤面模組。110~112 年度對其銷售金額分別為 58,679 千元、461,443 千元及 393,741

千元，銷售比重分別為 9.75%、44.03%及 32.62%。該公司及其子公司最近三年度對 B 集團銷售金額呈現逐年上升，主係自 110 年度起，A 集團為縮短裝機時程及提高設備生產效率，將部分廠區設備之規劃委由 B 集團統籌，故該公司及其子公司對 B 集團之銷售金額顯著增加。目前該公司及其子公司對 B 集團所銷售之設備主係皆為 A 所需，致 B 集團最近三年度皆為該公司及其子公司之前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

C. J 公司

J 公司成立於民國 94 年，位於臺灣臺南市，主要經營半導體及顯示器相關設備及材料之製造及銷售，包含 FPD 顯示技術相關設備及半導體顯示設備之技術服務，為該公司於 109 年 12 月 31 日收購 100%子公司昇和精技公司之原主要客戶，故該公司及其子公司與 J 公司交易始於 110 年。

該公司及其子公司 110~111 年度對 J 公司銷售金額上升，主係因該公司及其子公司對於 PVD 真空設備之設計與改造擁有多多年經驗，並可提供客戶客製化之設備關鍵技術及材料更新及改造，惟 112 年度受景氣影響，客戶需求下降使銷售金額微幅下降，然該公司及其子公司持續獲得 J 公司之訂單挹注並為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

D. K 集團

K 集團成立於民國 69 年，總部位於臺灣新竹市，主要經營積體電路及半導體相關零組件，包含邏輯/混合信號、嵌入式高壓解決方案及嵌入式非揮發性記憶體等。該公司及其子公司與 K 集團交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 K 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及機器設備相關耗材等。110~112 年度對其銷售金額分別為 26,506 千元、22,561 千元及 67,296 千元，銷售比重分別為 4.40%、2.15%及 5.57%。K 集團為貼近市場並滿足中國在地之 IC 設計業者需求，於中國地區擴建晶圓廠，故對該公司及其子公司光罩半導體相關設備需求增加，另因 112 年度仍持續擴充廠區產能，故使 K 集團 110~112 年度皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

E. G 集團

G 集團成立於民國 57 年，總部位於美國加利福尼亞州，主要經營業務為中央處理器(CPU)、伺服器及其相關解決方案之設計、製造、銷售及服務，產品應用包含邊緣計算、5G、雲端服務、AI 和自動駕駛等新興領域。該公司及其子公司與 G 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 G 集團主要銷售產品為高階光罩儲存櫃、全自動 EIP 表面檢查機及其他小型設備輔助器具等。110~112 年度對其銷售金額分別為

22,695 千元、105,358 千元及 260,897 千元，銷售比重分別為 3.77%、10.05% 及 21.61%。該公司及其子公司對 G 集團銷售金額呈現逐年上升的趨勢，主係因 G 集團分別於美國及歐盟地區興建半導體晶圓廠，並投入研發、設計及製造，使對半導體設備需求增加。因該公司及其子公司為 G 集團開發客製化機器設備，機器設備之妥善率受到 G 集團肯定，故該公司及其子公司持續獲得訂單挹注，使 G 集團 110~112 年度皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

F. E 集團

E 集團成立於民國 89 年，總部位於中國上海市，為中國境內主要的積體電路晶圓代工廠之一，主要經營業務為 8 吋及 12 吋晶圓代工與技術服務，其產品應用於智慧型手機、智能家電及消費性電子等領域。該公司及其子公司與 E 集團交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 E 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機、機台改造及設備相關耗材等。110~112 年度對其銷售金額分別為 11,060 千元、4,168 千元及 16,037 千元，銷售比重分別為 1.84%、0.40%及 1.33%。為因應全球對於半導體需求大增，且中國政府持續支持半導體產業發展，110~112 年度 E 集團持續擴充產能及對各廠產品製程優化，對半導體機台設備需求增加，故 110 及 112 年度成為銷貨前十大客戶；111 年度之銷售產品主係設備改造及相關耗材，故使得該公司及其子公司對其營業收入下降並未列入銷貨前十大之列，經評估其變化尚屬合理。

G. F 集團

F 集團成立於民國 67 年，總部位於美國愛達荷州，為全球記憶體解決方案之領導廠商，主要經營業務為記憶體及儲存裝置之設計、開發及製造等，包含動態隨機存取存儲器(DRAM)、NAND 快閃記憶體、NOR 快閃記憶體及儲存產品等。該公司及其子公司與 F 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 F 集團主要銷售產品為 EUV 及高階光罩儲存櫃、光罩清洗機、設備維護服務及機器設備相關耗材等。110~112 年度對其銷售金額分別為 6,439 千元、5,816 千元及 38,690 千元，銷售比重分別為 1.07%、0.55% 及 3.20%。隨各家 DRAM 廠將製程推進至 EUV 製程，為因應技術升級及擴增無塵室空間，F 集團擴建臺中晶圓廠，隨製程演進對於半導體設備需求大幅增加，故分別於 110 及 112 年度向該公司及其子公司採購光罩相關半導體設備，故 110 及 112 年度成為銷貨前十大客戶；111 年度主要交易產品為小型半導體相關機器設備、設備維護服務及機器設備相關零組件等，故使得該公司及其子公司對其營業收入下降並未列入前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

H. L 公司

L 公司成立於民國 104 年，位於安徽省合肥市，主要經營晶圓代工服務，包含液晶面板、手機等消費電子相關之晶片，該公司及其子公司與 L 公司交易始於 107 年。

該公司及其子公司對 L 公司主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃等。110~112 年度對其銷售金額分別為 5,439 千元、11,997 千元及 454 千元，銷售比重分別為 0.90%、1.14%及 0.04%。該公司及其子公司於 110~111 年度對 L 公司銷售金額上升，主係因 L 公司關注面板驅動晶片相關產品布局，且為因應半導體產業持續擴張，故 L 公司持續積極擴充產能，並於 110 年進行晶圓廠擴廠，晶圓廠設備陸續進機安裝，故對於該公司及其子公司光罩相關半導體設備需求也隨之增加，使 L 公司 110~111 年度皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，然隨 L 公司擴廠逐漸完工，使得該公司及其子公司對其營業收入下降並退出銷貨前十大之列，經評估其變化尚屬合理。

I. M 集團

M 集團成立於民國 24 年，為日本代表性機械設備商之一，主要從事纖維機械、工作機械、板金加工機械、自動化物流系統、無塵室搬送系統相關設備之銷售及售後服務。該公司及其子公司與 M 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 M 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及設備封板壓條模組等。110~112 年度對其銷售金額分別為 4,772 千元、49,002 千元及 6,463 千元，銷售比重分別為 0.79%、4.68%及 0.54%。110~111 年度該公司及其子公司對 M 集團銷售金額上升，係因物聯網、5G 應用及電動車對半導體的需求不斷增加，且 A 集團部分廠區為縮短裝機時程及提高設備生產效率，指定由 M 集團進行下單並進行設備整合，致使 M 集團 110~111 年度皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶；112 年度因 M 集團來自 A 集團之訂單減少，故使 M 集團退出前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

J. Brooks 集團

Brooks 集團成立於民國 67 年，總部位於美國馬薩諸塞州，主要經營業務為自動化及機器人之解決方案，包含半導體工廠自動化及生技協作機器人相關技術服務等。該公司及其子公司與 Brooks 集團交易始於 106 年，目前與 Brooks 集團主要交易對象為 Brooks Automation CCS RS AG 及 Brooks Automation (Germany) GmbH。

該公司及其子公司對 Brooks 集團主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃及機器設備相關耗材等。110~112 年度對其銷售金額分別為 2,733 千元、11,233 千元及 3,607 千元，銷售比重分別為 0.45%、1.07%及 0.30%。110~111 年度因應終端客戶需求，故向該公司及其子公司購置光罩儲存櫃，使 Brooks 集團

110~111 年度銷售金額持續增加；然 112 年度終端客戶委託 Brooks 集團之專案接近尾聲，故使 Brooks 集團退出前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

K. N 集團

N 集團成立於民國 98 年，總部位於美國加利福尼亞州，為世界前五大專業晶圓代工廠，提供客戶 IC 製造服務，生產一系列半導體產品，主要應用包含智慧型手機、電動車、資料中心及物聯網等應用領域，在美國、德國、新加坡均有設立晶圓廠。該公司及其子公司與 N 集團交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 N 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機、機台改造服務及設備相關耗材。110~112 年度對其銷售金額分別為 1,996 千元、17,662 千元及 23 千元，銷售比重分別為 0.33%、1.69%及 0.00%。110~111 年度該公司及其子公司對 N 集團銷售金額上升主要係全球終端數位電子產品及半導體需求增加使晶圓產量上升，N 集團於 110 年擴建東南亞廠區，並向該公司及其子公司採購一台光罩清洗機，以因應晶片生產需求，111 年度於廠房基礎建設完成後，相關晶圓製程所需設備陸續進機所致，110 年度主係銷售設備相關耗材，故 N 集團僅 111 年度為本公司之銷貨前十大客戶，另自 112 年度起，考量銷售區域之服務便利之因素，N 集團委託 P 公司進行下單及設備組裝，故相關設備訂單轉由 P 公司下單，經評估其變化尚屬合理。

L. O 公司

O 公司成立於民國 76 年，總部位於臺灣臺中市，主要經營記憶體 IC 設計、製造與銷售，包含利基型記憶體、行動記憶體以及編碼型快閃記憶體等，該公司及其子公司與 O 公司交易始於 105 年。

該公司及其子公司對 O 公司主要銷售產品為高階光罩充氣儲存櫃、光罩清洗機及機器設備相關耗材等。110~112 年度對其銷售金額分別為 0 千元、15,769 千元及 17,576 千元，銷售比重分別為 0%、1.50%及 1.46%。該公司及其子公司 111 年度對 O 公司之銷售金額較 110 年度增加，主要係 O 公司因應產能需求，於 111 年擴廠，隨建廠進度推進行，對於該公司及其子公司之光罩相關半導體設備需求增加，故 O 公司 111~112 年度皆為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

M. D 集團

D 集團成立於民國 105 年，總部位於安徽省合肥市，主要經營業務為動態隨機存取記憶體(DRAM)之設計、研發、生產及銷售，主要產品有 DDR4 SDRAM、LPDDR4x 及相關模組，應用於智慧型手機、電腦、伺服器、VR 及物聯網等領域，該公司及其子公司與 D 集團交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 D 集團主要銷售產品為高階光罩清洗機及設備相關

耗材。110~112 年度對其銷售金額分別為 0 千元、14,852 千元及 1,006 千元，銷售比重分別為 0%、1.42%及 0.08%。111 年度主係 D 集團進行 DRAM 廠房擴產計畫，故向該公司及其子公司採購高階光罩清洗機所致，其餘年度主係銷售設備相關耗材，致使 D 集團僅 111 年度為該公司及其子公司之銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

N. H 公司

H 公司成立於民國 97 年，位於臺灣新竹市，主要經營業務為 12 吋及 8 吋晶圓專業代工服務，包含邏輯暨特殊應用產品及記憶體產品之晶圓代工，產品終端應用於電腦、通訊應用、消費性電子及車用電子等，該公司及其子公司與 H 公司交易始於 109 年。

該公司及其子公司對 H 公司主要銷售產品為高階光罩清洗機及設備相關耗材。110~112 年度對其銷售金額分別為 186 千元、179 千元及 48,216 千元，銷售比重分別為 0.03%、0.02%及 3.99%。H 公司 112 年度因應擴廠計畫，向該公司及其子公司購買光罩相關設備，使 H 公司 112 年度為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，然 110~111 年度之交易主要為設備相關零組件需求及維修服務等，故於 110~111 年度未列入前十大銷售客戶，經評估其變化尚屬合理。

O. P 公司

P 公司成立於民國 74 年，總部位於位於新加坡，主要經營微污染控制工程服務，提供無塵室和無塵空氣設備之設計及製造、無塵室性能測試及認證、微污染儀器的銷售、校準及維修等，該公司及其子公司與 P 公司交易始於 106 年。

該公司及其子公司對 P 公司主要銷售產品為高階光罩清洗機及機器設備相關耗材等。110~112 年度對其銷售金額分別為 93 千元、47 千元及 20,980 千元，銷售比重分別為 0.02%、0.00%及 1.74%。110~111 年度之交易主要為設備相關零組件需求及維修服務等，112 年主係因應 N 集團建廠之需求，對於該公司及其子公司之光罩相關半導體設備採購增加，並由 P 公司負責機台後續組裝及相關服務，故於 112 年度為該公司及其子公司銷貨前十大客戶，經評估其變化尚屬合理。

(3) 是否有銷貨集中之風險

該公司及其子公司 110~112 年度對前十大銷售客戶之銷售金額分別為 591,210 千元、1,008,568 千元及 1,176,038 千元，銷售比重分別為 98.21%、96.24% 及 97.42%，其中 110 年對 A 集團銷售金額占營收比重為 67.71%，另 A 集團因將部分廠區設備之規劃委由 B 集團統籌，故該公司及其子公司 111~112 年度對 B 集團銷售金額占營收比重分別為 44.03%及 32.62%。該公司及其子公司雖有銷貨集中之情形，惟目前 A 集團為全球最主要且技術領先之晶圓代工業者，該公

司及其子公司不僅憑藉著迅速服務及彈性的交期、穩定的產品品質及客製化的產品設計，以及整體解決方案服務等優勢深獲客戶的信賴，更因此與其他主要客戶均維持長期且良好之合作關係；此外，該公司及其子公司持續致力於開發新客戶及新產品線以爭取不同的客戶群，期以擴大並分散業務來源。以下就其銷貨集中之合理性及因應對策進行說明：

A.銷貨集中之原因

(A)半導體產業特性

由於半導體晶圓在製程當中，環境中的微粒會對良率造成影響，隨著製程的微縮，環境中的微粒對良率影響越大，當晶圓製程達到 28 奈米以下時，晶圓於載具輸送時的環境條件控制及潔淨化將變得相當重要；當達到 20 奈米以下的等級時，此種微污染防治設備裝置成為晶圓廠載具傳輸設備的標準配備，因此亦隨著客戶製程之演進推升，對於此製程微污染防治設備之需求將會更加殷切。

根據集邦科技(TrendForce)旗下拓璞產業研究院進行的調查，2022 年第四季全球晶圓代工的市占率排名前三名分別為台積電、三星及聯電，此前三名業者市占率合計占 80.6%，顯示因半導體製造屬高度寡占市場，半導體設備廠商之銷售對象有限，晶圓代工產能集中於少數晶圓大廠中，A 集團市占達 58.5%，且 A 集團持續推進先進製程並保持業界技術領先地位，近年來資本支出金額為業界最高，該公司及其子公司雖有銷貨集中於 A 集團情形，乃產業特性所致。

由於半導體為技術與資本密集行業，晶圓代工產業集中於少數晶圓大廠，經檢視半導體設備供應商之京鼎及華景電 111 年度對其第一大銷售客戶之銷售比重分別為 82.98%及 69.92%，顯示該公司及其子公司銷貨集中現象，與同業相較係符合產業特性。

(B)半導體設備進入門檻高，且供應鏈更換不易

客戶對晶圓製造環境的污染控制要求甚高，廠商一旦成為其合格供應商後，除非所提供之服務或品質發生嚴重瑕疵，否則客戶更換供應商之可能性甚低，且客戶要採用其他供應商，必須先通過認證且機台各式規格不同也需逐一認證，所需耗費時間及成本可觀。近年來，客戶對於光罩潔淨度越趨嚴格，該公司及其子公司自 105 年起與 A 集團合作開發，針對客戶需求開發光罩相關之微環境機器設備，經長年合作，不論品質深獲肯定及準時達交率高，且產品皆已通過安全性認證，加上該公司及其子公司於半導體機台所需之光罩相關微污染防治設備客製化設計能力強，以提供客製化服務來穩固產品與客戶之密切合作關係，在技術、品質、成本及交期均能滿足客戶需求且較同業具有優勢下，故得以維持長期穩定之供應鏈關係，

且客戶亦滿意其提供之服務，進而使得該公司有銷貨集中於該主要客戶集團之情形。

綜上所述，隨著客戶的需求攀升，致該公司及其子公司對該主要客戶集團之銷貨金額逐年成長，此乃該客戶在市場具有領先之地位，對相關產品亦有一定的需求，該公司在半導體領域耕耘多年，秉持提供客戶客製化服務，強化競爭利基並獲致客戶的肯定，也陸續反映在公司近年的營收規模增長。因此除了上述客戶外，該公司亦積極開發新客戶及新型全自動機台，隨著新客戶、認證產品之增加，期以提高該公司及其子公司營業收入金額以逐步降低對單一客戶銷售之比重。

B.銷貨集中之風險及因應措施

(A)銷貨集中之風險

a.更換供應商的風險或倒帳的風險

半導體前端製程產業擁有技術不斷創新以及市場參與者寡占的產業特性，更出現市場參與者大者恆大之情形，導致該公司及其子公司主要銷貨對象雖為半導體產業的國際代工大廠，但銷售對象仍然有限，而出現銷貨集中之情事，若主要客戶出現更換供應商或倒帳情形，將對公司營運產生重大影響。該公司及其子公司產品推出前，會針對客戶製程所需規格客製化設計開發階段至驗證約 3~6 個月的前置期，故經重點客戶採用後，以客戶觀點考量其已投入的時間成本，除非有產品品質問題否則不會輕易更換，致影響其產線之運作。

另檢視該公司對 A 集團、B 集團之收款條件、應收帳款帳齡及應收帳款收回情形，其收款條件為出貨後即收取出機款，約銷貨金額之 80%，設備驗收後收取尾款，約銷貨金額之 20%，應收帳款未曾發生應收帳款逾期而無法收回之情形，故其對該公司應收帳款倒帳風險尚低。

b.因品質而被抽單的風險

考量半導體設備進入門檻高及產業特性，廠商一旦成為其合格供應商後，除非所提供之服務或品質發生嚴重瑕疵，否則客戶更換供應商之可能性甚低；一座 Fab 廠約上千機台設備且幾乎是歐美日十數家國際設備廠所囊括，尤其是晶圓廠內一台動輒數億的機台，搭配的相關客製化機台零組件雖然造價相對較低，但附屬機台若無法與主製程設備良好搭配，亦會影響晶圓廠的生產良率，因此供應商若因產品品質問題將可能面臨抽單風險。

綜上，因該公司及其子公司產品通過客戶嚴峻之品質考驗，並配合開發客製化產品，同時具備售後維護的能力，且價格具競爭力。因此，透過

維持產品品質及客製化服務，更可增加客戶與該公司的緊密度，藉此降低供應商更換或因品質而被抽單之風險。加上，相關主要客戶均為財務健全且營運良好之國際大廠，整體而言，該公司及其子公司面臨上述風險之可能性較低。

(B)因應措施

a.技術延伸至新產品或新市場開發

該公司及其子公司為避免單一客戶過於集中之風險，積極拓展多元化業務市場，將利用研發設計能力，有效運用該公司及其子公司為客戶產品需求設計及開發解決能力，持續發展半導體相關新產品，有助於開拓及掌握未來商機。光罩相關半導體設備目前亦切入國際半導體大廠供應鏈，隨著全球產業市場對於微環境設備需求與日俱增趨勢，該公司及其子公司已陸續拓展相關業務，未來將持續挹注營收成長。

b.鞏固與客戶之密切合作關係

由於該主要客戶為晶圓代工之領導廠商，該公司除了積極維持與主要客戶之良好互動及合作關係，該公司及其子公司於新竹及臺南地區設置營運據點，強化因應客戶臨時需求時調配人力之彈性，此外該公司及其子公司與其長期合作的關係，且該公司及其子公司對客戶需求的即時掌握，並能滿足其各式客製化之訂單需求，故而獲得客戶持續下單採購，隨著客戶在市場具領導地位，該公司及其子公司藉此參與前瞻技術之機會並提升本身技術能力，將為該公司及其子公司帶來廣大的客戶效益，有助於該公司銷售策略之運用。

c.積極開發其他客戶

該公司及其子公司深耕於半導體設備多年，由於各國政府積極扶植半導體產業之政策，近幾年大幅增加對半導體產業的投資，以降低對國外進口的依賴。該公司及其子公司逐步拓展業務至歐美等區域，以提升及拓展該公司及其子公司位於全球半導體先進製程設備之市占率。

(4)該公司及其子公司之銷售政策

該公司及其子公司主要營業項目為光罩相關半導體設備之研究、製造及銷售，主要銷售產品為 EUV 相關半導體設備、高階相關半導體設備及零組件買賣等，產品多屬高度客製化為主。茲將該公司及其子公司之銷售政策列示如下：

A.即時掌握客戶需求，共創雙贏局面。

B.強化售後服務，維持強化現有客戶之支援及服務，積極開拓新產品線。

C.專注及掌握客戶應用需求，開發符合客戶及市場脈動，建立產品口碑及快速成

長等雙贏目標。

D.積極拓展潛在市場，分散市場風險。

2.最近三年度及申請年度截至最近期止各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，分析最近三年度及申請年度截至最近期止主要供應商名稱、價格及條件之變化原因是否合理，是否有進貨集中之風險，並簡述申請公司之進貨政策。

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新臺幣千元；%

項目	110 年度				111 年度				112 年度			
	名稱	進貨淨額	%	與發行人關係	名稱	進貨淨額	%	與發行人關係	名稱	進貨淨額	%	與發行人關係
1	鑫達懋業	103,300	20.34	無	鑫達懋業	94,057	13.79	無	鑫達懋業	68,346	12.80	無
2	嘉彰	56,626	11.15	無	嘉彰	79,839	11.70	無	嘉彰	45,543	8.54	無
3	皇乾企業	35,923	7.07	無	皇乾企業	45,280	6.64	無	銖恩帕斯集團	44,150	8.27	註 1
4	銖恩帕斯集團	31,202	6.14	無	銖恩帕斯集團	41,924	6.14	無	盟立	31,700	5.94	無
5	甲公司	26,098	5.14	無	立明板金	38,324	5.62	無	皇乾企業	27,549	5.16	無
6	乙公司	23,581	4.64	無	甲公司	25,258	3.70	無	堔鉸	24,604	4.61	註 2
7	光鈦國際	19,028	3.75	無	竺揚工程	24,623	3.61	無	竺揚工程	22,883	4.29	無
8	立明板金	18,584	3.66	無	乙公司	23,836	3.49	無	元宸	22,001	4.12	無
9	強新工業	17,105	3.37	無	丙公司	17,948	2.63	無	乙公司	20,925	3.92	無
10	丙公司	9,861	1.94	無	士林電機	13,206	1.93	無	丙公司	18,094	3.39	無
	小計	341,308	67.20	—	小計	404,295	59.25	—	小計	325,795	61.04	—
	其他	166,606	32.80		其他	278,008	40.75		其他	207,978	38.96	
	進貨淨額	507,914	100.00		進貨淨額	682,303	100.00		進貨淨額	533,773	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：銖恩帕斯集團於 112/7 成為實質關係人

註 2：堔鉸於 112/2 成為實質關係人

(2)主要供應商變化情形之原因分析

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，並包含有檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，故銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。該公司及其子公司主要進貨項目為組裝設備所需之零組件如：質量流量控制器、微塵過濾器、含氧感知器等電料及充氣底板、金屬加工件及電控、管路組件等。110~112 年度之進貨淨額分別為 507,914 千元、682,303 千元及 533,773 千元，採購金額變動主係隨營業規模持續成長及採購策略等因素，並配合客戶訂單產品及交期進行下單所致。以下茲就該公司及其子公司 110~112 年度主要供應商之變化情形分析說明如下：

A. 鑫達懋業股份有限公司(以下簡稱：鑫達懋業)

鑫達懋業成立於民國 80 年，位於臺中市，為專業自動控制產品代理商，主要引進 Fuji、OMRON 及 Rockwell Automation 等美、日知名大廠產品，並提供技術整合服務。該公司及其子公司自 105 年開始與鑫達懋業交易。

該公司及其子公司對鑫達懋業主要進貨項目為質量流量控制器及通訊閘道等電料，110~112 年度對其進貨淨額分別為 103,300 千元、94,057 千元及 68,346 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 20.34%、13.79%及 12.80%，其中 111 年度較 110 年度下降主係因 110 年度受新冠肺炎疫情影響，致對鑫達懋業之主要進貨項目交期拉長，故該公司及其子公司依訂單需求提前備料，使進貨金額較高，111 年度因交期回歸正常區間及 110 年度已提前備料，致進貨金額略為下降；112 年度進貨金額下降，主係配合客戶訂單交期調整所致。整體而言，該公司及其子公司對鑫達懋業採購金額之變動主係配合客戶訂單交期對其進行下單所致，其 110~112 年度供應商排名皆為第一大，經評估尚無重大異常之情事。

B. 皇乾企業有限公司(以下簡稱：皇乾企業)

皇乾企業成立於民國 89 年，位於新竹縣，主要提供半導體先進製程相關設備、氣體分裝系統及光罩檢查設備等各式自動化系統工程服務。該公司及其子公司自 105 年度開始與皇乾企業交易。

該公司及其子公司對皇乾企業主要進貨項目為電控軟、硬體組件及 SECS(SEMI Equipment Communications Standard))通訊元件等電控、管路組件，110~112 年度對其進貨淨額分別為 35,923 千元、45,280 千元及 27,549 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 7.07%、6.64%及 5.16%，電控、管路組件係搭配光罩充氣儲存櫃體、光罩清洗機及光罩交換機及等產品生產，該公司及其子公司 110~111 年度因高效能運算產業、5G 通訊及車用電子等需求強勁，以及半導體產業先進製程推進所帶動之相關設備需求，使業績逐步成長，對皇

乾之進貨金額亦同步上升；112 年度進貨金額下降，主係配合客戶訂單產品需求調整下單，其 110~112 年度供應商排名分別為第三大、第三大及第五大，經評估尚無重大異常之情事。

C. 嘉彰股份有限公司(以下簡稱：嘉彰)

嘉彰成立於民國 74 年，位於桃園市，為臺灣上市公司(股票代碼：4942)，係金屬沖壓之專業製造商，主要產品應用於光電、資訊及通訊等內外部金屬沖壓零部件及相關精密沖壓模具設計與製造。該公司及其子公司自 106 年開始與嘉彰交易。

該公司及其子公司對嘉彰主要進貨項目為一體式充氣底板及盤面板金等金屬加工件，110~112 年度對其進貨淨額分別為 56,626 千元、79,839 千元及 45,543 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 11.15%、11.70%及 8.54%，來自嘉彰之主要進貨主係使用於光罩充氣儲存櫃體之生產，隨著該公司及其子公司之業績逐年持續成長，110~111 年度對嘉彰之進貨金額亦同步上升；112 年度進貨金額略為下降，主係配合客戶訂單交期調整所致，其 110~112 年度供應商排名皆為第二大，經評估尚無重大異常之情事。

D. 甲公司

甲公司成立於民國 107 年，位於新竹市，主要提供材料光學、雷射光學、自動化領域、精密模具之開發、設備及管路規劃之安裝服務。該公司及其子公司自 108 年開始與甲公司交易。

該公司及其子公司對甲公司主要進貨項目為流量顯示器、限流控制閥及氣鏟刀頭等電料及管路配置工程及管路二次配工程等電控、管路組件，110~112 年度對其進貨淨額分別為 26,098 千元、25,258 千元及 12,229 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 5.14%、3.70%及 2.29%，最近三年度對甲公司之進貨金額主係配合產品生產所需而變動，另 111 年度因設備訂單大幅增加，該公司及其子公司為降低進貨集中風險及靈活調整採購來源，將部份電控、管路組件轉向其他合格供應商採購，致進貨金額略微下降；其 110~111 年度供應商排名分別為第五大及第六大，112 年度進貨金額下降，主係配合客戶訂單交期調整下單，故退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

E. 銖恩帕斯集團

銖恩帕斯集團成立於民國 98 年，位於臺南市，主要營運項目為製程管路設計和製程管路配管工程管理服務，以及半導體設備相關零組件製作。該公司及其子公司自 105 年開始與銖恩帕斯交易，目前與銖恩帕斯集團主要交易對象為銖恩帕斯科技股份有限公司及匯聚光能管理顧問有限公司。

該公司及其子公司對銖恩帕斯集團主要進貨項目為分氣管等金屬加工件及管路配置工程及管路二次配工程等電控、管路組件，110~112 年度對其進貨

淨額分別為 31,202 千元、41,924 千元及 44,150 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 6.14%、6.14%及 8.27%，鍊恩帕斯集團主要進貨項目係使用於光罩充氣儲存櫃體之生產，故該公司及其子公司 110~112 年度對其之進貨金額增加主係伴隨業績逐步成長同步上升及配合客戶訂單產品需求調整下單，其 110~112 年度供應商排名分別為第四大、第四大及第三大，經評估尚無重大異常之情事。

F.乙公司

乙公司成立於民國 76 年，位於臺北市，主要提供精密流體過濾器與系統及高精密流體流量控制機構以及高真空壓力測量部件及其他相關廠務設備及技術服務。該公司及其子公司自 106 年開始與乙公司交易。

該公司及其子公司對乙公司主要進貨項目為微塵過濾器等電料，110~112 年度對其進貨淨額分別為 23,581 千元 23,836 千元及 20,925 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 4.64%、3.49%及 3.92%。110 及 111 年度對乙公司之進貨金額約當；112 年度進貨金額下降，主係配合客戶訂單產品需求調整下單，其 110~112 年度供應商排名分別為第六大、第八大及第九大，經評估尚無重大異常之情事。

G.立明板金股份有限公司(以下簡稱：立明板金)

立明板金成立於民國 106 年，位於臺中市，主要營業項目為精密機械板金零件及機台骨架製造及機台代工組裝服務，跨足半導體製程、光電、醫療等領域之。該公司及其子公司自 107 年開始與立明板金交易。

該公司及其子公司對立明板金主要進貨項目為各式板金及固定座等金屬加工件，110~112 年度對其進貨淨額分別為 18,584 千元、38,324 千元及 15,562 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.66%、5.62%及 2.92%，立明板金之主要進貨項目於全數機台皆可使用，故該公司及其子公司 110~111 年度因營業規模持續受惠於半導體產業需求成長，致相關設備採購訂單持續增加，對立明板金之進貨金額亦同步上升，110~111 年度供應商排名分別為第八大及第五大，112 年度進貨金額下降，主係因調整採購策略，新增多家合格供貨廠商，致其退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

H.光鈦國際工業股份有限公司(以下簡稱：光鈦國際)

光鈦國際成立於民國 86 年，位於桃園市，主要生產製造鋁擠型彈性組合框架，另有代理銷售國外知名品牌產品如：空壓元件、光電開關及音圈馬達等。該公司及其子公司自民國 105 年開始與光鈦國際交易。

該公司及其子公司對光鈦國際主要進貨項目為鋁擠框體等金屬加工件，110~112 年度對其進貨淨額分別為 19,028 千元、3,560 千元及 0 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.75%、0.52%及 0.00%。鋁擠框體於全數機台皆

可使用，111 年起進貨金額大幅下降主係因鋁擠框體之進貨價格受國際鋁價波動影響，該公司及其子公司有向相關合格供應商議價以控制價格波動，惟光鈦國際配合意願較低，故轉向其他合格供應商採購，致進貨金額下降，其 110 年度供應商排名為第七大，後續即退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

I. 竺揚工程有限公司(以下簡稱：竺揚工程)

竺揚工程成立於民國 95 年，位於新竹市，主要營業項目為鋁擠型機構架組裝及銷售鋁擠型材料、配建及耗材之買賣批發零售和人力服務。該公司及其子公司自 105 年開始與竺揚工程交易。

該公司及其子公司對竺揚工程主要進貨項目為鋁擠框體等金屬加工件，110~112 年度對其進貨淨額分別為 7,757 千元、24,623 千元及 22,883 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.53%、3.61%及 4.29%。該公司及其子公司對竺揚工程之進貨品項主係用於其設備機台組裝所需，111 年度因來自半導體客戶之相關設備採購訂單持續增加，另因鋁擠框體之進貨價格受國際鋁價波動影響，竺揚工程積極配合該公司及其子公司備料，故其轉向竺揚工程採購，致對竺揚工程進貨金額上升；112 年度進貨金額下降，主係配合客戶訂單產品需求調整下單。竺揚工程於 111 及 112 年度皆為其第七大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

J. 強新工業股份有限公司(以下簡稱：強新工業)

強新工業成立於民國 82 年，位於臺南市，其主要營業項目為碳鋼、合金鋼及不銹鋼線材製造，並自 92 年跨足生產超潔淨電解拋光管線與管配件，提供半導體、光電業及花工業等建廠工程所需。該公司及其子公司自 108 年開始與強新工業交易。

該公司及其子公司對強新工業主要進貨項目為 EUV N2 盤面管路及分氣管等金屬加工件，110~112 年度對其進貨淨額分別為 17,105 千元、6,122 千元及 0 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.37%、0.90%及 0.00%。該公司及其子公司最近三年度因營業規模持續擴展，故依其取得客戶之訂單需求，對於相關零配件等採購金額亦持續增加，惟 111 年度在成本考量之情況下，將部分採購訂單轉向其他符合品質需求及規格之同類別合格供應商，致對強新工業之進貨金額下降，故強新工業僅 110 年度進入前十大供應商為第九名，經評估尚無重大異常之情事。

K. 丙公司

丙公司成立於民國 101 年，位於宜蘭縣，主要營業項目為圖控軟體(SCADA)、人機介面及通信閘道器(Gateway)整合，其圖控軟體可適用於 OEM 人機及半導體設備業等。該公司及其子公司自 105 年開始與丙公司交易。

該公司及其子公司對丙公司主要進貨項目為圖控軟體及相關系統等品項，110~112 年度對其進貨淨額分別為 9,861 千元、17,948 千元及 18,094 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.94%、2.63%及 3.39%，其主要進貨項目係搭配光罩充氣儲存櫃體、光罩清洗機及光罩交換機及等產品生產，最近三年度因來自半導體客戶之相關設備採購訂單持續增加，使業績逐步成長，對丙公司之進貨金額亦同步上升，使其 110~112 年度進入前十大供應商，分別為第十大、第九大及第十大，經評估尚無重大異常之情事。

L. 士林電機股份有限公司(以下簡稱：士林電機)

士林電機成立於民國 44 年，為臺灣上市公司(股票代碼：1503)，主要產品有電力配電、車輛零件、自動化設備及零件及數位家電相關等產品。該公司及其子公司自 106 年開始與士林電機交易。

該公司及其子公司對士林電機主要進貨項目為三菱 CC-Link 遠端輸入模組、斷路器、可程式控制器及伺服電機等電料，110~112 年度對其進貨淨額分別為 7,997 千元、13,206 千元及 6,412 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.57%、1.93%及 1.20%，其主要進貨項目係搭配光罩充氣儲存櫃體、光罩清洗機及光罩交換機等產品生產，110~111 年度其因來自半導體客戶之相關設備採購訂單持續增加，使業績逐步成長，對士林電機之進貨金額亦同步上升，使其 111 年度進入前十大供應商，為第十大，112 年度進貨金額下降，主係配合客戶訂單產品需求調整下單，故退出前十大供應商，經評估尚無重大異常之情事。

M. 盟立自動化股份有限公司(以下簡稱：盟立)

盟立成立於民國 78 年，為臺灣上市公司(股票代碼：2464)，主要提供自動化設備系統及其零組件等產品。該公司及其子公司自 112 年開始與盟立交易。

該公司及其子公司對盟立主要進貨項目為 Mini Stoker 儲存系統工程電控、管路組件等，110~112 年度對其進貨淨額分別為 0 千元、0 千元及 31,700 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、0%及 5.94%，該公司及其子公司與盟立自 111 年起合作開發 Mini Stoker 櫃儲存體所需之電控、管路組件，並於 112 年開始出貨，使其 112 年度進入前十大供應商，為第四大，經評估尚無重大異常之情事。

N. 元宸新材料科技股份有限公司(以下簡稱：元宸)

元宸成立於民國 110 年，位於新竹縣，主要產品為半導體氣體配管材料及配管工程服務等產品。該公司及其子公司自 111 年開始與元宸交易。

該公司及其子公司對元宸主要進貨項目為 EUV N2 盤面管路、分氣管等金屬加工件及電控、管路組件等，110~112 年度對其進貨淨額分別為 0 千元、

9,438 千元及 22,001 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、1.38%及 4.12%，該公司與其子公司自 111 年開始與元宸交易，隨該公司業務成長及因應客戶需求持續備料，對元宸之進貨金額亦同步上升，其 112 年度進入前十大供應商，為第八大，經評估尚無重大異常之情事。

O. 堯鉉系統科技股份有限公司(以下簡稱：堯鉉)

堯鉉成立於民國 101 年，位於臺中市，主要產品工程配管施工及規劃服務及相關配管材料等產品。該公司及其子公司自 111 年開始與堯鉉交易。

該公司及其子公司對堯鉉主要進貨項目為調壓閥、壓力錶及壓力開關等電料、分氣管等金屬加工件及電控、管路組件等，110~112 年度對其進貨淨額分別為 0 千元、12,328 千元及 24,604 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、1.81%及 4.61%，自 111 年開始與堯鉉交易，隨該公司業務成長及因應客戶需求，對堯鉉之進貨金額亦同步上升，使其 112 年度進入前十大供應商，為第六大，經評估尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度主要供應商主增減變動情形主要受該公司營業規模持續成長及採購策略等因素所影響，惟自 109 年起，全球因受到新冠疫情之影響，封城、居家辦公之情況帶動晶片需求增加，另高效能運算產業、5G 通訊及車用電子等需求強勁，使半導體產業持續擴充產能，連帶推升半導體設備需求增加，使該公司及其子公司進貨金額隨營業規模持續擴大而連年增加，其 112 年度進貨金額下降，主係配合客戶訂單產品及交期調整進貨時程所影響。該公司及其子公司之採購單位除依客戶訂單進行備料外，亦積極瞭解各合格供應商之原物料庫存及交期，以避免生產進度因為缺料而中斷。經評估，其主要供應商之變動情形尚屬合理，並無重大異常之情事。

(3) 供貨來源穩定性

該公司及其子公司主要進貨項目為質量流量控制器、微塵過濾器及含氧感知器等電料及金屬加工件及電控、管路組件等。其主要原物料除客戶指定外，皆有一間以上合格供應商，並維持長期往來之合作關係，採購單位進行原物料採購時會考量訂單需求、供應商產能及交期等，並適時進行議價以確保進貨價格之合理性。因該公司及其子公司為客製化訂單生產，除依客戶訂單進行備料外，亦積極瞭解各供應商之產能及可能到貨之預估時間，以避免生產因為缺料而中斷。截至評估報告出具日止，該公司及其子公司並無供貨短缺或中斷情形發生。

(二)申請公司最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告應收款項變動合理性、備抵損失提列適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.應收款項變動之合理性

單位：新臺幣千元

項目	111 年度		112 年度	
	個體	合併	個體	合併
營業收入淨額	989,427	1,047,953	1,163,487	1,207,145
應收票據-非關係人	-	-	-	-
應收帳款-非關係人	275,548	283,100	142,918	146,115
應收帳款-關係人	101	101	-	-
小計	275,649	283,201	142,918	146,115
備抵損失提列數	(9,235)	(9,340)	(15,355)	(15,355)
應收款項淨額	266,414	273,861	127,563	130,760
應收款項週轉率(次)	5.88	5.79	5.56	5.62
應收款項收現天數(天)	63	64	66	65
授信條件	該公司依客戶之資本規模、營業規模、財務狀況及過往交易情形、收款紀錄等而訂定不同之授信條件，收款條件主要為月結30天~120天。			

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之個體及合併財務報告

(1)個體財務報告

該公司 111~112 年度個體財務報告之應收款項總額分別為 275,649 千元及 142,918 千元，112 年底應收款項總額較 111 年底減少 132,731 千元，減少幅度為 (48.15)%，主係光罩相關半導體機器設備營收規模成長，以及因應客戶需求，111 年底出貨增加，相關應收款項集中於 111 年年底，然相關應收帳款於 112 年度收回所致。整體而言，該公司最近二年度應收款項變化情形主係隨出貨情形而變動，尚無重大異常。

在應收款項週轉率方面，該公司 111~112 年度應收款項週轉率分別為 5.88 次及 5.56 次，應收款項收現天數分別為 63 天及 66 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。112 年度應收款項週轉率較前一年度下降，主係雖該公司 112 年度營業收入較去年同期成長 17.59%，因 111 年底大量出貨，致平均應收帳款餘額成長 18.51%，致應收款項週轉率微幅下降。

整體而言，該公司 111~112 年度個體財務報告之應收款項總額及應收款項週轉率之變動情形尚屬合理，且平均收現天數與與授信條件區間未有重大差異，經評估尚無重大異常之情事。

(2)合併財務報告

該公司 111~112 年度列入合併財務報告之公司除該公司外，尚有轉投資公司昇和精技公司。該公司統籌集團經營策略，主要負責光罩相關半導體設備、相關

零組件及維修服務等，而子公司昇和精技公司則負責物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition, PVD)設備改造及材料更換等客製化服務。該公司及其子公司合併應收帳款主要來自於該公司。

該公司及其子公司 111~112 年度合併財務報告之應收款項總額分別為 283,201 千元及 146,115 千元。112 年底應收款項總額較 111 年底減少 137,086 千元，變動比率為(48.41)%，主係於 112 年度收回部分機台款項所致。整體而言，該公司及其子公司最近二年度及最近期合併應收款項變化情形主係隨出貨情形而變動，尚無重大異常。

在應收款項週轉率方面，該公司及其子公司 111~112 年度應收款項週轉率分別為 5.79 次及 5.62 次，應收款項收現天數分別為 64 天及 65 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。該公司及其子公司 112 年度之應收款項週轉率較 111 年度下降，雖該公司截至 112 年底營業收入較去年度成長 15.19%，惟因 111 年底大量出貨，並於 112 年陸續收款，致平均期末應收帳款餘額較前期下降 48.41%，致應收款項週轉率微幅下降。

整體而言，該公司及其子公司 111~112 年度合併財務報告之應收款項總額及應收款項週轉率之變動情形尚屬合理，且平均收現天數與與授信條件區間未有重大差異，經評估尚無重大異常之情事。

2. 備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

(1) 備抵損失提列政策

該公司及其子公司採用 IFRS9 之簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況及產業經濟情勢。因該公司及其子公司之信用損失歷史經驗顯示，不同客戶群之損失型態並無顯著差異，因此準備矩陣未進一步區分客戶，僅以應收帳款立帳天數訂定預期信用損失率。該公司及其子公司依準備矩陣衡量之預期信用損失率列示如下：

應收帳款 立帳天數	預期信用損失率	
	111 年度	112 年度
1-90 天	0.66%	2.00%
90-180 天	4.93%	9.37%
181-270 天	12.11%	16.41%
271-365	15.19%	18.16%
366 天以上	100.00%	100.00%

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)備抵損失提列之適足性

A.個體財務報告

單位：新臺幣千元；%

項目	111 年度	112 年度
應收款項總額(B)	275,649	142,918
備抵損失金額(A)	9,235	15,355
備抵損失提列比率(A)/(B)(%)	3.35	10.74

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證之個體財務報告

該公司 111~111 年度個體財務報告之應收款項總額分別為 275,649 千元及 142,918 千元，備抵損失提列金額分別為 9,235 千元及 15,355 千元，占應收款項總額之提列比率分別為 3.35%及 10.74%。該公司已依其應收帳款帳齡分佈期間，並考量個別客戶經營狀況及帳款收回之可能性，綜合評估提列備抵呆帳。112 年度備抵損失提列金額較 111 年度增加 6,120 千元，主係因受客戶建廠計畫延宕，及驗收流程尚在進行所致。

綜上所述，該公司最近二個會計年度提列之備抵減損金額依所訂之政策執行，備抵損失金額應足以涵蓋該公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵減損提列之金額尚屬合理，適足性應無疑慮，尚無重大異常之情事。

B.合併財務報告

單位：新臺幣千元；%

項目	111 年度	112 年度
應收款項總額(B)	283,201	146,115
備抵損失金額(A)	9,340	15,355
備抵損失提列比率(A)/(B)(%)	3.30	10.51

資料來源：該公司及其子公司各期間經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司 111~112 年度提列之備抵呆帳金額分別為 9,340 千元及 146,115 千元，占各年度期末應收款項總額比率分別為 3.30%及 10.51%。該公司及其各子公司已依其應收帳款立帳天數分佈期間，並考量個別客戶經營狀況及帳款收回之可能性，綜合評估提列備抵呆帳。該公司及其子公司提列之備抵呆帳逐年增加，主係因受客戶建廠計畫延宕，及驗收流程尚在進行所致。

綜上所述，該公司及其子公司最近二個會計年度提列之備抵減損金額依所訂之政策執行，備抵損失金額應足以涵蓋該公司及其子公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵減損提列之金額尚屬合理，適足性應無疑慮，尚無重大異常之情事。

(3) 應收款項收回可能性評估

單位：新臺幣千元

項目	112 年 12 月底	截至 113 年 2 月底 之收回情形		截至 113 年 2 月底 之未收回情形	
		金額	%	金額	%
應收票據	-	-	-	-	-
應收帳款	146,115	76,100	52.08	70,015	47.92
應收帳款-關係人	-	-	-	-	-
合計	146,115	76,100	52.08	70,015	47.92

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司 112 年 12 月底之合併應收帳款餘額為 146,115 千元，截至 113 年 2 月 29 日止，合併應收帳款已收回金額及比率分別為 76,100 千元及 52.08%，未收回金額及比率則分別為 70,015 千元及 47.92%，未收回金額中主係客戶建廠延宕，且供應商付款相關系統尚未建立完善及因設備銷售為分批付款，該公司已依照政策提列足額備抵呆帳金額；其餘未收回帳款，主係受建廠及裝機時程影響，故應收帳款帳齡較長，根據該公司歷史經驗，其收回可能性應無重大疑慮，且該公司已依照政策提列足額備抵呆帳金額。

綜上所述，該公司及其子公司已針對立帳天數 366 天以上之帳款提列 100% 之備抵呆帳，其餘帳齡亦依政策提列足額備抵呆帳金額，該公司及其子公司持續對應收帳款積極追蹤並每月召開檢討會議，惟因其產業特性，客戶通常採階段性付款，設備驗收期間約為 30~180 天，故有部分應收帳款立帳天數較長，然該公司之銷售客戶多為國內外長期合作之知名廠商，111~112 年度客戶應收款項收回情形尚屬良好，經評估尚無重大異常之情事。

3. 與同業比較

單位：新臺幣千元

項目	公司	111 年度		112 年度	
		個體	合併	個體	合併
營業收入	家碩	989,427	1,047,953	1,163,487	1,207,145
	京鼎	12,055,139	14,843,221	10,089,159	13,051,357
	華景電	1,261,775	1,416,410	997,046	1,370,598
	天虹	1,741,090	1,815,477	1,667,072	1,992,643
應收款項 總額	家碩	275,649	283,201	142,918	146,115
	京鼎	798,466	981,065	561,511	782,872
	華景電	123,628	222,744	104,566	205,973
	天虹	375,018	444,872	502,322	477,847

項目	公司	111 年度		112 年度	
		個體	合併	個體	合併
備抵損失 帳列金額	家碩	9,235	9,340	15,355	15,355
	京鼎	215	3,221	167	232
	華景電	2,869	4,744	2,869	4,717
	天虹	909	1,625	327	866
應收款項 週轉率 (次)	家碩	5.88	5.79	5.56	5.62
	京鼎	10.54	11.06	14.84	14.80
	華景電	10.32	7.51	8.74	6.39
	天虹	5.36	4.88	3.80	4.32
應收款項 週轉天數 (天)	家碩	63	64	66	65
	京鼎	35	34	25	25
	華景電	36	49	42	58
	天虹	69	75	97	85
備抵損失 占應收帳 款之比重 (%)	家碩	3.35	3.30	10.74	10.51
	京鼎	0.03	0.33	0.03	0.03
	華景電	2.32	2.13	2.74	2.29
	天虹	0.24	0.37	0.07	0.18

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之個體及合併財務報告

(1) 個體財務報告

該公司 111~112 年度個體應收款項週轉率分別為 5.88 次及 5.56 次，應收款項收現天數分別為 63 天及 66 天，該公司最近二年度個體應收款項變化情形主係出貨情形而變動。與採樣同業相較，111~112 年度介於同業之間，該公司應收款項週轉率呈現下降趨勢，主係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致該公司及其子公司營業收入持續攀升，惟增加之幅度較平均應收款項增加幅度小，使得應收款項週轉率下降。

該公司 111~112 年度提列個體備抵損失金額分別為 9,235 千元及 15,355 千元，占各期應收帳款之比重分別為 3.35% 與 10.74%。與採樣同業相較，111~112 年度高於同業，主係依其備抵損失提列政策提列所致，惟該公司目前之應收款項收回情形尚屬良好，且其備抵損失金額應足以涵蓋該公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵損失提列之金額應屬允當。

綜上所述，該公司最近二個會計年度之應收款項週轉率、應收款項收現天數、備抵損失占應收款項比重，與同業比較評估，尚無重大異常之情事。

(2)合併財務報告

該公司及其子公司 111~112 年度之合併應收款項週轉率分別為 5.79 次及 5.62 次，應收款項收現天數分別為 64 天及 65 天，該公司及其子公司最近二年度合併應收款項變化情形主係隨出貨情形而變動。與採樣同業相較，該公司及其子公司 111~112 年度應收款項週轉率介於採樣同業，該公司及其子公司應收款項週轉率呈現下降趨勢，主係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致該公司及其子公司營業收入持續攀升，惟增加之幅度較平均應收款項增加幅度小，使得應收款項週轉率下降；另該公司及其子公司之往來客戶大多為國外知名大廠，財務狀況及營運狀況均為穩健，其授信條件與收款情形尚屬合理，且該公司及其子公司定期追蹤應收帳款期後收回情形，經評估尚無重大異常之情事。

該公司及其子公司 111~112 年度提列備抵損失金額分別為 9,340 千元及 15,355 千元，111~112 年度備抵損失金額高於同業，主係受客戶建廠及裝機時程影響，致應收帳款帳齡較長；該公司及其子公司已依照政策提列足額備抵呆帳金額，然根據該公司歷史經驗，其收回可能性應無重大疑慮。該公司及其子公司 111~112 年度備抵損失占應收帳款之比重分別為 3.30%及 10.51%。與採樣同業相較，均高於採樣同業；該公司及其子公司提列之備抵呆帳比例逐年增加，主係因受客戶建廠計畫延宕，及驗收流程尚在進行所致，該公司及其子公司最近二年度及最近期提列之備抵減損金額依所訂之政策執行，備抵損失金額應足以涵蓋該公司及其子公司應收款項可能發生壞帳之風險，經評估其備抵減損提列之金額尚屬合理，適足性應無疑慮，尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近二個會計年度及最近期之應收款項週轉率、應收款項收現天數、備抵損失占應收款項比重，與同業比較評估，尚無重大異常之情事。

(三)申請公司最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告存貨淨額變動合理性及去化情形、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列適足性之評估，並與同業比較評估

1.存貨淨額變動合理性

單位：新臺幣千元

項目	年度	111 年度		112 年度	
		個體	合併	個體	合併
營業收入		989,427	1,047,953	1,163,487	1,207,145
營業成本		582,211	597,074	612,060	621,607
期末 存貨 總額	原物料	60,158	60,264	45,908	45,941
	半成品	307	307	305	305
	在製品	548,241	553,404	535,102	535,936
	製成品	—	—	417	417
	總計	608,706	613,975	581,731	582,599
備抵存貨跌價損失及呆滯 損失		7,414	7,414	16,894	16,918
期末存貨淨額		601,292	606,561	564,837	565,681
存貨週轉率(次)		1.10	1.12	1.03	1.04
存貨週轉天數(天)		332	326	355	351

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之個體及合併財務報告

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究、製造及銷售等業務，其合併報表編製主體包含該公司本身暨其轉投資公司昇和精技公司。其中該公司統籌集團經營策略，主要負責 EUV 光罩設備、高階光罩設備及零組件及維修服務等，而子公司昇和精技公司則負責 PVD 真空技術相關機台設計及改造。該公司及其子公司其主要原物料為質量流量控制器及微塵過濾器電料、金屬加工件及電控、管路組件等；半成品主係機台維修備料等；在製品為尚在組裝及已出貨予客戶尚未驗收之之機台；製成品為已完工待出售之產品。該公司及其子公司之存貨主係依銷售客戶訂單需求而備料並投入生產，整體生產週期約需 3~4 個月。

(1)個體財務報告

該公司 111~112 年之個體財務報告存貨淨額分別為 601,292 千元及 564,837 千元，112 年底存貨淨額較 111 年底減少 36,455 千元，主係因配合客戶訂單交期調整進貨，使原物料金額下降，此外，111 年度已出貨未驗收之在製品於 112 年度已陸續完成驗收，致在製品金額下降。綜上所述，該公司最近兩年度存貨淨額變化主係因訂單需求調整進貨及投入生產所致，尚無重大異常情事。

在存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司 111~112 年度之存貨週轉率分別為 1.10 次及 1.03 次；週轉天數分別為 332 天及 355 天，112 年度存貨週轉率較 111 年度下降，主係 112 年度平均存貨受期初已出貨未驗收之機台較多，使平均存貨上升 12.86%，另 111 年度已出貨未驗收之機台於 112 年度陸續完成驗收

認列收入，使營業收入成長連帶影響營業成本增加 5.13%，惟在平均存貨上升幅度大於營業成本增加幅度下，致存貨週轉率下降，週轉天數上升。該公司在製成品受半導體設備產業特性影響，使該公司之已出貨但客戶尚未驗收之機台皆帳列在製品，惟其驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，致其驗收時間較長，該部分已於出貨後收取預收貨款，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司 111~112 年度之個體財務報告存貨淨額、週轉率及週轉天數變動情形尚屬合理，並無重大異常之情形。

(2) 合併財務報告

該公司及其子公司 111~112 年底合併財務報告存貨淨額分別為 606,561 千元及 565,681 千元，112 年底存貨淨額較 111 年底減少 40,880 千元，主係因配合客戶訂單交期調整進貨，使原物料金額下降，此外，111 年度已出貨未驗收之在製品於 112 年陸續完成驗收認列收入，使在製品金額下降，致整體存貨淨額減少，尚無重大異常情事。

在存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司及其子公司於 111~112 年度存貨週轉率分別為 1.12 次及 1.04 次；週轉天數分別為 326 天及 351 天，112 年度較 111 年度存貨週轉率下降，主係 112 年度平均存貨受期初已出貨未驗收之機台較多，使平均存貨上升 12.23%，另 111 年度已出貨未驗收之機台於 112 年度陸續完成驗收認列收入，使營業收入成長連帶影響營業成本增加 4.11%，惟在平均存貨上升幅度大於營業成本增加幅度下，致存貨週轉率下降，週轉天數上升。使該公司及其子公司之已出貨但客戶尚未驗收之機台皆帳列在製品，惟其驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，致其驗收時間較長，該部分已於出貨後收取預收貨款，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司 111~112 年底之合併財務報告存貨淨額、週轉率及週轉天數變動情形尚屬合理，並無重大異常之情形。

2. 最近期存貨去化情形

單位：新臺幣千元

項 目	112 年 12 月底 存貨金額	截至 113 年 2 月底 存貨去化情形		113 年 2 月底 餘額
		金額	比率(%)	
原 物 料	45,941	12,629	27.49	33,312
半 成 品	305	—	—	305
在 製 品	535,936	122,622	22.88	413,314
製 成 品	417	—	—	417
合 計	582,599	135,251	23.22	447,348

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司 112 年 12 月底存貨總額為 582,599 千元，截至 113 年 2 月底存貨去化金額為 135,251 千元，去化比率為 23.22%，未去化金額 447,348 千元，未去化比率為 76.78%，茲就各項存貨之去化情形分別說明如下：

(1)原物料

原物料存貨總額為 45,941 千元，占期末存貨總額 7.89%，截至 113 年 2 月底存貨去化金額為 12,629 千元，去化比率為 27.49%。未去化之原物料金額為 33,312 千元，其原物料主要為電料、金屬加工件及電控、管路組件等，主係依客戶訂單需求備料，原物料未去化金額占 113 年 2 月底比率 72.51%，惟該公司及其子公司營收持續增長，因應客戶訂單需求進行備料係有其必要性與合理性，經評估尚無重大異常之情事。

(2)半成品

半成品存貨總額為 305 千元，占期末存貨總額 0.05%，截至 113 年 2 月底存貨去化金額為 0 千元，去化比率為 0.00%。未去化之半成品金額為 305 千元，主係機台維修備料，占整體存貨總額之金額微小，經評估尚無重大異常情事。

(3)在製品

在製品存貨總額為 535,936 千元，占期末存貨總額 91.99%，截至 113 年 2 月底存貨去化金額為 122,622 千元，去化比率為 22.88%。未去化之在製品金額為 413,314 千元，包含尚在組裝之機台 114,058 千元及已出貨予客戶尚未驗收之機台 299,256 千元，其中已出貨予客戶尚未驗收之機台，其驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，有驗收時程較長之情形，惟該公司及其子公司於設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，應無存貨跌價或遭客戶取消訂單之風險，經評估尚無重大異常之情事。

(4)製成品

製成品存貨總額為 417 千元，占期末存貨總額 0.07%，截至 113 年 2 月底存貨去化金額為 0 千元，去化比率為 0.00%。未去化之製成品金額為 417 千元，主係已出貨尚未驗收之小型高階光罩儲存設備，經評估尚無重大異常情事。

3.備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列適足性之評估

(1)備抵存貨跌價損失提列政策

該公司及其子公司存貨係以成本與淨變現價值孰低法衡量，存貨成本之計算係採加權平均法，比較成本與淨變現價值孰低時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚須投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(2)備抵存貨呆滯損失提列政策

A.110 年度(含)以前

(A)該公司及其子公司 110 年度(含)以前，存貨呆滯損失提列政策如下：

項目	庫齡	1 年以下	1 年~2 年	2~3 年以上	3 年以上
	原物料		0%	25%	50%
半成品		0%	100%	0%	0%
在製品		0%	100%	0%	0%
製成品		0%	100%	0%	0%

資料來源：該公司及其子公司提供

(B)已出貨逾一年之在製品，依期末成本高於已收取款項之金額差額提列 100% 之備抵呆滯損失，採逐項認定。

(C)未出貨逾一年之在製品，採逐項認定。

B.111 年度以後

該公司及其子公司之存貨為客製化訂單生產，依客戶訂單進行備料，基於穩健原則，以採購入庫日做為庫齡計算基礎，並依存貨實際去化情形、產品性質、同業提列政策及過去生產週期評估後，於 111 年 12 月 24 日經核准通過訂定備抵跌價及呆滯損失提列政策如下：

(A)針對原物料、半成品、在製品及製成品提列呆滯損失如下：

項目	庫齡	1 年以下	1 年以上
	原物料		0%
半成品		0%	100%
在製品		0%	100%
製成品		0%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供

(B)已出貨逾一年之在製品，依期末成本高於已收取款項之金額差額提列 100% 之備抵呆滯損失，採逐項認定。

(C)未出貨逾一年之在製品，採逐項認定。

該公司及其子公司之存貨以在製品為主，原物料次之，原物料主係電料、金屬加工件及電控、管路組件等；在製品主係尚在組裝及已出貨予客戶尚未驗收之機台。其多數原物料交期平均約為 1 個月，少數機台之專用料件交期平均約為 3~6 個月，此外，該公司及其子公司定期開立產銷會議檢視原物料庫存、客戶訂單及預測未來訂單情形隨時調整其原物料進貨數量，在製品部分多數為已出貨予客戶尚未驗收之機台，其機台驗收時程受客戶機台安裝及驗收測試排程影響，致

驗收時程較長，其可能驗收時程可能為出貨後 3~12 個月。在考量上述因素及自 110 年度起該公司及其子公司逐步增長之業績與營運規模、加強存貨庫存管理效益及提升存貨流動性，依存貨實際去化情形、產品性質、同業提列政策及過去生產週期評估後，根據穩健原則，該公司及其子公司遂於 111 年度改變其原物料之備抵存貨呆滯損失提列方式，以庫齡超過一年以上提列 100%備抵存貨呆滯損失，其餘則維持不變。

綜上評估，該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策係以國際會計準則為依據，並考量所處行業特性、產品性質、產品生命週期及過往產銷經驗等，經評估其提列政策尚屬合理，並未發現重大異常之情事。

(2)備抵存貨跌價及呆滯損失提列適足性之評估

單位：新臺幣千元；%

項目	111 年度		112 年度	
	個體	合併	個體	合併
備抵存貨跌價及呆滯損失期末餘額(A)	7,414	7,414	16,894	16,918
存貨總額(B)	608,706	613,975	581,731	582,599
提列比率(A)/(B)(%)	1.22	1.21	2.90	2.90

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之個體及合併財務報告

A.個體財務報告

該公司 111~112 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 7,414 千元及 16,894 千元，占各期期末存貨總額比率分別為 1.22%及 2.90%，112 年度提列比例較 111 年度增加，主係因該公司配合客戶訂單交期，致備料時程及產品生產週期增加，使其提列金額上升。惟該公司各年度均依照訂定之提列政策執行，經評估該公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額尚屬適足，並無重大異常情事。

B.合併財務報告

該公司 111~112 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 7,414 千元及 16,918 千元，占各期期末存貨總額比率分別為 1.21%及 2.90%。其中子公司昇和精技 112 年度呆滯提列 24 千元，占合併財務報告存貨跌價及呆滯損失金額 0.14%，故合併財務報告 111~112 年度之之備抵存貨跌價及呆滯損失金額變動，主係因該公司配合客戶訂單交期，致備料時程及產品生產週期增加，使其提列金額增加。惟該公司及其子公司各年度均依照訂定之提列政策執行，經評估該公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額尚屬適足，無重大異常情事。

4.同業比較

單位：新臺幣千元；次；天；%

項目	年度	111 年度		112 年度	
		個體	合併	個體	合併
營業成本	家碩	582,211	597,074	612,060	621,607
	京鼎	9,619,283	10,399,687	8,241,865	9,636,790
	華景電	641,378	683,179	505,398	634,951
	天虹	1,079,411	969,505	947,957	1,115,501
期末存貨總額 (B)	家碩	608,706	613,975	581,731	582,599
	京鼎	546,582	3,867,885	540,169	2,708,768
	華景電	387,638	492,963	444,555	581,431
	天虹	1,026,679	1,127,893	1,143,104	1,227,347
備抵存貨跌價 及呆滯損失 (A)	家碩	7,414	7,414	16,894	16,918
	京鼎	2,047	60,832	2,492	88,639
	華景電	43,119	44,539	52,781	58,969
	天虹	120,372	125,238	73,912	83,779
期末存貨淨額	家碩	601,292	606,561	564,837	565,681
	京鼎	544,535	3,807,053	537,677	2,620,129
	華景電	344,519	448,424	391,774	522,462
	天虹	906,307	1,002,655	1,069,192	1,143,568
備抵存貨跌價 及呆滯損失提 列比率(%) (A)/(B)	家碩	1.22	1.21	2.90	2.90
	京鼎	0.37	1.57	0.46	3.27
	華景電	11.12	9.03	11.87	10.14
	天虹	11.72	11.10	6.47	6.83
存貨週轉率(次)	家碩	1.10	1.12	1.03	1.04
	京鼎	17.91	3.06	15.17	2.93
	華景電	1.64	1.42	1.21	1.18
	天虹	1.14	0.99	0.87	0.95
存貨週轉天數 (天)	家碩	332	326	355	351
	京鼎	21	120	24	125
	華景電	223	258	301	309
	天虹	321	369	418	385

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之個體及合併財務報告

(1)個體財務報告

該公司 111~112 年度之個體存貨週轉率分別為 1.10 次及 1.03 次，個體存貨週轉天數分別為 332 天及 355 天，與採樣同業相較，該公司 111 年度存貨週轉率低於採樣同業公司；112 年度存貨週轉率高於天虹，低於其他採樣同業，主係因該公司持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使存貨週轉率較採樣同業及同業平均為低，惟該公司之產品

主要係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，並考量該公司及採樣同業間其銷售產品及策略以及公司營運規模皆有所不同。整體而言，該公司個體存貨週轉率應無重大異常情形。

該公司 111~112 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率分別為 1.22%及 2.90%，與採樣同業相較，京鼎採多角化經營，其產品涵蓋半導體、顯示器、光電及綠能、工廠自動化等產業之先進製程暨自動化設備，主要為半導體設備製造商進行代工，其相關存貨去化速度較快，備抵存貨跌價及呆滯損失提列比例較低；華景電主要業務為半導體晶圓製程 AMC 微污染防治設備及 RFID 整合派工系統解決方案，因其原物料規格眾多，為避免斷料及進貨時間影響排程，且受訂單需求增加、分批交貨交期拉長及供應商最低採購量限制，致使有部分存貨庫齡較長，備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額較高；天虹主要產品有物理氣相沉積設備、原子層沉積設備、鍵合機、解鍵合機等薄膜製程設備及設備零備件，其中設備依客戶訂單需求備料外，設備零備件受零件稀缺性及供應商最低採購量影響其備料，其將存貨中屬標準品零件且呆滯過久者，視是否有未來訂單支應提列備抵存貨跌價及呆滯損失，使備抵存貨跌價及呆滯損失提列為高。綜上所述，該公司與採樣公司在銷售產品及營運規模不盡相同，其備抵存貨跌價及呆滯損失提列比例介於採樣同業間，且皆依訂定之提列政策執行，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司最近二年度之存貨變動及其週轉率變化情形與採樣同業比較評估、備抵存貨跌價及呆滯損失提列之適足性，尚無重大異常之情事。

(2)合併財務報告

該公司及其子公司 111~112 年度之合併存貨週轉率分別為 1.12 次及 1.04 次，合併存貨週轉天數分別為 326 天及 351 天，與採樣同業相較，該公司及其子公司 111~112 年度存貨週轉率高於天虹，低於其他採樣同業，主係因該公司及其子公司持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司及其子公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司及其子公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使存貨週轉率較採樣同業及同業平均為低，惟該公司及其子公司之產品主要係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，並考量該公司及採樣同業間其銷售產品及策略

以及公司營運規模皆有所不同。整體而言，該公司及其子公司合併存貨週轉率應無重大異常情形。

該公司及其子公司 111~112 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率分別為 1.21%及 2.90%，與採樣同業相較，111~112 年度之備抵存貨跌價及呆滯損失皆低於同業，主係其依客戶訂單進行備料生產，並訂期開立產銷會議檢視原物料庫存、客戶訂單及預測未來訂單情形隨時調整其原物料進貨數量及投入生產情形，積極管控其存貨庫齡，降低其存貨跌價及呆滯之風險。惟該公司及其子公司與採樣同業間之銷售產品、存貨組成及公司營運規模不盡相同，且其皆依訂定之提列政策執行，經評估該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額應屬適足，無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近二年度及最近期之存貨變動及其週轉率變化情形與採樣同業比較評估、備抵存貨跌價及呆滯損失提列之適足性，尚無重大異常之情事。

(四)申請公司最三年度及申請年度截至最近期之業績概況

1.列表並說明發行公司最近期及最近三個會計年度營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	110 年度	111 年度		112 年度	
		金額	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)
營業收入	家碩	601,932	1,047,953	74.10	1,207,145	15.19
	京鼎	12,246,437	14,843,221	21.20	13,051,357	(12.07)
	華景電	1,089,854	1,416,410	29.96	1,370,598	(3.23)
	天虹	1,655,712	1,815,477	9.65	1,992,643	9.76
營業毛利	家碩	215,994	450,879	108.75	585,538	29.87
	京鼎	3,092,667	4,443,534	43.68	3,414,567	(23.16)
	華景電	553,826	733,231	32.39	735,647	0.33
	天虹	662,528	845,972	27.69	877,142	3.68
營業利益	家碩	113,203	242,329	114.07	260,034	7.31
	京鼎	1,988,339	2,951,060	48.42	2,030,033	(31.21)
	華景電	294,243	434,807	47.77	361,795	(16.79)
	天虹	190,685	288,343	51.21	322,639	11.89

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司主要從事光罩相關半導體設備之研究開發、製造及銷售等業務，目前主要設備產品主係應用於極紫外光(EUV)、深紫外光(DUV)等製程所需之光罩傳載解決方案，包含檢查、交換、存取與儲存、充氣及清潔等功能，銷售產品區分為 EUV 光罩設備、高階光罩設備及其他。檢視目前上市櫃公司，選樣條件以產業類別同屬半導體設備之公司，並參酌營業項目較為相近者，選取京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱京鼎，股票代碼 3413，上市半導體業)、華景電通股份有限公司(以下簡稱華景電，股票代碼 6788 上櫃半導體業)、天虹科技股份有限公司(以

下簡稱天虹，股票代碼 6937，上市半導體業)作為採樣同業。京鼎主要經營業務為半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務、半導體/工業自動化高端設備之研發、製造及銷售等；華景電主要營業項目為半導體製程微污染防治設備與 RFID 自動化派工系統解決方案之研發、生產與銷售；天虹主要營業項目為半導體設備及相關零組件之研發、生產與銷售等，主要產品有物理氣相沉積設備、鍵合機、解鍵合機與原子層沉積設備等薄膜製程設備。

茲就該公司及其子公司與採樣同業京鼎、華景電及天虹之營業收入、營業毛利及營業利益比較說明如下：

(1)營業收入

該公司及其子公司 110~112 年度之營業收入分別為 601,932 千元、1,047,953 千元及 1,207,145 千元，營業收入成長率分別為 74.10%及 15.19%。111 年度營業收入成長 74.10%，主係該公司及其子公司除持續深耕既有客戶外，客戶擴廠計畫持續進行，積極尋求微影製程中光罩潔淨之解決方案，使該公司及其子公司整體光罩相關之機器設備營業收入增加 410,744 千元。112 年度營業收入成長 15.19%，主要係因該公司及其子公司高階光罩相關機器設備深受客戶青睞，並持續提供客戶客製化之機器設備及服務，使該公司及其子公司高階光罩相關機器設備營業收入增加 218,376 千元。

與採樣同業相較，除京鼎及華景電 112 年度營收下降外，該公司及其子公司與採樣同業 110~112 年度之營業收入皆呈現持續成長，111 年初起，因新型冠轉病毒疫情造成的區域封鎖、烏克蘭衝突、地緣政治的緊張局勢及貿易限制，使消費性產品需求放緩，惟在巨量數據運算及應用創新的驅動下，高速運算及 5G 相關應用等產業的成長，使得長期半導體需求結構性增長依然強勁，使 111~112 年該公司及其子公司與採樣同樣營收成長。整體而言，該公司及其子公司與採樣同業之營業收入均呈現成長態勢，尚無異常之情事。

綜上所述，110 年因 COVID 疫情持續蔓延，對於供應鏈中斷的疑慮及遠端生活型帶加速了數位轉型，使得全球對半導體的需求增加，111 年起雖烏俄戰爭、地緣政治與貿易限制的衝擊，但來自 5G 及高效能運算相關應用等產業的長期趨勢，使長期半導體需求仍持續增長，除京鼎及華景電 112 年度營收呈下降，其餘各公司最近三年度之營業收入均呈現成長趨勢，惟各公司之產品組合及銷售市場略有不同，致使營收成長之幅度亦有所差異，經評估應無重大異常之情事。

(2)營業毛利

單位：新臺幣千元；%

年度 公司	110 年度		111 年度		112 年度	
	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)
家碩	215,994	35.88	450,879	43.02	585,538	48.51
京鼎	3,092,667	25.25	4,443,534	29.94	3,414,567	26.16
華景電	553,826	50.82	733,231	51.77	735,647	53.67
天虹	662,528	40.01	845,972	46.60	877,142	44.02

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司 110~112 年度之營業毛利分別為 215,994 千元、450,879 千元及 585,538 千元，毛利率分別為 35.88%、43.02%及 48.51%。110~112 年度營業毛利分別較上一年度同期增加 234,885 千元及 134,659 千元，主係隨營業收入成長而增加。該公司及其子公司 110~112 年度毛利率逐年成長主係因該公司及其子公司持續開發客製化之功能性機器設備，且經過往的經驗累積，該公司及其子公司組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，使毛利率上升。

與採樣同業相較，各公司毛利率變動主係受其產品組合變化所影響，該公司及其子公司 111~112 年度之毛利率均係介於採樣同業之間。整體而言，該公司及其子公司之營業毛利變動應無重大異常之情事。

(3)營業利益

單位：新臺幣千元；%

年度 公司	110 年度		111 年度		112 年度	
	金額	營業 利益率(%)	金額	營業 利益率(%)	金額	營業 利益率(%)
家碩	113,203	18.81	242,329	23.12	260,034	21.54
京鼎	1,988,339	16.24	2,951,060	19.88	2,030,033	15.55
華景電	294,243	27.00	434,807	30.70	361,795	26.40
天虹	190,685	11.52	288,343	15.88	322,639	16.19

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司 110~112 年度之營業利益分別為 113,203 千元、242,329 千元及 260,034 千元，營業利益率分別為 18.81%、23.12%及 21.54%。111 年度之營業利益及營業利益率持續較 110 年度成長主係該公司及其子公司受惠於半導體代工業者持續擴充產能，致推升半導體設備需求增加，使其營業收入持續成長，加上該公司及其子公司持續開發客製化之功能性機器設備，且經過往的經驗累積，該公司及其子公司組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，使營業毛利及毛利率亦呈現上升，致使其營業利益及營業利益率持續成長；112 年度營業利益較 111 年度增加 17,705 千元，營業利益率下降至 21.54%，主係 112 年度毛利較高之高階光罩相關機器設備銷售成長，致毛利率及

營業毛利較去年同期上升，另因應營運規模成長而新聘員工且相應之董事及員工酬勞上升，且該公司持續投入研發，使營業費用上升，綜上因素使 112 年度營業費用亦較去年同期增加，整體營業費用增加幅度高於營業收入及營業毛利，致 112 年度營業利益率較 111 年度微幅下降，經評估其變動情形應尚屬合理。

與採樣同業相較，110~112 年度該公司及其子公司之營業利益率介於採樣同業之間，產品毛利率及營業利益均有所上升，經評估應無重大異常情事。

2. 列表並說明最近期及最近三個會計年度以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

主要產品別銷貨收入變動表

單位：新臺幣千元

產品別	年度	110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關機器設備		345,857	57.46	539,223	51.45	466,607	38.66
高階光罩相關機器設備		158,199	26.28	375,577	35.84	593,953	49.20
其他		97,876	16.26	133,153	12.71	146,585	12.14
合計		601,932	100.00	1,047,953	100.00	1,207,145	100.00

主要產品別銷貨成本變動表

單位：新臺幣千元

產品別	年度	110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關機器設備		239,100	61.95	357,493	59.87	271,738	43.72
高階光罩相關機器設備		102,294	26.51	198,642	33.27	309,203	49.74
其他		44,544	11.54	40,939	6.86	40,666	6.54
合計		385,938	100.00	597,074	100.00	621,607	100.00

主要產品別銷貨毛利變動表

單位：新臺幣千元

產品別	年度	110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
EUV 光罩相關機器設備		106,757	49.43	181,730	40.31	194,869	33.28
高階光罩相關機器設備		55,905	25.88	176,935	39.24	284,750	48.63
其他		53,332	24.69	92,214	20.45	105,919	18.09
合計		215,994	100.00	450,879	100.00	585,538	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司主要從事半導體設備之研究開發、製造及銷售，主要產品為 EUV 光罩相關機器設備、高階光罩相關設備及其他等。茲就該公司及其子公司主要產品別營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形說明如下：

(1) EUV 光罩相關機器設備

該公司及其子公司 EUV 光罩相關機器設備主要包含 EUV 光罩儲存櫃、EUV 光罩清洗機、EUV 光罩檢測機等客製化功能性機器設備，主係應用於 EUV 半導體之微影製程，並提供 EUV 光罩微環境防治之解決方案。該公司及其子公司 110~112 年度 EUV 光罩相關機器設備之營業收入分別為 345,857 千元、539,223 千元及 466,607 千元，其占整體營業收入淨額之比率分別為 57.46%、51.45%及 43.72%。111 年度銷售 EUV 光罩相關半導體設備金額較 110 年度增加 193,366 千元，主要係因應晶圓代工廠擴產，客戶對於大型之 EUV 光罩相關機器設備需求增加，雖機台數量並無成長，惟大型機台銷售占比上升，使 111 年度之 EUV 光罩相關半導體設備銷售金額增加；112 年度銷售金額較 111 年度減少 72,616 千元，主要係 112 年度因深耕既有客戶，EUV 光罩相關半導體設備銷售機台數量成長，惟單價較低之小型 EUV 光罩相關半導體銷售占比較高，使 112 年度之 EUV 光罩相關半導體設備銷售金額較 111 年度下降。

該公司及其子公司 110~112 年度 EUV 光罩相關機器設備之營業成本分別為 239,100 千元、357,493 千元及 271,738 千元，營業毛利分別為 106,757 千元、181,730 千元及 194,869 千元，毛利率分別為 30.87%、33.70%及 41.76%。110~112 年度 EUV 光罩相關機器設備之毛利率逐年增加，主係因該公司及其子公司持續開發高毛利之功能性設備及拓展小型機台設備之市場，且因應客戶需求調整產品整合模式，使生產效率提升，另透過過往的經驗累積，該公司及其公司更具備組裝經驗及客製化調整之能力，使機台組裝成本降低所致。整體而言，其變化尚無異常之情事。

(2) 高階光罩相關機器設備

該公司及其子公司高階光罩相關機器設備主要包含高階光罩儲存櫃、高階光罩清洗機、高階光罩交換機及高階光罩轉換機等客製化功能性機器設備，主係應用於 DUV 半導體之微影製程，並提供高階光罩微環境防治之解決方案。該公司及其子公司 110~112 年度高階光罩相關設備之營業收入分別為 158,199 千元、375,577 千元及 593,953 千元，占整體營業收入淨額之比率分別為 26.28%、35.84%及 49.20%。110~112 年度銷售高階光罩相關機器設備金額逐年成長，主要係因全球晶圓代工廠持續新建廠房，該公司及其子公司除配合客戶擴廠所須之設備需求外，並積極拓協助客戶開發其產線所須之客製化設備，故相關設備產品持續受到客戶青睞，使該公司及其子公司之高階光罩相關設備銷貨金額大增。

該公司及其子公司 110~112 年度高階光罩相關設備之營業成本分別為 102,294 千元、198,642 千元及 309,203 千元，營業毛利分別為 55,905 千元、176,935 千元及 284,750 千元，毛利率分別為 35.34%、47.11%及 47.94%。111~112 年度主要係因銷售產品均為毛利率較高之小型高階光罩儲存櫃及其他功能性機器設

備且銷售設備之數量亦均較前期增加，致使 111~112 年度高階光罩相關機器設備之營業毛利及毛利率均較前期成長。整體而言，其變化尚無異常之情事。

(3)其他

該公司及其子公司其他產品主要為機台客製化改造、修改、維修及機台設備零組件買賣等。該公司及其子公司 110~112 年度其他之營業收入分別為 97,876 千元、133,153 千元及 146,585 千元，占整體營業收入淨額之比率分別為 16.26%、12.71%及 12.14%。110~111 年度來自其他之營業收入金額逐年成長，主要係隨機台設備銷售數量持續增加，所衍生之維修服務、機台改造、零組件更換等持續增加所致。

該公司及其子公司 110~112 年度來自其他之營業成本分別為 44,544 千元、40,938 千元及 40,666 千元，營業毛利分別為 53,332 千元、92,214 千元及 105,919 千元，毛利率分別為 54.49%、69.25%及 72.26%。111 年度來自其他之營業毛利較 110 年度增加 38,882 千元，毛利率上升 14.76%，主係 111 年度該公司新增較多來自客戶客製化機台修改之需求，此類服務毛利率較高，故使營業毛利及毛利率均較前一年度增加；112 年度來自其他之營業毛利較 111 年度增加 13,705 千元，毛利率上升 3.01%，營業毛利隨營業收入上升而微幅增加，毛利率亦微幅上升。整體而言，其變化尚無異常之情事。

3.最近期及最近三個會計年度營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度之營業收入及毛利率變動率如下表所示：

單位：新臺幣千元

項目	年度	111 年度		112 年度	
	110 年度	金額	變動率	金額	變動率
營業收入	601,932	1,047,953	74.10	1,207,145	15.19
營業毛利	215,994	450,879	108.75	585,538	29.87
毛利率(%)	35.88	43.02	19.90	48.51	12.76

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司 110~111 年度之營業收入變動率達 20%以上，故進行價量分析。另該公司及其子公司之其他收入，主係例行或一次性維修服務、機台客製化改造、修改及零備件銷售，且非屬主要量產之產品業務，故不擬評估其價量分析。以下茲就該公司及其子公司之主要產品別價量變動情形及合理性分析說明如下：

單位：新臺幣千元

主要產品	分析項目	110 及 111 年度
EUV 相關 半導體 設備	(一)營業收入差異分析：	
	P(Q'-Q)	(37,056)
	Q(P'-P)	258,073
	(P'-P)(Q'-Q)	(27,651)
	P'Q'-PQ	193,366
	(二)營業成本差異分析：	
	P(Q'-Q)	(25,618)
	Q(P'-P)	161,292
	(P'-P)(Q'-Q)	(17,281)
	P'Q'-PQ	118,393
	(三)毛利變動金額：	74,973
高階 相關 半導體 設備	(一)營業收入差異分析：	
	P(Q'-Q)	213,707
	Q(P'-P)	1,561
	(P'-P)(Q'-Q)	2,110
	P'Q'-PQ	217,378
	(二)營業成本差異分析：	
	P(Q'-Q)	138,185
	Q(P'-P)	(17,796)
	(P'-P)(Q'-Q)	(24,041)
	P'Q'-PQ	96,348
	(三)毛利變動金額：	121,030

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：P'、Q' 為本期之單價及數量；P、Q 為前期之單價及數量

(1) EUV 相關半導體設備

A.110 及 111 年度

(A) 營業收入增加 193,366 千元

111 年 EUV 光罩銷售數量微幅下降，故產生數量不利差異 37,056 千元，然配合客戶廠區規劃，使單價較高之大型 EUV 儲存櫃銷售及功能性機器設備占比成長，故 111 年產生價格有利差異 258,073 千元，價量相乘效果產生營業收入組合不利差異 27,651 千元。

(B) 營業成本增加 118,393 千元

111 年度 EUV 光罩銷售數量微幅下降，故產生數量有利差異 25,618 千元，然 111 年度大型 EUV 光罩儲存櫃銷售占比成長且高單價功能性機器設備銷售數量增加，使平均單位成本增加，故產生價格不利差異 161,292 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 17,281 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 111 年度 EUV 相關半導體設備之營業毛利較 110 年度增加 74,973 千元。

(2)高階相關半導體設備

A.110 及 111 年度

(A)營業收入增加 217,378 千元

為支撐高效能運算及汽車等關鍵終端市場之長期成長與創新需求，推升產能，推升全球晶圓廠產能，延續擴廠計畫，且該公司及其子公司積極拓展客戶，故 111 年高階光罩相關機器設備產生數量有利差異 213,707 千元；111 年度因海外客戶小型高階光罩儲存櫃及功能性機台需求提升，因海外客戶因裝機及驗證成本較高，故售價亦提高，使小型高階光罩機器設備及功能性機台單價上升，致整體高階光罩相關機器設備單價上升，故產生價格有利差異 1,561 千元，價量相乘效果產生營業收入組合有利差異 2,110 千元。

(B)營業成本增加 96,348 千元

111 年度因高階光罩相關機器設備銷售數量上升，故產生數量不利差異 138,185 千元，該客戶針對高階相關光罩設備之組裝經驗及客製化功能之調整效率之提升，使機台組裝之投入成本降低，故 111 年度高階光罩相關機器設備產生價格有利差異 17,796 千元，價量相乘效果產生營業成本組合有利差異 24,041 千元。

綜上所述，該公司及其子公司 111 年度高階相關半導體設備之營業毛利較 110 年度增加 121,030 千元。

經評估該公司及其子公司 110~112 年度之主要產品別之營業收入、營業成本與營業毛利之變化情形，及其價量變化情形，尚屬合理，應無重大異常情事。

(五)最近三年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包含母子公司間交易事項)與關係人交易之評估

1.與關係人間業務交易往來情形，以評估其有無涉及非常規交易情事，如屬銷貨予關係人者，則再評估授信政策、交易條件、款項收回、所售產品關係人後續投入生產或再銷售之情形及其合理性，如未符一般交易常規，其差異之原因及合理性

(1)個體財務報告

A.關係人之名稱及關係

關係人名稱	與該公司之關係
家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)	母公司
昇和精技股份有限公司	子公司
Gudeng Inc.(以下簡稱家登美國公司)	兄弟公司
家崎科技股份有限公司(以下簡稱家崎公司)	兄弟公司
上海家登貿易有限公司(以下簡稱上海家登公司)	兄弟公司
堯鉦系統科技股份有限公司(以下簡稱堯鉦公司)	實質關係人
鍊恩帕斯科技股份有限公司(以下簡稱鍊恩帕斯公司)	實質關係人

B.關係人重大交易事項

(A)營業收入

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	328	1,672	367
上海家登公司	-	-	58
合計	328	1,672	425

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

(B)應收款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	-	101	-
合計	-	101	-

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

a.家登公司

該公司 110~112 年度對家登公司營業收入金額分別為 328 千元、1,672 千元及 367 千元，應收帳款金額分別為 0 千元、101 千元及 0 千元。家登公司 87 年成立於臺灣，主要營業項目為光罩及晶圓載板之傳載解決方案等，主要客戶為半導體晶圓廠及面板廠，並提供在地化服務，該公司

110~112 年度主要係提供機台改造服務及銷售機器設備相關耗材等，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為發票日後月結 35 天內付款，其交易條件與收款情形與一般銷售客戶相較，尚無重大異常之情形。

b.上海家登公司

該公司 110~112 年度對上海家登公司營業收入金額分別為 0 千元、0 千元及 58 千元，應收帳款金額皆為 0 千元。上海家登公司 110 年成立於中國上海，主要營業項目為塑膠製品、電子五金及五金交電等批發進出口，主要客戶為半導體晶圓廠及面板廠，該公司 112 年度主要係銷售銷售機器設備相關耗材等，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為發票日後月結 30 天內付款，其交易條件與收款情形與一般銷售客戶相較，尚無重大異常之情形。

(C)進貨

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	9,481	10,353	10,578
昇和精技公司	-	-	2,799
家登美國公司	-	105	-
家崎公司	-	-	231
壺鎡公司	-	-	19,882
鍊恩帕斯公司	-	-	33,350
合計	9,481	10,458	66,840

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

(D)應付款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	1,487	1,689	2,046
昇和公司	-	-	542
壺鎡公司	-	-	3,344
鍊恩帕斯公司	-	-	14,387
合計	1,487	1,689	20,319

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

a. 家登公司

該公司 110~112 年度對家登公司進貨金額分別為 9,481 千元、10,353 千元及 10,578 千元，應付帳款金額分別為 1,487 千元、1,689 千元及 2,046 千元。該公司 110~112 年向家登公司主要進貨項目為 PEEK 含管充氣頭及光罩盒等，其產品皆運用於 EUV 光罩相關設備中，該等進貨商品皆為客戶指定供應商及習慣用料，且為製程需求，考量其品質較佳，故持續與家登公司配合進貨。經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

b. 昇和精技公司

該公司 110~112 年度對昇和進貨金額分別為 0 千元、0 千元及 2,799 千元，應付帳款金額為 0 千元、0 千元及 542 千元。該公司為因應海外客戶交機需求，請昇和協助機器設備機構之組裝工程，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 60 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

c. 家登美國公司

該公司 110~112 年度對家登美國公司進貨金額分別為 0 千元、105 千元及 0 千元，應付帳款金額皆為 0 千元。該公司為因應美國客戶需求，外派人員至美國進行裝機及維修服務，外派期間借宿家登美國公司之宿舍所產生之專案成本，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 60 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

d. 家崎公司

該公司 110~112 年度對家崎公司進貨金額分別為 0 千元、0 千元及 231 千元，應付帳款金額皆為 0 千元。該公司因研發設備之需求，向家崎公司採購實驗及檢查用之晶圓片，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

e. 堯鉸公司

堯鉸公司因 112 年 2 月改選董事，成為該公司及其子公司之實質關係人。該公司 112 年度對堯鉸公司進貨金額為 19,882 千元，應付帳款金額為 3,344 千元。該公司因生產設備之需求，向堯鉸公司採購電控、管路組件及電料等材料，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

f. 鍊恩帕斯公司

鍊恩帕斯公司於 112 年 7 月成為該公司之實質關係人，該公司 112 年度對鍊恩帕斯公司進貨金額為 33,350 千元，應付帳款金額為 14,387 千元。該公司因生產設備之需求，向壺鉞公司採購電控、管路組件等材料，經核閱相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 90 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

(E)取得之不動產、廠房及設備

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	-	-	1,340

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

該公司及其子公司自成立初期即與家登公司購入 PEEK 含管充氣頭，然近期為使產品優化，再度與家登公司共同研發新型 PEEK 含管充氣頭，並向家登公司購買該等模具，經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(F)承租協議

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司			
取得使用權資產	7,866	-	17,045
租賃負債	3,965	-	13,754
利息費用	99	35	271

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

該公司向家登公司租賃樹谷工業園區之廠商做生產營業之用途，因作為長期生產基地使用，於 110 年簽訂兩年期，並於 111 年底到期後續簽五年期合約，故產生使用權資產、租賃負債及相關利息費用，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(G)租金支出

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	(32)	23	20
家登美國公司	-	-	62
合計	(32)	23	82

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

a. 家登公司

該公司 109 年起向家登公司承租位於臺南樹谷園區之廠房作為生產基地，向其以每月 333 千元承租無塵室、組裝區及辦公室等，作為新的生產基地，該公司依雙方合約議定之價款按月支付；另，該公司自成立之初，向家登公司借址登記於臺北土城，每月支付 1 千元作為租金。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

b. 家登美國公司

係該公司員工至美國出差，惟該公司於美國並無設立據點，是以由家登美國公司出租宿舍給該員工，再由該公司支付予家登美國公司之費用支出。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(H)其他關係人交易

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
其他費用—家登公司	1,732	790	3,069
其他費用—家登美國公司	-	-	166
其他費用—上海家登公司	-	-	89
利息收入—家登公司	(47)	9	9
租金收入—昇和精技公司	-	720	720
存出保證金—家登公司	669	669	596
其他應付款—家登公司	904	111	220
合約負債—家登公司	120	96	13,500
合約負債—上海家登公司	-	-	18,419

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之個體財務報告

a.其他費用—家登公司

該公司 110~112 年度對家登公司其他費用金額分別為 1,732 千元、790 千元及 3,069 千元，主係該公司搬遷至樹谷園區後，承租區域所產生的水電費用、租借公務車及文具費用等費用，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

b.其他費用—家登美國公司

該公司 112 年度對家登美國公司其他費用金額為 166 千元，主係該公司員工至美國拓展業務，惟該公司於美國並無設立據點，是以由家登美國公司事先代墊該公司參展等出差費用，再由該公司支付予家登美國公司之費用支出，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

c.其他費用—上海家登公司

係該公司員工至中國拓展業務，惟該公司於中國並無設立據點，是以由上海家登公司事先代墊該公司參展等出差費用，再由該公司支付予上海家登公司之費用支出，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

d.利息收入—家登公司

該公司 110~112 年度對家登公司利息收入金額分別為(47)千元、9 千元及 9 千元，主係該公司向家登公司承租臺南廠房所支付押金所產生之設算息，110 年利息收入為負，主要係因家登公司折讓迴轉 109 年所產生之押金設算息所致，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

e.租金收入—昇和精技公司

該公司於 111 年起以每月 60 千元出租新竹辦公室部分區域，供昇和精技公司作為營業之用途，昇和精技公司依雙方合約議定之價款按月支付，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

f.存出保證金—家登公司

該公司於 110~112 年度間向家登公司租賃臺南廠房及土城辦公室，於簽約時，提供出租人兩個月租金數額作為保證金，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關合約及交易憑證，尚無重大異常之情形。

g.其他應付款—家登公司

該公司對家登公司之其他應付款，係該公司委託家登公司進行機台測試費用及租賃臺南廠房所產生之水電費等所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

h.合約負債—家登公司

該公司 110~111 年度對家登公司之合約負債，係家登公司委託該公司進行機台維修服務提前付款所產生，其交易之必要性尚屬合理；112 年度對家登公司之合約負債，係家登公司向該公司購買機器設備提前付款所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

i.合約負債—上海家登公司

該公司 112 年度對上海家登公司之合約負債，係上海家登公司向該公司購買機器設備提前付款所產生，其交易之必要性尚屬合理。經核閱相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(2)合併財務報告

A.關係人名單

關係人名稱	與該公司之關係
家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)	母公司
Gudeng Inc. (以下簡稱家登美國公司)	兄弟公司
家崎科技股份有限公司(以下簡稱家崎公司)	兄弟公司
上海家登貿易有限公司(以下簡稱上海家登公司)	兄弟公司
壺鉸系統科技股份有限公司(以下簡稱壺鉸公司)	實質關係人
鍊恩帕斯科技股份有限公司(以下簡稱鍊恩帕斯公司)	實質關係人

B.關係人重大交易事項

(A)營業收入

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	328	1,672	367
上海家登公司	-	-	58
合計	328	1,672	425

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

(B)應收款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	-	101	-

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告參、業務狀況、一、營業概況、(五)最近三年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包含母子公司間交易事項)與關係人交易之評估、(1)個體財務報告、B.關係人重大交易事項(A)營業收入及(B)應收款項之分析說明。

(C)進貨

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	9,481	10,353	10,578
家登美國公司	-	105	-
家崎公司	-	-	231
壺鎡公司	-	-	19,882
銖恩帕斯公司	-	-	33,350
合計	9,481	10,458	64,041

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

(D)應付款項

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	1,487	1,689	2,046
	-	-	3,344
銖恩帕斯公司	-	-	14,387
合計	1,487	1,689	19,777

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告參、業務狀況、一、營業概況、(五)最近三年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包含母子公司間交易事項)與關係人交易之評估、(1)個體財務報告、B.關係人重大交易事項(C)進貨及(D)應付款項之分析說明。

(E)取得之不動產、廠房及設備

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	-	-	1,340

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告參、業務狀況、一、營業概況、(五)最近三年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包含母子公司間交易事項)與關係人交易之評估、(1)個體財務報告、B.關係人重大交易事項、(E)取得之不動產、廠房及設備之分析說明。

(F)承租協議

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
取得使用權資產			
家登公司	7,866	-	17,045
租賃負債			
家登公司	3,965	-	13,754
利息費用			
家登公司	99	35	271

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告參、業務狀況、一、營業概況、(五)最近三年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包含母子公司間交易事項)與關係人交易之評估、(1)個體財務報告、B.關係人重大交易事項、(F)承租協議之分析說明。

(G)租金支出

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家登公司	(32)	23	20
家登美國公司	-	-	62
合計	(32)	23	82

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告參、業務狀況、一、營業概況、(五)最近三年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包含母子公司間交易事項)與關係人交易之評估、(1)個體財務報告、B.關係人重大交易事項、(G)租金支出之分析說明。

(H)其他關係人交易

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
其他費用—家登公司	1,732	790	3,069
其他費用—家登美國公司	-	-	166
其他費用—上海家登公司	-	-	89
利息收入—家登公司	(47)	9	9
存出保證金—家登公司	669	669	596
其他應付款—家登公司	904	111	220
合約負債—家登公司	120	96	13,500
合約負債—上海家登公司	-	-	18,419

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

上述交易請參閱本評估報告參、業務狀況、一、營業概況、(五)最近三年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包含母子公司間交易事項)與關係人交易之評估、(1)個體財務報告、B.關係人重大交易事項、(H)其他關係人交易之分析說明。

2.發行人與同屬關係企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者)，有無相互競爭之情形

該公司及其子公司主係從事半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，其中主要包括應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。茲將各集團企業公司以其主要營運項目分類列示如下，並說明有無相互競爭之情形：

項次	集團企業名稱	主要營運項目
1	家登	光罩載具、晶圓載具。
2	家登創投	創業投資、管理顧問。
3	家崎	精密金屬加工、航太零件、蝕刻設備零件。
4	RP	轉投資公司控股。
5	PO	轉投資公司控股。
6	美國家登	美國地區半導體、航太零件貿易。
7	家宇航太	航空器及其零件零售、批發及製造。
8	家碩建設	不動產開發、買賣、租賃。
9	恆陽	能源設備安裝工程。
10	SP	轉投資公司控股。
11	GI	轉投資公司控股。
12	上海家登	大陸地區塑膠製品、電子產品、五金貿易。
13	蘇州堃鉅(註)	汽車銷售、維修、售後服務。
14	GIHK	轉投資公司控股。
15	富瑞昇	轉投資公司控股。
16	碩頂	模具、汽車金屬件、電子連接器。

項次	集團企業名稱	主要營運項目
17	柏升	精密刀具。
18	昇和	濺鍍設備。

資料來源：該公司及其子公司提供

註：蘇州堃鉅已於 112 年 9 月 14 日註銷登記

如上表所示，各集團企業公司之主要營運項目，歸納分類為半導體載具、精密金屬加工、汽車、不動產、投資控股，與該公司之主要業務或產品用途皆不相同，尚無相互競爭之情形。另，該公司及其子公司 111~112 年度銷售予集團企業公司之金額分別為 1,672 千元及 425 千元，占合併營業收入比重為 0.16%及 0.04%，金額及比重微小，顯示該公司及其子公司主要銷售對象非屬集團企業公司，且該公司完全自行掌握產品之研發設計、生產製造及業務銷售，具有獨立行銷之開發潛力。

二、財務狀況

(一)發行人最近期及最近三個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況及財務比率，並作變動分析與同業比較

1.選取採樣同業公司之理由

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，屬於半導體前段製程相關設備供應商。綜觀目前國內上市、上櫃及興櫃公司，就營業項目、業務型態及市場定位等因素綜合考量，選擇京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱京鼎公司，股票代碼 3413，上市半導體業)、華景電通股份有限公司(以下簡稱華景電公司，股票代碼 6788，上櫃半導體業)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱天虹公司，股票代碼 6937，上市半導體業)作為採樣同業。京鼎公司主要營業項目為先進設備設計及製造，其產品主要應用在半導體產業、面板產業及光電產業等，在半導體產業部分，其設備用途包含半導體前段晶圓製造之薄膜、蝕刻、化學機械研磨等製程所需之設備、晶圓傳輸自動化設備、微污染防治及惰性氣體充填裝置及晶圓外觀自動檢查設備；華景電公司主要營業項目為晶圓製程微粒子或氣態分子污染物(AMC)微污染防治設備、晶圓盒承載裝置無線射頻辨識(RFID)整合派工系統及其他等；天虹公司主要營業項目為半導體設備及相關零組件之技術與研發、製造、維修及銷售業務等。

此外，參考財團法人金融聯合徵信中心編印之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」中所列「C29 機械設備製造業」之財務比率作為同業平均之財務比率依據。

選取採樣公司之基本資料

公司名稱	代號	主要營業項目
京鼎	3413	半導體、面板及光電等產業之先進製程暨自動化設備，在半導體產業方面用途包含半導體前段晶圓製造之薄膜、蝕刻、化學機械研磨等製程所需之設備及關鍵零組件、晶圓傳輸自動化設備微污染防治及惰性氣體充填裝置及晶圓外觀自動檢查設備
華景電	6788	晶圓製程 AMC 微污染防治設備、RFID 整合派工系統、半導體專業消防工程及設備安裝
天虹	6937	物理氣相沉積設備(PVD)、原子層沉積設備(ALD)、晶圓鏈合機及解鏈合機設備(Bonder/Debonder)、半導體設備零備件及相關服務(Spares & Service)

資料來源：公開資訊觀測站、各公司年報

2. 最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證財務報告之損益狀況

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)	
營業收入	家碩	601,932	1,047,953	74.10	1,207,145	15.19	
	京鼎	12,246,437	14,843,221	21.20	13,051,357	(12.07)	
	華景電	1,089,854	1,416,410	29.96	1,370,598	(3.23)	
	天虹	1,655,712	1,815,477	9.65	1,992,643	9.76	
營業毛利	家碩	385,938	597,074	54.71	621,607	4.11	
	京鼎	1,115,501	10,399,687	832.29	9,636,790	(7.34)	
	華景電	536,028	683,179	27.45	634,951	(7.06)	
	天虹	993,184	969,505	(2.38)	1,115,501	15.06	
營業利益	家碩	215,994	450,879	108.75	585,538	29.87	
	京鼎	3,092,667	4,443,534	43.68	3,414,567	(23.16)	
	華景電	553,826	733,231	32.39	735,647	0.33	
	天虹	662,528	845,972	27.69	877,142	3.68	
營業費用	家碩	102,791	208,550	102.89	325,504	56.08	
	京鼎	1,104,328	1,492,474	35.15	1,384,534	(7.23)	
	華景電	259,583	298,424	14.96	373,852	25.28	
	天虹	471,843	557,629	18.18	554,503	(0.56)	
營業損益	家碩	113,203	242,329	114.07	260,034	7.31	
	京鼎	1,988,339	2,951,060	48.42	2,030,033	(31.21)	
	華景電	294,243	434,807	47.77	361,795	(16.79)	
	天虹	190,685	288,343	151114.31	322,639	11.89	
營業外收入及支出	家碩	(22,243)	13,029	(158.58)	17,281	32.63	
	京鼎	(73,724)	(60,358)	(18.13)	482,396	(899.22)	
	華景電	4,528	12,844	183.66	1,646	(87.18)	
	天虹	50,853	78,126	53.63	41,942	(46.31)	
本期淨利(損)	家碩	67,532	203,415	201.21	228,243	12.21	
	京鼎	1,518,523	2,344,363	54.38	1,990,468	(15.10)	
	華景電	229,723	349,442	52.11	268,083	(23.28)	
	天虹	224,620	316,862	41.07	306,661	(3.22)	

項目 \ 年度		110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	金額	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)
本期 其他 綜合 損益	家碩	-	-	-	註	(385)	註
	京鼎	8,577	(12,615)	(247.08)		4,358	(134.55)
	華景電	(909)	5,720	(729.26)		(4,870)	(185.14)
	天虹	(3,353)	13,135	(491.74)		(3,934)	(129.95)
本期 綜合 損益 總額	家碩	67,532	203,415	201.21		227,858	12.02
	京鼎	1,527,100	2,331,748	52.69		1,994,826	(14.45)
	華景電	228,814	355,162	55.22		263,213	(25.89)
	天虹	221,267	329,997	49.14		302,727	(8.26)

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

註：分母為 0，故無法計算

3. 變動分析及同業比較

(1) 營業收入、營業成本、營業毛利及營業(損)益

請參閱本評估報告參、一、(四)業績概況之說明。

(2) 營業費用變化原因及合理性

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度		110 年度		111 年度		112 年度	
		金額	比例	金額	比例	金額	比例
推銷費用		30,664	5.09	46,997	4.48	62,375	5.17
管理費用		42,067	6.99	78,582	7.50	106,510	8.82
研究發展費用		38,612	6.41	75,035	7.16	150,604	12.48
預期信用減損損失 (利益)		(8,552)	(1.42)	7,936	0.76	6,015	0.50
營業費用		102,791	17.08	208,550	19.90	325,504	26.97
營業利益		113,203	18.81	242,329	23.12	260,034	21.54

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

A. 營業費用

(A) 推銷費用

該公司及其子公司 110~112 年度之推銷費用分別為 30,664 千元、46,997 千元及 62,375 千元，主係業務人員薪資、勞健保費、交際費、旅費及相關費用等，111 年度推銷費用較 110 年度增加 16,333 千元，主係隨人員擴編及獲利成長增加提列績效獎金及員工酬勞使薪資費用增加，另該公司及其子公司持續拓展客戶，使旅費增加所致；112 年度推銷費用較 111 年度增加 15,378 千元，主係因獲利成長使薪資費用增加，另該公司及其子公司持續拓展客戶，使旅費及交際費增加，惟在費用控管得宜之情況下，該公司及其子公司推銷費用並未隨營收成長而大幅增加，110~112 年占營業收入之比重分別為 5.09%、4.48%及 5.17%，約略維持在 5%左右。

(B)管理費用

該公司及其子公司 110~112 年度之管理費用分別為 42,067 千元、78,582 千元及 106,510 千元，管理費用主係間接人員薪資、勞健保費、捐贈、各項折舊與攤銷及相關費用等，111 年度管理費用較 110 年度增加 36,515 千元，主係隨人員擴編及獲利成長增加提列績效獎金及員工酬勞使薪資費用增加，以及認列新竹辦公室使用權資產使折舊增加、捐贈台南市政府農業局及台南警局等使捐贈費用增加和因應 IPO 作業所需，會計師財稅簽及內控專審相關費用與券商輔導費用增加所致；112 年度管理費用較 111 年度增加 27,928 千元，主係隨人員擴編及獲利成長使薪資費用增加，以及捐贈獅子會重建花蓮縣東里國中捐款、贊助台南市政府等使捐贈增加和因應 IPO 作業所需，會計師財稅簽及內控專審費用與券商輔導費用增加所致，惟在費用控管得宜之情況下，該公司及其子公司之管理費用並未隨營收成長而大幅增加，110~112 年度占營業收入之比重分別為 6.99%、7.50% 及 8.82%。

(C)研究發展費用

該公司及其子公司 110~112 年度之研究發展費用分別為 38,612 千元、75,035 千元及 150,604 千元，研究發展費用主係研發人員薪資、勞健保費、產品開發、認證費及相關費用等，111 年度研發費用較 110 年度增加 36,424 千元，主係隨人員擴編及獲利成長使薪資費用增加及投入產品研發費用增加所致；112 年度研發費用較 111 年度增加 75,569 千元，主係隨人員擴編及獲利成長使薪資費用增加、投入產品研發費用及旅費增加，及因出貨至客戶的 Demo 機評估已無銷售可能，故轉列研發費用所致，110~112 年度占營業收入之比重分別為 6.41%、7.16%及 12.48%，研發費用逐年增加，主要係因該公司及其子公司持續開發新型機台及人員擴編所致。

(D)預期信用減損損失(利益)

預期信用減損損失(利益)主係因應收款項備抵損失之變動所產生，110 年度預期信用減損利益 8,552 千元，主係收回已提列備抵呆帳損失之應收帳款 9,160 千元所致；111 年度預期信用減損損失 7,936 千元，主係將客戶逾期超過 365 天以上之應收帳款 3,452 千元提列 100%備抵損失所致；112 年度之預期信用減損損失為 6,015 千元，主要係受客戶建廠及裝機時程影響，故其相關應收款項逾期時間較長。

B.營業利益

單位：%

項目	營業費用率			營業利益率		
	110 年度	111 年度	112 年度	110 年度	111 年度	112 年度
家碩	17.08	19.90	26.96	18.81	23.12	21.54
京鼎	9.02	10.05	10.61	16.24	19.88	15.55
華景電	23.82	21.07	27.28	27.00	30.70	26.40
天虹	28.50	30.72	27.83	11.52	15.88	16.19

與採樣同業相較，該公司 110~112 年度營業費用率介於採樣同業，而營業利益率 110~112 年度介於採樣同業之間，尚無發現有重大異常情事。

整體而言，該公司 110~112 年度之營業費用及營業利益變化情形尚無重大異常。

(3)營業外收支

單位：新臺幣千元

年度		110 年度	111 年度	112 年度
其他收入	利息收入	48	1,069	10,534
	其他收入	3	532	273
其他利益及損失	淨外幣兌換損益	(1,747)	11,777	5,735
	減損損失	(20,435)	-	-
	租賃修改(損失)利益	5	(192)	-
	廉價購買利益	-	-	1,512
	其他	-	(18)	(8)
財務成本		(117)	(139)	(733)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		-	-	(32)
合計		(22,243)	13,029	17,281

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司 110~112 年度之營業外收支分別為(22,243)千元、13,029 千元及 17,281 千元，占營收比重分別(3.69)%、1.24%及 1.43%，營業外收支主要包含利息收入(主係銀行存款息及押金設算息)、其他收入、淨外幣兌換(損)益、減損損失等項目，茲就金額較高之減損損失及淨外幣兌換(損)益之變化進行說明：

A.減損損失

該公司及其子公司 110~112 年度之減損損失分別為(20,435)千元、0 千元及 0 千元，主要係該公司及其子公司於 109 年底為拓展營運範疇，迎合 5G 技術發展與環境需求，為期擴展 PVD 真空鍍膜和相關設備核心技術及縮短自行開發之時程及減少研發成本，達到強化本身競爭優勢，故取得昇和精技(股)公司 100%股權，收購時因昇和精技已有銷售濺鍍設備實績，故預期隨新冠疫情

緩解，其他客戶可能會有相關需求，惟收購後因新冠疫情緩解狀況未如預期，故該公司及其子公司 110 年底評估減損時，認列商譽減損 20,435 千元，111~112 年度商譽並無減損跡象故無認列相關損失，尚無重大異常之情事。

B. 淨外幣兌換損益

該公司及其子公司 110~112 年度之淨外幣兌換損益分別為(1,747)千元、11,777 千元及 5,735 千元，該公司及其子公司銷貨交易幣別主要以新臺幣及美元計價，111~112 年度銷貨交易幣別為美金之比重分別為 18.79%及 29.74%，進貨及付款主要係以新臺幣為計價貨幣，故外幣淨資產以美元為主，兌換損益主要受美元兌新臺幣匯率變動所影響，111~112 年度由於美國實施貨幣緊縮政策及美國持續升息，使得 111~112 年度美元兌新臺幣期末匯率分別為 30.66 元及 30.705 元，相對 110 年度美元兌新臺幣期末匯率 27.63 為升值趨勢，故產生匯兌利益 11,777 千元及 5,735 千元，尚無重大異常之情事。

該公司及其子公司對於匯率風險之控管主係財務單位隨時蒐集匯率變化訊息，與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充分掌握國際間匯率走勢及變化訊息，並視實際資金需求及匯率高低情況於適當時機買賣外幣存款，以降低匯率波動對公司獲利之衝擊。

(4) 稅前純益及稅後純益變化原因及其合理分析

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
稅前淨利	90,960	255,358	277,315
所得稅費用	23,428	51,943	49,072
本期淨利	67,532	203,415	228,243
加權平均流通在外股數(註)	20,038	20,674	27,298
基本每股盈餘(元)(註)	3.37	9.84	8.36

資料來源：該公司及其子公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

註：該公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響

該公司及其子公司 110~112 年度之稅前淨利分別為 90,960 千元、255,358 千元及 277,315 千元；每股盈餘分別為 3.37 元、9.84 元及 8.36 元。該公司及其子公司之最近三年度稅前淨利持續伴隨營收規模成長而呈現上升趨勢。另該公司及其子公司最近三年度之每股盈餘之變化主係受各期稅後淨利所影響，此外，因該公司於 111 年底現金增資 6,000 千股，致 112 年度加權平均流通在外股數較追溯後 111 年度增加，112 年度每股盈餘較 111 年度些微下降。

整體而言，該公司及其子公司營運獲利仍穩定成長，稅前淨利呈逐期上升之態勢，其變化情形應屬合理。

(5)其他綜合損益

該公司及其子公司 110~112 年度之其他綜合損益分別為 0 千元、0 千元及 (385 千元)，112 年度之其他綜合損益係該公司 112 年 9 月投資 Gudeng Inc.產生之國外營運機構財務報表換算之兌換差額，經評估尚無重大異常之情事。

(6)本期綜合損益總額

該公司及其子公司 110~112 年度之綜合損益總額分別為 67,532 千元、203,415 千元及 227,858 千元，金額變化主要隨營收成長，營業利益、稅前純益及本期淨利變動所致。整體而言，該公司及其子公司最近三年度之綜合損益總額變化情形尚無重大異常情事。

4.最近期及最近三個會計年度財務比率之變動分析及與同業之比較

單位：%；次；每股元

項目		年度	110 年度	111 年度	112 年度
		公司			
財務結構	負債占資產比率(%)	家碩	78.23	66.73	61.01
		京鼎	46.94	44.99	40.10
		華景電	21.30	32.79	34.18
		天虹	51.66	37.74	25.54
		同業	50.50	46.50	註 4
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	家碩	1,717.71	3,706.17	1,004.44
		京鼎	502.92	366.86	418.77
		華景電	668.98	305.06	296.67
		天虹	189.17	291.17	316.54
		同業	216.45	226.24	註 4
償債能力	流動比率(%)	家碩	120.40	145.67	153.56
		京鼎	285.58	220.98	405.07
		華景電	501.35	341.43	308.82
		天虹	167.12	260.61	494.37
		同業	187.10	224.60	註 4
	速動比率(%)	家碩	58.81	84.65	102.36
		京鼎	209.60	161.20	324.85
		華景電	357.67	249.66	212.62
		天虹	76.12	127.04	285.63
		同業	125.00	148.80	註 4
	利息保障倍數(倍)	家碩	778.44	1,838.11	379.33
		京鼎	74.19	74.04	61.49
		華景電	299.17	185.83	75.81
		天虹	8.56	35.16	44.83
		同業	3,644.80	3,730.60	註 4
經營能力	應收款項週轉率(次)	家碩	8.34	5.79	5.62
		京鼎	9.24	11.06	14.80
		華景電	7.32	7.51	6.39
		天虹	6.44	4.88	4.32
		同業	4.70	4.80	註 4

項目		年度	110 年度	111 年度	112 年度
		公司			
	應收款項收現天數(天)	家碩	44	64	65
		京鼎	40	34	25
		華景電	50	49	58
		天虹	57	75	85
		同業	78	77	註 4
	存貨週轉率(次)	家碩	1.08	1.12	1.04
		京鼎	3.90	3.06	2.93
		華景電	1.62	1.42	1.18
		天虹	1.13	0.99	0.95
		同業	2.80	2.40	註 4
經營能力	平均售貨天數(天)	家碩	338	326	351
		京鼎	94	120	125
		華景電	225	257	309
		天虹	324	369	385
		同業	131	153	註 4
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	家碩	47.63	75.32	26.28
		京鼎	6.92	5.33	3.57
		華景電	5.33	3.41	2.21
		天虹	2.15	2.48	2.14
		同業	3.50	3.10	註 4
	總資產週轉率(次)	家碩	0.75	0.80	0.68
		京鼎	0.95	0.88	0.67
		華景電	0.78	0.68	0.57
		天虹	0.71	0.70	0.56
		同業	0.60	0.60	註 4
獲利能力	資產報酬率(%)	家碩	8.38	15.45	12.94
		京鼎	11.99	14.03	10.36
		華景電	16.45	16.94	11.30
		天虹	10.75	12.61	8.81
		同業	4.60	6.40	註 4
	權益報酬率(%)	家碩	37.65	53.27	35.56
		京鼎	23.29	25.54	17.75
		華景電	21.29	23.35	16.76
		天虹	28.97	21.79	12.33
		同業	7.20	11.00	註 4
	營業利益占實收資本額比率(%)	家碩	102.54	107.42	95.26
		京鼎	226.19	304.07	208.88
		華景電	84.70	125.16	104.14
		天虹	35.00	47.52	47.81
		同業	註 1	註 1	註 1
	稅前純益占實收資本額比率(%)	家碩	82.39	113.19	101.59
		京鼎	217.80	297.85	258.52
		華景電	86.00	128.86	104.62
天虹		44.34	60.40	54.03	
同業		註 1	註 1	註 1	

項目	公司	年度			
		110 年度	111 年度	112 年度	
純益率(%)	家碩	11.22	19.41	18.91	
	京鼎	12.40	15.79	15.25	
	華景電	21.08	24.67	19.56	
	天虹	13.57	17.45	15.39	
	同業	6.10	10.20	註 4	
	每股盈餘(元)	家碩(註 5)	3.37	9.84	8.36
		京鼎	17.01	24.64	20.48
		華景電	7.08	10.08	7.82
		天虹	4.57	5.66	5.02
		同業	註 1	註 1	註 1
現金流量	現金流量比率(%)	家碩	20.42	13.87	45.38
		京鼎	21.13	42.66	74.69
		華景電	38.44	92.46	49.55
		天虹	28.99	33.40	7.68
		同業	10.80	12.80	註 4
	現金流量允當比率(%)	家碩	91.53	93.20	148.40
		京鼎	98.91	95.44	87.11
		華景電	72.11	70.50	71.66
		天虹	註 3	註 3	33.65
		同業	註 1	註 1	註 1
	現金再投資比率(%)	家碩	70.68	25.70	57.94
		京鼎	1.92	13.56	7.22
		華景電	(0.56)	15.42	0.20
		天虹	16.16	11.93	(0.41)
		同業	6.30	2.70	註 4

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率、每股稅後盈餘及現金流量允當比率

註 2：應收款項週轉率及存貨週轉率係以總額計算；應收款項收現天數及平均售貨天數係以無條件進位計算

註 3：此財務指標未滿五年度，故無法計算

註 4：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版該年度之主要行業財務比率

註 5：該公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響

註 6：財務分析之計算公式如下

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額

(4) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率

(5) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額

(6) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額

4.獲利能力

- (1)資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額
- (2)權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額
- (3)營業利益占實收資本額比率 = 營業利益 / 期末實收資本額
- (4)稅前純益占實收資本額比率 = 稅前純益 / 期末實收資本額
- (5)純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額
- (6)每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數

5.現金流量

- (1)現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債
- (2)淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)
- (3)現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)

(1)財務結構

A.負債占資產比率

該公司及其子公司 110~112 年度之負債占資產比率分別為 78.23%、66.73%及 61.01%。111 年度因該公司辦理現金增資、業績持續成長及訂單需求旺盛致應收帳款及存貨上升，使 111 年度現金及約當現金及應收帳款大幅增加，致 111 年度負債占資產比率較 110 年度大幅下降；112 年度因業績持續成長，現金及約當現金大幅增加，致 112 年度負債占資產比率較 111 年度下降，經評估該公司及其子公司之負債占資產比率變化應無異常之情事。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度負債占資產比率皆高於其他採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，加上該公司之股本相較其他採樣同業為低(以 112 年度而言，該公司股本 272,976 千元，採樣同業京鼎公司、華景電公司及天虹公司之股本分別為 971,861 千元、347,397 千元及 674,773 千元)，致負債占資產比率占比較採樣同業高，惟該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司及其子公司未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情形，經評估尚無重大異常情事。

B.長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 110~112 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率為 1,717.71%、3,706.17%及 1,004.44%。該公司 111 年度長期資金占不動產、

廠房及設備比率較 110 年度上升，主要係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求提升，使該公司及其子公司之營運及獲利持續成長，且該公司於 111 年度辦理現金增資，股東權益逐年增加所致；112 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率大幅降低，主要係因該公司於 112 年度因研發所需，增加機器設備所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率皆高於其他採樣同業及同業平均，且該等比率大於 100%，顯示該公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之財務結構各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

(2)償債能力

A.流動比率及速動比率

該公司及其子公司 110~112 年度之流動比率分別為 120.40%、145.67%及 153.56%，速動比率分別為 58.81%、84.65%及 102.36%，其流動比率及速動比率皆呈現上升之趨勢，主係雖過去幾年度因疫情造成的區域封鎖、區域衝突及地緣政治的緊張局勢，嚴重擾亂了全球供應鏈，惟來自 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等相關應用產業之發展趨勢，仍使得長期半導體需求結構呈現持續增長，該公司及其子公司在配合客戶擴充產能及建廠規劃之需求情況下，最近三年度之營運規模及獲利呈現持續成長之趨勢，且該公司於 111 年度辦理現金增資，致其流動資產與速動資產均較各年度前期持續增加，致使流動比率及速動比率逐期上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之流動比率與速動比率皆低於採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，使流動負債大幅增加所致；另該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司及其子公司之財務與營運狀況皆屬穩健，且應收款項收現情況良好，經評估其短期償債能力尚無重大異常情事。

B.利息保障倍數

該公司及其子公司 110~112 年度之利息保障倍數分別為 778.44 倍、1,838.11 倍及 379.33 倍。111 年度利息保障倍數較 110 年度大幅上升，主係因該公司營運成長，稅前淨利增加所致；112 年度較 111 年度大幅下降，主係因 111 年底新增新竹辦公室及 112 年度新增臺南及臺中倉儲租賃，租賃負債利息費用增加所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之利息保障倍數均優於採樣同業，低於同業平均，該公司及其子公司之利息保障倍數主要係受租賃負債利息費用及稅前淨利變動影響，經評估該公司及其子公司因營運獲利穩定而償債能力尚屬穩健，整體而言尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

(3)經營能力

A.應收款項週轉率及應收款項收現天數

該公司及其子公司 110~112 年度之應收款項週轉率分別為 8.34 次、5.79 次及 5.62 次，應收款項收現天數分別為 44 天、64 天及 65 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。該公司及其子公司 111 年度應收帳款週轉率較前一年度下降，主係該公司及其子公司仍因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致其營業收入持續攀升，期末應收款項隨之增加所致；112 年度應收款項週轉率持續下降，雖該公司 112 年度營業收入較去年度成長 15.19%，惟因 111 年底大量出貨，且今年出貨量持續增加，致平均應收帳款餘額成長 18.51%，應收款項週轉率微幅下降。

與採樣同業及同業平均相較，110~112 年度應收款項週轉率皆介於採樣同業，高於同業平均。該公司及其子公司之往來客戶大多為國內外知名大廠，財務狀況及營運狀況均為穩健，其授信條件與收款情形尚屬合理，且該公司及其子公司定期追蹤應收帳款期後收回情形，整體而言尚無重大異常情事。

B.存貨週轉率及平均售貨天數

該公司及其子公司 110~112 年度之存貨週轉率分別為 1.08 次、1.12 次及 1.04 次，平均售貨天數分別為 338 天、326 天及 351 天。111 年度因營運規模持續成長，加上該公司及其子公司所生產之機台設備於出貨後，尚待客戶完成驗收後始得認列營業收入，又其驗收時程受機台設備安裝及客戶驗收測試排程所影響，110 年底已出貨未驗收之機台於 111 年度陸續驗收完畢，致 111 年度營業成本增加幅度大於存貨，致使期末存貨週轉率上升；112 年度較 111 年

度存貨週轉率下降，雖該公司 112 年度營業成本受營業收入成長較去年度成長 4.11%，惟平均存貨受 112 年度期初已出貨未驗收之在製品較多影響，致平均存貨餘額成長 12.23%，存貨週轉率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司存貨週轉率 110 年度低於採樣同業及同業平均；111~112 年度則高於天虹，低於其他採樣同業及同業平均。該公司及其子公司最近三年度持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司及其子公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司及其子公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使存貨週轉率較採樣同業及同業平均為低，惟該公司及其子公司之產品主要係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故其存貨尚無可能產生跌價減損或未能去化之情形。經評估該公司及其子公司之存貨週轉率及平均售貨天數變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

C. 不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率

該公司及其子公司 110~112 年度之不動產、廠房及設備週轉率分別為 47.63 次、75.32 次及 26.28 次，總資產週轉率分別為 0.75 次、0.80 次及 0.68 次。111 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 110 年度上升，主要係因該公司及其子公司受半導體產業需求提升，營業收入大幅成長所致；112 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度大幅下降，主要係因該公司因研發所需，增加機器設備所致。111 年度總資產週轉率較 110 年度略為上升，主要係因 111 年度營業收入大幅成長所致；112 年度之總資產週轉率較 111 年度下降，主要係因該公司及其子公司之現金及約當現金受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且營業收入亦呈上升趨勢，惟平均總資產金額增加幅度較營業收入增加幅度高，致總資產週轉率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之不動產、廠房及設備週轉率均高於採樣同業及同業平均。就總資產週轉率而言，該公司及其子公司 110~111 年度之總資產週轉率介於採樣同業，高於同業平均；112 年度則高於採樣同業，顯示其經營能力與同業相較尚屬良好，整體而言，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之經營能力各項指標變動尚屬合

理，經評估尚無重大異常之情事。

(4)獲利能力

A.資產報酬率

該公司及其子公司 110~112 年度之資產報酬率分別為 8.38%、15.45%及 12.94%。111 年度資產報酬率上升主係受半導體產業需求持續提升，該公司及其子公司業績成長，稅後淨利大幅增加所致；112 年度資產報酬率下降，主要係因該公司及其子公司之現金及約當現金受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且稅後淨利亦呈上升趨勢，惟平均總資產金額增加幅度較稅後淨利增加幅度高，致資產報酬率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司資產報酬率 110 年度低於採樣同業，高於同業平均；111 年度介於採樣同業，高於同業平均；112 年度高於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之資產運用尚屬得宜，並能創造合理之利潤，經評估其資產報酬率之變化應無重大異常情事。

B.權益報酬率

該公司及其子公司 110~112 年度之權益報酬率分別為 37.65%、53.27%及 35.56%。111 年度權益報酬率較 110 年度上升，主要係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，使該公司及其子公司業績成長，稅後淨利增加幅度大於股東權益增加幅度所致；112 年度權益報酬率較 111 年度下降，主要係該公司業績持續成長，惟平均股東權益增加幅度大於稅後淨利增加幅度所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司權益報酬率 110~112 年度皆高於採樣同業及同業平均。隨營運規模擴大，該公司及其子公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

C.營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 110~112 年度之營業利益占實收資本額比率分別為 102.54%、107.42%及 95.26%；稅前純益占實收資本額比率分別為 82.39%、113.19%及 101.59%。111 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 110 年度上升，主要係該公司及其子公司之營業規模持續受惠於半導體產業需求成長，致營業利益及稅前純益均成長所致；112 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 111 年度下降，主要係因該公司 112 年度發放股票股利，實收資本額增加所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 110~112 年度之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣同業，顯示該公司及其子公司獲利能力尚屬良好，整體而言尚應重大異常情事。

D.純益率及每股盈餘

該公司及其子公司 110~112 年度之純益率分別為 11.22%、19.41%及 18.91%；每股盈餘分別為 3.37 元、9.84 元及 8.36 元。111 年度因半導體產業需求持續擴張，使該公司及其子公司之營業規模及獲利持續增長，致稅後淨利大幅增加，致使純益率及每股盈餘較 110 年度上升；112 年度純益率較 111 年度下降，主要係因該公司及其子公司 112 年度營業費用因人員擴編及投入產品研發增加，稅後淨利增加幅度小於營業收入增加幅度所致，另因該公司於 111 年底現金增資 6,000 千股，致該公司 112 年度加權平均流通在外股數較追溯後 111 年度增加，112 年度每股盈餘較 111 年度些微下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110 年度純益率低於採樣同業，高於同業平均；111~112 年度則介於採樣同業，高於同業平均。另就每股盈餘而言，110 年度低於採樣同業；111 年度及 112 年度則介於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之營運仍保持穩定成長之趨勢，最近年度之營運獲利亦持續擴張，經評估其獲利能力應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之獲利能力尚屬穩定，其獲利能力各項指標變化尚屬合理，經評估其變化應無重大異常情事。

(5)現金流量

A.現金流量比率

該公司及其子公司 110~112 年度之現金流量比率分別為 20.42%、13.87%及 45.38%。該公司 111 年度之現金流量比率較 110 年度下降，主要係因該公司及其子公司合約負債因業績成長增加，應付帳款亦同時受進貨增加大幅增加，致流動負債上升，另該公司及其子公司受營運規模逐漸擴增影響，應收款項隨營業收入成長增加，存貨亦因業績成長待驗收之在製品增加，110~111 年度營業活動之淨現金流入逐年減少，致現金流量比率因而逐年下降；112 年度之現金流量比率較以前年度上升，主要係因該公司及其子公司於 112 年度陸續收回機台款項，且 111 年底已出貨尚未完成驗收之機台設備於 112 年度陸續驗收完畢，加上合約負債因業績成長持續增加，112 年度營業活動之淨現金流入大幅增加，致現金流量比率大幅上升。

與採樣公司與同業平均相較，該公司及其子公司現金流量比率 110~111 年度低於採樣同業，高於同業平均；112 年度則介於採樣同業。該公司 110~111 年度現金流量比率低於採樣同業主要係因該公司及其子公司業績逐年成長，依訂單預收客戶貨款及購料生產，流動負債受合約負債及應付帳款增加影響增加，惟該公司流動比率與速動比率均呈增加趨勢，且該公司及其子公司目前仍有充裕之銀行資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形，經評估應無重大異常之情事。

B.現金流量允當比率

該公司及其子公司 110~112 年度現金流量允當比率分別為 91.53%、93.20%及 148.40%。111 年度及 112 年度之現金流量允當比率逐期增加，主要係因該公司營運規模持續擴大，最近五年度營業活動淨現金流量增加所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 110~111 年度現金流量允當比率介於採樣同業，112 年度則高於採樣同業。該公司及其子公司現金流量允當比率均高於 90%且呈現正向成長，顯示該公司經常性營業活動所產生之現金流入，應可支應其每年資本投資及發放現金股利等活動之現金流量，經評估應無重大異常之情事。

C.現金再投資比率

該公司及其子公司 110~112 年度現金再投資比率分別為 70.68%、25.70%及 57.94%。該公司 111 年度之現金再投資比率呈下降趨勢，主要係因該公司之營運規模逐年成長，營運資金大幅增加所致；112 年度現金再投資比率上升，主要係因該公司及其子公司於 112 年度陸續收回機台款項，且 111 年底已出貨尚未完成驗收之機台設備於 112 年度陸續驗收完畢，加上合約負債因業績成長持續增加，112 年度營業活動之淨現金流入大幅增加所致。

與採樣同業與同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之現金再投資比率均高於採樣同業及同業平均，顯示該公司及其子公司現金再投資能力高於同業，經評估應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之現金流量之各項指標變動尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

(二)發行人及其各子公司(包括母子公司間交易事項)最近期及最近三個會計年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易之情形及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響

1.背書保證

該公司已訂定「背書保證作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理背書保證作業之依據。經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及背書保證備查簿等相關資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無為他人背書保證之情事。

2.重大承諾事項

該公司訂有「負債承諾及或有事項管理辦法」，業經董事會通過，經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄及相關合約資訊等，該公司及其子公司 110~112 年度之重大承諾事項係已簽訂之購置裝修合約，屬正常營業之所需，經抽核相關合約，並無重大限制條款，故對該公司及其子公司財務狀況尚不致有重大不利之影響。

單位：新臺幣千元

項目	110 年度	111 年度	112 年度
購置不動產、廠房及設備	2,630	6,018	1,155

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告

3.資金貸與他人

該公司已訂定「資金貸與他人作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理資金貸與作業之依據，經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及資金貸與他人備查簿等相關資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無資金貸與他人之情事。

4.衍生性商品交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，其中針對衍生性商品訂定處理程序，業經董事會及股東會決議通過，作為其衍生性商品交易之依據，經查閱該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及衍生性金融商品備查簿等相關資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無衍生性商品交易之情事。

5.重大資產交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為取得或處分資產交易之依據；子公司依該公司訂定並經董事會通過之「子公司監理管理辦法」遵循相關重大資產交易事項。經查閱該公司最近三年度及申請年度

截至最近期止之董事會議事錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告、公開資訊觀測站之公告及相關帳冊等資料，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止並無達實收資本額百分之二十或金額達三億元以上之重大資產交易之情事。

惟該公司及其子公司應營運需求及未來業務發展，規劃未來興建廠房使用，於 112 年 11 月 7 日董事會通過向南部科學園區管理局租賃土地案，預計於 113 年 7 月簽訂建廠土地租賃合約，係為重大資產交易，相關說明列示如下：

年度	承租公司	租賃標的物	公告日	董事會決議日	租賃期間	使用權資產總額	交易對象	與公司之關係
112 年	該公司	臺南科學園區 <專 46>用地	112/11/7	112/11/7	尚未執行	尚未執行	國家科學及技術委員會 南部科學園區管理局	無

(三)發行人最近期及最近三個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

單位：新臺幣千元

名稱 \ 年度	110 年度	111 年度	112 年度
期初股本	55,200	110,040	225,600
現金增資	-	60,000	-
股票股利	55,200	55,200	47,376
期末股本	110,040	225,600	272,976
營業收入淨額	601,932	1,047,953	1,207,145
稅後淨利	67,532	203,415	228,243
基本每股盈餘(元)	6.12	11.91	8.36

資料來源：該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之合併財務報告

該公司及其子公司 110 期初普通股股本為 55,200 千元至 112 年底普通股股本為 272,976 千元，增加 217,776 千元，主要係現金增資及盈餘轉增資所致。現金增資所募資金之運用情形及效益請詳本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

該公司及其子公司 110~112 年度營業收入淨額分別為 601,932 千元、1,047,953 千元及 1,207,145 千元；稅後淨利分別為 67,532 千元、203,415 千元及 228,243 千元；稅後基本每股盈餘分別為 6.12 元、11.91 元及 8.36 元。111 年度營業收入較 110 年度大幅增加 446,021 千元，成長 74.10%，主係全球半導體產業大舉投入擴廠，對該公司產品需求增加所致，另該公司開發客製化設備，因持續獲得客戶訂單並陸續驗收設備，故 111 年度營業收入增加；112 年度較 111 年度增加 159,192 千元，成長 15.19%，主係配合客戶之擴廠計畫及產品持續受到客戶青睞，使 112 年度營收增加。該公司雖於 110~112 年度股本增加 217,776 千元，然對股本之影響有限故並未對其每股盈餘造成重大影響，其 110~112 年度每股盈餘之變動主係受到營業收入波動影響所致，整體而言，該公司及其子公司每股盈餘之變化應無因對外公開募集資金而使股本過度膨脹、獲利稀釋而損及股東權益之情事。

(四)本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。前各次現金增資、併購或受讓其他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

1.本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

該公司本次辦理現金增資係用於充實營運資金，經檢視該公司編制之 113 年度及 114 年度之現金收支預測表，113 年 1~2 月為實際數，113 年 3~12 月及 114 年度預計投入之資本支出金額為 768,000 千元，主係用於興建廠房，該資本支出已逾本次募集資金 584,155 千元之百分之六十(350,493 千元)。

該公司業經 112 年 11 月 7 日審計委員會及董事會決議通過，向南部科學園區租地作為建廠所需，該公司擬於 113 年 7 月起租，預計 115 年完竣，預計 116 年開始量產，本次資本支出計畫係興建廠房，該重大資本支出之資金來源、用途及預計效益說明如下：

(1)資金來源

該公司 113~114 年度預計投入興建工程及購置機器設備合計為 768,000 千元，資金來源係以銀行借款及自有資金支應，另依據該公司截至 113 年 2 月之個體現金餘額為 944,240 千元，且該公司最近三年度個體營業活動淨現金分別為 144,823 千元、121,405 千元及 515,336 千元，此外該公司規劃 113 年向銀行申請建築融資額度 4.8 億元，然建築融資採階段性申請動用，該公司預計於動用年度之次年度還款，其餘以自有資金支應。綜上所述，該公司本次資本支出之資金來源應屬可行。

(2)資本支出用途

該公司係屬半導體設備業，主要產品需求來自客戶擴廠擴線之產能提升、製程升級及良率提升新方案，以及維修技術服務。近年面對全球半導體產能供不應求，該公司於進入國際半導體大廠供應鏈後，與客戶密切互動，自 110 年起接單情形持續成長，綜合業務及市場面之觀察探知，主要客戶全球擴張計畫、先進製程對光罩潔淨度要求越趨嚴格、因應廠房自動化及數位轉型及半導體後段先進封裝延伸應用所帶來之業務機會，及既有廠區之運作侷限，為滿足該公司中長期業務發展，在永續經營及提供員工良好工作環境之理念下，故興建自有廠房以供未來營運擴線所需。

(3)預計效益說明

該公司本次興建廠辦，展現公司永續經營之決心，以提供舒適工作環境為目標，使員工更有歸屬感及向心力，對公司之營運更有信心進而提升人員之穩定性及向心力，不僅有助於公司業務之拓展，更預留營運規模更加擴大之後，人員擴編所需之辦公空間，對公司整體資源之使用有正面之助益。該公司現有生產之廠房為租賃，且另外租賃倉儲空間，為有效整合廠區並因應營收規模逐年增加，預期未來廠房建置完成後，可視未來客戶訂單需求逐步擴充產線，隨著規模經濟效益浮現，將可挹注營收及獲利。

- 2.前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

該公司無併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債之情事。前各次現金增資計畫實際完成日距本次申報時尚未逾三年者，為111年11月辦理現金增資發行新股案，均已執行完畢，其相關計畫內容及執行情形請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形」之說明；惟111年11月辦理現金增資發行新股時，該公司非屬公開發行公司階段，並未對外承銷，無需編製先金收支預測表，故不適用本項評估。

(五)發行人其他特殊財務狀況

經參閱該公司最近三個會計年度經會計師查核簽證之財務報告，並無發現該公司有其他特殊財務狀況之情事。

肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

- 一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫

該公司截至評估報告出具日止並無辦理併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券，且前各次現金增資計畫業已執行完畢，並無重大變更之情事，故不適用本項評估。

二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益

該公司截至評估報告出具日止並無辦理併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券，且前各次現金增資計畫業已執行完畢，並無重大變更之情事，故不適用本項評估。

三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響

(一)111年11月現金增資

1.計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：111年12月7日新北府經司字第1118086929號函核准。

(2)計畫所需資金總額：新臺幣132,000千元。

(3)資金來源：現金增資發行新股6,000千股，每股面額新臺幣10元，每股發行價格22元，募集總金額為新臺幣132,000千元。

(4)計畫項目及資金運用情形：

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			112年第1季
充實營運資金	111年第4季	132,000	132,000

(5)變更計畫內容、變更原因以變更前後效益：不適用。

(6)計畫輸入證期局指定申報網站日期：不適用。

2.執行情形

單位：新臺幣千元；%

計畫項目	執行狀況		112年第1季	進度超前或落後情形、原因及改進計畫
	支用金額	預定	132,000	
充實營運資金			實際	132,000
	執行進度(%)		預定	100%
			實際	100%

3.效益評估

單位：新臺幣千元；%

項目/年度		110年 (增資前)	111年 (增資後)
基本財務資訊	流動資產	922,123	1,578,449
	流動負債	765,862	1,083,569
	負債總額	765,862	1,104,529
	營業收入	601,932	1,047,953
	利息支出	117	139
	每股盈餘(元)	4.08	11.91
財務結構(%)	負債比率	78.23	66.73
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,717.71	3,706.17
償債能力(%)	流動比率	120.40	145.67
	速動比率	58.81	84.65

資料來源：該公司自結數

該公司該次募集資金總額為新臺幣 132,000 千元，全數用於充實營運資金，已於 111 年 11 月完成募集，並依計畫進度執行完畢。該公司於募集資金後，在償債能力方面，籌資後流動比率自 120.40%增加至 145.67%，速動比率自 58.81%增加至 84.65%；在財務結構方面，籌資後負債比率自 78.23%下降至 66.73%，長期資金占不動產、廠房及設備比率自 1,717.71%提升至 3,706.17%；在營運規模方面，流動資產及營業收入均較 110 年度增加，負債總額則因 111 年預收貨款較 110 年增加所致。整體而言，該公司該次增資效益應已顯現。

四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務週轉困難情事。

經參閱該公司及其子公司最近三個會計年度及申請年度最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會及股東會會議記錄，該公司及其子公司發行之公司債或舉借長期債務並無未如期還本付息之情事，且最近三個會計年度及截至評估報告出具日止亦無財務週轉困難之情事。

五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開

該公司截至評估報告出具日止並無辦理私募有價證券之情事，故不適用本項評估。

伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事(格式如附表九)，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，辦理現金增資發行新股以供證券承銷商辦理上櫃前公開承銷之用，非依同準則第六條第二項第一款或第四款募集與發行有價證券，故不適用同準則第十三條第一項第二款所列情事之評估。

二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事

(一)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商審查意見如下：

審 查 情 事	有無左列情事		評 估 依 據
	有	無	
1.簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者		✓	經參閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告，簽證會計師並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列之情事。
2.簽證會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者		✓	經參閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告，簽證會計師並無出具保留意見之查核報告，故無左列之情事。
3.發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，顯示有違反法令或公司章程，致影響有價證券之募集與發行者。		不適用	該公司本次辦理現金增資發行新股係供初次上櫃前公開承銷之案件，依法令規定無需檢附發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，故不適用。
4.律師出具之法律意見書，表示有違反法令，致影響有價證券之募集與發行者。		✓	經參閱律師對本次現金增資發行新股出具之法律事項檢查表，該公司並無違反法令，致影響有價證券募集與發行之情事。
5.證券承銷商出具之評估報告，未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。		✓	本承銷商出具之評估報告，已明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性。(詳評估報告「陸」之說明)。
6.經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依本準則申報(請)案件，發行人自接獲本會通知即日起三個月內辦理前條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，不在此限。		✓	經檢視110~112年度及113年度截至評估報告出具日前止之董事會及股東會議事錄、該公司與主管機關之往來文件，並詢問該公司相關人員，並無左列情事。

審 查 情 事	有無左列情事		評 估 依 據
	有	無	
7.申報現金增資或發行公司債案件，直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部投資審議委員會規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資，不在此限。		✓	經查閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄及股東會議事錄，該公司本次募集資金之運用計畫並無用於直接或間接赴大陸地區投資之情事，故無左列情事。
8.上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依證券交易法第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理，情節重大者。		✓	經參閱該公司相關董事會議事錄，該公司已依法設置薪資報酬委員會，並依相關法令規定訂定其組織章程及委任薪資報酬委員，截至評估報告出具日止，並無左列情事。
9.未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。		✓	該公司已於公司章程第十條明訂將電子方式列為股東行使表決權管道之一，故無左列情事。
10.違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大者。		✓	經查閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會之議事錄、與主管機關之往來函文，及取得該公司出具之聲明書，截至評估報告出具日止，尚未發現該公司有重大違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時承諾事項之情事。
11.經金管會發現有違反法令，情節重大者。		✓	經查閱律師所出具之法律事項檢查表、該公司董事會議事錄與主管機關之往來函文，並取具公司聲明書，該公司截至評估報告出具日止，並無左列情事。

(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商審查意見如下：

審 查 情 事	有無左列情事			評 估 依 據
	有	無	不適用	
1.申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一，且其股東取得股份有違反證券交易法第四十三條之一規定。但於申報日前已完成補正者，不在此限。		✓		經參閱該公司111~112年度及113年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄及變更登記事項表，該公司為符合申請興櫃掛牌之規定，於112年5月31日召開股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)，故該公司董事變動達1/2以上，另該公司股東取得該公司股份並無違反證券交易法第四十三條之一規定，故無左列情事。
2.上市或上櫃公司有證券交易法第一百五十六條各款情事之一者。但依證券交易法第一百三十				

審 查 情 事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
九條第二項規定限制其上市買賣，不在此限。				
(1)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。		✓		經查閱律師所出具之法律事項檢查表、該公司110~112年度及113年截至評估報告出具日止與主管機關之往來函文、經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會議事錄，並取具該公司聲明書，並未發現該公司有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產之情事發生。
(2)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。		✓		經參酌律師填報之法律事項檢查表、核閱該公司110~112年度及113年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、目前存續之重要契約及經會計師查核簽證之財務報告，截至評估報告出具日止，該公司並無遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。
(3)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格。		✓		經參酌律師填報之法律事項檢查表、核閱該公司110~112年度及113年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證之財務報告，並取得該公司出具之聲明書，截至評估報告出具日止，該公司尚無虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。
(4)該有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌。		✓		經查詢櫃檯買賣中心網站所公告之交易資訊，該公司最近三個月興櫃股價並未發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌情形。
(5)發行該有價證券之公司發生重大公害或食品藥物安全事件。		✓		經參閱該公司110~112年度及113年截至目前之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告，並參酌律師出具之法律事項檢查表，該公司並無發生重大公害或食品藥物安全事件，而有影響市場秩序或損害公益之情事。
(6)其他重大情事。		✓		經參閱該公司110~112年度及113年截至目前之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告，該公司尚無其他重大情事，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。

審 查 情 事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
3. 本次募集與發行有價證券計畫不具可行性、必要性及合理性者。		✓		經本承銷商評估該公司本次募集與發行有價證券計畫確有其可行性、必要性及合理性。(詳評估報告「陸」之說明)
4. 前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行有下列情事之一，迄未改善者：				
(1) 無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成。		✓		經查閱該公司110~112年度及113年截至評估報告出具日止之董事會與股東會議事錄、查詢公開資訊觀測站相關資料，該公司並無私募有價證券之情事，且該公司前各次募集資金計畫均依計畫項目執行完畢，故無左列之情事。
(2) 無正當理由計畫經重大變更。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。		✓		經查閱該公司110~112年度及113年截至評估報告出具日止之董事會與股東會議事錄、查詢公開資訊觀測站相關資料，該公司並無私募有價證券之情事，且該公司前各次募集資金計畫均依計畫項目執行完畢，並無計畫經重大變更，故無左列之情事。
(3) 募集與發行有價證券計畫經重大變更，尚未提報股東會通過。			✓	經查閱該公司之董事會與股東會議事錄及公開資訊觀測站之公告資訊，該公司截至評估報告出具日止，前各次募集與發行有價證券並無變更計畫之情事，故不適用左列事項之評估。
(4) 最近一年內未確實依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第四款至第九款及發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十一條規定辦理。			✓	經參閱該公司與主管機關往來函文，查詢公開資訊觀測站相關公告資料，該公司最近一年內募集有價證券並無未依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第四款至第九款辦理之情事，且該公司並無募集與發行海外有價證券之情事。
(5) 未確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理，情節重大。			✓	經查閱該公司110~112年度及113年截至評估報告出具日止之董事會與股東會議事錄、查詢公開資訊觀測站相關資料，該公司未曾辦理私募有價證券之情事，故不適用左列事項之評估。
(6) 未能產生合理效益且無正當理由。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。		✓		經查閱該公司110~112年度及113年截至評估報告出具日止之董事會與股東會議事錄、查詢公開資訊觀測站相關資料，該公司並無私募有價證券之情事，且該公司前各次募集資金計畫並無左列之情事。
5. 本次募集與發行有價證券計畫之重要內容(如發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等)未經列成議		✓		該公司本次計畫重要內容已列成議案，於113年3月26日董事會討論並決議通過，故無左列之情事。

審 查 情 事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
案，依公司法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。				
6.非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。		✓		經查閱該公司及其子公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告及相關明細帳，截至案件評估日止，該公司尚無左列情事。
7.有重大非常規交易，迄未改善者。		✓		經查閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會議事錄，截至案件評估日止，該公司尚無左列情事。
8.持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫，達最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告歸屬於母公司業主之權益之百分之四十或本次申報現金增資或發行公司債募集總金額之百分之六十，而辦理現金增資或發行公司債者。但所募得資金用途係用於購買不動產、廠房及設備或用於合併非以買賣有價證券為主要業務之公司，且有具體募資計畫佐證其募集資金之必要性，不在此限。			✓	該公司本次係依照「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，辦理現金增資發行新股以供證券承銷商辦理上櫃前公開承銷之用，依同準則第八條第四項規定，得不適用左列之評估。
9.本次現金增資或發行公司債計畫之用途為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者。		✓		經查閱該公司董事會議事錄，該公司本次現金增資發行新股計畫之用途並非為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者，故無左列之情事。
10.不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，情節重大者。		✓		經查閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告，並無左列之情事。
11.違反「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定情事者。		✓		經查閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會會議記錄及收發文記錄，該公司並無左列情事，未來若發布財務預測資訊將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定，自申報日起至申報生效前，除依法令發布之資訊外，不得對特定人或不特定人說明或發布財務業務之預測性資訊。
12.內部控制制度之設計或執行有重大缺失者。		✓		經參閱該公司內控聲明書、稽核報告、稽核工作底稿及其簽證會計師出具之內部控制建議書內容，該公司內部控制制度應尚屬有效執行，並未發現有重大缺失之情事。

審 查 情 事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
13.申報日前一個月，其股價變化異常者。		✓		經查詢櫃檯買賣中心所公告之興櫃股票達通知標準資訊，該公司申報日前一個月間並無股價變化異常情事。
14.公司全體董事或監察人持股有下列情形之一者：				
(1)違反證券交易法第二十六條規定，經通知補足持股尚未補足。		✓		本年度截至案件申報時止，該公司股份總額為27,297,600股，而其全體董事(含代表人)持股總數為15,915,479股，占該公司發行股數之58.30%，另該公司已設置審計委員會取代監察人，經評估已符合「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定，故無左列情事。
(2)加計本次申報發行股份後，未符證券交易法第二十六條規定。但經全體董事或監察人承諾於募集完成時，補足持股，不在此限。		✓		該公司截至案件申報時止，全體董事(含代表人)持股數為15,915,479股，全體董事持股數占已發行股份總數加計本次現金增資後之實收資本股數30,014,600股之比例為53.03%，故應無違反證交法第二十六條之疑慮。
(3)申報年度及前一年度公司全體董事或監察人未依承諾補足持股。		✓		經查閱該公司112年度及113年度截至評估報告日止與主管機關往來文件，並未發現該公司有左列情事。
15.發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近三年內，因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法等工商管理法律，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		✓		經核閱本次募集與發行所出具之法律事項檢查表、該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會與股東會議事錄，並取具該公司及現任董事長、總經理相關聲明書，並未發現有左列之情事。
16.因違反證券交易法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行者。		✓		經參閱本次募集與發行所出具之法律事項檢查表、該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會與股東會議事錄，並未發現該公司並有左列之情事。
17.為他人借款提供擔保，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善者。		✓		經參閱該公司110~112年度經會計師查核簽證之財務報告及董事會議事錄，該公司截至評估日止，並無違反左列之情事。
18.合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，而有下列情形之一：			✓	該公司本次辦理上櫃前現金增資發行新股計畫，非屬合併發行新股、受讓他公司股份發行新股或依法律規定進行收購或分割發行新股，故不適用左列之規定。

審 查 情 事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
<p>(1)違反本會公開發行公司取得或處分資產處理準則第二章第五節規定，情節重大。</p> <p>(2)受讓或併購之股份非為他公司新發行之股份、所持有非流動之股權投資或他公司股東持有之已發行股份。</p> <p>(3)受讓之股份或收購之營業或財產有限制買賣等權利受損或受限制之情事。</p> <p>(4)違反公司法第一百六十七條第三項及第四項規定。</p> <p>(5)被合併公司最近一年度之財務報告非經會計師出具無保留意見之查核報告。但經出具保留意見之查核報告，其資產負債表經出具無保留意見，不在此限。</p>				
<p>19.有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款第六目規定之情事，且有下列情形之一：</p> <p>(1)申報現金發行新股，公司董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東未承諾將一定成數股份送交證券集中保管事業保管。</p> <p>(2)申報發行轉換公司債或附認股權公司債，未於發行辦法明定應募人應自前揭公司債發行日起將公司債及嗣後所轉換或認購之股份送交證券集中保管事業保管一年。</p>			✓	該公司本次係辦理現金增資發行新股以供辦理上櫃前公開承銷，非依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第一款或第四款募集與發行有價證券，亦無第十三條第一項第二款第六目之情事，故本項不適用。
<p>20.證券承銷商於發行人申報時最近一年內經本會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上，且自被處記缺點累計達十點之日起未逾三個月。但發行人辦理現金發行新股為初次上</p>			✓	本證券承銷商於該公司申報時最近一年內並未經金融監督管理委員、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上之情事。且本案係屬辦理現金發行新股供初次上櫃公開承銷，故不適用本項評估。

審 查 情 事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
市、上櫃公開銷售者，不在此限。				
21.其他金管會為保護公益認為有必要者。		✓		經查閱該公司與金融監督管理委員會之往來函文，並無左列情事。

經上述評估，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件並無違反「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事。

二之一、總括申報發行新股案件者，是否符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十九條之一及十九之二所列情事

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定

該公司本次募集與發行有價證券係屬現金增資發行普通股，故針對「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第壹章總則第一條至第四條及第貳章現金增資普通股第五條至第九條之規定，逐條評估如下：

自律規則條款	說明
第一條：為推動有價證券之發行，並保障投資，除其他法令另有規定外，中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司或外國發行人辦理募集與發行有價證券事宜時應遵守本自律規則。	本承銷商輔導該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件謹遵守本自律規則辦理。
第二條：承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券時，主辦承銷商與發行公司或外國發行人間不得有下列情事： 一、任何一方與其母公司、母公司之全部子公司，合計持有對方股份總額百分之十以上者。 二、任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。 三、任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。 四、任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。 五、任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。	經查核元大證券(股)公司與該公司之董事、大股東、經理人及關係人間之關係，雙方並無左列情事，且雙方亦已出具聲明書，聲明並無左列各項限制條款之一者，故元大證券(股)公司得為該公司募集與發行有價證券之主辦承銷商。

自律規則條款	說明
<p>六、任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。但證券承銷商為金融機構或金融控股公司之證券子公司時，如其母公司、母公司之全部子公司總計持有發行公司股份未逾發行公司已發行股份總額百分之十，且擔任發行公司董事或監察人席次分別未逾三分之一者，不在此限。</p> <p>七、雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。</p> <p>八、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者，致有失其獨立性之情事者。</p> <p>發行公司或外國發行人發行普通公司債及未涉及股權之金融債券，如銷售對象僅限於證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人，其主辦承銷商得不受前項規定之限制，發行公司或外國發行人如具證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。本條所稱母公司及子公司，應依證券商財務報告編製準則規定認定之。</p>	
<p>第二條之一：承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券應取得填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司或外國發行人、會計師及證券商具有下列關係之聲明書：</p> <p>一、財務會計準則公報第六號規定之關係人關係。</p> <p>二、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。</p> <p>依發行人募集與發行海外有價證券處理準則或外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定出具海外存託憑證、海外股票或海外公司債發行辦法與金融監督管理委員會同意生效內容無重大差異意見書中文本之律師，亦應符合前項之規定。</p>	<p>經取具翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之聲明書，本次出具法律事項檢查表之日，翰辰法律事務所邱雅文律師於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且與該公司、會計師及本承銷商並無左列關係之情事。</p>
<p>第三條：承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券，應於向本公會申報承銷契約副本時，檢送有關承銷商與發行公司或外國發行人於向金管會或其委託之機構申報案件至</p>	<p>本承銷商於向證券商同業公會申報承銷契約副本時，將依左列規定辦理。</p>

自律規則條款	說明
<p>繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限之聲明書；總括申報追補發行新股案件，前開聲明書之聲明期間為自承銷商出具評估總結意見之日起至繳款截止日止，承銷商並應複核發行公司或外國發行人有無違反前開規定。</p> <p>前項聲明書之聲明事項，應增列有關不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。</p> <p>經主管機關依證券交易法第二十二條第一項核定免向金管會申報生效者，第一項聲明書之聲明期間以向金管會申請案件至繳款截止日止。</p>	
<p>第四條：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券(員工認股權憑證除外)，加計其前各次(含其所私募者)上述有價證券流通在外餘額依各別轉換(認購)價格設算轉換(認購)後所增加之股數，不得逾已發行股數之百分之五十。</p> <p>發行公司或外國發行人以已發行之股份做為轉換(認購)之用者，其做為轉換(認購)用之已發行股份不列入前項增加股數之計算。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之一：承銷商輔導發行公司申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，以新發行之股份履行轉換義務或履約者，承銷商應加強輔導發行公司採取股票無實體發行之制度，惟自九十五年七月一日起，上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。</p> <p>承銷商輔導外國發行人募集與發行有價證券之交付，除外國發行人註冊地國另有規定外，應以帳簿劃撥方式為之。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之二：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司之發行與轉換(認購)辦法中應訂明「自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，辦理股票變更面額之</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>

自律規則條款	說明
<p>停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換(認購)」規定；另應注意避免現金增資認股停止過戶日前十五個營業日、股票變更面額之停止轉換(認購)起始日起暫停轉換(認購)期間與前各次具轉換(認股、交換)有價證券到期日前之停止轉換(認股、交換)期間接續，及已發行流通在外之轉換公司債其轉換股份時先交付股票再辦理變更登記者，如遇普通股除息、除權或現金增資認股時，應符合證交所「營業細則」及櫃檯中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十條有關二階段公告規定。</p> <p>前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換(認購)期間。</p>	
<p>第四條之三：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，自發行日後屆滿一定期間起，除依法暫停過戶期間外，持有人得依發行人所定之發行及轉換(認股、交換)辦法請求轉換(認股、交換)；但發行公司或外國發行人為未上市(櫃)、未登錄興櫃之公開發行公司者，轉換(認股、交換)期間自發行日後屆滿一定期間至到期日前十日止為限。</p> <p>前項所稱一定期間不得少於三個月，並應由發行人或外國發行人於轉換(認購、交換)辦法中訂定之。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之五：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換(交換、認購)性質之各種有價證券，應就發行年期、發行價格、贖回時點、轉換溢價率、收益率、賣回時點、擔保狀況、分券狀況等因素綜合評估其發行條件訂定之合理性。</p> <p>對於發行條件顯不相當者，承銷商應輔導發行公司或外國發行人於重新合理訂定發行條件後，再行送件。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之六：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行海外有價證券，其按發行價格計算之發行金額，應高於二千萬美元。但發行公司確有外幣需求或外國發行人確有</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>

自律規則條款	說明
<p>特殊需求，且發行條件合理者，不受此限。</p>	
<p>第四條之七：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認購)辦法中應訂明發行公司或外國發行人依發行與轉換(認購)辦法所定反稀釋調整公式計算其調整後轉換價格時，其公式中之已發行股數應加計已私募股數。</p> <p>承銷商輔導發行公司或外國發行人申報(請)發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認購)辦法中應訂明發行公司或外國發行人發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券後，除發行公司或外國發行人所私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，發行公司或外國發行人遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，發行公司或外國發行人應比照該發行與轉換(認購)辦法所定於遇有已發行普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時之轉換價格調整公式，計算其調整後轉換價格(向下調整，向上則不予調整)並函請證交所或櫃檯買賣中心公告，於私募有價證券交付日調整之。</p> <p>依第二項計算調整後轉換價格時，如須訂定每股時價，應以私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之八：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換(交換、認購)性質之各種有價證券，公開說明書中應充分揭露當次發行有價證券之發行條件及該發行條件對股權稀釋、股東權益之影響。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之九：除上市(櫃)公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理案件外，發行公司或外國發行人得先行印製價格以區間方式揭露之公開說明書寄交</p>	<p>本承銷商與該公司本次辦理現金增資發行普通股申請初次上櫃案件，將採競價拍賣及公開申購配售方式辦理公開承銷，將依左列規定辦理。</p>

自律規則條款	說明
<p>投資人，並於該公開說明書封面顯著處註明提醒投資人上網查詢、參閱承銷商配售通知之實際承銷價格並依承銷商之通知繳交價款。</p> <p>承銷商應注意交寄當日發行公司或外國發行人須將該公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站，另價格確定後二日內須將完整公開說電子檔傳送至金管會指定之網站。</p> <p>第一項公開說明書上揭露之價格區間應與承銷商辦理詢價公告之預計承銷價格之可能範圍一致。</p>	
<p>第四條之十：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有股權轉換(認購、交換)性質之各種有價證券，應注意發行與轉換(認購、交換)辦法中應訂明下列事項：</p> <p>一、債券到期還本付息之款項支付日。</p> <p>二、發行條件中包含債券持有人之賣回權者，應訂明行使賣回權之款項支付日。</p> <p>三、發行條件中包含發行公司之收回權者，應訂明行使收回權利之款項或有價證券交付日。</p> <p>四、發行條件中包含交換權者，應訂明投資人行使交換權之有價證券交付日。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之十一：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權性質之各種公司債，應注意發行公司或外國發行人應依財務會計準則公報第34及36號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第249條第2款及第250條第2款之規定。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之十二：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後三個月內不得買回本公司股份。現金增資發行新股案件，前項承諾書應承諾自申報日起至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。</p> <p>總括申報發行新股案件，第一項承諾書應承諾首次發行自申報日起及各次追補發行自承銷商出具評估總結意見</p>	<p>該公司本次申報現金增資發行新股已出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回該公司股份，故符合左列規定。</p>

自律規則條款	說明
<p>之日起，至股票掛牌後一個月內不得買回本公司股份。</p>	
<p>第四條之十三：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募集人民幣計價海外公司債時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書及到期償債資金來源之計畫，承諾海外募得人民幣資金係供海外營運實體使用，不以任何方式匯回臺灣。</p>	<p>該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。</p>
<p>第四條之十四：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於公開說明書記載發行公司、發行公司之董事、監察人、總經理、財務長以及與發行公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書，並依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」編製公開說明書及簡式公開說明書，且於申報募資案件及向本公會申報承銷契約前，檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。</p>	<p>該公司已依左列規定取得聲明書，彙編於公開說明書並上傳，並確實依左列規定辦理。</p>
<p>第四條之十五：承銷商輔導外國發行人辦理申報「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款至第三款募資案件時，應於募集完成年度及其後二個會計年度，協助其遵循中華民國證券相關法令。</p> <p>承銷商並應將前揭資金控管情形納入每季之募資計畫執行情形併予評估。承銷商輔導有重要子公司位於中國大陸之外國發行人辦理申報募資案，應輔導外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾應將在臺所募資金存放於台資銀行或其海外子(分)行並依計劃支用。承銷商並應將前揭資金控管情形納入每季之募資計畫執行情形併予評估。</p> <p>承銷商依前項輔導外國發行人申報在臺募集與發行公司債案件，擔保銀行</p>	<p>該公司此次係本國發行公司辦理國內現金增資發行新股，故不適用。</p>

自律規則條款	說明
及受託銀行限於在我國設有營業據點之銀行。	
第四條之十六：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應就發行公司或外國發行人之財務業務狀況製作檢查表，並於發行公司或外國發行人向金管會申報案件前五個營業日，向證交所或櫃買中心申報。	該公司本次現金增資發行普通股係供初次上櫃公開承銷用，故不適用左列條款之規定。
第四條之十七：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，若發行條件中訂有收回條款者，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認股、交換)辦法中應訂明債券持有人請求轉換(認股、交換)之最後期限為終止櫃檯買賣日後第二個營業日。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之十八：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應將發行公司或外國發行人辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，並協助其依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。	該公司本次辦理初次上櫃前現金增資發行新股案件，本承銷商已將該公司辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。
第四條之十九：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報募資案件時，應出具發行公司或外國發行人是否應依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證券監督管理委員會辦理備案之意見。承銷商應取得發行公司之說明意見，且發行公司應出具說明內容無虛偽、隱匿之聲明。	該公司本次現金增資發行普通股係供初次上櫃公開承銷用，故不適用左列條款之規定。
第五條：承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股，應於申報案件時出具發行公司或外國發行人之子公司不得參與新股認購之承諾書，如屬總括申報發行新股案件，並應承諾不得參與首次發行及各次追補發行之新股認購。	該公司並非已上市(櫃)公司，故不適用左列之規定。
第五條之一：承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如申請延長募集期間且其財務預測無重大變動者，應檢送由發行公司或外國發行人出具經會計師複核之財務預測仍屬有效性聲明書。	該公司本次辦理現金增資發行新股並未公告財務預測，故不適用左列規定。

自律規則條款	說明
<p>第五條之二：承銷商輔導發行公司或外國發行人以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件、股票申請創新板初次上市案件，除另有規定外，向金管會或其委託之機構申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成；如經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，得採股數區間方式辦理申報，並敘明實際發行價格或股數如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p> <p>以現金增資發行新股辦理股票初次上市、上櫃、股票申請創新板上市前之承銷案件，主辦承銷商應與發行公司或外國發行人約定，由發行公司或外國發行人協調股東按該次現金增資對外公開銷售之一定比例之已發行普通股股票，供主辦承銷商於承銷期間進行過額配售，並應依本公會「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」辦理。</p>	<p>本承銷商本次輔導該公司辦理現金增資發行普通股，謹遵守左列規定。相關評估內容請參閱評估報告陸之說明。</p>
<p>第六條：承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。</p> <p>承銷商輔導興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格除不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值外，應參考向本公會報備承銷契約前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之均價，並應提出合理說明。</p>	<p>截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上櫃公開承銷之用，故不適用左列之規定。</p>

自律規則條款	說明
<p>承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p>	
<p>第六條之一：承銷商輔導上市(櫃)公司、創新板上市公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如發行公司依證券交易法第二十八條之一第三項規定，決議提撥發行新股總額超過百分之十對外採公開申購配售辦理承銷，其發行價格訂定方式應提報公司股東會。</p>	<p>截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上櫃公開承銷之用，故不適用左列之規定。</p>
<p>第七條：承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，如採詢價圈購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成；如採競價拍賣方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理競價拍賣公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。</p> <p>承銷商輔導創新板上市公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。</p> <p>承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理</p>	<p>截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上櫃公開承銷之用，故不適用左列之規定。</p>

自律規則條款	說明
<p>或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p>	
<p>第七條之一：承銷商輔導上櫃(市)公司申請轉上市(櫃)為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件經股東會決議原股東全數放棄優先認股，採公開申購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理公開申購公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。</p> <p>承銷商輔導發行公司向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。</p> <p>承銷商應輔導發行公司於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。</p>	<p>該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上市公開承銷之用，非為上櫃(市)公司申請轉上市(櫃)為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件，故不適用左列之規定。</p>
<p>第八條：採詢價圈購配售辦理之承銷案件，於承銷契約報本公會前，如發行價格偏離市場價格過大者，應重新辦理詢價，並於詢價後，隨即進行承銷作業。</p> <p>承銷商於向本公會申報承銷契約時，應一併檢送下列資料：</p> <p>一、詢價圈購之相關資料(含詢價期間、詢價範圍、各圈購價格及其圈購股數、詢價公告暫訂發行價格占詢價公告日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之成數等資料)。</p> <p>二、配售原則及預計配售予自然人、法人及本公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十六條第一項第一款至第七款有關董事、監察人、大股東、關係人</p>	<p>本承銷商與該公司本次辦理現金增資發行普通股申請初次上櫃案件，將採競價拍賣及公開申購配售方式辦理公開承銷，故不適用左列之規定。</p>

自律規則條款	說明
<p>等之股數及配售比率。 承銷商於向本公會申報承銷契約後，應隨即辦理承銷公告及相關承銷事宜。</p>	
<p>第八條之一：承銷商輔導上市(櫃)公司辦理總括申報發行新股案件，準用第六條、第六條之一、第七條及第八條規定。</p>	<p>該公司並非上市(櫃)公司，且本次非辦理總括申報發行新股案件，故不適用左列之規定。</p>
<p>第九條：承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，其發行價格之訂定方式及依公司法第二百六十七條第一項保留員、工承購股份於員、工未認購時之處理方式，均應列成議案經股東會討論並決議通過。</p> <p>承銷商輔導上市(櫃)公司向金管會申報案件，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之八成。</p> <p>實際發行價格不得低於訂價日收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之八成。</p> <p>前項實際發行價格低於九成者，海外存託憑證持有人不得於發行後三個月內請求兌回，承銷商並應輔導上市(櫃)公司於發行計畫及存託契約中載明。</p> <p>創新板上市公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案件，前各項規定準用之。</p>	<p>截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司或創新板上市公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上櫃公開承銷之用，故不適用左列之規定。</p>

綜上所述，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件符合中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，本承銷商本次輔導該公司辦理現金增資發行新股亦將依自律規則之規定辦理。

四、法令之遵循及對公司營運影響

(一)發行人是否符合公司法第一百二十九條、第一百三十條、第一百五十六條第五項、第一百六十七條第三項及第四項、第二百四十六條、第二百四十七條及證券交易法第二十八條之四規定，且無公司法第二百四十九條及第二百五十條、第二百六十九條及第二百七十條規定之情事

法令	是否符合規定	評估依據
<p>公司法第 129 條： 發起人應以全體之同意訂立章程，載明下列各款事項，並簽名或蓋章： 一、公司名稱。 二、所營事業。 三、採行票面金額股者，股份總數及每股金額；採行無票面金額股者，股份總數。 四、本公司所在地。 五、董事及監察人之人數及任期。 六、訂立章程之年、月、日。</p>	是	經檢視該公司之公司章程，業已於章程明訂左列各款事項。
<p>公司法第 130 條： 下列各款事項，非經載明於章程者，不生效力： 一、分公司之設立。 二、解散之事由。 三、特別股之種類及其權利義務。 四、發起人所得受之特別利益及受益者之姓名。 前項第四款發起人所得受之特別利益，股東會得修改或撤銷之。但不得侵及發起人既得之利益。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
<p>公司法第 156 條第 5 項： 股東之出資，除現金外，得以對公司所有之貨幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之；其抵充之數額需經董事會決議。</p>	不適用	該公司本次係辦理現金增資發行新股，係以現金出資，故不適用左列之規定。
<p>公司法第 167 條第 3 項及第 4 項： 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或收為質物。 前項控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。</p>	是	經參閱該公司 110~112 年度經會計師查核簽證之財務報告，及最近期之股東名冊，未發現有左列之情事。
<p>公司法第 246 條： 公司經董事會決議後，得募集公司債。但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。 前項決議，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。

法令	是否符合規定	評估依據
<p>公司法第 247 條： 公開發行股票公司之公司債總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債後之餘額。 無擔保公司債之總額，不得逾前項餘額二分之一。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
<p>證券交易法第 28 條之 4： 已依證券交易法發行股票之公司，募集與發行公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，依下列規定辦理，不受公司法第二百四十七條規定之限制： 一、有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百。 二、前款以外之無擔保公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
<p>公司法第 249 條： 公司有下列情形之一者，不得發行無擔保公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結，自了結之日起三年內。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債，應負擔年息總額之百分之一百五十。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
<p>公司法第 250 條： 公司有左列情形之一者，不得發行公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
<p>公司法第 269 條： 公司有左列情形之一者，不得公開發行具有優先權利之特別股： 一、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，不足支付已發行及擬發行之特別股股息者。 二、對於已發行之特別股約定股息，未能按期支付者。</p>	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
<p>公司法第 270 條： 公司有左列情形之一者，不得公開發行新股： 一、最近連續二年有虧損者。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限。</p>	是	該公司 111 年及 112 年度稅後純益分別為 203,415 千元及 228,243 千元，並無最近連續二年有虧損之情事，且經檢視該公司 112 年度經會計師查核簽

法令	是否符合規定	評估依據
二、資產不足抵償債務者。		證之財務報告，資產總額為1,880,714千元，大於負債總額1,147,407千元，尚無資產不足抵償債務之情形，故無違反左列之規定。

綜上，該公司對上述各項應遵循之法令並未有違反情事，故對該公司之營運及本次有價證券之募集與發行應無不利影響。

(二)發行人是否有證券交易法第一百五十六條第一項各款情事

經取具該公司出具之聲明書，參閱該公司存續有效契約、最近三年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會、股東會會議記錄及主管機關往來函文，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之法律事項檢查表，該公司截至評估報告出具日止，並未發現該公司有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列情事。

(三)發行人及其現任董事、監察人、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近三個會計年度至刊印日止繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律事項檢查表，並查詢司法院裁判書系統，該公司於最近三年度及申報年度截至評估報告出具日止，除有下列已結訴訟事件外，並無其他尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟等事件：

李瓊慧主張，該公司勞工林志偉積欠李瓊慧債務並經法院判決確定，李瓊慧遂向法院聲請就林志偉對該公司之薪資債權為強制執行，然因該公司之疏失，未保留應扣押而不應發放予林志偉之薪資，導致李瓊慧之債權未能足額受償，故李瓊慧向臺灣新北地方法院起訴請求該公司賠償其損失 30 萬元。針對前述爭議，雙方於 112 年 8 月 15 日在臺灣新北地方法院板橋簡易庭成立調解，由家碩公司給付李瓊慧 3 萬 3,843 元，李瓊慧則拋棄其餘請求，本案終結。經查，該公司雖有前開已結訴訟案件，惟審酌個案事實及該公司處理結果，尚不致對家碩公司財務業務之正常營運造成重大不利影響。

除該公司之法人董事兼持股比例超過百分之十之股東家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)有下述訴訟案尚於進行中外，其餘董事、總經理及實質負責人均未有繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件之情事，相關評估分析如下：

- 1.家登公司主張，其為中華民國發明第 I238804 號「傳送盒之填充裝置改良」專利(以下簡稱系爭專利)之專利權人，因美國 Entegris, Inc. 在其網站公開展示之型號 A300 晶圓傳送盒(以下簡稱系爭產品)，經家登公司比對發現系爭產品已落入系爭專利請求項 1、4、5、8、9 之文義及均等範圍。因此，Entegris, Inc.、其子公司、負責臺

灣地區銷售業務之人及實質負責人等七人生產、製造、販賣系爭產品即屬侵害原告專利權之行為。故家登公司遂向智慧財產及商業法院起訴請求 Entegris, Inc. 等七人不得自行或委託、授權他人製造、販賣、使用、進口系爭產品及其他侵害系爭專利權之產品，並應銷毀侵害系爭專利權之物及連帶賠償家登公司 1 億元。查本案經智慧財產及商業法院審理後，因認系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義或均等範圍，故判決駁回家登公司之全部請求。家登公司不服已提出上訴，故本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院第二審審理中，迄未終結。

2. Entegris, Inc. 基於與前款相同之原因事實，主張系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義及均等範圍，且系爭專利有得撤銷事由，亦向智慧財產及商業法院起訴請求確認家登公司基於系爭專利，對於 Entegris, Inc. 系爭產品之防止侵害請求權、排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。查本案經智慧財產及商業法院審理後，因認系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義及均等範圍，故判決確認家登公司之前述請求權均不存在。家登公司不服已提出上訴，故本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院第二審審理中，迄未終結。

3. 美國 Entegris, Inc. 主張，家登公司未經授權製造「300 Diffuser FOUP」前開式晶圓傳送盒，侵害其中華民國發明第 I606534 號或 I515159 號發明專利，故向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求家登公司賠償 3,000 萬元等。查家登公司於 112 年 9 月 12 日收受本案起訴狀繕本後，已委託律師處理後續訴訟程序，本案目前仍繫屬於智慧財產及商業法院審理中，迄未終結。

4. 家登公司前羅姓勞工主張，其於上班期間發生車禍，發生職業災害，故起訴請求家登公司應補足職災期間(即 109 年 9 月至 111 年 9 月，共二年)原領工資差額及未足額提繳之勞工退休金共 463 千元。又因羅姓勞工前述職災事件經勞工局核定職災期間為 7 個月，非二年，故家登公司亦於 112 年 7 月依民法 179 條不當得利規定，就家登公司先前多給付之 1 年 5 個月工資補償計 902 千元提起反訴。經查，本案目前尚在法院審理中，迄未終結。

綜上評估，該公司法人董事兼持股比例超過百分之十之股東家登公司雖有上開已結及繫屬中訴訟事件，惟考量所涉個案事實皆與該公司無關，且前述事件並無礙家登公司遂行其法人董事職務，故前述訴訟事件對該公司財務業務之正常營運應無重大影響。

(四)發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近三個會計年度至刊印日止是否經法院判決有期徒刑以上之罪者

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律事項檢查表、該公司最近三年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告及主管機關往來函文，該公司或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近三年度至本評估報告刊印日止，並無經法院判決有期徒刑以上之罪情事。

(五)發行人及其各子公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

該公司最近年度及截至申請時仍有效存續及締結之重要契約條款如下表：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合同	永豐商業銀行	112.11.08-113.08.31	短期借款額度 新臺幣 80,000 千元	無
借款合同	元大商業銀行	112.11.08-113.11.07	短期借款額度 新臺幣 50,000 千元	無
借款合同	台北富邦商業銀行	113.03.22-113.12.29	短期借款額度 新臺幣 100,000 千元	無
租賃合約	家登精密工業(股)公司	112.01.01-116.12.31	台南廠區租賃(I)	無
租賃合約	家登精密工業(股)公司	112.01.01-116.12.31	台南廠區租賃(II)	無
租賃合約	家登精密工業(股)公司	113.01.01-113.12.31	新北辦公室租賃	無
租賃合約	財團法人褒忠亭義民中學財團	111.12.01-117.12.31	竹北辦公室租賃(I)	無
租賃合約	財團法人褒忠亭義民中學財團	112.01.01-117.12.31	竹北辦公室租賃(II)	無
租賃合約	東捷科技(股)公司	112.02.01-113.01.31	外倉租賃	無
租賃合約	靄歲科技(股)公司	112.07.01-115.06.30	外倉租賃	無
租賃合約	林 OO	112.05.18-115.05.17	外倉租賃	無

該公司重要契約皆為其基於公司正常營運所需而簽訂，經查閱契約內容，無影響投資人權益之情事。

(六)發行人及其各子公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律事項檢查表，查閱該公司與主管機關之往來函文，另並取得該公司出具之聲明書，該公司截至評估報告出具日止，尚無有重大勞資糾紛或污染環境事件。

(七)發行人之資金用途須經目的事業主管機關同意者，其核准之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券之情事

該公司本次籌資計畫之資金用途並無需經目的事業主管機關同意，故對本次募集與發行應無重大影響之情事。

(八)承銷商因前項之評估需求，若有洽請律師出具意見者，應說明事項。

本次並無洽請律師對前項評估出具意見，故不適用。

五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師未具有下列事項

(一)於最近一年內曾受法務部律師懲戒委員會懲戒

(二)與發行人、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有下列關係之一：

- 1.依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。
- 2.其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營

者。

經取具翰辰法律事務所邱雅文律師出具之聲明書，其於最近一年內未曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且未與該公司、最近期財務報告簽證會計師及本承銷商間具有主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係，或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者之關係。

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

本證券承銷商業依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定查核，所獲致之結論如下：

一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性

(一)本次計畫內容

1. 本次計畫所需資金總額：新臺幣 584,155 千元。

2. 本次計畫資金來源

現金增資發行新股 2,717 千股，每股面額 10 元，每股發行價格暫定為新臺幣 215 元，共可募集資金總額為新臺幣 584,155 千元。如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金支應；惟若實際募集金額高於預計募集金額時，增加部份將全數用以充實營運資金。

3. 計畫項目及預訂資金運用進度

單位：新臺幣千元

計畫項目	預計完成時間	所需資金總額	預定資金運用時間
			113 年第二季
充實營運資金	113 年第二季	584,155	584,155

資料來源：該公司提供

4. 預計可能產生效益

該公司本次籌資計畫中之 584,155 千元將用以充實營運資金，有助於提升資金運用調度彈性，健全公司財務結構，並強化公司長期競爭力。

(二)本次計畫之可行性評估

1. 於法定程序上之可行性

該公司本次辦理上櫃前現金增資發行普通股計畫，業經 112 年 4 月 14 日董事會及 112 年 5 月 31 日股東會決議通過辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷案，並於 113 年 3 月 26 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，且授權董事長全權處理相關增資事宜。經查與「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令規定並無不符，並經律師對本次募集現金增資計畫之內容出具法律事項檢查表，顯示本次現金增資發行普通股計畫確已

符合相關法令之規定，故該公司本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

2. 資金募集完成之可行性

該公司本次現金增資發行新股 2,717 千股，其中依公司法第二百六十七條規定保留百分之十五，計 407 千股由員工認購，餘 2,310 千股則依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」之規定，以現金增資發行新股方式委託證券商承銷商辦理上櫃前公開銷售，並按證券交易法第二十八條之一規定，於 112 年 5 月 31 日股東會決議通過，排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用。

該公司本次辦理現金增資發行新股預計採部份競價拍賣，部份公開申購方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，將授權董事長按發行價格洽特定人認購之，而對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故該公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

3. 資金運用計畫之可行性

該公司本次現金增資募集金額，考量主管機關審核與承銷作業時程，預計於 113 年第二季完成 584,155 千元資金募集後，將全數用於充實營運資金，可望強化該公司之財務結構，提升資金靈活調度之彈性，藉以提升競爭力及降低企業經營風險，故本次增資用於充實營運資金之計畫應屬可行。

(三) 本次計畫之必要性

該公司本次辦理現金增資發行新股係依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」規定，以現金增資發行新股方式委託證券商承銷商辦理上櫃前公開承銷，故本次辦理現金增資發行新股係配合主管機關初次上櫃新股承銷制度予以辦理，實有其必要性。

(四) 本次計畫之合理性評估

1. 資金運用計畫及預計進度之合理性

單位：新臺幣千元

計畫項目	預計完成時間	所需資金總額	預定資金運用時間
			113 年第二季
充實營運資金	113 年第二季	584,155	584,155

資料來源：該公司提供

該公司本次辦理現金增資發行新股係作為辦理初次上櫃前公開銷售之用，募得之資金將用於充實營運資金，本次增資計畫之運用進度，將視主管機關審查時間、公開承銷期間及繳款作業時程等因素而定，預計於 113 年第二季收足股款，待資金募集完成後，即用於充實營運資金，透過本次現金增資發行新股，除強化該公司財務結構外，適時挹注營運資金以增加資金靈活運用之彈性，更可有效提升該公司之競爭力，降低營運及財務風險，故本次資金運用計畫及預計進度應屬合理。

2. 預計可能產生效益之合理性

單位：新臺幣千元；%

項目/年度		112年度增資前	增資後
財務結構(%)	負債占資產比率	61.01	46.55
	長期資金占固定資產比率	1,004.44	1,768.43
償債能力(%)	流動比率	153.56	206.06
	速動比率	102.36	154.86

資料來源：該公司提供

註：本次籌資後各項財務比率係以 112 年度經會計師查核簽證之財務報告設算

該公司本次辦理現金增資用以充實營運資金，將可增加財務調度靈活性。就財務結構面觀之，該公司預計流動比率及速動比率將由籌資前之 153.56% 及 102.36% 分別提升至 206.06% 及 154.86%，長期資金占不動產、廠房及設備比率則由 1,004.44% 上升至 1,768.43%，而負債比率將由籌資前之 61.01% 降至 46.55%，故對該公司整體營運發展及健全財務結構等面相均有正面助益，故其現增效益尚屬合理。

一之一、總括申報發行新股案件者，應另就下列事項提供評估說明

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估

該公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式辦理初次上櫃前之公開銷售作業，故僅就發行新股對本年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

該公司本次辦理現金增資發行普通股 2,717,000 股，占該公司擬掛牌股本 30,014,600 股之 9.05%，本次增資預計於 113 年第二季募集完成，考量該公司未來整體營運應能維持穩定成長之趨勢，故本次現金增資發行新股對 112 年度每股盈餘稀釋之影響尚屬有限。

三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性

(一) 本次募集與發行有價證券資金計畫用於轉投資者之評估

該公司本次募集與發行有價證券資金計畫並非用於轉投資，故不適用本項評估。

(二) 本次募集與發行有價證券資金計畫用於償債或充實營運資金者之評估

1. 查閱該公司最近一年度財務報告暨申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表，以了解該公司之營業特性、應收帳款收款、應付帳款付款政策、資本支出計畫與前揭現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性，並分析本次增資計畫對發行人資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性。前述現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預期效益

(1) 營業特性

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，屬於半導體前段製程相關設備供應商。該公司主要現金流入為銷貨所產生之應收帳款收現；主要現金支出則為進貨及各項營業費用支出所產生之應付帳款及費用支出。該公司所編製之 113 年度及 114 年度各月份之現金收支預測表，係依據 113 年 1~2 月之實際營運情況為基礎，並參考過往之銷售經驗、公司營運行銷計劃及產業未來發展趨勢等因素作為編製申報年度及未來一年度各月份之收入與支出之依據，故其編製基礎尚屬合理。

(2) 應收帳款收款及應付帳款付款政策

在應收帳款收款政策方面，該公司係根據客戶以往歷史交易情形、營運規模及營運狀況而給予適當之授信額度及收款條件，而該公司所編製之 113 及 114 年度之現金收支預測表，其每月應收款收現數之編製基礎係依據該公司已往每月之實際收款情形，並參酌 113 及 114 年度預估營業收入預算、主要客戶之授信條件，按保守穩健之原則作為推估未來每月應收款項之收現情形，預估 113 及 114 年度應收帳款之收款政策與 112 年度並無明顯差異，故其編製基礎假設應屬合理。

在應付帳款付款政策方面，該公司所編製之 113 及 114 年度現金收支預測表之各月應付款項及費用付款情形，主要係依該公司之付款政策為參考依據，並預估未來之付款條件、薪資等費用作為推估未來每月應付款項付現之基礎，故編製基礎假設應屬合理。

綜上所述，該公司 113 及 114 年度現金流量預測表每月應收帳款收現及應付帳款付現基礎係考量廠商收付款條件、進銷貨需求情形等予以編製，尚無重大異常。

(3) 資本支出計畫

該公司 113 及 114 年度之資本支出計畫係依經營策略及營運發展擬定，主要項目為擴建新廠，113 年 1~2 月之資本支出實際數為 0 千元，113 年 3~12 月及 114 年度預估之資本支出為 768,000 千元。此資本支出計畫主係因應營運所需並依據年度計畫需求進行編製，其資金來源預計以自有資金或銀行借款支應，經評估編製基礎尚屬合理。

(4) 現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性

經核閱該公司編製之 113 及 114 年各月份現金收支預測表，其中 113 年 1~2 月為實際數，113 年 3~12 月及 114 年度為預估數，其預估數係依據該公司未來預計營運狀況，並考量款項收付情形及各項支出等因素按月編製而成，亦核對該公司 113 年之期初現金餘額與 112 年度經會計師查核簽證之財務報表之現金餘額相符，另本次籌資款項之預計現金流入及資金運用進度與本次籌資計畫一致。整體而言，該公司申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編製基礎尚屬合理。

另該公司並未對外公布財務預測，故不適用現金收支與財務預測關聯性之評估。

(5) 本次增資計畫對發行人資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性及合理性

該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上櫃前公開承銷案件，故不適用必要性之評估。

就該公司編製 113 及 114 年度各月份之現金收支預測表觀之，該公司考量未來業績成長所需之營運資金將增加，並為強化財務結構，故本次現金增資計畫係用於充實營運資金，以提升財務調度靈活性，藉以增加其競爭力及降低企業財務風險。此外，為配合承銷制度之規定，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，故該公司本次增資計畫有其必要性及合理性。

(6) 現金收支預測中，未來如有重大資本支出及長期投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

經檢視該公司編製之 113 年度及 114 年度之現金收支預測表，113 年 1~2 月為實際數，113 年 3~12 月及 114 年度預計投入之資本支出金額為 768,000 千元，主係計畫用於興建廠房，該資本支出已逾本次募集資金 584,155 千元之百分之六十(350,493 千元)。有關未來重大資本支出及長期股權投資之資金來源、用途及預計效益，請參閱本評估報告「參、二、(四)」之說明。

113 年度各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣千元

	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	953,785	904,138	944,240	935,082	830,420	1,443,316	1,472,057	1,488,298	1,517,039	1,545,780	1,562,021	1,590,762	953,785
加：非融資性收入													
應收款項收現	34,569	87,705	111,281	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	111,280	1,235,075
其他收入	7,640	5,537	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	17,677
收入合計(2)	42,209	93,242	111,731	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	111,730	1,252,752
減：非融資性支出													
應付款項付現	48,892	39,127	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	57,695	664,969
薪資付現	35,533	8,903	12,000	24,564	14,000	14,000	26,500	14,000	14,000	14,000	26,500	14,000	218,000
不動產、廠房及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,000	192,000
其他	7,431	5,110	51,194	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	11,294	165,381
支出合計(3)	91,856	53,140	120,889	93,553	82,989	82,989	95,489	82,989	82,989	95,489	82,989	274,989	1,240,350
要求最低現金餘額(4)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	391,856	353,140	420,889	393,553	382,989	382,989	395,489	382,989	382,989	395,489	382,989	574,989	1,540,350
融資前可供支用現金剩餘 (短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	604,138	644,240	635,082	653,259	559,161	1,172,057	1,188,298	1,217,039	1,245,780	1,262,021	1,290,762	1,127,503	666,187
加：融資淨額													
發行新股	-	-	-	-	584,155	-	-	-	-	-	-	-	584,155
借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,000	96,000
支付股利	-	-	-	(122,839)	-	-	-	-	-	-	-	-	(122,839)
融資合計(7)	-	-	-	(122,839)	584,155	-	-	-	-	-	-	96,000	557,316
期末現金餘額(8)=(1)+(2)- (3)+(7)	904,138	944,240	935,082	830,420	1,443,316	1,472,057	1,488,298	1,517,039	1,545,780	1,562,021	1,590,762	1,523,503	1,523,503

114 年度各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣千元

	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	1,523,503	1,516,169	1,547,255	1,506,341	1,349,861	1,380,947	1,340,033	1,358,619	1,389,705	1,348,791	1,367,377	1,398,463	1,523,503
加：非融資性收入													
應收款項收現	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	119,624	1,435,488
其他收入	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
收入合計(2)	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	120,074	1,440,888
減：非融資性支出													
應付款項付現	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	63,726	764,712
薪資付現	51,380	12,960	12,960	25,460	12,960	12,960	25,460	12,960	12,960	25,460	12,960	12,960	231,440
不動產、廠房及設備	-	-	144,000	-	-	144,000	-	-	144,000	-	-	144,000	576,000
其他	12,302	12,302	12,302	52,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	12,302	187,624
支出合計(3)	127,408	88,988	232,988	141,488	88,988	232,988	101,488	88,988	232,988	101,488	88,988	232,988	1,759,776
要求最低現金餘額(4)	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	427,408	388,988	532,988	441,488	388,988	532,988	401,488	388,988	532,988	401,488	388,988	532,988	2,059,776
融資前可供支用現金剩餘 (短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	1,216,169	1,247,255	1,134,341	1,184,927	1,080,947	968,033	1,058,619	1,089,705	976,791	1,067,377	1,098,463	985,549	904,615
加：融資淨額													
借款	-	-	72,000	-	-	72,000	-	-	72,000	-	-	72,000	288,000
償債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(96,000)	(96,000)
支付股利	-	-	-	(135,066)	-	-	-	-	-	-	-	-	(135,066)
融資合計(7)	-	-	72,000	(135,066)	-	72,000	-	-	72,000	-	-	(24,000)	56,934
期末現金餘額 (8)=(1)+(2)-(3)+(7)	1,516,169	1,547,255	1,506,341	1,349,861	1,380,947	1,340,033	1,358,619	1,389,705	1,348,791	1,367,377	1,398,463	1,261,549	1,261,549

2.就對發行人申報年度財務槓桿、負債比率(或自有資產與風險性資產比率)、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋等相關影響，了解本次增資計畫之必要性及合理性

該公司本次係辦理現金增資發行新股作為初次上櫃前公開承銷案件，故不適用必要性之評估。

單位：新臺幣千元；%

項目/年度	111年度	112年度
財務槓桿度(倍)	1.00	1.00
負債比率(%)	66.73	61.01
營業收入淨額	1,047,953	1,207,145
稅後淨利	255,358	277,315
基本每股盈餘(元)	11.91	8.36

資料來源：該公司提供

(1)財務槓桿度及負債比率

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險，評估利息費用之變動對於營業利益影響之程度，該項指標數值愈高，表示公司所承擔之財務風險愈大。該公司111~112年度之財務槓桿度皆為1.00倍，其數值顯示該公司之財務風險控管尚屬穩健，惟該公司為持續拓展事業版圖，為能保持正常營運資金所需，實有必要規劃長期而穩定之資金來源，故本次現金增資發行新股用以充實營運資金，將有助於降低該公司未來經營風險。

負債比率係用以衡量公司財務結構與財務風險，該公司111~112年度之負債比率分別為66.73%及61.01%，預計本次辦理現金增資發行新股充實營運資金後，負債比率將可降低至46.55%，除可降低該公司財務負擔及增加資金調度之彈性，亦可提升償債能力及改善財務結構，進一步鞏固並加深該公司之獲利能力，對於強化財務結構及降低營運風險均有正面之助益。

(2)營業收入及獲利能力

該公司111~112年度之營業收入淨額分別為1,047,953千元及1,207,145千元，稅後淨利分別為255,358千元及277,315千元，在該公司營運規模持續成長下，本次現金增資發行新股充實營運資金，除可提升股東權益外，亦可強化該公司財務結構，預期將對該公司營運之持續成長有所幫助。

(3)每股盈餘稀釋

該公司本次辦理現金增資發行新股係委託本承銷商辦理初次上櫃前之公開銷售，預計於113年第二季募集完成；本次辦理現金增資預計發行新股之股數為2,717,000股，占該公司現金增資後股份總數30,014,600股之9.05%，惟考量該公司未來整體營運應能呈成長趨勢，故本次辦理現金增資發行新股對該公司每股盈餘稀釋影響應屬有限。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資對113年度及未來年度，在整體營運發展及強化財務結構方面皆具有正面效益，因此為降低企業經營風險、提升市場競爭力，本次辦理現金增資發行新股用以充實營運資金尚具有合理性。

(三)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於購置營建用地或支付營建工程款者，就預計自購置土地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點與金額，評估可能產生效益是否具有合理性

該公司本次募集資金並非用於購買營建用地或支付營建工程款，故不適用本項評估。

(四)本次增資計畫如用於購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應就其賣方轉讓之理由、受讓價格之依據評估其合理性，並評估其受讓過程是否適法及對契約相對人權利義務之影響

該公司本次募集資金並非用於購買未完工程或承受賣方未履行契約者，故不適用本項評估。

三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性

該公司本次辦理現金增資發行新股係採現金出資方式，故不適用此評估項目。

四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應就下列事項評估其可行性與合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股未併同減資計畫辦理，故不適用此評估項目。

五、以低於票面金額辦理現金發行新股者：應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響

該公司本次辦理現金增資發行新股係以溢價發行，故不適用此評估項目。

六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，是否已評估下列事項

(一)已上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股原股東未放棄優先認股，採公開申購配售方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性

該公司為申請股票初次上櫃公司，且已於112年5月31日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，故不適用此評估項目。

(二)已上市(櫃)公司辦理現金增資，經股東會已決議原股東全數放棄優先認購，採全數詢價圈購或競價拍賣方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性。及暫定發行股數區間是否符合公司法第一百二十九條第三款規定之情事

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用此評估項目。

(三)以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件向金管會申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，並敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

1.暫定價格之訂定

該公司於113年3月26日經董事會決議辦理現金增資發行普通股2,717千股，每股面額10元，目前暫定之發行價格為每股新臺幣215元，其係依一般市場承銷價格訂定方式，參考本益比、股價淨值比等股價評價方法以及該公司近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據；再參酌該公司所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況，以及考量初次上櫃股票流動性風險貼水等因素後，由本承銷商與該公司共同議定之。而實際每股發行價格待主管機關核准後，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，並依該公司實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，與該公司另行議定上櫃掛牌承銷價格。

2.募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途、預計效益，其適法性及合理性

該公司本次現金增資計畫相關之發行價格、發行條件及其他相關事宜，如因主管機關指示或基於客觀環境變更而需修正時，業經該公司113年3月26日之董事會決議通過授權該公司董事長全權處理，故本次現金增資於法定程序應屬可行。

若該公司於本案件生效後，實際發行價格低於暫定發行價格，該公司將就其募集之資金不足計畫用途部分擬以自有資金支應。若該公司實際發行價格高於暫定承銷價格，擬將高於原預定募集總金額部分用以充實營運資金，增加其自有資金，以備未來因應營業規模成長而增加之資金需求，並可強化財務結構及提升競爭力與降低經營風險，故本次現金增資實際發行價格如有調增，其所導致募集資金增加時之資金用途及預計效益亦應屬合理。

綜上所述，本次現金增資募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，皆具適法性及合理性。

(四)公司債未足額發行者，需就募集資金不足時之處理方式之合理性予以說明

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

七、發行人申報發行人人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

陸之一、是否確實依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項

該公司本次辦理初次上櫃前現金增資發行新股案件，本承銷商已將該公司辦理永續發展相關事項納入輔導評估流程，該公司業已依規定於公開說明書揭露推動永續發展相關事項。

柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論
無。

拾肆、於公開說明書刊印日期，如有重大期後事項，亦應查明本要點個相關事項並加以更新說明與評估

無。

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司



負責人：陳修偉



中華民國 113 年 3 月 27 日

(僅供家碩科技股份有限公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股證券承銷商評估報告使用)

附件十八

承銷價格計算書

家碩科技股份有限公司
承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

(一)已發行股份總數

家碩科技股份有限公司(以下簡稱家碩科技或該公司)股票初次申請上櫃時之實收資本額為新臺幣 272,976 千元，每股面額新臺幣 10 元整，已發行股數為 27,298 千股。該公司擬於股票初次申請上櫃案經主管機關審查通過後，預計辦理現金增資發行新股 2,717 千股，扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，全數委託證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，預計股票上櫃掛牌時股數為 30,015 千股，實收資本額為 300,146 千元。

(二)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第 2 條規定，公開發行公司初次申請股票上櫃時，至少應提出擬上櫃股份總額百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售。但應提出承銷之股數超過二千萬股以上者，得以不低於二千萬股之股數辦理公開銷售。另若公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷總股數之百分之三十。

(三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦證券承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度內，提供已發行普通股股票供主辦證券承銷商辦理過額配售；惟主辦證券承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)依據該公司 113 年 3 月 24 日之股東名冊，記名股東人數共計 1,239 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東為 1,228 人，其所持有股份合計為 9,513,006 股，占已發行股份總額之 34.85%，已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第三條有關股權分散之標準。

(五)綜上所述，該公司依規定預計辦理現金增資發行新股 2,717 千股，扣除依公司法規定保留百分之十五予員工優先認購之 407 千股後，餘 2,310 千股依據「證券交易法」第二十八之一條規定，經 112 年 5 月 31 日股東臨時會決議通過由原股東全數放棄認購以辦理上櫃前公開承銷作業，排除公司法第 267 條第三項原股東優先認購之適用。該公司本次提出公開承銷股數 2,310 千股，加計興櫃徵提可扣除股數 693 千股，合計 3,003 千股已高於擬上櫃股份總額 30,015 千股之 10%，符合前揭規定。

二、具體說明申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

目前證券投資分析較常使用之股票價值評價方法主要包括市場法與成本法及收益法。各種方法皆有其優缺點，且採用方法不同，評估結果亦有所差異。其中，市場法包括本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)及股價淨值比法(Price/Book value ratio, P/B ratio)，皆係透過已公開的資訊，與整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，進行公司價值評估，再依被評價公司與採樣公司之差異，進行折溢價調整，作成公司價值之結論；成本法主係為淨值法，並以帳面歷史成本作為公司價值之評估基礎；收益法主係以未來利益流量(如：現金流量...等)作為公司價值之評估基礎。茲將市場法、成本法及收益法等計算方式、優缺點與適用時機整理列示如下：

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與同業公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，據以評估企業整體價值。
優點	<ol style="list-style-type: none"> 1.最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2.所估算之價值與市場的股價較接近。 3.較能反映市場、研判多空氣氛及投資價值認定。 4.市場價格資料容易取得。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.淨值係長期且穩定之指標。 2.當盈餘為負數時之替代評估方法。 3.市場價格資料容易取得。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.評估資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同而影響。 3.反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
缺點	1.盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3.企業盈餘為負數時不適用。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。 3.不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較為困難。	1.使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。
適用時機	1.企業生命週期屬成長型公司。 2.獲利型公司。	1.有鉅額資產但股價偏低的公司。 2.獲利波動幅度較大之公司。	1.適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。 2.虧損或營運衰退型公司。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

上述股價評價之各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦多有差異，其中因現金流量折現法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數之參考價值相對較低下，國內實務上較少採用此方法。因此，以市場法做為股價評價之基礎。

2.承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1)採樣同業之選擇

該公司及其子公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，屬於半導體前段製程相關設備供應商。綜觀目前國內上市、上櫃及興櫃公司，就營業項目、業務型態及市場定位等因素綜合考量，選擇京鼎精密科技股份有限公司(以下簡稱京鼎公司，股票代碼 3413，上市半導體業)、華景電通股份有限公司(以下簡稱華景電公司，股票代碼 6788，上櫃半導體業)、天虹科技股份有限公司(以下簡稱天虹公司，股票代碼 6937，上市半導體業)作為採樣同業。京鼎公司主要營業項目為先進設備設計及製造，其產品主要應用在半導體產業、面板產業及光電產業等，在半導體產業部分，其設備用途包含半導體前段晶圓製造之薄膜、蝕刻、化學機械研磨等製程所需之設備、晶圓傳輸自動化設備、微污染防治及惰性氣體充填裝置及晶圓外觀自動檢查設備；華景電公司主要營業項目為晶圓製程微粒子或氣態分子污染物(AMC)微污染防治設備、晶圓盒承載裝置無線射頻辨識(RFID)整合派工系統及其他等；天虹公司主要營業項目為半導體設備及相關零組件之技術與研發、製造、維修及銷售業務等。因上述公司與該公司之主要產品較類似，故選擇這三家作為採樣公司，並進行下列分析：

(2)市場法

A.該公司財務資料

單位：新臺幣千元

項目	110 年度	111 年度	112 年度
本期淨利	67,532	203,415	228,243
權益總額	213,116	550,569	733,307
擬上櫃掛牌股數			30,015
每股盈餘(元)(註)	2.25	6.78	7.60
每股淨值(元)(註)	7.10	18.34	24.43

資料來源：各期經會計師查核簽證之財務報告。

註：每股盈餘及每股淨值係以擬上櫃掛牌股數追溯調整計算。

B.本益比法

單位：新臺幣元

公司	期間	每股盈餘(註)	平均收盤價	平均本益比(倍)
京鼎 (3413)	113 年 1 月	20.48	210.11	10.26
	113 年 2 月		231.65	11.31
	113 年 3 月		273.00	13.33
華景電 (6788)	113 年 1 月	7.82	127.20	16.27
	113 年 2 月		138.54	17.72
	113 年 3 月		137.67	17.61
天虹 (6937)	113 年 1 月	4.54	203.52	44.78
	113 年 2 月		205.31	45.18
	113 年 3 月		210.31	46.28
上市公司 -半導體業	113 年 1 月	—	—	19.54
	113 年 2 月		—	22.74
	113 年 3 月		—	24.90
上櫃公司 -半導體業	113 年 1 月	—	—	29.51
	113 年 2 月		—	30.77
	113 年 3 月		—	29.77

資料來源：臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站及公開資訊觀測站

註：每股盈餘係以 112 年度稅後純益除以 112 年 12 月 31 日之股本計算

該公司採樣同業及上市櫃「半導體」類股最近三個月(113 年 1 月~3 月)之平均本益比區間介於 10.26 ~ 46.28 倍之間，然為避免取樣區間受極端值之影響，剔除京鼎及天虹，排除極端值後建構取樣之本益比區間約介於 16.27~30.77 倍，若以該公司 112 年度之每股盈餘約為 7.60 元(稅後純益除以擬上櫃掛牌股數)，按上述本益比區間計算，參考價格區間介於 123.65~233.85 元，考量該公司經營績效、獲利情形、財務結構、產業未來發展前景、興櫃市場近期股價及流動性不足之風險予以折價後，該公司此次上櫃與本證券承銷商議定之承銷價格每股新臺幣 216.80 元尚屬合理。

C. 股價淨值比法

單位：新臺幣元

公司	期間	最近期財報 每股淨值(註 2)	平均收盤價	平均股價 淨值比(倍)
京鼎 (3413)	113 年 1 月	119.38	210.11	1.76
	113 年 2 月		231.65	1.94
	113 年 3 月		273.00	2.29
華景電 (6788)	113 年 1 月	45.70	127.20	2.78
	113 年 2 月		138.54	3.03
	113 年 3 月		137.67	3.01
天虹 (6937)	113 年 1 月	46.32	203.52	4.39
	113 年 2 月		205.31	4.43
	113 年 3 月		210.31	4.54
上市公司 -半導體	113 年 1 月	—	—	4.05
	113 年 2 月		—	4.35
	113 年 3 月		—	4.76
上櫃公司 -半導體	113 年 1 月	—	—	3.66
	113 年 2 月		—	3.65
	113 年 3 月		—	3.69

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站

註 1：平均股價淨值比=平均收盤價/每股淨值

註 2：每股淨值係以 112 年 12 月 31 日歸屬於母公司業主之權益除以之股本計算

註 3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算

該公司採樣同業及上市櫃「半導體」類股最近三個月之平均股價淨值比介於 1.76~4.76 倍，以該公司擬以掛牌股數 30,015 千股計算之每股淨值 24.43 元為基礎計算，價格區間約為 43.00~116.29 元；惟股價淨值比法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本證券承銷商不擬採用此法作為議定承銷價格參考之依據。

(3) 成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等。其中，股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總和扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業價值，同時成本法使用上的限制有下列四項，因此國際上慣用成本法以評估企業價值者並不多見：

A. 無法表達目前真正及外來之經濟貢獻值。

- B.忽略了技術經濟壽命。
- C.技術廢舊及變革對於其所造成之風險無法預測。
- D.成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，且該公司 112 年 12 月 31 日經會計師核閱之歸屬母公司業主權益 733,307 千元及擬以掛牌股數 30,015 千股計算之每股淨值為 24.43 元，與興櫃市場交易價格差異甚大，且成本法並未考量公司成長性，較常用於評估傳統產業類股或衰退型公司，因此本證券承銷商不擬採用此種方法作為承銷價格訂定之參考依據。

(4)收益法-現金流量折現法

收益法係以公司預估未來產生之現金流量折現總和合計數認定為股東權益價值。由於未來之現金流量無法精確掌握，需推估公司未來數年之獲利及現金流量作為評價之基礎，然而預測期間長，在未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握情況下，不確定性風險相對高，亦不能合理評估公司應有之價值，故不擬採用收益法。

綜上所述，考量該公司產品市場定位、產業未來發展前景及發行市場環境等因素後，本推薦證券商經評估為能計算合理、客觀及具市場性之承銷價格，決定採以市場法中之本益比法作為該公司上櫃申請之承銷價格計算依據。

(二)申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

茲就該公司與採樣同業公司京鼎、華景電及天虹之財務狀況、獲利情形及本益比之比較分析列示如下：

單位：%；次；每股元

項目	年度 公司	110 年度	111 年度	112 年度
		家碩	78.23	66.73
負債占資產比率(%)	京鼎	46.94	44.99	40.10
	華景電	21.30	32.79	34.18
	天虹	51.66	37.74	25.54
	同業	50.50	46.50	註 3
	家碩	1,717.71	3,706.17	1,004.44
長期資金占不動產、 廠房及設備比率(%)	京鼎	502.92	366.86	418.77
	華景電	668.98	305.06	296.67
	天虹	189.17	291.17	316.54
	同業	216.45	226.24	註 3

項目		年度	110 年度	111 年度	112 年度
		公司			
償債能力	流動比率(%)	家碩	120.40	145.67	153.56
		京鼎	285.58	220.98	405.07
		華景電	501.35	341.43	308.82
		天虹	167.12	260.61	494.37
		同業	187.10	224.60	註 3
	速動比率(%)	家碩	58.81	84.65	102.36
		京鼎	209.60	161.20	324.85
		華景電	357.67	249.66	212.62
		天虹	76.12	127.04	285.63
		同業	125.00	148.80	註 3
	利息保障倍數(倍)	家碩	778.44	1,838.11	379.33
		京鼎	74.19	74.04	61.49
		華景電	299.17	185.83	75.81
		天虹	8.56	35.16	44.83
		同業	3,644.80	3,730.60	註 3
經營能力	應收款項週轉率(次)	家碩	8.34	5.79	5.62
		京鼎	9.24	11.06	14.80
		華景電	7.32	7.51	6.39
		天虹	6.44	4.88	4.32
		同業	4.70	4.80	註 3
	應收款項收現天數(天)	家碩	44	64	65
		京鼎	40	34	25
		華景電	50	49	58
		天虹	57	75	85
		同業	78	77	註 3
	存貨週轉率(次)	家碩	1.08	1.12	1.04
		京鼎	3.90	3.06	2.93
		華景電	1.62	1.42	1.18
		天虹	1.13	0.99	0.95
		同業	2.80	2.40	註 3
平均售貨天數(天)	家碩	338	326	351	
	京鼎	94	120	125	
	華景電	225	257	309	
	天虹	324	369	385	
	同業	131	153	註 3	

項目		年度	110 年度	111 年度	112 年度
		公司			
經營能力	不動產、廠房及設備週轉率(次)	家碩	47.63	75.32	26.28
		京鼎	6.92	5.33	3.57
		華景電	5.33	3.41	2.21
		天虹	2.15	2.48	2.14
		同業	3.50	3.10	註 3
	總資產週轉率(次)	家碩	0.75	0.80	0.68
		京鼎	0.95	0.88	0.67
		華景電	0.78	0.68	0.57
		天虹	0.71	0.70	0.56
		同業	0.60	0.60	註 3
獲利能力	資產報酬率(%)	家碩	8.38	15.45	12.94
		京鼎	11.99	14.03	10.36
		華景電	16.45	16.94	11.30
		天虹	10.75	12.61	8.81
		同業	4.60	6.40	註 3
	權益報酬率(%)	家碩	37.65	53.27	35.56
		京鼎	23.29	25.54	17.75
		華景電	21.29	23.35	16.76
		天虹	28.97	21.79	12.33
		同業	7.20	11.00	註 3
	營業利益占實收資本額比率(%)	家碩	102.54	107.42	95.26
		京鼎	226.19	304.07	208.88
		華景電	84.70	125.16	104.14
		天虹	35.00	47.52	47.81
		同業	註 1	註 1	註 1
	稅前純益占實收資本額比率(%)	家碩	82.39	113.19	101.59
		京鼎	217.80	297.85	258.52
		華景電	86.00	128.86	104.62
		天虹	44.34	60.40	54.03
		同業	註 1	註 1	註 1
純益率(%)	家碩	11.22	19.41	18.91	
	京鼎	12.40	15.79	15.25	
	華景電	21.08	24.67	19.56	
	天虹	13.57	17.45	15.39	
	同業	6.10	10.20	註 3	

項目		年度	110 年度	111 年度	112 年度
		公司			
獲利能力	每股盈餘(元)	家碩(註 4)	3.37	9.84	8.36
		京鼎	17.01	24.64	20.48
		華景電	7.08	10.08	7.82
		天虹	4.57	5.66	5.02
		同業	註 1	註 1	註 1

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率、每股稅後盈餘及現金流量允當比率

註 2：應收款項週轉率及存貨週轉率係以總額計算；應收款項收現天數及平均售貨天數係以無條件進位計算

註 3：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版該年度之主要行業財務比率

註 4：該公司計算每股盈餘時，業已追溯調整無償配股之影響

1.財務結構

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 110~112 年度之負債占資產比率分別為 78.23%、66.73% 及 61.01%。111 年度因該公司辦理現金增資、業績持續成長及訂單需求旺盛致應收帳款及存貨上升，使 111 年度現金及約當現金及應收帳款大幅增加，致 111 年度負債占資產比率較 110 年度大幅下降；112 年度因業績持續成長，現金及約當現金大幅增加，致 112 年度負債占資產比率較 111 年度下降，經評估該公司及其子公司之負債占資產比率變化應無異常之情事。

與採樣公司及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度負債占資產比率皆高於其他採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，加上該公司之股本相較其他採樣同業為低(以 112 年度而言，該公司股本 272,976 千元，採樣同業京鼎公司、華景電公司及天虹公司之股本分別為 971,861 千元、347,397 千元及 674,773 千元)，致負債占資產比率占比較採樣同業高，惟該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司及其子公司未有資金無法支應營運活動或對財務造成重大影響之情形，經評估尚無重大異常情事。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 110~112 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率為 1,717.71%、3,706.17%及 1,004.44%。該公司 111 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 110 年度上升，主要係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求提升，使該公司及其子公司之營運及獲利持續成長，且該公司於 111 年度辦理現金增資，股東權益逐年增加所致；112 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率大幅降低，主要係因該公司於 112 年度因研發所需，增加機器設備所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率皆高於其他採樣同業及同業平均，且該等比率大於 100%，顯示該公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之財務結構各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

2.償債能力

(1)流動比率及速動比率

該公司及其子公司 110~112 年度之流動比率分別為 120.40%、145.67%及 153.56%，速動比率分別為 58.81%、84.65%及 102.36%，其流動比率及速動比率皆呈現上升之趨勢，主係雖過去幾年度因疫情造成的區域封鎖、區域衝突及地緣政治的緊張局勢，嚴重擾亂了全球供應鏈，惟來自 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等相關應用產業之發展趨勢，仍使得長期半導體需求結構呈現持續增長，該公司及其子公司在配合客戶擴充產能及建廠規劃之需求情況下，最近三年度之營運規模及獲利呈現持續成長之趨勢，且該公司於 111 年度辦理現金增資，致其流動資產與速動資產均較各年度前期持續增加，致使流動比率及速動比率逐期上升。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之流動比率與速動比率皆低於採樣同業及同業平均，主要係因該公司及其子公司之設備銷售係依客戶訂單購料生產，近年隨著因 5G、高效能運算(HPC)、車用電子及人工智慧(AI)等產業需求強勁，使半導體代工業者持續擴充產能，連代推升半導體設備需求增加，故使該公司及其子公司之營業規模逐年成長，且因該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故因預收貨款產生之合約負債伴隨營業規模擴大而逐年增加，使流動負債大幅增加所致；另該公司及其子公司之主要客戶均為國內外半導體大廠，雙方長期合作而有穩定訂單來源，且主要負債係來自預收客戶貨款，將於交機驗收後認列營業收入，目前該公司與其子公司帳上仍有充裕之流動資金可供營運使用，亦與銀行簽訂授信合約供營運週轉，並無資金不足或有財務困難的情形。整體而言，該公司

及其子公司之財務與營運狀況皆屬穩健，且應收款項收現情況良好，經評估其短期償債能力尚無重大異常情事。

(2)利息保障倍數

該公司及其子公司 110~112 年度之利息保障倍數分別為 778.44 倍、1,838.11 倍及 379.33 倍。111 年度利息保障倍數較 110 年度大幅上升，主係因該公司營運成長，稅前淨利增加所致；112 年度較 111 年度大幅下降，主係因 111 年底新增新竹辦公室及 112 年度新增臺南及臺中倉儲租賃，租賃負債利息費用增加所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之利息保障倍數均優於採樣同業，低於同業平均，該公司及其子公司之利息保障倍數主要係受租賃負債利息費用及稅前淨利變動影響，經評估該公司及其子公司因營運獲利穩定而償債能力尚屬穩健，整體而言尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

3.經營能力

(1)應收款項週轉率

該公司及其子公司 110~112 年度之應收款項週轉率分別為 8.34 次、5.79 次及 5.62 次，應收款項收現天數分別為 44 天、64 天及 65 天，介於收款條件月結 30 天~120 天內，尚無重大異常之情事。該公司及其子公司 111 年度應收帳款週轉率較前一年度下降，主係該公司及其子公司仍因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，致其營業收入持續攀升，期末應收款項隨之增加所致；112 年度應收款項週轉率持續下降，雖該公司 112 年度營業收入較上年度成長 15.19%，惟因 111 年底大量出貨，且今年出貨量持續增加，致平均應收帳款餘額成長 18.51%，應收款項週轉率微幅下降。

與採樣同業及同業平均相較，110~112 年度應收款項週轉率皆介於採樣同業，高於同業平均。該公司及其子公司之往來客戶大多為國內外知名大廠，財務狀況及營運狀況均為穩健，其授信條件與收款情形尚屬合理，且該公司及其子公司定期追蹤應收帳款期後收回情形，整體而言尚無重大異常情事。

(2)存貨週轉率

該公司及其子公司 110~112 年度之存貨週轉率分別為 1.08 次、1.12 次及 1.04 次，平均售貨天數分別為 338 天、326 天及 351 天。111 年度因營運規模持續成長，加上該公司及其子公司所生產之機台設備於出貨後，尚待客戶完成驗收後始得認列營業收入，又其驗收時程受機台設備安裝及客戶驗收測試排程所影響，110 年底已出貨未驗收之機台於 111 年度陸續驗收完畢，致 111 年度營業成本增加幅度大於存貨，致使期末存貨週轉率上升；112 年度較 111 年度存貨

週轉率下降，雖該公司 112 年度營業成本受營業收入成長較去年度成長 4.11%，惟平均存貨受 112 年度期初已出貨未驗收之在製品較多影響，致平均存貨餘額成長 12.23%，存貨週轉率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司存貨週轉率 110 年度低於採樣同業及同業平均；111~112 年度則高於天虹，低於其他採樣同業及同業平均。該公司及其子公司最近三年度持續配合半導體代工業者因擴充廠房及產能之需求，其營業規模及出貨數量逐年成長，惟該公司及其子公司所生產之主要設備係應用於 EUV 及高階光罩製程中，因相關製程皆位於無塵室環境，並需保持光罩之潔淨度免於受到空氣微塵污染及靜電損害，加上相關製程多已自動化，故其客戶對於相關設備彼此間運作之相容性、精密度有極為嚴格之要求，因此該公司及其子公司於機台設備出貨後，尚須待設備安裝及客戶進行驗收測試後，始得認列營業收入，因已出貨尚未驗收之設備造成期末存貨大幅增加，致使存貨週轉率較採樣同業及同業平均為低，惟該公司及其子公司之產品主要係出貨予國際知名晶片製造商，相關設備訂單係依客戶訂單需求而進行採購，且該公司及其子公司於機台設備交機後驗收前將向客戶預收 8 成以上款項，故其存貨尚無可能產生跌價減損或未能去化之情形。經評估該公司及其子公司之存貨週轉率及平均售貨天數變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(3) 不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率

該公司及其子公司 110~112 年度之不動產、廠房及設備週轉率分別為 47.63 次、75.32 次及 26.28 次，總資產週轉率分別為 0.75 次、0.80 次及 0.68 次。111 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 110 年度上升，主要係因該公司及其子公司受半導體產業需求提升，營業收入大幅成長所致；112 年度之不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度大幅下降，主要係因該公司因研發所需，增加機器設備所致。111 年度總資產週轉率較 110 年度略為上升，主要係因 111 年度營業收入大幅成長所致；112 年度之總資產週轉率較 111 年度下降，主要係因該公司及其子公司之現金及約當現金受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且營業收入亦呈上升趨勢，惟平均總資產金額增加幅度較營業收入增加幅度高，致總資產週轉率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110~112 年度之不動產、廠房及設備週轉率均高於採樣同業及同業平均。就總資產週轉率而言，該公司及其子公司 110~111 年度之總資產週轉率介於採樣同業，高於同業平均；112 年度則高於採樣同業，顯示其經營能力與同業相較尚屬良好，整體而言，應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之經營能力各項指標變動尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

4.獲利能力

(1)資產報酬率

該公司及其子公司 110~112 年度之資產報酬率分別為 8.38%、15.45%及 12.94%。111 年度資產報酬率上升主係受半導體產業需求持續提升，該公司及其子公司業績成長，稅後淨利大幅增加所致；112 年度資產報酬率下降，主要係因該公司及其子公司之現金及約當現金受業績成長而增加，雖該公司及其子公司營運狀況穩定且稅後淨利亦呈上升趨勢，惟平均總資產金額增加幅度較稅後淨利增加幅度高，致資產報酬率下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司資產報酬率 110 年度低於採樣同業，高於同業平均；111 年度介於採樣同業，高於同業平均；112 年度高於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之資產運用尚屬得宜，並能創造合理之利潤，經評估其資產報酬率之變化應無重大異常情事。

(2)權益報酬率

該公司及其子公司 110~112 年度之權益報酬率分別為 37.65%、53.27%及 35.56%。111 年度權益報酬率較 110 年度上升，主要係因半導體產業持續擴張，帶動半導體設備需求旺盛，使該公司及其子公司業績成長，稅後淨利增加幅度大於股東權益增加幅度所致；112 年度權益報酬率較 111 年度下降，主要係該公司業績持續成長，惟平均股東權益增加幅度大於稅後淨利增加幅度所致。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司權益報酬率 110~112 年度皆高於採樣同業及同業平均。隨營運規模擴大，該公司及其子公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(3)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 110~112 年度之營業利益占實收資本額比率分別為 102.54%、107.42%及 95.26%；稅前純益占實收資本額比率分別為 82.39%、113.19%及 101.59%。111 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 110 年度上升，主要係該公司及其子公司之營業規模持續受惠於半導體產業需求成長，致營業利益及稅前純益均成長所致；112 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均較 111 年度下降，主要係因該公司 112 年度發放股票股利，實收資本額增加所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 110~112 年度之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率均介於採樣同業，顯示該公司及其子公司獲利能力尚屬良好，整體而言尚應重大異常情事。

(4)純益率及每股稅後盈餘

該公司及其子公司 110~112 年度之純益率分別為 11.22%、19.41%及 18.91%；每股盈餘分別為 3.37 元、9.84 元及 8.36 元。111 年度因半導體產業需求持續擴張，使該公司及其子公司之營業規模及獲利持續增長，致稅後淨利大幅增加，致使純益率及每股盈餘較 110 年度上升；112 年度純益率較 111 年度下降，主要係因該公司及其子公司 112 年度營業費用因人員擴編及投入產品研發增加，稅後淨利增加幅度小於營業收入增加幅度所致，另因該公司於 111 年底現金增資 6,000 千股，致該公司 112 年度加權平均流通在外股數較追溯後 111 年度增加，112 年度每股盈餘較 111 年度些微下降。

與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 110 年度純益率低於採樣同業，高於同業平均；111~112 年度則介於採樣同業，高於同業平均。另就每股盈餘而言，110 年度低於採樣同業；111 年度及 112 年度則介於採樣同業。整體而言，該公司及其子公司之營運仍保持穩定成長之趨勢，最近年度之營運獲利亦持續擴張，經評估其獲利能力應無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之獲利能力尚屬穩定，其獲利能力各項指標變化尚屬合理，經評估其變化應無重大異常情事。

5.本益比

請參閱本承銷價格計算書「二、(一)、2、(2)、B.本益比法」之評估說明。

(三)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本次承銷價格之議訂並無採取專家意見或鑑價報告。

(四)申請公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司於 112 年 6 月 26 日於興櫃市場掛牌，最近一個月(113 年 3 月 26 日~4 月 25 日)之月平均股價及成交量分別為 306.35 元及 3,758,904 股。另經查詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站，該公司自申請上櫃日迄今尚未有財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依「興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第 4 條規定公告為「興櫃公布注意股票」，或依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「興櫃股票買賣辦法」第 11 條之 1 規定暫停交易(啟動興櫃股票市場冷卻機制)之情事，故應無價格波動過大之情事。

(五)推薦證券商就其與申請公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本推薦證券商經參酌國際慣用之市場法下之本益比法評量，承銷價之參考價格區間為 123.65~233.85 元，另該公司最近一個月興櫃股票市場之成交均價為 306.35 元，而該公司初次上櫃前現金增資案之對外募資金額採競價拍賣之方式承銷，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條及第 17 條規定，應以申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成(以 113 年 4 月 16 日往

前推算興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除除息後簡單算數平均數299.71元，故七成為209.79元)為最低承銷價之上限，爰訂定最低承銷價格為188.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格275.01元為之，惟該均價高於最低承銷價格之1.15倍，故承銷價格定為每股新臺幣216.80元溢價發行，尚屬合理。

發行公司：家碩科技股份有限公司



負責人：邱銘乾



中 華 民 國 113 年 4 月 26 日

(僅供家碩科技股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

主辦承銷商：元大證券股份有限公司



負責人：陳修偉



中 華 民 國 113 年 4 月 26 日

(僅供家碩科技股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

協辦承銷商：合作金庫證券股份有限公司



負 責 人：羅瑞燕



中 華 民 國 113 年 4 月 26 日

(僅供家碩科技股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

協辦承銷商：永豐金證券股份有限公司



負責人：朱士廷



中 華 民 國 113 年 4 月 26 日

(僅供家碩科技股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

協辦承銷商：凱基證券股份有限公司



負責人：方維昌



中 華 民 國 1 1 3 年 4 月 26 日

(僅供家碩科技股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

家碩科技股份有限公司



董事長：邱銘乾

